

合肥晶合集成电路股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录

序号	名称	页码
1	发行保荐书	2
2	财务报表及审计报告	47
3	内部控制鉴证报告	206
4	经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表	226
5	法律意见书	244
6	律师工作报告	918
7	发行人公司章程（草案）	1115
8	证监会统同意注册的批复	1160

中国国际金融股份有限公司
关于合肥晶合集成电路股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的
发行保荐书

保荐机构（主承销商）



（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

中国国际金融股份有限公司
关于合肥晶合集成电路股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的发行保荐书

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”、“公司”或“发行人”）拟申请首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》中相同的含义。）

一、本次证券发行的基本情况

（一）保荐机构名称

中国国际金融股份有限公司

（二）具体负责本次推荐的保荐代表人

周玉：于 2016 年取得保荐代表人资格，曾经担任中国广核电力股份有限公司 A 股 IPO 项目、杭州银行股份有限公司 A 股非公开发行项目等项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

李义刚：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾经执行华西证券股份有限公司 A 股 IPO 项目、中国工商银行股份有限公司 2019 年度优先股项目、五矿资本股份有限公司 2020 年度优先股项目、招商证券股份有限公司 2020 年度配股项目、山西证券股份有限公司 2020 年度配股项目、瑞达期货股份有限公司 2020 年度可转债项目等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：梁晶晶，于 2008 年取得证券从业资格，曾经执行国电电力发展股份有限公司 A 股公开增发项目、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 A 股公开增发项目、杭州银行股份有限公司 A 股 IPO 项目、中国电信股份有限公司 A 股 IPO 项目等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

项目组其他成员：刘飞峙、艾雨、郭宇泽、卓一帆、乔达、黄泽瑞、孙起帆、章响、余朝辉、熊采薇、张驰、谭乃中。

（四）发行人基本情况

公司名称	合肥晶合集成电路股份有限公司
注册地址	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号
有限公司成立日期	2015 年 5 月 19 日
股份公司成立日期	2020 年 11 月 25 日

联系电话 0551-62637000

经营范围 集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次证券发行类型 首次公开发行股票并在科创板上市

（五）发行人与本机构之间的关联关系

1、本机构自身及本机构下属子公司持有或通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况：

截至本发行保荐书出具之日，中金公司通过全资子公司中金浦成持有发行人 0.12% 的股份；根据国家企业信用信息公示系统公开信息显示，中金公司通过其以自有或投资的已经基金业协会备案的相关金融产品等形式间接持有发行人股东集创北方、宁波华淳的股权/财产份额（穿透后持有发行人股份的比例不超过 0.01%），该等投资行为并非中金公司主动针对公司进行投资。

中金公司作为本次发行项目的保荐机构，严格遵守相关法律法规及监管要求，切实执行内部信息隔离制度，充分保障保荐机构的职业操守和独立性。中金公司已建立并实施包括《限制名单政策》在内的信息隔离墙制度，在制度上确保各业务之间在机构设置、人员、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的妥善管理，以防范内幕交易及避免因利益冲突产生的违法违规行为。

中金浦成作为发行人的发起人之一，持有发行人股份依据其自身独立投资研究决策，与本次项目保荐并无关联。

截至本发行保荐书出具之日，本机构自身、本机构下属子公司及本机构控股股东、实际控制人、重要关联方合计持有的晶合集成的股份占晶合集成股份总数的 0.12%。上述情形不违反《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十二条的规定，不会影响保荐机构公正履行保荐职责。

本机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。本机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。

除此之外，本机构自身及本机构下属子公司不存在持有发行人或其控股股东、实际

控制人、重要关联方股份的其他情况。

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方除可能存在的少量二级市场投资外，不存在持有本机构及本机构下属子公司股份的情况。

3、本机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

4、中金公司控股股东为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”或“上级股东单位”），截至2022年12月31日，中央汇金及其全资子公司中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国投资咨询有限责任公司合计持有中金公司约40.17%的股份。中央汇金为中国投资有限责任公司的全资子公司，中央汇金根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。中央汇金不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。根据发行人提供的资料及公开信息资料显示，中金公司上级股东单位与发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互持股的情况，中金公司上级股东单位与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互提供担保或融资的情况。

5、本机构与发行人之间不存在其他关联关系。

综上所述，本机构依据相关法律法规和公司章程，独立公正地履行保荐职责。

（六）本机构的内部审核程序与内核意见

本次证券发行的中金公司内部审核程序如下：

1、内部审核程序

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及中金公司质控和内核制度，本机构自项目立项后即由项目执行与质量控制委员会组建对应的质控小组，质控小组对项目风险实施过程管理和控制；内核部组建内核工作小组，与内核委员会共同负责实施内核工作，通过公司层面审核的形式对项目进行出口管理和终端风险控制，履行以公司名义对外提交、报送、出具或披露材料和文件的最终审批决策职责。

本机构内部审核程序如下：

（1）立项审核

项目组在申请项目立项时，项目执行与质量控制委员会就立项申请从项目执行风险角度提供立项审核意见，内核部从项目关键风险角度提供立项审核意见。

（2）辅导阶段的审核

辅导期间，项目组需向质控小组和内核工作小组汇报辅导进展情况，项目组向中国证监会派出机构报送的辅导备案申请、辅导报告、辅导验收申请等文件需提交质控小组和内核工作小组，经质控小组审核通过并获得内核工作小组确认后方可对外报送。项目组在重点核查工作实施之前，应就具体核查计划与质控小组进行讨论并获得质控小组的确认；后续实际核查过程中如有重大事项导致核查计划的重大调整，也应及时与质控小组进行沟通。如有需重点讨论事项，可由项目组与质控小组、内核工作小组召开专题会议进行讨论。

（3）申报阶段的审核

项目组按照相关规定，将申报材料提交质控小组和内核工作小组，质控小组对申报材料、尽职调查情况及工作底稿进行全面审核，针对审核中的重点问题及工作底稿开展现场核查。质控小组审核完毕后，由项目执行与质量控制委员会组织召开初审会审议并进行问核。初审会后，质控小组出具项目质量控制报告及尽职调查工作底稿验收意见，并在内核委员会会议（以下简称“内核会议”）上就审核情况进行汇报。内核部组织召开内核会议就项目进行充分讨论，就是否同意推荐申报进行表决并出具内核意见。

（4）申报后的审核

项目组将申报材料提交证券监管机构后，项目组须将证券监管机构的历次问询函回复/反馈意见答复、申报材料更新及向证券监管机构出具的其他文件提交质控小组和内核工作小组，经质控小组和内核工作小组审核通过后方可对外报送。

（5）发行上市阶段审核

项目获得中国证监会予以注册决定后，项目组须将发行上市期间需经项目执行与质量控制委员会/资本市场部质控团队审核的文件提交质控小组/资本市场部质控团队、内核工作小组，经质控小组/资本市场部质控团队和内核工作小组审核通过后方可对外报送。

（6）持续督导期间的审核

项目组须将持续督导期间以中金公司名义出具的文件提交投资银行部后督专员、质控小组和内核工作小组，经投资银行部后督专员复核、质控小组和内核工作小组审核通过后方可对外报送。

2、内核意见

经按内部审核程序对合肥晶合集成电路股份有限公司本次证券发行的申请进行严格审核，本机构对本次发行申请的内核意见如下：

合肥晶合集成电路股份有限公司符合首次公开发行股票并在科创板上市的基本条件，申报文件真实、准确、完整，同意上报上海证券交易所审核。

二、保荐机构承诺事项

（一）本机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上交所的规定，对发行人及其发起人、控股股东、实际控制人进行了尽职调查和审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

（二）作为合肥晶合集成电路股份有限公司本次发行的保荐机构，本机构：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规、中国证监会以及上交所有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证本发行保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会以及上交所的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会、上交所依照相关法律、行政法规采取的监管措施。

三、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的规定，本保荐机构对保荐机构和发行人为本次证券发行有偿聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为进行了核查。

（一）本保荐机构有偿聘请第三方行为的核查

为控制项目法律风险，加强对项目法律事项开展的尽职调查工作，本机构聘请北京市海问律师事务所担任本次证券发行的保荐机构/主承销商律师。北京市海问律师事务所的基本情况如下：

名称	北京市海问律师事务所
成立日期	1992年5月26日
统一社会信用代码	31110000E00017525U
住所	北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层
执行事务合伙人/负责人	张继平
经营范围/执业领域	-
实际控制人（如有）	-

北京市海问律师事务所持有统一社会信用代码为31110000E00017525U的《律师事务所执业许可证》，且具备从事证券法律业务资格。北京市海问律师事务所同意接受保荐机构委托，在该项目中向保荐机构/主承销商提供法律服务，服务内容主要包括：协助保荐机构/主承销商完成该项目的法律尽职调查工作，协助起草、修改、审阅保荐机构/主承销商就该项目出具的相关法律文件并就文件提出专业意见，协助保荐机构/主承销商收集、整理、编制该项目相关的工作底稿等。本项目聘请保荐机构/主承销商律师的费用由双方协商确定，并由中金公司以自有资金按照聘用协议约定的付款进度以银行

转账方式支付给保荐机构/主承销商律师。截至本发行保荐书出具之日，中金公司尚未实际支付法律服务费用。

为控制项目财务风险，加强对项目财务事项开展的尽职调查工作，本机构聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次证券发行的保荐机构/主承销商会计师。立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况如下：

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2011年1月24日
统一社会信用代码	91310101568093764U
注册地	上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人/负责人	杨志国、朱建弟
经营范围/执业领域	审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
实际控制人（如有）	-

立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有编号为31000006的《会计师事务所执业证书》，且具备从事证券期货业务的资格。立信会计师事务所（特殊普通合伙）同意接受保荐机构/主承销商之委托，在该项目中向保荐机构/主承销商提供财务咨询服务，服务内容主要包括：协助保荐机构/主承销商完成该项目的财务尽职调查工作，就项目中遇到的财务问题提供咨询意见，协助保荐机构/主承销商收集、整理、编制该项目相关的工作底稿等。本项目聘请保荐机构/主承销商会计师的费用由双方协商确定，并由中金公司以自有资金按照聘用协议约定的付款进度以银行转账方式支付给保荐机构/主承销商会计师。截至本发行保荐书出具之日，中金公司尚未实际支付保荐机构/主承销商会计师服务费用。

经核查，保荐机构认为上述聘请第三方的行为合法合规。除上述情形外，保荐机构不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

（二）发行人有偿聘请第三方行为的核查

在本项目中，发行人除依法为该项目聘请的证券服务机构之外，还聘请了行业咨询机构为本次发行提供行业咨询服务，聘请了翻译公司为本次发行提供外文文件翻译服务，

聘请了境外律师为本次发行提供法律咨询服务。

经核查，保荐机构认为上述聘请其他第三方的行为合法合规。除上述情形外，发行人不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

（三）保荐机构结论性意见

综上，经核查，保荐机构认为：本次发行中，除聘请北京市海问律师事务所作为本次项目的保荐机构/主承销商律师、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次项目的保荐机构/主承销商会计师，保荐机构不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方的行为；发行人在本次发行中除依法聘请证券服务机构，同时聘请行业咨询机构、翻译公司、境外律师之外，不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。前述相关行为合法合规，符合中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22号）的相关规定。

四、本机构对本次证券发行的推荐意见

（一）本机构对本次证券发行的推荐结论

本机构作为合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，按照《公司法》、《证券法》、《首发办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会、上交所的有关规定，通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，并与发行人、发行人律师及发行人审计师经过充分沟通后，认为合肥晶合集成电路股份有限公司具备首次公开发行股票并在科创板上市的基本条件。因此，本机构同意保荐合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市。

（二）发行人就本次证券发行履行的决策程序

经核查，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会、上交所规定的决策程序，具体如下：

1、董事会决策程序

2021年2月9日，发行人召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于合肥晶合集成电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上

市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》、《关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》、《关于〈合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划〉的议案》、《关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》、《关于〈合肥晶合集成电路股份有限公司滚存未分配利润分配方案〉的议案》、《关于合肥晶合集成电路股份有限公司出具上市相关承诺及提出约束措施的议案》、《关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于上市后适用的〈合肥晶合集成电路股份有限公司章程（草案）〉的议案》等与本次发行相关的议案，对本次发行的具体方案以及其他必须明确的事项作出了决议，并提请股东大会审议；

2021年8月12日，发行人召开第一届董事会第六次会议审议通过了关于变更上市募集资金投资项目的议案；

2022年3月15日，发行人召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于延长合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案有效期的议案》《关于提请股东大会继续授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》；

2023年3月1日，发行人召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续延长合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案有效期的议案》《关于提请股东大会继续授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》。

2、股东大会决策程序

2021年3月16日，发行人召开2020年年度股东大会，审议通过了本次发行相关的议案；

2021年8月27日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，审议关于变更上市募集资金投资项目的议案；

2022年3月16日，发行人召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于

延长合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案有效期的议案》《关于提请股东大会继续授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》；

2023年3月16日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续延长合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案有效期的议案》《关于提请股东大会继续授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》。

综上，保荐机构认为，发行人本次发行已获得董事会、股东大会的批准，发行人董事会已取得股东大会关于本次发行的授权，发行人就本次发行履行的决策程序符合《公司法》《证券法》《首发办法》等法律法规以及发行人公司章程的相关规定。

（三）本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件

发行人本次拟发行每股面值为人民币一元的股票，每股的发行条件和价格相同，每一股份具有同等权利，任何单位或者个人认购每股股份应当支付相同价额，且发行价格不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十六条、第一百二十七条的规定。

（四）本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件

本机构对本次证券发行是否符合《证券法》规定的发行条件进行了尽职调查和审慎核查，核查结论如下：

1、根据发行人提供的资料，发行人已经按照《首发办法》《科创板上市规则》等法律法规及规范性文件的要求设立了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会等组织机构，并完善了组织制度及其他内部管理制度，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第（一）项的规定；

2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z0133号）及本保荐机构的审慎核查，发行人2020年度、2021年度和2022年度的营业收入分别为151,237.05万元、542,900.93万元和1,005,094.86万元，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第（二）项之规定；

3、发行人最近三年财务会计报告已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z0133号），符合《证券法》第十二条

第（三）项之规定；

4、经本保荐机构的审慎核查、相关政府部门出具的证明以及合肥建投出具的说明，发行人及其控股股东最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第（四）项之规定；

5、发行人符合中国证监会、上交所规定的其他条件，符合《证券法》第十二条第（五）项之规定：中国证监会发布的《首发办法》对于首次公开发行股票并在科创板上市规定了相关具体发行条件，本机构对发行人符合该等发行条件的意见请见下文第（五）部分。

综上所述，发行人本次发行符合《证券法》规定的发行条件。

（五）本次证券发行符合《首发办法》规定的发行条件

本机构对发行人是否符合《首发办法》规定的发行条件进行了逐项核查，核查意见如下：

1、发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，持续经营三年以上，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

本机构按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对发行人的主体资格进行了尽职调查，查证过程包括但不限于：核查发行人设立至今的工商登记资料、公司章程、审计报告、股权变动涉及的股权转让协议、主要资产权属证明、相关内部决议文件、发起人和股东的工商登记资料、发行人开展生产经营所需的业务许可证照或批准等文件资料；查阅了发行人的公司章程、议事规则和相关会议文件资料、董事会专门委员会工作规则、独立董事工作制度、董事会秘书工作制度、总经理工作细则；对发行人、董事、监事和高级管理人员进行了访谈，并向发行人律师、会计师进行了专项咨询和会议讨论。

经对发行人主体资格的尽职调查和审慎核查，核查结论如下：

（1）发行人的依法设立

①有限责任公司设立情况

2015年4月27日，合肥市人民政府与力晶科技签署《12吋晶圆制造基地项目合作框架协议》，约定双方共同合作实施合肥新站综合开发试验区12吋晶圆制造基地项目。

2015年5月12日，合肥市国资委下发《关于同意组建合肥晶合集成电路股份有限

公司的批复》(合国资产权[2015]60号),同意合肥建投组建全资子公司合肥晶合集成电路股份有限公司(以工商登记为准),注册资本为1,000.00万元。

2015年5月19日,合肥建投签署《合肥晶合集成电路有限公司章程》,晶合有限注册资本为1,000.00万元,由合肥建投全额认缴。

2015年5月19日,合肥市工商行政管理局向晶合有限核发了《营业执照》(注册号:340108000130981)。

2021年3月12日,容诚出具《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0049号),经复核,截至2015年5月29日,晶合有限已收到合肥建投缴纳的实收资本合计1,000.00万元。

晶合有限设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	合肥建投	1,000.00	100.00
	合计	1,000.00	100.00

②股份有限公司设立情况

2020年10月19日,容诚出具以2020年9月30日为基准日的《审计报告》(容诚审字[2020]230Z3994号),截至2020年9月30日,晶合有限账面净资产为7,353,140,545.50元。

2020年10月21日,中水致远出具了《合肥晶合集成电路有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》(中水致远评报字[2020]第020502号),以2020年9月30日为基准日对晶合有限的净资产进行评估,评估值为918,198.75万元。2020年11月9日,合肥市国资委就上述资产评估项目基本情况及资产评估结果出具了《国有资产评估项目备案表》。

2020年10月21日,晶合有限董事会作出决议,同意以2020年9月30日为股改基准日将晶合有限整体变更为股份公司,原公司章程自股份公司完成设立登记之日起自动终止。

2020年11月5日,晶合有限全体股东签署《合肥晶合集成电路股份有限公司发起人协议》,一致同意以晶合有限净资产折股整体变更的方式共同发起设立股份公司。

2020年11月12日，合肥市国资委出具《关于同意合肥晶合集成电路有限公司变更为合肥晶合集成电路股份有限公司的批复》（合国资产权[2020]105号），同意按照《公司法》的规定，以截至2020年9月30日经审计的晶合有限账面净资产人民币7,353,140,545.50元按1:0.20462的比例折合1,504,601,368股，即每股面值人民币1元，将晶合有限变更为晶合集成。

2020年11月20日，发行人召开创立大会，以截至2020年9月30日股改基准日经容诚审计的晶合有限账面净资产7,353,140,545.50元为基础，按1:0.204620的比例折合1,504,601,368股，每股面值为人民币1元，将晶合有限整体变更为股份公司。整体变更后，股份公司注册资本1,504,601,368元，股份总数为1,504,601,368股，整体变更后股份公司的股本与整体变更前的注册资本保持一致，资本公积和未分配利润在整体变更前后保持不变。

2020年11月20日，容诚出具《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0263号），经审验，截至2020年11月20日，发行人之全体发起人已按发起人协议和公司章程的规定，以其拥有的晶合有限截至2020年9月30日止经审计的净资产人民币7,353,140,545.50元，按照1:0.204620比例折合股份1,504,601,368股，完成缴纳注册资本人民币1,504,601,368元，整体变更后的股本与整体变更前的注册资本保持一致。

2020年11月25日，合肥市市场监督管理局向发行人核发《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q）。

发行人整体变更设立后的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	合肥建投	468,474,592	31.14
2	合肥芯屏	328,736,799	21.85
3	力晶科技	412,824,208	27.44
4	美的创新	88,014,118	5.85
5	中安智芯	39,606,354	2.63
6	惠友豪创	26,404,236	1.75
7	合肥存鑫	26,404,236	1.75
8	海通创新	17,602,824	1.17
9	杭州承富	15,402,471	1.02
10	泸州隆信	13,202,118	0.88

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
11	宁波华淳	13,202,118	0.88
12	中小企业基金	13,202,118	0.88
13	安华创新	8,801,412	0.58
14	集创北方	8,801,412	0.58
15	中金浦成	1,760,282	0.12
16	合肥晶焠	5,195,398	0.35
17	合肥晶遂	4,197,429	0.28
18	合肥晶炯	3,813,060	0.25
19	合肥晶咖	1,456,606	0.10
20	合肥晶珏	1,262,054	0.08
21	合肥晶梢	1,174,082	0.08
22	合肥晶柔	862,798	0.06
23	合肥晶悬	852,648	0.06
24	合肥晶本	779,902	0.05
25	合肥晶洛	581,966	0.04
26	合肥晶辽	497,378	0.03
27	合肥晶确	414,481	0.03
28	合肥晶铁	414,481	0.03
29	合肥晶妥	406,023	0.03
30	合肥晶雄	253,764	0.02
合计		1,504,601,368	100.00

（2）发行人的持续经营

发行人前身为 2015 年 5 月 19 日成立的晶合有限，并于 2020 年 11 月 25 日以经审计确认的账面净资产折股整体变更设立股份有限公司，其持续经营时间自晶合有限 2015 年 5 月 19 日成立至今已超过三年。

（3）发行人的组织机构及运行情况

发行人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《科创板上市规则》等适用法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定和要求设立了股东大会、董事会（下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会）、监

事会、独立董事、董事会秘书制度，形成了规范的公司治理结构。同时，发行人制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内部审计制度》《战略委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》等相关治理制度。

根据保荐机构对发行人提供的股东大会、董事会、监事会会议记录及决议的适当核查，发行人均能按照有关规定召开股东大会、董事会和监事会会议，会议的召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，并保存有关会议文件。

综上，发行人符合《首发办法》第十条的规定：“发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。”

2、发行人会计基础工作规范，内部控制制度健全且被有效执行

本机构按照《保荐人尽职调查工作准则》等法规的要求对发行人的会计基础和内部控制制度进行了尽职调查，查证过程包括但不限于：对经审计的财务报告及经审核的内部控制鉴证报告以及其他相关财务资料进行了审慎核查；就发行人报告期内收入和成本构成变动、收入来源和成本支出原因、收入确认和成本支出确认方式、资产状况、盈利状况和现金流量等财务数据和财务指标的变化情况进行分析，并与同期相关行业、市场和可比公司情况进行对比分析；对主要产品销售价格变动、财务指标和比率变化，与同期相关行业、市场和可比公司情况进行了对比分析；查阅了报告期内重大销售合同、是否存在对外担保和仲裁、诉讼的相关资料、主要税种纳税资料以及税收优惠或财政补贴等财务资料；走访并调查了发行人的主要客户、主要供应商；就发行人财务会计问题，保荐机构项目执行人员与发行人财务人员和会计师进行密切沟通，并召开了多次专题会议。

经对发行人的会计基础和内部控制制度的尽职调查和审慎核查，核查结论如下：

发行人会计基础工作规范，公司财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，无虚假记载，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计

报告》（容诚审字[2023]230Z0133号）。

发行人已建立规范、健全的内部控制管理体系。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z0277号），认为发行人于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

综上，发行人符合《首发办法》第十一条的规定：“发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。”

3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力

本机构按照《保荐人尽职调查工作准则》等要求对发行人的业务完整性和独立持续经营能力进行了尽职调查，查证过程包括但不限于：核查了发行人的组织结构资料及发行人控股股东的工商资料，调阅了发行人的销售和采购记录，实地考察了发行人销售和采购系统，访谈了发行人主要第三方客户和供应商；核查了发行人主要经营性资产的权属证明和实际使用情况；调查了发行人金额较大的应收应付款项产生的原因、交易记录和资金流向；核查了发行人员工名册及劳务合同；核查了发行人的财务管理制度、银行开户资料和纳税资料；核查了发行人相关内部决议和内部机构规章制度；查阅行业研究资料和统计资料、咨询行业分析师、了解发行人竞争对手情况；就发行人业务、财务和机构、人员的独立性，对发行人及发行人股东进行了访谈；查阅了董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的履历资料及任职文件，并向其进行了问卷调查；查阅了对外担保的相关资料、仲裁、诉讼相关资料；向发行人律师、会计师进行了专项咨询和会议讨论。

经对发行人的业务完整性和独立持续经营能力的尽职调查和审慎核查，核查结论如下：

(1) 发行人的资产完整和独立性

①资产完整

发行人具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有

与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

②人员独立

报告期内，发行人存在合肥建投、力晶科技向发行人委派高级管理人员的情形，具体包括：合肥建投曾向发行人委派销售副总监周义亮（曾兼任采购副总监），采购副总监王继武，总会计师朱才伟，审计师、敬业促进委员会委员长、行政副总经理朱晓娟，审计师、敬业促进委员会委员长杨幼玲；力晶科技曾向发行人委派副总会计师邱垂源，副总会计师李迦谕，行政副总经理刘荫，审计师陈美华，审计师潘炯升。截至本发行保荐书出具之日，发行人高级管理人员均由公司聘任并在公司专职工作。

截至本发行保荐书出具之日，发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

③财务独立

发行人已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；发行人未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

④机构独立

发行人已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

⑤业务独立

发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

综上，发行人符合《首发办法》第十二条第（一）项的规定：“资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。”

(2) 发行人最近 2 年主营业务，董事、高级管理人员及核心技术人员的变化情况和股权情况

①主营业务变化

发行人主营业务为 12 英寸晶圆代工服务，自设立以来未发生改变。

②董事、高级管理人员及核心技术人员最近 2 年内的变化

A.董事的变动情况

最近两年，发行人董事变化情况如下：

变动情况	原因	影响
2021 年 12 月 20 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司更换董事的议案》，同意选举陈小蓓为公司董事	股东更换委派董事	不构成重大不利变化

B.高级管理人员的变动情况

最近两年，发行人高级管理人员变化情况如下：

变动情况	原因	影响
2021 年 11 月 30 日，发行人召开第一届董事会第八次会议，周义亮由协理变更为公司副总经理	发行人内部培养产生	不构成重大不利变化

C.核心技术人员的变动情况

发行人核心技术人员最近两年未发生变化。

上述董事、高级管理人员、核心技术人员的变更均依法履行了《公司法》及《公司章程》规定的程序，且该等变动未对发行人的法人治理结构、经营政策的延续性产生重大不利影响，不属于董事、高级管理人员、核心技术人员发生重大变化的情形。

③发行人的股权情况

截至本发行保荐书出具之日，合肥建投直接持有发行人 31.14%的股份，并通过合肥芯屏控制发行人 21.85%的股份，合计控制发行人 52.99%的股份，系发行人的控股股东；合肥市国资委持有合肥建投 100%的股权，系发行人的实际控制人。最近 2 年发行

人控股股东、实际控制人没有发生变更，控制权稳定。

截至本发行保荐书出具之日，发行人控股股东直接或间接持有的发行人股份权属清晰，不存在质押或其他有争议的情况。

综上，发行人符合《首发办法》第十二条第（二）项的规定：“主营业务、控制权和管理团队稳定，……首次公开发行股票并在科创板、创业板上市的，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；首次公开发行股票并在科创板上市的，核心技术人员应当稳定且最近二年内没有发生重大不利变化；发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，……首次公开发行股票并在科创板、创业板上市的，最近二年实际控制人没有发生变更。”

（3）发行人的其他重大事项

①经核查，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷；

②经核查，发行人不存在重大偿债风险，也不存在影响持续经营的重大担保、诉讼、仲裁等或有事项；

③经核查，发行人的经营环境和行业地位均保持良好，不存在已经或者将要发生重大变化的情况，2022年第三季度以来晶圆代工行业市场需求及价格变动属于行业周期性波动，不会对发行人的持续经营构成重大不利影响；

④经核查，发行人不存在其他可能对发行人持续经营构成重大不利影响的情形。

综上，发行人符合《首发办法》第十二条第（三）项的规定：“不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。”

4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策

本机构按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对发行人的生产经营进行了尽职调查，查证过程包括但不限于：取得了发行人的书面声明和相关政府部门出具的证明，并走访了相关政府部门；查阅了董事、监事、高级管理人员的履历资料及任职文件，并向其进行了问卷调查；向发行人律师、会计师进行了专项咨询和会议讨论。

经对发行人生产经营的尽职调查和审慎核查，核查结论如下：

发行人主要从事 12 英寸晶圆代工业务，致力于研发并应用行业先进的工艺，为客

户提供多种制程节点、不同工艺平台的晶圆代工服务。发行人所代工的主要产品为面板显示驱动芯片，其被广泛应用于液晶面板领域，包括电视、显示屏、笔记本电脑、平板电脑、手机、智能穿戴设备等产品中，获得了众多境内外知名芯片设计公司和终端产品公司的认可。2022年度，公司12英寸晶圆代工产能为126.21万片。根据Frost&Sullivan的统计，截至2020年底，发行人已成为中国大陆收入第三大、12英寸晶圆代工产能第三大的纯晶圆代工企业（不含外资控股企业）；根据市场研究机构TrendForce的统计，2022年第二季度，在全球晶圆代工企业中，发行人营业收入排名全球第九。发行人的生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

最近三年内，发行人不存在重大违法违规行为，也不存在受到相关主管机关重大处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况；发行人控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

综上，发行人符合《首发办法》第十三条的规定：“发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。”

综上所述，发行人本次发行符合《首发办法》规定的股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的基本条件。

（六）关于发行人及其控股股东等责任主体做出的承诺及约束措施事项的核查意见

根据中国证监会于2013年11月30日发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）等相关文件的要求，发行人、控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、全体董事、监事、高级管理人员等相关责任主体就发行

人本次发行分别做出了相关承诺并出具承诺函，承诺的内容合法、合理，失信补救措施及时有效，符合中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法规的规定。

（七）关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》有关事项的核查意见

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，发行人已召开第一届董事会第三次会议以及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市摊薄即期回报及填补措施的议案》。

1、实际控制人合肥市国资委的承诺

“在作为晶合集成实际控制人期间，本单位承诺不越权干预晶合集成经营管理活动，不侵占晶合集成利益。

在本次发行上市完成前，如监管机构作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的其他细化规定，且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时，本单位承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。”

2、控股股东合肥建投的承诺

“在作为晶合集成控股股东期间，本公司承诺不越权干预晶合集成经营管理活动，不侵占晶合集成利益。

在本次发行上市完成前，如监管机构作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的其他细化规定，且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。”

3、控股股东合肥建投一致行动人合肥芯屏的承诺

“在作为晶合集成控股股东的一致行动人期间，本企业承诺不越权干预晶合集成经营管理活动，不侵占晶合集成利益。

在本次发行上市完成前，如监管机构作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的其他细化规定，且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时，本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。”

4、发行人董事及高级管理人员的承诺

“本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，不会越权干预公司经营管理，也不会采用其他方式侵占或损害公司利益。

本人承诺将对本人的职务消费行为进行约束。

本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

若公司后续推出股权激励政策，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

在本次发行上市完成前，如监管机构作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的其他细化规定，且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

若本人违反上述承诺，给公司或者股东造成损失的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，依法承担对公司和股东的补偿责任，并无条件接受中国证监会或上海证券交易所等监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。”

经核查，保荐机构认为，发行人所预计的即期回报摊薄情况合理，填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，亦符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神。

（八）关于发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的核查情况及结论

根据中国证监会《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》（证监会公告[2020]43号）等相关文件的要求，保荐机构核查了审计截止日2022年12月31日后发行人生产经营的内外部环境是否或将要发生重大变化，包括产业政策重大调整，进出口业务受到重大限制，税收政策出现重大变化，行业周期性变化，业务模式及竞争趋势发生重大变化，主要原材料的采购规模及采购价格或主要产品的生产、销售规模及销售价格出现大幅变化，新增对未

来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，主要客户或供应商出现重大变化，重大合同条款或实际执行情况发生重大变化，重大安全事故，以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面，并了解发行人对 2023 年 1-3 月的业绩预测信息。

经核查，财务报告审计截止日至本发行保荐书出具之日，发行人总体经营情况良好，经营模式未发生重大变化；发行人客户结构稳定，主要供应商合作情况良好，不存在重大不利变化；发行人所处晶圆代工行业长期发展前景良好，2022 年第三季度以来晶圆代工行业市场需求及价格变动属于行业周期性波动，行业的产业政策、税收政策均未发生重大变化；发行人合理预计 2023 年第一季度将出现亏损。发行人已在招股说明书中对上述情形进行了披露，并提示投资者关注业绩下滑风险。

（九）发行人存在的主要风险

1、与发行人相关的风险

（1）经营业绩下滑的风险

报告期各期，发行人营业收入分别为 151,237.05 万元、542,900.93 万元和 1,005,094.86 万元，归属于母公司普通股股东的净利润分别为-125,759.71 万元、172,883.20 万元和 304,543.08 万元。报告期内，随着发行人产销量的提高，发行人的营业收入已有所上升，盈利水平逐步改善，发行人整体经营业绩已有所提升。

2022 年第三季度以来，受消费性终端需求疲软的影响，晶圆代工行业景气度下行，发行人 2022 年下半年经营业绩承压，其中第三季度盈利水平环比出现下降，第四季度出现单季亏损；同时，发行人合理预计 2023 年第一季度仍将出现亏损。

未来，不排除受市场规模变化、行业竞争加剧、产品更新换代等因素综合影响，下游市场需求可能发生波动。如果发行人未能及时应对上述市场变化，将面临经营业绩下滑和亏损的风险。

（2）制程节点技术研发滞后的风险

发行人所处的晶圆代工行业技术更新迭代快，研发周期长。自设立至今，发行人专注于 12 英寸晶圆代工业务，已实现 150nm-90nm 制程节点量产，正在进行 55nm 制程技术平台的风险量产，但台积电、联华电子、中芯国际等行业领先企业已达 5nm、14nm 等制程节点，发行人与之存在差距。根据发行人规划，发行人拟进一步研发更先进制程，

技术研发难度不断增加，对工艺、设备、原材料、研发人员的要求将进一步提升。如无法及时完成相关技术平台的研发以响应市场需求，将对发行人的市场竞争力及市场份额造成不利影响。

（3）工艺平台技术研发无法满足市场需求的风险

发行人报告期内形成主营业务收入的工艺平台应用领域主要为 DDIC，正在研发中的工艺平台应用领域主要为 CIS、MCU 及 PMIC。以上工艺平台的终端市场应用主要为液晶面板、手机、车用、消费电子等，具有技术革新速度快、产品需求多元化等特点。如发行人工艺平台技术研发方向、进度、成果等无法满足市场需求，将可能导致发行人前期研发投入难以收回、发行人代工服务应用领域难以拓展，对发行人经营造成不利影响。

（4）技术研发投入不足的风险

发行人所处的晶圆代工行业研发投入大，随着制程不断缩小，研发投入将进一步增长。报告期内，发行人研发费用分别为 24,467.56 万元、39,668.49 万元和 85,707.00 万元，占营业收入比重分别为 16.18%、7.31%和 8.53%。如发行人后续研发投入不足，亦可能造成研发进度滞后，导致发行人失去技术优势并存在产品被竞争对手替代的风险，从而对发行人稳定经营产生不利影响。

（5）研发人员不足或流失的风险

发行人所处的晶圆代工行业属于技术密集型行业，技术研发涉及多学科交叉，生产工艺流程复杂，对研发人员专业程度、经验水平均有较高要求。不断吸纳技术人才、持续扩充研发团队是集成电路企业增加竞争力的重要因素。近年来，我国集成电路行业发展迅速，但相关人才储备仍有缺口，人员专业程度存在不足。目前集成电路行业人才争夺较为激烈、人员流动较为频繁。

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人研发人员 1,388 人，占发行人员工比例 32.86%。发行人正在进行 55nm 低功耗逻辑及触控与显示驱动整合技术等技术平台的研发、风险量产工作，人才需求较大。如发行人无法持续吸引人才并扩充研发团队，或发行人无法留住研发人员并保持研发团队的稳定性，将对发行人的技术研发及生产经营造成不利影响。

(6) 发行人与行业领先企业相比，在技术水平、业务规模、盈利能力等方面存在较大差距的风险

技术水平方面，自设立至今，发行人专注于 12 英寸晶圆代工业务，已实现 150nm-90nm 制程节点量产，正在进行 55nm 制程技术平台的风险量产。但台积电、联华电子、中芯国际等全球行业领先企业已达 5nm、14nm 等制程节点，发行人与之存在较大差距。

业务规模和盈利能力方面，报告期内，发行人主营业务收入分别为 151,186.11 万元、542,084.44 万元和 1,002,549.95 万元；2020 年至 2022 年，产能分别为 266,237 片/年、570,922 片/年和 1,262,110 片/年；综合毛利率分别为-8.57%、45.13%和 46.16%；净利润分别为-125,759.71 万元、172,883.20 万元和 315,619.62 万元，毛利率、业务规模和市场占有率低于台积电、联华电子等行业领先企业，发行人在业务规模和盈利能力等方面与行业领先企业存在较大差距。

如果发行人无法在未来持续推动技术进步，丰富产品结构、拓展客户、提高业务规模和市场占有率、增强盈利能力，将可能难以缩短与行业领先企业的差距，在激烈的市场竞争中受到不利影响。

(7) 晶圆代工服务的产品应用领域单一，后续研发投入大，业务拓展面临技术风险

报告期内，发行人主要从事 12 英寸晶圆代工业务，主要向客户提供 DDIC 及其他工艺平台的晶圆代工服务，上述晶圆代工服务的产品应用领域主要为面板显示驱动芯片领域。报告期内，发行人 DDIC 晶圆代工服务形成的收入合计分别为 148,394.24 万元、467,914.67 万元和 714,261.58 万元，占主营业务收入的比例分别为 98.15%、86.32%和 71.24%，形成主营业务收入的晶圆代工服务的产品应用领域较为单一。

晶圆代工客户对发行人技术迭代和产品多元化的要求日益提高。报告期内，发行人研发费用分别为 24,467.56 万元、39,668.49 万元和 85,707.00 万元，呈逐年上升趋势，主要用于 55nm、40nm、28nm 等更先进制程研发，以及 CIS、MCU、PMIC 等其他产品技术平台拓展；未来，发行人将投入 49 亿元募集资金用于合肥晶合集成电路先进工艺研发项目，其中包括 55nm 后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台、40nm MCU 工艺平台、40nm 逻辑芯片工艺平台、28nm 逻辑及 OLED 芯片工艺平台等项目研发。随

着制程节点进一步提升及技术平台种类增加，预计发行人研发投入将持续增长。

如发行人在面板显示驱动芯片领域客户订单流失或议价能力下降，且未能及时完成 CIS、MCU 的扩产和 PMIC 等其他技术平台的研发及量产工作，无法在短时间内形成多元化的产品应用领域结构，或先进制程节点研发进度滞后，则可能对发行人的经营业绩造成不利影响。

（8）客户集中度较高的风险

报告期内，发行人前五大客户的销售收入合计分别为 135,804.49 万元、380,807.45 万元和 608,959.01 万元，占营业收入的比例分别为 89.80%、70.14%和 60.59%，客户集中度较高。发行人目前与主要客户维持了长期业务往来关系并与部分客户签署了长期框架协议，如果发行人的主要客户生产经营出现问题，导致其向发行人下达的订单数量下降，则可能对发行人的业绩稳定性产生影响。未来，若发行人无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，将可能对发行人经营业绩产生不利影响。

（9）供应商集中度较高的风险

报告期内，发行人向前五大原材料供应商采购额合计分别为 33,895.37 万元、59,363.58 万元和 93,108.26 万元，占原材料采购总额比例分别为 53.58%、47.35%和 45.65%，供应商集中度较高。

报告期内，发行人向境外供应商采购主要设备占比分别为 94.26%、95.31%和 94.77%，虽然在报告期内呈现出一定的下降趋势，但是发行人向境外供应商采购主要设备占比仍然较高，存在依赖境外供应商的情形；硅片采购方面，发行人硅片采购主要集中于 Global Wafers Co., Ltd.，2022 年度的采购占比达 55.61%，存在单一供应商依赖及境外供应商依赖的情形。

如未来由于贸易摩擦、关税制度或其他不可抗力因素导致原材料或设备供应商延迟交货、限制供应或提高价格，致使发行人原材料或生产设备无法顺利取得或取得成本大幅增加，而发行人未能及时找到替代供应商，则发行人持续生产经营能力将受到不利影响。

（10）IP 授权商终止对公司授权的风险

根据集成电路行业垂直分工模式，主要可分为芯片设计企业、芯片制造企业、芯片封测企业，此外还有设备制造商、IP 授权商等。其中 IP 授权商设计特定功能的集成电路模块并提供给其他集成电路公司使用，通过收取技术授权费用的方式营利。

报告期内，发行人与 IP 授权商签订了技术授权协议，通过支付设计服务费及权利金的方式取得相关第三方 IP 授权。报告期内，发行人使用了上述第三方 IP 授权的产品所形成的主营业务收入占发行人主营业务收入的比重分别为 77.58%、69.38% 和 79.81%。

以上授权 IP 为发行人相应技术平台的重要组成部分，如发行人在技术授权协议到期后，因贸易摩擦、国际政治、不可抗力等因素，无法与其中部分 IP 授权商继续签订授权协议或取得 IP 授权成本大幅增加，且发行人无法在合理期限内自行开发或找到其他 IP 授权商，则会对发行人正常生产经营产生不利影响。

（11）报告期内，发行人与力晶科技及力积电从事同类型业务的风险

报告期内，发行人与力晶科技及力积电均从事晶圆代工业务。力晶科技与发行人独立开展经营，力晶科技作为发行人股东，通过委派董事正常参与发行人具体生产经营管理，不存在通过股东地位及委派董事导致双方非公平竞争、利益输送、相互或单方让渡商业机会的情形。倘若未来公司治理和内部控制体系不能有效运行，内部管理不能适应发展需要，将影响发行人持续、稳定、健康的发展。

（12）力晶科技未来退出影响发行人后续经营的风险

在公司治理方面，晶圆代工行业具有较高的专业性，力晶科技系半导体行业国际知名企业，在晶圆代工领域具有多年的行业经验，力晶科技及其提名的董事在参与公司董事会、股东大会时，对于公司治理方面起到积极促进作用，发行人的经营及重大决策在目前的治理结构下运行稳定。未来，如力晶科技退出发行人，发行人现有股东大会、董事会的结构将发生变化，若发行人未能及时找到合适的董事人选，或新进股东、新任董事不认同发行人目前的管理层及经营策略，可能会对公司治理造成不利影响。

（13）控股股东控制的风险

截至本发行保荐书出具之日，发行人控股股东合肥建投及其一致行动人合肥芯屏合计控制发行人本次发行前 52.99% 的股份。本次发行完成后，发行人控股股东仍为合肥

建投。虽然发行人已建立起旨在保护全体股东利益的法人治理机构和公司制度，但不能排除在本次发行后控股股东通过行使表决权对发行人的重大经营、人事决策等进行控制进而影响其他股东利益的可能性。

（14）公司规模扩张带来的管理风险

报告期内，发行人进行新厂建设，资产规模、业务规模和员工数量均持续增长。截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，发行人总资产分别为 1,564,233.24 万元、3,127,227.47 万元和 3,876,457.45 万元，发行人员工总数分别为 1,666 人、2,720 人和 4,224 人。公司规模快速扩张会使得发行人的组织结构和经营管理趋于复杂化，对发行人的管理水平将提出更高的要求。此外，发行人成功上市后，也将面对资本市场的考验和更高的管理要求，发行人可能存在一定的管理风险。

（15）政府补助政策变化风险

报告期各期，发行人获得的计入当期损益的政府补助金额分别为 8,706.06 万元、18,975.01 万元和 15,895.57 万元，均属于非经常性损益。未来，若政府部门对发行人的支持政策发生变化，发行人能否继续获得政府补助以及获得政府补助的金额等存在不确定性，进而对发行人盈利水平产生一定的影响。

（16）应收账款坏账风险

报告期各期末，发行人应收账款账面余额分别为 26,522.01 万元、94,885.30 万元和 50,874.52 万元，应收账款账面余额占当期营业收入的比例分别为 17.54%、17.48% 和 5.06%。发行人应收账款集中度较高，报告期内前五大应收账款账面余额占比分别为 97.26%、76.09% 和 70.17%。若出现宏观经济环境不佳、行业周期景气度差、重要客户经营状况出现恶化等不利情形，发行人可能存在应收账款发生坏账的风险。

（17）存货跌价风险

报告期各期末，发行人的存货账面价值分别为 38,579.42 万元、78,700.55 万元和 102,165.32 万元，占总资产比例分别为 2.47%、2.52% 和 2.64%，呈现不断增长态势。

报告期各期末，发行人的存货跌价准备金额分别为 3,559.33 万元、2,315.43 万元和 32,705.17 万元，对应期末余额的计提比例分别为 8.45%、2.86% 和 24.25%，2022 年末，公司存货跌价准备计提比例增长，主要系受公司产能利用率下降等原因影响，导致存货

可变现净值降低所致。发行人存货跌价准备的计提主要系发行人尚处于产能、产量爬坡阶段，同时由于设备等生产性长期资产投入大，单位产品承担较大的折旧、摊销导致单位产品生产成本高于可变现净值，进而计提较多存货跌价准备。如果未来发行人产能、产量爬坡未达预期，可能持续存在存货跌价风险。

（18）固定资产投资风险

晶圆代工行业属于典型的资本密集型行业，固定资产投资的需求较高、设备购置成本高，而发行人近年为紧抓行业发展机遇积极进行产能扩充，固定资产投资规模较大。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人固定资产的账面价值为 2,143,736.82 万元，占发行人总资产的比例为 55.30%；发行人在建工程的账面价值为 138,504.36 万元，占发行人总资产的比例为 3.57%。发行人持续的产能扩充对后续资金投入提出了较高要求，发行人的资金筹措能力面临较大的考验。同时，若发行人未来收入规模的增长无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，发行人将面临盈利能力下降的风险。

（19）无形资产减值风险

报告期各期末，发行人的无形资产账面价值分别为 129,948.64 万元、125,422.67 万元和 143,392.28 万元，占非流动资产的比例分别为 12.43%、5.24%和 5.13%。发行人的无形资产主要由专利构成。

报告期内，发行人每年均对无形资产进行减值测试。2020 年度，发行人受外部环境、产品结构规划调整等因素影响，当期计提无形资产减值准备 29,573.92 万元；2021 年度及 2022 年度发行人无形资产因未有减值迹象而未计提减值准备。如果未来出现市场环境变化、产业变革、技术更新迭代等导致发行人产品市场需求下降的情形，则可能有继续产生无形资产减值的风险，从而对发行人当期损益造成不利影响。

（20）偿债能力下降的风险

为满足较大资本开支需求，发行人资产负债率维持在较高水平。报告期各期末，发行人资产负债率（合并）分别为 54.24%、68.38%和 53.44%。目前发行人尚处于产能持续扩充阶段，后续资金投入需求较高，若未来发行人不能保持较好的盈利能力并有效拓宽融资渠道，将面临一定偿债能力下降的风险。

（21）核心技术失密风险

发行人拥有若干具有自主知识产权的核心技术，是发行人保持行业竞争优势的关键和核心竞争力的体现，发行人核心技术人员的稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。若发行人未来不能有效保护知识产权、核心技术及商业秘密，则可能削弱发行人核心竞争优势，进而对发行人的生产经营产生不利影响。

（22）知识产权风险

发行人所处的半导体行业属于典型的技术密集型行业。发行人一方面重视自身研发体系的自主性与合规性，竭力避免自身技术和产品落入竞争对手专利的保护范围；另一方面发行人也重视对自主知识产权的保护，建立了知识产权保护体系。若发行人被第三方提出知识产权侵权指控，或者发行人自身的知识产权被第三方侵犯，将导致发行人发生知识产权纠纷或诉讼，对发行人的生产经营造成不利影响。

（23）向控股股东子公司租赁主要生产经营用地及厂房的风险

截至本发行保荐书出具之日，发行人及其子公司均无自购或自建房产，发行人所有生产经营场所均为租赁。发行人主要生产经营用地、厂房位于安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号，其土地使用权及房屋所有权系控股股东子公司合肥蓝科拥有。

2017 年 6 月 28 日，合肥蓝科与晶合有限已签订《电子器件厂房设施租赁合同》，约定晶合有限租赁电子器件厂房，租赁期限自 2017 年 6 月 28 日（交付日）至 2037 年 6 月 27 日（终止日），且如发行人无重大营运问题，将自动按原条件续约。2021 年 4 月 8 日，合肥蓝科同发行人已签订《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》，约定租赁范围为晶合二厂洁净室与厂务设施及配套设施，租赁期限为 10 年，具体起租时间以实际交付日为准，租赁期满后，发行人有优先承租权，续租协议由双方另行协商确定。

但若租赁合同到期后，新租赁合同商务条款发生重大不利变化或产权人不愿与发行人续签新租赁合同，或发行人未来收购制造基地厂房或者厂务设施存在障碍等，发行人将面临续租成本增加甚至无法续租的风险。若发行人此时未拥有能够替代的土地、房产，将会对发行人的生产经营产生不利影响。

2021 年 8 月 12 日，发行人召开 2021 年第一届第六次董事会审议通过了《关于变更上市募投项目的议案》。2021 年 8 月 27 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会

审议通过上述议案。募投项目变更后，拟使用 31 亿募集资金用于收购制造基地厂房及厂务设施，以保证发行人的独立性及资产的完整性。

（24）安全生产风险

发行人高度重视安全生产，制定了完备的安全生产管理规范，建立了完善的安全生产管理体系。但由于发行人的生产工艺复杂，在生产中会使用操作难度高的大型设备、腐蚀性化学品等，存在一定危险性且对操作人员的技术要求较高。如果员工在日常生产中出现操作不当、设备使用失误等意外事故，发行人将面临安全生产事故、人员伤亡及财产损失等风险。

（25）环境保护风险

发行人的生产过程会产生废水、废气、固体废弃物和噪声，需遵守环境保护方面的相关法律法规。发行人在日常生产经营过程中，积极配合当地环境保护部门履行环保义务，投入大量人力、财力、物力完善环保设施、提高环保能力，并制定了严格的环保制度。但随着国家对环境保护的日益重视，民众环保意识的不断提高，有关国家政策、法律法规的出台可能对发行人的生产经营提出更为严格的要求。若发行人不能及时对生产设施进行升级改造以提高对废水、废气和固体废弃物的处理能力，满足更为严格的环保标准和环保要求，甚至发生环境污染事件，将给发行人生产经营带来不利影响。

2、与行业相关的风险

（1）晶圆代工业务投资规模大，受下游景气度影响较大的风险

发行人所处的晶圆代工行业技术更新迭代快、资金投入大、研发周期长，属于典型的资本密集型行业，固定资产投资的需求较高、设备购置成本高，而发行人近年来不断进行产能扩充，固定资产投资规模较大。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人固定资产的账面价值为 2,143,736.82 万元，占发行人总资产的比例为 55.30%；发行人在建工程的账面价值为 138,504.36 万元，占发行人总资产的比例为 3.57%。未来，发行人将进一步扩充产能并提高研发投入以满足下游客户对发行人稳定性更高、平台更多元的晶圆代工服务需求，发行人也将提高对固定资产的投入，资金筹措能力面临较大的考验。

同时，2020 年-2022 年间，发行人营业收入由 151,237.05 万元上升至 1,005,094.86 万元，年均复合增长率达到 157.79%。发行人营业收入快速增长与下游市场需求息息相关。2018 年-2020 年间，中国大陆晶圆代工行业市场规模由 107.3 亿美元上升至 148.9

亿美元，年均复合增长率为 17.8%；中国大陆 DDIC 出货量由 38.5 亿颗上升至 52.7 亿颗，年均复合增长率为 17%。晶圆代工行业受下游景气度影响较大，不排除未来市场规模变化、行业竞争加剧、产品更新换代等因素综合影响，导致下游市场需求发生波动进而对发行人业绩造成不利影响。

报告期各期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 47,282.88 万元、957,388.50 万元和 628,003.34 万元。如发行人无法维持充足的现金流，导致业务拓展困难、市场开拓无法达到预期；或未能及时应对下游市场变化，导致经营业绩下滑，将对发行人稳定经营产生不利影响。

（2）国际贸易摩擦的风险

发行人使用的主要生产设备，硅片、设备零配件等主要原材料均主要通过向境外企业采购取得。发行人的部分主要客户亦为境外企业，报告期各期，发行人向境外客户销售产品实现主营业务收入分别为 126,253.69 万元、317,382.24 万元和 453,647.82 万元，占发行人主营业务收入比例为 83.51%、58.55%和 45.25%。

未来，如果因贸易摩擦、国际政治、不可抗力等因素造成发行人设备、原材料进口成本增加，产品境外销售利润率下降。基于目前国际政治环境、多边合作关系变动、各大经济体贸易政策存在不确定性，发行人的境外采购及销售可能因此受到影响。倘若未来国际贸易环境发生重大不利变化，一方面，发行人直接向境外采购可能会受到不利影响，另一方面，发行人的中国大陆供应商可能会受到不利影响进而使发行人的采购受到不利影响，该等不利影响可能导致发行人无法采购相关生产设备或生产设备的零配件，进而可能导致发行人面临关键设备采购不到位影响生产的风险。

（3）产业政策变化的风险

近年来，国务院推出了《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）、《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等多项产业政策，促进集成电路行业发展；我国各级政府亦为集成电路企业提供了相关政策支持，在财税、投融资、研究开发、人才、知识产权等方面给予一系列优惠措施，进一步加强信息产业的创新能力和国际竞争力。如未来上述产业政策出现不利变化，将对发行人的业务布局、人才引进、生产经营产生一定不利影响。

(4) 行业波动导致的产能利用率降低的风险

根据 TrendForce 的统计与分析，2021 年，5G 及新能源汽车兴起带动半导体需求增加，晶圆厂产能又无法快速投产，产能缺口不断扩大。但是在 2022 年，智能手机、消费电子需求下行，受到消费性终端需求疲软的影响，整体而言，2022 年第三季度起产能缺口情况有所缓解，使得晶圆代工产能利用率面临挑战。发行人作为半导体晶圆代工企业，生产经营会受到行业整体需求变化及周期性波动的影响，倘若发行人不能在行业波动中调整经营策略、挖掘客户需求、维护客户关系，则存在产能利用率降低的风险。

(5) 汇率波动风险

发行人的记账本位币为人民币，而部分交易采用美元、日元等外币计价。报告期内，发行人汇兑收益分别为-3,246.73 万元、14,346.43 万元和 27,458.14 万元。发行人在经营过程中重视外币资产和外币负债在规模上的匹配，合理控制外汇风险敞口。但未来若境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得本外币汇率大幅波动，发行人仍将面临汇兑损失的风险。

3、其他风险

(1) 本次发行失败的风险

发行人本次申请首次公开发行股票并上市，发行结果将受到发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、公司经营业绩及发展前景、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内外部因素的影响，发行人存在因发行认购不足等未能达到上市条件的情形而导致的发行失败风险。

(2) 与募集资金相关的风险

发行人本次公开发行股票募集资金将投入以下项目：

序号	项目名称	实施主体	拟使用募集资金额 (亿元)
1	合肥晶合集成电路先进工艺研发项目	晶合集成	49.0
1.1	后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目(包含 90 纳米及 55 纳米)	晶合集成	6.0
1.2	微控制器芯片工艺平台研发项目(包含 55 纳米及 40 纳米)	晶合集成	3.5
1.3	40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目	晶合集成	15.0
1.4	28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目	晶合集成	24.5

序号	项目名称	实施主体	拟使用募集资金额 (亿元)
2	收购制造基地厂房及厂务设施	晶合集成	31.0
3	补充流动资金及偿还贷款	晶合集成	15.0
合计			95.0

本次募集资金投资项目金额较大，新增研发工艺平台种类及数量较多，募集资金投资项目是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素所作出的安排，项目实施与未来行业竞争情况、市场供求状况、技术进步等因素密切相关。如果未来 DDIC、CIS、MCU、OLED 芯片等产品的市场需求或该等产品的终端应用的市场需求不及预期，行业竞争加剧或集成电路市场环境发生重大变化，或如果未来后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台、微控制器芯片工艺平台、40 纳米逻辑芯片工艺平台和 28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台的研发失败或研发成果不达预期，募集资金投资项目未能按照计划顺利实施，发行人则可能面临无法按既定计划实现预期收益的风险。

(3) 公司触发退市条件的风险

未来发行人上市后，若生产经营环境发生重大不利变化，或者发行人经营决策出现重大失误，发行人将可能持续亏损，营业收入、净资产大幅下降，导致营业收入低于 1 亿元，或者净资产为负，触发退市风险警示标准，甚至出现明显丧失经营能力情形，从而触发退市标准，出现退市风险。

同时，未来发行人上市后，若生产经营环境发生重大不利变化，或者发行人经营决策出现重大失误，发行人股票投资价值将大幅下降，将可能出现交易不活跃情形，股票市值及交易价格、股票交易量、股东数量可能因发行人投资价值大幅降低而触发退市标准，出现退市风险。

(十) 对发行人发展前景的简要评价

1、发行人所处行业前景广阔

(1) 集成电路行业近三年发展情况

①全球晶圆代工行业市场规模持续增长

随着全球信息化和数字化的持续发展，新能源汽车、人工智能、消费电子、移动通

信、工业电子、物联网、云计算等新兴领域的快速成长带动了全球集成电路和晶圆代工行业市场规模的不断增长。根据 Frost & Sullivan 的统计，2018 年至 2020 年，按照销售额口径，全球晶圆代工行业市场规模从 578 亿美元增长至 677 亿美元，年均复合增长率为 8.2%。

②全球晶圆代工产业逐渐向中国大陆转移

中国大陆是全球最大且增速最快的集成电路市场之一，在市场需求、国家政策、资本投入的驱动下，全球晶圆代工产业逐渐向中国大陆转移。根据 Frost & Sullivan 的统计，2016 年至 2020 年，全球新增投产的晶圆厂为 62 座，其中有 26 座建设于中国大陆，占全球总数的 42%。产业的转移将给中国大陆集成电路行业带来新的发展机遇，促进中国大陆集成电路行业的革新与发展。

③大陆晶圆代工市场处于快速发展阶段

中国大陆晶圆代工行业起步较晚，但随着国内经济的发展和科学技术水平的提高，国内芯片设计公司对晶圆代工服务的需求日益提升，在国家政策的支持下，中国大陆晶圆代工行业实现了快速的发展。根据 Frost & Sullivan 的统计，2018 年至 2020 年，按照销售额口径，中国大陆晶圆代工市场规模从 107.3 亿美元增长至 148.9 亿美元，年均复合增长率为 17.8%。

④中国大陆集成电路国产替代空间巨大

近年来，中国大陆集成电路行业高速发展，但仍无法满足快速增长的市场需求，大量集成电路产品仍要依赖进口。根据中国半导体行业协会统计，2021 年中国大陆集成电路进口额达 4,325.5 亿美元，同期中国大陆集成电路出口额为 1,537.9 亿美元，贸易逆差达 2,787.6 亿美元，仍有巨大的国产替代空间。

2017-2021 年中国大陆集成电路行业进出口情况

单位：亿美元



数据来源：中国半导体行业协会

⑤国家陆续出台政策推动集成电路行业发展

集成电路是信息化、数字化的基石，被广泛应用于通信、安防、军事、工业、交通、消费电子等领域，在国家安全、经济建设和人民的日常生活中发挥着重要的作用。为保证国家经济安全，提高中国大陆集成电路行业的国产化程度，国家相继出台产业政策推动中国大陆集成电路行业发展。

⑥2022 年第三季度起，产能缺口情况有所缓解

根据 TrendForce 的统计与分析，2021 年，5G 及新能源汽车兴起带动半导体需求增加，晶圆厂产能又无法快速投产，产能缺口不断扩大。但是在 2022 年，智能手机、消费电子需求下行，受到消费性终端需求疲软的影响，整体而言，2022 年第三季度起产能缺口情况有所缓解，使得晶圆代工产能利用率面临挑战。

(2) 集成电路行业未来发展趋势

①技术水平持续提升

近年来，中国大陆集成电路市场的快速发展推动了中国大陆集成电路领域的技术进步与革新，未来，中国大陆晶圆代工企业在晶圆代工领域的技术水平将持续突破，工艺

平台将持续丰富，并逐渐缩小与国外龙头晶圆代工企业的差距，将为中国大陆集成电路产业的发展以及国产化程度的提高奠定坚实的基础。

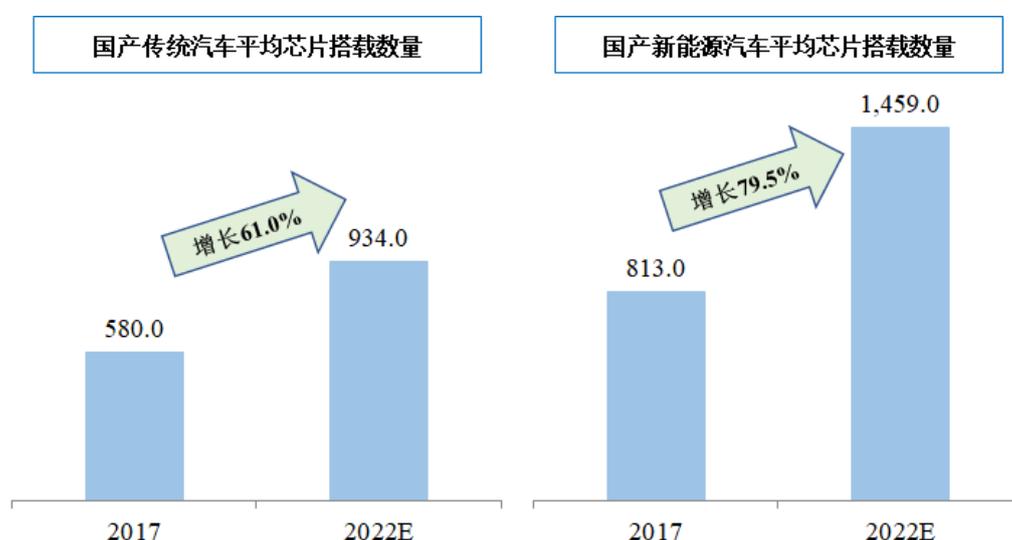
②新兴领域带来增量空间

物联网、5G 通信、人工智能等新技术的发展带来了诸多产业的革新，工业电子、消费电子、汽车电子等集成电路下游应用产业升级为集成电路行业带来增量空间。

例如：在汽车电子领域，根据 Frost & Sullivan 的统计，2017 年至 2022 年，国产传统汽车平均芯片搭载数量将从 580 颗/辆增长至 934 颗/辆，增长率为 61.0%，国产新能源汽车平均芯片搭载数量从 813 颗/辆增长至 1,459 颗/辆，增长率为 79.5%。

2017-2022 年国产汽车芯片搭载数量变化

单位：颗/辆



数据来源：Frost & Sullivan

③国产化替代趋势日益明显

在近年国际贸易摩擦日益严重的情况下，一方面，提高晶圆代工行业国产化的重要性日益凸显，国家陆续出台政策支持境内晶圆代工行业的发展；另一方面，部分境内集成电路设计企业亟需寻找可以满足其需求的境内晶圆代工产能，以保证其生产安全。晶圆代工行业国产化替代的重要性越发凸显，国产化替代将成为中国大陆集成电路发展的重要趋势。

2、发行人具有较强的竞争优势

(1) 完善的技术体系和高效的研发能力

发行人重视技术创新与工艺研发，建立了完善的研发创新体系，在研发平台、研发团队、技术体系等方面形成了较强的优势。发行人研发中心根据总体战略与技术发展战略，以客户需求为导向，进行成熟工艺精进开发，多个领域掌握领先的特色工艺，搭建了 150nm、110nm、90nm、55nm 等制程的研发平台，涵盖了 DDIC、CIS、MCU、PMIC、E-Tag、Mini LED 以及其他逻辑芯片等领域。截至本发行保荐书出具之日，发行人目前已实现 150nm 至 90nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的量产，正在进行 55nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的风险量产。未来，发行人将利用上市募集资金投入至 40nm、28nm 等更先进制程平台的自主研发，进一步增强先进制程服务能力，拓宽产品结构。

此外，发行人通过持续对研发人才的招聘和培养，组建了由境内外资深专家组成的研发核心团队，其拥有在行业内多年的技术研发经验。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人共有研发人员 1,388 人，占员工总数的 32.86%。

报告期内，发行人持续进行研发投入，致力追求技术突破，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人已取得了 316 项发明专利，专利分布在中国大陆、中国台湾地区、美国、日本等各个国家及地区。

（2）以面板显示驱动芯片为基础，覆盖国际一线客户

发行人立足于晶圆代工领域，以面板显示驱动芯片为基础，已与境内外领先芯片设计厂商特别是面板显示驱动芯片设计厂商建立了长期稳定的合作关系，能够掌握行业、产品最新技术动态，及时了解和把握客户最新需求，准确地进行晶圆代工服务更新升级，确保发行人产品在市场竞争中保持竞争优势，同时积累产品行业应用经验，完善产品性能，提高产品质量水平。根据 Frost & Sullivan 的统计，截至 2020 年底，发行人已成为中国大陆收入第三大、12 英寸晶圆代工产能第三大的纯晶圆代工企业（不含外资控股企业）。根据市场研究机构 TrendForce 的统计，2022 年第二季度，在全球晶圆代工企业中，发行人营业收入排名全球第九。

发行人向客户提供 DDIC 等多个工艺平台的晶圆代工服务，已经成功开发了 150nm 至 90nm 多种制程节点、用于不同工艺技术平台的晶圆代工核心技术。报告期各期，发行人 150nm、110nm 及 90nm 产品已经实现大批量生产，2020 年度、2021 年度及 2022 年度，营业收入分别为 151,237.05 万元、542,900.93 万元和 1,005,094.86 万元，呈现快

速增长趋势，且 90nm 制程产品收入持续提升，产品结构持续优化。报告期内，发行人已经覆盖国际一线客户，且正在积极开发新客户资源。

（3）依托新兴产业，拓展丰富的工艺平台

发行人所在地合肥拥有新型显示器件、集成电路和人工智能 3 个国家战略性新兴产业集群，显示面板、白色家电等芯片需求较为旺盛的重点产业已经形成，新能源汽车等新兴产业初步形成。此外，随着 5G、物联网、云计算、智能汽车等新兴产业的驱动下，全球集成电路市场规模有望持续增长。

此外，合肥是集电路设计、制造、封装测试以及设备材料产业链于一体的城市之一，发行人所处的半导体代工环节为半导体产业链中最为重要的环节之一。发行人依靠成熟的制程制造经验，已经具备 DDIC、MCU、CIS、E-Tag、Mini-LED、PMIC 等工艺平台晶圆代工的技术能力，可为客户提供通讯产品、消费品、汽车、工业等不同领域集成电路晶圆代工服务。发行人在显示面板驱动芯片为基础，已有国际一线客户的覆盖，并获得了良好的行业认知度，为发行人进一步利用工艺平台拓展业务范围打下了坚实的基础。

（4）国际化经营理念以及本土化人才策略

发行人顺应半导体产业链格局，初步建立了海外研发团队与运营网络，并在日本设立了研发中心。发行人研发团队成员来自于中国、日本、韩国等国家，以便更好拓展市场，快速响应客户需求。发行人持续通过多元化激励持续吸引晶圆代工行业高端人才的加入，提升发行人技术水平。

发行人以国际一线的资源为基础，从 EDA 供应商，到光罩供应商、封测合作厂商，发行人均选择与国内外一流企业合作，保证优质的产品输出。通过对产品质量的严格要求，发行人主要产品的良率一直保持较高水平。

晶圆代工行业属于人才密集型行业。发行人制定了多元化的激励策略，持续吸引晶圆代工行业高端人才的加入，提升发行人技术水平。发行人持续加强人才培养，通过一系列的机制吸引并留住人才，增加员工的本地归属感。此外，发行人坚持本土化人才策略，员工中的境内人员比例持续增长，人才梯队逐步形成。

（5）完善的质量管理体系

发行人致力于打造完善的质量管理系统，在生产、研发、安全、环保等生产各环节

积极进行国际标准验证，发行人目前已经建立了从工艺研发到产品交付的全流程质量管理体系，并在具体的日常工作中严格按照国际标准的要求执行。

截至本发行保荐书出具之日，发行人已通过 ISO9001 质量管理体系认证、QC080000 环境有害物质管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证；2020 年 6 月已启动 IATF16949 汽车业管理体系认证程序，并于 2021 年 1 月通过审查，取得资质确认，2022 年 12 月通过第三方（BSI）认证机构审查，2023 年 1 月取得符合性证明函。

（6）深谙行业发展和具有创新精神的管理团队

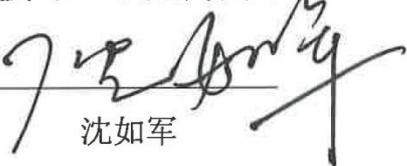
发行人管理层由来自中国大陆和中国台湾地区的资深半导体行业专业人士组成，董事长蔡国智先生拥有数十年高科技产业的经验，在多家国内外科技及半导体相关公司担任高管及董事职务。总经理蔡辉嘉先生在知名晶圆代工企业工作 21 年，历任工程师、部经理、厂长等职务。研发副总经理詹奕鹏先生曾于联华电子、中芯国际担任研发与管理职务，曾任中国科学院上海微系统国家重点实验室顾问。

综上，保荐机构认为，发行人具备持续经营的能力，发展前景良好。

（全文结束）

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的发行保荐书》签章页)

董事长、法定代表人:


沈如军

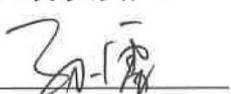
2023年3月28日

首席执行官:


黄朝晖

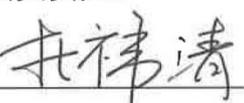
2023年3月28日

保荐业务负责人:


孙雷

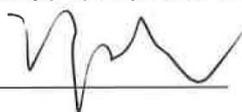
2023年3月28日

内核负责人:


杜祎清

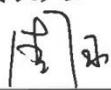
2023年3月28日

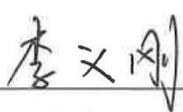
保荐业务部门负责人:


许佳

2023年3月28日

保荐代表人:


周玉


李义刚

2023年3月28日

项目协办人:


梁晶晶

2023年3月28日

保荐人公章

中国国际金融股份有限公司



2023年3月28日

中国国际金融股份有限公司保荐代表人专项授权书

兹授权我公司周玉和李义刚作为保荐代表人，按照有关法律、法规、规章的要求具体负责合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐工作。

截至本授权书出具日：

（一）上述两名保荐代表人最近3年内不存在被中国证券监督管理委员会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分的违规记录情况；

（二）周玉最近3年内曾担任过已完成的杭州银行股份有限公司主板非公开发行A股股票项目的签字保荐代表人；李义刚最近3年内未曾担任过已完成的首次公开发行A股、再融资项目的签字保荐代表人；

（三）上述两名保荐代表人目前申报的在审企业情况如下：

1、周玉：目前申报的在审企业家数为1家，为泰盈科技集团股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市项目签字保荐代表人；

2、李义刚：目前无申报的在审企业。

保荐机构承诺，具体负责此次发行上市的保荐代表人周玉、李义刚符合《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条的有关规定：品行良好、具备组织实施保荐项目的专业能力，熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近五年内具备三十六个月以上保荐相关业务经历、最近十二个月持续从事保荐相关业务，最近十二个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚。

综上，上述两名保荐代表人作为本项目的签字保荐代表人符合《关于进一步加强保荐业务监管有关问题的意见》的规定，我公司法定代表人和本项目签字保荐代表人承诺上述事项真实、准确、完整，并承担相应的责任。

（全文结束）

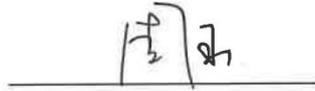
(本页无正文, 为《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人专项授权书》之签章页)

法定代表人:



沈如军

保荐代表人:



周玉



李义刚



审计报告

合肥晶合集成电路股份有限公司

容诚审字[2023]230Z0133号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	审计报告	1-6
2	合并资产负债表	7-8
3	合并利润表	9
4	合并现金流量表	10
5	合并所有者权益变动表	11-13
6	母公司资产负债表	14-15
7	母公司利润表	16
8	母公司现金流量表	17
9	母公司所有者权益变动表	18-20
10	财务报表附注	21-152



审计报告

容诚审字[2023]230Z0133 号

合肥晶合集成电路股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称晶合集成）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度、2021 年度和 2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晶合集成 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度、2021 年度和 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于晶合集成，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2022年度、2021年度和2020年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认



相关会计期间：2022 年度、2021 年度和 2020 年度。

1、事项描述

晶合集成主要从事晶圆代工业务，根据财务报表附注“三、23、收入确认原则和计量方法”及财务报表附注“五、36、营业收入和营业成本”所述，2022年度、2021年度和2020年度营业收入金额分别为1,005,094.86万元、542,900.93万元和151,237.05万元，营业收入增幅较大且构成晶合集成利润表重要项目，营业收入的确认是否恰当对晶合集成经营成果产生重大影响，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括：

（1）了解晶合集成销售与收款相关的关键内部控制，测试和评估销售与收款相关的关键内部控制设计及运行的有效性；

（2）抽样检查晶合集成与客户签订的销售订单，并对管理层和业务人员访谈，了解和评估收入确认的会计政策；

（3）对营业收入和毛利率情况执行分析程序，复核营业收入及毛利率变动的合理性；

（4）检查主要客户销售订单、销售发票、报关单、运输单、签收单及回款单据等，核实销售收入真实性；

（5）对重要客户进行现场或其他形式访谈，进一步核查收入确认的真实性；

（6）结合应收账款的审计，向主要客户函证应收账款余额及报告期销售额等；

（7）针对资产负债表日前后确认的销售收入，选取样本核对收入确认的支持性文件，评估销售收入是否在恰当的期间确认。

（二）固定资产及在建工程的账面价值

相关会计期间：2022 年度、2021 年度和 2020 年度。



1、事项描述

根据财务报表附注“五、10、固定资产”、“五、11、在建工程”所述，晶集成 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的固定资产和在建工程账面价值分别为 2,282,241.19 万元、1,965,504.58 万元和 915,678.28 万元，占资产总额的比例分别为 58.87%、62.85%和 58.54%。由于管理层对确定在建工程达到预定可使用状态转入固定资产的时点、估计固定资产的经济可使用年限及残值等方面的判断，会对固定资产和在建工程的账面价值确定造成影响，且该影响可能对合并财务报表具有重要性，因此我们将固定资产和在建工程账面价值确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对固定资产账面价值确认实施的相关程序主要包括：

(1) 了解与固定资产和在建工程确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 对比同行业固定资产的会计政策及会计估计，评价管理层对固定资产的经济可使用年限及残值的估计，复核相关会计政策及会计估计是否正确且一贯地运用；

(3) 选取固定资产及在建工程本期增加的样本，检查采购订单、发票、验收单据、付款单据等支持性文件，检查固定资产及在建工程入账价值及会计处理是否正确；

(4) 抽查在建工程达到预定可使用状态转入固定资产的单据，分析在建工程转入固定资产的时点是否异常；

(5) 实地检查重要的固定资产和在建工程；

(6) 复核折旧费用的计提与分配是否正确；

(7) 结合应付账款函证，向主要供应商函证本期采购额。



四、管理层和治理层对财务报表的责任

晶合集成管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估晶合集成的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算晶合集成、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督晶合集成的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对晶合集成持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在



重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致晶合集成不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就晶合集成中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

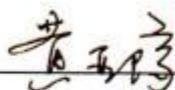
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

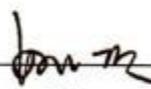


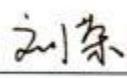
(此页无正文，为合肥晶合集成电路股份有限公司容诚审字[2023]230Z0133号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  
黄亚琼 (项目合伙人)

中国注册会计师:  
姚捷

中国注册会计师:  
刘荣

2023年3月1日



合并资产负债表

编制单位：合肥晶合集成电路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金	五、1	7,894,596,939.63	5,295,545,868.35	4,464,381,227.31
交易性金融资产	五、2	1,257,160,004.54		
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	五、3	506,672,375.18	948,852,726.93	265,220,095.91
应收款项融资				
预付款项	五、4	63,208,824.65	196,720,691.77	9,706,755.36
其他应收款	五、5	17,739,474.04	14,785,197.95	4,609,964.89
其中：应收利息				
应收股利				
存货	五、6	1,021,653,220.98	787,005,501.09	385,794,196.11
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	五、7	77,468,389.15	97,055,820.71	56,060,782.98
流动资产合计		10,838,499,228.17	7,339,965,806.80	5,185,773,022.56
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资				
其他权益工具投资	五、8	29,107,294.40		
其他非流动金融资产	五、9	301,733,208.33		
投资性房地产				
固定资产	五、10	21,437,368,245.69	16,325,987,525.29	7,766,077,816.88
在建工程	五、11	1,385,043,636.61	3,329,058,296.25	1,390,705,017.22
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	五、12	2,866,058,896.16	2,994,810,870.03	
无形资产	五、13	1,433,922,798.57	1,254,226,706.08	1,299,486,368.12
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	五、14	337,979.60	587,251.28	
递延所得税资产	五、15			
其他非流动资产	五、16	472,503,254.43	27,638,224.88	290,167.48
非流动资产合计		27,926,075,313.79	23,932,308,873.81	10,456,559,369.70
资产总计		38,764,574,541.96	31,272,274,680.61	15,642,332,392.26

法定代表人：

蔡智国

主管会计工作负责人：

朱伟

会计机构负责人：

王瑞



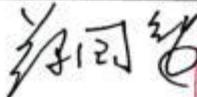
合并资产负债表（续）

编制单位：合肥晶合集成电路股份有限公司

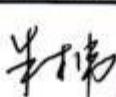
单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：				
短期借款	五、17	287,073,782.03	2,512,384,284.94	
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	五、18	926,245,358.53	2,487,629,756.02	1,113,785,875.49
预收款项				
合同负债	五、19	832,694,391.05	1,335,767,714.78	66,591,986.84
应付职工薪酬	五、20	368,249,010.83	185,234,288.25	12,773,286.36
应交税费	五、21	69,591,698.08	32,729,574.00	15,761,624.12
其他应付款	五、22	5,937,693,608.38	5,773,175,260.38	177,912,669.08
其中：应付利息				8,635,747.60
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	五、23	710,855,709.18	654,101,544.80	186,218,643.30
其他流动负债	五、24	78,944,030.61		
流动负债合计		9,211,347,588.69	12,981,022,423.17	1,573,044,085.19
非流动负债：				
长期借款	五、25	8,226,871,870.98	5,176,859,123.84	4,848,790,724.81
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	五、26	1,965,003,454.76	2,088,844,422.38	
长期应付款	五、27			929,312,245.46
长期应付职工薪酬	五、28	39,966,996.45	26,306,395.67	11,393,747.76
预计负债	五、29		847,053.42	2,748,659.56
递延收益	五、30	1,271,422,272.68	1,109,705,327.24	1,119,108,660.15
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		11,503,264,594.87	8,402,562,322.55	6,911,354,037.74
负债合计		20,714,612,183.56	21,383,584,745.72	8,484,398,122.93
所有者权益：				
股本	五、31	1,504,601,368.00	1,504,601,368.00	1,504,601,368.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	五、32	11,209,073,499.23	10,358,077,394.18	10,021,448,833.46
减：库存股				
其他综合收益	五、33	4,803,486.54	-272,705.48	468,627.68
专项储备				
盈余公积	五、34	26,575,971.33		
未分配利润	五、35	379,102,268.61	-2,639,752,570.35	-4,368,584,559.81
归属于母公司所有者权益合计		13,124,156,593.71	9,222,653,486.35	7,157,934,269.33
少数股东权益		4,925,805,764.69	666,036,448.54	
所有者权益合计		18,049,962,358.40	9,888,689,934.89	7,157,934,269.33
负债和所有者权益总计		38,764,574,541.96	31,272,274,680.61	15,642,332,392.26

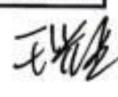
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




合并利润表

编制单位：合肥晶合集成电路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入		10,050,948,608.55	5,429,009,291.12	1,512,370,504.71
其中：营业收入	五、36	10,050,948,608.55	5,429,009,291.12	1,512,370,504.71
二、营业总成本		6,715,581,462.55	3,800,289,703.39	2,556,600,384.61
其中：营业成本	五、36	5,411,481,665.26	2,978,972,052.02	1,641,908,608.65
税金及附加	五、37	23,282,396.83	20,784,021.71	11,305,324.53
销售费用	五、38	59,737,022.38	39,687,781.14	19,794,919.01
管理费用	五、39	294,924,951.04	242,753,869.12	274,032,797.83
研发费用	五、40	857,070,011.90	396,684,911.99	244,675,569.19
财务费用	五、41	69,085,415.14	121,407,067.41	364,883,165.40
其中：利息费用		413,864,727.22	285,713,378.40	334,941,761.19
利息收入		77,457,373.16	29,183,209.75	24,277,059.65
加：其他收益	五、42	107,897,949.98	90,048,750.26	82,160,583.90
投资收益（损失以“-”号填列）	五、43	3,692,333.28	13,598,907.52	12,490,510.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、44	3,625,879.54		-3,265,902.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、45	-1,829,365.18	-250,094.09	241,830.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、46	-306,613,283.77	-4,886,424.42	-310,267,324.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、47			2,930.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,142,140,659.85	1,727,230,727.00	-1,262,867,251.73
加：营业外收入	五、48	14,348,231.85	8,077,652.66	5,476,116.30
减：营业外支出	五、49	84,667.63	6,045,341.22	76,942.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,156,404,224.07	1,729,263,038.44	-1,257,468,077.91
减：所得税费用	五、50	207,992.58	431,048.98	128,981.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,156,196,231.49	1,728,831,989.46	-1,257,597,059.28
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,156,196,231.49	1,728,831,989.46	-1,257,597,059.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,045,430,810.29	1,728,831,989.46	-1,257,597,059.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		110,765,421.20		
六、其他综合收益的税后净额	五、51	5,076,192.02	-741,333.16	-81,112.27
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,076,192.02	-741,333.16	-81,112.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益		5,350,678.40		
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动		5,350,678.40		
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益		-274,486.38	-741,333.16	-81,112.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额		-274,486.38	-741,333.16	-81,112.27
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额		3,161,272,423.51	1,728,090,656.30	-1,257,678,171.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		3,050,507,002.31	1,728,090,656.30	-1,257,678,171.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额		110,765,421.20		
八、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）		2.02	1.15	-0.27
（二）稀释每股收益（元/股）		2.02	1.15	-0.27

法定代表人：

汪同书

主管会计工作负责人：

朱伟

会计机构负责人：

毛光生



合并现金流量表

编制单位：合肥晶合集成电路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金		9,948,274,620.77	5,949,508,033.83	1,382,969,952.67
收到的税费返还		148,298,619.44	12,856,004.54	12,639,994.47
收到其他与经营活动有关的现金	五、52(1)	414,121,997.52	5,831,717,568.82	311,710,478.74
经营活动现金流入小计		10,510,695,237.73	11,794,081,607.19	1,707,320,425.88
购买商品、接受劳务支付的现金		2,784,466,288.05	1,405,310,009.95	731,619,617.31
支付给职工以及为职工支付的现金		1,280,438,498.59	694,462,560.71	412,216,889.76
支付的各项税费		28,578,476.18	20,562,349.72	20,710,653.83
支付其他与经营活动有关的现金	五、52(2)	137,178,577.52	99,861,680.81	69,944,457.36
经营活动现金流出小计		4,230,661,840.34	2,220,196,601.19	1,234,491,618.26
经营活动产生的现金流量净额		6,280,033,397.39	9,573,885,006.00	472,828,807.62
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金			2,641,000,000.00	3,771,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,692,333.28	13,598,907.52	12,490,510.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				2,930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		3,692,333.28	2,654,598,907.52	3,783,493,440.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,890,317,128.25	9,976,702,114.14	4,901,830,363.19
投资支付的现金		1,579,023,949.33	2,641,000,000.00	3,284,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		8,469,341,077.58	12,617,702,114.14	8,185,830,363.19
投资活动产生的现金流量净额		-8,465,648,744.30	-9,963,103,206.62	-4,402,336,923.06
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金		5,000,000,000.00	1,000,000,000.00	4,465,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
取得借款收到的现金		6,754,041,401.27	5,981,465,128.11	
收到其他与筹资活动有关的现金	五、52(3)	413,549,401.77		
筹资活动现金流入小计		12,167,590,803.04	6,981,465,128.11	4,465,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,806,334,235.50	2,830,595,097.93	116,086,411.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		319,826,010.16	294,971,073.41	286,198,982.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	五、52(4)	718,278,282.70	416,346,775.44	62,352,130.65
筹资活动现金流出小计		6,844,438,528.36	3,541,912,946.78	464,637,524.79
筹资活动产生的现金流量净额		5,323,152,274.68	3,439,552,181.33	4,000,362,475.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
		453,744,625.95	-5,955,308.75	-31,461,347.35
五、现金及现金等价物净增加额				
		3,591,281,553.72	3,044,378,671.96	39,393,012.42
加：期初现金及现金等价物余额		4,145,055,816.83	1,100,677,144.87	1,061,284,132.45
六、期末现金及现金等价物余额				
		7,736,337,370.55	4,145,055,816.83	1,100,677,144.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

编制单位：合肥国电智能电网股份有限公司 2022年度	归属母公司所有者权益										所有者权益合计		
	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		小计	少数股东权益
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,504,601,348.00				10,358,077,294.18		-372,705.48				9,221,653,486.35	666,036,448.54	9,888,689,934.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本期期初余额	1,504,601,348.00				10,358,077,294.18		-372,705.48				9,221,653,486.35	666,036,448.54	9,888,689,934.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					850,996,105.05		5,076,192.02		26,575,971.33	3,018,854,838.96	3,901,500,107.36	4,259,759,316.15	8,161,272,423.51
(一) 综合收益总额					850,996,105.05		5,076,192.02			3,045,470,810.29	3,898,567,003.31	110,765,421.20	3,161,272,423.51
(二) 所有者投入和减少资本											850,996,105.05	4,149,003,894.95	5,000,000,000.00
1. 股东投入的普通股					850,996,105.05						850,996,105.05	4,149,003,894.95	5,000,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									26,575,971.33	-26,575,971.33			
1. 提取盈余公积									26,575,971.33	-26,575,971.33			
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	1,504,601,348.00				11,209,073,499.33		4,893,086.54		26,575,971.33	378,102,268.61	13,124,156,993.71	4,925,805,764.09	18,049,963,758.49

法定代表人： 郑国波

主管会计工作负责人： 郭

会计机构负责人： 王



合并所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

	2011年度											
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,504,601,348.00				10,021,418,833.46	468,027.68			-1,268,584,259.81	7,157,934,269.33		7,157,934,269.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本期增减变动	1,504,601,348.00				10,021,418,833.46	468,027.68			-2,268,584,259.81	7,157,934,269.33		7,157,934,269.33
三、本年期初余额(减少以“-”号填列)					336,628,260.72	-741,333.16			1,728,831,989.46	2,064,719,217.02	666,036,448.54	2,730,755,665.56
(一)综合收益总额					336,628,260.72	-741,333.16			1,728,831,989.46	1,728,070,656.30		1,728,070,656.30
(二)所有者投入和减少资本										236,628,260.72	666,036,448.54	1,002,665,099.26
1. 投资者投入的普通股					333,963,351.46							
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					2,665,009.26					2,665,009.26		2,665,009.26
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,504,601,348.00				10,358,077,204.18	-272,705.48			-2,620,752,170.35	9,222,653,406.35	666,036,448.54	9,889,499,934.89

王静 郭 蔡智印



合并所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度												
	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	6,940,000,000.00						549,739.95				3,839,563,239.42		3,839,563,239.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本期期初余额	6,940,000,000.00						549,739.95				3,839,563,239.42		3,839,563,239.42
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-5,415,098,432.00				10,021,418,832.46		-81,112.27				3,328,372,039.91		3,328,372,039.91
(一) 综合收益总额							-81,112.27				-1,257,397,099.28		-1,257,397,099.28
(二) 所有者投入和减少资本	504,601,368.00				4,081,448,833.46						4,586,050,201.46		4,586,050,201.46
1. 股东投入的普通股	504,601,368.00				3,960,398,632.00						4,465,000,000.00		4,465,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					121,050,201.46						121,050,201.46		121,050,201.46
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	-5,940,000,000.00				5,940,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他	-5,940,000,000.00				5,940,000,000.00								
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,524,901,568.00				10,021,418,832.46		468,627.68				7,157,934,599.33		7,157,934,599.33

法定代表人：

蔡国智



主管会计工作负责人：

朱伟

会计机构负责人：

张欣



母公司资产负债表

编制单位：合肥晶合集成电路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金		7,878,771,236.11	4,278,599,053.25	4,460,889,364.41
交易性金融资产		1,257,160,004.54		
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	十五、1	757,726,323.32	979,359,185.07	265,220,095.91
应收款项融资				
预付款项		63,190,287.01	196,704,220.78	9,648,020.39
其他应收款	十五、2	388,150,628.49	4,492,329,048.13	4,164,229.13
其中：应收利息				
应收股利				
存货		893,015,829.52	695,007,102.27	385,794,196.11
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		77,075,208.03	96,883,977.97	55,600,738.12
流动资产合计		11,315,089,517.02	10,738,882,587.47	5,181,316,644.07
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	十五、3	4,021,127,950.00	4,021,127,950.00	21,127,950.00
其他权益工具投资		29,107,294.40		
其他非流动金融资产		301,733,208.33		
投资性房地产				
固定资产		9,601,955,391.05	9,853,849,766.12	7,765,520,396.50
在建工程		842,499,850.82	1,404,170,943.89	1,390,705,017.22
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产		2,865,874,890.85	2,994,031,834.55	
无形资产		1,427,736,640.04	1,247,337,793.78	1,299,480,036.53
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		337,979.60	587,251.28	
递延所得税资产				
其他非流动资产		466,780,032.25	27,638,224.88	290,167.48
非流动资产合计		19,557,153,237.34	19,548,743,764.50	10,477,123,567.73
资产总计		30,872,242,754.36	30,287,626,351.97	15,658,440,211.80

法定代表人：

蔡智

主管会计工作负责人：

朱伟

会计机构负责人：

孙悦



母公司资产负债表（续）

编制单位：合肥晶合集成电路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：				
短期借款		287,073,782.03	2,512,384,284.94	
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款		2,450,608,135.96	2,491,116,848.25	1,116,148,026.85
预收款项				
合同负债		832,694,391.05	1,335,767,714.78	66,591,986.84
应付职工薪酬		354,387,576.43	184,258,141.44	11,987,899.50
应交税费		68,136,036.82	30,999,986.24	15,554,671.01
其他应付款		5,937,074,821.34	5,772,857,221.68	177,912,669.08
其中：应付利息				8,635,747.60
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		707,233,782.88	653,483,880.25	186,218,643.30
其他流动负债		78,944,030.61		
流动负债合计		10,716,152,557.12	12,980,868,077.58	1,574,413,896.58
非流动负债：				
长期借款		5,079,871,870.98	5,176,859,123.84	4,848,790,724.81
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债		1,965,003,454.76	2,088,709,076.10	
长期应付款				929,312,245.46
长期应付职工薪酬		39,966,996.45	26,306,395.67	11,393,747.76
预计负债			847,053.42	2,748,659.56
递延收益		1,271,422,272.68	1,109,705,327.24	1,119,108,660.15
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		8,356,264,594.87	8,402,426,976.27	6,911,354,037.74
负债合计		19,072,417,151.99	21,383,295,053.85	8,485,767,934.32
所有者权益：				
股本		1,504,601,368.00	1,504,601,368.00	1,504,601,368.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		10,024,113,842.72	10,024,113,842.72	10,021,448,833.46
减：库存股				
其他综合收益		5,350,678.40		
专项储备				
盈余公积		26,575,971.33		
未分配利润		239,183,741.92	-2,624,383,912.60	-4,353,377,923.98
所有者权益合计		11,799,825,602.37	8,904,331,298.12	7,172,672,277.48
负债和所有者权益总计		30,872,242,754.36	30,287,626,351.97	15,658,440,211.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：合肥晶合集成电路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	十五、4	10,326,152,707.44	5,459,515,749.26	1,512,370,504.71
减：营业成本	十五、4	6,085,485,834.16	3,009,478,510.16	1,641,908,608.65
税金及附加		19,535,798.60	17,896,353.46	11,295,201.51
销售费用		59,737,022.38	39,687,781.14	19,794,919.01
管理费用		290,402,071.45	241,430,683.09	273,103,121.47
研发费用		808,078,141.17	397,597,702.39	246,181,223.72
财务费用		48,934,076.25	126,027,838.66	364,795,620.77
其中：利息费用		393,668,161.41	285,670,856.86	334,941,761.19
利息收入		72,745,729.67	24,635,171.67	24,276,987.07
加：其他收益		107,897,949.98	90,048,750.26	82,160,583.90
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	3,692,333.28	13,598,907.52	12,490,510.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,625,879.54		-3,265,902.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,829,255.18	-250,094.09	241,830.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-251,146,507.16	-4,886,424.42	-310,267,324.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）				2,930.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,876,220,163.89	1,725,908,019.63	-1,263,345,562.25
加：营业外收入		14,008,129.33	8,057,284.74	5,456,455.85
减：营业外支出		84,667.37	4,971,292.99	76,942.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,890,143,625.85	1,728,994,011.38	-1,257,966,048.75
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,890,143,625.85	1,728,994,011.38	-1,257,966,048.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,890,143,625.85	1,728,994,011.38	-1,257,966,048.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额		5,350,678.40		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		5,350,678.40		
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动		5,350,678.40		
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额		2,895,494,304.25	1,728,994,011.38	-1,257,966,048.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：合肥晶合集成电路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金		10,002,931,229.66	5,949,508,033.83	1,382,969,952.67
收到的税费返还		148,298,619.44	12,856,004.54	12,639,994.47
收到其他与经营活动有关的现金		408,820,889.06	5,826,621,501.08	311,690,745.71
经营活动现金流入小计		10,560,050,738.16	11,788,985,539.45	1,707,300,692.85
购买商品、接受劳务支付的现金		2,940,693,458.99	1,405,047,686.21	730,222,393.79
支付给职工以及为职工支付的现金		1,221,465,169.50	681,367,195.47	400,396,815.48
支付的各项税费		23,853,098.89	18,772,902.76	19,996,859.42
支付其他与经营活动有关的现金		150,367,935.61	112,049,495.86	84,571,799.95
经营活动现金流出小计		4,336,379,662.99	2,217,237,280.30	1,235,187,868.64
经营活动产生的现金流量净额		6,223,671,075.17	9,571,748,259.15	472,112,824.21
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金			2,641,000,000.00	3,771,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,692,333.28	13,598,907.52	12,490,510.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,893,342,831.11	3,987,726,220.91	2,930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		8,897,035,164.39	6,642,325,128.43	3,783,493,440.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,595,709,932.00	9,976,702,114.14	4,901,705,013.17
投资支付的现金		1,579,023,949.33	6,641,000,000.00	3,284,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		8,174,733,881.33	16,617,702,114.14	8,186,105,013.17
投资活动产生的现金流量净额		722,301,283.06	-9,975,376,985.71	-4,402,611,573.04
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				4,465,000,000.00
取得借款收到的现金		3,607,041,401.27	5,981,465,128.11	
收到其他与筹资活动有关的现金		413,549,401.77		
筹资活动现金流入小计		4,020,590,803.04	5,981,465,128.11	4,465,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,806,334,235.50	2,830,595,097.93	116,086,411.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		303,123,137.93	294,971,073.41	286,198,982.18
支付其他与筹资活动有关的现金		717,706,982.00	415,706,987.76	62,352,130.65
筹资活动现金流出小计		6,827,164,355.43	3,541,273,159.10	464,637,524.79
筹资活动产生的现金流量净额		-2,806,573,552.39	2,440,191,969.01	4,000,362,475.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
		453,873,859.46	-5,639,522.69	-31,388,043.75
五、现金及现金等价物净增加额				
		4,593,272,665.30	2,030,923,719.76	38,475,682.63
加：期初现金及现金等价物余额		3,128,109,001.73	1,097,185,281.97	1,058,709,599.34
六、期末现金及现金等价物余额				
		7,721,381,667.03	3,128,109,001.73	1,097,185,281.97

法定代表人：

蔡国智

主管会计工作负责人：

朱伟

会计机构负责人：

王斌



母公司所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

编制单位：合肥国智光电股份有限公司	2022年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,504,601,368.00				10,024,113,842.72					-2,624,383,912.60	8,904,331,298.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期期初余额	1,504,601,368.00				10,024,113,842.72					-2,624,383,912.60	8,904,331,298.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一)综合收益总额						5,350,678.40			26,575,971.33	2,863,567,654.52	2,895,494,304.25
(二)所有者投入和减少资本						5,350,678.40			2,890,143,625.83		2,895,494,304.25
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积									26,575,971.33	-26,575,971.33	
2. 对所有者(或股东)的分配									26,575,971.33	-26,575,971.33	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,504,601,368.00				10,024,113,842.72	5,350,678.40			26,575,971.33	239,183,741.92	11,799,825,602.37

法定代表人：蔡国智

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：王娟

蔡国智

李伟

王娟



母公司所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度						所有者权益合计					
	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股		其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
	优先股	普通股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,504,601,368.00					10,021,448,833.46					-4,353,377,923.98	7,172,672,277.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,504,601,368.00					10,021,448,833.46					-4,353,377,923.98	7,172,672,277.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						2,665,009.26					1,728,994,011.38	1,731,659,020.64
(一) 综合收益总额											1,728,994,011.38	1,728,994,011.38
(二) 所有者投入和减少资本						2,665,009.26						2,665,009.26
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额						2,665,009.26						2,665,009.26
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,504,601,368.00					10,024,113,842.72					-2,624,383,912.60	8,904,331,298.12

法定代表人：

蔡国智

主管会计工作负责人：

郭伟

会计机构负责人：

王琳



母公司所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

编制单位：合肥晶合集成电路股份有限公司	2020年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,940,000,000.00										3,844,588,124.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期期初余额	6,940,000,000.00										3,844,588,124.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-5,435,398,632.00				10,021,448,833.46						3,328,084,152.71
(一)综合收益总额											-1,257,966,048.75
(二)所有者投入和减少资本	504,601,368.00				4,081,448,833.46						4,586,050,201.46
1. 股东投入的普通股	504,601,368.00				3,960,398,632.00						4,465,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					121,050,201.46						121,050,201.46
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	-5,940,000,000.00				5,940,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他	-5,940,000,000.00				5,940,000,000.00						
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,504,601,368.00				10,021,448,833.46						7,172,672,377.48

法定代表人：蔡智国

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：王瑞



蔡智国



合肥晶合集成电路股份有限公司

财务报表附注

2020 年至 2022 年

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

1. 公司概况

公司名称：合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

公司注册地址：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号。

法定代表人：蔡国智。

公司经营范围：集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售。

财务报告批准报出日：本财务报表于 2023 年 3 月 1 日经本公司董事会决议批准报出。

2. 历史沿革

(1) 有限公司设立及出资

本公司是由合肥晶合集成电路有限公司（以下简称“晶合有限”）整体变更设立的股份有限公司。2015 年 5 月，经合肥市人民政府国有资产监督管理委员会批准（合国资产产权[2015]60 号），晶合有限于 2015 年 5 月 19 日设立。晶合有限设立时注册资本为人民币 1,000.00 万元，由合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”）全额认缴。

晶合有限设立时的股权结构如下：

序号	出资人姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投	1,000.00	1,000.00	100.00
	合计	1,000.00	1,000.00	100.00

(2) 有限公司第一次增资

2016 年 1 月，根据董事会决议和修改后的章程规定，并经合肥市人民政府国有资产监督管理委员会审批（合国资产产权[2016]9 号）及合肥市商务局审批（合商审[2016]7 号），晶合有限增加注册资本 110,000.00 万元，其中合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合肥芯屏”）以货币出资 99,996.28 万元、力晶科技股份有限公司（以下简称“力

晶科技”)以货币出资 10,000.00 万元、合肥建投以晶合有限 2015 年 11 月 30 日经审计的未分配利润转增 3.72 万元,增资后的注册资本为人民币 111,000.00 万元。本次增资业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具会验字[2016]2407 号《验资报告》审验。2016 年 2 月,晶合有限对本次增资事宜办理了工商变更登记。

本次增资完成后,晶合有限的股权结构如下:

序号	出资人姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	合肥建投	1,003.72	1,003.72	0.90
2	合肥芯屏	99,996.28	99,996.28	90.09
3	力晶科技	10,000.00	10,000.00	9.01
合计		111,000.00	111,000.00	100.00

(3)有限公司第二次增资

2017 年 3 月,根据董事会决议和修改后的章程规定,并经合肥市人民政府国有资产监督管理委员会审批(合国资产权[2017]45 号),晶合有限增加注册资本 446,000.00 万元,其中力晶科技以货币出资 20,000.00 万元、以技术出资 200,000.00 万元,合肥建投以货币出资 226,000.00 万元,增资后的注册资本为人民币 557,000.00 万元。本次增资业经安徽安智会计师事务所出具安智验字[2017]第 021 号《验资报告》审验。2017 年 3 月,晶合有限对本次增资事宜办理了工商变更登记。

本次增资完成后,晶合有限的股权结构如下:

序号	出资人姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	合肥建投	227,003.72	227,003.72	40.76
2	合肥芯屏	99,996.28	99,996.28	17.95
3	力晶科技	230,000.00	230,000.00	41.29
合计		557,000.00	557,000.00	100.00

(4)有限公司第三次增资

2018 年 10 月,根据董事会决议和修改后的章程规定,晶合有限增加注册资本 137,000.00 万元,其中力晶科技以货币出资 56,500.00 万元,合肥芯屏以货币出资 80,500.00 万元,增资后的注册资本为人民币 694,000.00 万元,本次增资业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具会验字[2018]5985 号《验资报告》审验。2018 年 10 月,晶合有限对本次增资事宜办理了工商变更登记。

本次增资完成后,晶合有限的股权结构如下:

序号	出资人姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投	227,003.72	227,003.72	32.71
2	合肥芯屏	180,496.28	180,496.28	26.01
3	力晶科技	286,500.00	286,500.00	41.28
合计		694,000.00	694,000.00	100.00

(5)有限公司减资

2020年7月，根据董事会决议和修改后的章程规定，并经合肥市人民政府国有资产监督管理委员会审批，晶合有限减少注册资本594,000.00万元，变更后的注册资本为人民币100,000.00万元，股东持股比例不变。本次减资业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]230Z0190号《验资报告》审验。2020年9月15日，晶合有限对本次减资事宜办理了工商变更登记。

本次减资完成后，晶合有限的股权结构如下：

序号	出资人姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投	32,709.47	32,709.47	32.71
2	合肥芯屏	26,008.11	26,008.11	26.01
3	力晶科技	41,282.42	41,282.42	41.28
合计		100,000.00	100,000.00	100.00

(6)有限公司第四次增资

2020年9月，根据增资协议、董事会决议和修改后的章程规定，并经合肥市人民政府国有资产监督管理委员会审批（合国资产权[2020]84号），晶合有限增加注册资本人民币23,219.7669万元，变更后的注册资本为人民币123,219.7669万元。其中合肥建投出资14,137.9895万元、合肥芯屏出资6,865.5704万元、合肥晶煨企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥晶煨”）出资519.5398万元、合肥晶咖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥晶咖”）出资145.6606万元、合肥晶珏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥晶珏”）出资126.2054万元、合肥晶悬企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥晶悬”）出资85.2648万元、合肥晶辽企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥晶辽”）出资49.7378万元、合肥晶梢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥晶梢”）出资117.4082万元、合肥晶柔企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥晶柔”）出资86.2798万元、合肥晶炯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥晶炯”）出资381.3060万元、合肥晶雄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥晶雄”）出资25.3764万元、合肥晶本企业管理合伙企业（有

限合伙) (以下简称“合肥晶本”) 出资 77.9902 万元、合肥晶洛企业管理合伙企业(有限合伙) (以下简称“合肥晶洛”) 出资 58.1966 万元、合肥晶确企业管理合伙企业(有限合伙) (以下简称“合肥晶确”) 出资 41.4481 万元、合肥晶遂企业管理合伙企业(有限合伙) (以下简称“合肥晶遂”) 出资 419.7429 万元、合肥晶铁企业管理合伙企业(有限合伙) (以下简称“合肥晶铁”) 出资 41.4481 万元及合肥晶妥企业管理合伙企业(有限合伙) (以下简称“合肥晶妥”) 出资 40.6023 万元。本次增资业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 出具容诚验字[2020]230Z0191 号《验资报告》审验。2020 年 9 月 16 日, 晶合有限对本次增资事宜办理了工商变更登记。

本次增资完成后, 晶合有限的股权结构如下:

序号	出资人姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	合肥建投	46,847.46	46,847.46	38.03
2	合肥芯屏	32,873.68	32,873.68	26.68
3	力晶科技	41,282.42	41,282.42	33.50
4	合肥晶焮	519.54	519.54	0.42
5	合肥晶遂	419.74	419.74	0.34
6	合肥晶炯	381.31	381.31	0.31
7	合肥晶咖	145.66	145.66	0.12
8	合肥晶珏	126.21	126.21	0.10
9	合肥晶梢	117.41	117.41	0.10
10	合肥晶柔	86.28	86.28	0.07
11	合肥晶息	85.26	85.26	0.07
12	合肥晶本	77.99	77.99	0.06
13	合肥晶洛	58.20	58.20	0.05
14	合肥晶辽	49.74	49.74	0.04
15	合肥晶确	41.45	41.45	0.03
16	合肥晶铁	41.45	41.45	0.03
17	合肥晶妥	40.60	40.60	0.03
18	合肥晶雄	25.38	25.38	0.02
合计		123,219.78	123,219.78	100.00

(7) 有限公司第五次增资

2020 年 9 月, 根据增资协议、董事会决议和修改后的章程规定, 并经合肥市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意引入战略投资者对合肥晶合集成电路有限公司增

资扩股的批复》(合国资产权(2020)89号)审批,晶合有限增加注册资本人民币27,240.3699万元,变更后的注册资本为人民币150,460.1368万元。其中美的创新投资有限公司(以下简称“美的创新”)出资8,801.4118万元,合肥中安智芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中安智芯”)出资3,960.6354万元、深圳市惠友豪创科技投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“惠友豪创”)出资2,640.4236万元、合肥存鑫集成电路投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥存鑫”)出资2,640.4236万元、海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创新”)出资1,760.2824万元、杭州承富投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州承富”)出资1,540.2471万元、泸州隆信投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泸州隆信”)出资1,320.2118万元、宁波华淳投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波华淳”)出资1,320.2118万元、中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)(以下简称“中小企业基金”)出资1,320.2118万元、安徽安华创新风险投资基金有限公司(以下简称“安华创新”)出资880.1412万元、北京集创北方科技股份有限公司(以下简称“集创北方”)出资880.1412万元及中金浦成投资有限公司(以下简称“中金浦成”)出资176.0282万元认缴。本次增资业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚验字[2020]230Z0205号《验资报告》审验。2020年9月28日,晶合有限对本次增资事宜办理了工商变更登记。

本次增资完成后,晶合有限的股权结构如下:

序号	出资人姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	合肥建投	46,847.46	46,847.46	31.14
2	合肥芯屏	32,873.68	32,873.68	21.85
3	力晶科技	41,282.42	41,282.42	27.44
4	美的创新	8,801.41	8,801.41	5.85
5	中安智芯	3,960.64	3,960.64	2.63
6	惠友豪创	2,640.42	2,640.42	1.75
7	合肥存鑫	2,640.42	2,640.42	1.75
8	海通创新	1,760.28	1,760.28	1.17
9	杭州承富	1,540.25	1,540.25	1.02
10	泸州隆信	1,320.21	1,320.21	0.88
11	宁波华淳	1,320.21	1,320.21	0.88
12	中小企业基金	1,320.21	1,320.21	0.88
13	安华创新	880.14	880.14	0.58

序号	出资人姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
14	集创北方	880.14	880.14	0.58
15	合肥晶煨	519.54	519.54	0.35
16	合肥晶遂	419.74	419.74	0.28
17	合肥晶炯	381.31	381.31	0.25
18	中金浦成	176.03	176.03	0.12
19	合肥晶咖	145.66	145.66	0.10
20	合肥晶珏	126.21	126.21	0.08
21	合肥晶梢	117.41	117.41	0.08
22	合肥晶柔	86.28	86.28	0.06
23	合肥晶悬	85.26	85.26	0.06
24	合肥晶本	77.99	77.99	0.05
25	合肥晶洛	58.20	58.20	0.04
26	合肥晶辽	49.74	49.74	0.03
27	合肥晶确	41.45	41.45	0.03
28	合肥晶铁	41.45	41.45	0.03
29	合肥晶妥	40.60	40.60	0.03
30	合肥晶雄	25.38	25.38	0.02
合计		150,460.14	150,460.14	100.00

(8)有限公司整体变更股份公司

2020年11月20日，根据股东大会和修改后的章程规定，并经合肥市人民政府国有资产监督管理委员会审批（合国资产权（2020）105号），同意以晶合有限截至2020年9月30日经审计的净资产735,314.0546万元按比例折股，整体变更设立股份有限公司，折合股本的金额为150,460.1368万元，资本公积和未分配利润在变更前后保持不变。

本次变更业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]230Z0263号《验资报告》审验。2020年11月25日，公司对本次增资事宜办理了工商变更登记。

股份公司设立时，本公司股权结构如下：

序号	股东姓名	股份数额（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	合肥建投	46,847.46	31.14	净资产
2	合肥芯屏	32,873.68	21.85	净资产
3	力晶科技	41,282.42	27.44	净资产
4	美的创新	8,801.41	5.85	净资产

序号	股东姓名	股份数额(万股)	持股比例(%)	出资方式
5	中安智芯	3,960.64	2.63	净资产
6	惠友豪创	2,640.42	1.75	净资产
7	合肥存鑫	2,640.42	1.75	净资产
8	海通创新	1,760.28	1.17	净资产
9	杭州承富	1,540.25	1.02	净资产
10	泸州隆信	1,320.21	0.88	净资产
11	宁波华淳	1,320.21	0.88	净资产
12	中小企业基金	1,320.21	0.88	净资产
13	安华创新	880.14	0.58	净资产
14	集创北方	880.14	0.58	净资产
15	合肥晶煅	519.54	0.35	净资产
16	合肥晶遂	419.74	0.28	净资产
17	合肥晶炯	381.31	0.25	净资产
18	中金浦成	176.03	0.12	净资产
19	合肥晶咖	145.66	0.10	净资产
20	合肥晶珏	126.21	0.08	净资产
21	合肥晶梢	117.41	0.08	净资产
22	合肥晶柔	86.28	0.06	净资产
23	合肥晶悬	85.26	0.06	净资产
24	合肥晶本	77.99	0.05	净资产
25	合肥晶洛	58.20	0.04	净资产
26	合肥晶辽	49.74	0.03	净资产
27	合肥晶确	41.45	0.03	净资产
28	合肥晶铁	41.45	0.03	净资产
29	合肥晶妥	40.60	0.03	净资产
30	合肥晶雄	25.38	0.02	净资产
合计		150,460.14	100.00	—

3. 合并财务报表范围及变化

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	晶合日本株式会社	日本晶合	100.00	-

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
2	晶芯成（北京）科技有限公司	北京晶芯成	100.00	-
3	南京晶驱集成电路有限公司	南京晶驱	100.00	-
4	合肥新品集成电路有限公司	新品集成	52.02	-

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	晶芯成（北京）科技有限公司	北京晶芯成	2020 年度	新 设
2	南京晶驱集成电路有限公司	南京晶驱	2020 年度	新 设
3	合肥新品集成电路有限公司	新品集成	2021 年度	新 设

本报告期内无减少子公司情况。

本报告期内新增子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财

务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。

③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

(3) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(4) 报告期内增加子公司的处理

同一控制下企业合并增加的子公司或业务

①编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

②编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

③编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(5) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

6. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

8. 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

A.如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

B.如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具

的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 因销货而产生的应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 无风险组合（纳入合并范围内的关联方款项、应收退税款、押金及保证金、员工借款及备用金等）

其他应收款组合 4 账龄组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③ 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没

有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或

报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、9。

9. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

10. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、备品备件、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

11. 合同资产及合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时

间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、8。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

12. 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失,并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债:

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值

准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

13. 长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该

资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的

初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、18。

14. 固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	-	5.00-3.33
机器设备	年限平均法	5-10 年	-	20.00-10.00
运输工具	年限平均法	4 年	-	25.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	-	33.33-20.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法(适用 2020 年度及以前)

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15. 在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
专利权及非专利技术	10-12年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件及其他	1-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18. 长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产及无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

20. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将

全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末,本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

- A.服务成本;
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22. 股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

23. 收入确认原则和计量方法

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代

第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户

转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务，公司在客户或其委托的其他公司签收后确认收入。

②提供服务

本公司与客户之间的提供服务合同包含运行维护的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益（或本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项），本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

24. 政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

（3）政府补助的会计处理

- ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税

的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

26. 租赁

自 2021 年 1 月 1 日起适用

(1) 租赁的识别

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

A. 租赁负债的初始计量金额；

B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

C. 承租人发生的初始直接费用；

D. 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注三、21。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

各类使用权资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	-	5.00-3.33
机器设备	年限平均法	5-10 年	-	20.00-10.00
运输工具	年限平均法	4 年	-	25.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	-	33.33-20.00

类别	折旧方法	使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
土地使用权	年限平均法	根据产权证书记载年限确定	-	根据产权证书记载年限确定

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容:

A.固定付款额及实质固定付款额, 存在租赁激励的, 扣除租赁激励相关金额;

B.取决于指数或比率的可变租赁付款额;

C.购买选择权的行权价格, 前提是承租人合理确定将行使该选择权;

D.行使终止租赁选择权需支付的款项, 前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;

E.根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率, 无法确定租赁内含利率的, 采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用, 在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用, 并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后, 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时, 本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债, 并相应调整使用权资产的账面价值。

以下经营租赁和融资租赁会计政策适用于 2020 年度及以前

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁, 除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时, 将经营租赁的租金支出, 在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的, 本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法或其他合理的方法进行分摊, 免租期内

确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)

2017 年 7 月 5 日, 财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入(2017 年修订)》(财会【2017】22 号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则, 对会计政策的相关内容进行调整, 详见附注三、23。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时, 本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2019 年 12 月 10 日, 财政部发布了《企业会计准则解释第 13 号》。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行该解释, 对以前年度不进行追溯。

执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会【2018】35 号)

2018 年 12 月 7 日, 财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则, 其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则, 对会计政策的相关内容进行调整, 详见附注三、26。

对于首次执行日前已存在的合同, 本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同, 本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整:

A.对于首次执行日前的融资租赁, 本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值, 分别计量使用权资产和租赁负债;

B.对于首次执行日前的经营租赁, 本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次

执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

C.在首次执行日，本公司按照附注三、18 对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

A.将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

B.计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

C.使用权资产的计量不包含初始直接费用；

D.存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

E.作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

F.首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定。

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号) (以下简称“解释 15 号”)，其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”(以下简称“试运行销售的会计处理规定”)和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，

以下简称解释 16 号)，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

(3) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动负债：			
预收款项	24,215,645.67	-	-24,215,645.67
合同负债	-	24,215,645.67	24,215,645.67

母公司资产负债表

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动负债：			
预收款项	24,215,645.67	-	-24,215,645.67
合同负债	-	24,215,645.67	24,215,645.67

(4) 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
预付账款	9,706,755.36	9,653,359.93	-53,395.43
非流动资产：			
固定资产	7,766,077,816.88	6,146,177,842.97	-1,619,899,973.91
使用权资产	-	1,695,127,889.26	1,695,127,889.26
流动负债：			
应付账款	1,113,785,875.49	1,106,744,606.23	-7,041,269.26
一年内到期的非流动负债	186,218,643.30	191,013,156.45	4,794,513.15

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
非流动负债：			
租赁负债	-	972,657,269.10	972,657,269.10
长期应付款	929,312,245.46	-	-929,312,245.46
递延收益	1,119,108,660.15	1,153,184,912.54	34,076,252.39

母公司资产负债表

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产：			
固定资产	7,765,520,396.50	6,145,620,422.59	-1,619,899,973.91
使用权资产	-	1,693,572,207.97	1,693,572,207.97
流动负债：			
应付账款	1,116,148,026.85	1,109,106,757.59	-7,041,269.26
一年内到期的非流动负债	186,218,643.30	191,013,156.45	4,794,513.15
非流动负债：			
租赁负债	-	971,154,983.24	971,154,983.24
长期应付款	929,312,245.46	-	-929,312,245.46
递延收益	1,119,108,660.15	1,153,184,912.54	34,076,252.39

四、税项

1. 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、13%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地面积	5 元/平方米

晶合日本株式会社按日本国内税法缴纳消费税、法人税及其他税费。

2. 税收优惠

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《安徽省 2020 年第二批高新技术企业通过认定名单的通知》（皖科高〔2020〕37 号），本

公司被认定为安徽省 2020 年第二批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号为 GR2020003384，有效期：3 年）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自 2020 年度起适用 15% 的所得税税率。

五、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	-	-	-
银行存款	7,736,337,370.55	4,145,055,816.83	1,100,677,144.87
其他货币资金	158,259,569.08	1,150,490,051.52	3,363,704,082.44
合计	7,894,596,939.63	5,295,545,868.35	4,464,381,227.31
其中：存放在境外的款项总额	863,266.18	1,530,026.44	3,149,746.24

(1) 其他货币资金系存入的押汇保证金、信用证保证金、保函保证金。

(2) 除其他货币资金中的押汇保证金、信用证保证金、保函保证金外，报告期各期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 交易性金融资产

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,257,160,004.54	-	-
其中：结构性存款投资	956,602,671.21	-	-
可转让大额存单	300,557,333.33	-	-
合计	1,257,160,004.54	-	-

注：本公司交易性金融资产系购入的保本浮动收益型结构性存款和可转让大额存单。

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	508,745,236.89	948,853,015.93	265,220,095.91
小计	508,745,236.89	948,853,015.93	265,220,095.91
减：坏账准备	2,072,861.71	289.00	-
合计	506,672,375.18	948,852,726.93	265,220,095.91

(2) 按坏账计提方法分类披露

①2022年12月31日

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	508,745,236.89	100.00	2,072,861.71	0.41	506,672,375.18
其中：因销货产生的应收款项	508,745,236.89	100.00	2,072,861.71	0.41	506,672,375.18
合计	508,745,236.89	100.00	2,072,861.71	0.41	506,672,375.18

②2021年12月31日

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	948,853,015.93	100.00	289.00	0.00	948,852,726.93
其中：因销货产生的应收款项	948,853,015.93	100.00	289.00	0.00	948,852,726.93
合计	948,853,015.93	100.00	289.00	0.00	948,852,726.93

③2020年12月31日

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	265,220,095.91	100.00	-	-	265,220,095.91
其中：因销货产生的应收款项	265,220,095.91	100.00	-	-	265,220,095.91
合计	265,220,095.91	100.00	-	-	265,220,095.91

各报告期坏账准备计提的具体说明：

2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日，按因销货产生的应收款项计提坏账准备的应收账款

逾期时间	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	467,288,002.69	-	-
逾期时间0-60天(含)	41,457,234.20	2,072,861.71	5.00
合计	508,745,236.89	2,072,861.71	0.41

(续上表)

逾期时间	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	948,847,235.93	-	-
逾期时间0-60天(含)	5,780.00	289.00	5.00
合计	948,853,015.93	289.00	0.00

(续上表)

逾期时间	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	265,220,095.91	-	-
合计	265,220,095.91	-	-

(3) 坏账准备的变动情况

①2022年度变动情况

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	289.00	2,072,572.71	-	-	2,072,861.71
合计	289.00	2,072,572.71	-	-	2,072,861.71

②2021年的变动情况

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	-	289.00	-	-	289.00
合计	-	289.00	-	-	289.00

③2020年的变动情况

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	230,833.74	-230,833.74	-	-	-

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
合计	230,833.74	-230,833.74	-	-	-

(4) 各报告期无实际核销应收账款情况。

(5) 各报告期按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	2022年12月31日余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
联咏科技股份有限公司	157,392,594.94	30.94	-
深圳天德钰科技股份有限公司	91,331,535.73	17.95	1,684,644.46
深圳市爱协生科技股份有限公司	68,657,646.65	13.50	-
合肥奕斯伟计算技术有限公司	20,560,195.66	4.04	887.99
合肥豪迪微电子有限公司	19,044,698.70	3.74	-
合计	356,986,671.68	70.17	1,685,532.45

(续上表)

单位名称	2021年12月31日余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
联咏科技股份有限公司	317,728,801.54	33.49	-
北京集创北方科技股份有限公司	187,856,369.54	19.80	-
奇景光电股份有限公司	89,656,591.69	9.45	-
思特威(合肥)电子科技有限公司	67,249,123.91	7.09	-
敦泰电子股份有限公司	59,506,665.10	6.27	-
合计	721,997,551.78	76.09	-

(续上表)

单位名称	2020年12月31日余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
联咏科技股份有限公司	195,949,442.85	73.88	-
集创北方(香港)有限公司	32,782,343.86	12.36	-
合肥捷达微电子有限公司	17,171,116.06	6.47	-
奇景光电股份有限公司	8,416,579.43	3.17	-
NewVisionMicro. (HK) Limited	3,655,154.37	1.38	-
合计	257,974,636.57	97.26	-

(6) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	63,206,464.55	100.00	196,720,691.77	100.00	9,695,907.36	99.89
1至2年	2,360.10	0.00	-	-	10,848.00	0.11
合计	63,208,824.65	100.00	196,720,691.77	100.00	9,706,755.36	100.00

注：本公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 各报告期按预付对象归集的余额前五名的预付款项情况

单位名称	2022年12月31日余额	占预付款项余额合计数的比例(%)
TOPPAN CHUNGHWA ELECTRONICS CO.,LTD	39,772,635.17	62.92
中国太平洋财产保险股份有限公司合肥中心支公司	17,655,394.01	27.93
南京中静裕德信息科技有限公司	962,961.43	1.52
中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司	955,577.31	1.51
上海开赞数字技术有限公司	566,037.76	0.90
合计	59,912,605.68	94.78

(续上表)

单位名称	2021年12月31日余额	占预付款项余额合计数的比例(%)
GlobalWafers Co., Ltd.	178,850,285.60	90.92
中国太平洋财产保险股份有限公司合肥中心支公司	5,761,209.30	2.93
Nikko Metals Taiwan Co.,Ltd Science park	5,467,148.90	2.78
Siltronic Singapore Pte.Ltd	2,407,382.92	1.22
南京中静裕德信息科技有限公司	693,638.21	0.35
合计	193,179,664.93	98.20

(续上表)

单位名称	2020年12月31日余额	占预付款项余额合计数的比例(%)
Nikko Metals Taiwan Co.,Ltd Science park	2,974,912.36	30.65
中国太平洋财产保险股份有限公司合肥中心支公司	1,763,130.54	18.16

单位名称	2020年12月31日余额	占预付款项余额合计数的比例(%)
FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP.	1,070,714.02	11.03
南京中静裕德信息科技有限公司	698,658.49	7.20
合肥鑫城国有资产经营有限公司	455,700.00	4.69
合计	6,963,115.41	71.73

5. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	17,739,474.04	14,785,197.95	4,609,964.89
合计	17,739,474.04	14,785,197.95	4,609,964.89

(2) 应收利息

①分类列示

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
定期存款、大额存单	-	-	-
小计	-	-	-
减：坏账准备	-	-	-
合计	-	-	-

②各报告期期末无逾期利息。

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	17,030,760.09	13,594,247.43	2,723,991.41
1至2年	169,312.00	400,000.00	837,549.12
2至3年	400,000.00	67,449.12	102,500.00
3年以上	147,310.91	974,617.89	947,235.76
小计	17,747,383.00	15,036,314.44	4,611,276.29
减：坏账准备	7,908.96	251,116.49	1,311.40
合计	17,739,474.04	14,785,197.95	4,609,964.89

②按款项性质分类情况

款项性质	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收退税款	10,020,499.67	6,440,612.57	156,298.60
押金及保证金	4,042,337.77	1,941,412.08	2,287,146.67
员工借款及备用金	3,526,366.31	1,633,203.91	2,141,741.06
其他	158,179.25	5,021,085.88	26,089.96
小计	17,747,383.00	15,036,314.44	4,611,276.29
减：坏账准备	7,908.96	251,116.49	1,311.40
合计	17,739,474.04	14,785,197.95	4,609,964.89

③按坏账计提方法分类披露

A. 截至2022年12月31日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	17,747,383.00	7,908.96	17,739,474.04
第二阶段	-	-	-
第三阶段	-	-	-
合计	17,747,383.00	7,908.96	17,739,474.04

截至2022年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	17,747,383.00	0.04	7,908.96	17,739,474.04
其中：无风险组合	17,589,203.75	-	-	17,589,203.75
账龄组合	158,179.25	5.00	7,908.96	150,270.29
合计	17,747,383.00	0.04	7,908.96	17,739,474.04

其中：2022年12月31日，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收退税款	10,020,499.67	-	-
押金及保证金	4,042,337.77	-	-
员工借款及备用金	3,526,366.31	-	-
合计	17,589,203.75	-	-

其中：2022年12月31日，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	158,179.25	7,908.96	5.00
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	158,179.25	7,908.96	5.00

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段及第三阶段的坏账准备。

B. 截至 2021 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	15,036,314.44	251,116.49	14,785,197.95
第二阶段	-	-	-
第三阶段	-	-	-
合计	15,036,314.44	251,116.49	14,785,197.95

截至 2021 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	15,036,314.44	1.67	251,116.49	14,785,197.95
其中：无风险组合	10,015,228.56	-	-	10,015,228.56
账龄组合	5,021,085.88	5.00	251,116.49	4,769,969.39
合计	15,036,314.44	1.67	251,116.49	14,785,197.95

其中：2021 年 12 月 31 日，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收退税款	6,440,612.57	-	-
押金及保证金	1,941,412.08	-	-
员工借款及备用金	1,633,203.91	-	-
合计	10,015,228.56	-	-

其中：2021 年 12 月 31 日，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,020,947.67	251,047.38	5.00
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	138.21	69.11	50.00

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合计	5,021,085.88	251,116.49	5.00

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段及第三阶段的坏账准备。

C. 截至 2020 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	4,611,276.29	1,311.40	4,609,964.89
第二阶段	-	-	-
第三阶段	-	-	-
合计	4,611,276.29	1,311.40	4,609,964.89

截至 2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,611,276.29	0.03	1,311.40	4,609,964.89
其中：无风险组合	4,585,186.33	-	-	4,585,186.33
账龄组合	26,089.96	5.03	1,311.40	24,778.56
合计	4,611,276.29	0.03	1,311.40	4,609,964.89

其中：2020 年 12 月 31 日，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金及保证金	2,287,146.67	-	-
员工借款及备用金	2,141,741.06	-	-
应收退税款	156,298.60	-	-
合计	4,585,186.33	-	-

其中：2020 年 12 月 31 日，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,951.75	1,297.58	5.00
1 至 2 年	138.21	13.82	10.00
合计	26,089.96	1,311.40	5.03

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段及第三阶段的坏账准备。

④坏账准备的变动情况

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	251,116.49	-243,207.53	-	-	7,908.96
合计	251,116.49	-243,207.53	-	-	7,908.96

(续上表)

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	1,311.40	249,805.09	-	-	251,116.49
合计	1,311.40	249,805.09	-	-	251,116.49

(续上表)

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	12,308.60	-10,997.20	-	-	1,311.40
合计	12,308.60	-10,997.20	-	-	1,311.40

⑤各报告期无实际核销其他应收款情况。

⑥各报告期按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2022年12月31日余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备
应收退税款	应收退税款	10,020,499.67	1年以内	56.46	-
合肥市住房租赁发展股份有限公司	押金及保证金	1,526,950.00	2年以内	8.60	-
合肥新创投资控股有限公司	押金及保证金	766,500.00	1年以内	4.32	-
合肥合燃华润燃气有限公司	押金及保证金	720,000.00	3年以内	4.06	-
安徽逐梦房产管理有限公司	押金及保证金	450,000.00	1年以内	2.54	-
合计	—	13,483,949.67	—	75.98	-

(续上表)

单位名称	款项的性质	2021年12月31日余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备
应收退税款	应收退税款	6,440,612.57	1年以内	42.83	-
中国太平洋财产保险股份有限公司安徽分公司	赔偿款	4,974,120.66	1年以内	33.08	248,706.03

单位名称	款项的性质	2021年12月31日余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备
合肥鑫城国有资产经营有限公司	押金及保证金	714,000.00	6年以内	4.75	-
合肥燃气集团有限公司	押金及保证金	400,000.00	2年以内	2.66	-
合肥市住房租赁发展股份有限公司	押金及保证金	219,000.00	1年以内	1.46	-
合计	—	12,747,733.23	—	84.78	248,706.03

(续上表)

单位名称	款项的性质	2020年12月31日余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备
合肥鑫城国有资产经营有限公司	押金及保证金	1,274,100.00	5年以内	27.63	-
合肥燃气集团有限公司	押金及保证金	400,000.00	1年以内	8.67	-
洪启恭	员工借款及备用金	168,816.64	1年以内	3.66	-
应收退税款	应收退税款	156,298.60	1年以内	3.39	-
邓元吉	员工借款及备用金	153,762.00	1年以内	3.33	-
合计	—	2,152,977.24	—	46.68	-

⑦各报告期不存在涉及政府补助的其他应收款。

⑧各报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨各报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2022年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	585,399,097.39	129,529,839.50	455,869,257.89
在产品	614,398,746.84	164,763,763.48	449,634,983.36
库存商品	131,080,620.77	22,370,325.84	108,710,294.93
发出商品	17,826,412.04	10,387,727.24	7,438,684.80
合计	1,348,704,877.04	327,051,656.06	1,021,653,220.98

(续上表)

项目	2021年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	303,201,440.10	3,500,657.76	299,700,782.34
在产品	478,695,128.91	846,325.38	477,848,803.53
库存商品	27,572,350.25	18,807,307.13	8,765,043.12
发出商品	690,872.10	-	690,872.10
合计	810,159,791.36	23,154,290.27	787,005,501.09

(续上表)

项目	2020年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	187,688,676.41	1,849,356.29	185,839,320.12
在产品	206,169,402.47	15,357,552.86	190,811,849.61
库存商品	26,305,652.51	18,372,406.78	7,933,245.73
发出商品	1,223,809.97	14,029.32	1,209,780.65
合计	421,387,541.36	35,593,345.25	385,794,196.11

(2) 存货跌价准备

项目	2021年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2022年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,500,657.76	128,577,129.51	-	2,547,947.77	-	129,529,839.50
在产品	846,325.38	164,085,408.31	-	167,970.21	-	164,763,763.48
库存商品	18,807,307.13	3,563,018.71	-	-	-	22,370,325.84
发出商品	-	10,387,727.24	-	-	-	10,387,727.24
合计	23,154,290.27	306,613,283.77	-	2,715,917.98	-	327,051,656.06

(续上表)

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,849,356.29	3,111,930.34	-	1,460,628.87	-	3,500,657.76
在产品	15,357,552.86	501,806.90	-	15,013,034.38	-	846,325.38
库存商品	18,372,406.78	443,725.28	-	8,824.93	-	18,807,307.13
发出商品	14,029.32	-	-	14,029.32	-	-
合计	35,593,345.25	4,057,462.52	-	16,496,517.50	-	23,154,290.27

(续上表)

项 目	2019年12月31日	会计政策变更	2020年1月1日	本期增加金额		本期减少金额		2020年12月31日
				计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	34,194,310.32	-	34,194,310.32	307,499.54	-	32,652,453.57	-	1,849,356.29
在产品	123,593,946.11	-	123,593,946.11	11,243,671.42	-	119,480,064.67	-	15,357,552.86
库存商品	24,153,263.89	-	24,153,263.89	817,180.93	-	6,598,038.04	-	18,372,406.78
发出商品	-	-	-	14,029.32	-	-	-	14,029.32
合计	181,941,520.32	-	181,941,520.32	12,382,381.21	-	158,730,556.28	-	35,593,345.25

7. 其他流动资产

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
待抵扣及待认证增值税进项税	60,789,440.67	87,986,147.46	55,531,864.65
上市费用	16,495,283.05	8,860,377.38	-
预缴税费	161,731.98	169,012.55	460,044.86
其他	21,933.45	40,283.32	68,873.47
应收退货成本	-	828,961.90	2,145,761.07
小 计	77,468,389.15	97,884,782.61	58,206,544.05
应收退货成本减值	-	828,961.90	2,145,761.07
合 计	77,468,389.15	97,055,820.71	56,060,782.98

8. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
上市权益工具投资	29,107,294.40	-	-
合计	29,107,294.40	-	-

(2) 非交易性权益工具的投资情况

项 目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
思特威（上海）电子科技股份有限公司	-	5,350,678.40	-	-	非交易性	-
合计	-	5,350,678.40	-	-	—	-

本公司持有思特威（上海）电子科技股份有限公司股权比例为 1.88%，投资成本 23,756,616.00 元，本期确认其他权益工具投资公允价值变动 5,350,678.40 元，期末投资余额为 29,107,294.40 元。

9. 其他非流动金融资产

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
可转让大额存单	301,733,208.33	-	-
合计	301,733,208.33	-	-

2022 年末其他非流动金融资产金额 30,173.32 万元主要系公司购买的可转让大额存单。

10. 固定资产

(1) 分类列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产	21,437,368,245.69	16,325,987,525.29	7,766,077,816.88
固定资产清理	-	-	-
合计	21,437,368,245.69	16,325,987,525.29	7,766,077,816.88

(2) 固定资产

① 固定资产情况

A. 2022 年度

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 2021 年 12 月 31 日	29,643,533.22	18,906,017,587.80	2,740,838.31	190,146,772.38	19,128,548,731.71
2. 本期增加金额	13,894,716.46	7,449,221,111.89	-	74,308,451.02	7,537,424,279.37
(1) 购置	-	-	-	74,357,282.18	74,357,282.18
(2) 在建工程转入	13,894,716.46	7,449,221,111.89	-	-	7,463,115,828.35
(3) 汇率变动	-	-	-	-48,831.16	-48,831.16
3. 本期减少金额	-	-	2,060.00	388,537.44	390,597.44
(1) 处置或报废	-	-	2,060.00	388,537.44	390,597.44
4. 2022 年 12 月 31 日	43,538,249.68	26,355,238,699.69	2,738,778.31	264,066,685.96	26,665,582,413.64
二、累计折旧					
1. 2021 年 12 月 31 日	3,113,373.65	2,716,586,841.65	2,740,128.31	80,120,862.81	2,802,561,206.42
2. 本期增加金额	1,402,638.68	2,374,241,542.21	710.00	50,398,668.08	2,426,043,558.97
(1) 计提	1,402,638.68	2,374,241,542.21	710.00	50,425,402.42	2,426,070,293.31

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
(2) 汇率变动	-	-	-	-26,734.34	-26,734.34
3.本期减少金额	-	-	2,060.00	388,537.44	390,597.44
(1) 处置或报废	-	-	2,060.00	388,537.44	390,597.44
4.2022年12月31日	4,516,012.33	5,090,828,383.86	2,738,778.31	130,130,993.45	5,228,214,167.95
三、减值准备					
1.2021年12月31日	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.2022年12月31日	-	-	-	-	-
四、固定资产账面价值					
1.2022年12月31日	39,022,237.35	21,264,410,315.83	-	133,935,692.51	21,437,368,245.69
2.2021年12月31日	26,530,159.57	16,189,430,746.15	710.00	110,025,909.57	16,325,987,525.29

B.2021年度

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.2020年12月31日	1,894,501,967.12	7,653,560,685.91	2,740,838.31	87,687,207.43	9,638,490,698.77
会计政策变更	-1,867,879,529.91	-	-	-2,684,389.47	-1,870,563,919.38
2021年1月1日	26,622,437.21	7,653,560,685.91	2,740,838.31	85,002,817.96	7,767,926,779.39
2.本期增加金额	3,021,096.01	11,258,607,581.89	-	105,155,966.65	11,366,784,644.55
(1) 购置	-	-	-	105,283,662.64	105,283,662.64
(2) 在建工程转入	3,021,096.01	11,258,607,581.89	-	-	11,261,628,677.90
(3) 汇率变动	-	-	-	-127,695.99	-127,695.99
3.本期减少金额	-	6,150,680.00	-	12,012.23	6,162,692.23
(1) 处置或报废	-	6,150,680.00	-	12,012.23	6,162,692.23
4.2021年12月31日	29,643,533.22	18,906,017,587.80	2,740,838.31	190,146,772.38	19,128,548,731.71
二、累计折旧					
1.2020年12月31日	250,543,040.74	1,564,914,556.63	2,738,708.31	54,216,576.21	1,872,412,881.89
会计政策变更	-248,784,872.85	-	-	-1,879,072.62	-250,663,945.47
2021年1月1日	1,758,167.89	1,564,914,556.63	2,738,708.31	52,337,503.59	1,621,748,936.42

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
2.本期增加金额	1,355,205.76	1,151,774,796.37	1,420.00	27,786,962.88	1,180,918,385.01
(1) 计提	1,355,205.76	1,151,774,796.37	1,420.00	27,852,288.84	1,180,983,710.97
(2) 汇率变动	-	-	-	-65,325.96	-65,325.96
3.本期减少金额	-	102,511.34	-	3,603.67	106,115.01
(1) 处置或报废	-	102,511.34	-	3,603.67	106,115.01
4.2021年12月31日	3,113,373.65	2,716,586,841.65	2,740,128.31	80,120,862.81	2,802,561,206.42
三、减值准备					
1.2020年12月31日	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.2021年12月31日	-	-	-	-	-
四、固定资产账面价值					
1.2021年12月31日	26,530,159.57	16,189,430,746.15	710.00	110,025,909.57	16,325,987,525.29
2.2020年12月31日	1,643,958,926.38	6,088,646,129.28	2,130.00	33,470,631.22	7,766,077,816.88

C.2020年度

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.2019年12月31日	1,890,802,885.79	6,341,660,510.01	2,740,838.31	67,840,858.74	8,303,045,092.85
2.本期增加金额	3,699,081.33	1,311,900,175.90	-	19,888,476.69	1,335,487,733.92
(1) 购置	-	-	-	19,901,519.91	19,901,519.91
(2) 在建工程转入	3,699,081.33	1,311,900,175.90	-	-	1,315,599,257.23
(3) 汇率变动	-	-	-	-13,043.22	-13,043.22
3.本期减少金额	-	-	-	42,128.00	42,128.00
(1) 处置或报废	-	-	-	42,128.00	42,128.00
4.2020年12月31日	1,894,501,967.12	7,653,560,685.91	2,740,838.31	87,687,207.43	9,638,490,698.77
二、累计折旧					
1.2019年12月31日	178,230,327.21	878,110,170.21	2,239,598.86	35,101,004.44	1,093,681,100.72
2.本期增加金额	72,312,713.53	686,804,386.42	499,109.45	19,157,699.77	778,773,909.17
(1) 计提	72,312,713.53	686,804,386.42	499,109.45	19,163,052.35	778,779,261.75

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
(2) 汇率变动	-	-	-	-5,352.58	-5,352.58
3.本期减少金额	-	-	-	42,128.00	42,128.00
(1) 处置或报废	-	-	-	42,128.00	42,128.00
4.2020年12月31日	250,543,040.74	1,564,914,556.63	2,738,708.31	54,216,576.21	1,872,412,881.89
三、减值准备					
1.2019年12月31日	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.2020年12月31日	-	-	-	-	-
四、固定资产账面价值					
1.2020年12月31日	1,643,958,926.38	6,088,646,129.28	2,130.00	33,470,631.22	7,766,077,816.88
2. 2019年12月31日	1,712,572,558.58	5,463,550,339.80	501,239.45	32,739,854.30	7,209,363,992.13

②各报告期无暂时闲置的固定资产。

③各报告期通过融资租赁租入的固定资产情况：

A.2020年12月31日

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	1,867,879,529.91	248,784,872.85	-	1,619,094,657.06
电子设备及其他	2,684,389.47	1,879,072.62	-	805,316.85
合计	1,870,563,919.38	250,663,945.47	-	1,619,899,973.91

注：本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，将融资租入固定资产原值及累计折旧调整计入使用权资产原值及累计折旧，具体情况见“三、重要会计政策及会计估计27、重要会计政策和会计估计的变更”。

④各报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

⑤截止2022年12月31日无未办妥产权证书的固定资产情况。

11. 在建工程

(1) 分类列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
在建工程	1,385,043,636.61	3,329,058,296.25	1,390,705,017.22
工程物资	-	-	-
合计	1,385,043,636.61	3,329,058,296.25	1,390,705,017.22

(2) 在建工程

①在建工程情况

项 目	2022 年 12 月 31 日			2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	1,385,043,636.61	-	1,385,043,636.61	3,329,058,296.25	-	3,329,058,296.25	1,390,705,017.22	-	1,390,705,017.22
合计	1,385,043,636.61	-	1,385,043,636.61	3,329,058,296.25	-	3,329,058,296.25	1,390,705,017.22	-	1,390,705,017.22

②重要在建工程项目变动情况

A.2022 年度

项目名称	预算数	2021 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2022 年 12 月 31 日
在安装设备	—	3,329,058,296.25	5,519,101,168.71	7,463,115,828.35	-	1,385,043,636.61
合计	—	3,329,058,296.25	5,519,101,168.71	7,463,115,828.35	-	1,385,043,636.61

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
在安装设备	—	—	-	-	-	自筹
合计	—	—	-	-	-	—

B.2021 年度

项目名称	预算数	2020 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2021 年 12 月 31 日
在安装设备	—	1,390,705,017.22	13,199,981,956.93	11,261,628,677.90	-	3,329,058,296.25
合计	—	1,390,705,017.22	13,199,981,956.93	11,261,628,677.90	-	3,329,058,296.25

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
在安装设备	—	—	-	-	-	自筹
合计	—	—	-	-	-	—

C.2020 年度

项目名称	预算数	2019年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2020年12月31日
在安装设备	—	403,274,603.18	2,303,029,671.27	1,315,599,257.23	-	1,390,705,017.22
合计	—	403,274,603.18	2,303,029,671.27	1,315,599,257.23	-	1,390,705,017.22

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
在安装设备	—	—	-	-	-	自筹
合计	—	—	-	-	-	—

③期末在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。

12. 使用权资产

(1) 2022 年度

项目	土地使用权	房屋及建筑物	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.2021年12月31日	73,391,968.50	3,264,933,465.19	2,684,389.47	3,341,009,823.16
2.本期增加金额	-	13,200,284.80	-	13,200,284.80
(1) 新增租赁	-	13,275,559.70	-	13,275,559.70
(2) 汇率变动	-	-75,274.90	-	-75,274.90
3.本期减少金额	-	7,921,981.84	-	7,921,981.84
4.2022年12月31日	73,391,968.50	3,270,211,768.15	2,684,389.47	3,346,288,126.12
二、累计折旧				
1.2021年12月31日	2,575,156.79	341,207,845.82	2,415,950.52	346,198,953.13
2.本期增加金额	2,575,156.79	133,566,345.35	268,438.95	136,409,941.09
(1) 计提	2,575,156.79	133,587,009.05	268,438.95	136,430,604.79
(2) 汇率变动	-	-20,663.70	-	-20,663.70

项 目	土地使用权	房屋及建筑物	电子设备及其他	合计
3.本期减少金额	-	2,379,664.26	-	2,379,664.26
4.2022年12月31日	5,150,313.58	472,394,526.91	2,684,389.47	480,229,229.96
三、减值准备				
1.2021年12月31日	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.2022年12月31日	-	-	-	-
四、账面价值				
1.2022年12月31日	68,241,654.92	2,797,817,241.24	-	2,866,058,896.16
2.2021年12月31日	70,816,811.71	2,923,725,619.37	268,438.95	2,994,810,870.03

(2) 2021年度

项 目	土地使用权	房屋及建筑物	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.2020年12月31日	-	-	-	-
会计政策变更	73,391,968.50	1,869,715,476.76	2,684,389.47	1,945,791,834.73
2021年1月1日	73,391,968.50	1,869,715,476.76	2,684,389.47	1,945,791,834.73
2.本期增加金额	-	1,395,217,988.43	-	1,395,217,988.43
(1) 新增租赁	-	1,395,410,357.62	-	1,395,410,357.62
(2) 汇率变动	-	-192,369.19	-	-192,369.19
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.2021年12月31日	73,391,968.50	3,264,933,465.19	2,684,389.47	3,341,009,823.16
二、累计折旧				
1.2020年12月31日	-	-	-	-
会计政策变更	-	248,784,872.85	1,879,072.62	250,663,945.47
2021年1月1日	-	248,784,872.85	1,879,072.62	250,663,945.47
2.本期增加金额	2,575,156.79	92,422,972.97	536,877.90	95,535,007.66
(1) 计提	2,575,156.79	92,457,974.74	536,877.90	95,570,009.43
(2) 汇率变动	-	-35,001.77	-	-35,001.77
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.2021年12月31日	2,575,156.79	341,207,845.82	2,415,950.52	346,198,953.13
三、减值准备				
1.2020年12月31日	-	-	-	-

项 目	土地使用权	房屋及建筑物	电子设备及其他	合计
会计政策变更	-	-	-	-
2021年1月1日	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.2021年12月31日	-	-	-	-
四、账面价值				
1.2021年12月31日	70,816,811.71	2,923,725,619.37	268,438.95	2,994,810,870.03
2.2021年1月1日	73,391,968.50	1,620,930,603.91	805,316.85	1,695,127,889.26

13. 无形资产

(1) 无形资产情况

①2022年度

项 目	专利权及非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值			
1.2021年12月31日	2,020,315,790.00	313,467,166.85	2,333,782,956.85
2.本期增加金额	195,093,497.32	202,123,335.89	397,216,833.21
(1) 购置	195,093,497.32	202,124,016.67	397,217,513.99
(2) 汇率变动	-	-680.78	-680.78
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2022年12月31日	2,215,409,287.32	515,590,502.74	2,730,999,790.06
二、累计摊销			
1.2021年12月31日	666,936,850.67	116,880,218.36	783,817,069.03
2.本期增加金额	137,789,305.63	79,731,435.09	217,520,740.72
(1) 计提	137,789,305.63	79,731,896.71	217,521,202.34
(2) 汇率变动	-	-461.62	-461.62
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2022年12月31日	804,726,156.30	196,611,653.45	1,001,337,809.75
三、减值准备			
1.2021年12月31日	295,739,181.74	-	295,739,181.74
2.本期增加金额	-	-	-

项 目	专利权及非专利技术	软件及其他	合计
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.2022年12月31日	295,739,181.74	-	295,739,181.74
四、账面价值			
1.2022年12月31日	1,114,943,949.28	318,978,849.29	1,433,922,798.57
2.2021年12月31日	1,057,639,757.59	196,586,948.49	1,254,226,706.08

②2021年度

项 目	专利权及非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值			
1.2020年12月31日	2,020,315,790.00	177,114,760.91	2,197,430,550.91
2.本期增加金额	-	136,352,405.94	136,352,405.94
(1) 购置	-	136,354,145.72	136,354,145.72
(2) 汇率变动	-	-1,739.78	-1,739.78
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2021年12月31日	2,020,315,790.00	313,467,166.85	2,333,782,956.85
二、累计摊销			
1.2020年12月31日	530,527,082.65	71,677,918.40	602,205,001.05
2.本期增加金额	136,409,768.02	45,202,299.96	181,612,067.98
(1) 计提	136,409,768.02	45,203,404.52	181,613,172.54
(2) 汇率变动	-	-1,104.56	-1,104.56
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2021年12月31日	666,936,850.67	116,880,218.36	783,817,069.03
三、减值准备			
1.2020年12月31日	295,739,181.74	-	295,739,181.74
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.2021年12月31日	295,739,181.74	-	295,739,181.74
四、账面价值			
1.2021年12月31日	1,057,639,757.59	196,586,948.49	1,254,226,706.08

项 目	专利权及非专利技术	软件及其他	合计
2.2020年12月31日	1,194,049,525.61	105,436,842.51	1,299,486,368.12

③2020年度

项 目	专利权及非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值			
1.2019年12月31日	2,020,315,790.00	171,788,897.29	2,192,104,687.29
2.本期增加金额	-	17,385,794.65	17,385,794.65
(1) 购置	-	17,385,983.76	17,385,983.76
(2) 汇率变动	-	-189.11	-189.11
3.本期减少金额	-	12,059,931.03	12,059,931.03
(1) 处置	-	12,059,931.03	12,059,931.03
4.2020年12月31日	2,020,315,790.00	177,114,760.91	2,197,430,550.91
二、累计摊销			
1.2019年12月31日	375,169,298.25	47,975,307.77	423,144,606.02
2.本期增加金额	155,357,784.40	35,762,541.66	191,120,326.06
(1) 计提	155,357,784.40	35,762,612.74	191,120,397.14
(2) 汇率变动	-	-71.08	-71.08
3.本期减少金额	-	12,059,931.03	12,059,931.03
(1) 处置	-	12,059,931.03	12,059,931.03
4.2020年12月31日	530,527,082.65	71,677,918.40	602,205,001.05
三、减值准备			
1.2019年12月31日	-	-	-
2.本期增加金额	295,739,181.74	-	295,739,181.74
(1) 计提	295,739,181.74	-	295,739,181.74
3.本期减少金额	-	-	-
4.2020年12月31日	295,739,181.74	-	295,739,181.74
四、账面价值			
1.2020年12月31日	1,194,049,525.61	105,436,842.51	1,299,486,368.12
2.2019年12月31日	1,645,146,491.75	123,813,589.52	1,768,960,081.27

(2) 无未办妥产权证书的土地使用权情况。

14. 长期待摊费用

项 目	2021年12月31日	本期增加	本期减少		2022年12月31日
			本期摊销	其他减少	
装修费支出	587,251.28	-	249,271.68	-	337,979.60
合计	587,251.28	-	249,271.68	-	337,979.60

(续上表)

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少		2021年12月31日
			本期摊销	其他减少	
装修费支出	-	747,815.00	160,563.72	-	587,251.28
合计	-	747,815.00	160,563.72	-	587,251.28

(续上表)

项 目	2019年12月31日	本期增加	本期减少		2020年12月31日
			本期摊销	其他减少	
装修费支出	101,636.25	-	101,636.25	-	-
合计	101,636.25	-	101,636.25	-	-

15. 递延所得税资产

(1) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
可抵扣暂时性差异	1,890,598,857.78	1,046,110,331.92	878,175,426.14
可抵扣亏损	16,599,677.35	2,313,097,322.65	3,851,546,212.42
合 计	1,907,198,535.13	3,359,207,654.57	4,729,721,638.56

(2) 期末未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2022年12月31日
2026	9,320,389.00
2027	6,978,108.80
2028	-
2029	-
2030	57,983.34
2031	195,436.68
2032	47,759.53
合 计	16,599,677.35

16. 其他非流动资产

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
预付长期资产购置款	253,398,924.09	25,324,927.93	290,167.48
待验软件	30,388,817.76	2,313,296.95	-
预付产能保证金	188,715,512.58	-	-
合 计	472,503,254.43	27,638,224.88	290,167.48

17. 短期借款

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
质押借款	-	208,672,401.65	-
信用借款	287,073,782.03	2,303,711,883.29	-
合 计	287,073,782.03	2,512,384,284.94	-

18. 应付账款

(1) 按性质列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付设备工程和软件款	568,127,193.22	1,949,584,369.80	910,135,478.50
应付货款	124,511,041.45	182,369,317.77	112,320,116.26
应付其他款项	233,607,123.86	355,676,068.45	91,330,280.73
合 计	926,245,358.53	2,487,629,756.02	1,113,785,875.49

(2) 各报告期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(3) 各报告期按应付对象归集的余额前五名的应付账款情况

单位名称	2022 年 12 月 31 日余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)
Nikon Corporation	297,904,621.86	1 年以内	32.16
IMEC vzw	59,862,096.78	1 年以内	6.46
国网安徽省电力有限公司合肥供电公司	35,750,862.63	1 年以内	3.86
Applied Materials South East Asia	30,170,238.17	2 年以内	3.26
北京北方华创微电子装备有限公司	29,071,712.80	2 年以内	3.14
合 计	452,759,532.24	—	48.88

(续上表)

单位名称	2021年12月31日余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
Applied Materials South East Asia Pte. Ltd	378,353,861.52	1年以内	15.21
Nikon Corporation	252,843,708.34	1年以内	10.16
Tokyo Electron Limited	249,523,065.81	1年以内	10.03
Lam Research International Sarl	136,311,114.61	1年以内	5.48
海程邦达国际物流有限公司	128,873,024.20	1年以内	5.18
合计	1,145,904,774.48	—	46.06

(续上表)

单位名称	2020年12月31日余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
Applied Materials South East Asia Pte. Ltd	230,182,586.70	1年以内	20.67
Tokyo Electron Limited	141,687,523.78	1年以内	12.72
Nikon Corporation	120,598,680.00	1年以内	10.83
Canon Inc.	100,867,800.00	1年以内	9.06
Lam Research International Sarl	66,746,753.41	1年以内	5.99
合计	660,083,343.89	—	59.27

19. 合同负债

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
预收货款	832,694,391.05	1,335,767,714.78	66,591,986.84
合计	832,694,391.05	1,335,767,714.78	66,591,986.84

20. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
一、短期薪酬	185,234,288.25	1,414,190,980.25	1,231,176,257.67	368,249,010.83
二、离职后福利-设定提存计划	-	56,023,401.12	56,023,401.12	-
合计	185,234,288.25	1,470,214,381.37	1,287,199,658.79	368,249,010.83

(续上表)

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
一、短期薪酬	12,773,286.36	846,122,177.55	673,661,175.66	185,234,288.25
二、离职后福利-设定提存计划	-	29,377,519.64	29,377,519.64	-

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
合计	12,773,286.36	875,499,697.19	703,038,695.30	185,234,288.25

(续上表)

项 目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
一、短期薪酬	5,454,028.47	418,529,843.43	411,210,585.54	12,773,286.36
二、离职后福利-设定提存计划	-	3,184,868.29	3,184,868.29	-
合计	5,454,028.47	421,714,711.72	414,395,453.83	12,773,286.36

(2) 短期薪酬列示

项 目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,132,254.16	907,265,297.30	915,404,457.59	7,993,093.87
二、职工福利费	-	62,665,162.69	62,665,162.69	-
三、社会保险费	-	20,352,020.65	20,352,020.65	-
其中：医疗及生育保险费	-	18,978,543.26	18,978,543.26	-
工伤保险费	-	1,373,477.39	1,373,477.39	-
四、住房公积金	11,388.00	40,731,791.00	40,743,179.00	-
五、工会经费和职工教育经费	3,909,466.17	23,364,944.08	18,779,785.59	8,494,624.66
六、短期利润分享计划	164,404,043.71	352,879,205.81	166,420,029.66	350,863,219.86
七、其他	777,136.21	6,932,558.72	6,811,622.49	898,072.44
合计	185,234,288.25	1,414,190,980.25	1,231,176,257.67	368,249,010.83

(续上表)

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,666,943.12	585,679,329.66	579,214,018.62	16,132,254.16
二、职工福利费	-	45,037,910.35	45,037,910.35	-
三、社会保险费	-	11,665,376.39	11,665,376.39	-
其中：医疗及生育保险费	-	11,107,060.80	11,107,060.80	-
工伤保险费	-	558,315.59	558,315.59	-
四、住房公积金	-	20,592,999.92	20,581,611.92	11,388.00
五、工会经费和职工教育经费	2,320,956.38	12,410,026.95	10,821,517.16	3,909,466.17
六、短期利润分享计划	-	164,404,043.71	-	164,404,043.71
七、其他	785,386.86	6,332,490.57	6,340,741.22	777,136.21
合计	12,773,286.36	846,122,177.55	673,661,175.66	185,234,288.25

(续上表)

项 目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,827,809.00	353,058,935.40	346,219,801.28	9,666,943.12
二、职工福利费	-	35,943,175.82	35,943,175.82	-
三、社会保险费	-	4,836,993.49	4,836,993.49	-
其中：医疗及生育保险费	-	4,820,583.47	4,820,583.47	-
工伤保险费	-	16,410.02	16,410.02	-
四、住房公积金	-	12,233,800.00	12,233,800.00	-
五、工会经费和职工教育经费	1,987,653.82	7,241,067.85	6,907,765.29	2,320,956.38
六、其他	638,565.65	5,215,870.87	5,069,049.66	785,386.86
合计	5,454,028.47	418,529,843.43	411,210,585.54	12,773,286.36

(3) 设定提存计划列示

项 目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
基本养老保险费	-	51,643,120.45	51,643,120.45	-
失业保险费	-	1,610,193.20	1,610,193.20	-
其他	-	2,770,087.47	2,770,087.47	-
合计	-	56,023,401.12	56,023,401.12	-

(续上表)

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
基本养老保险费	-	26,110,237.73	26,110,237.73	-
失业保险费	-	816,929.68	816,929.68	-
其他	-	2,450,352.23	2,450,352.23	-
合计	-	29,377,519.64	29,377,519.64	-

(续上表)

项 目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
基本养老保险费	-	1,100,597.12	1,100,597.12	-
失业保险费	-	38,671.54	38,671.54	-
其他	-	2,045,599.63	2,045,599.63	-
合计	-	3,184,868.29	3,184,868.29	-

21. 应交税费

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
个人所得税	61,487,251.47	19,533,786.25	11,265,340.39
代扣代缴税费	4,160,887.16	4,148,148.20	1,258,004.15
印花税	2,018,345.69	4,864,366.39	277,206.70
房产税	1,216,807.77	1,216,807.59	2,433,310.00
土地使用税	263,881.38	263,881.38	527,762.88
水利基金	255,478.70	19,551.80	-
企业所得税	189,045.91	174,953.07	-
残疾人就业保障金	-	2,508,079.32	-
合 计	69,591,698.08	32,729,574.00	15,761,624.12

22. 其他应付款

(1) 分类列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付利息	-	-	8,635,747.60
应付股利	-	-	-
其他应付款	5,937,693,608.38	5,773,175,260.38	169,276,921.48
合计	5,937,693,608.38	5,773,175,260.38	177,912,669.08

(2) 应付利息

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-	8,635,747.60
短期借款利息	-	-	-
合计	-	-	8,635,747.60

注：各报告期期末无已逾期未支付的利息。

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
保证金	5,929,363,145.85	5,765,961,157.90	142,143,078.55
借转补款项	5,000,000.00	5,000,000.00	21,100,000.00
代收代付人才补助	376,977.66	373,090.00	896,860.00
代付款	-	-	4,968,971.31

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他	2,953,484.87	1,841,012.48	168,011.62
合计	5,937,693,608.38	5,773,175,260.38	169,276,921.48

②各报告期期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

③各报告期按应付对象归集的余额前五名的其他应付款情况

单位名称	2022 年 12 月 31 日余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)
奕力科技股份有限公司	981,697,978.84	2 年以内	16.53
联咏科技股份有限公司	646,872,048.00	2 年以内	10.89
联发科技股份有限公司	511,480,224.00	2 年以内	8.61
北京集创北方科技股份有限公司	449,597,161.50	2 年以内	7.57
北京奕斯伟计算技术有限公司	300,933,504.20	2 年以内	5.07
合计	2,890,580,916.54	—	48.68

(续上表)

单位名称	2021 年 12 月 31 日余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)
联咏科技股份有限公司	947,480,025.60	1 年以内	16.41
北京集创北方科技股份有限公司	731,635,418.40	2 年以内	12.67
奕力科技股份有限公司	499,472,338.00	1 年以内	8.65
联发科技股份有限公司	468,231,408.00	1 年以内	8.11
成都爱旗科技有限公司	378,222,588.00	1 年以内	6.55
合计	3,025,041,778.00	—	52.40

(续上表)

单位名称	2020 年 12 月 31 日余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)
思特威(上海)电子科技有限公司	50,000,000.00	1 年以内	29.54
北京集创北方科技股份有限公司	49,119,840.00	1 年以内	29.02
借转补项目	21,100,000.00	4 年以内	12.46
深圳市爱协生科技有限公司	20,906,560.00	1 年以内	12.35
合肥蓝科投资有限公司	7,129,443.31	4 年以内	4.21
合计	148,255,843.31	—	87.58

23. 一年内到期的非流动负债

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	408,949,854.61	362,241,363.53	121,800,423.92
一年内到期的长期应付款	-	-	64,418,219.38
一年内到期的租赁负债	260,128,810.66	259,988,866.24	-
一年内到期的长期应付职工薪酬	41,777,043.91	31,871,315.03	-
合计	710,855,709.18	654,101,544.80	186,218,643.30

24. 其他流动负债

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
尚未结算的返利款	78,944,030.61	-	-
合计	78,944,030.61	-	-

25. 长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
信用借款	498,299,769.51	199,334,277.85	-
保证借款	8,137,521,956.08	5,339,766,209.52	4,970,591,148.73
小计	8,635,821,725.59	5,539,100,487.37	4,970,591,148.73
减：一年内到期的长期借款	408,949,854.61	362,241,363.53	121,800,423.92
合计	8,226,871,870.98	5,176,859,123.84	4,848,790,724.81

(2) 长期借款分类的说明

截至 2022 年 12 月 31 日，长期借款中的保证借款中 498,704.50 万元由合肥市建设投资控股（集团）有限公司提供担保，具体担保情况见“十、关联方及关联方交易 5. 关联方交易情况（3）关联担保情况”；长期借款中的保证借款中 315,047.69 万元系新晶集成借入，由晶合集成为其提供担保。

26. 租赁负债

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
租赁付款额	3,216,180,002.45	3,471,787,969.61	—
减：未确认融资费用	991,047,737.03	1,122,954,680.99	—
小计	2,225,132,265.42	2,348,833,288.62	—
减：一年内到期的租赁负债	260,128,810.66	259,988,866.24	—
合计	1,965,003,454.76	2,088,844,422.38	—

注：2021 年 4 月 8 日，本公司与合肥蓝科投资有限公司签订了《晶合二厂厂务及

配套项目租赁合同》，合肥蓝科投资有限公司出资负责新建生产之洁净室与相关厂务及配套设施，合肥蓝科投资有限公司为洁净室与相关厂务及配套设施的权利人，建设完成后将其租赁给本公司使用，租赁期为 10 年。

2021 年，本公司与合肥蓝科投资有限公司签订了《晶合二厂厂务及配套项目收购意向协议》，协议约定本公司在项目交付之日，以实际交付之日起五年内完成收购。

27. 长期应付款

(1) 分类列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
长期应付款	-	-	993,730,464.84
专项应付款	-	-	-
小计	-	-	993,730,464.84
减：一年内到期的长期应付款项	-	-	64,418,219.38
合计	-	-	929,312,245.46

(2) 按款项性质列示长期应付款

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付融资租赁款	-	-	1,801,828,788.19
减：未确认融资费用	-	-	808,098,323.35
小计	-	-	993,730,464.84
减：一年内到期的长期应付款	-	-	64,418,219.38
合计	-	-	929,312,245.46

注：2015 年 4 月 27 日，合肥市人民政府与力晶科技股份有限公司签署《12 吋晶圆制造基地项目合作框架协议书》，双方共同合作实施合肥新站综合开发试验区 12 吋晶圆制造基地项目。

2015 年 10 月，本公司与力晶科技股份有限公司、合肥蓝科投资有限公司签订了《厂房建设与租用协议》。协议约定由合肥蓝科投资有限公司出资购买合肥市综合保税区内土地使用权，并建设 12 吋晶圆厂生产之无尘室与相关厂务设施。建设完成后，由本公司租用无尘室与相关厂务设施。

2017 年 6 月 28 日，本公司与合肥蓝科投资有限公司签订了《电子器件厂房设施租

赁合同》，合肥蓝科投资有限公司已按照本公司的要求将电子器件厂房基础设施建设完毕，合肥蓝科投资有限公司作为无尘室与相关厂务设施的权利人，同意将电子器件厂房设施及土地租赁给本公司。租赁期限自 2017 年 6 月 28 日起至 2037 年 6 月 27 日止。

2020 年 10 月 28 日，合肥蓝科投资有限公司与本公司签署《电子器件厂房设施租赁合同之补充协议》，对租金的具体金额及租期的起始时间进行了明确约定。

本公司按照最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，长期应付款的入账价值与最低租赁付款额现值的差额，确认为未确认融资费用，在租赁期内采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。融资租入资产按照竣工决算金额入账，本公司对于竣工决算金额与最低租赁付款额现值的差额，确认为政府补助，计入递延收益，在租赁期内进行分摊，计入其他收益。

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本公司将长期应付款调整计入租赁负债，租赁的会计政策具体内容见“三、重要会计政策及会计估计 26.租赁”，会计政策变更的具体情况首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况见“三、重要会计政策及会计估计 27.重要会计政策和会计估计的变更”。

28. 长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他长期福利	81,744,040.36	58,177,710.70	11,393,747.76
小计	81,744,040.36	58,177,710.70	11,393,747.76
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	41,777,043.91	31,871,315.03	-
合计	39,966,996.45	26,306,395.67	11,393,747.76

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、期初余额	58,177,710.70	11,393,747.76	-
二、计入当期损益的设定受益成本	58,798,101.90	46,783,962.94	11,393,747.76
1.当期服务成本	55,473,531.11	46,783,962.94	11,393,747.76
2.过去服务成本	-	-	-

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-	-	-
4. 利息净额	3,324,570.79	-	-
三、计入其他综合收益的设定受益成本	-	-	-
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-	-	-
四、其他变动	35,231,772.24	-	-
1. 结算时支付的对价	35,231,772.24	-	-
2. 已支付的福利	-	-	-
五、期末余额	81,744,040.36	58,177,710.70	11,393,747.76

设定受益计划净负债

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、期初余额	58,177,710.70	11,393,747.76	-
二、计入当期损益的设定受益成本	58,798,101.90	46,783,962.94	11,393,747.76
三、计入其他综合收益的设定受益成本	-	-	-
四、其他变动	35,231,772.24	-	-
五、期末余额	81,744,040.36	58,177,710.70	11,393,747.76

注：长期应付职工薪酬（含一年内到期的长期应付职工薪酬）2022 年末余额较 2021 年末增加 2,356.63 万元，2021 年末余额较 2020 年末增加 4,678.40 万元，主要系随员工服务时间增加，计入当期服务成本增加所致。

29. 预计负债

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	形成原因
尚未结算的返利款	-	847,053.42	2,748,659.56	尚未结算返利款
合 计	-	847,053.42	2,748,659.56	—

30. 递延收益

(1) 递延收益情况

项 目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	其他变动	2022 年 12 月 31 日
政府补助	1,109,705,327.24	255,514,000.00	93,797,054.56	-	1,271,422,272.68
合计	1,109,705,327.24	255,514,000.00	93,797,054.56	-	1,271,422,272.68

(续上表)

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	其他变动	2021年12月31日
政府补助	1,119,108,660.15	60,926,252.39	70,329,585.30	-	1,109,705,327.24
合计	1,119,108,660.15	60,926,252.39	70,329,585.30	-	1,109,705,327.24

(续上表)

项 目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	其他变动	2020年12月31日
政府补助	1,059,418,368.69	133,764,000.00	62,053,047.60	-12,020,660.94	1,119,108,660.15
合计	1,059,418,368.69	133,764,000.00	62,053,047.60	-12,020,660.94	1,119,108,660.15

(2) 涉及政府补助的项目

补助项目	2021年12月31日	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2022年12月31日	与资产相关/与收益相关
合肥市政府招商引资投资厂房	838,441,971.36	-	32,786,300.16	-	805,655,671.20	与资产相关
三重一创建设专项引导资金(一事一议)	215,103,278.51	196,000,000.00	51,476,181.61	-	359,627,096.90	与资产相关
三重一创重大新兴产业基地新建项目补助	7,259,156.91	-	1,286,341.19	-	5,972,815.72	与资产相关
集成电路产业政策资金-研发设备及工具补助	8,128,442.83	-	1,076,724.71	-	7,051,718.12	与资产相关
省集成电路新基地建设专项补助	3,612,360.05	-	507,222.91	-	3,105,137.14	与资产相关
企业购置研发设备补助	5,309,364.52	2,264,000.00	938,339.76	-	6,635,024.76	与资产相关
外贸发展专项资金-固定资产投资补助	319,444.42	-	55,555.58	-	263,888.84	与资产相关
12寸晶圆制造基地项目专项财政扶持资金	15,871,908.41	-	2,737,099.08	-	13,134,809.33	与资产相关
工业互联网政策研发设备补贴	9,909,400.23	-	1,087,197.24	-	8,822,202.99	与资产相关
2020年创新型省份建设资金	5,750,000.00	3,250,000.00	-	-	9,000,000.00	与收益相关
科技创新计划奖补	-	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	与资产及收益相关
先进制造业发展政策资金-企业技术改造补贴	-	20,000,000.00	1,465,139.92	-	18,534,860.08	与资产相关
2022年合肥市集成电路产业政策奖补-EDA工具软件	-	2,000,000.00	380,952.40	-	1,619,047.60	与资产相关
合计	1,109,705,327.24	255,514,000.00	93,797,054.56	-	1,271,422,272.68	-

(续上表)

补助项目	2020年12月31日	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2021年12月31日	与资产相关/与收益相关
合肥市政府招商引资投资厂房	837,152,019.15	34,076,252.39	32,786,300.18	-	838,441,971.36	与资产相关
三重一创建设专项引导资金（一事一议）	248,647,136.40	-	33,543,857.89	-	215,103,278.51	与资产相关
三重一创重大新兴产业基地新建项目补助	8,558,503.34	-	1,299,346.43	-	7,259,156.91	与资产相关
集成电路产业政策资金-研发设备及工具补助	9,205,167.55	-	1,076,724.72	-	8,128,442.83	与资产相关
省集成电路新基地建设专项补助	4,119,582.86	-	507,222.81	-	3,612,360.05	与资产相关
企业购置研发设备补助	6,051,250.84	-	741,886.32	-	5,309,364.52	与资产相关
外贸发展专项资金-固定资产投资补助	375,000.01	-	55,555.59	-	319,444.42	与资产相关
12寸晶圆制造基地项目专项财政扶持资金	-	16,100,000.00	228,091.59	-	15,871,908.41	与资产相关
工业互联网政策研发设备补贴	-	10,000,000.00	90,599.77	-	9,909,400.23	与资产相关
2020年创新型省份建设资金	5,000,000.00	750,000.00	-	-	5,750,000.00	与收益相关
合计	1,119,108,660.15	60,926,252.39	70,329,585.30	-	1,109,705,327.24	-

（续上表）

补助项目	2019年12月31日	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2020年12月31日	与资产相关/与收益相关
合肥市政府招商引资投资厂房	879,761,600.58	-	30,588,920.49	-12,020,660.94	837,152,019.15	与资产相关
三重一创建设专项引导资金（一事一议）	160,093,885.02	117,000,000.00	28,446,748.62	-	248,647,136.40	与资产相关
三重一创重大新兴产业基地新建项目补助	9,865,509.78	-	1,307,006.44	-	8,558,503.34	与资产相关
集成电路产业政策资金-研发设备及工具补助	4,779,654.58	5,000,000.00	574,487.03	-	9,205,167.55	与资产相关
省集成电路新基地建设专项补助	-	4,500,000.00	380,417.14	-	4,119,582.86	与资产相关
企业购置研发设备补助	4,487,163.17	2,264,000.00	699,912.33	-	6,051,250.84	与资产相关
外贸发展专项资金-固定资产投资补助	430,555.56	-	55,555.55	-	375,000.01	与资产相关
创新型省份建设资金	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	与收益相关
合计	1,059,418,368.69	133,764,000.00	62,053,047.60	-12,020,660.94	1,119,108,660.15	-

注：递延收益中“合肥市政府招商引资投资厂房”补助项目详见“五、合并财务报表项目注释 27.长期应付款”。

31. 股本

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
合肥建投	468,474,592.00	468,474,592.00	468,474,592.00
合肥芯屏	328,736,799.00	328,736,799.00	328,736,799.00
力晶科技	412,824,208.00	412,824,208.00	412,824,208.00
美的创新	88,014,118.00	88,014,118.00	88,014,118.00
中安智芯	39,606,354.00	39,606,354.00	39,606,354.00
惠友豪创	26,404,236.00	26,404,236.00	26,404,236.00
合肥存鑫	26,404,236.00	26,404,236.00	26,404,236.00
海通创新	17,602,824.00	17,602,824.00	17,602,824.00
杭州承富	15,402,471.00	15,402,471.00	15,402,471.00
泸州隆信	13,202,118.00	13,202,118.00	13,202,118.00
宁波华淳	13,202,118.00	13,202,118.00	13,202,118.00
中小企业基金	13,202,118.00	13,202,118.00	13,202,118.00
安华创新	8,801,412.00	8,801,412.00	8,801,412.00
集创北方	8,801,412.00	8,801,412.00	8,801,412.00
合肥晶煅	5,195,398.00	5,195,398.00	5,195,398.00
合肥晶遂	4,197,429.00	4,197,429.00	4,197,429.00
合肥晶炯	3,813,060.00	3,813,060.00	3,813,060.00
中金浦成	1,760,282.00	1,760,282.00	1,760,282.00
合肥晶咖	1,456,606.00	1,456,606.00	1,456,606.00
合肥晶珏	1,262,054.00	1,262,054.00	1,262,054.00
合肥晶梢	1,174,082.00	1,174,082.00	1,174,082.00
合肥晶柔	862,798.00	862,798.00	862,798.00
合肥晶悬	852,648.00	852,648.00	852,648.00
合肥晶本	779,902.00	779,902.00	779,902.00
合肥晶洛	581,966.00	581,966.00	581,966.00
合肥晶辽	497,378.00	497,378.00	497,378.00
合肥晶确	414,481.00	414,481.00	414,481.00
合肥晶铁	414,481.00	414,481.00	414,481.00
合肥晶妥	406,023.00	406,023.00	406,023.00

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
合肥晶雄	253,764.00	253,764.00	253,764.00
合 计	1,504,601,368.00	1,504,601,368.00	1,504,601,368.00

注：本公司报告期股权结构变化详见“一、公司的基本情况 2.历史沿革”。

32. 资本公积

(1) 2022 年度

项 目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
股本溢价	10,358,077,394.18	850,996,105.05	-	11,209,073,499.23
合 计	10,358,077,394.18	850,996,105.05	-	11,209,073,499.23

(2) 2021 年度

项 目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
股本溢价	10,021,448,833.46	336,628,560.72	-	10,358,077,394.18
合 计	10,021,448,833.46	336,628,560.72	-	10,358,077,394.18

(3) 2020 年度

项 目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
股本溢价	-	10,021,448,833.46	-	10,021,448,833.46
合 计	-	10,021,448,833.46	-	10,021,448,833.46

注：2022 年度资本公积增加主要系子公司新晶集成本期增资扩股形成。

2021 年度资本公积增加 33,662.86 万元，由以下两部分构成：①原员工持股平台人员自公司离职后，将其持有的股份转让于其他人员新确认股份支付 266.50 万元；②子公司新晶集成本期增资扩股形成资本公积 33,396.36 万元。

2020 年度资本公积增加 1,002,144.88 万元，由以下三部分构成：①2020 年 7 月，公司注册资本由 694,000.00 万元减少至 100,000.00 万元，其差额 594,000.00 万元计入当期资本公积；②2020 年 9 月，公司增资扩股形成资本公积 396,039.86 万元；③2020 年，公司员工持股平台对本公司增资形成的股份支付增加资本公积 12,105.02 万元。

33. 其他综合收益

(1) 2022 年度

项 目	2021年12月31日	本期发生金额						2022年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	5,350,678.40	-	-	-	5,350,678.40	-	5,350,678.40
其他权益工具投资公允价值变动	-	5,350,678.40	-	-	-	5,350,678.40	-	5,350,678.40
二、将重分类进损益的其他综合收益	-272,705.48	-274,486.38	-	-	-	-274,486.38	-	-547,191.86
外币财务报表折算差额	-272,705.48	-274,486.38	-	-	-	-274,486.38	-	-547,191.86
其他综合收益合计	-272,705.48	5,076,192.02	-	-	-	5,076,192.02	-	4,803,486.54

(2) 2021 年度

项 目	2020年12月31日	本期发生金额						2021年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	468,627.68	-741,333.16	-	-	-	-741,333.16	-	-272,705.48
外币财务报表折算差额	468,627.68	-741,333.16	-	-	-	-741,333.16	-	-272,705.48
其他综合收益合计	468,627.68	-741,333.16	-	-	-	-741,333.16	-	-272,705.48

(3) 2020 年度

项 目	2019年12月31日	本期发生金额						2020年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其	-	-	-	-	-	-	-	-

项 目	2019年12月31日	本期发生金额					2020年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	549,739.95	-81,112.27	-	-	-	-81,112.27	-
外币财务报表折算差额	549,739.95	-81,112.27	-	-	-	-81,112.27	-
其他综合收益合计	549,739.95	-81,112.27	-	-	-	-81,112.27	-

34. 盈余公积

项 目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
法定盈余公积	-	26,575,971.33	-	26,575,971.33
合计	-	26,575,971.33	-	26,575,971.33

35. 未分配利润

项 目	2022年度	2021年度	2020年度
调整前上期末未分配利润	-2,639,752,570.35	-4,368,584,559.81	-3,110,987,500.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	-
调整后期初未分配利润	-2,639,752,570.35	-4,368,584,559.81	-3,110,987,500.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,045,430,810.29	1,728,831,989.46	-1,257,597,059.28
减：提取法定盈余公积	26,575,971.33	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
期末未分配利润	379,102,268.61	-2,639,752,570.35	-4,368,584,559.81

36. 营业收入和营业成本

项 目	2022年度		2021年度		2020年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,025,499,527.49	5,402,848,765.06	5,420,844,427.64	2,974,097,632.69	1,511,861,078.57	1,641,461,883.16
其他业务	25,449,081.06	8,632,900.20	8,164,863.48	4,874,419.33	509,426.14	446,725.49
合计	10,050,948,608.55	5,411,481,665.26	5,429,009,291.12	2,978,972,052.02	1,512,370,504.71	1,641,908,608.65

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
55nm	39,126,543.19	86,493,104.50	49,850.67	8,509.20	-	-
90nm	5,212,406,600.76	2,886,967,592.73	3,033,104,627.63	1,743,289,766.59	802,688,217.11	939,565,769.25
110nm	3,165,079,583.83	1,577,481,425.69	1,323,284,120.22	712,406,042.21	407,254,812.13	419,797,513.00
150nm	1,608,886,799.71	851,906,642.14	1,064,405,829.12	518,393,314.69	301,918,049.33	282,098,600.91
合 计	10,025,499,527.49	5,402,848,765.06	5,420,844,427.64	2,974,097,632.69	1,511,861,078.57	1,641,461,883.16

(2) 收入分解信息

于 2022 年度，营业收入按收入确认时间分解后的信息如下：

项 目	2022 年度
收入确认时间：	10,050,948,608.55
在某一时刻确认收入	10,050,948,608.55
在某段时间确认收入	-
合 计	10,050,948,608.55

37. 税金及附加

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
印花税	11,567,240.44	12,183,072.65	3,261,912.93
房产税	4,867,231.18	4,867,230.85	4,866,467.27
残疾人就业保障金	4,376,693.94	2,508,079.32	2,064,171.06
土地使用税	1,055,525.72	1,055,525.64	1,055,525.70
其他税费	1,415,705.55	170,113.25	57,247.57
合 计	23,282,396.83	20,784,021.71	11,305,324.53

38. 销售费用

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	54,542,986.70	35,690,562.84	16,949,865.76
专业服务费	1,511,195.52	1,098,037.34	1,131,485.36
业务招待费	1,118,105.14	712,700.09	251,979.20
会务费	528,970.61	405,264.76	446,229.84
差旅费	737,213.72	529,062.40	279,625.73
保险费	27,566.27	492,993.72	497,313.29
样品费	130,046.98	142,411.41	15,308.29
其他	1,140,937.44	616,748.58	223,111.54

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
合 计	59,737,022.38	39,687,781.14	19,794,919.01

39. 管理费用

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	212,823,160.59	151,168,844.12	84,543,687.59
固定资产折旧	19,486,083.57	11,952,604.85	23,204,214.62
专业服务费	17,963,427.50	26,505,758.64	17,740,247.39
环保费用	8,070,991.69	4,988,654.59	3,417,574.21
物业费	5,177,400.94	4,424,796.05	3,947,164.84
使用权资产折旧	4,400,333.19	10,679,579.06	-
无形资产摊销	3,230,364.56	2,973,438.39	2,640,414.67
修理费	3,432,977.20	4,133,308.20	3,817,680.94
保险费	1,593,945.10	1,146,222.61	1,167,138.32
办公楼改造费	1,004,586.16	5,357,956.45	2,913,736.64
邮电费	1,323,592.96	1,151,381.19	996,421.51
招聘费	1,789,192.80	6,767,248.28	377,973.67
差旅费	598,755.28	625,356.57	120,802.06
股份支付费用	-	2,665,009.26	121,050,201.46
租赁费	-	-	2,024,333.64
其他	14,030,139.50	8,213,710.86	6,071,206.27
合 计	294,924,951.04	242,753,869.12	274,032,797.83

40. 研发费用

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	517,252,118.55	223,708,872.98	94,784,301.41
固定资产折旧	118,406,562.64	92,509,751.48	77,511,675.72
材料投入	61,209,955.91	18,063,265.29	17,531,213.21
无形资产摊销	61,847,060.89	31,295,860.85	21,115,541.44
研究测试费用	43,367,077.80	14,234,828.20	11,402,624.78
委托研究开发费	42,091,776.52	8,953,500.15	18,227,208.22
修缮费	3,935,204.70	2,060,117.13	373,076.89
专业服务费	1,982,680.34	2,418,825.74	1,077,231.33
使用权资产折旧	1,443,962.88	1,373,271.43	-

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
其他	5,533,611.67	2,066,618.74	2,652,696.19
合计	857,070,011.90	396,684,911.99	244,675,569.19

41. 财务费用

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
利息支出	281,803,901.23	207,404,266.03	286,010,152.17
减：利息收入	77,457,373.16	29,183,209.75	24,277,059.65
利息净支出	204,346,528.07	178,221,056.28	261,733,092.52
汇兑损益	-274,581,440.85	-143,464,308.11	32,467,282.66
银行手续费	3,934,931.14	7,029,840.59	3,996,479.37
未确认融资费用摊销	132,060,825.99	78,309,112.37	48,931,609.02
长期薪酬财务费用	3,324,570.79	1,311,366.28	58,901.83
股权融资费	-	-	17,695,800.00
合计	69,085,415.14	121,407,067.41	364,883,165.40

42. 其他收益

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	93,797,054.56	70,329,585.30	62,053,047.60	与资产相关
直接计入当期损益的政府补助	14,100,895.42	19,719,164.96	20,107,536.30	与收益相关
合计	107,897,949.98	90,048,750.26	82,160,583.90	—

43. 投资收益

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
理财产品及大额存单投资收益	3,692,333.28	13,598,907.52	12,490,510.13
合计	3,692,333.28	13,598,907.52	12,490,510.13

44. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2022 年度	2021 年度	2020 年度
结构性存款	1,602,671.21	-	-3,265,902.78
可转让大额存单	2,023,208.33	-	-
合计	3,625,879.54	-	-3,265,902.78

45. 信用减值损失

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
应收账款坏账损失	-2,072,572.71	-289.00	230,833.74
其他应收款坏账损失	243,207.53	-249,805.09	10,997.20
合计	-1,829,365.18	-250,094.09	241,830.94

46. 资产减值损失

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、存货跌价损失	-306,613,283.77	-4,057,462.52	-12,382,381.21
二、无形资产减值损失	-	-	-295,739,181.74
三、其他流动资产-应收退货成本减值损失	-	-828,961.90	-2,145,761.07
合计	-306,613,283.77	-4,886,424.42	-310,267,324.02

47. 资产处置收益

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-	-	2,930.00
其中：固定资产	-	-	2,930.00
合计	-	-	2,930.00

48. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
与企业日常活动无关的政府补助	13,290,000.00	7,800,000.00	4,900,000.00
罚款收入	250,932.40	137,477.00	84,385.11
其他	807,299.45	140,175.66	491,731.19
合 计	14,348,231.85	8,077,652.66	5,476,116.30

(2) 与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度	与资产相关/ 与收益相关
企业上市奖励	2,000,000.00	3,000,000.00	-	与收益相关
引进高层次人才奖补	1,650,000.00	1,650,000.00	-	与收益相关
制造业增产增收政策奖补	5,000,000.00	-	-	与收益相关
稳企增效政策奖补	3,340,000.00	-	-	与收益相关
高质量发展政策-激励企业扩大规模	700,000.00	-	-	与收益相关

补助项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度	与资产相关/ 与收益相关
省人才资助奖补	600,000.00	300,000.00	350,000.00	与收益相关
企业直接融资省级财政奖励资金	-	1,200,000.00	-	与收益相关
支持企业挂牌上市奖励	-	500,000.00	-	与收益相关
技术合同交易额奖补	-	500,000.00	-	与收益相关
创新型省份建设资金-R&D 经费支出“双百强”规上企业奖励	-	500,000.00	500,000.00	与收益相关
首次认定高新技术企业奖补	-	100,000.00	-	与收益相关
企业表彰-绿色发展奖	-	50,000.00	50,000.00	与收益相关
集成电路产业政策资金-促进企业加速成长（企业上台阶奖励）	-	-	2,000,000.00	与收益相关
集成电路产业政策资金-鼓励知识产权创造	-	-	1,000,000.00	与收益相关
集成电路产业政策资金-企业上台阶奖励	-	-	500,000.00	与收益相关
新站经贸发展局财政性奖励-一次性股改奖励	-	-	500,000.00	与收益相关
合 计	13,290,000.00	7,800,000.00	4,900,000.00	—

49. 营业外支出

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
捐赠支出	55,397.48	-	-
存货报废损失	-	4,871,999.50	65,955.76
非流动资产毁损报废损失	-	1,082,456.56	-
其他	29,270.15	90,885.16	10,986.72
合 计	84,667.63	6,045,341.22	76,942.48

50. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
当期所得税费用	207,992.58	431,048.98	128,981.37
递延所得税费用	-	-	-
合 计	207,992.58	431,048.98	128,981.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
利润总额	3,156,404,224.07	1,729,263,038.44	-1,257,468,077.91

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
按法定/适用税率计算的所得税费用	473,460,633.62	259,389,455.77	-188,620,211.69
子公司适用不同税率的影响	26,813,465.39	286,541.88	45,588.25
调整以前期间所得税的影响	25,557,645.35	127,560.44	-
非应税收入的影响	-	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	763,877.26	2,078,601.76	661,620.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-344,481,810.72	-230,796,648.97	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	109,803,714.96	25,219,551.37	214,118,266.86
研发费用加计扣除	-111,930,997.16	-55,874,013.27	-26,076,282.58
税收优惠影响	-179,778,536.12	-	-
所得税费用	207,992.58	431,048.98	128,981.37

注：根据国发（2020）8号《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》规定：国家鼓励的集成电路线宽小于65纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

根据发改高技（2022）390号：《国家发展改革委工业和信息化部财政部海关总署税务总局关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》规定：企业可依据税务有关管理规定，先行按照企业条件和项目标准享受相关国内税收优惠政策。

公司结合实际情况对税收优惠政策中所列的要求逐项对比分析，判断预计很可能享受五免五减半的税收优惠政策，公司拟于2023年第一季度提出申请，2022年度作为五免五减半的第一年依据上述税收优惠政策享受所得税减免。

51. 其他综合收益

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况以及其他综合收益各项目的调节情况详见“附注五、33 其他综合收益”。

52. 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
政府补助	320,672,695.42	146,270,514.96	158,771,536.30
往来款	14,933,697.09	5,655,986,191.45	126,920,273.65
利息收入	77,457,373.16	29,183,209.75	25,442,552.49
罚款、违约金等收入	1,058,231.85	277,652.66	576,116.30
合 计	414,121,997.52	5,831,717,568.82	311,710,478.74

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
管理费用付现	48,673,028.48	62,470,220.86	41,796,876.73
研发费用付现	79,509,829.50	26,519,983.45	20,212,297.01
银行手续费	3,934,931.14	7,029,840.59	3,996,479.37
销售费用付现	4,823,804.10	3,750,750.75	3,474,081.82
外部单位往来款	152,316.67	-	387,779.95
其他	84,667.63	90,885.16	76,942.48
合 计	137,178,577.52	99,861,680.81	69,944,457.36

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
收回的借款保证金	413,549,401.77	-	-
合 计	413,549,401.77	-	-

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
支付的借款保证金	413,549,401.77	240,350,601.33	-
偿还租赁负债	296,635,880.93	166,604,174.11	-
支付的上市费用	8,093,000.00	9,392,000.00	-
偿还的长期应付款	-	-	62,352,130.65
合 计	718,278,282.70	416,346,775.44	62,352,130.65

53. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2022 年度	2021 年度	2020 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	3,156,196,231.49	1,728,831,989.46	-1,257,597,059.28

补充资料	2022 年度	2021 年度	2020 年度
加：资产减值准备	306,613,283.77	4,886,424.42	310,267,324.02
信用减值损失	1,829,365.18	250,094.09	-241,830.94
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,426,070,293.31	1,180,983,710.97	778,779,261.75
使用权资产折旧	136,430,604.79	95,570,009.43	-
无形资产摊销	217,521,202.34	181,613,172.54	191,120,397.14
长期待摊费用摊销	249,271.68	160,563.72	101,636.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-	-2,930.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	1,082,456.56	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,625,879.54	-	3,265,902.78
财务费用（收益以“-”号填列）	180,359,042.16	234,335,752.29	368,549,336.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,692,333.28	-13,598,907.52	-12,490,510.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-541,261,003.66	-406,097,729.40	-236,795,465.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	913,951,671.65	-939,654,925.53	-185,912,783.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-510,608,352.50	7,502,857,385.71	392,735,326.78
其他*1	-	2,665,009.26	121,050,201.46
经营活动产生的现金流量净额	6,280,033,397.39	9,573,885,006.00	472,828,807.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-	-
债务转为资本	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-	-
现金的期末余额	7,736,337,370.55	4,145,055,816.83	1,100,677,144.87
减：现金的期初余额	4,145,055,816.83	1,100,677,144.87	1,061,284,132.45
加：现金等价物的期末余额	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	3,591,281,553.72	3,044,378,671.96	39,393,012.42

注：*1、其他为确认的股份支付费用。

(2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一、现金	7,736,337,370.55	4,145,055,816.83	1,100,677,144.87
其中：库存现金	-	-	-
可随时用于支付的银行存款	7,736,337,370.55	4,145,055,816.83	1,100,677,144.87
可随时用于支付的其他货币资金	-	-	-
二、现金等价物	-	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	7,736,337,370.55	4,145,055,816.83	1,100,677,144.87

54. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2022 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	158,259,569.08	押汇保证金、保函保证金、信用证保证金
固定资产	2,334,803,763.00	抵押用于反担保
合 计	2,493,063,332.08	—

55. 外币货币性项目

(1) 2022 年末外币货币性项目

项 目	2022 年 12 月 31 日外币 余额	折算汇率	2022 年 12 月 31 日折算 人民币余额
货币资金			5,828,292,688.93
其中：美元	836,575,876.41	6.9646	5,826,416,348.85
日元	35,835,372.00	0.05236	1,876,340.08
应收账款			447,057,684.38
其中：美元	64,190,001.49	6.9646	447,057,684.38
其他应收款			365,816.86
其中：日元	6,986,571.00	0.05236	365,816.86
应付账款			632,440,919.62
其中：美元	32,736,308.33	6.9646	227,995,293.00
日元	6,534,437,026.00	0.05236	342,143,122.68
欧元	8,393,283.48	7.4229	62,302,503.94
其他应付款			3,352,684,479.19
其中：美元	481,373,141.25	6.9646	3,352,571,379.55
日元	2,160,039.00	0.05236	113,099.64

(2) 2021 年末外币货币性项目

项 目	2021 年 12 月 31 日外币 余额	折算汇率	2021 年 12 月 31 日折算 人民币余额
货币资金			2,036,840,113.24
其中：美元	316,888,376.36	6.3757	2,020,385,221.16
日元	296,912,524.00	0.05542	16,454,892.08
应收账款			933,940,355.98
其中：美元	146,484,363.44	6.3757	933,940,355.98
其他应收款			400,709.51
其中：美元	842.00	6.3757	5,368.34
日元	7,133,547.00	0.05542	395,341.17
应付账款			1,906,226,829.07
其中：美元	170,147,445.11	6.3757	1,084,809,065.79
日元	14,774,410,179.00	0.05542	818,797,812.12
欧元	362,889.20	7.2197	2,619,951.16
其他应付款			3,253,287,849.34
其中：美元	510,217,751.25	6.3757	3,252,995,316.64
日元	5,278,468.00	0.05542	292,532.70
短期借款			1,899,395,235.91
其中：美元	99,490,524.01	6.3757	634,321,733.93
日元	22,827,020,966.79	0.05542	1,265,073,501.98

(3) 2020 年末外币货币性项目

项 目	2020 年 12 月 31 日外币 余额	折算汇率	2020 年 12 月 31 日折算 人民币余额
货币资金			438,583,799.09
其中：美元	64,468,347.32	6.5249	420,649,519.43
日元	283,590,760.00	0.06324	17,934,279.66
应收账款			265,220,095.91
其中：美元	40,647,380.94	6.5249	265,220,095.91
其他应收款			456,975.36
其中：美元	1,722.57	6.5249	11,239.60
日元	7,048,320.00	0.06324	445,735.76
应付账款			1,000,264,456.59
其中：美元	82,992,589.87	6.5249	541,518,349.64

项 目	2020 年 12 月 31 日外币 余额	折算汇率	2020 年 12 月 31 日折算 人民币余额
日元	7,228,868,081.00	0.06324	457,153,617.44
欧元	198,441.06	8.025	1,592,489.51
其他应付款			6,524,900.00
其中：美元	1,000,000.00	6.5249	6,524,900.00

56. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助

项 目	金 额	资产负 债表 列报 项 目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额			计入当 期损 益 或 冲 减 相 关 成 本 费 用 损 失 的 列 报 项 目
			2022 年度	2021 年度	2020 年度	
合肥市政府招商引资投资厂房	981,795,519.36	递延收益	32,786,300.16	32,786,300.18	30,588,920.49	其他收益
三重一创-建设专项引导资金（一事一议）	487,000,000.00	递延收益	51,476,181.61	33,543,857.89	28,446,748.62	其他收益
三重一创-重大新兴产业基地新建项目补助	12,804,300.00	递延收益	1,286,341.19	1,299,346.43	1,307,006.44	其他收益
支持企业研发投入-研发设备及工具补助	5,000,000.00	递延收益	547,895.63	528,829.08	528,829.06	其他收益
集成电路产业政策资金-研发设备及工具补助	5,000,000.00	递延收益	528,829.08	547,895.64	45,657.97	其他收益
购置研发仪器设备补助	9,056,000.00	递延收益	938,339.76	741,886.32	699,912.33	其他收益
省集成电路新基地建设专项资金	4,500,000.00	递延收益	507,222.91	507,222.81	380,417.14	其他收益
省级外经贸发展专项资金-固定资产投入补助	500,000.00	递延收益	55,555.58	55,555.59	55,555.55	其他收益
12 寸晶圆制造基地项目专项财政扶持资金	16,100,000.00	递延收益	2,737,099.08	228,091.59	-	其他收益
工业互联网政策研发设备补贴	10,000,000.00	递延收益	1,087,197.24	90,599.77	-	其他收益
先进制造业发展政策资金-企业技术改造补贴	20,000,000.00	递延收益	1,465,139.92	-	-	其他收益
2022 年合肥市集成电路产业政策奖补-EDA 工具软件	2,000,000.00	递延收益	380,952.40	-	-	其他收益
科技创新计划奖补	32,000,000.00	递延收益	-	-	-	—
合 计	1,585,755,819.36	—	93,797,054.56	70,329,585.30	62,053,047.60	—

(2) 与收益相关的政府补助

项 目	种类	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额			计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
		2022 年度	2021 年度	2020 年度	
人才补贴	与收益相关	5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	其他收益
合肥市外贸促进政策项目-物流补贴	与收益相关	1,950,000.00	2,183,120.00	2,501,997.00	其他收益
“三代”税款手续费返还	与收益相关	1,069,674.58	838,371.24	1,126,565.93	其他收益
企业购买省外先进技术成果补助	与收益相关	500,000.00	500,000.00	-	其他收益
政策兑现科技保险补助	与收益相关	300,000.00	-	-	其他收益
知识产权政策奖补	与收益相关	218,000.00	160,000.00	60,000.00	其他收益
外经贸发展专项资金-国际认证、商标注册和专利申请费补贴	与收益相关	248,000.00	470,000.00	300,000.00	其他收益
政策兑现合同转化与技术合同交易补助	与收益相关	100,000.00	-	-	其他收益
贷款贴息	与收益相关	37,767,800.00	91,901,350.00	-	财务费用
海峡两岸集成电路产业合作试验区展示馆补助	与收益相关	-	1,950,000.00	-	其他收益
智能工厂奖补	与收益相关	-	1,000,000.00	-	其他收益
高管住房补贴	与收益相关	-	840,000.00	840,000.00	其他收益
承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金-加工贸易物流补贴	与收益相关	-	652,039.00	839,129.00	其他收益
稳岗补贴	与收益相关	827,620.84	555,534.72	354,572.00	其他收益
首次认定高企及辅导费补贴	与收益相关	-	290,000.00	-	其他收益
降低企业引进高科技人才成本资金	与收益相关	544,700.00	280,100.00	230,700.00	其他收益
集成电路产业政策资金-购买 IP 补助	与收益相关	3,000,000.00	-	3,000,000.00	其他收益
稳定就业补贴	与收益相关	-	-	500,000.00	其他收益
失业保险费返还	与收益相关	-	-	354,572.37	其他收益
新录入人员岗前技能培训	与收益相关	258,400.00	-	-	其他收益
高质量发展政策知识产权专利授权奖补	与收益相关	84,500.00	-	-	其他收益
企业上市受理奖励	与收益相关	2,000,000.00	3,000,000.00	-	营业外收入
引进高层次人才奖补	与收益相关	1,650,000.00	1,650,000.00	-	营业外收入
企业直接融资省级财政奖励资金	与收益相关	-	1,200,000.00	-	营业外收入
支持企业挂牌上市奖励	与收益相关	-	500,000.00	-	营业外收入
技术合同交易额奖补	与收益相关	-	500,000.00	-	营业外收入
创新型省份建设资金-R&D 经费支出“双百强”规上企业奖励	与收益相关	-	500,000.00	500,000.00	营业外收入

项 目	种类	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额			计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
		2022 年度	2021 年度	2020 年度	
省人才资助奖补	与收益相关	600,000.00	300,000.00	350,000.00	营业外收入
首次认定高新技术企业奖补	与收益相关	-	100,000.00	-	营业外收入
企业表彰-绿色发展奖	与收益相关	-	50,000.00	50,000.00	营业外收入
集成电路产业政策资金-促进企业加速成长（企业上台阶奖励）	与收益相关	-	-	2,000,000.00	营业外收入
集成电路产业政策资金-鼓励知识产权创造	与收益相关	-	-	1,000,000.00	营业外收入
集成电路产业政策资金-企业上台阶奖励	与收益相关	-	-	500,000.00	营业外收入
新站经贸发展局财政性奖励-一次性股改奖励	与收益相关	-	-	500,000.00	营业外收入
高质量发展政策-激励企业扩大规模	与收益相关	700,000.00	-	-	营业外收入
稳企增效政策奖补	与收益相关	3,340,000.00	-	-	营业外收入
制造业增产增收政策奖补	与收益相关	5,000,000.00	-	-	营业外收入
合 计	—	65,158,695.42	119,420,514.96	25,007,536.30	—

(3) 报告期内不存在政府补助退回情况

六、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动—新设子公司

子公司简称	公司成立时间	注册资本	投资主体	出资额	持股比例
北京晶芯成	2020/9/07	20.00 万元	本公司	20.00 万元	100.00%
南京晶驱	2020/8/24	20.00 万元	本公司	20.00 万元	100.00%
新品集成	2021/8/24	400,000.00 万元	本公司	400,000.00 万元	52.02%

七、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
日本晶合	日本	日本	设计、研发	100.00	-	设立
北京晶芯成	北京市	北京市	集成电路设计及销售服务	100.00	-	设立
南京晶驱	江苏南京	江苏南京	集成电路设计及销售服务	100.00	-	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新晶集成	合肥市	合肥市	集成电路芯片及产品制造、销售服务	52.02	-	设立

2. 在合营安排或联营企业中的权益

公司无合营或联营企业。

八、与金融工具相关的风险

1. 定性信息

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

2. 信用风险信息

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、合同资产以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：①定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；②定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生

资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2022 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
短期借款	287,073,782.03	-	-	-
应付账款	926,245,358.53	-	-	-
其他应付款	2,404,219,038.40	1,052,803,908.42	1,129,377,467.19	1,351,293,194.37
一年内到期的非流动负债	669,078,665.27	-	-	-
其中：一年内到期的长期借款	408,949,854.61	-	-	-
其中：一年内到期的租赁负债	260,128,810.66	-	-	-
长期借款	-	828,579,569.67	1,178,777,758.74	6,219,514,542.57
租赁负债	-	258,346,850.38	255,473,078.64	2,442,231,262.77
合计	4,955,695,509.50	2,139,730,328.47	2,563,628,304.57	10,013,038,999.71

备注：上表所列一年内到期的非流动负债不含一年内到期的长期应付职工薪酬。租赁负债及长期借款列示金额为原值减一年内到期的负债。

4. 市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。

①截止 2022 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目名称	2022 年 12 月 31 日					
	美元		欧元		日元	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	836,575,876.41	5,826,416,348.85	-	-	35,835,372.00	1,876,340.08
应收账款	64,190,001.49	447,057,684.38	-	-	-	-

项目名称	2022年12月31日					
	美元		欧元		日元	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
其他应收款	-	-	-	-	6,986,571.00	365,816.86
应付账款	32,736,308.33	227,995,293.00	8,393,283.48	62,302,503.94	6,534,437,026.00	342,143,122.68
其他应付款	481,373,141.25	3,352,571,379.55	-	-	2,160,039.00	113,099.64

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响，公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

① 敏感性分析

于2022年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值10%，那么本公司当期的净利润将减少或增加26,929.07万元。

于2022年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于欧元升值或贬值10%，那么本公司当期的净利润将增加或减少623.03万元。

于2022年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于日元升值或贬值10%，那么本公司当期的净利润将增加或减少3,400.14万元。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止2022年12月31日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，本公司当期的净利润就会下降或增加2,804.47万元。

九、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值

所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

1. 于 2022 年 12 月 31 日，以公允价值计量的资产和负债的公允价值

项 目	2022 年 12 月 31 日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	29,107,294.40	1,558,893,212.87	-	1,588,000,507.27
（一）其他权益工具投资	29,107,294.40	-	-	29,107,294.40
（二）交易性金融资产	-	1,257,160,004.54	-	1,257,160,004.54
（三）其他非流动金融资产	-	301,733,208.33	-	301,733,208.33
二、非持续的公允价值计量	-	-	-	-

本公司其他权益工具投资系持有思特威（上海）电子科技股份有限公司股权，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

2. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、一年内到期的非流动负债、租赁负债和长期应付款等。

十、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
合肥建投	合肥市	城市建设、投资及管理	1,329,800.00 万元	31.14	31.14

① 本公司的母公司情况的说明：合肥建投直接持有本公司 31.14% 股权、通过间接持有本公司 21.85% 股权，合计持有本公司 52.99% 股权，为本公司控股股东。

② 本公司最终控制方：合肥市国有资产监督管理委员会。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3. 本公司合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	公司简称	其他关联方与本公司关系
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	合肥芯屏	持有公司 21.85%的股份且受合肥建投控制
美的创新投资有限公司	美的创新	持有公司 5.85%的股份
力晶科技股份有限公司	力晶科技	持有公司 27.44%的股份
合肥蓝科投资有限公司	合肥蓝科	受合肥建投控制
合肥合燃华润燃气有限公司	合肥燃气	受合肥建投控制
合肥供水集团有限公司	合肥供水	受合肥建投控制
合肥蜀山百大购物中心有限公司	百大购物	受合肥建投控制
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	百大合家福	受合肥建投控制
合肥市住房租赁发展股份有限公司	合肥市住房租赁	受合肥建投控制
智成电子股份有限公司	智成电子	受力晶科技控制
晶相光电股份有限公司	晶相光电	本公司董事担任该公司董事
合肥融科项目投资有限公司	融科投资	受合肥建投控制
合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）	建恒新能源基金	受合肥建投控制
蔡国智	—	本公司董事长
蔡辉嘉	—	本公司总经理
邱显寰	—	本公司副总经理
詹奕鹏	—	本公司副总经理
简瑞荣	—	本公司协理
朱才伟	—	本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人
周义亮	—	本公司副总经理
李迦谕	—	本公司协理
王燕	—	本公司职工代表监事

备注：合肥燃气集团有限公司于 2022 年 12 月变更名称为合肥合燃华润燃气有限公司。

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2022 年度发生额	2021 年度发生额	2020 年度发生额
智成电子	采购服务	16,158,185.10	7,844,846.17	3,726,170.72
合肥燃气	采购货物	12,950,127.05	5,962,037.60	3,080,928.55
合肥供水	采购货物	12,944,480.39	6,333,855.56	3,684,248.72
力晶科技	专利转让手续费	-	-	74,479.78
力晶科技	咨询服务	-	-	1,527,218.86
合肥建投	咨询服务	-	-	1,996,852.80
百大购物	采购货物	-	-	27,000.00
百大合家福	采购货物	-	-	22,800.00
合肥市住房租赁	房屋租赁及代缴水电费	153,199.76	1,428,000.00	-

2022 年 4 月 27 日，公司与合肥市住房租赁发展股份有限公司签订了《关于预存水、电费缴纳结算协议》，根据协议约定，为保证智能水电表正常使用，公司预存水电费至合肥市住房租赁发展股份有限公司账户中，并在合肥市住房租赁发展股份有限公司每月扣款后，于月底前将上述款项再次充值至指定账户。

②出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2022 年度发生额	2021 年度发生额	2020 年度发生额
晶相光电	销售商品	65,421.72	62,289.92	-

(2) 关联租赁情况

①2020 年度

本公司作为承租方的土地租赁情况如下：

出租方名称	租赁资产种类	2020 年度确认的租赁费
合肥蓝科	土地使用权	2,632,423.48

本公司作为承租方租入合肥蓝科厂房及厂务设备，报告期内长期应付款原值增减变动情况列示如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2020 年度	1,839,387,854.06	24,793,064.77	62,352,130.64	1,801,828,788.19

②2021 年至 2022 年

A.合肥蓝科

本公司于 2021 年 1 月 1 日实施新租赁准则，按照新租赁准则相关要求，本公司将上述租入的土地使用权、厂房及厂务设备调整计入使用权资产，相关负债调整计入租赁负债。

2022 年度与 2021 年度与土地使用权租赁、厂房及厂务设备相关的租赁负债原值增减变动情况列示如下：

出租方名称	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
合肥蓝科	3,464,490,208.36	-	255,237,501.36	3,209,252,707.00

(续上表)

出租方名称	2020 年 12 月 31 日	会计政策变更	2021 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
合肥蓝科	-	1,884,449,926.13	1,884,449,926.13	1,743,539,118.65	163,498,836.42	3,464,490,208.36

厂房及厂务设备等为本公司向合肥蓝科通过融资租赁租入资产，相关数据披露详见附注“五、合并财务报表项目注释 10.固定资产”、“五、合并财务报表项目注释 26.租赁负债”及“五、合并财务报表项目注释 27.长期应付款”。

B.合肥市住房租赁

2022 年，公司与合肥市住房租赁签订房屋租赁合同，相关的租赁负债原值增减变动情况列示如下：

出租方名称	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
合肥市住房租赁	-	4,800,600.00	4,258,818.00	541,782.00

(3) 关联担保情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司接受关联方的担保情况如下：

担保方	出借人	借款余额（含一年内到期的长期借款）	借款日期	到期日	担保是否已经履行完毕	本公司是否提供反担保
合肥建投	华泰资产管理有限公司	1,300,000,000.00	2018/9/28	2028/9/27	否	是
合肥建投	华泰资产管理有限公司	300,000,000.00	2018/10/30	2028/10/29	否	是
合肥建投	华泰资产管理有限公司	420,000,000.00	2018/11/8	2028/11/7	否	是

担保方	出借人	借款余额（含一年内到期的长期借款）	借款日期	到期日	担保是否已经履行完毕	本公司是否提供反担保
合肥建投	华泰资产管理有限公司	900,000,000.00	2019/7/18	2029/7/17	否	是
合肥建投	华泰资产管理有限公司	80,000,000.00	2019/8/29	2029/8/28	否	是
合肥建投	平安银行股份有限公司合肥分行	620,800,000.00	借款发放日	2027/10/10	否	是
合肥建投	兴业银行股份有限公司合肥分行	151,254,015.29	借款发放日	2028/1/7	否	是
合肥建投	兴业银行股份有限公司合肥分行	390,000,000.00	借款发放日	2027/10/10	否	是
合肥建投	中国银行股份有限公司庐阳支行	633,978,305.08	借款发放日	2028/1/15	否	是
合肥建投	中国银行股份有限公司庐阳支行	182,926,900.00	2021/3/19	2027/10/10	否	是

备注：上表所列借款余额为借款本金余额，含一年内到期的长期借款本金余额。

2018年8月20日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司与华泰资产管理有限公司签署了《华泰—合肥晶合集成电路基础设施债权投资计划保证担保合同》，为本公司与华泰资产管理有限公司签署的《投资计划》提供本金不超过300,000.00万元的全额无条件不可撤销连带责任保证担保，保证期间为保证担保合同生效之日起至投资合同项下约定的债务人履行全部债务期限届满之日起两年。

2021年3月17日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司与平安银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证担保合同》，为本公司与平安银行股份有限公司合肥分行签署的《综合授信额度合同》提供85,000.00万元连带责任保证担保，保证期间为《最高额保证担保合同》生效日至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后两年。

2017年12月29日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证合同》，为本公司最高本金限额70,000.00万元提供连带责任保证担保。保证额度有效期自2017年12月29日至2028年1月5日止。

2017年12月14日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司与中国银行股份有限公司庐阳支行签署了《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司庐阳支行签署的《授信额度协议》70,000.00万元提供连带责任保证担保，保证期间为《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日期间主债权发生期间届满之日起两年。

2021年3月17日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司与中国银行股份有限公司庐阳支行签署了《保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司庐阳支行签署的《固定资产借款合同》25,000.00万元提供连带责任保证担保，保证期间为《固定资产借款合同》之主债权的清偿期届满之日起三年。

2021年4月13日，本公司与合肥市建设投资控股（集团）有限公司签订了《反担保合同补充协议》，在符合海关监管相关规定的前提下，合肥市建设投资控股（集团）有限公司对于本公司所有的晶合一期5万片月产能所对应的机器设备及原物料中海关监管期限已届满的部分有权变卖处分和优先受偿。对于本公司其余在海关监管期限内的机器设备及原物料，在海关监管期限届满后，合肥市建设投资控股（集团）有限公司自动享有前述权利。

2021年7月1日，本公司与合肥市建设投资控股（集团）有限公司签订《动产浮动抵押合同》，约定合肥市建设投资控股（集团）有限公司对于本公司所有的晶合一期5万片月产能所对应的机器设备及原物料中海关监管期限已届满的部分有权变卖处分和优先受偿，对于抵押人其余在海关监管期限内的机器设备及原物料，在海关监管期限届满后合肥市建设投资控股（集团）有限公司自动享有前述权利。

合肥市建设投资控股（集团）有限公司对本公司海关监管期限届满的部分机器设备办理抵押登记，截至2022年12月31日，已办理抵押登记的机器设备于2022年12月31日的账面原值、累计折旧及账面价值如下：

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
机器设备	4,438,714,993.41	2,103,911,230.41	2,334,803,763.00

（4）关键管理人员报酬

项目	2022年度发生额	2021年度发生额	2020年度发生额
关键管理人员报酬	36,318,308.13	21,689,409.99	14,404,283.87

（5）其他关联方交易

2022年8月29日，公司与融科投资签订了3份《徽商银行单位大额存单产品转让协议》，约定公司按照商定的转让价格受让融科投资持有的3份产品徽商银行股份有限公司单位大额存单，并委托徽商银行合肥蜀山支行办理相关转让事宜，转让信息具体如下：

产品名称	产品本金	转让价格
徽商银行股份有限公司单位大额存单	100,000,000.00	100,162,555.56
徽商银行股份有限公司单位大额存单	100,000,000.00	100,162,555.56
徽商银行股份有限公司单位大额存单	100,000,000.00	100,162,555.56

2022年12月26日，公司与建恒新能源基金签订了2份《徽商银行单位大额存单产品转让协议》，约定公司按照商定的转让价格受让建恒新能源基金持有的2份产品徽商银行股份有限公司单位大额存单，并委托徽商银行合肥蜀山支行办理相关转让事宜，转让信息具体如下：

产品名称	产品本金	转让价格
徽商银行股份有限公司单位大额存单	100,000,000.00	100,178,222.22
徽商银行股份有限公司单位大额存单	50,000,000.00	50,089,111.11

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	合肥燃气	720,000.00	-	400,000.00	-	400,000.00	-
其他应收款	合肥市住房租赁	1,526,950.00	-	219,000.00	-		
其他应收款	詹奕鹏	20,212.50	-	-	-	20,212.50	-
其他应收款	李迦谕	-	-	11,624.52	-		
其他应收款	邱显襄	26,819.42	-	-	-	138,310.40	-
其他应收款	简瑞荣	32,409.68	-	-	-	1,809.68	-
其他应收款	智成电子	-	-	599.32	29.97	-	-

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
其他应付款	晶相光电	-	18,219,710.38	-
其他应付款	合肥蓝科	636,672.00	1,299,072.00	7,129,443.31
其他应付款	蔡辉嘉	13,374.40	5,148.00	-
其他应付款	简瑞荣	-	3,817.50	-
其他应付款	邱显襄	-	3,442.80	-

项目名称	关联方	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
其他应付款	蔡国智	-	1,690.00	-
其他应付款	周义亮	-	1,049.00	742.50
其他应付款	李迦谕	-	-	3,424.65
其他应付款	朱才伟	-	-	543.00
应付账款	合肥燃气	1,056,937.84	578,968.45	271,823.78
应付账款	智成电子	6,887,785.07	5,834,739.04	1,897,390.35
应付账款	合肥供水	-	133,596.20	-
应付账款	合肥蓝科	-	-	7,041,269.26
应付账款	力晶科技	-	-	74,393.13
应付账款	合肥市住房租赁	23,954.35	-	-
合同负债	晶相光电	19,942,560.42	-	-
长期应付款	合肥蓝科	-	-	1,801,828,788.19
租赁负债	合肥蓝科	3,209,252,707.00	3,464,490,208.36	-
租赁负债	合肥市住房租赁	541,782.00	-	-

备注：上表所列租赁负债金额为租赁负债原值（含一年内到期的租赁负债）金额。

7. 其他事项

根据合肥市政府、合肥建投与力晶科技分别签订的《合作框架协议》及《投资参股协议》等，基于合作需要，力晶科技与本公司于2015年10月19日签订《委托经营管理合约》。2020年1月2日，本公司与力晶科技签订了《委托经营管理合约之终止协议》，双方同意自2019年12月25日起即终止《委托经营管理合约》。

十一、股份支付

以权益结算的股份支付情况

1、2022年度，本公司未发生以权益结算的股份支付。

2、2021年度

授予日权益工具公允价值的确定方法	可行权权益工具数量的确定依据	本期以权益结算的股份支付计入资本公积的金额	本期以权益结算的股份支付确认的费用总额
与授予日最接近日期公司PE入股价格	《增资协议》	2,665,009.26	2,665,009.26

3、2020年度

授予日权益工具公允价值的确定方法	可行权权益工具数量的确定依据	本期以权益结算的股份支付计入资本公积的金额	本期以权益结算的股份支付确认的费用总额
与授予日最接近日期公司 PE 入股价格	《增资协议》	121,050,201.46	121,050,201.46

4、2020年9月，公司实施了员工持股计划，设立合肥晶焠、合肥晶咖、合肥晶珏、合肥晶恳、合肥晶辽、合肥晶梢、合肥晶柔、合肥晶炯、合肥晶雄、合肥晶本、合肥晶洛、合肥晶确、合肥晶遂、合肥晶铁及合肥晶妥十五个员工持股平台，合计持有本公司13,100.00万元出资额的股权，对应股改后股份公司2,216.21万股股份，占公司总股本的1.4729%。2020年9月公司引入外部投资者，故以该次增资的投前估值为计算股份支付的公允价值参考依据，在2020年9月一次性确认股份支付费用并计入管理费用。

十二、承诺及或有事项

1、厂务及配套项目收购意向协议

2021年，本公司与合肥蓝科投资有限公司签订了《晶合二厂厂务及配套项目收购意向协议》，合同约定在项目交付日5年内参考第三方机构资产评估价值及晶合已支付之建造成本，一次性完成收购。

2、产能预约

客户通过与本公司签订产能保证金合同并支付产能保证金的形式预定本公司未来产品产能。截至2022年12月31日，客户预定本公司未来产品产能的具体情况如下：

单位：片

产品名称	2023年	2024年	2025年	2026年	合计
28nm	-	-	60,000.00	60,000.00	120,000.00
40nm	-	35,025.00	62,600.00	65,800.00	163,425.00
55nm	61,200.00	226,200.00	250,200.00	249,600.00	787,200.00
90nm	519,605.00	70,875.00	75,300.00	83,100.00	748,880.00
110nm	299,710.00	366,250.00	416,700.00	450,500.00	1,533,160.00
150nm	459,390.00	184,225.00	229,000.00	235,000.00	1,107,615.00
合计	1,339,905.00	882,575.00	1,093,800.00	1,144,000.00	4,460,280.00

3、开具保函情况

开证行	保函编号	受益人名称	保函金额	币种	开立日期	失效日期
中国银行合肥庐阳支行	GC0886922000808	中华人民共和国合肥海关	5,000,000.00	CNY	2022/5/23	2023/5/23
中国银行合肥庐阳支行	GC0886922000139	中华人民共和国合肥海关	10,000,000.00	CNY	2022/1/21	2023/1/21
中国银行合肥庐阳支行	GC0886922001444	中华人民共和国合肥海关	10,000,000.00	CNY	2022/9/14	2023/9/14

4、开立信用证情况

截至2022年12月31日止，本公司开立信用证情况如下：

序号	开证行	信用证号码	受益人	信用证金额	币种	开立日	到期日	未使用金额
1	中国农业银行合肥金寨路支行	121810LC19000372	ThermoKeytekLLC	232,872.00	USD	2019-11-29	2020-5-24	23,287.20
2	平安银行合肥分行营业部	LC2661202000021	MALVERNANALYTICALB.V	606,000.00	EUR	2021-1-15	2021-10-30	60,600.00
3	中国银行合肥庐阳支行	LC0886921000654	TECHMAXINTERNATIONALTRADING(SHANGHAI)CO.,LTD	173,265,000.00	JPY	2021-6-11	2022-1-31	17,326,500.00
4	平安银行合肥分行营业部	LC2661202100035	MalvernPanalyticalB.V	604,000.00	EUR	2021-7-30	2022-3-31	60,400.00
5	兴业银行望江东路支行	08101LC21003496C	SpiroxInternationalLimited	1,550,000.00	USD	2021-9-10	2022-3-31	155,000.00
6	平安银行合肥分行营业部	LC2661202100047	EdwardsLimited	1,450,238.00	USD	2021-9-15	2022-11-30	121,500.00
7	中国银行合肥庐阳支行	LC0886921001048	BEIJINGNAURAMICROELECTRONICSEQUIPMEN TCO.,LTD.	2,080,000.00	USD	2021-10-9	2022-4-30	208,000.00
8	中信银行合肥分行	732601LC21001064	TECHMAXINTERNATIONALTRADING(SHANGHAI)CO.,LTD	56,680,000.00	JPY	2021-11-1	2022-4-30	5,668,000.00
9	徽商银行蜀山支行	LC40102372100002	BEIJINGNAURAMICROELECTRONICSEQUIPMEN TCO.,LTD.	6,000,000.00	USD	2021-12-14	2022-6-30	600,000.00
10	徽商银行蜀山支行	LC40102372100003	BEIJINGNAURAMICROELECTRONICSEQUIPMEN TCO.,LTD.	6,000,000.00	USD	2021-12-14	2022-6-30	600,000.00
11	浦发银行合肥分行营业部	LC580121000185	BEIJINGNAURAMICROELECTRONICSEQUIPMEN TCO.,LTD.	2,080,000.00	USD	2021-12-8	2022-6-30	208,000.00
12	中国农业银行合肥金寨路支行	121810LC21000300	EdwardsLimited	1,015,736.00	USD	2021-12-22	2023-5-31	31,316.00
13	徽商银行蜀山支行	LC40102372100004	BEIJINGNAURAMICROELECTRONICSEQUIPMEN TCO.,LTD.	6,360,000.00	USD	2021-12-14	2022-6-30	636,000.00
14	徽商银行蜀山支行	LC40102372100010	BEIJINGNAURAMICROELECTRONICSEQUIPMEN TCO.,LTD.	1,050,000.00	USD	2021-12-21	2022-6-30	105,000.00
15	中国银行合肥庐阳支行	LC0886921001344	CanonInc.	1,406,000,000.00	JPY	2021-12-23	2023-7-31	83,657,000.00
16	平安银行合肥分行营业部	LC2661202100057	MalvernPanalyticalB.V	606,000.00	EUR	2021-12-22	2022-5-31	60,600.00
17	浦发银行合肥分行营业部	LC580122000054	CanonInc.	484,000,000.00	JPY	2022-4-29	2022-12-31	48,400,000.00

序号	开证行	信用证号码	受益人	信用证金额	币种	开立日	到期日	未使用金额
18	徽商银行蜀山支行	LC40102372100031	BEIJINGNAURAMICROELECTRONICSEQUIPMEN TCO.,LTD.	2,080,000.00	USD	2022-1-6	2022-7-31	208,000.00
19	徽商银行蜀山支行	LC40102372100032	BEIJINGNAURAMICROELECTRONICSEQUIPMEN TCO.,LTD.	3,180,000.00	USD	2022-1-6	2022-7-31	318,000.00
20	平安银行合肥分行营业部	LC2661202100058	BrooksCCSJapanK.K.	1,200,000.00	USD	2022-1-14	2022-7-31	120,000.00
21	平安银行合肥分行营业部	LC2661202200007	EdwardsLimited	1,918,216.00	USD	2022-2-18	2023-9-30	103,316.00
22	平安银行合肥分行营业部	LC2661202200013	MalvernPanalyticalB.V.	606,000.00	EUR	2022-4-26	2022-10-31	60,600.00
23	招商银行合肥分行营业部	551LC2200182	A & BAnalytical & BioScienceInstruments	146,800,000.00	JPY	2022-4-24	2022-10-30	14,680,000.00
24	招商银行合肥分行营业部	551LC2200225	EdwardsLimited	526,000.00	USD	2022-4-29	2023-4-29	153,000.00
25	中国银行合肥庐阳支行	LC0886922000127	CanonInc.	1,890,000,000.00	JPY	2022-1-24	2023-7-31	75,924,000.00
26	中信银行合肥分行	732601LC22000411	EVGroupEurope & Asia/PacificGmbH	3,829,000.00	EUR	2022-5-6	2023-2-5	547,000.00
27	中信银行合肥分行	732601KL22000037	迪科特测试科技(苏州) 有限公司	4,972,800.00	CNY	2022-6-13	2022-12-31	497,280.00
28	徽商银行蜀山支行	LC40102372200003	ECITechnology,Inc.	1,315,150.00	USD	2022-7-8	2023-4-9	131,515.00
29	浦发银行合肥分行	LC580122000089	TokyoElectronLimited	210,574,000.00	JPY	2022-7-27	2023-2-28	21,057,400.00
30	中信银行合肥分行	732601LC22000827	ADVANTESTCORPORAT ION	282,005.14	USD	2022-9-1	2023-1-31	28,200.51
31	招商银行合肥分行	551LC2200399	THERMOFISHERSCIENT IFIC(CHINA)CO.,LTD.	160,000.00	USD	2022-9-23	2023-1-31	16,000.00
32	招商银行合肥分行	551LC2200437	AppliedMaterialsSouthEast AsiaPte.Ltd	4,826,500.00	USD	2022-9-21	2023-4-30	482,650.00
33	中国银行合肥庐阳支行	LC0886922001037	KLACORPORATION	2,793,000.00	USD	2022-9-19	2023-2-28	2,793,000.00
34	中国银行合肥庐阳支行	LC0886922001068	KLACORPORATION	3,882,500.00	USD	2022-9-28	2023-3-20	388,250.00
35	中国民生银行合肥分行	3401LC22000140	AppliedMaterialsSouthEast AsiaPte.Ltd	4,728,000.00	USD	2022-10-27	2023-6-30	472,800.00
36	中国民生银行合肥分行	3401LC22000141	MurataMachinery,Ltd.	657,937,091.00	JPY	2022-11-2	2023-10-20	657,937,091.00
37	中国民生银行合肥分行	3401LC22000154	SHIBAURAMECHATRO NICSCORPORATION	191,000,000.00	JPY	2022-12-2	2023-6-30	191,000,000.00
38	兴业银行合肥分行	08101LC22003974C	QUALITAU,INC	1,497,000.00	USD	2022-12-6	2023-9-30	1,497,000.00
39	招商银行合肥分行	LC5512200171	国网通金财(北京)信息 科技有限公司	1,461,782.03	CNY	2022-12-9	2023-3-9	1,461,782.03
40	招商银行合肥分行	551LC2200595	AppliedMaterialsSouthEast AsiaPte.Ltd	12,608,000.00	USD	2022-12-28	2023-8-19	12,608,000.00
41	中国农业银行合肥金寨路支行	121810LC22000136	KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION	147,032,000.00	JPY	2022-8-5	2023-4-30	14,703,200.00
42	招商银行合肥分行	551LC2200465	NIKON CORPORATION	2,870,000,000.00	JPY	2022-9-30	2023-3-31	287,000,000.00
43	中国徽商银行合肥分行	LC40102372200006	KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION	63,900,000.00	JPY	2022-9-15	2023-6-30	6,390,000.00

序号	开证行	信用证号码	受益人	信用证金额	币种	开立日	到期日	未使用金额
44	中国徽商银行 合肥分行	LC4010237 2200007	APPLIED MATERIALS SOUTH EAST ASIA PTE.LTD	2,905,750.00	USD	2022- 9-21	2023- 4-30	290,575.00
45	招商银行合肥 分行	551LC2200 588	Lam Research InternationalSdn. Bhd.	4,834,714.00	USD	2022- 12-20	2023- 6-30	4,834,714.00
46	兴业银行	08101LC22 003265C	中微半导体设备（上海） 股份有限公司	3,850,000.00	USD	2022- 10-9	2023- 3-20	3,850,000.00
47	兴业银行	08101LC22 003391C	Applied Materials South East Asia Pte. Ltd	6,205,500.00	USD	2022- 10-19	2023- 5-30	620,550.00

截至 2022 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无其他需要披露的重大承诺事项及或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1. 抵押登记

根据本公司与合肥市建设投资控股（集团）有限公司签订的《动产浮动抵押合同》、《反担保合同》和《反担保合同补充协议》规定，本公司与合肥市建设投资控股（集团）有限公司每年应根据机器设备及原物料当年海关监管期限届满的进度确定办理抵押登记的时间，原则上每年统一办理一次抵押登记。

2023 年 2 月 2 日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司对本公司部分机器设备办理抵押登记，对应机器设备账面原值、抵押价值如下：

项目	账面原值	抵押价值
固定资产	1,970,747,741.39	1,182,448,644.87

截至 2023 年 3 月 1 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	759,799,185.03	979,359,474.07	265,220,095.91
小计	759,799,185.03	979,359,474.07	265,220,095.91
减：坏账准备	2,072,861.71	289.00	-

账龄	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
合计	757,726,323.32	979,359,185.07	265,220,095.91

(2) 按坏账计提方法分类披露

①2022年12月31日(按简化模型计提)

类别	2022年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	759,799,185.03	100.00	2,072,861.71	0.27	757,726,323.32
其中:因销货产生的应收款项	759,799,185.03	100.00	2,072,861.71	0.27	757,726,323.32
合计	759,799,185.03	100.00	2,072,861.71	0.27	757,726,323.32

②2021年12月31日(按简化模型计提)

类别	2021年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	979,359,474.07	100.00	289.00	0.00	979,359,185.07
其中:因销货产生的应收款项	979,359,474.07	100.00	289.00	0.00	979,359,185.07
合计	979,359,474.07	100.00	289.00	0.00	979,359,185.07

③2020年12月31日(按简化模型计提)

类别	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	265,220,095.91	100.00	-	-	265,220,095.91
其中:因销货产生的应收款项	265,220,095.91	100.00	-	-	265,220,095.91
合计	265,220,095.91	100.00	-	-	265,220,095.91

各报告期坏账准备计提的具体说明:

2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日按因销货产生的应收款项计提坏账准备的应收账款

逾期时间	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	718,341,950.83	-	-
逾期时间0-60天(含)	41,457,234.20	2,072,861.71	5.00
合计	759,799,185.03	2,072,861.71	0.27

(续上表)

逾期时间	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	979,353,694.07	-	-
逾期时间0-60天(含)	5,780.00	289.00	5.00
合计	979,359,474.07	289.00	0.00

(续上表)

逾期时间	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	265,220,095.91	-	-
合计	265,220,095.91	-	-

(3) 坏账准备的变动情况

①2022年度的变动情况

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	289.00	2,072,572.71	-	-	2,072,861.71
合计	289.00	2,072,572.71	-	-	2,072,861.71

②2021年度的变动情况

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	-	289.00	-	-	289.00
合计	-	289.00	-	-	289.00

③2020年度的变动情况

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	230,833.74	-230,833.74	-	-	-

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
合计	230,833.74	-230,833.74	-	-	-

(4) 各报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	2022年12月31日余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
合肥新品集成电路有限公司	251,053,948.14	33.04	-
联咏科技股份有限公司	157,392,594.94	20.72	-
深圳天德钰科技股份有限公司	91,331,535.73	12.02	1,684,644.46
深圳市爱协生科技股份有限公司	68,657,646.65	9.04	-
合肥奕斯伟计算技术有限公司	20,560,195.66	2.71	887.99
合计	588,995,921.12	77.52	1,685,532.45

(续上表)

单位名称	2021年12月31日余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
联咏科技股份有限公司	317,728,801.54	32.44	-
北京集创北方科技股份有限公司	187,856,369.54	19.18	-
奇景光电股份有限公司	89,656,591.69	9.15	-
思特威(合肥)电子科技有限公司	67,249,123.91	6.87	-
敦泰电子股份有限公司	59,506,665.10	6.08	-
合计	721,997,551.78	73.72	-

(续上表)

单位名称	2020年12月31日余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
联咏科技股份有限公司	195,949,442.85	73.88	-
集创北方(香港)有限公司	32,782,343.86	12.36	-
合肥捷达微电子有限公司	17,171,116.06	6.47	-
奇景光电股份有限公司	8,416,579.43	3.17	-
NewVisionMicro. (HK) Limited	3,655,154.37	1.38	-
合计	257,974,636.57	97.27	-

(6) 各报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 各报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2. 其他应收款

(1) 分类列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	388,150,628.49	4,492,329,048.13	4,164,229.13
合计	388,150,628.49	4,492,329,048.13	4,164,229.13

(2) 应收利息

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
定期存款、大额存单	-	-	-
小 计	-	-	-
减：坏账准备	-	-	-
合 计	-	-	-

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	387,441,804.54	4,491,528,715.50	2,723,991.41
1 至 2 年	169,312.00	400,000.00	837,549.12
2 至 3 年	400,000.00	67,449.12	102,500.00
3 年以上	147,310.91	584,000.00	501,500.00
小计	388,158,427.45	4,492,580,164.62	4,165,540.53
减：坏账准备	7,798.96	251,116.49	1,311.40
合计	388,150,628.49	4,492,329,048.13	4,164,229.13

②按款项性质分类情况

款项性质	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收合并范围内关联方款项	370,779,061.31	4,477,939,191.35	-
应收退税款	10,020,499.67	6,440,612.57	156,298.60
员工借款及备用金	3,526,366.31	1,633,203.91	2,141,741.06

款项性质	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
押金及保证金	3,676,520.91	1,546,070.91	1,841,410.91
其他	155,979.25	5,021,085.88	26,089.96
小计	388,158,427.45	4,492,580,164.62	4,165,540.53
减：坏账准备	7,798.96	251,116.49	1,311.40
合计	388,150,628.49	4,492,329,048.13	4,164,229.13

③按坏账计提方法分类披露

A.截至2022年12月31日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	388,158,427.45	7,798.96	388,150,628.49
第二阶段	-	-	-
第三阶段	-	-	-
合计	388,158,427.45	7,798.96	388,150,628.49

截至2022年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	388,158,427.45	0.00	7,798.96	388,150,628.49
其中：无风险组合	388,002,448.20	-	-	388,002,448.20
账龄组合	155,979.25	5.00	7,798.96	148,180.29
合计	388,158,427.45	0.00	7,798.96	388,150,628.49

其中：2022年12月31日，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收合并范围内关联方款项	370,779,061.31	-	-
应收退税款	10,020,499.67	-	-
员工借款及备用金	3,526,366.31	-	-
押金及保证金	3,676,520.91	-	-
合计	388,002,448.20	-	-

其中：2022年12月31日，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	155,979.25	7,798.96	5.00
1-2年	-	-	-

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	155,979.25	7,798.96	5.00

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段及第三阶段的坏账准备。

B.截至 2021 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	4,492,580,164.62	251,116.49	4,492,329,048.13
第二阶段	-	-	-
第三阶段	-	-	-
合计	4,492,580,164.62	251,116.49	4,492,329,048.13

截至 2021 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,492,580,164.62	0.01	251,116.49	4,492,329,048.13
其中：无风险组合	4,487,559,078.74	-	-	4,487,559,078.74
账龄组合	5,021,085.88	5.00	251,116.49	4,769,969.39
合计	4,492,580,164.62	0.01	251,116.49	4,492,329,048.13

其中：2021 年 12 月 31 日，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收合并范围内关联方款项	4,477,939,191.35	-	-
应收退税款	6,440,612.57	-	-
员工借款及备用金	1,633,203.91	-	-
押金及保证金	1,546,070.91	-	-
合计	4,487,559,078.74	-	-

其中：2021 年 12 月 31 日，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,020,947.67	251,047.38	5.00
1-2 年	-	-	-
2-3 年	138.21	69.11	50.00
合计	5,021,085.88	251,116.49	5.00

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段及第三阶段的坏账准备。

C.截至 2020 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	4,165,540.53	1,311.40	4,164,229.13
第二阶段	-	-	-
第三阶段	-	-	-
合计	4,165,540.53	1,311.40	4,164,229.13

截至 2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,165,540.53	0.03	1,311.40	4,164,229.13
其中：无风险组合	4,139,450.57	-	-	4,139,450.57
账龄组合	26,089.96	5.03	1,311.40	24,778.56
合计	4,165,540.53	0.03	1,311.40	4,164,229.13

其中：2020 年 12 月 31 日，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
员工借款及备用金	2,141,741.06	-	-
押金及保证金	1,841,410.91	-	-
应收退税款	156,298.60	-	-
合计	4,139,450.57	-	-

其中：2020 年 12 月 31 日，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,951.75	1,297.58	5.00
1-2 年	138.21	13.82	10.00
合计	26,089.96	1,311.40	5.03

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段及第三阶段的坏账准备。

④各报告期坏账准备的变动情况

类别	2021 年 12 月 31 日	本期变动金额			2022 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	251,116.49	-243,317.53	-	-	7,798.96

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
合计	251,116.49	-243,317.53	-	-	7,798.96

(续上表)

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	1,311.40	249,805.09	-	-	251,116.49
合计	1,311.40	249,805.09	-	-	251,116.49

(续上表)

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	12,308.60	-10,997.20	-	-	1,311.40
合计	12,308.60	-10,997.20	-	-	1,311.40

⑤各报告期无实际核销的其他应收款情况。

⑥按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2022年12月31日余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备
合肥新品集成电路有限公司	应收合并范围内关联方款项	370,779,061.31	1年以内	95.52	-
应收退税款	应收退税款	10,020,499.67	1年以内	2.58	-
合肥市住房租赁发展股份有限公司	押金及保证金	1,526,950.00	2年以内	0.39	-
合肥新创投资控股有限公司	押金及保证金	766,500.00	1年以内	0.20	-
合肥合燃华润燃气有限公司	押金及保证金	720,000.00	3年以内	0.19	-
合计	—	383,813,010.98	—	98.88	-

(续上表)

单位名称	款项的性质	2021年12月31日余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备
合肥新品集成电路有限公司	应收合并范围内关联方款项	4,477,939,191.35	1年以内	99.67	-
应收退税款	应收退税款	6,440,612.57	1年以内	0.14	-
中国太平洋财产保险股份有限公司安徽分	赔偿款	4,974,120.66	1年以内	0.11	248,706.03

单位名称	款项的性质	2021年12月31日余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备
公司					
合肥鑫城国有资产经营有限公司	押金及保证金	714,000.00	6年以内	0.02	-
合肥燃气集团有限公司	押金及保证金	400,000.00	2年以内	0.01	-
合计	—	4,490,467,924.58	—	99.95	248,706.03

(续上表)

单位名称	款项的性质	2020年12月31日余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备
合肥鑫城国有资产经营有限公司	押金及保证金	1,274,100.00	5年以内	30.60	-
合肥燃气集团有限公司	押金及保证金	400,000.00	1年以内	9.61	-
洪启恭	员工借款及备用金	168,816.64	1年以内	4.05	-
应收退税款	应收退税款	156,298.60	1年以内	3.75	-
邓元吉	员工借款及备用金	153,762.00	1年以内	3.69	-
合计	—	2,152,977.24	—	51.70	-

⑦各报告期不存在涉及政府补助的其他应收款。

⑧各报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨各报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

3. 长期股权投资

项目	2022年12月31日			2021年12月31日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,021,127,950.00	-	4,021,127,950.00	4,021,127,950.00	-	4,021,127,950.00	21,127,950.00	-	21,127,950.00
合计	4,021,127,950.00	-	4,021,127,950.00	4,021,127,950.00	-	4,021,127,950.00	21,127,950.00	-	21,127,950.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日	本期计提减值准备	2022年12月31日减值准备余额
晶合日本株式会社	20,727,950.00	-	-	20,727,950.00	-	-

被投资单位	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日	本期计提减值准备	2022年12月31日减值准备余额
晶芯成(北京)科技有限公司	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
南京晶驱集成电路有限公司	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
合肥新品集成电路有限公司	4,000,000,000.00	-	-	4,000,000,000.00	-	-
合计	4,021,127,950.00	-	-	4,021,127,950.00	-	-

(续上表)

被投资单位	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日	本期计提减值准备	2021年12月31日减值准备余额
晶合日本株式会社	20,727,950.00	-	-	20,727,950.00	-	-
晶芯成(北京)科技有限公司	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
南京晶驱集成电路有限公司	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
合肥新品集成电路有限公司	-	4,000,000,000.00	-	4,000,000,000.00	-	-
合计	21,127,950.00	4,000,000,000.00	-	4,021,127,950.00	-	-

(续上表)

被投资单位	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	本期计提减值准备	2020年12月31日减值准备余额
晶合日本株式会社	20,727,950.00	-	-	20,727,950.00	-	-
晶芯成(北京)科技有限公司	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-
南京晶驱集成电路有限公司	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-
合计	20,727,950.00	400,000.00	-	21,127,950.00	-	-

4. 营业收入和营业成本

项目	2022年度		2021年度		2020年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,025,499,527.49	5,801,625,409.77	5,420,844,427.64	2,974,097,632.69	1,511,861,078.57	1,641,461,883.16
其他业务	300,653,179.95	283,860,424.39	38,671,321.62	35,380,877.47	509,426.14	446,725.49
合计	10,326,152,707.44	6,085,485,834.16	5,459,515,749.26	3,009,478,510.16	1,512,370,504.71	1,641,908,608.65

5. 投资收益

项目	2022年度	2021年度	2020年度
理财产品及大额存单投资收益	3,692,333.28	13,598,907.52	12,490,510.13
合计	3,692,333.28	13,598,907.52	12,490,510.13

十六、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
非流动资产处置损益	-	-1,082,456.56	2,930.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,318,212.82	13,598,907.52	9,224,607.35
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	158,955,749.98	189,750,100.26	87,060,583.90
股份支付	-	-2,665,009.26	-121,050,201.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	973,564.22	-4,685,232.00	499,173.82
减：所得税影响额	-	-268,512.00	-
少数股东损益影响额	163,132.00	-	-
合 计	167,084,395.02	195,184,821.96	-24,262,906.39

2. 净资产收益率及每股收益

①2022 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.91	2.02	2.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.44	1.91	1.91

②2021 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.55	1.15	1.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.12	1.02	1.02

③2020 年度

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-28.93	-0.27	-0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-28.37	-0.27	-0.27

公司名称：合肥晶合集成电路股份有限公司

日期：2023年3月1日



证书序号: 0011869

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局



二〇一三年六月二十六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



黄碧琼

年 月 日

16

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

17

注册会计师事务所工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

容诚会计师事务所
CPC

特 别 注 册 会 计 师
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred from

容诚会计师事务所
CPC

特 别 注 册 会 计 师
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

18

注册会计师事务所工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

容诚会计师事务所
CPC

特 别 注 册 会 计 师
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred from

容诚会计师事务所
CPC

特 别 注 册 会 计 师
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

19



姓 名 黄碧琼
性 别 女
出生日期 1986-01-24
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通
合伙)安徽分所
身份证号码 310101540009



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

310101540009

证书编号:
No. of Certificate

注册注册会计师
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

安徽注册会计师协会

1987-07-22

年 月 日





姓名 Full name 周洪林
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1980-06-05
 工作单位 Working unit 安徽省注册会计师协会
 身份证号码 Identity card No. 34012219800605001X

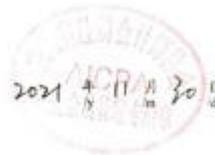


本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320214
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年05月11日
 Date of issuance Y M D



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
Y M D

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Y M D



姓名: _____
 Sex: _____
 出生日期: _____
 Date of birth: _____
 工作单位: _____
 Working unit: _____
 身份证号码: _____
 Identity card No.: _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320451
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2020-11-03
Date of issuance: y m d



2021 年 11 月 30 日
y m d

内部控制鉴证报告

合肥晶合集成电路股份有限公司

容诚专字[2023]230Z0277号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	内部控制鉴证报告	1-3
2	企业内部控制自我评价报告	4-13



内部控制鉴证报告

容诚专字[2023]230Z0277 号

合肥晶合集成电路股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称晶合集成）董事会编制的 2022 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供晶合集成成为申请首次公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为晶合集成申请首次公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、企业对内部控制的责任

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晶合集成董事会的责任。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晶合集成财务报告内部控制的有效性独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



五、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

六、鉴证结论

我们认为，晶合集成于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



(此页无正文，为合肥晶合集成电路股份有限公司容诚专字[2023]230Z0277号之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 黄亚琼 
黄亚琼 (项目合伙人)

中国注册会计师: 姚捷 
姚捷

中国注册会计师: 刘荣 
刘荣

2023年3月1日



合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

截止 2022 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告

一、董事会对内部控制报告的声明

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及经理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

（一）公司建立内部控制制度的目标

1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

3、规范公司经营行为，保证会计资料、财务信息的真实、准确和完整。

4、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

5、确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部控制制度的贯彻执行。

（二）公司建立内部控制制度遵循的原则

1、全面性原则：内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。

2、重要性原则：内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3、制衡性原则：内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面起到相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、适应性原则：内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、内部控制评价的依据

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》（以下简称“评价指引”）的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对本公司截止 2022 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

（一）财务报告内部控制缺陷认定标准

1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
潜在错报金额占公司资产总额百分比	≥1%	0.5%-1%（不含）	<0.5%

2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、公司董事、监事和高级管理人员严重舞弊； 2、对已经公告的财务报表进行重大差错更正； 3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报； 4、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷	1、未按公认会计准则选择和应用会计政策； 2、未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施； 3、未对财务报告涉及的信息系统进行有效控制； 4、存在重大交易未被披露的。
一般缺陷	不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

(二) 非财务报告内部控制缺陷认定标准

1、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失占公司资产总额百分比	≥1%	0.5%-1% (不含)	<0.5%

2、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、公司经营活动严重违反国家法律、法规； 2、公司决策程序不科学，导致重大失误，给公司造成重大财产损失； 3、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制； 4、中高级管理人员和高级技术人员流失严重； 5、负面消息频现，引起监管部门高度关注，并在长时间内无法消除； 6、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。
重要缺陷	1、决策程序导致出现一般性失误； 2、重要业务制度或系统存在缺陷； 3、关键岗位业务人员流失严重； 4、评价的结果特别是重要缺陷未得到整改； 5、外部审计机构认为公司存在其他重大缺陷的情况。
一般缺陷	不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

四、内部控制评价的范围

1、纳入评价范围的单位包括：合肥晶合集成电路股份有限公司及其子公司晶合日本株式会社、南京晶驱集成电路有限公司、晶芯成（北京）科技有限公司、合肥晶合集成电路有限公司。

2、纳入评价范围的单位占比：

指标	占比 (%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

五、公司内部控制的主要内容

(一) 内部控制环境

1、发展战略

公司对行业整体发展具有较为深刻的认识，在对现实状况和未来趋势进行综合分析及科学预测的基础上，根据行业现状、发展趋势、市场需求及时、高效的制定符合公司实际状况的发展战略，保证公司运营管理模式的专业性、高效和可持续性。公司以客户需求为导向，结合平板显示、汽车电子、家用电器、工业控制、人工智能、物联网等产业发展趋势，提供面板驱动芯片、微控制器(MCU)、CMOS 图像传感器(CIS)、电源管理(PMIC)、人工智能物联网(AIoT)等不同应用领域芯片代工，矢志成为中国最卓越的集成电路专业制造公司之一。

2、组织结构

公司依据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会有关法律法规和公司发展战略的要求，按照决策、执行和监督相互分离、权责明确、相互制衡的原则，建立了完善的治理结构。

公司形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的决策、经营管理及监督体系。股东大会、董事会、监事会及经理层授权明晰、操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。

公司章程明确股东大会、董事会、监事会、高级管理人员的设立程序、职责权限、人员配置与任职资格、议事规则、工作程序等事项。董事会、监事会、高级管理人员的产生程序合法合规，其人员构成、知识结构、能力素质满足履行职责的要求。

公司设立独立董事，独立董事具备相应任职资格，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

公司董事会设立审计专门委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

公司设立董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。

3、人力资源

公司建立并完善了人力资源管理和劳动用工制度，促进就业，保障员工的合法权益。公司及子公司严格遵守国家和地方有关劳动用工和社会保障方面的法律、法规和规范性文件要求，依法为其员工足额缴纳了职工养老、失业、医疗、生育和工伤等社会保险，制定并实施《招聘及员工录用管理办法》、《教育训练管理办法》、《员工绩效考核办法》、《职位、职等、职称核叙办法》等一系列规章制度，为员工招聘、培训、晋升、薪酬、考核、激励和职业生涯的设计建立了制度保证和体系保障。根据近年来公司业务增长，通过不断引进人才充实到管理、技术、营销等岗位，为公司持续快速发展提供不竭的源动力。

4、企业文化

公司注重企业文化建设，公司在生产经营实践中，逐步形成了为全体员工所认同并遵守的“尊重、当责、卓越”的核心精神，“矢志成为全球第一的面板驱动晶圆代工厂和全中国最卓越的集成电路专业制造公司”的企业愿景。

公司一直致力于企业文化的培育，通过多种方式和各项活动进行宣传贯彻，增强了公司的凝聚力、向心力，树立了公司的整体形象。公司与下属分、子公司的企业文化有机融合成一个整体，具有很强的企业凝聚力。

5、社会责任

公司根据国家法律法规，结合行业特点在生产经营过程中积极履行社会责任和义务，并将其全面融入了公司战略和日常经营活动。在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力保护自然环境和生态资源，积极履行对股东、债权人、职工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任。同时制定并持续完善了《环境安全卫生管理手册》、《员工健康管理办法》、《环安卫教育训练细则》等管理制度，履行社会公益责任义务，提升公司社会形象。

（二）风险评估

根据公司的战略目标及发展思路，结合行业特点，公司组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价，并拟定应对措施，对结果进行追踪。同时，公司每月针对各项预算费用之执行结果进行差异比较，针对差异超过一定标准之项目，需请各执行单位提出解释及改善方案，以考虑营运单位无法达成目标之风险。

（三）重点控制活动

1、销售及收款管理

为了促进企业销售稳定增长，扩大市场份额，规范销售行为，防范销售及收款风险，根据有关法律法规和《企业内部控制应用指引第9号》—销售业务，制定了公司销售及收款循环相关作业控制矩阵，及《授信管理办法》、《产品报价与受订交运管理办法》、《应收账款管理办法》、《退货受理与处理作业办法》、《财务收支管理办法》等制度。

2、采购及付款管理

为了促进公司合理采购，满足生产经营需要，规范采购行为，防范采购及付款风险，根据有关法律法规和《企业内部控制应用指引第7号》—采购业务，制定了公司采购及付款循环相关作业控制矩阵，及《请购作业办法》、《采购

作业办法》、《招标作业办法》、《供应商管理办法》、《进口作业规范》、《财务收支管理办法》等制度。

3、人力资源管理

为了促进公司加强人力资源建设,充分发挥人力资源对实现企业发展战略的重要作用,根据有关法律法规和《企业内部控制应用指引第3号》—人力资源,制定了公司薪工循环相关作业控制矩阵,及《招聘及员工录用管理办法》、《职位、职等、职称核叙办法》、《员工绩效考核办法》、《年度晋升作业施行细则》等制度。

4、投/融资管理

为保障生产、经营和发展需要,规范资金筹集渠道及筹集方法,保证资金的有效使用,保持资本结构合理,根据有关法律法规和《企业内部控制应用指引第6号》—资金活动,制定了公司投/融资循环相关作业控制矩阵,及《会计制度》、《借款作业管理办法》、《取得和处理衍生性商品管理办法》、《对外投资管理制度》、《财务作业权责划分表》等制度。

5、生产管理

为了确保公司合理安排生产计划,充分利用产能,实施生产过程中质量控制和安全控制,制定了公司生产循环相关作业控制矩阵,及《晶圆生产之计划与控制作业细则》、《生产计划作业细则》、《变更管理办法》、《原物料进料检验实施细则》、《仓储管理作业办法》等制度。

6、固定资产管理

为了提高资产使用效能,保证资产安全,根据有关法律法规和《企业内部控制指引第8号》—资产管理,制定了公司固定资产循环相关作业控制矩阵,及《资产管理办法》、《N1厂工程送审作业管理细则》、《进口设备于收验时发现损害账务作业细则》、《保险作业管理办法》等制度。

7、研发管理

为了促进公司自主创新，增强核心竞争力，有效控制研发风险，实现发展战略，根据有关法律法规和《企业内部控制应用指引第 10 号》—研究与开发，制定了公司研发循环相关作业控制矩阵，及《产品实现规划管理办法》、《研发专案管理流程》、《SPICE Model 管理作业细则》、《专利管理办法》等制度。

8、信息系统管理

为了促进企业有效实施内部控制，提高企业现代化管理水平，减少人为因素，根据有关法律法规和《企业内部控制指引第 18 号》—信息系统，制定了公司使用计算机信息系统相关作业控制矩阵，及《信息安全管理办法》、《信息安全政策》、《信息需求管理规范》、《信息维护管理规范》、《SAP 系统管理规范》、《MIS 备份管理规范》等制度。

9、重大投资、对外担保的内部控制

为了促进公司科学确定投资项目、拟定投资方案、确保投资项目的收益、规避投资项目的风险，公司制定了《对外投资管理办法》；为了加强公司担保业务管理，防范担保业务风险，公司制定了《对外担保管理办法》等管理制度，对重大投资、对外担保事宜进行了规范。同时，公司所有重大投资、对外担保事宜均按照《公司章程》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》的相关规定，并严格执行相应的审批程序。

10、关联交易的内部控制

为了保证公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司制定了《关联交易管理办法》，对关联方及关联关系、关联交易的范围进行了明确界定，强调公司进行关联交易需坚持必要、公允的原则，规范关联交易的决策程序，包括相关的回避措施、决策权限等，以确保公司的关联交易不存在损害股东利益的情形。

11、对子公司的管理控制

为加强对子公司的管理，公司制定了对子公司监督与管理作业控制矩阵。本公司派任子公司之董事定期参加子公司董事会，并合理要求子公司管理阶层呈报企业重大经营、财务及业务等事项。同时，本公司内部审计单位将子公司纳入内部审计范围，不定期执行审计作业，有效实施了对子公司的内控管理。

（四）信息与沟通

在信息化建设方面，公司运用 SAP 系统，加强了公司基础业务信息和财务信息的及时传递，公司通过内网、MyOA 系统、邮件系统，保证公司的制度更新、重大业务信息、企业文化信息等及时、有效传递，提高公司管理效率。在沟通方面，公司通过伙伴的话、敬业申报/检举系统，确保公司内外部沟通机制的有效运行与实施。同时，公司设有统一对外传达公司相关信息的单位，建立并维护公司形象。

（五）内部监督

本公司设立了内部审计单位，制定了《内部审计制度》，内部审计单位向董事会负责并报告工作，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。

内部审计单位以业务环节为基础开展审计工作，审计内容涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括：销货与收款、采购及付款、生产管理、固定资产管理、投资与融资管理、人力资源管理和信息系统管理等。内部审计单位会依据公司所处行业及生产经营特点，对上述业务环节进行调整。内部审计的日常工作加强了公司内部管理和监督，维护了公司合法权益，促进改善了公司的经营管理，提高了公司的经济效益。

六、内部控制缺陷和异常事项的改进

随着公司的发展，公司内部控制也要不断优化。公司现有内部控制制度总体能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提

供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规的有效遵循提供保证，能够保护公司资产安全、完整。

截至 2022 年 12 月 31 日，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大和重要缺陷。

七、内部控制自我评价

（一）本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、反馈、完善提供了合理的保证。

（二）本公司按照不断完善和满足公司持续发展需要的要求判断公司的内部控制制度的设计是否完整和合理，内部控制的执行是否有效。判断分别按照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行。

（三）本公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业特点，在公司积累的多年管理经验基础上，保证了内部控制符合公司生产经营需要，对经营风险起到了有效控制作用；公司制定内部控制制度以来，各项制度均得到有效执行，对公司加强管理、规范运作、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。

（四）公司董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

（五）本自我评价报告已经全体董事审核并同意。



2023 年 3 月 1 日



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；提供资产评估服务；从事会计、税务咨询、税务代理、涉税服务、代理记账、管理咨询、内部控制、法律及审计软件的开发和推广应用；接受金融机构委托，依法提供审计服务；接受国家有关规定允许的法律法规规定范围内的经营活动，不得从事国家法律法规禁止和限制类项目的经营活动。

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26(体)



登记机关

2022年06月07日

证书序号: 0011869

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月米日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



黄亚琼

年 月 日
/ /

10

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/ /

11

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

宏诚会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 12月 10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

宏诚会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 12月 22日

12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

宏诚会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

宏诚会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

13



姓名 Full name 黄亚琼
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1986-04-24
工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 Identity card No. 610103198604242861



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340101640009
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1987-07-22
Date of Issuance



5





姓名: 刘 翔
 Full name: 刘翔
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-08-05
 Date of birth: 1989-08-05
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 宣城分所
 Working unit: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 宣城分所
 身份证号码: 34012219890805813X
 Identity card No. 34012219890805813X



本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320276
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019-03-14
 Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



中国注册会计师协会



姓名 Name 刘翠
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1991-03-11
 工作单位 Working unit 安徽信成会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽中成
 身份证号码 Identity card No. 150125199404153528

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320451
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-04-09 年 月 日
 Date of issuance 4 4 9



非经常性损益鉴证报告

合肥晶合集成电路股份有限公司
容诚专字[2023]230Z0276号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	非经常性损益鉴证报告	1-3
2	非经常性损益明细表及附注	4-11



关于合肥晶合集成电路股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告

容诚专字[2023]230Z0276 号

合肥晶合集成电路股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称晶合集成)管理层编制的 2022 度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益明细表。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供晶合集成为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为晶合集成申请首次公开发行股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益(2008)》的有关要求编制非经常性损益明细表是晶合集成管理层的责任,这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对晶合集成管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相



信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，上述非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定编制，公允反映了晶合集成 2022 度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益情况。



(此页无正文，为合肥晶合集成电路股份有限公司容诚专字[2023]230Z0276号之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 黄亚琼 
黄亚琼 (项目合伙人)

中国注册会计师: 姚捷 
姚捷

中国注册会计师: 刘荣 
刘荣

2023年3月1日



非经常性损益明细表

编制单位：合肥晶合集成电路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

序号	非经常性损益项目	附注	2022年度	2021年度	2020年度
1	非流动资产处置损益	—		-1,082,456.56	2,930.00
2	越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
3	计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	二	158,955,749.98	189,750,100.26	87,060,583.90
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
5	企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
6	非货币性资产交换损益				
7	委托他人投资或管理资产的损益				
8	因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
9	债务重组损益				
10	企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
11	交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
12	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
13	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
14	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	三	7,318,212.82	13,598,907.52	9,224,607.35
15	单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
16	对外委托贷款取得的损益				
17	采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
18	根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	四		-2,665,009.26	-121,050,201.46
19	受托经营取得的托管费收入				
20	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	五	973,564.22	-4,685,232.00	499,173.82
21	其他符合非经常性损益定义的损益项目				
22	非经常性损益总额		167,247,527.02	194,916,309.96	-24,262,906.39
23	减：所得税影响数			-268,512.00	
24	少数股东损益影响数		163,132.00		
25	归属于公司普通股股东的非经常性损益		167,084,395.02	195,184,821.96	-24,262,906.39

法定代表人：

陈同海

主管会计工作负责人：

朱才信

朱才信

会计机构负责人：

王瑞

王瑞



非经常性损益明细表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、非流动资产处置损益

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
资产处置收益	-	-	2,930.00
营业外支出-非流动资产毁损报废损失	-	-1,082,456.56	-
合 计	-	-1,082,456.56	2,930.00

二、计入当期损益的政府补助

1、2022 年度

项目名称	来源	依据或批准文件	金额
三重一创-建设专项引导资金（一事一议）	新站区经贸发展局	皖政（2017）51号	51,476,181.61
贷款贴息	合肥综保区管理办公室	12吋晶圆制造基地项目合作框架协议	37,767,800.00
合肥市政府招商引资投资厂房	合肥市政府	12吋晶圆制造基地项目合作框架协议书、合肥12吋晶圆制造基地项目入区协议	32,786,300.16
人才补贴	合肥综合保税区管理办公室	合肥12吋晶圆制造基地项目补充协议	5,000,000.00
制造业增产增收政策奖补	合肥市经济和信息化局	合经信（2022）169号	5,000,000.00
稳企增效政策奖补	合肥市经济和信息化局	合政办秘（2022）4号	3,340,000.00
集成电路产业政策资金-购买IP补助	合肥新站高新技术产业开发区经贸发展局	合政办（2021）18号	3,000,000.00
12吋晶圆制造基地项目专项财政扶持资金	新站区经贸发展局	12吋晶圆制造基地项目使用集成电路产业集聚发展基地“借转补”专项财政扶持资金协议书	2,737,099.08
企业上市受理奖励	新站区经贸发展局	合新管（2020）25号	2,000,000.00
合肥市外贸促进政策项目-物流补贴	新站区经贸发展局	访谈确认	1,950,000.00
引进高层次人才奖补	合肥新站高新技术产业开发区人事劳动局	合政办秘（2020）32号	1,650,000.00

项目名称	来源	依据或批准文件	金额
先进制造业发展政策资金-企业技术改造补贴	新站区经贸发展局	合政办（2022）8号	1,465,139.92
三重一创-重大新兴产业基地新建项目补助	新站区经贸发展局	皖政（2017）51号	1,286,341.19
工业互联网政策研发设备补贴	新站区经贸发展局	关于开展2021年支持工业互联网发展若干政策资金项目申报工作的通知	1,087,197.24
“三代”税款手续费返还	税务局	财行（2019）11号	1,069,674.58
购置研发仪器设备补助	安徽省科技厅/合肥市科学技术局	皖科资秘（2019）410号	938,339.76
稳岗补贴	合肥失业保险管理中心	合人社秘（2022）44号	827,620.84
高质量发展政策-激励企业扩大规模	合肥市经济和信息化局	合经信法规（2021）125号	700,000.00
省人才资助奖补	中共合肥市委组织部	关于做好2022年全省引进高层次人才创新创业人才资助奖补申报工作的通知	600,000.00
支持企业研发投入-研发设备及工具补助	合肥市经济和信息化局	皖经信电子函（2019）212号	547,895.63
降低企业引进高科技人才成本资金	合肥市科技局	皖科智秘（2022）69号	544,700.00
集成电路产业政策资金-研发设备及工具补助	合肥市经济和信息化局	皖经信电子函（2020）218号	528,829.08
省集成电路新基地建设专项资金	新站区经贸发展局	合发改产业（2019）1294号	507,222.91
企业购买省外先进技术成果补助	合肥市科技局和新站区科技局	皖科资秘（2021）317号	500,000.00
政策兑现科技保险补助	合肥市科技局	合科（2022）17号	300,000.00
合肥市集成电路产业政策奖补-EDA工具软件	新站区经贸发展局	合办（2022）18号	380,952.40
新录入人员岗前技能培训	合肥新站高新技术产业开发区人事劳动局	合人社秘（2017）175号	258,400.00
外经贸发展专项资金-国际认证、商标注册和专利申请费补贴	新站区经贸局	访谈确认	248,000.00

项目名称	来源	依据或批准文件	金额
知识产权政策奖补	新站区市场监督管理局	合办（2021）8号	218,000.00
政策兑现合同转化与技术合同交易补助	合肥市科技局	合科（2022）17号	100,000.00
高质量发展政策知识产权专利授权奖补	合肥市市场监督管理局	合市监函（2021）129号	84,500.00
省级外经贸发展专项资金-固定资产投资补助	新站区经贸发展局	访谈确认	55,555.58
合计			158,955,749.98

2、2021年度

项目名称	来源	依据或批准文件	金额
贷款贴息	合肥综保区管理办公室	12吋晶圆制造基地项目合作框架协议	91,901,350.00
三重一创-建设专项引导资金（一事一议）	新站区经贸发展局	皖政（2017）51号	33,543,857.89
合肥市政府招商引资投资厂房	合肥市政府	12吋晶圆制造基地项目合作框架协议书、合肥12吋晶圆制造基地项目入区协议	32,786,300.18
人才补贴	合肥综合保税区管理办公室	合肥12吋晶圆制造基地项目补充协议	10,000,000.00
企业上市受理奖励	合肥市地方金融监督管理局	合办（2021）8号第18条	3,000,000.00
合肥市外贸促进政策项目-物流补贴	新站区经贸发展局	访谈确认	2,183,120.00
海峡两岸集成电路产业合作试验区展示馆补助	新站区经贸发展局	合发改高技（2019）104号	1,950,000.00
引进高层次人才奖补	新站区人事劳动局	合政办秘（2020）32号	1,650,000.00
三重一创-重大新兴产业基地新建项目补助	新站区经贸发展局	皖政（2017）51号	1,299,346.43
企业直接融资省级财政奖励资金	新站区经贸发展局	财金（2019）126号	1,200,000.00
智能工厂奖补	新站区经贸发展局	关于开展2021年支持工业互联网发展若干政策资金项目申报工作的通知	1,000,000.00
高管住房补贴	合肥新站高新技术产业开发区管委会	合肥12吋晶圆制造基地项目补充协议	840,000.00
“三代”税款手续费返还	新站区税务局	财行（2019）11号	838,371.24

项目名称	来源	依据或批准文件	金额
购置研发仪器设备补助	安徽省科技厅/合肥市科学技术局	皖科资秘〔2019〕410号	741,886.32
承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金-加工贸易物流补贴	新站区经贸发展局	合外商贸〔2017〕153号	652,039.00
稳岗补贴	合肥市失业保险管理中心、合肥市新站区人事劳动局	皖人社发〔2021〕15号、关于中小微企业稳岗补贴“免申即享”部分企业提供信息及材料的通知	555,534.72
集成电路产业政策资金-研发设备及工具补助	合肥市经济和信息化局	皖经信电子函〔2020〕218号	547,895.64
支持企业研发投入-研发设备及工具补助	合肥市经济和信息化局	皖经信电子函〔2019〕212号	528,829.08
省集成电路新基地建设专项资金	新站区经贸发展局	合发改产业〔2019〕1294号	507,222.81
企业购买省外先进技术成果补助	安徽省科学技术厅	皖科资秘〔2021〕317号	500,000.00
支持企业挂牌上市奖励	合肥新站高新技术产业开发区管委会	合新管〔2020〕25号	500,000.00
技术合同交易额奖补	合肥市科学技术局	合科〔2021〕29号	500,000.00
创新型省份建设资金-R&D经费支出“双百强”规上企业奖励	安徽省科学技术厅	皖科规秘〔2021〕243号	500,000.00
外经贸发展专项资金-国际认证、商标注册和专利申请费补贴	新站区经贸发展局	访谈确认	470,000.00
省人才资助奖补	中共合肥市委组织部	关于做好2021年全省引进高层次人才创新创业人才资助奖补申报工作的通知	300,000.00
首次认定高企及辅导费补贴	新站区科学技术局	关于开展2020年新站高新区高企培育政策兑现补助申请有关事项的通知	290,000.00
降低企业引进高科技人才成本资金	安徽省科学技术厅	皖科智秘〔2021〕144号、合科〔2020〕33号	280,100.00
12寸晶圆制造基地项目专项财政扶持资金	新站区经贸发展局	12寸晶圆制造基地项目使用集成电路产业集聚发展基地“借转补”专项财政扶持资	228,091.59

项目名称	来源	依据或批准文件	金额
		金协议书	
知识产权政策奖补	新站区市场监督管理局	合知(2021)4号	160,000.00
首次认定高新技术企业奖补	合肥市科学技术局	合科(2021)29号	100,000.00
工业互联网政策研发设备补贴	新站区经贸发展局	关于开展2021年支持工业互联网发展若干政策资金项目申报工作的通知	90,599.77
省级外经贸发展专项资金-固定资产投资补助	新站区经贸发展局	访谈确认	55,555.59
企业表彰-绿色发展奖	新站高新区管委会经贸发展局	2020年度新站高新区优秀企业获奖名单	50,000.00
合计			189,750,100.26

3、2020年度

项目名称	来源	依据或批准文件	金额
合肥市政府招商引资投资厂房	合肥市政府	12寸晶圆制造基地项目合作框架协议书、合肥12寸晶圆制造基地项目入区协议	30,588,920.49
三重一创-建设专项引导资金(一事一议)	新站区经贸发展局	皖政(2017)51号	28,446,748.62
人才补贴	合肥综合保税区管理办公室	合肥12寸晶圆制造基地项目补充协议	10,000,000.00
集成电路产业政策资金-购买IP补助	新站区经贸发展局	合办(2018)27号	3,000,000.00
合肥市外贸促进政策项目-物流补贴	新站区经贸发展局	访谈确认	2,501,997.00
集成电路产业政策资金-促进企业加速成长(企业上台阶奖励)	合肥市经济和信息化局	皖经信电子函(2020)218号	2,000,000.00
三重一创-重大新兴产业基地新建项目补助	新站区经贸发展局	皖政(2017)51号	1,307,006.44
“三代”税款手续费返还	新站区税务局	财行(2019)11号	1,126,565.93
集成电路产业政策资金-鼓励知识产权创造	合肥市经济和信息化局	皖经信电子函(2020)218号	1,000,000.00
高管住房补贴	合肥综合保税区管理办公室	合肥12寸晶圆制造基地项目补充协议	840,000.00
承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金-加	新站区经贸发展局	合商外贸(2020)74号	839,129.00

项目名称	来源	依据或批准文件	金额
工贸易物流补贴			
购置研发仪器设备补助	安徽省科技厅/合肥市科学技术局	皖科资秘(2019)410号	699,912.33
支持企业研发投入-研发设备及工具补助	合肥市经济和信息化局	皖经信电子函(2019)212号	528,829.06
集成电路产业政策资金-企业上台阶奖励	新站区经贸发展局	合办(2018)27号	500,000.00
稳定就业补贴	合肥市社保局	合人社秘(2020)41号	500,000.00
创新型省份建设资金-R&D经费支出“双百强”规模以上企业奖励	安徽省科技厅	皖科资秘(2020)251号	500,000.00
新站经贸发展局财政性奖励-一次性股改奖励	新站区经贸发展局	合新管(2020)25号	500,000.00
省集成电路新基地建设专项资金	新站区经贸发展局	合发改产业(2019)1294号	380,417.14
失业保险费返还	合肥市财政局	皖就(2020)6号	354,572.37
稳岗补贴	合肥市财政局	皖人社秘(2019)42号	354,572.00
省人才资助奖补	中共合肥市委组织部	关于做好2020年全省引进高层次人才资助奖补申报审核工作的通知	350,000.00
外经贸发展专项资金-国际认证、商标注册和专利申请费补贴	新站区经贸发展局	关于2019年省级外贸促进政策项目申报工作的通知	300,000.00
降低企业引进高科技人才成本资金	新站区科学技术局	合科(33)号	230,700.00
知识产权政策奖补	新站区市场监督管理局	合知(2020)1号	60,000.00
省级外经贸发展专项资金-固定资产投资补助	新站区经贸发展局	访谈确认	55,555.55
企业表彰-绿色发展奖	新站区经贸发展局	合新管(2020)12号	50,000.00
集成电路产业政策资金-研发设备及工具补助	合肥市经济和信息化局	皖经信电子函(2020)218号	45,657.97
合计			87,060,583.90

三、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
理财产品投资收益	3,692,333.28	13,598,907.52	12,490,510.13
公允价值变动收益	3,625,879.54	-	-3,265,902.78
合 计	7,318,212.82	13,598,907.52	9,224,607.35

四、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
股份支付	-	-2,665,009.26	-121,050,201.46
合计	-	-2,665,009.26	-121,050,201.46

五、除上述各项之外的其他营业外收入和支出

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业外收入	1,058,231.85	277,652.66	576,116.30
营业外支出	-84,667.63	-4,962,884.66	-76,942.48
合计	973,564.22	-4,685,232.00	499,173.82

合肥晶合集成电路股份有限公司



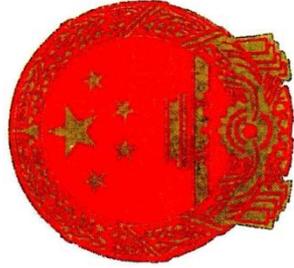
2023年3月1日

证书序号: 0011869

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

1. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
2. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
3. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

发证机关:

北京市财政局

二〇一三年 六月 廿 日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



黄亚琼

年 月 日
y m d

10

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d

1101020362092

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

容诚会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月10日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月22日
y m d

12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

容诚会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d

13



姓名 Full name 黄亚琼
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1968-04-24
工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 Identity card No. 610103196804242861



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340101540009
批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会
发证日期: 1997-07-22
Date of Issuance 年 月 日



5



姓名: 刘 娟
 Full name: LIU JUAN
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1989-08-05
 Date of birth: 1989-08-05
 工作单位: 安徽会计师事务所(安徽自贸试验区芜湖片区)
 Working unit: Anhui Institute of Certified Public Accountants (Wuhu Area of Anhui Free Trade Zone)
 身份证号码: 34012219890805813X
 Identity card No.:



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320276
 No. of Certificate:

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs:

发证日期: 2019-03-14
 Date of Issuance: 2019-03-14



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 / 月 / 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日



姓名: 刘翠
性别: 女
出生日期: 1994-04-16
工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 150125199404163620
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320451
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-04-09 年 月 日
Date of issuance: 4/9/2020



北京市金杜律师事务所
关于合肥晶合集成电路股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书

致：合肥晶合集成电路股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市事宜出具本法律意见书。

本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和证监会的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行上市相关事项进行了充分的

核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次发行上市所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

引 言

为出具本法律意见书，本所依据《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等有关规定，编制和落实了查验计划，亲自收集证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在发行人保证提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材料（包括原始书面材料、副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料，无论该等资料是通过电子邮件、移动硬盘传输、项目工作网盘或开放内部文件系统访问权限等各互联网传输和接收等方式所获取的）是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，其所提供的副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签名、印章是真实的，并已履行该等签名和盖章所需的法律程序，获得合法授权；所有的口头陈述和说明均与事实一致的基础上，本所独立、客观、公正地遵循审慎性及重要性原则，合理、充分地运用了面谈、书面审查、实地调查、查询和函证、计算和复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。

本所按照《证券法律业务执业规则》的要求，独立、客观、公正地就业务事项是否与法律相关、是否应当履行法律专业人士特别注意义务作出了分析、判断。对需要履行法律专业人士特别注意义务的事项，本所拟定了履行义务的具体方式、手段和措施，并逐一落实；对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务。本所对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评估机构、公证机构等机构直接取得的文书，按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；对于不是从前述机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。本所对于从前述机构抄录、复制的材料，经相关机构确认，并按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；未取得相关机构确认的，对相关内容进行核查和验证后作为出具法律意见的依据。从不同来源获取的证据材料或者通过不同查验方式获取的证据材料，对同一事项所证明的结论不一致的，本所追加了必要的程序作进一步查证。

在本法律意见书和《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）中，本所仅就与发行人本次发行上市有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。本所不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项及境外法律事项发表意见，在本法律意见书和《律师工作报告》中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告及境外法律意见的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所不具备核查和评价该等数据的适当资格。

本法律意见书和《律师工作报告》仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书和《律师工作报告》作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市所制作的《招股说明书（申报稿）》中自行引用或按照中国证监会和证券交易所的审核要求引用本法律意见书或《律师工作报告》的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

金杜/本所	指	北京市金杜律师事务所
公司/发行人/晶合集成	指	合肥晶合集成电路股份有限公司
晶合有限	指	发行人前身合肥晶合集成电路有限公司
日本晶合	指	晶合日本株式会社，发行人全资子公司
北京晶芯成	指	晶芯成（北京）科技有限公司，发行人全资子公司
南京晶驱	指	南京晶驱集成电路有限公司，发行人全资子公司
上海晶合	指	合肥晶合集成电路股份有限公司上海分公司，发行人分公司
合肥建投	指	合肥市建设投资控股（集团）有限公司
合肥芯屏	指	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）
力晶科技	指	力晶科技股份有限公司
美的创新	指	美的创新投资有限公司
中安智芯	指	合肥中安智芯股权投资合伙企业（有限合伙）
惠友豪创	指	深圳市惠友豪创投资合伙企业（有限合伙）
合肥存鑫	指	合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙）
海通创新	指	海通创新证券投资有限公司
杭州承富	指	杭州承富投资管理合伙企业（有限合伙）
泸州隆信	指	泸州隆信投资合伙企业（有限合伙）
宁波华淳	指	宁波华淳投资管理合伙企业（有限合伙）
中小企业基金	指	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）
安华创新	指	安徽安华创新风险投资基金有限公司
集创北方	指	北京集创北方科技股份有限公司
中金浦成	指	中金浦成投资有限公司
合肥晶煨	指	合肥晶煨企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶遂	指	合肥晶遂企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶炯	指	合肥晶炯企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶咖	指	合肥晶咖企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶珏	指	合肥晶珏企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶梢	指	合肥晶梢企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶柔	指	合肥晶柔企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶悬	指	合肥晶悬企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持

		股平台
合肥晶本	指	合肥晶本企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶洛	指	合肥晶洛企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶辽	指	合肥晶辽企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶确	指	合肥晶确企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶铁	指	合肥晶铁企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶妥	指	合肥晶妥企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶雄	指	合肥晶雄企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶策	指	合肥晶策企业管理有限公司，为发行人员工持股平台的管理机构
保荐机构/中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
容诚	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中水致远	指	中水致远资产评估有限公司
A 股	指	境内上市人民币普通股
本次发行上市	指	发行人首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
合肥市市监局	指	合肥市市场监督管理局
合肥市工商局	指	原合肥市工商行政管理局，现已整合为合肥市市监局
合肥市国资委	指	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
《合资合同》	指	根据上下文意所需，指当时有效的《关于合肥晶合集成电路有限公司之合资合同》
《发起人协议》	指	合肥建投、合肥芯屏、力晶科技、美的创新、中安智芯、惠友豪创、合肥存鑫、海通创新、杭州承富、泸州隆信、宁波华淳、中小企业基金、安华创新、集创北方、中金浦成、合肥晶焯、合肥晶遂、合肥晶炯、合肥晶咖、合肥晶珏、合肥晶梢、合肥晶柔、合肥晶悬、合肥晶本、合肥晶洛、合肥晶辽、合肥晶确、合肥晶铁、合肥晶妥、合肥晶雄于 2020 年 11 月 5 日共同签署的《合肥晶合集成电路股份有限公司发起人协议》
《公司章程》	指	根据上下文意所需，指当时有效的《中外合资经营企业合肥晶合集成电路有限公司章程》、《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》
《发行人章	指	发行人为本次发行上市而修订的公司章程，经发行人于 2021

程》		年 2 月 9 日召开的第一届董事会第三次会议及于 2021 年 3 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，自发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市之日起生效实施
《股东大会议事规则》	指	发行人于 2020 年 11 月 20 日召开的创立大会审议通过的《合肥晶合集成电路股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	发行人于 2020 年 11 月 20 日召开的创立大会审议通过的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	发行人于 2020 年 11 月 20 日召开的创立大会审议通过的《合肥晶合集成电路股份有限公司监事会议事规则》
《独立董事工作制度》	指	发行人于 2020 年 11 月 20 日召开的第一届董事会第一次会议审议通过的《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》
《关联交易实施细则》	指	发行人于 2020 年 11 月 20 日召开的创立大会审议通过的《合肥晶合集成电路股份有限公司关联交易实施细则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2018 修正）》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2019 修订）》
《注册管理办法》	指	《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《编报规则第 12 号》	指	《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发[2001]37 号）
《证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国司法部令 41 号）
《证券法律业务执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国司法部公告[2010]33 号）
《私募基金登记备案办法》	指	中国证券投资基金业协会于 2014 年 1 月 17 日发布并于 2014 年 2 月 7 日实施的《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（中基协发[2014]1 号）
《私募基金管理办法》	指	中国证监会于 2014 年 8 月 21 日发布并实施的《私募投资基金监督管理暂行办法》（中国证券监督管理委员会令 105 号）
台湾理律	指	理律法律事务所新竹事务所
台湾杰宇	指	杰宇法律事务所
日本律师	指	King & Wood Mallesons Law Offices (Foreign Law Joint Enterprise)
《律师工作报告》	指	《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》
本法律意见书	指	《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》
《台湾理律法律意见书》	指	台湾理律于 2021 年 4 月 20 日出具的关于晶合集成的法律意见书
《台湾杰宇法	指	台湾杰宇于 2021 年 1 月 22 日出具的关于力晶科技的法律意见

律意见书》		书
《日本法律意见书》	指	日本律师于 2021 年 3 月 12 日出具的关于日本晶合的法律意见书
《审计报告》	指	容诚为本次发行上市于 2021 年 2 月 9 日出具的《审计报告》（[2021]230Z0089），包括后附的经审计的发行人的财务报表及其附注
《内控报告》	指	容诚为本次发行上市于 2021 年 2 月 9 日出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司内部控制鉴证报告》（[2021]230Z0141）
《主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》	指	容诚为本次发行上市于 2021 年 2 月 9 日出具的《主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》（[2021]230Z0143）
《招股说明书（申报稿）》	指	《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》
报告期/最近三年	指	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
中国香港	指	中华人民共和国香港特别行政区
中国台湾	指	中华人民共和国台湾地区
中国	指	中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）
元	指	人民币元

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

正文

一、本次发行上市的批准和授权

（一）本次发行上市的批准

根据发行人提供的第一届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会的会议通知、会议议案及会议决议并经本所律师核查，发行人于 2021 年 2 月 9 日召开第一届董事会第三次会议，会议审议通过《关于合肥晶合集成电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案；发行人于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过《关于合肥晶合集成电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。

经本所律师核查，发行人第一届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本所认为，发行人本次发行上市已获得公司 2020 年年度股东大会的批准，该次股东大会的召开程序、决议内容合法有效。

（二）本次发行上市的授权

发行人 2020 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》，授权董事会及其授权人士（董事长蔡国智先生、董事会秘书朱才伟先生）全权办理本次发行上市有关具体事宜。

经本所律师核查，发行人股东大会已授权董事会办理本次发行上市事宜，上述授权范围、程序合法有效。

综上，本所认为，发行人本次发行上市已获得发行人内部的批准及授权；发行人本次发行尚待上交所科创板股票上市委员会审核，并报中国证监会履行发行注册程序；本次发行完成后，发行人股票于上交所上市交易尚待获得上交所审核同意。

二、发行人本次发行上市的主体资格

（一）发行人发行上市的主体资格

发行人系由晶合有限按照经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，自2015年5月19日晶合有限成立之日起计算，发行人持续经营时间已超过3年。

发行人现持有合肥市市场监管局于2020年11月25日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q），注册资本：人民币1,504,601,368元；住所：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号；法定代表人：蔡国智；公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）；成立日期：2015年5月19日；营业期限：长期；经营范围：集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人依法有效存续

根据本所律师登录国家企业信用信息公示系统进行查询与检索，发行人自设立至今依法有效存续，不存在因营业期限届满、股东大会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的需要终止的情形。

（三）发行人的组织机构

发行人已依据《公司法》等法律法规设立了股东大会、董事会和监事会，在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并建立了独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会工作制度，聘请了高级管理人员，设置了若干职能部门。发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

综上，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条之规定，发行人具备本次发行上市的主体资格。

三、本次发行上市的实质条件

（一）本次发行上市符合《证券法》的相关条件

1、发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事和董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

2、根据《审计报告》、发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》、发行人及其境内子公司相关主管部门出具的证明及发行人书面说明，截至本法律意见书出具日，发行人依法存续，不存在因违法经营而被相关主管部门责令停业整顿或吊销营业执照的情形，不存在根据法律、法规及《公司章程》规定需要终止的情形。发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

3、根据《审计报告》，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

4、根据发行人及其子公司所在地公安机关出具的证明、发行人控股股东填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》及发行人书面说明，并经本所律师登录中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）、人民法院公告网（<http://rmfygg.court.gov.cn>）、中国检察网（<http://www.12309.gov.cn>）等网站查询，发行人及其控股股东最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

（二）本次发行上市符合《注册管理办法》规定的相关条件

1、如本法律意见书“二、发行人本次发行上市的主体资格”所述，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

2、根据《审计报告》《内控报告》和发行人书面说明，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具标准无保留意见的《审计报告》；根据《内控报告》和发行人书面说明，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具标准无保留意见的《内控报告》，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

(1) 如本法律意见书“五、发行人的独立性”所述，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立；如本法律意见书“九、关联交易及同业竞争”所述，发行人与控股股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项之规定。

(2) 如本法律意见书“八、发行人的业务”所述，发行人的主营业务最近两年内未发生重大不利变化；如本法律意见书“十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”所述，发行人的董事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内未发生重大不利变化；如本法律意见书“六、发起人和股东”所述，发行人的股权权属清晰，控股股东和受控股股东支配的股东持有的发行人股份权属清晰，最近两年控制权稳定、实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项之规定。

(3) 如本法律意见书“十、发行人的主要财产”“十一、发行人的重大债权债务”及“二十一、诉讼、仲裁或行政处罚”所述，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项之规定。

4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策：

(1) 如本法律意见书“八、发行人的业务”所述，根据工商、税务等相关政府部门出具的证明文件和发行人书面说明，经本所律师核查，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定。

(2) 如本法律意见书“二十一、诉讼、仲裁或行政处罚”所述，根据发行人及其子公司所在地相关政府部门出具的证明文件、发行人控股股东填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》及发行人书面说明，并经本所律师核查，最近三年内，发行人及其控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

(3) 如本法律意见书“二十一、诉讼、仲裁或行政处罚”所述，根据发行人董事、监事和高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》及其在中国证监会安徽监管局诚信信息查询结果并访谈发行人董事、监事和高级管理人员，经本所律师核查，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第三款的规定。

(三) 本次发行上市符合《上市规则》规定的相关条件

1、本次发行上市符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》规定的发行条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定。

2、根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》及《招股说明书（申报稿）》，本次发行上市后股本总额不少于 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

3、根据《招股说明书（申报稿）》和本次发行上市相关股东大会决议，发行人股本总额超过 4 亿元，本次发行完成后，发行人公开发行的股份数将达到本次发行后发行人股份总数的 10%以上，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

4、根据《审计报告》、保荐机构出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司预计市值的分析报告》及发行人书面说明，发行人申请本次发行上市，预计市值不低于30亿元，且最近一年营业收入不低于3亿元，符合《上市规则》第2.1.2条第（四）项规定的市值和财务指标标准及第2.1.1条第（四）项的规定。

综上，本所认为，发行人具备本次发行上市的实质条件。

四、发行人的设立

（一）发行人设立的程序、方式

发行人系由晶合有限整体变更设立的股份有限公司，其整体变更为股份有限公司时履行了以下程序：

2020年10月19日，容诚出具《审计报告》（容诚审字[2020]230Z3994号），经审计，截至2020年9月30日，晶合有限账面净资产值为7,353,140,545.50元。

2020年10月21日，中水致远出具《合肥晶合集成电路有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第020502号）。根据该报告，截至2020年9月30日，晶合有限的净资产评估值为918,198.75万元。2020年11月9日，合肥市国资委就上述资产评估项目基本情况及资产评估结果出具了《国有资产评估项目备案表》。

2020年10月21日，晶合有限召开董事会，同意公司整体变更为股份公司的方案，公司全体股东作为发起人以公司按截至2019年9月30日经容诚审计的账面净资产值7,353,140,545.50元为基础，按1:0.20462的比例折合1,504,601,368股，公司的注册资本变更为1,504,601,368元，资本公积和未分配利润在整体变更前后保持不变。

2020年11月5日，晶合有限全体股东签署《合肥晶合集成电路股份有限公司发起人协议》。

2020年11月20日，晶合有限召开创立大会，审议通过《关于合肥晶合集成电路股份有限公司筹备情况的报告的议案》《关于合肥晶合集成电路股份有限公司筹备费用的报告的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司章程>的议案》

等议案，选举产生第一届董事会董事、第一届监事会监事，并授权公司董事会办理工商注册登记及相关事宜。

2020年11月20日，容诚出具《验资报告》（容诚验字[2020]第230Z0263号），对晶合有限整体变更为股份有限公司的情况予以审验。

2020年11月25日，合肥市市场监管局向晶合集成换发《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q）。根据合肥市人民政府办公厅发布的《加快推进“三证合一”登记制度改革工作方案》相关规定，发行人取得由工商行政管理部门核发的营业执照后，无需另行申领税务登记证。

综上，本所认为，发行人设立的程序、方式等符合有关法律、法规和规范性文件的规定，发行人已完成工商登记注册和税务登记相关程序，整体变更相关事项符合《公司法》等法律法规规定。

（二）发行人的设立资格和条件

经本所律师核查，发行人具备《公司法》第七十六条、第七十八条规定的股份有限公司设立的资格和条件，具体如下：

- 1、发起人共有30名，符合法定人数，且半数以上在中国境内有住所；
- 2、发起人缴纳的注册资本为1,504,601,368元，符合《公司章程》规定的全体发起人认购的股本总额；
- 3、发起人将其在晶合有限的权益所对应的净资产投入发行人，并折算为各发起人所持有的发行人的股份，整体变更后的股本与整体变更前的注册资本保持一致，资本公积和未分配利润在整体变更前后保持不变，股份发行、筹办事项符合法律规定；
- 4、发起人共同签署《公司章程》；
- 5、发行人有公司名称，并且设立了股东大会、董事会、监事会、总经理等股份有限公司应当具备的组织机构；

6、发行人注册于安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号，具有公司住所。

综上，本所认为，发行人设立的资格、条件等符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人设立过程中签订的改制重组合同

经本所律师核查，发行人不存在国有企业、集体企业改制而来的或历史上存在挂靠集体组织经营的情形。2020 年 11 月 5 日，晶合有限全体股东签署《发起人协议》，约定了改制方案，股份公司的名称、住所，公司的经营宗旨和经营范围，公司设立的方式、组织形式，公司注册资本、股份总额、发起人认购股份的数额、形式及期限，发起人的权利和义务，费用承担等重要事项。

本所认为，《发起人协议》的签署符合有关法律、法规和规范性文件规定，不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷。

（四）发行人设立过程中的审计、资产评估及验资事项

1、发行人设立过程中的审计事项

根据容诚于 2020 年 10 月 19 日出具的以 2020 年 9 月 30 日为基准日的《审计报告》（容诚审字[2020]230Z3994 号），截至 2020 年 9 月 30 日，晶合有限账面净资产值为 7,353,140,545.50 元。

2、发行人设立过程中的资产评估事项

根据中水致远于 2020 年 10 月 21 日出具的以 2020 年 9 月 30 日为基准日的《合肥晶合集成电路有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第 020502 号），截至 2020 年 9 月 30 日，晶合有限的净资产评估值为 918,198.75 万元。2020 年 11 月 9 日，合肥市国资委就上述资产评估项目基本情况及资产评估结果出具了《国有资产评估项目备案表》。

3、发行人设立过程中的验资事项

根据容诚于 2020 年 11 月 20 日出具的《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0263 号），晶合集成登记的注册资本为人民币 1,504,601,368 元，由晶合有限全体股东以其拥有的晶合有限截至 2020 年 9 月 30 日止的净资产缴纳 7,353,140,545.50 元，并按照 1:0.20462 比例折合股本 1,504,601,368 元，整体变更后的股本与整体变更前的注册资本保持一致，资本公积和未分配利润在整体变更前后保持不变。

综上，本所认为，发行人设立过程中有关审计、资产评估、验资等已履行了必要程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（五）发行人创立大会的程序及所议事项

根据发行人提供的创立大会会议通知、议案及决议并经本所律师核查，发行人于 2020 年 11 月 20 日召开创立大会，审议通过《关于合肥晶合集成电路股份有限公司筹办情况的报告的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司章程>的议案》《关于选举合肥晶合集成电路股份有限公司第一届董事会成员的议案》《关于选举合肥晶合集成电路股份有限公司第一届监事会成员的议案》《关于合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事薪酬的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司关联交易实施细则>的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司对外投资管理制度>的议案》《关于设置董事会专门委员会的议案》《关于授权办理合肥晶合集成电路股份有限公司设立相关事宜的议案》。

经核查，本所认为，发行人创立大会的程序及所议事项符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

（六）改制中是否存在侵害债权人合法权益情形

2020 年 10 月 21 日，晶合有限召开董事会，同意公司整体变更为股份公司的方案，整体变更后的注册资本为 1,504,601,368 元，未高于晶合有限经审计的净资产额 7,353,140,545.50 元，同时，公司的一切资产及债权、债务，由依法变更后的股份公司

继承，不存在通过自身资产的调整或者企业间资产转移等行为侵害债权人合法利益的情形。

经查询中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等，截至本法律意见书出具日，发行人不存在改制中侵害债权人合法权益而导致的纠纷。

综上，本所认为，发行人改制中不存在侵害债权人合法权益的情形，发行人不存在改制中侵害债权人合法权益而导致的纠纷。

五、发行人的独立性

（一）发行人的业务独立

根据发行人提供的业务合同台账、订单台账及重大业务合同、订单等相关文件资料和发行人书面说明，经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人依法经营，发行人独立开展业务并对外签署合同，其业务独立于发行人控股股东及其控制的其他企业。如本法律意见书“九、关联交易及同业竞争”所述，截至本法律意见书出具日，发行人与控股股东及其控制的其他企业不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响发行人独立性或显失公平的关联交易。

本所认为，截至本法律意见书出具日，发行人的业务独立。

（二）发行人的资产独立、完整

根据容诚出具的《审计报告》《验资报告》、发行人提供的工商档案文件、相关资产权属证明等文件和发行人书面说明，经本所律师核查，发行人不存在部分资产来自于上市公司的情形；发行人设立及历次增资时的出资均已经会计师事务所验资，发行人的注册资本已足额缴纳。如本法律意见书“十、发行人的主要财产”所述，发行人具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；发行人主要生产经营厂房系向控股股东下属子公司合肥蓝科投资有限公司租赁，相关厂房以租赁方式提供给公司使用系合肥市

人民政府与力晶科技合作初始确定的招商引资政策之一，发行人能够长期使用上述厂房、土地，不会对发行人正常生产经营造成重大不利影响。

本所认为，截至本法律意见书出具日，发行人的资产独立、完整。

（三）发行人的人员独立

根据发行人高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》和发行人书面说明，经本所律师核查，报告期内，发行人存在合肥建投、力晶科技向发行人委派高级管理人员的情形，具体包括：合肥建投曾向发行人委派销售副总监周义亮（曾兼任采购副总监），采购副总监王继武，总会计师朱才伟，审计师、敬业管理委员会委员长、行政副总朱晓娟，审计师、敬业管理委员会委员长杨幼玲；力晶科技曾向发行人委派副总会计师邱垂源、李迦谕，行政副总经理刘荫，审计师陈美华、潘炯升。截至本法律意见书出具日，公司高级管理人员均由公司聘任并在公司专职工作。

截至本法律意见书出具日，发行人的总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

本所认为，截至本法律意见书出具日，发行人的人员独立。

（四）发行人的机构独立

根据《内控报告》《公司章程》等公司内部治理文件和发行人书面说明，经本所律师核查，发行人已按照《公司法》及《公司章程》的规定，设立股东大会、董事会及其专门委员会、监事会等机构，聘请高级管理人员，发行人按照自身经营管理的需要设置了相关职能部门，已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

本所认为，截至本法律意见书出具日，发行人的机构独立。

（五）发行人的财务独立

根据《内控报告》、发行人财务会计制度和发行人书面说明，经本所律师通过对发行人财务负责人访谈等方式进行核查，发行人设立了独立的财务部门，已建立独立的财务会计核算体系，能够独立作出财务决策；发行人具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；发行人依法独立设立账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

本所认为，截至本法律意见书出具日，发行人的财务独立。

（六）发行人具有面向市场自主经营的能力

根据《内控报告》、发行人说明以及本所律师对发行人经营场所的实地调查结果，经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人主要从事 12 英寸晶圆代工业务；发行人拥有业务经营所需的资质许可，独立从事经营范围内的业务，其业务独立于发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系；发行人具有健全的内部组织结构，独立地面向市场进行经营活动。

本所认为，截至本法律意见书出具日，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，发行人拥有业务经营所需的资质许可，独立从事经营范围内的业务，其业务独立于发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人的业务独立、人员独立、财务独立、机构独立、资产独立完整，具有面向市场自主经营的能力。

六、发起人和股东

（一）发起人的资格

根据发行人提供的工商档案资料，并经本所律师核查，发行人整体变更为股份有限公司的发起人共 30 名，分别为合肥建投、合肥芯屏、力晶科技、美的创新、中安智芯、惠友豪创、合肥存鑫、海通创新、杭州承富、泸州隆信、宁波华淳、中小企业基金、安华创新、集创北方、中金浦成、合肥晶煅、合肥晶遂、合肥晶炯、合肥晶咖、合肥晶珏、合肥晶梢、合肥晶柔、合肥晶悬、合肥晶本、合肥晶洛、合肥晶辽、合肥

晶确、合肥晶铁、合肥晶妥、合肥晶雄，该等发起人分别以其持有的晶合有限股权所对应的净资产作为对发行人的出资。

各发起人的具体情况详见《律师工作报告》“六、发起人和股东”之“（一）发起人的资格”。经本所律师核查，本所认为，各发起人均具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人或进行出资的资格。

（二）发起人的人数、住所、出资比例

根据发行人《公司章程》《发起人协议》及容诚于 2020 年 11 月 20 日出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司（筹）验资报告》（容诚验字[2020]230Z0263 号）并经本所律师核查，发行人股份公司设立时，发起人共计 30 名。各发起人的住所情况详见《律师工作报告》“六、发起人和股东”之“（一）发起人的资格”。

综上，本所认为，发行人的发起人人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人的现有股东

经本所律师核查，自发行人设立至本法律意见书出具日，发行人的股份结构未发生变化，发行人的现有股东即发行人的发起人。

（四）发行人现有股东之间的关联关系

根据发行人股东提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人现有股东之间存在的关联关系情况如下：

合肥建投直接持有合肥芯屏 47.44%的合伙份额，并通过持有合肥芯屏普通合伙人合肥建投资本管理有限公司 70.83%的股权控制合肥芯屏。发行人 15 个员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构。

除上述情况外，发行人股东之间不存在关联关系。

（五）发行人的控股股东及实际控制人

1、发行人的控股股东及实际控制人的认定

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，合肥建投直接持有发行人 31.14%的股份，并通过合肥芯屏控制发行人 21.85%的股份，合计控制发行人 52.99%的股份；发行人董事会中，6 名董事由合肥建投提名，合肥建投系发行人的控股股东。合肥市国资委持有合肥建投 100%的股权，系发行人的实际控制人。经核查，发行人控股股东、实际控制人不存在设立在国际避税区且持股层次复杂的情形。

2、发行人实际控制人近两年未发生变更

经本所律师核查，报告期内，合肥建投支配发行人 50%以上的股权，委派或提名发行人半数以上董事，合肥建投实际支配的表决权足以对发行人董事会、股东大会的决议产生重大影响；合肥建投的唯一股东为合肥市国资委。本所认为，发行人最近两年实际控制人未发生变更。

（六）发起人的出资

1、根据《发起人协议》《公司章程》及容诚于 2020 年 11 月 20 日出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司（筹）验资报告》（容诚验字[2020]230Z0263 号），并经本所律师核查，发行人系由其前身晶合有限以其经审计净资产值折股整体变更而来，各发起人均以其所持晶合有限股权所对应的净资产作为对发行人的出资。各发起人投入发行人的资产产权关系清晰，将上述资产投入发行人不存在法律障碍。

2、经本所律师核查，发行人的设立属于有限责任公司整体变更为股份有限公司，发行人不存在将全资附属企业或其他企业先注销再折价入股或以在其他企业中的权益折价入股的情形。

3、经本所律师核查，发行人的设立属于有限责任公司整体变更为股份有限公司，各发起人以其对晶合有限出资形成的权益所对应的净资产折为其所拥有的发行人的股份，晶合有限的资产、业务和债权、债务全部由发行人承继，相应的资产或权利的权属证书所有人名称已变更为发行人或正在办理变更为发行人的手续。

（七）员工持股计划

1、员工持股计划的人员构成

发行人 15 个员工持股平台的人员构成详见《律师工作报告》“六、发起人和股东”之“（一）发起人的资格”。

本所认为，发行人员工持股计划的人员构成符合公司《员工持股管理办法》的规定。

2、减持承诺

根据公司《员工持股管理办法》，员工持股平台不在公司首次公开发行股票时转让股份，并自公司上市之日起锁定 36 个月。

发行人 15 个员工持股平台作为发行人股东，分别出具了《关于股份锁定的承诺函》，就所持发行人股份的锁定期承诺如下：自晶合集成本次发行上市之日起 36 个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份，也不由晶合集成回购本公司/本企业在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份。

本所认为，发行人员工持股平台上述锁定承诺符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规和中国证监会、上交所的相关规定。

3、员工持股平台的具体安排及规范运行情况

2020 年 9 月 10 日，晶合有限董事会通过《员工持股管理办法》，对于员工加入及退出员工持股平台进行了明确规定，具体如下：

（1）员工加入持股平台的相关规定

根据公司《员工持股管理办法》，除非另有规定，在经批准的员工持股计划实施方案范围内，公司相关员工达到公司考核标准后，经员工持股平台管理人书面同意，可以取得员工持股平台的股权/出资份额。如直系亲属多人在公司的，只能一人持股。员工持股计划实行以岗定股，相关员工不得存在以下情形：最近 12 个月内因重大违法违规被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；最近 36 个月内存在损害公司利益的情形的；存在《公司法》第 148 条规定的行为，违反其对公司、子公司或任职关联企业的忠实义务的；为各级党委、政府及其部门、机构任命的国有

企业领导人员；为公司外部董事、监事（含职工代表监事）；法律法规规定不得参与员工持股计划的。

（2）员工退出持股平台的相关规定

根据公司《员工持股管理办法》，除非另有规定，并经员工持股平台管理人事先书面同意，于禁售期届满前员工不得向第三人（包括员工持股平台的其他员工）转让其在员工持股平台中的全部或部分股权/财产份额。员工违反本办法擅自转让的，该转让行为无效并应当赔偿由此给员工持股平台造成的损失。

根据公司《员工持股管理办法》，于禁售期届满前，员工因任何原因（包括但不限于解除或终止劳动合同关系、退休、丧失民事行为能力、死亡等）自公司或其子公司或关联企业离职的，则该员工（或其继承人、法定代理人或监护人）应当向员工持股平台管理人（或其指定的符合条件的人士；下同）转让其持有的员工持股平台全部股权/财产份额，但另有约定或员工持股平台管理人书面同意的除外。员工（或其继承人、法定代理人或监护人）按照规定向员工持股平台管理人转让其股权/财产份额的，转让价格由交易双方协商确定，员工持股平台向该等员工支付转让价款时将扣减相应的税费。

于禁售期届满后，员工因任何原因（包括但不限于解除或终止劳动合同关系、退休、丧失民事行为能力、死亡等）自公司或其子公司或关联企业离职的，则该员工（或其继承人、法定代理人或监护人）应当向员工持股平台管理人转让其持有的、尚未完全解除出售限制的全部员工持股平台股权/财产份额，但另有约定或员工持股平台管理人书面同意的除外。员工（或其继承人、法定代理人或监护人）按照规定向员工持股平台管理人转让其股权/财产份额的，转让价格由交易双方协商确定，员工持股平台向该等员工支付转让价款时将扣减相应的税费。

除另有约定或员工持股平台管理人书面同意外，无论员工因任何原因离职，该员工（或其继承人、法定代理人或监护人）应于其提出离职之日起 15 个自然日内（以下简称出售期限）向员工持股平台管理人发出指示，按规定出售/减持其持有的员工持股平台股权/财产份额。出售期限届满后，员工未向员工持股平台管理人发出出售/减持指示的，员工持股平台管理人有权自主决定出售/减持上述员工持有的股权/财产份额，

且无须对此承担法律责任。离职员工持有的未经解除出售限制的股权/财产份额，依照前述规定办理。

员工持股平台的合伙人如存在与发行人解除或终止劳动合同关系的情形，经员工持股平台管理人同意后，向员工持股平台管理人及其指定的符合条件的人士转让。

（3）员工持股平台的规范运行情况

根据发行人书面说明，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人 15 个员工持股平台中的有限合伙人均为发行人在职员工，符合《员工持股管理办法》的相关规定，具体情况详见《律师工作报告》“六、发起人和股东”之“（一）发起人的资格”。

4、是否履行登记备案程序

发行人的员工持股平台，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，不涉及由私募投资基金管理人管理并进行有关投资活动，或者受托管理任何私募投资基金的情形，除投资发行人外，未开展其他经营活动。本所认为，发行人的员工持股平台不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需按照规定履行私募投资基金备案程序。

七、发行人的股本及其演变

（一）发行人设立时的股本结构

发行人设立时的具体情况详见《律师工作报告》“四、发行人的设立”。经本所律师核查，本所律师认为，发行人设立时的股权设置、股本结构合法有效。

（二）发行人及其前身的历次股权变动情况

发行人及其前身的历次股权变动情况详见《律师工作报告》“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。

经本所律师核查，本所认为，发行人历史上不存在工会、职工持股会持股或者自然人股东人数较多等情形，发行人历次股权变动均合法、有效。

（三）国有股东标识管理

2021年3月19日，合肥市国资委出具《关于合肥晶合集成电路股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》（合国资产权[2021]27号）。根据该批复，合肥市国资委同意将合肥建投所持发行人的股份界定为国有法人股，其证券账户应标识为“SS”。

（四）发行人股份质押情况

根据发行人及其全体股东出具的书面确认并经本所律师检索国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），截至本法律意见书出具日，发行人股东所持发行人的股份未设置质押。

八、发行人的业务

（一）经营范围和经营方式

根据发行人现持有的《营业执照》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），发行人的经营范围为“集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

发行人境内子公司的经营范围详见本法律意见书“十、发行人的主要财产”之“（五）发行人的子公司”。

根据发行人及其子公司所在地工商、税务等相关政府部门出具的证明文件、发行人书面确认并经核查，本所认为，发行人及其子公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规的规定，已经取得经营所需的相关业务资质及许可。

（二）境外业务

根据发行人说明、《审计报告》并经本所律师核查，截至2020年12月31日，发行人拥有1家境外子公司（日本晶合），主要从事集成电路设计服务及技术开发。发

行人境外子公司的具体情况详见本法律意见书“十、发行人的主要财产”之“（五）发行人的子公司”。

（三）主营业务变更情况

根据《审计报告》、发行人提供的工商资料及书面确认并经本所律师核查，发行人最近两年内主营业务未发生变更。

（四）主要业务资质、许可或备案

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人拥有的主要经营资质证书情况如下：

资质名称	证书/登记编号	授予单位/登记机关	有效期限
辐射安全许可证	皖环辐证[A0390]	安徽省生态环境厅、合肥市生态环境局	2020年6月5日至2022年5月21日
排污许可证	91340100343821433Q001W	合肥市生态环境局	2019年11月11日至2022年11月10日
对外贸易经营者备案登记表	02360936	-	-
海关进出口货物收发货人备案	3401660005	庐州海关	2020年7月8日至长期

（五）发行人的主营业务

根据《招股说明书（申报稿）》《审计报告》及发行人书面确认，截至本法律意见书出具日，发行人主要从事12英寸晶圆代工业务。

（六）发行人的持续经营能力

根据《招股说明书（申报稿）》《审计报告》《企业信用报告》以及发行人的书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人依法存续，主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情况，不存在影响其持续经营的法律障碍。

（七）发行人合作研发的相关情况

发行人目前 CIS 技术平台分别与合肥海图微电子有限公司、思特威（上海）电子科技有限公司进行合作开发，PMIC 技术平台与杰华特微电子（杭州）有限公司进行合作开发。报告期内，发行人 CIS、PMIC 工艺平台对营业收入贡献较小。

九、关联交易及同业竞争

（一）关联方

根据《公司法》《上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人的主要关联方如下：

1、发行人的控股股东、实际控制人

发行人的控股股东为合肥建投，实际控制人为合肥市国资委。合肥建投的具体情况，详见本法律意见书“六、发起人和股东”之“（五）发行人的控股股东及实际控制人”。

2、发行人的控股股东直接或间接控制的其他企业

截至本法律意见书出具日，除发行人及其控股子公司以外，发行人控股股东直接或间接控制的其他主要企业如下：

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
1	合肥芯屏	2016年1月18日	合肥市包河区武汉路229号	投资管理、资产管理；投资咨询。
2	合肥蓝科投资有限公司（以下简称合肥蓝科）	2008年11月5日	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内	项目投资；基础设施建设；自营和代理各类商品和技术进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术）；房产租赁；仓储（除危险品）物流；房地产开发及经营；科技工业园开发及管理；物业管理；酒店管理；展览展示服务；会议服务。
3	合肥燃气集团有限公司（以下简称合肥燃气）	1995年11月13日	合肥市蜀山区合作化南路466号	燃气生产、销售和管道输配；市政公用工程、燃气工程、供暖工程及配套工程的设计、建设、安装、维修、服务、监理、咨询；房屋建筑

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				工程的监理及咨询；机电设备安装，装修装饰工程，土方工程，铆焊加工；燃气器具制造经营；燃气设备及智能安全家居产品生产销售与安装维修；商务信息咨询；教育信息咨询；保险信息咨询；能源项目建设、开发利用、运营管理；汽车货物运输；自有房产及设备租赁。
4	合肥供水集团有限公司 (以下简称合肥供水)	1994年7月21日	安徽省合肥市屯溪路70号	自来水生产与供应、管道安装、水质监测、水表阀门修理、科研设计、工程监理、自有固定资产租赁。
5	合肥蜀山百大购物中心有限公司 (以下简称百大购物)	2012年6月27日	安徽省合肥市蜀山区望江西路218号	预包装食品批发兼零售(在许可证有效期内经营)；保健食品销售(李宝赢堂牌参茸酒)(在许可证有效期内经营)；日用百货、针纺织品、鞋帽、服装、五金交电、化工产品(除危险品)、文体用品、办公用品、金银珠宝玉器、家具、皮革制品、钟表眼镜、照相器材、工艺品、儿童游乐设施、通讯设备、家电、电子产品、计算机软硬件及配件、劳保用品、建材、装饰材料、儿童用品销售；卷烟零售；合肥通卡代收代付(在协议范围内经营)；物业服务；企业管理咨询；房屋租赁。
6	安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 (以下简称百大合家福)	2000年6月15日	安徽省合肥市沿河路118号	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售、散装食品(含冷藏冷冻食品、含散装熟食)销售、保健食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售、热食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、糕点类食品制售、自制饮品制售、其他类食品制售；酒、卷烟零售、农副产品、餐饮服务(现场制售：面点、熟食、豆制品、泡菜、中餐)；农产品收购；日用百货、针纺织品、家用电器及电子产品、通讯器材销售；家具、文体用品、五金车件、化工产品(除危险品)、建筑材料、劳保用品、汽车

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				(除小轿车)及配件、摩托车及配件、花卉、玩具、宠物用品销售、自行车、电动车、服装、黄金制品、珠宝首饰零售;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定和禁止企业经营商品除外);医疗器械销售(除国家限制项目)、音像制品、图书;儿童娱乐服务;彩扩服务;房屋租赁、场地出租(涉及许可在许可证有效期内经营);停车场服务项目;特殊医学用途配方食品销售;网络表演;为本超市销售产品提供配送服务。
7	合肥市建设投资有限公司	1992年4月15日	合肥市滨湖新区武汉路229号	项目投资、股权投资、资产重组及并购(未经金融监管部门批准,不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务);房屋租赁。
8	合肥市交通投资控股有限公司	2004年2月11日	安徽省合肥市梅山路77号	公路项目建设、营运、收费、咨询及服务;城乡交通基础设施及相关产业的投资与运营;营运授权范围内的国有资产;按照法定程序处置、租赁所属企业土地和房屋资产;国内广告制作、代理、发布;公路服务区经营、策划及住宿、餐饮服务;车辆救援服务及汽车维修;交通工程物资销售;道路普通货运;仓储服务;实业投资;旅游项目的投资开发。
9	合肥城建投资控股有限公司	2001年12月6日	合肥市滨湖区武汉路229号	城市建设项目开发和经营,房地产综合开发,对项目和企业进行投资,参股和收购,物资贸易,房屋租赁。
10	合肥百货大楼集团股份有限公司	1996年7月29日	安徽省合肥市长江中路150号	预包装食品、酒、乳制品销售,烟、西药制剂及中成药零售,汽车运输,土产品、纺织品、服装、工艺美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品、针织品、家具、食用农产品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售及为网上销售提供服务,自制饮品销售,糕点类食品制售,保健食品、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、音像制品、书刊、电子出

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				版物及设备的零售，接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务，进出口业务，黄金饰品零售及修旧改制，服装、鞋帽、塑料制品加工，房屋租赁，玩具及轨道赛车服务，餐饮、停车服务。
11	合肥丰乐种业股份有限公司	1997年4月16日	合肥市蜀山区创业大道4号	农作物种子、种苗生产、销售；大米、芝麻、棉花生产、销售；肥料销售；农药、专用肥、植物生长素、食用香料香精、薄荷脑及薄荷油、茶叶生产、销售；粮食作物、油料作物种植、储藏、运输、销售；农副产品及其深加工产品、花卉、包装材料生产、销售；农业高新技术开发及成果转让；农业技术咨询、技术服务；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；农业机械类产品的出口和种子的进出口业务。
12	合肥科融高科技产业投资有限公司	2009年11月10日	安徽省合肥市滨湖新区武汉路229号	高科技产业风险投资，企业参股、并购及重组，项目投资及运营，股权管理。
13	合肥市轨道交通集团有限公司	2009年6月2日	安徽省合肥市阜阳路17号	城市轨道交通系统项目策划、投资、建设、运营、管理及资源开发；系统设备租赁、销售；轨道交通沿线及相关地区、地下空间资源开发及管理；物业管理；酒店管理；城市基础设计及咨询；代理设计、制作、发布国内广告。
14	合肥金太阳能科技股份有限公司	2010年12月30日	安徽省合肥市高新区黄山路630号	大中型光伏并网电站、小型并（离）网光伏发电系统、光伏建筑一体化项目勘测设计、施工安装、工程总承包服务、运营管理；系统集成；技术咨询。
15	合肥文旅博览集团有限公司	2002年4月30日	安徽省合肥政务文化新区习友路988号	高端现代服务业投融资平台研发；文化体育产业策划、投资、运营管理；旅游产业策划、投资、运营管理；会展场馆运营、展会开发、广告搭建及展会综合配套服务；酒店投资运营及受托管理；餐饮管理；物业管理；教育投资及咨询；大健康产业、休闲养老产业投资建设运

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				营管理；公益设施、基本建设项目开发、经营、融资管理；资产管理；投资管理；房地产综合开发、销售；供应链管理；电子商务、农业支撑服务；中介服务；房屋、停车场租赁、管理；企业管理咨询；信息技术咨询。
16	合肥市水环境建设投资有限公司	2000年8月8日	安徽省合肥市包河区包河大道398号A座1-7楼	水务和环境项目的投资、建设、运营、管理；承担政府性项目的投资、融资、委托代建、运营和管理任务；受政府委托从事土地一级开发，土地收储、拆迁、整理、基础配套等熟化工作；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；房屋租赁；承担市政府授权的其他工作。
17	合肥通航控股有限公司	2015年10月19日	合肥市包河区徽州大道1号骆岗机场	机场运营、资产管理、设备维修、物业管理、企业管理、投资咨询、企业策划、航空投资、计算机系统集成、数据处理。
18	合肥建投资本管理有限公司	2016年1月11日	合肥市包河区武汉路229号	投资管理、资产管理。
19	合肥市乡村振兴投资有限责任公司	2013年1月9日	安徽省合肥市包河区包河大道398号建投综合办公区A座8-9楼	农业、文化旅游产业项目投资及运营管理；农村基础设施建设及人居环境建设；乡村旅游开发；特色小镇开发及田园综合体开发；农产品生产种植与销售；城市基础设施建设；土地整治；土地储备业务。
20	安徽环巢湖生态发展有限公司	2004年10月18日	安徽省巢湖市巢庐路（原东庵林场）	生态产业投资与建设，休闲旅游产业、文化旅游产业的投资与运营，旅游景区的开发、建设、运营，旅行社、旅游交通服务，文化演艺与婚庆、展览服务，旅游商品开发与销售，酒店管理，物业管理，会议、培训服务，旅游策划与管理咨询，文化体育运动的组织与服务。
21	合肥市电动汽车充电设施投资运营	2015年2月15日	合肥市蜀山区合作化南路466号燃气大厦22-24	电动汽车充、换电设施的投资运营、建设及网络规划、设计；电动汽车充、换电服务；售电业务；电

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
	有限公司		层	动汽车采购、销售；销售汽车配件；电动汽车租赁；计算机信息系统及互联网技术开发和服务；发布国内广告；充、换电设施及零部件的销售、维修服务；停车场运营管理。
22	合肥市综合管廊投资运营有限公司	2016年12月23日	合肥市包河区武汉路229号建投大厦	城市地下综合管廊或管沟等的投资、建设及运营管理工作；地下空间开发及运营；资产管理及物业管理。
23	合肥融科项目投资有限公司	2010年11月11日	合肥市新站区大禹路与东方大道交口西北角合肥综合保税区进口商品展示中心大楼12-14层	项目投资。
24	合肥市引江济淮投资有限公司	2017年8月30日	安徽省合肥市经济技术开发区九龙路118号	引江济淮主体工程沿线土地、岸线、水资源、生态旅游综合开发和经营；产业投资、项目建设、项目管理与运营；股权投资；文化旅游、休闲、养老、健康产业的物业投资、管理。
25	合肥市建庐建设投资有限公司	2017年12月21日	合肥市庐江县庐城镇晨光路17号东方水岸写字楼15层	县域基础设施项目投资、建设、运营和管理。
26	安徽中安智通科技股份有限公司	2015年12月16日	合肥市包河区常青街道姚公社居委南屏路555号	城市智能交通系统设计施工、产品研发、技术服务和销售；城市交通项目投资；交通设施和器材的研发、设计、制作、安装及维护维修；机械式立体停车设备、智能车位引导等自动化控制系统及系统集成的研发设计、生产制造销售、技术服务；停车场相关设计施工、技术服务、管理服务；软件开发；广告发布、传媒灯箱、信息咨询服务；住房及商用房屋租赁；物业管理。
27	合肥市住房租赁发展股份有限公司	2020年5月18日	安徽省合肥市蜀山区长江西路460号合房租赁办公区	住房租赁，商业房产运营，房地产开发、咨询、代理、经纪，房屋建筑工程施工，室内外装饰工程设计施工，酒店管理，物业管理，停车场（库）运营，户外广告、道路绿

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				化及工程施工咨询，家具及家用电器用品出租服务，计算机和网络安全服务，互联网信息服务。

此外，过去 12 个月内发行人控股股东直接或间接控制的其他企业亦为发行人的关联方。

3、发行人的控股子公司

截至本法律意见书出具日，发行人在中国境内拥有 2 家控股子公司，在中国境外拥有 1 家控股子公司。上述公司的具体情况，详见本法律意见书“十、发行人的主要财产”之“（五）发行人的子公司”。

4、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

发行人现任董事、监事、高级管理人员以及过去 12 个月内曾经担任发行人董事、监事、高级管理人员的人员构成发行人关联方，上述人员的具体情况，详见本法律意见书“十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”。此外，与上述人员关系密切的家庭成员亦构成发行人的关联方。

5、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者由前述人员（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织

截至本法律意见书出具日，发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者除独立董事外的前述人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织的情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	智慧记忆科技股份有限公司	蔡国智担任董事、郑素芬担任董事
2	Xsense Technology Corporation	蔡国智担任董事
3	合肥建投	陆勤航担任董事兼总经理、黄颢担任董事兼副总经理
4	启迪控股股份有限公司	陆勤航担任董事

序号	关联方名称	关联关系说明
5	合肥建投资本管理有限公司	黄颢担任董事
6	合肥德轩投资管理有限公司	黄颢担任董事
7	合肥京东方显示技术有限公司	黄颢担任董事长
8	合肥市信实产业投资基金（有限合伙）	黄颢担任执行事务合伙人委派代表
9	合肥奕斯伟封测控股有限公司	黄颢担任董事
10	合肥颀中封测技术有限公司	黄颢担任董事
11	合肥维信诺科技有限公司	黄颢担任董事
12	蔚来控股有限公司	黄颢担任董事
13	启迪新基建产业（合肥）集团有限公司	黄颢担任董事
14	合肥德电新能源汽车股份有限公司	黄颢担任董事
15	合肥神州数码信创控股有限公司	黄颢担任董事
16	智丰科技股份有限公司	郑素芬担任总经理
17	新相科技股份有限公司	郑素芬担任董事长
18	顺立投资股份有限公司	郑素芬担任董事
19	瑞相科技股份有限公司	郑素芬担任董事
20	晶相光电股份有限公司	郑素芬担任董事
21	力相光学股份有限公司	郑素芬担任董事
22	宏丽数位创意股份有限公司	郑素芬担任董事
23	智合精准医学科技股份有限公司	郑素芬担任董事
24	智成电子股份有限公司（以下简称智成电子）	郑素芬担任董事
25	景睿科技股份有限公司	郑素芬担任董事
26	集邦科技股份有限公司	郑素芬担任董事
27	智仁科技开发股份有限公司	郑素芬担任董事
28	智高医学科技股份有限公司	郑素芬担任董事
29	英达投资股份有限公司	胡竞英担任董事长且控制
30	疯狂秀股份有限公司	胡竞英担任董事
31	中兴农林开发股份有限公司	胡竞英担任董事
32	合富润生企业管理咨询（上海）有限公司	胡竞英担任董事

序号	关联方名称	关联关系说明
33	合润生活国际有限公司	胡竞英担任董事

此外，过去 12 个月内发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者除独立董事外的前述人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织亦为发行人的关联方。

6、直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织

截至本法律意见书出具日，除合肥建投以外，直接持有发行人 5%以上股份的股东为合肥芯屏、力晶科技、美的创新。

美的集团股份有限公司直接持有美的创新 70%的股权，并通过全资子公司佛山市美的空调工业投资有限公司间接持有美的创新 30%的股权，亦系发行人的关联方。

7、直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织

截至本法律意见书出具日，直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织包括：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	力信投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
2	世仁投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
3	富硕投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
4	Sprout International Limited	力晶科技直接或间接控制
5	智典国际股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
6	世成科技股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
7	智仁科技开发股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
8	智慧记忆体科技股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
9	Deutron Japan Corp.	力晶科技直接或间接控制
10	智翔投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
11	智成电子	力晶科技直接或间接控制

序号	关联方名称	关联关系说明
12	力相光学股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
13	广东美云智数科技有限公司	美的创新直接或间接控制
14	深圳数智场景定位科技有限公司	美的创新直接或间接控制
15	上海美仁半导体有限公司	美的创新直接或间接控制

此外，过去 12 个月内直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织亦为发行人的关联方。

8、直接控制上市公司的法人的董事、监事、高级管理人员及其控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

(1) 直接控制发行人的法人的董事、监事、高级管理人员

直接控制发行人的法人为合肥建投，截至 2020 年 12 月 31 日，合肥建投的董事、监事、高级管理人员及其控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织如下：

序号	关联方姓名	关联关系说明
1	李宏卓	合肥建投董事长
2	陈小蓓	合肥建投董事
3	陆勤航	合肥建投董事兼总经理
4	黄颢	合肥建投董事兼副总经理
5	倪敬东	合肥建投董事
6	吴子能	合肥建投董事
7	杨雪蕾	合肥建投董事
8	黄跃明	合肥建投监事
9	杨国庆	合肥建投监事
10	范红金	合肥建投监事
11	田胜彬	合肥建投监事
12	朱庆	合肥建投监事
13	罗文萍	合肥建投高级管理人员

过去 12 个月内曾经担任合肥建投董事、监事、高级管理人员的人员构成发行人关联方。

(2) 前述关联自然人直接或者间接控制的法人或其他组织

前述关联自然人中，陆勤航、黄灏亦系发行人董事。除陆勤航、黄灏外，其他关联自然人控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	合肥维信诺科技有限公司	李宏卓担任董事长
2	合肥建投资本管理有限公司	李宏卓担任董事长，陈小蓓、罗文萍担任董事
3	合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
4	合肥芯屏	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
5	合肥新站高新创业投资合伙企业（有限合伙）	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
6	合肥市乡村振兴产业投资合伙企业（有限合伙）	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
7	合肥市大数据资产运营有限公司	陈小蓓担任董事
8	合肥通航控股有限公司	陈小蓓担任董事
9	安徽省合肥联合发电有限公司	陈小蓓担任董事
10	合肥高特佳创业投资有限责任公司	陈小蓓担任董事
11	合肥百货大楼集团股份有限公司	陈小蓓担任董事
12	合肥丰乐种业股份有限公司	陈小蓓担任董事
13	合肥市水务环境建设投资有限公司	吴子能担任董事长
14	合肥市铭城建设发展有限公司	吴子能担任董事长
15	合肥市环巢湖建设发展有限公司	吴子能担任董事长
16	合肥泽众城市智能科技有限公司	吴子能担任副董事长
17	安徽庐铜铁路有限公司	吴子能担任副董事长
18	铜陵江北港铁路专用线有限责任公司	吴子能担任副董事长
19	合肥新桥国际机场有限公司	吴子能担任副董事长
20	合肥龙和投资咨询有限公司	黄跃明担任董事兼总经理

序号	关联方名称	关联关系说明
21	合肥科融高科技产业投资有限公司	黄跃明担任执行董事兼总经理
22	合肥二号线轨道交通有限公司	田胜彬担任董事
23	合肥市建庐建设投资有限公司	杨雪蕾担任董事长，田胜彬担任董事
24	合肥建翔投资有限公司	田胜彬担任董事
25	合肥市建设投资有限公司	罗文萍担任执行董事兼总经理
26	合肥市乡村振兴投资有限责任公司	杨雪蕾担任执行董事

除此之外，前述关联自然人过去 12 个月内曾经担任董事、高级管理人员的法人或其他组织亦为发行人的关联方。

9、其他关联方

除上述关联方外，发行人的其他关联方还包括其他根据《上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定认定的关联方。

10、关联方信息披露

根据发行人的书面说明，并经本所律师核查，发行人已在《招股说明书（申报稿）》中按照《公司法》《企业会计准则》和中国证监会的相关规定认定并披露关联方。

11、注销或转让重要关联方

根据发行人控股股东填写的调查表和发行人的书面说明，并经本所律师核查，报告期内，发行人不存在注销或转让的子公司，亦不存在与发行人存在关联交易的关联方注销或转让的情形。

（二）关联交易

根据《审计报告》和发行人书面说明，并经本所律师核查，发行人报告期内关联交易的情况如下：

1、向关联方采购商品及接受服务

报告期内，发行人向关联方采购商品及接受服务的相关情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
合肥建投	咨询服务	199.69	0.12%	672.40	0.63%	696.23	0.85%
合肥燃气	采购燃气	368.42	0.22%	303.58	0.28%	286.98	0.35%
合肥供水	采购厂区用水	308.09	0.19%	293.89	0.27%	516.43	0.63%
百大购物	采购商品	2.70	0.00%	-	-	-	-
百大合家福	采购商品	2.28	0.00%	-	-	-	-
力晶科技	采购商品及服务	160.17	0.10%	2,236.81	2.09%	1,890.24	2.32%
智成电子	采购服务	372.62	0.23%	152.95	0.14%	177.18	0.22%
关联采购合计		1,413.97	0.86%	3,659.62	3.42%	3,567.06	4.37%

2、向关联方销售商品及提供服务

报告期内，发行人未向关联方销售商品及提供服务。

3、关联租赁

报告期内，发行人因经营需要向关联方合肥蓝科租赁土地、厂房及厂务设施，均位于安徽省合肥市瑶海区综合保税区内西淝河路 88 号，为发行人的注册地及主要办公场所。根据发行人与合肥蓝科、力晶科技签订的《厂房建设与租用协议》及发行人与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》，发行人作为承租方向合肥蓝科租入土地、厂房及配套厂务设施的具体情况如下：

单位：万元

关联方	租赁资产种类	2020 年度	2019 年度	2018 年度
合肥蓝科	土地	263.24	263.24	263.24
合肥蓝科	厂房及配套厂务设施	6,235.21	3,117.61	-

4、关联担保情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人接受关联方担保的情况如下：

单位：元

担保方	出借人	借款余额（含一年内到期的长期借款）	借款日期	到期日	担保是否已经履行完毕	是否提供反担保
合肥建投	华泰资产管理有限公司（以下简称华泰资产）	1,300,000,000.00	2018/9/28	2028/9/27	否	是
		300,000,000.00	2018/10/30	2028/10/29	否	是
		420,000,000.00	2018/11/8	2028/11/7	否	是
		900,000,000.00	2019/7/18	2029/7/17	否	是
		80,000,000.00	2019/8/29	2029/8/28	否	是
	平安银行股份有限公司合肥分行	809,397,599.99	借款发放日	2027/10/10	否	是
	兴业银行股份有限公司合肥分行	668,360,017.01	借款发放日	2028/1/7	否	是
中国银行股份有限公司合肥北城支行	492,833,531.73	借款发放日	2028/1/15	否	是	

2017年12月14日，合肥建投与中国银行股份有限公司合肥北城支行（以下简称中国银行北城支行）签署了《最高额保证合同》，约定合肥建投为公司与中国银行北城支行签署的《授信额度协议》项下70,000万元授信提供连带责任保证担保，保证期间为《授信额度协议》生效之日至主债权期限届满之日起两年。

2017年12月28日，合肥建投与平安银行股份有限公司合肥分行（以下简称平安银行合肥分行）签署了《最高额保证担保合同》，合肥建投为公司与平安银行合肥分行签署的《综合授信额度合同》项下110,000万元的债务提供最高额连带责任保证担保，担保期限至主合同项下债务完全清偿。

2017年12月29日，合肥建投与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称兴业银行合肥分行）签署了《最高额保证合同》，合肥建投为公司与兴业银行合肥分行在保证额度有效期内最高本金限额70,000万元的债务提供连带责任保证担保，保证额度有效期自2017年12月29日至2028年1月5日止。

2018年8月20日，合肥建投与华泰资产签署了《华泰—合肥晶合集成电路基础设施债权投资计划保证担保合同》，合肥建投为公司与华泰资产签署的《华泰-合肥晶合集成电路基础设施债权投资计划投资合同》项下本金300,000万元的债务提供连带责任保证担保，担保期间自同生效之日起至全部债务期限届满之日起两年。

根据公司与合肥建投签订的反担保合同及补充协议，公司就合肥建投为公司上述借款的担保以部分机器设备及原物料提供反担保。

5、关联方资金拆借

报告期内，发行人作为借款人向关联方进行资金拆借情况如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利率
合肥建投	75,500.00	2018/5/9	2018/10/18	4.35%
合肥建投	5,000.00	2018/5/2	2018/10/18	4.35%

2018年4月28日，发行人与合肥建投、中国银行合肥北城支行签订人民币委托贷款合同，合同约定借款金额为80,500.00万元，借款期限为6个月，借款利率为4.35%，按季结息。截至2018年10月18日，发行人和关联方的上述资金拆借情况已清理完毕。报告期内未再发生发行人与关联方资金拆借的情形。

6、关键管理人员薪酬

报告期内，发行人向关键管理人员支付薪酬，关联交易金额分别为1,002.60万元、1,022.05万元和1,417.96万元。

7、关联方往来余额

(1) 应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	邱显寰	13.83	-	11.10	-	3.12	-
其他应收款	詹奕鹏	2.02	-	-	-	-	-
其他应收款	简瑞荣	0.18	-	-	-	-	-
其他应收款	朱才伟	-	-	7.30	-	1.20	-
其他应收	黎湘鄂	-	-	-	-	5.58	-

项目名称	关联方	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
款							
其他应收款	谢明霖	-	-	0.90	-	-	-
其他应收款	合肥燃气	40.00	-	94.00	-	94.00	-
其他非流动资产	力晶科技	-	-	-	-	1,330.39	-

(2) 应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
其他应付款	周义亮	0.07	0.22	-
其他应付款	王燕	-	0.02	-
其他应付款	李洳谕	0.34	-	-
其他应付款	朱才伟	0.05	-	-
其他应付款	简瑞荣	-	-	0.80
其他应付款	合肥蓝科	712.94	444.12	338.05
应付账款	合肥蓝科	704.13	444.20	235.96
应付账款	力晶科技	7.44	-	1,376.54
应付账款	合肥燃气	27.18	5.02	5.93
应付账款	智成电子	189.74	92.01	75.05
长期应付款	合肥蓝科	180,182.88	183,938.79	187,056.39

注：其他应付个人款项主要为员工报销款；合肥蓝科长期应付款系发行人向合肥蓝科融资租赁厂房及配套厂务设备形成。

8、其他关联交易事项

(1) 《委托经营管理合约》的签订与解除情况

2015年10月19日，晶合有限与力晶科技签订《委托经营管理合约》，约定公司委托力晶科技进行经营管理，以协助公司执行于合肥新站区建成12英寸晶圆制造厂项目。2020年1月2日，公司与力晶科技签订了《委托经营管理合约之终止协议》，双方同意自2019年12月25日起即终止《委托经营管理合约》。

（2）专利所有权的转让情况

2017年3月，力晶科技使用58项专利技术使用权等专有技术向晶合有限增资。2020年9月3日，力晶科技与晶合有限签署《专利转让协议》，约定将上述58项专利中尚在有效期内的44项专利的所有权无偿转让给晶合有限。截至本法律意见书出具日，前述44项专利的所有权已转让至晶合有限，相关专利具体情况详见本法律意见“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。

（三）关联交易的决策程序

1、报告期内关联交易所履行的决策程序

发行人于2021年2月9日召开的第一届董事会第三次会议以及于2021年3月16日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于确认合肥晶合集成电路股份有限公司2018年度至2020年度期间关联交易的议案》《关于<合肥晶合集成电路股份有限公司2021年度日常关联交易预计>的议案》，对发行人在报告期内关联交易以及报告期后预计持续发生的日常关联交易的公允性进行了确认，关联董事和关联股东已回避表决，独立董事已就发行人报告期内关联交易出具了独立意见：“（1）上述关联交易事项审议程序和表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决；（2）上述关联交易事项均是为了满足公司日常正常业务开展的需要而进行，该等关联交易是必要、合理的；（3）合肥蓝科投资有限公司系依据合肥市人民政府相关政策向公司出租厂房，租赁价格虽低于市场价格，但公司已按照相应会计准则确认为政府补助，计入递延收益，该等关联交易符合公司和全体股东的利益；（4）除此之外，公司其他与关联方的交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，关联交易事项按照一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意上述关联交易事项。”

发行人于2021年3月5日召开的第一届董事会第四次会议以及于2021年3月16日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于公司与合肥建投签订反担保相关协议的议案》《关于公司与合肥蓝科签订<晶合二厂厂务及配套项目租赁合同>及<晶合二厂厂务及配套项目收购意向协议>的议案》，关联董事和关联股东已回避表决，独立董事已就上述报告期外新增关联交易出具了独立意见：“（1）上述关联交易事项审议程序和

表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决；（2）上述关联交易事项均是为了满足公司日常正常业务开展的需要而进行，该等关联交易是必要、合理的；（3）公司与关联方的交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，关联交易事项经双方充分商业谈判达成相关条款，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意上述关联交易事项。”

综上所述，发行人与关联方之间关联交易合同的签订和决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》及发行人内部规章制度的规定。本所认为，发行人与关联方进行上述关联交易已经公司董事会、股东大会审议或确认，独立董事就此事宜发表了相关意见，上述关联交易已经采取必要措施对其他股东的利益进行保护，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

2、发行人《公司章程》等对于关联交易决策程序的规定

发行人在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》以及上市后生效的《发行人章程》中，规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序。

发行人除在上述制度中规定了关联交易决策程序的内容以外，还专门制定了《关联交易实施细则》。该制度就关联人的界定、关联交易的范围、关联人报备、关联交易披露及决策程序、关联交易定价、关联人及关联交易应当披露的内容、日常关联交易披露和决策程序的特别规定、关联交易披露和决策程序的豁免等内容进行了具体规定。

综上所述，本所认为，发行人已在其《公司章程》及其他内部规章制度中明确了关联交易的公允决策程序。

（四）减少和规范关联交易的措施

为规范及减少公司与关联方之间未来可能发生的关联交易，发行人控股股东及其他持股 5%以上的股东出具承诺如下：

1、发行人控股股东合肥建投就规范并减少关联交易事宜出具承诺如下：

“（1）本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将尽量减少与晶合集成及其控股子公司的关联交易。

（2）对于与晶合集成经营活动相关的且无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件中关于关联交易的相关要求，履行晶合集成公司章程中关联交易决策程序，按照公平合理的原则确定关联交易价格，并依法履行信息披露义务。

（3）本公司保证将依照有关适用的法律、法规、规范性文件、晶合集成的公司章程及相关制度行使相应权利，承担相应义务，不会利用控股股东地位谋求晶合集成及其控股子公司在业务经营等方面给予本公司及本公司直接或间接控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益，不利用关联交易非法转移晶合集成及其控股子公司的资金、利润，保证不通过关联交易损害晶合集成及其无关联关系股东的合法权益。

（4）如违反上述承诺，本公司愿意承担由此给晶合集成造成的实际损失。”

2、发行人控股股东的一致行动人合肥芯屏就规范并减少关联交易事宜出具承诺如下：

“（1）本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将尽量减少与晶合集成及其控股子公司的关联交易。

（2）对于与晶合集成经营活动相关的且无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件中关于关联交易的相关要求，履行晶合集成公司章程中关联交易决策程序，按照公平合理的原则确定关联交易价格，并依法履行信息披露义务。

（3）本企业保证将依照有关适用的法律、法规、规范性文件、晶合集成的公司章程及相关制度行使相应权利，承担相应义务，不会利用控股股东一致行动人的地位谋求晶合集成及其控股子公司在业务经营等方面给予本企业及本企业直接或间接控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益，不利用关联交易非法转移晶合集成及其控股子公司的资金、利润，保证不通过关联交易损害晶合集成及其无关联关系股东的合法权益。

(4) 如违反上述承诺，本企业愿意承担由此给晶合集成造成的实际损失。”

3、其他持股 5%以上的股东出具的承诺

其他单独或合计持有发行人 5%以上股份的股东力晶科技、美的创新就规范并减少关联交易事宜出具承诺如下：

“（1）本公司及本公司直接或间接控制的公司将尽量减少与晶合集成及其控股子公司的关联交易。

（2）对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司直接或间接控制的公司将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本公司保证不通过关联交易损害晶合集成除本公司之外的其他股东的合法权益。

（3）保证将依照有关法律、法规、规范性文件、晶合集成章程和相关制度行使相应权利，承担相应义务，不利用股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移晶合集成及其控股子公司的资金、利润，保证不利用关联交易损害晶合集成除本公司之外的其他股东的合法权益。

（4）如违反上述承诺，本公司愿意承担由此给公司造成的全部损失。”

（五）同业竞争

1、发行人控股股东及其控制的其他企业

发行人控股股东及其控制的其他企业的基本情况详见本法律意见书“六、发起人和股东”之“（五）发行人的控股股东及实际控制人”以及本法律意见书“九、关联交易及同业竞争”之“（一）关联方”。

截至本法律意见书出具日，发行人从事 12 英寸晶圆代工业务。根据合肥建投提供的对外投资企业清单并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统、天眼查网站等方式进行核查，合肥建投除投资发行人外，未控制其他从事晶圆代工业务的公司，合肥建投及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争。

（六）避免同业竞争的承诺或措施

为了避免未来可能发生的同业竞争情况，合肥建投及合肥芯屏已分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：

1、本企业目前一直公允地对待本企业直接或间接控制的其他企业，将来也不会利用控股股东（及其一致行动人）的地位谋求不正当利益或作出不利于晶合集成而有利于其他下属企业的任何决定，不会损害晶合集成及其他股东的合法权益。因违反本承诺函的任何条款而导致晶合集成及其控股子公司遭受的一切损失、损害和开支，本企业将予以赔偿。

2、本企业及本企业直接或间接控制的其他企业，目前不存在、将来也不会在中国境内外，以任何方式直接或间接从事与晶合集成及其控股子公司所从事的主营业务相同或相似业务的情形。

3、如果本企业及本企业直接或间接控制的其他企业从事了与晶合集成业务相同或相似的业务，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将愿意以公平合理的价格将构成竞争业务有关的资产或股权（若有）转让给晶合集成或其控股子公司，晶合集成享有优先受让上述资产或股权的权利。若晶合集成因任何原因决定不行使前述优先受让的权利，应及时通知本企业，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将停止该等业务，或转让该等资产或股权直至不再控制。

4、如果本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将来可能存在任何与晶合集成业务产生竞争的业务机会，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将通知晶合集成并尽力促使该业务机会首先提供给晶合集成或其控股子公司，晶合集成或其控股子公司享有优先获取上述业务的权利。若晶合集成或其控股子公司因任何原因决定不行使前述优先获取的权利，应及时通知本企业；本企业直接或间接控制的其他企业应确保不会导致与晶合集成产生同业竞争。

5、本企业及本企业直接或间接控制的其他企业不向晶合集成业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供与晶合集成业务有关之专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

6、本企业保证将严格遵循相关法律法规和上海证券交易所及中国证监会的要求，确保晶合集成按照上市公司的规范独立自主经营，保证晶合集成的资产、业务、财务、人员、机构独立。

7、上述承诺于本企业作为晶合集成的控股股东（及其一致行动人）期间内持续有效。

（七）发行人对关联交易及同业竞争事项的披露

根据发行人的书面说明，并经本所律师核查，发行人已在《招股说明书（申报稿）》中对有关减少和规范关联交易的措施及避免同业竞争的承诺进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

十、发行人的主要财产

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有或使用的主要财产情况如下：

（一）土地使用权及房屋所有权

1、自有物业

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人无自有物业。

2、租赁物业

经发行人确认并经本所律师核查发行人及其子公司的租赁协议及租赁物业产权证明，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司承租用于办公、生产经营的房产共计 3 处，面积合计约 215,654.47 平方米。上述租赁房产及土地使用权的具体情况，详见《律师工作报告》“十、发行人的主要财产”之“（一）土地使用权及房屋所有权”。

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人不存在租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产的情形。

（二）在建工程

根据《审计报告》《招股说明书（申报稿）》以及发行人书面说明，截至本法律意见书出具日，发行人的在建工程主要为公司新购置待安装机台设备。截至 2020 年 12 月 31 日，发行人在建工程的账面余额为 139,070.50 万元。

（三）知识产权

1、商标

根据发行人提供的《商标注册证》等相关文件、商标注册代理机构出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于中国境外注册商标相关事宜的确认函》、国家工商行政管理总局商标局查册结果并查询中国商标网（<http://sbj.cnipa.gov.cn>），并经本所律师核查，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司共拥有 93 项注册商标，其中，在中国境内注册的商标 17 项，在中国境外注册的商标 76 项。该等商标的具体情况详见《律师工作报告》“十、发行人的主要财产”之“（三）知识产权”。

2、专利

根据发行人提供的专利证书等相关文件、专利注册代理机构出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于中国境外注册专利相关事宜的确认函》、国家知识产权局查册结果并查询国家知识产权局综合服务平台专利检索及分析系统（<http://pss-system.cnipa.gov.cn>），并经本所律师核查，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司在中国境内共拥有 54 项已授权专利，在中国境外共拥有 44 项已授权专利。该等专利注册的具体情况详见《律师工作报告》“十、发行人的主要财产”之“（三）知识产权”。

3、互联网域名

截至 2020 年 12 月 31 日，根据发行人提供的域名证书，并经本所律师核查工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统（<http://beian.miit.gov.cn>），发行人及其子公司合法拥有 1 项注册域名。该等域名的具体情况如下：

序号	注册域名	注册所有人	注册日期	到期日期
1	nexchip.com.cn	晶合集成	2015 年 9 月 16 日	2023 年 9 月 16 日

4、发行人使用的授权许可知识产权（IP）

截至 2020 年 12 月 31 日，公司正在使用的授权许可知识产权（IP）情况详见《律师工作报告》“十、发行人的主要财产”之“（三）知识产权”。

（四）主要生产经营设备

根据《审计报告》、重大生产经营设备的购置合同、履行凭证及发行人说明，发行人的主要生产经营设备包括机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等。截至 2020 年 12 月 31 日，机器设备的账面价值为 608,864.61 万元、电子设备及其他的账面价值为 3,347.06 万元、运输工具的账面价值为 0.21 万元。

（五）发行人的子公司

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人在中国境内拥有 2 家控股子公司及 1 家分支机构，在中国境外拥有 1 家控股子公司。具体情况详见《律师工作报告》“十、发行人的主要财产”之“（五）发行人的子公司”。

（六）主要财产所有权或使用权的受限制情况

根据发行人提供的相关债权合同、担保合同、发行人说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，除本法律意见书“九、关联交易及同业竞争”之“（二）关联交易”之“4、关联担保情况”所述发行人向合肥建投提供的反担保外，发行人及其子公司拥有的主要财产所有权或使用权不存在担保或其他权利受到限制的情况。

十一、发行人的重大债权债务

（一）经本所律师核查，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司签署的对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同包括销售合同、采购合同、借款合同以及入区协议、一厂厂房租赁协议、90nm 项目技术协议、二厂厂务设施租赁及收购意向协议、合作框架协议以及授权使用 IP 相关协议，具体情况详见《律师工作报告》“十一、发行人的重大债权债务”。

(二) 上述适用中国法律的重大合同内容和形式不违反中国法律、行政法规的禁止性规定，发行人及其子公司作为上述适用中国法律的重大合同的主体，继续履行该等合同不存在实质性法律障碍。

(三) 根据发行人说明、相关工商行政管理部门、人事劳动社会保障部门、税务部门等出具的证明，经本所律师在发行人及其子公司相关主管部门政府网站核查，发行人及其子公司报告期内没有因知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

(四) 根据《审计报告》并经本所律师核查，截至报告期末，除本法律意见书“九、关联交易及同业竞争”及“十一、发行人的重大债权债务”所述之外，发行人与其关联方之间不存在其他重大债权债务关系，亦不存在其他相互提供担保的情况。

(五) 报告期内，发行人金额较大的应收款、应付款是因正常的经营及投资活动发生，合法有效。

十二、发行人重大资产变化及收购兼并

(一) 发行人的增资扩股及减资

发行人自设立以来历次增资扩股及减资情况详见《律师工作报告》“七、发行人的股本及其演变”。经本所律师核查，发行人的历次增资扩股及减资符合当时中国法律、法规和规范性文件的规定，已经履行了必要的中国法律手续。

(二) 发行人重大资产收购/出售

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，发行人报告期内无重大资产收购或出售。

(三) 发行人拟进行的重大资产出售/收购

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人没有拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等计划或安排。

十三、发行人公司章程的制定与修改

《公司章程》系晶合有限整体变更为发行人时制定的公司章程，经 2020 年 11 月 20 日召开的发行人创立大会审议通过，《公司章程》已报合肥市市监局备案。发行人及其前身晶合有限最近三年对公司章程的修订详见《律师工作报告》“十三、发行人公司章程的制定与修改”。

经本所律师核查，发行人公司章程的制定及最近三年的历次修订已经履行了必要的法定程序，其内容符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

为本次发行上市之目的，发行人已按照《公司法》《上市公司章程指引》及其他有关规定制定了《发行人章程》，《发行人章程》已获发行人 2020 年年度股东大会审议通过，自发行人完成首次公开发行 A 股股票并在科创板上市之日起生效。经本所律师核查，《发行人章程》的内容符合《公司法》等现行法律、法规和规范性文件的规定。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人的组织机构

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人已设置股东大会、董事会、监事会，选举了公司董事（包括独立董事）、监事（包括职工代表监事），并聘请了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员；董事会由独立董事和非独立董事组成，独立董事人数占全体董事人数不少于三分之一；董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，发行人具有健全的组织机构。

（二）发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则

经本所律师核查，发行人根据《公司法》并参照《上市公司股东大会规则》等规定，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《战略委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《关联交易实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等制度。

本所认为，该等议事规则及公司治理制度符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人历次股东大会、董事会、监事会会议的召开情况

1、股东大会会议

自发行人整体变更为股份有限公司至本法律意见书出具日，发行人共召开了 2 次股东大会会议，其主要情况如下：

序号	股东大会会议名称	会议日期
1	创立大会	2020年11月20日
2	2020年年度股东大会	2021年3月16日

2、董事会会议

自发行人整体变更为股份有限公司至本法律意见书出具日，发行人共召开了 4 次董事会会议，其主要情况如下：

序号	董事会会议名称	会议日期
1	第一届董事会第一次会议	2020年11月20日
2	第一届董事会第二次会议	2020年12月25日
3	第一届董事会第三次会议	2021年2月9日
4	第一届董事会第四次会议	2021年3月5日

3、监事会会议

自发行人整体变更为股份有限公司至本法律意见书出具日，发行人共召开了 2 次监事会会议，其主要情况如下：

序号	监事会会议名称	会议日期
1	第一届监事会第一次会议	2020年11月20日
2	第一届监事会第二次会议	2021年2月9日

经本所律师核查上述会议的召开通知、会议议案、会议决议、会议记录等文件资料，本所认为，发行人上述历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

（四）发行人股东大会、董事会历次授权或重大决策

根据发行人提供的股东大会、董事会会议决议、会议记录等文件资料，并经本所律师核查，本所认为，发行人股东大会、董事会做出历次授权或重大决策行为，均符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及公司其他现行有效的内部规章制度所规定的股东大会或董事会的职权范围，该等授权或重大决策行为合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化的具体情况，详见《律师工作报告》“十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”。

经本所律师核查，发行人的董事、监事、高级管理人员的任职符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。发行人董事、高级管理人员的上述变化符合法律法规及当时有效的公司章程的有关规定，并已履行必要的法律程序。发行人董事、高级管理人员、核心技术人员最近两年内没有发生重大不利变化，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。除陈绍亨、BEICHAO ZHANG（张北超）尚待取得独立董事资格证书并完成上交所科创板独立董事视频课程学习外，发行人的独立董事任职资格、职权范围符合法律、法规、规范性文件、中国证监会的有关规定及《发行人章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定。

十六、发行人的税务

（一）税务登记及税种、税率

根据《审计报告》《主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》及发行人书面确认，并经本所律师核查，发行人及其境内子公司报告期内执行的主要税种及税率情况，详见《律师工作报告》“十六、发行人的税务”。

本所认为，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其境内子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

（二）税收优惠

发行人及其境内子公司报告期内享受的主要税收优惠的具体情况，详见《律师工作报告》“十六、发行人的税务”。

本所认为，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其境内子公司享受的税收优惠合法、合规，不存在税收优惠到期的情形。

（三）政府补贴

根据《审计报告》、发行人说明并经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度获得的与资产相关的政府补助分别为 33,318,547.22 元、47,527,511.10 元及 62,053,047.60 元；与收益相关的政府补助为 18,760,685.60 元、29,542,567.16 元及 30,007,536.30 元。

本所认为，发行人及其境内控股子公司在报告期内享受的主要政府补贴合法、合规。

（四）税务合规证明

2021 年 2 月 3 日，国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局向晶合集成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经征管系统查询，该纳税人自 2018 年 1 月 1 日以来，按时申报缴纳各项税费款，未发现欠缴税费款，未发现税收违法行为不良记录及因违反税收相关法律法规和规范性文件规定受到行政处罚。”

2021 年 2 月 3 日，国家税务总局南京市栖霞区税务局向南京晶驱出具《涉税信息查询结果告知书》，“该公司自 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 1 月 31 日经税务征管系统查询能够按时申报纳税，未发现其有偷税漏税情况及违规情况。”

2021 年 1 月 6 日，国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所（办税服务厅）向北京晶芯成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经查询，晶芯成（北京）科技有限公司为我局登记户，该单位于 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日在我局无缴纳税款。根据税务核心系统记载，该企业在此期间未接受过行政处罚。”

2021年2月25日，国家税务总局上海市浦东新区税务局向上海晶合出具《税务证明》，“在2019年12月1日至2020年12月31日期间，能按税法的规定按期办理纳税申报，暂未发现有欠税、偷逃税款和重大违反税收管理法规的情形。”

（五）税务处罚

报告期内，发行人及其境内子公司不存在税务处罚。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）环境保护

根据发行人说明及其提供的文件，截至本法律意见书出具日，北京晶芯成、南京晶驱无实际经营，日本晶合不从事生产，不涉及环保相关事项。发行人环保实施情况详见《律师工作报告》“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”之“（一）环境保护”。

经核查，发行人主要环保设施运行正常，环保相关成本费用与处理公司生产经营所产生的污染总体上相匹配；发行人生产经营符合国家和地方产业政策和环保规定，符合相关主管部门的要求；发行人已建项目履行了环评手续，报告期内未发生过环境污染事故，也未因环境违法行为受到环保行政处罚或立案调查。本所认为，发行人的经营情况总体符合国家和地方环保要求。

（二）产品质量和技术监督标准

根据发行人书面说明，截至本法律意见书出具日，北京晶芯成、南京晶驱无实际经营，日本晶合不从事生产，不涉及产品质量和技术监督标准相关事项。根据发行人书面说明，并经本所律师登录安徽省市场监督管理局网站（<http://amr.ah.gov.cn>）、合肥市市场监督管理局网站（<http://amr.hefei.gov.cn>）查询，发行人及其子公司最近三年没有因违反国家、地方有关质量、技术监督方面的规定而被质量技术监督部门处罚的情形。

（三）安全生产

根据发行人书面说明，截至本法律意见书出具日，北京晶芯成、南京晶驱无实际经营，日本晶合不从事生产，不涉及安全生产相关事项。发行人安全生产合规情况如下：

2021年1月15日，合肥市新站高新技术产业开发区应急管理局出具《关于合肥晶合集成电路股份有限公司安全生产有关情况的证明》，“自2018年1月1日至今，我局未发现合肥晶合集成电路股份有限公司在合肥新站高新技术产业开发区发生重大安全生产事故，也未因违反安全生产法律法规而受到我局安全生产行政处罚。”

根据上述安全生产监督管理部门出具的证明、发行人书面确认并经本所律师核查，发行人及其子公司的生产经营符合安全生产监督管理要求，最近三年未发生过安全生产事故，未受过安全生产方面的行政处罚。

十八、发行人的劳动及社会保障

（一）劳动及社会保险

1、劳动合同

根据发行人提供的《劳动合同》模板，并经本所律师抽样核查发行人与员工签署的《劳动合同》，该等劳动合同的内容、形式符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的要求。

2、社会保险缴纳情况

根据发行人提供的社保缴纳凭证及其说明，报告期内，发行人及其境内子公司为员工缴纳社会保险的具体情况，详见《律师工作报告》“十八、发行人的劳动及社会保障”。

报告期内，发行人及其境内子公司未为全部员工缴纳社会保险的原因主要为：1）存在个别当月社会保险扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳社会保险；2）在境内任职的中国台湾籍员工按照台湾地区法规缴纳了劳健保；3）在境内任职的外籍员工未缴纳社会保险。

2021年1月7日，合肥市人力资源和社会保障局出具证明：经核实，晶合集成依法足额缴纳各项社会保险费，自2018年1月1日至2021年1月7日未发现劳动用工违法行为，无人力资源社会保障行政部门处罚的不良记录。

（二）住房公积金缴纳情况

报告期内，发行人及其境内子公司未为全部员工缴纳住房公积金的原因主要为：

1) 存在个别当月住房公积金扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳住房公积金；2) 在境内任职的中国台湾籍、外籍员工未缴纳住房公积金。

2021年1月8日，合肥市住房公积金管理中心出具证明：晶合集成自2016年7月在我中心开户缴存职工住房公积金，该公司住房公积金缴存正常，未发现违反住房公积金相关法律法规的行为，公司未因住房公积金问题而受到行政处罚。

（三）劳务派遣及劳务外包

1、劳务派遣

报告期内，发行人及其子公司不存在劳务派遣用工。

2、劳务外包

报告期内，发行人劳务外包主要为保安、保洁、物业、搬运等生产经营中辅助性工作，各年度劳务外包费用占发行人管理费用的比例较低，发行人不存在将主要生产经营活动交由劳务外包公司实施的情况。

十九、发行人募集资金的运用

2021年3月16日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于合肥晶合集成电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》《关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》，公司拟公开发行不超过501,533,789股人民币普通股（行使超额配售选择权前），实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

单位：亿元

序号	实施主体	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	发行人	12英寸晶圆制造二厂项目	165	120

发行人“12英寸晶圆制造二厂项目”的实施地点为安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号，位于发行人厂区范围内，募投项目实施相关厂房系向合肥蓝科租赁，合肥蓝科已取得相关房屋的不动产权证，具体情况如《律师工作报告》“十、发行人的主要财产”之“（一）土地使用权及房屋所有权”所述。

发行人“12英寸晶圆制造二厂项目”已向相关部门申请备案，备案完成后可向环保主管部门申请办理环评相关审批手续。

本所认为，发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、投资项目管理、环境保护、土地管理及其他法律、行政法规和规章的规定。

二十、发行人业务发展目标

（一）发行人业务发展目标与主营业务的一致性

根据《招股说明书（申报稿）》及发行人出具的书面说明，发行人的发展战略为：

在当前的国内行业上下游仍高度依赖进口的背景下，发行人将抓住5G、AI、物联网等市场机遇，提升晶圆制造环节的本土企业市场影响力，实现国内显示驱动芯片、微处理器、CMOS图像传感器等集成电路产品的自主可控供应，进一步提高集成电路行业的国产化水平。

未来，公司将不断依托核心优势、提升专业技术水平，整合行业及客户资源，发挥管理团队和技术团队能动性，进一步向兼顾晶圆代工产品和设计服务能力的综合性晶圆制造企业发展，逐步形成显示驱动、图像传感、微控制器、电源管理四大集成电路特色工艺应用产品线，矢志成为全球第一的面板驱动晶圆代工厂，矢志成为中国卓越的集成电路专业制造公司。

本所认为，发行人的业务发展目标与其主营业务一致。

（二）发行人业务发展目标的合法性

经本所律师核查，本所认为，发行人在《招股说明书（申报稿）》中所述的业务发展目标符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十一、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）发行人及其下属公司

经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/>）、信用中国网（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、人民法院公告网（<http://rmfygg.court.gov.cn/>）、中国检察网（[http://www.12309.gov.cn/ajxxgk.jcy.gov.cn/12309/index.shtml](http://www.12309.gov.cn/ajxxgk/jcy.gov.cn/12309/index.shtml)）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>），访谈发行人董事、监事和高级管理人员并根据发行人书面确认，截至2020年12月31日，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚。

（二）持有发行人5%以上股份的股东

根据持有发行人5%以上股份的主要股东填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》、持有发行人5%以上股份的主要股东出具的承诺函、境外法律意见书，并经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/>）、信用中国网（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、人民法院公告网（<http://rmfygg.court.gov.cn/>）、中国检察网（[http://www.12309.gov.cn/ajxxgk.jcy.gov.cn/12309/index.shtml](http://www.12309.gov.cn/ajxxgk/jcy.gov.cn/12309/index.shtml)）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，截至2020年12

月 31 日，持有发行人 5% 以上股份的主要股东不存在对晶合集成产生影响的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

根据发行人董事、监事、高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》、核心技术人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司核心技术人员调查表》，中国证监会安徽监管局诚信信息查询结果，并经本所律师查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、人民法院公告网（<http://rmfygg.court.gov.cn/>）等网站，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

二十二、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施

（一）发行人及其控股股东等责任主体相关承诺的合法性

根据发行人及其控股股东等责任主体签署的相关承诺函并经本所律师核查，发行人及其控股股东等责任主体就本次发行上市涉及的相关事宜作出的主要承诺如下：

序号	承诺事项	承诺方
1	关于所持股份锁定期	发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		持有发行人5%以上股份的股东力晶科技、美的创新
		持有发行人不足5%股份的股东
		持有发行人股份的董事、高级管理人员，以及核心技术人员
2	关于持股意向及减持意向	发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		持有发行人5%以上股份的股东力晶科技、美的创新
3	关于上市后三年内稳定公司股价措施	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		董事（不含独立董事）及高级管理人员
4	股份回购和股份购回的措施和承诺	发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
5	对欺诈发行上市的股份购回承	发行人

序号	承诺事项	承诺方
	诺	发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
6	关于摊薄即期回报填补措施	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		全体董事、高级管理人员
7	关于依法承担赔偿责任或赔偿责任	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
8	关于避免同业竞争	发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		全体董事、监事、高级管理人员
9	关于规范并减少关联交易	发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		持有发行人5%以上股份的股东力晶科技、美的创新
		全体董事、监事、高级管理人员
10	关于未履行承诺事项的约束措施	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		持有发行人5%以上股份的股东力晶科技、美的创新
		全体董事、监事、高级管理人员，以及核心技术人员
11	关于避免资金占用和违规担保	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
12	关于诉讼/仲裁事项及行政处罚事项	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		持有发行人5%以上股份的股东力晶科技、美的创新
13	关于缴纳社保及公积金	发行人
14	关于不存在违规情形的承诺函	全体董事、监事、高级管理人员
15	关于申请文件真实、准确、完整	发行人
		全体董事、监事、高级管理人员
16	关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		全体董事、监事、高级管理人员
17	股东信息披露专项承诺	发行人
18	力晶科技出具的其他承诺	持有发行人5%以上股份的股东力晶科技

经本所律师核查，本次发行上市涉及的相关责任主体作出的主要承诺文件已经相关责任主体或其授权代表签署，相关承诺合法合规。

（二）发行人及其控股股东等责任主体未履行相关承诺的约束措施的合法性

经本所律师核查，上述对于未履行相关承诺的约束措施已经发行人及其控股股东等相关责任主体签署，内容合法、合规，符合《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》对相关责任主体作出公开承诺事项应同时提出未履行承诺时的约束措施的相关要求。

同时，发行人已就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了摊薄即期回报的填补措施。发行人及其董事、高级管理人员、控股股东已根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，就确保发行人填补回报措施的切实履行作出了承诺。发行人第一届董事会第三次会议已将摊薄即期回报分析、填补即期回报措施及上述相关承诺主体的承诺等事项形成议案，由发行人2020年年度股东大会审议通过。

二十三、发行人《招股说明书（申报稿）》法律风险的评价

本所律师已参与《招股说明书（申报稿）》的编制和讨论，已审阅了《招股说明书（申报稿）》，并特别审阅了其中引用本法律意见书和《律师工作报告》的相关内容。本所认为，《招股说明书（申报稿）》引用本法律意见书和《律师工作报告》相关内容与本法律意见书和《律师工作报告》无矛盾之处。本所对《招股说明书（申报稿）》中引用本法律意见书和《律师工作报告》的相关内容无异议，确认《招股说明书（申报稿）》不致因引用本法律意见书和《律师工作报告》的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十四、关于本次发行上市的总体结论性意见

综上所述，本所认为，发行人符合《证券法》《公司法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的各项条件，不存在重大违法违规行为。本所对发行人《招股说明书（申报稿）》中引用本法律意见书和《律师工作报告》的相关内容无异议，确认《招股说明书（申报稿）》不致因引

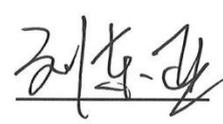
用本法律意见书和《律师工作报告》的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人本次发行尚待获得上交所审核同意并报经中国证监会注册，本次发行完成后，经上交所审核同意，发行人股票可于上交所科创板上市交易。

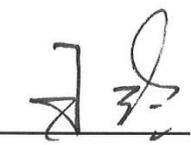
（本页以下无正文，下接签章页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》之签章页)



经办律师： 
苏 峥


刘东亚

单位负责人： 
王 玲

二〇二一年四月二十五日

北京市金杜律师事务所
关于合肥晶合集成电路股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
补充法律意见书（一）

致：合肥晶合集成电路股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“发行人”）委托，担任发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已于2021年4月26日出具《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）。

鉴于上交所于2021年6月6日下发《关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公

开发股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）[2021]308号）（以下简称“《问询函》”），本所现根据《问询函》的要求，就其中所涉及的法律问题进行核查，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对本所已出具的《法律意见书》《律师工作报告》的补充，并构成《法律意见书》《律师工作报告》不可分割的组成部分；本所在《法律意见书》《律师工作报告》中对相关用语的释义、缩写适用于本补充法律意见书；本所在《法律意见书》《律师工作报告》中发表法律意见的引言、前提和假设同样适用于本补充法律意见书。对于本补充法律意见书特别说明的事项，以本补充法律意见书的说明为准。

在本补充法律意见书中，本所仅就与发行人本次发行上市有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。本所不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项及境外法律事项发表意见，在本补充法律意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告、验资报告及境外法律意见等某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所不具备核查和评价该等数据的适当资格。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市制作的《招股说明书（申报稿）》中自行引用或按照中国证监会、上交所的审核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，根据有关法律、法规和中国证监会及上交所有关规定的要求，出具本补充法律意见书如下：

目录

一、《问询函》第 1 题：关于实际控制人认定.....	4
二、《问询函》第 2 题：关于以专利技术使用权出资	20
三、《问询函》第 3 题：关于特殊权利条款	41
四、《问询函》第 4 题：关于第二大股东力晶科技从事同类型业务.....	44
五、《问询函》第 8 题：关于客户集中度	49
六、《问询函》第 11 题：关于技术来源和先进性.....	51
七、《问询函》第 12.1 题：委托经营管理.....	76
八、《问询函》第 12.2 题：委派管理人员.....	100
九、《问询函》第 12.3 题：向控股股东子公司租赁厂房及设施	115
十、《问询函》第 12.4 题：订单互补支持.....	126
十一、《问询函》第 12.5 题：社保缴纳情况	128
十二、《问询函》第 12.6 题	130
十三、《问询函》第 13 题：关于关联交易	131
十四、《问询函》第 14 题：关于存在累计未弥补亏损	136
十五、《问询函》第 22 题：关于信息披露豁免.....	140
十六、《问询函》第 24 题：关于募投项目	141
十七、《问询函》第 25 题：关于股东核查情况.....	143

一、《问询函》第 1 题：关于实际控制人认定

根据申报材料：（1）发行人控股股东为合肥建投，直接持有发行人 31.14%的股份，并通过合肥芯屏控制发行人 21.85%的股份，合计控制发行人 52.99%的股份，系发行人的控股股东。发行人实际控制人为合肥市国资委，直接持有合肥建投 100%的股权。（2）2015 年 10 月，公司与第二大股东力晶科技签订《委托经营管理合约》，约定公司委托力晶科技进行经营管理。根据保荐工作报告，2019 年 12 月以前，发行人最高权力机构董事会，有 9 名董事。公司章程规定重大经营、财务、人事事项需 2/3 董事同意。而合肥建投占 5 席，未达 2/3。（3）目前，公司董事长蔡国智的提名人为力晶科技。

请发行人披露合肥建投能够控制合肥芯屏的原因。

请发行人说明：（1）委托经营管理合约终止前，合肥市国资委在发行人生产经营、重大事项决策和日常经营管理等方面发挥的作用；（2）委托经营管理合约终止前后公司实际控制人认定情况；（3）力晶科技是否将发行人并入合并报表；（4）结合公司报告期内股东（大）会、董事会表决情况，董监高及重要岗位的提名任免，重大事项决策机制，委托经营管理及执行情况，2019 年 12 月以前合肥建投占董事会席位未达 2/3 等，说明报告期内实际控制人认定情况，充分论证发行人最近两年实际控制人是否发生变更。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见，请申报会计师对上述事项（3）进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）请发行人披露合肥建投能够控制合肥芯屏的原因

1、合肥建投资本管理有限公司对合肥芯屏具有控制力

根据合肥芯屏持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，截至本补充法律意见书出具日，合肥芯屏的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	合肥建投资本管理有限公司（以下简称建投资本）	普通合伙人	1,000.00	0.04
2	合肥建投	有限合伙人	1,159,000.00	47.44
3	合肥瀚和投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,033,125.00	42.29
4	合肥瀚屏投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	250,000.00	10.23
合计		-	2,443,125.00	100.00

根据合肥芯屏的合伙协议，普通合伙人建投资本为执行事务合伙人，有限合伙人
不执行合伙事务；合肥芯屏设立投资决策委员会，5名委员均由执行事务合伙人委派，
投资决策委员会负责合伙企业投资项目决策。建投资本作为合肥芯屏的执行事务合
伙人对外代表合伙企业、执行合伙事务，并通过委派投资决策委员会委员能够控制合
肥芯屏投资项目决策。因此，建投资本对合肥芯屏具有控制力。

2、合肥建投对建投资本具有控制力

根据建投资本持有的《营业执照》、现行有效的《公司章程》，截至本补充法律
意见书出具日，建投资本的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投	7,083.00	70.83
2	合肥德轩投资管理有限公司	2,917.00	29.17
合计		10,000.00	100.00

根据建投资本的《公司章程》，股东会是公司的最高权力机构，股东会对公司增
加或者减少注册资本、分立、合并、修改章程、解散或者变更公司形式等重大事项作
出决议必须经全体股东通过，其他事项必须经代表 1/2 以上表决权的股东通过；建
投资本设董事会，由 5 名董事组成，董事人选由股东推荐，其中合肥建投推荐 4 名，合
肥德轩投资管理有限公司推荐 1 名，董事会对相关事项作出决议，必须经全体董事
2/3 以上同意通过。合肥建投持有建投资本 70.83%的股权，是建投资本的控股股东，

且合肥建投推荐的董事占建投资本全体董事的 2/3 以上。因此，合肥建投对建投资本具有控制力。

综上所述，合肥建投通过建投资本能够控制合肥芯屏。

（二）委托经营管理合约终止前，合肥市国资委在发行人生产经营、重大事项决策和日常经营管理等方面发挥的作用

1、公司设立背景及定位

随着电子信息产业的高速发展，我国已成为全球最大的集成电路市场，但集成电路高端制造技术欠缺、晶圆制造产能仍有较大缺口，特别是门槛较高的 12 英寸集成电路制造能力仍较为薄弱，导致集成电路产品对外依赖度较高。2014 年 6 月，国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，将集成电路产业发展上升到国家战略层面，纲要指出：“集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业”，要求“加速发展集成电路制造业。以生产线建设带动关键装备和材料配套发展”。

作为国家级科技创新型试点城市，合肥市政府制定了集成电路产业发展规划，并结合自身特色，提出了“芯屏器合”的产业发展战略，其中，“芯”指芯片产业，“屏”指新型显示产业，“器”指装备制造和机器人等产业，“合”指人工智能和制造业融合为代表的新兴产业等。2015 年，合肥市新型显示产业已形成规模，京东方 6 代线、8.5 代线已投产，10.5 代线项目即将开工建设，但芯片产业仍处于起步初期。合肥市拟引进国际知名企业合作设立晶圆代工厂，利用合肥市新型显示产业的协同效应，以显示驱动芯片为切入点，通过面板显示等终端应用带动芯片产业发展，建设自主可控的芯片制造能力。

为落实国家集成电路产业发展战略和合肥市集成电路产业发展规划，2015 年 4 月，合肥市政府与力晶科技签署《12 吋晶圆制造基地项目合作框架协议书》（以下简称“《合作框架协议》”），与力晶科技合作 12 英寸晶圆制造基地项目并由合肥建投设立晶合有限作为项目公司。发行人主营业务为 12 英寸晶圆代工业务，是芯片制造的关键环节之一。发行人设立初期所代工产品的主要应用领域为面板显示驱动芯片领域，配套服务于新型显示产业。

2、合肥市国资委在发行人生产经营、重大事项决策和日常经营管理等方面发挥的作用

(1) 合肥市国资委与合肥建投的基本情况 & 定位

合肥市国资委系合肥市政府直属特设机构，受合肥市政府委托，代表合肥市政府履行出资人职责，对全市国有（集体）企业、授权的事业单位进行国有资产监督管理，主要职责包括：履行出资人职责，监督市属政府委托授权单位的国有资产；承担监督所监管单位国有资产的保值增值的责任；参与指导监管单位的投资、融资工作；通过法定程序对所监管单位负责人进行任免；代表市政府向所监管单位派出监事会；对监管范围内的国有资产进行预算管理等。根据《合肥市属国有企业投资管理办法》《合肥市市属国有企业功能界定与分类方案》《市国资委以管资本为主推进职能转变方案》等文件的规定，合肥市国资委对企业投资实行分类、分级监管，市属国有企业对其实际控制子公司进行类别界定；将延伸到子企业的管理事项，原则上归位于重点监管企业，将部分审批权限下放给企业集团，层层落实责任，确保国有资产保值增值。

合肥建投是经合肥市人民政府批准、合肥市国资委授权经营的国有独资公司，属于合肥市国资委重点监管企业。合肥建投的主要业务板块包括战略性新兴产业投资、工程建设、城市运营服务、乡村振兴和现代农业、商业百货、文旅博览等。在战略性新兴产业投资方面，合肥建投发挥国有资本投资运营公司的平台功能，推动京东方、维信诺、蔚来汽车、彩虹股份等项目在合肥落户投产。

(2) 合肥市国资委及合肥建投在发行人生产经营、重大事项决策和日常经营管理等方面发挥的作用

根据发行人提供的工商档案文件、发行人报告期内历次董事会、股东大会会议文件、发行人履行国资汇报、备案或审批程序的相关文件、《审计报告》以及发行人出具的说明等资料并本所律师核查，《委托经营管理合约》终止前，合肥市国资委、合肥建投在发行人生产经营、重大事项决策和日常经营管理等方面发挥的作用主要如下：

①合肥建投通过委派董事在董事会层面审议公司重大事项决策

《委托经营管理合约》终止前，公司最高权力机构为董事会。根据晶合有限当时

适用的公司章程，董事会行使的职权包括：决定合资公司的经营方针和投资计划；决定董事、监事报酬；审议批准合资公司年度财务预算方案、决算方案；审议批准合资公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对合资公司增加或减少注册资本作出决议；对合资公司进行股权、债券融资作出决议；决定董事会委员会的设置和组成，推选董事长；决定合资公司总经理的任免和报酬事项，并根据总经理的提名任命高级管理人员；决定聘请或解聘为合资公司审计的会计师事务所；对合资公司合并、分立、解散、清算或变更组织形式作出决议；修改合资公司章程及其他职权。

董事会作为晶合有限股改前的最高决策机构，决定晶合有限的年度经营总结及次年经营规划、签订重大合同、聘任高级管理人员、增加注册资本等一切重大事项。公司召开董事会会议前，相关议案需提交合肥建投先行内部审议，合肥建投审议通过后再由其委派的董事在董事会会议上进行表决。

因此，《委托经营管理合约》终止前，合肥建投通过委派董事在董事会层面审议公司重大事项决策。

②合肥建投通过委派高管对发行人日常经营进行监督和管理

公司日常经营计划由高级管理人员负责制定及执行。自 2016 年至股改前，公司部分高级管理人员由合肥建投委派并经公司董事会聘任，合肥建投委派高级管理人员的具体情况如下：

委派高管职务	委派期间	主要职责
总会计师	2016 年 3 月至 2020 年 3 月	总体负责公司财务方面各项工作，合肥建投通过委派总会计师对公司整体财务状况进行监督和管理
采购副总监	2016 年 4 月至 2020 年 4 月	参与公司采购流程、决策，合肥建投通过委派采购副总监对公司采购情况进行监督和管理
销售副总监	2016 年 4 月至 2020 年 3 月	参与公司销售流程、决策，合肥建投通过委派销售副总监对公司销售情况进行监督和管理
行政副总经理	2019 年 10 月至 2020 年 3 月	总体负责公司人事与总务等行政工作，合肥建投通过委派行政副总经理

	月	对公司行政事务进行监督和管理
审计师	2019年1月至2020年4月	总体负责公司内部审计工作，合肥建投通过委派审计师对公司内部控制进行监督
敬业促进委员会 委员长	2017年8月至2020年11月	规范公司员工行为、鼓励敬业服务，合肥建投通过委派敬业促进委员会委员长对公司员工行为及敬业情况进行了解

《委托经营管理合约》终止前，合肥建投曾向公司委派总会计师、采购副总监、销售副总监、行政副总经理、审计师、敬业促进委员会委员长等高级管理人员，涉及公司财务、采购、业务、行政等主要日常经营环节，通过委派高管对公司日常经营进行监督和管理。

③合肥市国资委、合肥建投按照国有控股企业对公司进行管理

发行人设立至今，合肥市国资委和合肥建投始终按照国有控股企业对公司进行管理，具体情况如下：

(A) 公司设立及产权变动

公司设立、历次股权变动、股改均按照《企业国有资产交易监督管理办法》等规定，履行了国有及国有控股企业相关的审批、资产评估及备案等程序。2021年4月，合肥市国资委出具《关于确认合肥晶合集成电路股份有限公司历史沿革中涉及国有股权变动事项合规性的函》，确认“晶合集成的设立、历次股权变动、股改等事项均履行了审批程序，符合国资监管的有关规定，不存在损害国有股东权益及造成国有资产流失的情形”。

(B) 关键岗位人员任命

2016年2月，力晶科技入股后，公司成立了董事会。公司董事长、总经理人选由合肥建投履行内部审核流程后，再由公司董事会进行聘任。

(C) 投资设立子公司、分公司

公司设立日本子公司、上海分公司，均按照《合肥市属国有企业投资管理暂行办法》中对于国有控股企业的相关规定，履行了国资审批程序，经合肥建投请示合肥市国资委批准同意后实施。

（D）确定重大采购招投标模式

公司在确定机台、设备等重大采购的采购方式时，均按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》《合肥市 2016 年公共资源集中交易目录》《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市 2016 年市级政府集中采购目录及限额标准的通知》中对于国有控股企业相关项目的规定，履行了国资审批程序，经合肥建投、合肥市公共资源交易监督管理局、合肥市政府审批后实施。

④合肥市国资委、合肥建投对发行人生产经营的支持

（A）向公司出租土地、厂房及配套设施

根据合肥市政府与力晶科技签署的《合作框架协议》，合肥市政府负责提供土地与厂房建设资金，并以租赁方式供发行人使用该等土地及厂房，租赁期限为全产能量产后 20 年，租期届满后若项目营运顺利，再以相同条件续租 10 年。合肥蓝科系合肥建投的全资子公司，依据前述《合作框架协议》投资建设了相关厂房、无尘室、厂务设施及配套设施，并租赁给公司。该等厂房系按照半导体行业生产标准进行定制化设计和建设，较难在市场租赁或购置第三方同类厂房，对发行人生产经营具有重要作用。

（B）在公司业务拓展方面提供支持

发行人直接客户为芯片设计公司，发行人所代工产品需在下游终端产品公司验证通过后才能进行量产。为加快发行人与客户建立合作，推动合肥市新型平板显示产业与集成电路产业协同发展，合肥建投积极协调京东方等终端产品公司，为发行人产品验证、业务拓展方面提供了支持。

（C）为公司提供借款及担保支持

晶圆代工行业属于资本密集型行业，产能扩充和持续研发都需要大量的资金投入。合肥建投作为控股股东，在公司资金紧张或有融资需求时提供支持。2018 年 4 月，合

肥建投通过中国银行合肥北城支行向公司提供 80,500.00 万元委托贷款，支持公司经营发展；2018 年 10 月，公司增资扩股后向合肥建投归还了上述委托贷款。此外，截至 2020 年 12 月 31 日，公司长期借款（含一年内到期的长期借款）均由合肥建投提供担保。除合肥建投外，力晶科技或其他股东均未向公司提供借款或担保等财务方面的支持。

综上所述，本所认为，委托经营管理合约终止前，合肥市国资委通过合肥建投在发行人生产经营、重大事项决策和日常经营管理等方面发挥了重要作用。

（三）委托经营管理合约终止前后公司实际控制人认定情况

《委托经营管理合约》终止前后，公司实际控制人均为合肥市国资委，具体认定情况如下：

1、在公司最高权力机构中占主导地位

公司股改前，最高权力机构为董事会，合肥市国资委通过合肥建投、合肥芯屏（以下合称“合肥国资方”）控制公司 50%以上的股权，委派的董事数量占公司董事会成员半数以上，且合肥国资方委派董事在发行人董事会中占实质主导地位。自 2016 年 3 月公司设立董事会至股改前，公司共计召开 33 次董事会，历次董事会会议上力晶科技委派董事均未对相关审议事项投反对票，仅发生 1 次力晶科技部分委派董事在董事会审议中弃权事宜，未发生因力晶科技委派董事单方面反对或弃权而无法形成决策的情形。

公司股改后，最高权力机构为股东大会，合肥国资方控制公司 50%以上的股份，提名的董事数量占公司董事会成员半数以上。

因此，《委托经营管理合约》终止前后，根据《上市规则》《上市公司收购管理办法》中关于实际控制人认定的相关标准，公司实际控制人均为合肥市国资委。

2、委派高级管理人员监督、管理公司日常经营

自 2016 年 3 月至 2020 年合肥建投向发行人委派高级管理人员，在财务、采购、业务、行政等主要日常经营环节进行监督和管理，详见本补充法律意见书第 1 题之

“（二）委托经营管理合约终止前，合肥市国资委在发行人生产经营、重大事项决策和日常经营管理等方面发挥的作用”以及第 12.2 题之“（一）委托经营管理合约终止前后合肥建投和力晶科技委派管理人员的具体情况及其主要考虑”的相关回复。

3、按照国有控股企业对公司进行管理

合肥市国资委、合肥建投对公司设立及产权变动、关键岗位人员任命、投资设立子公司及分公司、重大采购招投标等事项，均按照国有及国有控股企业相关规定进行管理，并履行了相关国资审批程序，详见本补充法律意见书第 1 题之“（二）委托经营管理合约终止前，合肥市国资委在发行人生产经营、重大事项决策和日常经营管理等方面发挥的作用”的相关回复。《委托经营管理合约》终止前后，合肥市国资委、合肥建投均按照国有及国有控股企业对公司进行管理，公司重要决策均在国资监管下进行。

4、提供公司生产经营所需土地、厂房

公司生产经营所使用的土地、厂房均租赁自合肥建投的全资子公司合肥蓝科，详见本补充法律意见书第 12.3 题之“向控股股东子公司租赁厂房及设施”的相关回复。《委托经营管理合约》终止前后，发行人均向合肥国资方租赁土地、厂房及配套设施等重要资产，对于公司生产经营具有重大影响。

5、公司未将经营管理权交予力晶科技

《委托经营管理合约》签订后，力晶科技仅履行了部分条款，公司未将经营管理权交予力晶科技。《委托经营管理合约》未对发行人日常经营及重大事项决策机制造成实质影响，发行人实际控制人认定情况未因此发生变化。详见本补充法律意见书第 12.1 题之“（一）《委托经营管理合约》签署的背景、主要内容、委托经营管理范围及具体方式，相关条款的具体执行情况，除《委托经营管理合约》及终止协议外，是否还存在其他对委托经营管理事项的约定”的相关回复。

6、主要股东对公司实际控制人认定予以确认

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》，在确定公司控制权归属时，应当本着实事求是的原则，尊重企业的实际情况，以发行人自身的认定为

主，由发行人股东予以确认。

根据合肥建投出具的确认函，自晶合集成成立以来，合肥建投一直系晶合集成的直接或间接控股股东，且不存在与力晶科技共同控制晶合集成的情形。

根据力晶科技出具的确认函，力晶科技充分认可合肥建投方的控股股东地位，对晶合集成重大决策战略方针、企业发展方向、经营决策、重大投资等具有决定性影响力，认可并尊重合肥市国资委作为晶合集成实际控制人的地位。力晶科技自入股以来未以任何形式谋求晶合集成的控制权，亦不存在与合肥市国资委共同控制晶合集成的情形。

综上所述，本所认为，《委托经营管理合约》终止前后，发行人的实际控制人均为合肥市国资委。

（四）力晶科技是否将发行人并入合并报表

根据力晶科技公开披露的 2016 年至 2020 年期间的年度报告，自 2016 年 2 月力晶科技入股公司至今，力晶科技均未将公司纳入合并报表范围，仅作为参股投资企业列示。

（五）结合公司报告期内股东（大）会、董事会表决情况，董监高及重要岗位的提名任免，重大事项决策机制，委托经营管理及执行情况，2019 年 12 月以前合肥建投占董事会席位未达 2/3 等，说明报告期内实际控制人认定情况，充分论证发行人最近两年实际控制人是否发生变更

1、报告期内股东大会表决情况

报告期初至股改前，公司最高权力机构为董事会；自 2020 年 11 月，公司整体变更为股份有限公司后，公司最高权力机构为股东大会，合肥国资方控制公司 50%以上的股份。

报告期内，发行人共召开 1 次股东大会，经全体股东同意，审议通过了《关于合肥晶合集成电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权办理首次公开发

行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2、报告期内董事会表决情况

报告期内，合肥国资方委派的董事数量占公司董事会成员半数以上，且合肥国资方委派董事在发行人董事会中占实质主导地位。公司召开董事会会议前，相关议案需提交合肥建投先行内部审议，合肥建投审议通过后再由其委派的董事在董事会会议上进行表决。报告期内，公司历次董事会会议上均未发生因力晶科技委派董事单方面反对或弃权而无法形成决策的情形。

3、董监高及重要岗位的提名任免情况

（1）董事的提名任免情况

报告期初至股改前，公司董事由双方股东委派并经公司董事会任命。股份公司成立后，公司董事由股东提名，股东大会选举产生。报告期内，合肥国资方委派或提名的董事数量均占多数。公司董事席位分布情况如下：

股东名称	2018年1月至2019年12月	2019年12月至2020年11月	2020年11月至2020年12月
合肥国资方	委派5名董事	委派6名董事	提名4名非独立董事、2名独立董事
力晶科技	委派4名董事	委派3名董事	提名2名非独立董事、1名独立董事

（2）监事的提名任免情况

报告期初至股改前，公司不设监事会，由双方股东各委派一名监事。股份公司成立后，公司设监事会，股东代表监事由股东提名，股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表选举产生。报告期内，公司监事席位分布情况如下：

股东名称	2018年1月至2020年11月	2020年11月至2020年12月
合肥国资方	委派1名监事	提名1名监事

股东名称	2018年1月至2020年11月	2020年11月至2020年12月
力晶科技	委派1名监事	提名1名监事
其他	-	职工代表大会选举产生1名监事

(3) 高级管理人员的提名任免情况

报告期初至股改前，公司部分高级管理人员岗位一直系董事会直接聘任、由公司员工任职，部分高级管理人员岗位最初由双方股东委派，逐步转化为董事会直接聘任、由公司员工任职。股份公司成立后，公司高级管理人员均由公司员工任职，由董事长、总经理提名，由董事会聘任。

报告期内，发行人的日常经营运作仍以发行人自身员工和合肥国资方委派高管为主导，发行人经营管理团队主要来源于发行人员工。报告期内。公司高级管理人员的具体变化情况如下：

序号	职能	职位	2018.1	2018.3	2018.5	2018.12	2019.3	2019.5	2019.10	2019.12	2020.3	2020.4	2020.6	2020.11	2020.12	
1	/	总经理	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	
2	营运	副总经理	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	未设置	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	
3		协理	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	公司员工	公司员工	未设置	未设置	未设置	公司员工
4	销售	总监/副总经理	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	未设置	未设置	未设置	公司员工	未设置	未设置	未设置	未设置
5		协理	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工
6		副总监	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	未设置	未设置	未设置	未设置
7	采购	总监/副总经理	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	未设置	未设置	
8		协理	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	公司员工	公司员工
9		副总监	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	未设置	未设置	未设置	未设置
10	研发	副总经理	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工
11		协理	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	未设置	未设置	未设置	未设置
12	财务	总会计师/副总经理	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工
13		副总会计师/协理	力晶科技	力晶科技	力晶科技	力晶科技	力晶科技	力晶科技	力晶科技	力晶科技	力晶科技	力晶科技	力晶科技	公司员工	公司员工	公司员工
14	内审	审计师	力晶科技	力晶科技	力晶科技	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	未设置	未设置	未设置	未设置
15	敬业监督	敬业促进委员会委员长	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	不再为高级管理人员	
16	行政	副总经理	力晶科技	力晶科技	未设置	未设置	未设置	未设置	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工
17	证券	董事会秘书	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工

4、重大事项决策机制

报告期初至股改前，公司最高权力机构为董事会，根据当时有效的《中外合资经营企业法》及其实施条例，合营企业章程的修改、合营企业的中止、解散、合并、分立以及注册资本的增加、减少等重大事项需要出席董事会会议的董事一致通过方可作出决议。自 2020 年 11 月，发行人整体变更为股份有限公司后，发行人最高权力机构为股东大会。

报告期内，公司最高权力机构对重大事项的决策机制如下：

期间	决议类型	审议内容
2018 年 1 月至 2020 年 11 月股改前	一般事项	除下述一致批准事项和特殊表决事项以外，其它一般事项根据在符合法定人数的董事会会议上以出席会议董事的简单多数票决定。
	一致批准事项	有关下列事项的董事会决议应由出席会议董事（本人或其书面委托的代理人）在按规定程序召开的董事会会议上一致投赞成票方可通过： (a) 合资公司公司《章程》的修改； (b) 合资公司的中止、解散； (c) 合资公司注册资本的增加、减少； (d) 合资公司的合并、分立； (e) 推选董事长和 CEO 的人事任免； (f) 合资公司公司《章程》《投资参股协议》《技术移转协议》中载明的其它事项。
	特殊表决事项	有关下列事项的董事会决议应有至少包括出席会议 2/3 的董事投赞成票方可通过： (a) 重大的经营事项：制定或改变合资公司中长期发展规划、经营方针、年度或季度经营计划、投资计划和方案；改变合资公司主营业务或合资公司公司名称；经营计划之外处置合资公司重要业务、资产或其控制权；设立分公司、子公司、对外投资；购置高档汽车或者房地产；选择 IPO 承销商和上市交易所；IPO 的估值、条款和条件。 (b) 重大的财务事项：合资公司季度和年度预算、决算；对

期间	决议类型	审议内容
		<p>财务制度或会计政策作出变更；聘请或变更会计师事务所；预算之外的借贷行为；预算之外的重大财务开支；宣布或支付股息、分配利润；减资或回购股份。</p> <p>(c) 重大的人事事项：总会计师、COO、CTO、副总经理及采购副总监、销售副总监以上高级管理人员的职数设立、人事任免及其薪酬待遇管理。</p> <p>(d) 其它重大事项：任何对外担保；任何关联交易；证券、期货或金融衍生产品投资；对第三方作出无限制的或超过一定金额的责任承诺。</p>
2020年11月股改后至2020年12月	普通决议	<p>普通决议由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>（五）公司年度报告；</p> <p>（六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项</p>
	特别决议	<p>特别决议由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）公司章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）公司现金分红政策的调整或者变更；</p> <p>（七）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以</p>

期间	决议类型	审议内容
		普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

公司成立初期，为控制公司经营决策风险，重大事项由绝对多数董事通过有利于公司稳健运营，因此当时有效的《公司章程》约定，公司部分重大事项需全体董事或2/3以上董事投赞成票方能通过。2018年1月至2019年12月期间，合肥国资方委派董事占公司董事会席位未达2/3，该等董事会席位设置系合肥国资方出于招商引资需要及保护小股东利益考虑，而经友好协商确定。

合肥国资方及其委派董事对公司的战略方针、经营决策及重大经营管理等事项拥有重大影响。公司召开董事会会议前，相关议案需提交合肥建投先行内部审议，合肥建投审议通过后再由其委派的董事在董事会会议上进行表决。合肥国资方委派董事在发行人董事会中占实质主导地位，报告期内公司历次董事会会议上均未发生因力晶科技委派董事单方面反对或弃权而无法形成决策的情形。

根据力晶科技出具的确认函，力晶科技充分认可合肥建投方的控股股东地位，对晶合集成重大决策战略方针、企业发展方向、经营决策、重大投资等具有决定性影响力，认可并尊重合肥市国资委作为晶合集成实际控制人的地位。力晶科技自入股以来未以任何形式谋求晶合集成的控制权，亦不存在与合肥市国资委共同控制晶合集成的情形。

5、委托经营管理及执行情况

签订《委托经营管理合约》主要目的系在发行人经营、发展状况不及预期时，合肥国资方能约束力晶科技向公司投入更多精力和支持。《委托经营管理合约》签订后，公司未实际将经营管理权交予力晶科技，仅部分条款实际履行，详见本补充法律意见书第12.1题之“（一）《委托经营管理合约》签署的背景、主要内容、委托经营管理范围及具体方式，相关条款的具体执行情况，除《委托经营管理合约》及终止协议外，是否还存在其他对委托经营管理事项的约定”的相关回复。《委托经营管理合约》未对发行人日常经营及重大事项决策机制造成实质影响，发行人实际控制人认定情况未因此发生变化。

6、说明报告期内实际控制人认定情况，充分论证发行人最近两年实际控制人是否发生变更

结合前述分析，考虑到：

（1）报告期内，合肥建投为发行人控股股东，合肥国资方控制公司 50%以上的股份。合肥国资方委派的董事数量占公司董事会成员半数以上。

（2）公司成立初期，为控制公司经营决策风险，重大事项由绝对多数董事通过有利于公司稳健运营，因此当时有效的《公司章程》约定，公司部分重大事项需全体董事或 2/3 以上董事投赞成票方能通过。2018 年 1 月至 2019 年 12 月期间，合肥国资方委派董事占公司董事会席位未达 2/3，该等董事会席位设置系合肥国资方出于招商引资需要及保护小股东利益考虑而经友好协商确定。报告期内，合肥国资方委派董事在发行人董事会中占实质主导地位，公司历次董事会会议上均未发生因力晶科技委派董事单方面反对或弃权而无法形成决策的情形

（3）报告期内，发行人的日常经营运作以发行人自身员工和合肥国资方委派高管为主导，发行人经营管理团队主要来源于发行人员工。

（4）《委托经营管理合约》签订后，公司未实际将经营管理权交予力晶科技，《委托经营管理合约》未对发行人日常经营及重大事项决策机制造成实质影响，发行人实际控制人认定情况未因此发生变化。

（5）根据力晶科技出具的确认函，力晶科技充分认可合肥建投方的控股股东地位，认可并尊重合肥市国资委作为晶合集成实际控制人的地位。力晶科技自入股以来未以任何形式谋求晶合集成的控制权，亦不存在与合肥市国资委共同控制晶合集成的情形。

综上所述，报告期内，发行人的实际控制人均为合肥市国资委，发行人最近两年实际控制人未发生变更。

二、《问询函》第 2 题：关于以专利技术使用权出资

根据保荐工作报告：2017年3月，经台湾经济部投资审议委员会批准，力晶科技以58项专利技术使用权作价人民币20亿元向晶合集成增资。

请发行人说明：（1）专利技术使用权出资的背景及具体情况，是否存在期限即将届满的专利，相关专利技术使用权作价20亿元的评估定价依据，是否存在利益输送，增资后力晶科技能否继续使用或授予其他方使用；（2）力晶科技以专利技术使用权作价出资是否符合当时法律法规的规定，出资方式及内容是否与外资审批机构的批复相符；（3）受让技术在使用、后续研发等方面是否受到我国台湾地区政策等方面的限制或存在相关风险；（4）上述专利技术在发行人的生产经营中的实际使用情况及技术发展过程中所起的作用；（5）相关专利对应的收入和专利的账面价值，报告期内发生减值的情况。

请保荐机构和发行人律师对上述事项（1）至（4）进行核查并发表明确意见，请保荐机构和申报会计师对上述事项（5）进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）专利技术使用权出资的背景及具体情况，是否存在期限即将届满的专利，相关专利技术使用权作价20亿元的评估定价依据，是否存在利益输送，增资后力晶科技能否继续使用或授予其他方使用

1、专利技术使用权出资的背景及具体情况

（1）专利技术使用权出资的背景

发行人设立初期所代工产品的主要应用领域为面板显示驱动芯片领域，配套服务于新型显示产业。考虑到晶合集成初期的产品定位，以及需充分运用力晶科技成熟的技术优势和12英寸晶圆厂运营经验，帮助晶合集成以最快的速度掌握整套DDIC制程技术并实现产品量产的需求，合肥市政府要求力晶科技投入150nm大尺寸驱动IC、110nm小尺寸驱动IC、90nm小尺寸驱动IC相关的三项DDIC制程技术（以下简称“三项制程技术”）。拟投入的三项制程技术包含专利技术、技术文件及数据，以及运用该等技术过程中形成的技术经验等内容，其中：技术文件及数据、技术经验较为难以量化且涉及商业秘密，而专利技术由于已进入公开领域并受到保护，其范围与边

界较为清晰，因此双方协商以专利技术作为技术出资的载体。除专利技术外，其他制程平台所需技术文件及数据、技术经验等也由力晶科技导入晶合集成，帮助晶合集成最终实现量产。由于当时力晶科技自身仍在使用前述三项制程技术生产相关产品，无法将相关专利技术的所有权转让给晶合集成，经过合肥市政府与力晶科技多轮谈判，力晶科技同意以前述三项制程技术中涉及的专利技术使用权对晶合集成进行出资。

(2) 专利技术使用权出资的具体情况

2015年4月，合肥市政府与力晶科技签署《合作框架协议》，约定双方共同合作实施合肥新站综合开发试验区12英寸晶圆制造基地项目，力晶科技为晶合集成提供完整的驱动IC芯片代工制程技术，技术出资作价20亿元。2015年10月，合肥建投、发行人与力晶科技签署《技术移转协议》，约定了力晶科技三项制程技术移转的步骤及实施细节，包括技术整备、技术移转团队建置与人才培育、进行技术授权与导入、移转技术之技术试验载体产品、移转技术验证完成与时程，及技术验证完成之后续事项等。

力晶科技用于出资的58项专利使用权具体情况如下：

序号	专利名称	国家/地区	专利类型	专利号	申请日	到期日
1	光学光刻方法	中国	发明专利	ZL03155531.4	2003/8/28	2023/8/27
2	具有自行对准接触窗的半导体元件及其制造方法	中国	发明专利	ZL200510065580.3	2005/4/18	2025/4/17
3	导线的制造方法	中国	发明专利	ZL200510065608.3	2005/4/18	2025/4/17
4	导线的制造方法以及缩小导线与图案间距的方法	中国	发明专利	ZL200510129767.5	2005/12/5	2025/12/4
5	半导体元件及其制造方法	中国	发明专利	ZL200610005891.5	2006/1/19	2026/1/18

序号	专利名称	国家/地区	专利类型	专利号	申请日	到期日
6	电路结构及用以定义此电路结构的光掩模	中国	发明专利	ZL200710161775.7	2007/9/26	2027/9/25
7	监控光刻工艺的方法与监控标记	中国	发明专利	ZL200810093317.9	2008/4/18	2028/4/17
8	以交替式相位移原理改善接触洞图案解析度之方法	中国台湾	发明专利	I313889	2003/7/21	2023/7/20
9	制作通孔的方法	中国台湾	发明专利	I240988	2004/1/7	2024/1/6
10	浅沟渠隔离结构的制造方法	中国台湾	发明专利	I234228	2004/5/12	2024/5/11
11	具有自行对准接触窗之半导体元件及其制造方法	中国台湾	发明专利	I254409	2005/2/16	2025/2/15
12	导线的制造方法	中国台湾	发明专利	I254365	2005/1/27	2025/1/26
13	自行对准接触窗开口的制作方法	中国台湾	发明专利	I301997	2005/6/17	2025/6/16
14	半导体元件及其制造方法	中国台湾	发明专利	I267190	2005/8/29	2025/8/28
15	隔离结构的制造方法	中国台湾	发明专利	I300968	2006/6/28	2026/6/27
16	光罩复验方法与系统	中国台湾	发明专利	I305004	2006/7/17	2026/7/16
17	管制规格界限之制定方法	中国台湾	发明专利	I305838	2006/9/29	2026/9/28
18	分离闸极快闪记忆体的故障检测方法	中国台湾	发明专利	I301982	2006/9/28	2026/9/27
19	半导体元件的制造	中国台湾	发明	I464831	2012/6/27	2032/6/26

序号	专利名称	国家/地区	专利类型	专利号	申请日	到期日
	方法		专利			
20	接触窗的形成方法	中国台湾	发明专利	I473206	2012/7/3	2032/7/2
21	Semiconductor device having reduced interconnect-line parasitic capacitance	美国	发明专利	US 6,531,776 B2	2001/8/29	2021/8/28
22	Method for forming stepped contact hole for semiconductor devices	美国	发明专利	US 6,444,574 B1	2001/9/6	2021/9/5
23	Method of forming stepped contact trench for semiconductor devices	美国	发明专利	US 6,583,055 B1	2002/1/25	2022/1/24
24	Method of manufacturing semiconductor device with formation of a heavily doped region by implantation through an insulation layer	美国	发明专利	US 6,670,254 B1	2002/10/1	2022/9/30
25	Semiconductor device formed on silicon-on-insulator substrate	美国	发明专利	US 6,828,633 B2	2003/2/26	2023/2/25
26	Silicon-on-insulator device structure	美国	发明专利	US 7,019,582 B2	2004/9/29	2024/9/28
27	Method for automatically controlling defect -	美国	发明专利	US 6,807,454 B2	2003/3/17	2023/3/16

序号	专利名称	国家/地区	专利类型	专利号	申请日	到期日
	specification in a semiconductor manufacturing process					
28	Method for producing a gate	美国	发明专利	US 6,699,755 B1	2003/3/24	2023/4/29
29	Half-tone phase shift mask and patterning method using thereof	美国	发明专利	US 7,461,472 B2	2003/6/16	2025/12/11
30	Method of improving a resolution of contact hole patterns by utilizing alternate phase shift principle	美国	发明专利	US 7,008,733 B2	2003/9/25	2024/5/31
31	Re-performable spin-on process	美国	发明专利	US 6,881,590 B2	2003/8/25	2023/8/24
32	Method for fabricating a through hole on a semiconductor substrate	美国	发明专利	US 6,995,086 B2	2004/6/28	2024/8/4
33	Method for forming a titanium nitride layer	美国	发明专利	US 7,030,015 B2	2004/9/16	2023/4/3
34	Method of manufacturing semiconductor device	美国	发明专利	US 7,056,787 B2	2005/1/12	2025/1/11
35	Method of forming contact hole and method of fabricating semiconductor device	美国	发明专利	US 7,098,124 B2	2005/5/31	2025/5/30

序号	专利名称	国家/地区	专利类型	专利号	申请日	到期日
36	Method of fabricating conductive lines with silicide layer	美国	发明专利	US 7,550,372 B2	2005/8/29	2026/12/19
37	Semiconductor device having self-aligned contact	美国	发明专利	US 7,612,433 B2	2005/9/21	2027/1/30
38	Method for forming buried doped region	美国	发明专利	US 7,465,632 B2	2005/10/28	2027/1/31
39	Method of fabricating semiconductor device	美国	发明专利	US 7,268,055 B2	2005/11/7	2025/12/14
40	Method for manufacturing gate dielectric layer	美国	发明专利	US 7,273,787 B2	2005/11/18	2026/4/3
41	Method of manufacturing self-aligned contact openings	美国	发明专利	US 7,429,527 B2	2007/9/11	2025/12/14
42	Manufacturing method of semiconductor device having self-aligned contact	美国	发明专利	US 7,803,692 B2	2009/9/18	2025/9/20
43	Method for forming contact window	美国	发明专利	US 8,722,538 B2	2012/9/12	2032/9/11
44	Method for manufacturing semiconductor device	美国	发明专利	US 8,822,303 B2	2012/9/15	2032/9/20
45	PROCESS FOR FORMING SHALLOW TRENCH	美国	发明专利	5747377	1996/9/6	2016/9/5

序号	专利名称	国家/地区	专利类型	专利号	申请日	到期日
	ISOLATION					
46	SELF-BIASED VOLTAGE-REGULATED CURRENT SOURCE	美国	发明专利	5801580	1996/11/26	2016/11/25
47	LOW-CURRENT SOURCE CIRCUIT	美国	发明专利	5805010	1996/12/3	2016/12/2
48	Low mask count cmos process with inverse-t gate ldd structure	美国	发明专利	5854101	1997/4/4	2017/4/3
49	Method of fabricating a short-channel mos device	美国	发明专利	5773348	1997/5/21	2017/5/20
50	Method of fabricating a mos device having a gate-side air-gap structure	美国	发明专利	5736446	1997/5/21	2017/5/20
51	Method of fabricating a mos device with a localized punchthrough stopper	美国	发明专利	5963811	1997/8/5	2017/8/4
52	METHOD TO FORM METAL-TO-METAL ANTIFUSE FOR FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY APPLICATIONS USING LIQUID PHASE DEPOSITION	美国	发明专利	5937281	1997/8/5	2017/8/4

序号	专利名称	国家/地区	专利类型	专利号	申请日	到期日
	(LPD)					
53	Sub-range flash analog-to-digital converter	美国	发明专利	5973632	1998/3/3	2018/3/2
54	Method of Fabricating lightly-doped drain transistor having inverse-t gate structure	美国	发明专利	6130135	1998/5/18	2018/5/17
55	Method for fabricating trench-isolation structure	美国	发明专利	6069057	1998/5/18	2018/5/17
56	Circuit for Removing Bubble Errors Occurring in Thermal Codes	美国	发明专利	5995028	1998/2/12	2018/2/11
57	分距快闪式类比数位转换器	中国台湾	发明专利	409464	1998/7/2	2018/7/1
58	移除热码内气泡错误电路	中国台湾	发明专利	421924	1998/7/2	2018/7/1

2、是否存在期限即将届满的专利

合肥市政府与力晶科技于 2015 年初即协商确定以驱动 IC 制程技术向公司出资，并于 2015 年 4 月签署《合作框架协议》。根据《合作框架协议》，公司、合肥建投与力晶科技于 2015 年 10 月签订《技术移转协议》，各方已确认力晶科技用以出资的专利技术范围。上述协议签订时，力晶科技用以出资的 58 项专利不存在期限届满的情况，有 3 项专利即将在 2016 年内届满。截至评估基准日 2016 年 10 月 31 日，力晶科技用以出资的专利中有 1 项专利期限届满，有 2 项专利有效期即将在当年届满。

由于力晶科技用以出资的专利技术是《技术移转协议》约定下三项制程技术所需要使用的专利，相关专利在双方协商谈判的过程中均视为一个技术包进行整体考虑，

截至资产评估基准日，个别专利存在期限届满或即将届满的情形，不会实质影响相关专利对发行人的作用及价值。

3、相关专利技术使用权作价 20 亿元的评估定价依据，是否存在利益输送

力晶科技用于出资的 58 项专利使用权，是《技术移转协议》项下三项制程技术所需要使用的专利技术，相关专利在应用于三项制程技术的过程中整体产生价值。另外，根据《技术移转协议》的约定，除前述 58 项专利外，三项制程技术所需的其他技术文件及数据、技术经验等，也由力晶科技同步移转，与前述 58 项专利形成整体制程技术包，共同对发行人生产经营发挥作用。

合肥建投与力晶科技就力晶科技用于出资的 58 项专利技术使用权委托安徽华洲资产评估有限公司进行评估，评估方法为收益法，即通过估测资产未来预期收益的现值来判断其价值，具体通过销售收入提成率（或收益分成率）将资产贡献的收入从全部收入中“分离”出来，并将其折现得到评估值。该等通过出资方式获取的专利使用权广泛应用于发行人生产制造过程的各个环节及工艺流程，共同对生产产品发挥作用，故在评估时预测发行人整体收入及相关专利技术对发行人收入的整体贡献，并推算相关专利技术的价值。具体评估过程包括：（1）经济寿命分析；（2）未来销售收入预测；（3）确定无形资产提成率；（4）确定专利销售收入提成额；（5）根据对比公司估计折现率；（6）计算评估价值。

2016 年 12 月 28 日，安徽华洲资产评估有限公司就力晶科技拟以无形资产出资项目出具《资产评估报告书》（华洲评报字（2016）第 056 号），根据收益法评估结果，截至评估基准日 2016 年 10 月 31 日，力晶科技拟出资 58 项专利技术使用权的评估价值为 204,950.05 万元。2017 年 3 月 10 日，合肥市国资委就上述资产评估项目基本情况及资产评估结果出具了《接受非国有资产评估项目备案表》。

由于安徽华洲资产评估有限公司不具备证券期货相关业务评估资格，晶合集成聘请具备证券期货相关业务资格的评估机构同致信德（北京）资产评估有限公司（以下简称“同致信德”）对上述专利技术使用权出资进行评估复核。2020 年 1 月 20 日，同致信德出具了《关于对华州评报字（2016）第 056 号<力晶科技股份有限公司拟以无形资产出资项目>资产评估报告的复核报告》（同致信德评核字（2020）第 050001

号)，经复核，安徽华洲资产评估有限公司出具的原评估报告书所涉及评估基准日的选择适当，评估所依据的法律、法规和政策基本齐全，评估报告的格式、内容全面、正确、基本符合规范要求，评估方法的选用恰当，评估结论合理。原评估目的和评估范围表述不准确。根据力晶科技、公司、合肥建投签订的《技术移转协议》，力晶科技转移的是晶圆芯片代工所需的 58 项专利技术使用权（普通许可）及专有技术使用权，而原评估报告中评估目的和评估范围描述的仅仅是 58 项专利技术使用权，表述不准确。

经与同致信德确认，调整评估范围表述的原因为：截至原评估基准日 2016 年 10 月 31 日，58 项专利技术使用权中存在部分专利的有效期限已经届满的情形，因此将有效期限届满的专利技术使用权认定为专有技术使用权，评估范围调整为 58 项专利技术使用权及专有技术使用权。

4、增资后力晶科技能否继续使用或授予其他方使用

根据 2015 年 10 月晶合集成与力晶科技、合肥建投签订的《技术移转协议》，力晶科技用以出资的转移技术授权发行人使用，该等授权为不可转让、不可再授权、全球性、非专属性的授权，该等转移技术的知识产权归力晶科技所有。因此，力晶科技在增资后能继续使用或授予其他方使用该等转移技术。

根据力晶科技出具的书面确认，力晶科技用以出资的 58 项专利在出资时点仍在实际使用。2019 年 5 月，力晶科技与其下属企业力积电进行业务重组，力晶科技将其全部晶圆代工业务及相关资产转让至力积电，力晶科技成为控股型企业，转让的资产包中即包含上述 58 项专利中尚在有效期内的专利。根据力积电与发行人共同签署的确认函，本次转让不影响力晶科技与晶合集成此前签订的《技术移转协议》，晶合集成可以根据前述协议依法继续使用相关专利技术。2020 年初，为进一步完善力晶科技无形资产出资的资产的权利完整性，合肥国资方与力晶科技进行了谈判，要求其将技术出资涉及的相关专利所有权转让给发行人。为此，力积电对当时其使用的技术情况进行了梳理，确认其自 2020 年 3 月起已不再使用力晶科技用于出资的相关专利技术。2020 年 3 月，力晶科技与力积电签署协议，力积电将前述在有效期内的专利所有权转让予力晶科技。

2020 年 9 月，力晶科技与发行人签署《专利转让协议》，约定将尚在有效期内的

44 项专利所有权无偿转让给晶合集成，转让完成之日起，晶合集成对前述专利享有完整的所有相关权利，力晶科技保证不向任何第三方许可上述专利，且协议签署前任何针对前述专利的许可（如有）已全部解除。2020 年 10 月，双方就前述 44 项专利办理了所有权变更登记手续。

根据力晶科技出具的书面确认，力晶科技与晶合集成签署《专利转让协议》后，力晶科技、力积电未使用也未许可他人使用《专利转让协议》项下的相关专利。

（二）力晶科技以专利技术使用权作价出资是否符合当时法律法规的规定，出资方式及内容是否与外资审批机构的批复相符

1、力晶科技以专利技术使用权作价出资是否符合当时法律法规的规定

力晶科技于 2017 年 3 月以专利技术使用权向发行人作价出资，根据当时有效的《中外合资经营企业法实施条例（2014 修订）》第二十二条规定，合营者可以用专有技术作价出资。以专有技术作为出资的，其作价由合营各方按照公平合理的原则协商确定，或者聘请合营各方同意的第三者评定。根据当时有效的《中华人民共和国公司法（2013 修正）》第二十七条规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。因此除法律、行政法规规定不得出资的财产，“可以用货币估价”并“可以依法转让”的非货币财产可以作价出资。专利技术使用权不属于《公司注册资本登记管理规定》第五条列举的“劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等”不得作价出资的财产，不违反当时法律法规的规定。此外，根据当时有效的《中华人民共和国专利法》（2008 年修订），被许可人实施专利应向专利权人支付专利使用费。根据当时有效的《合同法》，“技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。”综上，专利使用权可以依法转让并用货币估价，且不属于当时法律法规规定不得作价出资的财产。

此外，双方已就专利技术使用权出资履行了资产评估、工商登记等手续。

根据合肥新站高新技术产业开发区市场监督管理局出具的《证明》，发行人无因违反市场监管类法律法规而受到该局行政处罚的记录。因此，发行人未因力晶科技以

专利技术使用权出资受到市场监督管理部门的行政处罚。

综上，本所认为，力晶科技以 58 项专利技术使用权作价出资符合当时有效的《中外合资经营企业法实施条例（2014 修订）》《中外合资经营企业法实施条例》《中华人民共和国公司法（2013 修正）》《公司注册资本登记管理规定》等法律、法规的相关规定。

2、出资方式及内容是否与外资审批机构的批复相符

自 2016 年 2 月力晶科技投资参股晶合有限后，晶合有限变更为中外合资经营企业，属于外商投资企业。2017 年 3 月力晶科技以专利技术使用权作价出资时，根据当时有效的《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》第六条规定，外商投资企业投资者基本信息变更，包括认缴出资额、出资方式、出资期限、资金来源地、投资者类型变更等，应由外商投资企业指定的代表或委托的代理人在变更事项发生后 30 日内通过综合管理系统在线填报和提交《外商投资企业变更备案申报表》及相关文件，办理变更备案手续。根据上述规定，外商投资企业的出资额及出资方式发生变更的，不需要事先取得审批，应在线报送设立备案信息或办理变更备案手续。

就力晶科技本次出资，发行人已完成了外商投资企业相关备案手续。

综上，力晶科技以专利技术使用权出资事宜无需经外资审批机构批复，发行人已依法办理外资备案手续。

（三）受让技术在使用、后续研发等方面是否受到我国台湾地区政策等方面的限制或存在相关风险

1、力晶科技以专利使用权出资时已经过中国台湾投审委核准

（1）以专利使用权出资需要经过中国台湾投审会核准的相关规定

力晶科技以专利使用权出资时有效的《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》（以下简称“《许可办法》”）第七条规定：“台湾地区人民、法人、团体或其他机构依本办法规定在大陆地区从事投资或技术合作者，应先备具申请书件向投审会申请许可”。力晶科技以专利使用权出资属于《许可办法》所规定的“在大陆地区从事投

资”，需要经中国台湾投审会核准。

（2）力晶科技以专利使用权出资时已经过中国台湾投审会核准

根据台湾投审委于 2017 年 3 月 29 日出具的经审二字第 10600015560 号函，依据《许可办法》及《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》的规定，核准力晶科技以专门技术（晶圆代工制程相关技术）作价人民币 20 亿元，用于对晶合集成进行技术出资。

根据《台湾法律意见书》，力晶科技依《投资参股协议》《技术移转协议》执行技术移转的行为，事先已经中国台湾投审会核准。因此，力晶科技已履行完毕中国台湾地区相关审批程序。晶合集成使用、后续研发力晶科技用以出资的专利技术不会受到中国台湾地区政策等方面的限制，亦不存在相关风险。

2、力晶科技将相关专利所有权转让给发行人时无需台湾投审委核准

经核查，2020 年 9 月 3 日，为进一步完善力晶科技无形资产出资的资产权利完整性，力晶科技与晶合集成签订了《专利转让协议》，力晶科技将上述 58 项专利中尚在有效期内的 44 项专利的所有权无偿转让给晶合集成。2020 年 10 月，双方完成专利所有权的转让。

根据力晶科技将相关专利所有权转让给发行人时有效的《许可办法》第七条规定：“台湾地区人民、法人、团体或其他机构依本办法规定在大陆地区从事投资或技术合作者，应先备具申请书件向投审会申请许可。”《许可办法》第五条对“技术合作”进行了解释：“本办法所称在大陆地区从事技术合作，系指台湾地区人民、法人、团体或其他机构，提供专门技术、专利权、商标专用权或著作财产权与大陆地区人民、法人、团体或其他机构之合作”。根据台湾法律意见书，“技术合作指专门技术、专利权等之授权，不包含专门技术、专利权等之转让”。

因此，力晶科技将相关专利所有权转让给发行人时，专利权转让不属于《许可办法》所规定的“在大陆地区从事技术合作”或“在大陆地区从事投资”的情形，无需中国台湾投审会核准。

综上，力晶科技以专利技术使用权出资已取得中国台湾投审会核准，力晶科技将

相关专利所有权转让给发行人时不需要取得中国台湾投审会核准。发行人已取得相关专利技术的所有权，受让技术在发行人使用、后续研发等方面不会受到中国台湾地区政策等方面的限制，亦不存在相关风险。

（四）上述专利技术在发行人的生产经营中的实际使用情况及技术发展过程中所起的作用

根据发行人提供的专利证书等相关资料，发行人从力晶科技处受让取得的 58 项专利发行人生产经营中使用情况具体如下：

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利技术作用	专利技术使用情况
1	发明专利	光学光刻方法	ZL03155531.4	用于增加曝光制程精准度	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
2	发明专利	具有自行对准接触窗的半导体元件及其制造方法	ZL200510065580.3	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
3	发明专利	导线的制造方法	ZL200510065608.3	用于提升铜导线制程精准度	55nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
4	发明专利	半导体元件及其制造方法	ZL200610005891.5	用于减少焊垫面积	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
5	发明专利	导线的制造方法以及缩小导线与图案间距的方法	ZL200510129767.5	用于缩小导线间距	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
6	发明专利	电路结构及用以定义此电路结构的光掩模	ZL200710161775.7	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
7	发明专利	监控光刻工艺的方法与监控标记	ZL200810093317.9	用于提高光刻准确度	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
8	发明	Semiconductor	US 6,531,776 B2	用于达到有效	150nm、

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利技术作用	专利技术使用情况
	专利	device having reduced interconnect-line parasitic capacitance		电容面积	110nm、90nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
9	发明专利	Method for forming stepped contact hole for semiconductor devices	US 6,444,574 B1	用于有效控制接触面	110nm、90nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
10	发明专利	Method of forming stepped contact trench for semiconductor devices	US 6,583,055 B1	用于有效控制浅沟槽深度位置	110nm、90nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
11	发明专利	Method for automatically controlling defect-specification in a semiconductor manufacturing process	US 6,807,454 B2	用于改善良率	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
12	发明专利	Method of manufacturing semiconductor device with formation of a heavily doped region by implantation through an insulation layer	US 6,670,254 B1	用于使电性稳定	90nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
13	发明专利	Semiconductor device formed on silicon-on-insulator substrate	US 6,828,633 B2	用于 SOI 器件改善浮体效应	150nm、110nm、90nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
14	发明	Silicon-on-	US 7,019,582 B2	用于 SOI 器件	150nm、

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利技术作用	专利技术使用情况
	专利	insulator device structure		改善浮体效应	110nm、90nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
15	发明专利	Method for producing a gate	US 6,699,755 B1	用于减少光刻层数，节省光罩	110nm、90nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
16	发明专利	Half-tone phase shift mask and patterning method using thereof	US 7,461,472 B2	用于增加曝光制程容忍度	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
17	发明专利	Method of improving a resolution of contact hole patterns by utilizing alternate phase shift principle	US 7,008,733 B2	用于增加曝光制程容忍度	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
18	发明专利	Re-performable spin-on process	US 6,881,590 B2	用于通过重复旋转涂布工艺生成介电层来改善半导体器件良率	150nm、110nm、90nm，制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC 产品
19	发明专利	Method for fabricating a through hole on a semiconductor substrate	US 6,995,086 B2	用于增加通孔接触率	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
20	发明专利	Method for forming a titanium nitride layer	US 7,030,015 B2	用于提高氮化钛膜品质	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利技术作用	专利技术使用情况
21	发明专利	Method of manufacturing semiconductor device	US 7,056,787 B2	用于减少光刻层数，节省光罩	110nm、90nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
22	发明专利	Method of forming contact hole and method of fabricating semiconductor device	US 7,098,124 B2	用于形成多个自对准接触孔	150nm、110nm、90nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
23	发明专利	Semiconductor device having self-aligned contact	US 7,612,433 B2	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
24	发明专利	Manufacturing method of semiconductor device having self-aligned contact	US 7,803,692 B2	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
25	发明专利	Method of fabricating conductive lines with silicide layer	US 7,550,372 B2	用于提升铜导线制程精准度提升	55nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
26	发明专利	Method for forming buried doped region	US 7,465,632 B2	用于减少光刻层数，节省光罩	55nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
27	发明专利	Method of manufacturing self-aligned contact openings	US 7,429,527 B2	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
28	发明专利	Method of fabricating semiconductor device	US 7,268,055 B2	用于有效控制闸极面积	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利技术作用	专利技术使用情况
29	发明专利	Method for manufacturing gate dielectric layer	US 7,273,787 B2	用于减少光刻层数，节省光罩	110nm、90nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
30	发明专利	Method for forming contact window	US 8,722,538 B2	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
31	发明专利	Method for manufacturing semiconductor device	US 8,822,303 B2	用于改善数据的非易失性安全存储传输延迟问题	110nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
32	发明专利	以交替式相位移原理改善接触洞图案解析度之方法	I313889	用于增加曝光制程容忍度	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
33	发明专利	制作通孔的方法	I240988	用于提高抗反射层移除率增加通孔接触率	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
34	发明专利	浅沟渠隔离结构的制造方法	I234228	用于减少光刻层数，节省光罩	110nm、90nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
35	发明专利	具有自行对准接触窗之半导体元件及其制造方法	I254409	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
36	发明专利	导线的制造方法	I254365	用于提升铜导线制程精准度	55nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
37	发明专利	自行对准接触窗开口的制作方法	I301997	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利技术作用	专利技术使用情况
38	发明专利	半导体元件及其制造方法	I267190	用于减少焊垫面积	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
39	发明专利	隔离结构的制造方法	I300968	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
40	发明专利	光罩复验方法与系统	I305004	用于降低光罩异常风险	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
41	发明专利	管制规格界限之制定方法	I305838	用于提高产品质量	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
42	发明专利	分离闸极快闪记忆体的故障检测方法	I301982	半导体组件故障检测的方法，用于分析产品良率不佳的主要原因	110nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
43	发明专利	接触窗的形成方法	I473206	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
44	发明专利	半导体元件的制造方法	I464831	增加半导体堆叠结构之间的气隙比，改善传输延迟	110nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
45	发明专利	PROCESS FOR FORMING SHALLOW TRENCH ISOLATION	5747377	用于减少鸟嘴效应、热氧化应力和沟槽缺陷	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
46	发明专利	SELF-BIASED VOLTAGE-REGULATED CURRENT SOURCE	5801580	用于稳定电流源输出电流	110nm、90nm 制程 Driver IC
47	发明	LOW-CURRENT SOURCE	5805010	用于产生具有最小空闲状态	110nm、90nm

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利技术作用	专利技术使用情况
	专利	CIRCUIT		的恒定电流和参考电压	制程 Driver IC
48	发明专利	Low mask count cmos process with inverse-t gate ldd structure	5854101	用于减少光掩模数并最小化门锁和沟道热载流子效应	Driver IC 、 MCU 、 CIS 、 Logic、 PMIC
49	发明专利	Method of fabricating a short-channel mos device	5773348	用于降低当前光刻工艺的限制	Driver IC 、 MCU 、 CIS 、 Logic、 PMIC
50	发明专利	Method of fabricating a mos device having a gate-side air-gap structure	5736446	用于改善 MOS 器件的栅极延迟时间和功耗	Driver IC 、 MCU 、 CIS 、 Logic、 PMIC
51	发明专利	Method of fabricating a mos device with a localized punchthrough stopper	5963811	用于防止由减小的沟道长度引起的穿通现象	Driver IC 、 MCU 、 CIS 、 Logic、 PMIC
52	发明专利	METHOD TO FORM METAL-TO-METAL ANTIFUSE FOR FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY APPLICATIONS USING LIQUID PHASE DEPOSITION (LPD)	5937281	用于改善反熔丝结构性能	Driver IC
53	发明专利	Sub-range flash analog-to-digital converter	5973632	用于校正闪存数位转换器中粗分比较和细分比较之间的不匹配	110nm 制程 Driver IC 、 MCU 、 CIS 、 Logic、 PMIC

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利技术作用	专利技术使用情况
54	发明专利	Method of Fabricating lightly-doped drain transistor having inverse-t gate structure	6130135	用于减小漏极附近的电场并防止热载流子退化以提高器件可靠性	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
55	发明专利	Method for fabricating trench-isolation structure	6069057	用于减小硅局部氧化隔离（LOCOS）中的鸟嘴效应和机械应力	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
56	发明专利	Circuit for Removing Bubble Errors Occurring in Thermal Codes	5995028	用于消除热码中出现的气泡错误	110nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
57	发明专利	分距快闪式类比数位转换器	409464	用于通过热码校正方式校正粗分比较和细分比较间的失配	110nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
58	发明专利	移除热码内气泡错误电路	421924	用于消除热码中出现的气泡错误	110nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC

上述专利相关技术主要用于发行人成立初期，为快速完成产线搭建、开展生产经营、承接客户需求，减少发行人自行重复研发上述技术所需的时间及费用，在生产经营中实际使用了前述相关专利技术，对于发行人生产经营及技术发展起到了推进作用。

三、《问询函》第3题：关于特殊权利条款

根据保荐工作报告，合肥建投同力晶科技签订的《投资参股协议》，约定了增资选择权、后续增资、股份处置限制条件等条款，但未具体说明相关条款内容。双方已

签署补充协议，约定自该协议签署之日起，该条款终止，且对双方不再有约束力，无论何种情况下亦不再恢复。

请发行人说明：（1）上述该等特殊约定条款的签署背景及主要内容，相关条款的履行情况，与委托经营管理的关系以及对公司治理的影响；（2）相关条款终止是否存在纠纷或潜在纠纷，是否影响控制权稳定。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）上述该等特殊约定条款的签署背景及主要内容，相关条款的履行情况，与委托经营管理的关系以及对公司治理的影响

1、上述该等特殊约定条款的签署背景及主要内容

根据合肥建投与力晶科技签订的《投资参股协议》，及力晶科技、合肥建投的说明，《投资参股协议》中特殊约定条款的主要内容及签署背景如下：

条款名称	具体内容	签署背景
增资选择权	晶合集成获利起 5 年内，乙方（力晶科技）享有对晶合集成现金增资 12 亿元的选择权。 上述现金增资，若在晶合集成 IPO 前，则以晶合集成当期评估净值增资；若在晶合集成 IPO 之后，则依据中国上市公司定向增发相关规定执行。为引入战略合作厂商、鼓励员工或其它营运需要，经双方协商一致，乙方可以其本人或指定的第三方执行前述的增资选择权。	签署本条款系合肥市政府招商引资的条件之一，主要目的在于激励力晶科技在投资后能积极履行股东义务，促进力晶科技关注、参与公司经营，有利于公司发展。如履行相关增资选择权，在晶合集成实现获利后，力晶科技可以享受更多分红及股权增值等收益。另外，根据双方约定的投资规模，在晶合集成实现获利后，即使力晶科技增资 12 亿元，其持股比例仍不会超过合肥国资方控制的股权比例，该等条款并非出于力晶科技谋求公司控制权而设置。
后续增资	晶合集成资本额达到 83.1 亿元后，若拟再增加资本额（乙方因本协议	签署本条款系力晶科技为维护自身小股东权益而提出，避免

	第二条第六项依增资选择权入股者，不在此限）晶合集成须取得其已发行普通股 2/3 以上股份同意后 方得进行增资。	引入其他投资方造成力晶科技的持股比例被进一步稀释，或引入与力晶科技晶圆代工业务的直接竞争者，以促进双方合作稳定，并相互提供保障。
股份处置条件	于晶合集成 IPO 前，除甲方（合肥建投）向其组建的基金及其关联方转让持股及乙方向其关联方转让持股外，非经甲方特洽股东全体及乙方书面同意，所有股东不得转让持股，若任一股东因不可抗力事由而需处置持股，其它股东依其持股比例可以相同条件享有优先承购权。若甲方各特洽股东因不可抗力事由需处置持股，而乙方未执行优先承购权，甲方各特洽股东售股对象不得为乙方晶圆代工的直接竞争者。	

2、相关条款的履行情况

根据发行人提供的工商档案资料、合肥建投与力晶科技签订的《投资参股协议》及其补充协议以及力晶科技、合肥建投出具的确认函，上述增资选择权、后续增资、股份处置条件等特殊约定条款均未实际履行。2021 年 3 月，合肥建投与力晶科技签订《投资参股协议之补充协议》，上述特殊约定条款均已终止。

3、与委托经营管理的关系以及对公司治理的影响

上述特殊约定条款系出于保护力晶科技小股东权益、稳固双方合作关系等目的而签订，与委托经营管理不存在关系；上述增资选择权、后续增资、股份处置条件等特殊约定条款均未实际履行，对公司治理不存在不利影响。

（二）相关条款终止是否存在纠纷或潜在纠纷，是否影响控制权稳定

鉴于相关条款均未实际履行，合肥建投与力晶科技经协商一致后签署《投资参股协议之补充协议》，终止上述特殊约定条款。2021 年 6 月，合肥建投、力晶科技分别出具确认函，确认双方签订《投资参股协议之补充协议》系双方真实意思表示，不存在任何纠纷或潜在纠纷。

综上，相关条款终止不存在纠纷或潜在纠纷，不影响发行人控制权稳定。

四、《问询函》第 4 题：关于第二大股东力晶科技从事同类业务

根据保荐工作报告，力晶科技及其关联企业力积电从事晶圆代工业务，与发行人主营业务属于同一类型业务。在定位方面，双方均定位于晶圆代工领域；主要产品方面，发行人晶圆代工服务主要为制程为 90nm-150nm 的 12 英寸晶圆代工，力晶科技及力积电晶圆代工服务主要为制程为 65nm 及以上的 12 英寸、8 英寸晶圆代工；工艺平台方面，发行人主要工艺平台为 DDIC 晶圆代工，力晶科技及力积电主要工艺平台为 DDIC、PMIC、分离式元件、Flash、影像感测 IC、记忆体整合芯片。同时，发行人与力晶科技及力积电主要客户、供应商存在重叠的情形。

请发行人：（1）具体说明公司与力晶科技及其关联企业在晶圆代工业务及技术方面的差异情况；（2）报告期内力晶科技及其关联企业晶圆代工业务的收入规模及毛利情况；（3）发行人与力晶科技及力积电的主要客户、供应商重叠的具体情况和原因，是否会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平竞争、利益输送等情形，是否存在损害发行人利益的情形及风险。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）具体说明公司与力晶科技及其关联企业在晶圆代工业务及技术方面的差异情况

1、公司与力晶科技及其关联企业在晶圆代工业务方面的差异情况

报告期内，力晶科技及其关联企业中，从事晶圆代工业务的主体包括力晶科技和力积电。根据力晶科技公开披露的年报、审计报告等公开资料，力晶科技逐步淡出标准型内存产品的生产和销售，于 2013 年转型成为晶圆代工企业。力晶科技由 DRAM 制造企业转型至晶圆代工企业后，2019 年 5 月将位于中国台湾的 3 座 12 英寸晶圆厂

相关净资产、业务分割让与力积电，由力积电主导其晶圆代工服务的生产与销售。至此，力晶科技不再拥有晶圆代工产能，不再从事晶圆代工业务。

根据力积电公开披露的年报、审计报告等公开资料，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人与力积电均从事晶圆代工业务，发行人从事 12 英寸半导体晶圆代工，力积电从事 12 英寸及 8 英寸半导体晶圆代工；在制程节点方面，发行人以 150nm、110nm、90nm 半导体晶圆代工为主，力积电可以提供 350nm 至 25nm 制程节点的半导体晶圆代工服务；在工艺平台方面，报告期内，发行人以显示驱动芯片晶圆代工为主，力积电以记忆体产品晶圆代工、逻辑及特殊应用产品（例如：显示驱动芯片、电源管理芯片等）晶圆代工为主。

2、公司与力晶科技及其关联企业在晶圆代工技术方面的差异情况

根据发行人出具的说明，发行人在力晶科技技术出资取得的相关专利、及与力晶科技签订技术转让协议导入 90nm 衍生技术及 90nm M+技术平台的基础上，针对不同的客户需求和工艺平台进行了独立自主的研发，对产品结构、工艺流程进行了自主设计，拓展了新的工艺平台，增强了发行人的技术实力和技术独立性，扩大了发行人晶圆代工服务的产品结构，提升了产品质量，更加契合客户的产品需求，降低了发行人的生产成本，提高了产品性价比，有效增强了发行人晶圆代工服务的市场竞争力。

经过多年发展，发行人的晶圆代工技术在制程节点、代工晶圆尺寸、金属制程、技术路线、产品特性等方面已与力晶科技和力积电存在一定差异。

（二）报告期内力晶科技及其关联企业晶圆代工业务的收入规模及毛利情况

根据力晶科技和力积电公开披露的年报、审计报告等公开资料，报告期内，力晶科技和力积电晶圆代工业务的收入规模及毛利情况如下：

1、2018 年

2018 年度，力晶科技与力积电均具备晶圆代工产能，其收入规模及毛利情况如下：

单位：千新台币

项目	力晶科技 ¹	力积电
----	-------------------	-----

营业收入	42,276,344	7,637,449
其中：晶圆代工	41,607,352	7,637,436
包装元件	216,922	-
其他	452,070	13
营业成本	29,196,532	5,637,731
毛利	13,079,812	1,999,718
毛利率 ²	30.94%	26.18%

注 1：力晶科技数据为个体数据，不合并力积电

注 2：力晶科技、力积电未单独披露晶圆代工营业成本，但除晶圆代工外营收规模较小，晶圆代工毛利率与整体毛利率相近。，数据出自力晶科技、力积电的年报和审计报告。

2、2019 年

2019 年 5 月 1 日，力晶科技将旗下三座 12 英寸晶圆厂及相关营业、净资产移转给力积电。收购完成后，力晶科技不再拥有晶圆代工产能，力积电拥有三座 12 英寸晶圆代工厂、两座 8 英寸晶圆代工厂，其收入规模及毛利情况如下：

单位：千新台币

项目	力晶科技	力积电 ¹
营业收入	-	35,897,121
其中：晶圆代工	-	35,514,287
包装元件	-	382,834
营业成本	-	32,896,453
毛利	-	3,000,668
毛利率 ²	-	8.36%

注 1：力积电数据以收购后之营运规模为基础，2019 年三座 12 英寸晶圆厂转至力积电前产生的收入与利润计入力积电。

注 2：力积电未单独披露晶圆代工营业成本，但除晶圆代工外营收规模较小，晶圆代工毛利率与整体毛利率相近，数据出自力晶科技、力积电的年报和审计报告。

3、2020 年

2020 年，力积电具备晶圆代工产能，力晶科技不具备晶圆代工产能，其收入规模

及毛利情况如下：

单位：千新台币

项目	力晶科技	力积电
营业收入	-	45,684,615
其中：晶圆代工	-	45,552,596
包装元件	-	132,019
营业成本	-	34,692,204
毛利	-	10,992,411
毛利率*	-	24.06%

注：力积电未单独披露晶圆代工营业成本，但除晶圆代工外营收规模较小，晶圆代工毛利率与整体毛利率相近，数据出自力晶科技、力积电的年报和审计报告。

（三）发行人与力晶科技及力积电的主要客户、供应商重叠的具体情况和原因，是否会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平竞争、利益输送等情形，是否存在损害发行人利益的情形及风险

1、发行人与力晶科技及力积电的主要客户重叠情况和原因

（1）具体情况

报告期内，发行人前五大客户占发行人营业收入的比重分别为 99.74%、94.70% 和 89.80%，该等客户占力晶科技及力积电营业收入比重分别为 15.61%、14.22%和 14.63%，2020 年度，其客户重要性在力晶科技及力积电较低。

（2）客户重叠的原因

根据公开资料，近年来全球晶圆代工产能紧缺，上游芯片设计企业在全全球范围内寻求稳定、可靠的晶圆代工产能。根据第三方咨询机构 Omdia 的统计，2020 年大尺寸显示驱动芯片市场份额排名前 8 的企业的市占率为 92.3%，市场集中度较高；排在前八名的企业中，芯片设计（Fabless）企业共有六名，包括：联咏科技（24.1%）、奇景光电（14.2%）、Silicon Works（14.2%）、瑞鼎科技（9.1%）、天钰科技（8.7%）、集创北方（3.2%），市占率合计达 73.5%。

一方面，该等芯片设计企业对晶圆代工需求较高，单一晶圆代工企业无法满足其生产需求，在全球范围内寻找稳定可靠的晶圆代工产能；另一方面，不同晶圆代工企业可以提供不同制程和工艺平台的代工服务，芯片设计企业需要根据设计需求，向不同晶圆代工企业下单，同时，芯片设计企业在多个晶圆代工企业下单，也可以达到分散风险的作用。

因此，上述芯片设计企业同时向力晶科技/力积电和发行人采购晶圆代工服务符合行业特征，发行人与力晶科技/力积电客户重叠具备合理性。

2、发行人与力晶科技及力积电的主要供应商重叠情况和原因

（1）具体情况

根据发行人取得的报告期内力晶科技及力积电采购占比达 90%以上的原材料供应商明细表（采购占比由大到小排序，合计占比达 90%以上），报告期内，从供应商数量来看，发行人与力晶科技及力积电的主要供应商存在重叠较高的情形，发行人在报告期内向重叠原材料供应商采购的金额分别为 2.37 亿元、2.94 亿元和 5.40 亿元，占发行人向原材料供应商采购总额的比重分别为 83.30%、88.99%和 85.34%。

（2）供应商重叠的原因

①半导体原材料行业市场集中度较高

半导体行业原材料对纯度、材料稳定性等有较高要求，属于高端化学品、高端材料领域，行业领先的供应商在产品质量、供货稳定性、售后服务等方面具有优势，受到晶圆代工厂的青睐；除向发行人和力晶科技及力积电供货外，该等供应商亦向其他晶圆代工厂供货。

发行人与力晶科技及力积电的供应商存在重叠符合行业集中度特征。

②经营初期发行人主要向由力晶科技技术转让所取得《合格供应商名单》中载明的供应商采购

根据发行人与力晶科技签订的《技术移转协议》，发行人自力晶科技处取得了相关技术文件，其中的《合格供应商名单》载明了晶圆代工各生产环节所需主要原材料

的主要供应商名称。在发行人生产经营初期，为确保技转成功、品质稳定，发行人结合过往行业经验及生产经营的实际需要，主要向《合格供应商名单》中载明的供应商进行采购。因此，发行人与力晶科技及力积电的供应商存在重叠具备合理性。

报告期内，发行人的供应商均由发行人独立开发、谈判、维护。发行人的主要原材料和设备采购均由发行人独立决策、独立执行。力晶科技及力积电不参与发行人采购的任何环节。

3、是否会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平竞争、利益输送等情形，是否存在损害发行人利益的情形及风险

根据发行人出具的说明，发行人与力晶科技在技术方面存在差异，双方提供的晶圆代工服务存在差异，不具备完全的互相替代性；发行人的前五大客户和供应商均为行业知名企业，与发行人、实际控制人和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在配合发行人进行利益输送的情形；同时，全球晶圆代工市场规模较大，发行人与力晶科技及力积电均具有较大的发展空间，同一客户在多个晶圆代工厂同时下单、同一供应商同时向多个晶圆代工企业供货等情形具备合理性。

力晶科技已于 2021 年 3 月 23 日签署关于独立性与同业竞争的《承诺函》，并承诺：

“2018 年 1 月至今，本公司及本公司下属企业与晶合集成存在部分客户、供应商重叠，该等重叠的客户、供应商均系双方独立开发、谈判、维护，不存在非公平竞争、通过重叠客户或供应商进行利益输送、相互或单方让渡商业机会等情形。”

综上所述，报告期内，发行人与力晶科技及力积电的主要客户、供应商重叠具备合理性，不会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平竞争和利益输送，亦不存在对发行人利益造成重大损害的情形及风险。

五、《问询函》第 8 题：关于客户集中度

招股说明书披露：报告期内，发行人前五大客户的销售收入合计分别为

21,708.56 万元、50,563.95 万元、135,804.49 万元，占营业收入的比例分别为 99.74%、94.70%、89.80%，客户集中度较高，2020 年向第一大客户联咏科技股份有限公司销售收入占比 51%。合肥捷达微成立于 2017 年，2018 年与发行人开始合作，2019 年向发行人采购 2,439.84 万元；集创北方于 2020 年 9 月以货币出资 10,000.00 万元认缴 880.14 万元新增注册资本，持有发行人股份 0.58%，同时报告期各期均为发行人前五大客户之一。重大合同部分的销售合同主要披露了产能预留合同、订单等。

请发行人按照《问答（二）》第 12 条的要求进行相关信息披露。

请发行人说明：（1）报告期主要客户的获取方式、订单的下达方式及相关沟通记录，参与的销售人员情况及是否与力晶科技存在关系，获取客户的方式与销售费用的关系，列表说明协议签订方、签订时间、约定内容等协议相关的具体内容、委托经营管理前后协议签订的具体变化；是否与主要客户签订框架合同，如是，请说明销售合同披露的准确性，并提供相关合同；（2）联咏科技向发行人大额采购的原因，是否构成对联咏科技的重大依赖；采购量占联咏科技同类产品出货量的比例，联咏科技与力晶科技、发行人、实际控制人和董监高之间是否存在关联关系和潜在利益安排，联咏科技与力晶科技的合作历史，在发行人之前向力晶科技的采购情况；（3）前五大客户向发行人采购的产品类型、数量和单价，单价与同行业同类别产品价格的比较情况，发行人产能、产量、销量、客户采购量及存货的匹配关系；（4）合肥捷达微成立不久即向发行人大额采购的原因，合肥捷达微和集创北方向发行人采购后的使用情况或向下游客户的销售情况，回款情况，与发行人、实际控制人和董监高是否存在关联关系或其他利益安排；集创北方入股价格的公允性，是否需要股份支付。

请保荐机构和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见，请保荐机构、发行人律师和申报会计师说明对发行人的客户来源与力晶科技之间关联的核查方式和核查结论。

回复：

对发行人的客户来源与力晶科技之间关联的核查方式和核查结论

（一）对发行人的客户来源与力晶科技之间关联的核查方式

针对发行人的客户来源与力晶科技之间关联关系，发行人律师采取了以下核查方式：

1、对公司管理层和销售人员进行访谈，了解公司销售业务的主要模式、交易流程、客户获取方式等；

2、通过企查查等工商信息查询系统查询主要客户工商信息，核实主要客户与力晶科技是否存在关联关系及其他利益安排；

3、取得力晶科技出具的关于发行人主要客户来源情况的确认函；

4、实地走访/视频访谈主要客户，就客户与发行人的合作情况、初次接洽情况、与力晶科技的关联关系以及历史合作情况等进行咨询并形成书面访谈记录，获取客户确认的与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系确认函的承诺函。

（二）对发行人的客户来源与力晶科技之间关联的核查结论

发行人在 2017 年自力晶科技技术移转和产品验证的过程中，力晶科技负责将与奇景光电、奕力科技涉及技术移转的相关技术文件和数据资料移转至发行人，以此完成发行人初期产品和工艺平台的验证；在力晶科技与发行人确认了技术转让平台的适用性和产品可靠性后，发行人与奇景光电、奕力科技进行独立沟通、谈判签署相关合同订单，并完成试产、风险量产、量产以及后续客户关系维护等工作。

除上述情况外，发行人其余主要客户均为发行人自主联系、独立开发，双方通过邮件、电话等沟通确认需求，正式订单主要通过邮件等方式进行下达。与主要客户对接的主要销售人员刘忠育、李俊嘉、缪凤玲均为发行人员工，与发行人签署独立劳动关系合同，与力晶科技不存在关联关系。

六、《问询函》第 11 题：关于技术来源和先进性

根据申报材料：（1）招股说明书对核心技术情况披露较为简单。公司取得力晶科

技相关技术后，对工艺流程及参数指标进行优化，形成了现有技术平台。（2）核心技术人员多为中国台湾籍且具有力晶科技任职背景，部分曾有中芯国际、联华电子等工作经历。（3）截至 2020 年 12 月 31 日，发行人发明专利数量 2018 年为 0 项，2019 年为 2 项，2020 年为 71 项。（4）2015 年 10 月，《技术移转协议》约定力晶科技提供驱动 IC 代工所需之制程技术予公司，用以出资的转移技术作价 20 亿元。（5）2020 年 9 月，力晶科技将用于出资的 58 项专利技术使用权中尚在有效期的 44 项无偿转让给晶合有限。（6）2018 年 4 月、2021 年 4 月，发行人同力晶科技签订了《90nm 项目技术协议》及《补充协议》，约定力晶科技向公司移转 90nm M+驱动 IC 制程技术相关技术数据及文件，公司需合计支付 500 万美元。

请发行人详细披露核心技术的形成过程，力晶科技在发行人技术发展过程中的作用，现有技术平台和技术先进性的具体表征。

请发行人说明：（1）自身研发团队取得力晶科技技术后改进优化所取得的技术成果，对公司业务及生产经营的影响；（2）2018 年、2019 年发行人发明专利数量较少的原因；（3）2020 年新增多项发明专利的原因，除力晶科技转让的 44 项发明专利外，其他发明专利的形成过程及研发人员情况，与力晶科技的技术及人员间的关系，新增自有专利在发行人生产经营中的作用；受让专利部分注册地位于美国的原因；（4）用以转移出资的技术与 90nm M+相关协议约定的技术之间的关系，支付费用获取 90nm M+驱动 IC 制程技术的必要性，非一次性支付的原因，若不购买上述技术公司能否独立开展 90nm 晶圆代工研发及生产；（5）力晶科技转让给发行人的相关技术与自身（包括力积电）技术的差异；（6）结合发行人部分高管及核心技术人员曾在力晶科技任职、力晶科技向发行人转让技术、委托经营管理等情况，说明发行人自我研发能力体现在何处，是否对力晶科技构成研发和技术体系依赖，是否具备独立研发能力。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。请发行人律师说明对核心技术人员是否存在违反竞业禁止、保密协议的情形，是否使用原任职单位技术成果，是否存在纠纷或潜在纠纷事项的核查情况及核查结论。

回复：

（一）自身研发团队取得力晶科技技术后改进优化所取得的技术成果，对公司业

务及生产经营的影响

在取得力晶科技转让的相关技术后，为更好地满足客户需求，提升自身的市场竞争力，发行人针对市场需求，由发行人自身的研发团队采取了一系列技术研发措施，对工艺结构和工艺流程进行了自主设计和创新升级，形成了发行人的核心技术平台，并将部分技术成果申请并获得了专利。

2015年，力晶科技依据技术转让协议，将驱动芯片代工相关的90纳米、110纳米、150纳米工艺制程的基础技术文件及规格文件提供给发行人。2018年，发行人同力晶科技签订了《90nm项目技术协议》，导入90nm M+技术平台。该等技术虽然可以用于部分产品的生产，但该等产品与客户需求存在差距，倘若不进行技术升级，则无法满足客户更高规格、更高效能的晶圆代工服务需求，产品应用种类亦存在局限性，无法满足公司进一步市场开拓的需要，难以进一步提高市场竞争力、丰富产品结构、提高收入规模。

通过自主设计工艺结构、改造工艺流程等持续的创新优化和技术研发，发行人积累了丰富的技术成果与研发经验，在150nm、110nm、90nm制程节点形成了LCD显示驱动、LED显示驱动、CIS、E-tag、MCU等领域的核心技术平台，增强了发行人的技术实力和技术独立性，扩大了发行人晶圆代工服务的范围和质量，更加契合客户的产品需求，有效提高了发行人晶圆代工服务的市场竞争力，为发行人在晶圆代工领域开拓市场、提高收入规模、丰富产品结构提供了有效的支撑。

报告期内，2018年至2020年，发行人晶圆代工业务收入分别为21,765.95万元、53,336.01万元和151,186.11万元，实现了稳健增长。

（二）2018年、2019年发行人发明专利数量较少的原因

根据发行人报告期内专利申请明细、《专利管理办法》等内部制度以及发行人出具的说明，发行人在设立初期，主要精力投入在调试机台及产能建设中。在人员配备上，主要以制程工程师、设备工程师为主。在实现产品量产后，公司立即加大对专利申请和保护工作的投入。

公司于2018年1月成立专利委员会，组织专利评审会，在内部推行正式的专利申

请奖励制度，并开始相关技术的专利申请流程。2018年3月公司成立研发副总经理室，下设设计服务处、模型器件处、先进整合处、光学模型处。研发副总经理室主要职责包括开发先进技术平台，提供集成电路IP设计、测试及管理。研发副总经理室成立后，公司研发人员逐步完善。

根据公司提供的员工花名册，截至2018年2月末，公司研发人员共计30位；截至2018年12月31日，公司研发人员增加至119名；截至2019年12月31日公司研发人员共计207名。此外，根据国家知识产权局出具的证明，公司2018年申请境内发明专利13项，境外发明专利6项；2019年申请境内发明专利29项，境外发明专利10项。中国、美国及其他国家或地区的专利申请一般在提交日起至少18个月后才予以公布。因此，发行人2018年不存在获得授权的发明专利，2019年发行人获得授权的发明专利为2项。

本所认为，公司在2018年及2019年获得授权的专利较少存在合理原因，与公司业务发展阶段相匹配。

（三）2020年新增多项发明专利的原因，除力晶科技转让的44项发明专利外，其他发明专利的形成过程及研发人员情况，与力晶科技的技术及人员间的关系，新增自有专利在发行人生产经营中的作用；受让专利部分注册地位于美国的原因

1、2020年新增多项发明专利的原因

根据发行人报告期内专利申请明细、发行人已取得的专利证书、报告期内研发人员名单以及发行人出具的说明，随着发行人代工产品数量上升、业务规模不断扩大，发行人核心技术的保护需求增加。与此同时，发行人研发团队不断扩充，相关技术研发投入持续加大。根据中国（南京）知识产权保护中心及中国（北京）知识产权保护中心网站，经知识产权保护中心预审合格的专利申请，可进入国家知识产权局快速审查通道，将大幅缩短专利申请的审查周期。2020年发行人先后在北京、南京成立子公司，以通过当地知识产权保护中心的预审服务申请及进入快速审查通道，加快取得授权发明专利速度

经核查，2020年发行人新增境内授权发明专利20项，境外授权发明专利5项，新增专利的具体情况如下：

类型	数量
境内新增授权发明专利	20
其中：	
2020年申请的发明专利	14
2019年申请的发明专利	5
2018年申请的发明专利	1
境外新增授权发明专利	5
其中：	
2019年申请的发明专利	3
2018年申请的发明专利	2

2、除力晶科技转让的 44 项发明专利外，其他发明专利的形成过程及研发人员情况，与力晶科技的技术及人员间的关系，新增自有专利在发行人生产经营中的作用

截至 2020 年 12 月 31 日，除力晶科技转让的 44 项发明专利外，发行人拥有自行申请的发明专利共计 27 项，该等发明专利的形成过程、专利作用及研发人员情况具体如下：

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
1	中国	MOS 场效应晶体管及其制造方法	2018/10/23	ZL201811237197.5	陈耿川	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题：随着集成电路中元件特征尺寸的逐渐减小，由于尖角效应，栅极覆盖的沟道区边界附近的栅介质层变薄，并且沟道和栅极之间的电场增强，导致栅极覆盖沟道区边界处的泄露电流增大，并影响器件的性能和可靠性。</p> <p>采取的措施：发行人技术人员通过增加栅极覆盖的沟道边界处的阈值电压解决上述问题。</p> <p>实现的效果：增加栅极覆盖的沟道区边界的阈值电压，改进器件的可靠性，降低工艺复杂程度，利于生产。</p>
2	中国	沟槽隔离结构的形成方法	2019/1/18	ZL201910048694.9	张玉贵； 吴佳特	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题：在采用高密度等离子体工艺改善绝缘材料层对沟槽的填充性能时会导致衬底表面上相应的沉积有较大厚度的绝缘材料层，从而使衬底表面不平坦，导致化学机械研磨后的表面更容易产生凹陷，使得研磨后的表面平坦度降低，此将会对后续的工艺造成不利影响。</p> <p>采取的措施：发行人技术人员通过形成含氧绝缘层并进一步注入硼离子，改进工艺流程解决上述问题。</p>

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
						实现的效果： 增加了沟槽隔离结构的隔离性能，避免出现由化学机械研磨工艺所产生的表面凹陷的问题，提高了良率。
3	中国	一种存储器及其制造方法	2019/2/1	ZL201910104747.4	许春龙； 李庆民； 杨宗凯	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题：目前业界现有的可擦除可编程只读存储器（EPROM）一般都是先进行存储区浮栅（Floating Gate）及介电层（ONO:Oxide-SiN-Oxide）、存储区控制闸及逻辑区闸极的制作，再进行后段接触孔和金属互连的制作，闸极材料一般为多晶硅。现行的工艺必须先进行浮栅、控制闸与逻辑闸的制作，并最终通过接触孔将控制闸接出，工艺步骤比较复杂。</p> <p>采取的措施：发行人技术人员在上述工艺基础上，将 EPROM 控制闸的制作工艺与接触孔同时制作，降低层间介质（ILD）的厚度。</p> <p>实现的效果：降低工艺的复杂程度，降低成本。</p>
4	中国	预处理方法、金属硅化物的形成方法以及半导体处理装置	2019/7/8	ZL201910611966.1	黄志贤； 刘小东； 方建智； 刘镇豪	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题：在 110nm 以及 150nm 逻辑产品中发现，由于氧化层掉落源极与漏极使金属硅化物无法顺利形成，造成金属硅化物形成存在缺陷，进而影响良率。</p>

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
						<p>采取的措施：发行人技术人员改变预处理方法避免氧化层掉落，进而顺利形成金属硅化物。</p> <p>实现的效果：增加 110nm 以及 150nm 逻辑产品稳定度，减少不良产品出现。</p>
5	中国	沟槽制作方法及半导体隔离结构制作方法	2019/12/11	ZL201911268173.0	许春龙； 李庆民； 杨宗凯	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题：集成电路制造技术对于器件（Device）与器件之间的隔离，多使用浅沟槽隔离（STI: Shallow Trench Isolation)的方法。器件按操作电压可分为低压（LV: Low Voltage）器件（约 0.8V~2.5V）和高压(HV: High Voltage)器件（约大于 3.3V），低压与高压器件所需浅沟槽隔离的深度不同(低压区约小于 2,000Å，高压区约大于 3,000Å)。现有的制造工艺主要是使用两枚不同的光罩（Mask）分别对低压及高压区进行光刻及蚀刻的过程来实现制作不同深度浅沟槽隔离的目的。</p> <p>采取的措施：发行人技术人员利用低压与高压区域沟槽宽度不同及硼磷硅玻璃加热融化流动的特性，将融化后流入沟槽的硼磷硅玻璃作为高图形密度区的沟槽阻挡层，再蚀刻低图形密度区域的沟槽，达到两种不同的沟槽深度的效果。</p> <p>实现的效果：只使用一枚光罩即可制作两种不同深度的浅沟槽隔离，简化了现行工艺并可以降低制造</p>

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
						成本。
6	中国	扩散型场效应晶体管的形成方法	2020/1/15	ZL202010043997.4	王梦慧； 李庆民； 祝进专	<p>发行人技术人员自行研发。</p> <p>面临的问题：在现有 110nm 平台横向扩散金属氧化物半导体（LDMOS）结构中，发现器件击穿电压比较低，导通电阻比较大。</p> <p>采取的措施：发行人技术人员在现有 LDMOS 结构基础上，提出一种新型 LDMOS 结构，包括形成在漂移区中的沟槽隔离结构等。</p> <p>实现的效果：对器件的耐压性能的双重优化。</p>
7	中国	半导体器件及其制造方法	2020/2/18	ZL202010099798.5	翁文杰； 王恒	<p>发行人技术人员自行研发。</p> <p>面临的问题：在孔洞成型要针对沟槽刻蚀时，必须要填入抗刻蚀物质；填入的过程中多余的部份必须要透过不同机台清除，导致产品制造时间长。</p> <p>采取的措施：在填入抗刻蚀物质的机台新增 OKA73，直接在填入的机台将多余的物质清除。</p> <p>实现的效果：缩短制造的时间。</p>
8	中国	半导体元件的制造方法	2019/2/1	ZL201910103609.4	田矢真敏；中野纪夫；熊	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题：在集成电路中混合搭载多种半导体元件进行制造，可变电容元件会与例如场效应晶体管</p>

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
					谷裕弘	<p>(FET) 等混合在一起制造, 在此工艺流程中, 有时部分杂质会被注入到可变电容元件, 存在使可变电容元件的电容特性劣化的可能性的问题。</p> <p>采取的措施: 发行人技术人员通过将极性与 FET 的阱相同的杂质注入衬底的表面, 形成一层掩模对可变电容元件进行保护, 抑制可变电容元件的 C-V 特性的劣化的问题。</p> <p>实现的效果: 降低成本, 防止可变电容元件的电容特性的劣化。</p>
9	中国	一种半导体结构及其制造方法	2020/9/28	ZL202011039422.1	罗雪婷; 林士程; 吴建宏	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题: 55nm 制程生产工艺中, 由于抗反射涂层 (Barc) 填充不平整, 从而使光刻胶胶厚不均匀, 导致线宽变化及驻波效应。</p> <p>采取的措施: 发行人技术人员通过创新沟槽填充材料使沟槽平坦化解决上述问题。</p> <p>实现的效果: 减少驻波效应产生, 提供更高的刻蚀选择性。</p>
10	中国	测试结构及其测试方法	2020/10/16	ZL202011106814.5	周山; 王丽雅; 俞佩佩	<p>发行人技术人员自行研发。</p> <p>面临的问题: 半导体集成电路的钝化层 (Passivation) 内存在的膜内应力对外部环境温度变化较敏感, 可能造成钝化层破裂, 在芯片使用过程中</p>

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
						<p>中会产生裂缝导致芯片故障。</p> <p>采取的措施：设计一种钝化层质量评估的测试结构，在代工厂内即可以进行相关测试，实现对钝化层质量的评估。</p> <p>实现的效果：降低钝化层破裂风险，提高良率。</p>
11	中国	一种金属互连结构的形成方法	2020/9/30	ZL202011054620.5	张国伟； 许宗能； 王建智	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题：铜制程工艺在开发过程中，由于为金属通孔（TV）陡直，这样沉积的薄膜的垂直厚度高，蚀刻时造成残留，在钝化层刻蚀（PV Etch）容易造成部分氧化硅（SiO₂）和氮化硅（SiN）残留在上层金属通孔（TV）形成的开口中，造成封测（Bumping）良率损失。</p> <p>采取的措施：发行人技术人员通过改良 TV 结构，并改进工艺流程解决上述问题。</p> <p>实现的效果：提升铜制程代工产品良率。</p>
12	中国	晶圆裂片方法及其应用	2020/9/8	ZL202010931740.2	陈曦	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题：在半导体工艺的开发和失效分析中，采用金刚石笔手工在晶圆上划出一定深度的划痕，然后利用晶圆特性使其沿着划痕裂开，从而获得所需要的横断面，受限于手工的操作限制，难以达到</p>

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
						微米级的精准度。 采取的措施： 发行人技术人员通过利用漏斗式激光标记解决上述问题，简化裂片工序以缩短裂片时间的同时，并使得裂片的精度达到微米级。 实现的效果： 能够对晶圆进行快速有效的失效分析。
13	中国	一种检测半导体设备检测感度的方法和检测系统	2020/9/9	ZL202010938526.X	温育杰；李文庆；吴小贤；王曼真；陈晓红	发行人技术人员自主研发 面临的问题： 在逻辑平台制程开发过程中，发现现行检验方法应用在离子注入机台时，由于感度低而无法检测机台的差异，无法反应产品状况。 采取的措施： 在原有的离子注入基础上再加入一道反向掺杂，增加两组半导体设备的电阻差异。 实现的效果： 提高检测感度，解决机台差异问题。
14	中国	一种光阻层阻挡能力的检测方法及检测系统	2020/9/9	ZL202010937768.7	温育杰；程攀；李昌达；方晓宇；郭宜婷	发行人技术人员自主研发 面临的问题： 现有技术中判断光阻层的阻挡能力会因表面结构缺陷导致判定困难，且击穿离子数量/离子能量太低时无法感测。 采取的措施： 建立不同的检测机制，改变表面结构特性，使热导率检测感度提升。

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
						实现的效果： 简化测试过程，快速测量光阻层阻挡离子注入的能力。
15	中国	一种浅沟槽结构制备方法	2020/9/24	ZL202011012959.9	林子荏； 杨智强； 林政纬； 林祐丞	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题：在 55nm 逻辑平台工艺开发过程中，在浅沟槽制程中，在利用氢氟酸蚀刻氧化硅时，浅沟槽中的硅都会有一定程度的损伤，所以必须在氢氟酸中添加抑制剂避免浅沟槽中的硅受到损伤。</p> <p>采取的措施：发行人技术人员利用干蚀刻方式使用对硅有高选择比的蚀刻方式做氧化硅蚀刻。</p> <p>实现的效果：避免上述损伤，节省成本。</p>
16	中国	一种半导体结构的制备方法	2020/9/9	ZL202010937769.1	林祐丞； 杨智强； 林子荏； 林政纬	<p>发行人技术人员自行研发。</p> <p>面临的问题：在 Flash Memory 平台开发过程中，发现控制栅极蚀刻后若氧化物-氮化物-氧化物结构的包围层（ONO fence）太高易藏有多晶硅残留造成短路影响良率。</p> <p>采取的措施：发行人技术人员在这道工艺进行蚀刻时采用特殊策略在最小的副作用下将 ONO fence 消除。</p> <p>实现的效果：提升良率。</p>

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
17	中国	一种半导体结构的制备方法	2020/9/25	ZL202011021798.X	卢俊玮; 贾涛; 范广超	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题: 现有蚀刻工艺会导致盖帽层圆弧化及金属硬掩模刻蚀侧壁受损, 导致金属互连线的导通性能受到影响。</p> <p>采取的措施: 发行人技术人员通过在刻蚀过程中在金属硬掩模侧壁上形成一层保护膜, 用于解决盖帽层圆弧化及金属硬掩模侧壁受损的问题。</p> <p>实现的效果: 利用此技术保障金属互连线的导通, 有效提高公司产品的良率和稳定性。</p>
18	中国	电容器及其制备方法	2020/9/28	ZL202011037143.1	陈明睿; 任雪琪; 汪文婷; 姚子凤; 刘苑	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题: 目前半导体制程单层电容值很小, 需要多层才能够扩大电容值, 但这将会导致器件尺寸的增加。</p> <p>采取的措施: 发行人技术人员将同一基底的两个MOS电容串联, 扩大电容值。</p> <p>实现的效果: 提高电容器的单位电容值, 减小电容器尺寸。</p>
19	中国	一种静电放电防护线路	2020/10/15	ZL202011099926.2	陈明睿; 许嘉哲; 曾权飞;	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题: 做静电释放测试时, 发现内部电路与</p>

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
					田姿璘	平台距离太近，导致内部电路被静电损伤。 采取的措施： 发行人技术人员通过改变静电防护模块内部的接线方式，使放电路径变长，达到减小被静电损伤的危害。 实现的效果： 延长了静电释放路径，保护内部电路不受损伤。
20	中国	半导体器件的制备方法	2020/10/14	ZL202011093528.X	阳清；崔助凤；金起準	发行人技术人员自主研发。 面临的问题： 高压平台开发中器件存在漏电问题。 采取的措施： 发行人技术人员通过增加退火，减轻栅极预掺杂导致颗粒化效应，同时提升 N 型和 P 型硅栅极的蚀刻均一性解决该问题。 实现的效果： 解决高压平台开发中器件漏电大性能不佳及 SRAM 软失效问题，提升器件可靠性及 SRAM 良率，加快平台开发进程
21	美国	SPLIT-GATE NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATI ON METHOD	2018/11/25	US10,636,801 B2	陈耿川	发行人技术人员自主研发。 面临的问题： 现有的隧道介电层的材料不是完全的绝缘体，当隧道介电层的厚度较小时，容易引起漏电流，电荷存储在浮栅泄漏到擦除栅中并被擦除，引起数据不良的问题。 采取的措施： 将浮栅的顶部设计为尖锐的尖端，可

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
		THEREOF				<p>以增加擦除栅和浮栅之间的隧穿电介质层的厚度，从而避免了泄漏电流，并且使分离栅非易失性存储器具有更好的数据保留。</p> <p>实现的效果：使分离栅非易失性存储器具有更好的数据保存效果。</p>
22	美国	METHOD OF FORMING METAL SILICIDE LAYER, SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FABRICATING SAME	2018/8/31	US10,490,647 B1	张玉贵; 方建智; 彭康钧; 林群证	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题：在金属硅化物层中容易出现金属硅化物的团聚，将导致衬底内的许多针孔缺陷，并增加了金属硅化物层表面的粗糙程度。</p> <p>采取的措施：在金属硅化物层形成中提供缓冲层，利用该缓冲层减小金属原子从金属层到基板中的扩散速度和深度。</p> <p>实现的效果：防止在衬底中发生的针孔缺陷，改善金属硅化物层的表面粗糙度。</p>
23	美国	NON-VOLATILE MEMORY CELL, ARRAY AND FABRICATION	2018/11/25	US10,726,894 B2	陈耿川	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题：目前的能隙间隧穿机制令 P 通道非易失性存储器的编程电流较低(<1 uA)，由于空穴迁移率低于电子迁移率，所以 P 沟道非易失性存储器具有单元读取电流低的缺点。</p>

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
		METHOD				<p>采取的措施：采用双层导电层(如多晶硅)结构，对非易失性存储单元和阵列进行编程时引起碰撞电离，并且产生相对较高的N沟道电流。</p> <p>实现的效果：减少所需的电子数量，降低编程电流。</p>
24	美国	SILICON ISLAND STRUCTURE AND METHOD OF FABRICATING SAME	2018/10/18	US 10,490,441 B1	蒲甜松； 李庆民； 陈信全	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题：在绝缘衬底上通过硅技术实现隔离一般需要对衬底进行离子注入工艺来形成隔离，或者通过硅片键合来形成隔离，其方法相对工艺比较复杂，成本较高，且生产周期相对较长。</p> <p>采取的措施：发行人技术人员在形成第一凹槽后，在第一凹槽内形成第二凹槽，再在第二凹槽的侧壁形成保护层，之后对第一凹槽的侧壁进行氧化时，保护层起到保护作用，从而只在第一凹槽未被保护层覆盖的侧壁上形成氧化层，之后去除保护层，填充隔离材料，最终形成多个完全绝缘的硅岛。</p> <p>实现的效果：不需要额外的离子注入、键合等工艺实现特定区域硅岛的形成，降低工艺的复杂程度，降低成本。</p>
25	美国	NON-VOLATILE MEMORY AND	2019/2/18	US 10,854,758 B2	陈耿川	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题：目前非易失性存储器的存储单元尺寸</p>

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
		MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME				<p>大，擦除效率低，擦除电压要求高且数据保持力差。</p> <p>采取的措施：发行人技术人员通过在浮栅结构上设置第一尖锐部与第二尖锐部，且浮栅结构的一侧面与浮栅结构的一部分顶面所构成的拐角未被控制栅结构遮盖，拐角连接于第一尖锐部与第二尖锐部的一端之间，擦除栅结构的隧穿介电层包覆第一尖锐部、第二尖锐部及拐角的尖端部分，由此解决上述面临的问题。</p> <p>实现的效果：提高了擦除效率，降低了擦除电压以及提高了数据保持力。</p>
26	日本	ラッチ回路	2019/5/21	特许第 6761074 号	Hidemitsu Kojima	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题：目前的锁存电路占用面积比较大。</p> <p>采取的措施：发行人技术人员通过设计第一 PMOS 晶体管及第一 NMOS 晶体管、第二 PMOS 晶体管及第二 NMOS 晶体管的阈值电压，使其分别相差在预定值以上，以适当地构成锁存电路。</p> <p>实现的效果：有效的减少了锁存电路的占用面积。</p>
27	日本	SRAM、半 导体集積回 路及び LCD	2019/6/19	特许第 6801053 号	Hidemitsu Kojima	<p>发行人技术人员自主研发。</p> <p>面临的问题：SRAM 以并联方式输出数据时，数据线的面积较大。另一方面，在对 SRAM 的高速性</p>

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
		ドライバ				<p>要求较低的设备中，基于并联输出的高速性有时会有性能过剩的情况，数据线也因并联输出而需要较多的面积。</p> <p>采取的措施： 发行人技术人员通过将 SRAM 划分为多个存储单元及输入、输出电路，并且多个输入、输出电路串联，以解决数据线并联占用较多面积的问题。</p> <p>实现的效果： 减少输入、输出所需要的数据线的数量，进而减少了数据线的占用面积。</p>

根据晶合集成提供的上述发明人的劳动合同，晶合集成新增专利均为自主研发，发明人均与晶合集成签署劳动合同，为晶合集成的员工。其在发行人任职期间形成的技术成果均为执行发行人指派的工作任务，并利用了发行人提供的物质技术条件完成，属于本人在发行人的职务发明，与力晶科技的技术及人员间无任何关系。

3、受让专利部分注册地位于美国的原因

根据专利转让协议以及发行人出具的说明，发行人受让的力晶科技部分专利主要应用于生产显示驱动芯片产品。专利权具有地域性，部分目标客户所生产的终端产品市场涉及美国，为了促进市场拓展和产品推广，同时保证相关专利在美国获得保护，故受让的力晶科技部分专利注册地位于美国，有利于对公司技术的保护。此外，在美国、日本或中国台湾等国家或地区申请专利符合集成电路行业惯例，发行人在美国等重点国家拥有专利权将减少其晶圆代工业务相关的专利风险。

（四）用以转移出资的技术与 90nm M+相关协议约定的技术之间的关系，支付费用获取 90nm M+驱动 IC 制程技术的必要性，非一次性支付的原因，若不购买上述技术公司能否独立开展 90nm 晶圆代工研发及生产

1、用以转移出资的技术与 90nm M+相关协议约定的技术之间的关系，支付费用获取 90nm M+驱动 IC 制程技术的必要性

根据《90nm 项目技术协议》及发行人出具的说明，2018 年初，根据联咏科技需求，公司拟着手生产 90nm 触控与显示驱动整合芯片平台。但公司当时持有的受让于力晶科技技术转让的 90M 平台无法满足联咏科技的产品需求。

因此，为适应市场变化，完成产品更新换代，公司需要在当时拥有的 90M 技术平台上进行技术升级改造。2018 年 4 月 10 日，发行人同力晶科技签订了《90nm 项目技术协议》，约定力晶科技向发行人移转 90nm M+驱动 IC 制程技术相关技术数据及文件，发行人向力晶科技合计支付 500 万美元。

在通过取得 90nm M+相关技术平台后，经发行人技术团队与客户沟通比较，90nm M+相关技术相比发行人自力晶科技技术转移的 90 M 技术，在设计模型、设计元件等方面接近客户的技术标准，但仍不能满足客户的产品设计开发的要求，随后公

司由核心技术人员李庆民带领研发团队对 90nm M+技术平台进行开发改进，同时公司取得了新增第三方 IP 公司力旺电子的 IP 授权，形成了公司核心技术平台 90nm 触控与显示驱动整合芯片平台并实现量产，以满足联咏科技的技术要求。

2、非一次性支付的原因

根据发行人与力晶科技签署《90nm 项目技术协议》中相关条款，非一次性支付为双方协商与技术文件分批次约定交付时间所致，为正常商业安排，具有合理性。

3、若不购买上述技术公司能否独立开展 90nm 晶圆代工研发及生产

若不购买上述技术，晶合亦可独立开展 90nm 晶圆代工研发及生产，但开发时间将至少延后 9 至 12 个月（其中包括工艺设计及开发 6 个月，SPICE 模型提取 3-6 个月），且研发费用预估将增加 600 万美元以上。

（五）力晶科技转让给发行人的相关技术与自身（包括力积电）技术的差异

根据《技术移转协议》《技术转移协议确认函》及发行人出具的说明，晶合集成与力晶科技于 2015 年 10 月 19 日签订了技术移转协议，此次技转均为力晶科技主流技术节点，包括三项制程技术（即 0.15um 大尺寸驱动 IC 及 90nm/0.11um 小尺寸驱动 IC 制程技术），包含专利技术、技术文件及数据以及运用该等技术过程中形成的技术经验等内容。根据发行人与力晶科技的《技术移转完成证明书》，力晶科技于 2018 年 3 月 31 日已完成技转。整体来看，截至双方完成技术转移之日，力晶科技转让给发行人的相关技术与其自身（包括力积电）技术均为当时的 90nm-150nm 主流技术平台，整体无显著差异。

经过三年多发展，考虑到集成电路行业的快速发展进步、不同客户领域的产品需求等方面均有所差异，对设备成本、质量、可靠性、性能等方面的要求各不相同，力晶科技转让给公司的技术在研发、生产和服务方面的成功经验不再完全适用，公司逐步依靠自身研发能力形成 110nm-55nm 的多种工艺平台产品并获得了客户认可。关于目前发行人与力晶科技的技术差异，具体情况详见本补充法律意见书第 4 题之“（一）具体说明公司与力晶科技及其关联企业在晶圆代工业务及技术方面的差异情况”的相关回复。

（六）结合发行人部分高管及核心技术人员曾在力晶科技任职、力晶科技向发行人转让技术、委托经营管理等情况，说明发行人自我研发能力体现在何处，是否对力晶科技构成研发和技术体系依赖，是否具备独立研发能力

根据力晶科技出具的《确认函》及发行人出具的说明，在发行人 10 名高级管理人员和核心技术人员中，有 4 名曾在力晶科技任职。自 2016 年 10 月至今，上述 4 人均在发行人处任职并与公司签署劳动合同，不再在力晶科技及其下属企业担任任何职务。同时，上述 4 人与公司签署了保密及竞业禁止协议，约定员工在工作过程中研发的或利用发行人生产工具制造的任何性质的知识产权均属于员工的职务成果，该等职务成果归属于发行人所有。

《委托经营管理合约》签订后，公司研发部门主要管理岗位包括研发副总、副处长、代副处长。公司研发部门成立于 2018 年 3 月，研发部门人员、研发团队均系公司员工，相关员工利用公司自有资源独立进行研发工作并将自主研发的成果申请专利，累积申请数十项专利，获得 10 项专利授权，力晶科技人员未参与公司技术研发。

报告期内，公司建立生产、销售、采购、财务、行政、企划、研发、内审等各部门，相关部门在董事会、管理层的领导下负责各自职责事项，根据公司经营需要制定经营计划，由公司董事会最终决策；公司自主研发主营业务相关技术，独立开发客户及开拓市场，在实际经营过程中独立承担经营责任和风险；公司在技术、人员、经营、管理等各方面均不存在对力晶科技依赖。

发行人所在晶圆代工行业主要依靠自身的工艺平台技术和客户设计图纸进行匹配，发行人在力晶科技技转的基础上已持续自主研发并创新升级，以满足不同客户针对不同制程节点、不同工艺平台的产品需求，后续的技术发展不需要依赖力晶科技的进一步授权或技术转让，对力晶科技不构成研发和技术体系上的依赖。

公司研发投入及研发人员占比较高，具有较强自主研发能力，公司自设立以来始终重视晶圆代工技术创新与工艺研发，公司通过持续对研发人才的招聘和培养，组建了由境内外资深专家组成的研发核心团队，其拥有在行业内多年的技术研发经验。

发行人的研发团队均为自有员工，不属于力晶科技员工或委派人员，在发行人任职期间形成的技术成果均为独立、自主地执行发行人指派的工作任务，对力晶科技不

构成研发和技术体系上的依赖。

《委托经营管理合约》期间，力晶科技人员未参与公司技术研发，发行人自主研发主营业务相关技术，独立开发客户及开拓市场，在实际经营过程中独立承担经营责任和风险；公司在技术、人员、经营、管理等各方面均不存在对力晶科技依赖。发行人的自我研发能力体现在机制、团队、专利和客户等方面，不依赖于力晶科技的研发和技术体系，在自主研发能力方面具备独立性。

（七）核心技术人员是否存在违反竞业禁止、保密协议的情形，是否使用原任职单位技术成果，是否存在纠纷或潜在纠纷

1、核心技术人员入职发行人的时间及入职前任职情况

根据晶合集成提供的核心技术人员的劳动合同、核心技术人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司核心技术人员调查表》、《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》及核心技术人员出具的声明，经本所律师核查，核心技术人员入职发行人的时间及入职前任职情况如下：

姓名	入职发行人时间	入职前任职情况			
		任职期间	入职前任职单位	职务	离职时间
蔡辉嘉	2016年4月	1992年至1995年5月	华隆微电子股份有限公司	工程师	1995年5月
		1995年6月至2016年6月	力晶科技	历任工程师、课长、代副理、经理、部经理、副处长、副厂长、厂长、协理	2016年6月
詹奕鹏	2019年4月	1997年7月至2001年8月	联华电子股份有限公司	主任工程师	2001年8月
		2001年8月至2018年5月	中芯国际集成电路制造（上	资深技术总监	2018年5月

姓名	入职发行人时间	入职前任职情况			
		任职期间	入职前任职单位	职务	离职时间
		月	海)有限公司		
		2018年5月至2019年4月	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	顾问	2019年4月
邱显寰	2016年6月	1996年6月至2007年6月	力晶科技	历任工程师、黄光工程部副理、黄光工程部经理	2007年6月
		2007年6月至2013年8月	瑞晶电子股份有限公司	历任黄光工程部经理、制程模组工程一处处长	2013年8月
		2013年8月至2015年9月	台湾美光记忆体股份有限公司	历任制程模组工程处处长、新技术处处长	2015年9月
		2015年9月至2016年6月	力晶科技	技术处长	2016年6月
张伟瑾	2016年6月	1995年9月至2013年7月	力晶科技	制造部课长	2013年7月
		2013年8月至2013年12月	台湾美光记忆体股份有限公司	制造部经理	2013年12月
		2013年11月至2016年6月	力晶科技	制造部经理	2016年6月
李庆民	2016年10月	1982年8月至1983年3月	工业技术研究院(光电所)	工程师	1983年3月
		1983年3月	华邦电子股份	制程整合工程	1984年3月

姓名	入职发行人时间	入职前任职情况			
		任职期间	入职前任职单位	职务	离职时间
		至 1984 年 3 月	有限公司	师	
		1984 年 3 月至 1986 年 10 月	台湾茂矽电子股份有限公司	元件开发工程师	1986 年 10 月
		1986 年 10 月至 1987 年 11 月	联瑞电子股份有限公司	副理	1987 年 11 月
		1987 年 10 月至 1989 年 4 月	联华电子有限公司	技术开发副理	1989 年 4 月
		1989 年 4 月至 1989 年 12 月	合泰电子股份有限公司	整合经理	1989 年 12 月
		1989 年 12 月至 2012 年 2 月	联华电子有限公司	历任整合经理、资深经理	2012 年 2 月
		2012 年 2 月至 2016 年 10 月	力晶科技	开发处经理、开发部经理	2016 年 10 月

2、核心技术人员不存在违反竞业禁止、保密协议的情形

根据台湾法律意见书、力晶科技及发行人核心技术人员出具的书面确认、相关离职证明，发行人核心技术人员不存在违反竞业禁止、保密协议的情形。

3、未使用原单位技术成果，与原单位不存在纠纷或潜在纠纷

根据发行人核心技术人员的书面确认，其在发行人任职期间形成的技术成果均为执行发行人指派的工作任务，并利用了发行人提供的物质技术条件完成，属于本人在发行人的职务发明。在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务与在发行人承担的工作任务无关，不存在使用原任职单位技术成果的情形。

根据核心技术人员的书面确认并经检索中国裁判文书网等相关网站，核心技术人员与原任职单位之间不存在纠纷或潜在纠纷。

综上，本所认为，公司核心技术人员不存在违反原任职单位竞业禁止、保密协议的情形，亦不存在使用原任职单位技术成果，核心技术人员与原任职单位不存在纠纷或潜在纠纷。

七、《问询函》第 12.1 题：委托经营管理

根据申报材料：2015 年 10 月，公司与力晶科技签订《委托经营管理合约》，约定公司委托力晶科技进行经营管理，以协助公司执行于合肥新站区建成 12 英寸晶圆制造厂项目。2020 年 1 月 2 日，公司与力晶科技签订终止协议，双方同意自 2019 年 12 月 25 日起即终止《委托经营管理合约》。根据合约约定，力晶科技应将公司视为其工厂之延伸，全力支持公司经营管理，使公司迅速获利、扩充产能并且达到 IPO 的目标。但申报材料中未充分说明《委托经营管理合约》终止前后对发行人经营模式、公司治理、人员结构、技术等方面的变动及影响。

请发行人说明：（1）《委托经营管理合约》签署的背景、主要内容、委托经营管理范围及具体方式，相关条款的具体执行情况，除《委托经营管理合约》及终止协议外，是否还存在其他对委托经营管理事项的约定；（2）合约自 2019 年 12 月 25 日起终止但于 2020 年 1 月 2 日签订终止协议的原因，终止合约是否附带相应条件及期限；（3）各方当事人对于委托经营管理解除是否存在纠纷或潜在纠纷；（4）详细说明《委托经营管理合约》终止前后对发行人经营模式、客户、供应商、技术、日常经营管理等方面的变动及影响，并梳理完善招股说明书相关信息披露情况；（5）报告期内力晶科技如何全力支持公司经营管理，使公司在业务、技术、财务等方面达到 IPO 申报条件。

请保荐机构、发行人律师和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

(一) 《委托经营管理合约》签署的背景、主要内容、委托经营管理范围及具体方式，相关条款的具体执行情况，除《委托经营管理合约》及终止协议外，是否还存在其他对委托经营管理事项的约定

1、《委托经营管理合约》签署的背景

(1) 设立晶合集成的目的系建设合肥市国资方自主可控的芯片制造能力

2014年6月，国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，将集成电路产业发展上升到国家战略层面，纲要指出：“集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业”，要求“加速发展集成电路制造业。以生产线建设带动关键装备和材料配套发展”。

作为国家级科技创新型试点城市，合肥市政府制定了集成电路产业发展规划，并结合自身特色，提出了“芯屏器合”的产业发展战略。2015年，合肥市新型显示产业已形成规模，京东方6代线、8.5代线已投产，10.5代线项目即将开工建设，但芯片产业仍处于起步初期。合肥市拟引进国际知名企业合作设立晶圆代工厂，利用合肥市新型显示产业的协同效应，以显示驱动芯片为切入点，通过面板显示等终端应用带动芯片产业发展。

投资设立发行人的初衷系落实国家集成电路产业发展战略，由合肥国资方主导建设国有控股的芯片制造企业，力晶科技作为合作方协助公司建立独立的运营能力，而非将公司作为力晶科技下属子厂进行管理。

(2) 签订《委托经营管理合约》的目的系促进合作及控制投资风险

根据《合作框架协议》及《投资参股协议》，合肥市政府与力晶科技合作12英寸晶圆制造基地项目，并选定合肥建投为国资方投资平台，设立晶合集成作为项目公司。力晶科技系国际知名的晶圆制造企业，在晶圆制造企业营运方面有较为成熟的经验，且中国台湾地区在晶圆制造行业较为领先，而当时中国大陆拥有晶圆制造行业建厂及营运经验的企业、人才较为稀缺，合肥市国资方亦首次投资晶圆制造项目，对于晶圆制造企业的发展及营运无任何经验。因此，为了使晶合集成项目建成后能够尽快投产、建立独立的营运能力，降低公司的营运风险，合肥国资方拟借助力晶科技的成功经验，并结合行业特点以及中国大陆地区的实际情况，帮助公司完善晶圆制造行业各项制度的落地，建立独立的营运团队，加快公司整体发展，落实合肥市政府与力晶科技签订

的《合作框架协议》的要求及精神。2015年10月19日，力晶科技与公司签订《委托经营管理合约》，主要目的系促进双方合作以及配合技术导入，帮助公司尽快建立独立的营运能力；同时，如发行人出现经营、发展状况不及预期时，合肥国资方也能够约束力晶科技向公司投入更多精力与支持，降低投资风险。

(3) 公司建设进程顺利，双方根据公司发展需求仅履行了《委托经营管理合约》中的部分条款

《委托经营管理合约》签订于双方建立合作意向初期，尽管《委托经营管理合约》的合同名称包含“委托经营”，但签订《委托经营管理合约》的本意系落实《合作框架协议》项下力晶科技导入建厂经验的责任，约束力晶科技帮助公司建立独立的营运能力，协议中并未约定委托经营的期限、委托经营的费用以及相关违约责任等在常规委托经营模式下的约定事项。在实际履行过程中，公司自身经营团队建立的进展顺利，部分为了预防经营、发展状况不及预期而设定的条款已无履行必要，双方仅根据公司发展的需求履行了《委托经营管理合约》中的部分条款，公司与力晶科技之间相互独立，力晶科技未将公司视为在大陆的子厂，公司未将经营管理权委托予力晶科技。

2、《委托经营管理合约》的主要内容、委托经营管理范围及具体方式

《委托经营管理合约》的具体条款如下，其中第一条第一款及第二款对委托管理范围和方式进行了约定：

对应条款	主要内容
第一条第一款 委托经营管理范围	乙方审计师、副总会计师及其他经营管理团队由甲方指派。乙方财务实行总会计师与副总会计师会签及核决制度，采购、销售业务实行总监与副总监会签制度。乙方日常经营运作，包含业务、生产营运、组织人事、技术等皆委托甲方管理。
第一条第二款 经营管理模式	甲方将透过移转与授权技术、移转经营经验与经营管理系统、业务支持互补、移转或派驻经营团队、训练当地之干部与人才等方式，达成乙方付托之经营管理任务。甲方除遴选适当人员至乙方各组织，以兼职、派驻或全职身份按相关组织核决权限执行业务外，乙方董事会下应设立经营管理委员会，由甲方之高管及合肥建投委派至乙方，依第一条第一款所列之全部人员担任委员会成员，具体协助董事会指导并督促乙方所有经理人与经营团队。
第二条第一款	甲方应按照技术移转协议，于乙方建置完成可进行驱动 IC 代工业务

技术移转	之相关技术，确保乙方能够完全掌握该技术，并可在无须另行依赖其他技术的前提下，完整地生产出本项目所涉全部合格产品。
第二条第二款 经营经验导入 与经营管理系 统建立	<p>（一）甲方应将现行于甲方实行，具备效率与竞争力之经营管理经验导入乙方，由乙方人员建置吸收并且在乙方推行，成为乙方的企业文化或 SOP。</p> <p>（二）甲方应将现行于甲方量产，具备竞争力之量产全部参数导入乙方机台，并训练乙方生产与技术人员，达成和甲方一致或超越之效率与生产力。</p> <p>（三）甲方应将现行于甲方运作，具备竞争力之全部经营管理系统，包含但不限于生产管理软件、派工作业、自动化控制生产系统、会计系统、人事系统、签核流程等，导入乙方之计算机系统内，并训练乙方管理人员进行操作与问题解决能力，达成和甲方一致或超越之效率与生产力。</p>
第二条第三款 业务能力建立 与订单互补支 持	<p>（一）针对技术授权之制程技术及代工业务，甲方应协助建立乙方之业务能力，让乙方业务人员运用大陆之优势，开拓并争取业务订单，以达成国产化之目标。</p> <p>（二）当甲方之业务量需求超过甲方产能，且乙方之产能仍可支持时，甲方应移转订单到乙方进行生产。当乙方之业务量超过乙方产能，且甲方产能仍可支持时，乙方应移转订单到甲方。针对代工移转订价，应考虑市场行情、符合法定并且双方互利。</p>
第二条第四款 派驻或经营团 队建立	<p>除技术移转协议规范之技术团队外，甲方应派驻并建立乙方所需之经营管理团队，以执行经营管理职务，类型与相关规定如下：</p> <p>（一）兼职人员：兼职人员系指具备甲方员工身分，但必须于乙方挂职以执行乙方业务之人员。此类人员之薪资由甲方负担，在移转技术验证完成之前，若因执行乙方业务时产生之差旅费及各项费用，由乙方支付。乙方可经过乙方董事会核准，支付该兼职人员薪资补贴。</p> <p>（二）派驻人员：派驻人员系指由乙方雇佣并约定一定期间期满后即结束与乙方聘雇关系之相关人员。派驻人员派驻期间之薪资由乙方负担，派驻期间之相关保险与退休，亦由乙方按照法令予以支付，甲方及乙方可给予相对优惠条件于派驻人员，吸引人员愿意派驻。</p> <p>（三）全职人员：全职人员系指由乙方雇用且正式任职乙方之人员。乙方于法令许可条件下，可以优惠条件吸引甲方相关团队（包含技术人员）成为乙方之全职人员。</p>
第二条 第五款 训练全职或当 地之经营人才	甲方应从各方面促使乙方尽速建立全职或当地之经营人才及员工，以达成经营效率目标。

与员工	
第三条 第一款	甲乙双方同意并了解，甲方与乙方皆为独立之公司，各自执行业务皆须满足各自之法令、公司内稽内控或审计制度、会计制度、组织签核权限等，不能因为人员重复而有混淆。相关精神与原则甲方与乙方须落实倡导，让相关人员得以遵守。
第三条 第二款	乙方所需之各项系统与设备，包含软硬件或劳务服务，若由乙方专用且须支付费用向第三方购买时，由乙方发包采购付款并列为乙方资产。
第三条 第三款	乙方所需有形资产（软硬件系统或设备），若需向甲方购买，则乙方可经过董事会核准后向甲方采购，并列为乙方资产。若乙方所需为甲方之无形资产，甲方应于移转技术验证完成之前无偿移转该无形资产予乙方。
第三条 第四款	本项委托经营乙方除因特别需求并经董事会批准之外，无需向甲方支付本协议约定外的其他任何费用。
第四条 委托经营管理 目标	<p>甲方应将乙方视为甲方工厂之延伸，全力支持乙方之经营管理，使乙方迅速获利、扩充产能并且达成 IPO 之目标。甲方在约定时间内完成以下委托经营管理目标：</p> <p>一、争取乙方于建厂完成后 12 个月内开始获利，并保持持续盈利能力。</p> <p>二、争取乙方于建厂完成后第 13 至 24 个月期间净利润不低于 3 亿元，第 25-36 个月期间净利润不低于 4 亿元，第 27 至 48 个月期间净利润不低于 5 亿元，委托经营期内乙方税前内部收益率不低于 10%。</p> <p>三、争取于建厂完成后的 5 个会计年度内达成乙方于中国大陆资本市场 IPO 需满足的除委托经营事项外的其他基本条件，同时乙方应立即启动中国大陆资本市场 IPO 申报程序。</p> <p>四、甲方承诺为乙方聘雇的大陆员工提供必要培训，并保证建厂完成后 5 年内乙方具备独立经营能力，包括但不限于：</p> <p>资产完整。乙方应具有开展生产经营所必备的完整资产，包括使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产，乙方拥有健全的技术研发、应用能力。</p> <p>人员独立。乙方高级管理人员、经营团队、技术团队等均独立于甲方，为其自行聘雇的全职人员。乙方的劳动、人事及工资管理均完全独立。</p> <p>财务独立。乙方设置独立的财务部门，具有独立的财务核算体系、健全的财务会计管理制度，能够独立核算，独立进行财务决策，已发独</p>

	<p>立纳税。</p> <p>机构独立。乙方的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，甲方及其职能部门与乙方及其职能部门之间不存在上下级关系。</p> <p>业务独立。乙方应独立于甲方，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，具备独立的产、供、销系统，甲、乙双方之间无法避免的关联交易必须遵循市场公正、公平的原则。乙方委托甲方进行产品销售或原材料采购的金额，占其主营业务收入或外购原材料总额的比例均不应超过 30%。</p> <p>上述目标中的第一、二、三项系由甲方依据自身经验与市场现况拟定，实际执行仍须双方进行分析及调研后讨论定案。甲方将努力争取完成上述目标，若因市场变化、营运策略、与产品组合之异动有所增减，得而由双方议定后更改。</p>
<p>第五条 解除委托经营管理合约</p>	<p>本合约有效期自签约生效日起至乙方满足于中国大陆资本市场 IPO 所需除委托经营事项外的其他基本条件之日止。本合约有效期截止后，乙方应立即启动中国大陆资本市场 IPO 申报程序。双方保证在取得其主管机关、董事会及其他法定必要的许可、核准及审批后方签署本合约。甲方应善尽善良管理人责任，依据委托经营管理合约执行管理义务，若单独因甲方未尽委托经营管理职责或有其他违反法律情事致使公司严重亏损，如经乙方要求甲方仍未补正者，乙方可要求终止委托经营管理合约，并追究甲方法律责任。</p>
<p>第六条 保密责任</p>	<p>任一方因履行本合约而知悉或持有他方之机密信息或对于本合约之内容，除依法令而应揭露外，应负保密责任，并非经揭露方书面同意，任一方不得泄露、告知或交付予任何第三人。任一方并应担保其员工或第三方亦遵守此一条款，若任一方或其员工或第三方违反此一条款时，该方应与违反之行为人负连带损害赔偿赔偿责任。本条款于本合约终止或解除后仍有效存在。</p>
<p>第七条 通知</p>	<p>本合约所称各项请求、通知或双方相互之间请求、通知，应以书面为之，并以挂号函件或快递亲签方式送达下列地址：</p> <p>甲方：力晶科技股份有限公司 地址：台湾新竹市科学工业园区力行一路 12 号</p> <p>乙方：合肥晶合集成电路有限公司 地址：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内</p> <p>上述地址如有变更，变更之一方应即通知他方，否则不得以其变更对抗他方。</p>

第八条 违约责任	<p>甲乙任何一方如有不履行或违法本合约规定之任一承诺、保证或约定事项之情事时，经他方提出异议而未于适当期限内改善或补正者，即视为违约。</p> <p>除本合约另有规定外，未违约之一方得径自通知解除或终止本合约书，或（并）对违约之他方请求因违约而产生之损害赔偿。</p>
第九条 准据法	本合约以中华人民共和国法律为准据法。
第十条 仲裁	双方倘因本合约事宜发生争议，同意提交上海国际经济贸易仲裁委员会，依据该会之仲裁规则进行仲裁。双方同意对争议之内容及仲裁之提起、进行、内容、程序、结果，对外应严守秘密。
第十一条 转让	非经他方事前书面同意，本合约任一方当事人不得转让其于本合约之权利或义务之全部或一部予任何第三人，或设定负担或为其他任何处分。
第十二条 本合约份数	本合约正本一式二份，甲方、乙方各执一份存查。

2015年10月，公司与力晶科技签署《委托经营管理合约》的同时，合肥建投与力晶科技签署了《投资参股协议》，其中亦对落实力晶科技导入晶圆代工厂建设经营，协助公司建立经营管理团队，以及双方向公司委派高级管理人员共同对公司生产经营实施监督进行了约定，并在后续签订的《公司章程》《合资合同》中予以沿用。具体条款如下：

文件名称及 签订主体	签订时间	具体内容	终止情况
《投资参股协议》，其中：甲方为合肥建投、乙方为力晶科技	2015年 10月	<p>第五条第二款 团队组成</p> <p>甲乙双方同意，由乙方指派经营团队管理与主导晶合集成所有营运，包括但不限于建厂、技术导入、量产、公司经营等事项。</p> <p>由甲方指派总会计师、财务部门负责人，由乙方指派审计师、副总会计师。此外，甲方指派采购副总监、销售副总监各1位，其余经营团队及经理人皆由乙方指派。</p> <p>乙方应指派专属团队，常驻于合资公司协助营运，乙方指派其员工派驻执行相关业务时，合</p>	2021年 3月，双方签订《投资参股协议之补充协议》，相关条款均已终止。

		<p>资公司可制定相关补贴标准，经董事会核准后，对特定员工给予补贴。未来常驻团队将逐步转为合资公司全职员工，由其直接聘录（相关规定细节亦由《委托经营管理合约》约定）。</p> <p>叁方指派高管或经理人时必须依照合资公司之公司制度，依叁方在本合约中针对董事会及管理团队之约定，通过相关程序并取得相关核准后才可就任。</p>	
《公司章程》，由合肥芯屏、合肥建投、力晶科技共同签署	2016年1月20日	<p>第33条 合资公司的管理机构由以下高级管理人员组成：一名总经理、若干名副总经理，总会计师、审计师、副总会计师、采购副总监及销售副总监各一名，合资合同规定的其他高级管理人员以及视合资公司的经营需要由董事会不时任命的其他高级管理人员</p>	2020年11月，公司改制为股份有限公司，全体股东签署了新的《公司章程》，前述条款均已终止
《合资合同》，其中：甲方为合肥芯屏，乙方为力晶科技，丙方为合肥建投	2016年1月20日	<p>8.1 组建</p> <p>甲乙丙叁方同意，由乙方指派经营团队管理与主导合资公司所有营运，包括但不限于建厂、技术导入、量产、公司经营等事项。</p> <p>合资公司的管理机构由以下高级管理人员组成：一名总经理、若干名副总经理、并由甲方及丙方共同指派总会计师、财务部门负责人，由乙方指派审计师、副总会计师。此外，甲方及丙方共同指派采购副总监、销售副总监各1位，其余经营管理团队及经理人皆由乙方指派。</p> <p>乙方应指派专属团队，常驻于合资公司协助营运，乙方指派其员工派驻执行相关业务时，合资公司可制定相关补贴标准，经董事会核准后，对特定员工给予补贴。未来常驻团队将逐步转为合资公司全职员工，由其直接聘录（相关规定细节亦由《委托经营管理合约》约定）。</p> <p>叁方指派高管或经理人时必须依照合资公司之</p>	2020年11月，公司改制为股份有限公司前，各方签署《关于合肥晶合集成电路有限公司之〈合资合同〉之终止协议》，《合资合同》已终止

		公司制度，依叁方在本合约中针对董事会及管理团队之约定，通过相关程序并取得相关核准后才可就任。	
--	--	--	--

3、相关条款的具体执行情况

根据发行人自设立以来历次董事会会议记录、经营管理委员会会议记录、部分发行人日常经营性会议的会议记录、发行人员工花名册及部分员工合同、发行人组织机构图及审批权限表、力晶科技及合肥建投向发行人委派人员的名单、自力晶科技入股以来发行人全部台籍员工的名单、曾在力晶科技任职员工的名单、力晶科技出具的《确认函》以及发行人出具的说明等资料，并经本所律师访谈发行人主要客户、供应商，相关条款的具体执行情况如下：

(1) 第一条第一款“委托经营管理范围”的具体执行情况

本条款主要目的系约定委托经营管理范围，明确双方权利义务。力晶科技通过委派高管人员，对公司生产经营实施监督，防止控股股东滥用控股地位；同时导入力晶科技在晶圆代工厂方面已较为成熟的各项制度，控制公司经营风险。具体执行情况如下：

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
1	<p>条款内容：</p> <p>乙方审计师、副总会计师由甲方指派</p> <p>具体执行情况：</p> <p>合肥建投通过委派总会计师对下级控股企业的财务方面进行监督与管理，力晶科技为保障其作为小股东对公司财务状况的知情权以及共同对公司的运营情况进行监督，要求向公司委派审计师、副总会计师。该等约定在《投资参股协议》以及后续签订的《合资合同》、《公司章程》中亦有体现。股东双方委派高管参与管控、监督合资企业运营为国有企业与外资企业合资时的通常约定，非为委托经营特别约定事项。</p> <p>①《委托经营管理合约》签订后，公司内审部门主要管理岗位包括审计师、副审计师。《委托经营管理合约》签订后初期，公司的审计师由力晶科技委派，未设置副审计师；自 2019 年 1 月起，改由合肥建投委派审计师、力晶科技委派副审计师。上述委派安排系双方股东依</p>	实际履行

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
	<p>据《投资参股协议》的约定，共同对公司的运营情况进行监督。</p> <p>②《委托经营管理合约》签订后，公司财会部门主要管理岗位包括总会计师、副总会计师，总会计师由合肥建投委派，副总会计师由力晶科技委派。上述委派安排系双方股东依据《投资参股协议》的约定，保障力晶科技作为小股东对公司财务状况的知情权。</p> <p>由于上述条款并非为委托经营特别约定事项，《委托经营管理合约》终止后，双方股东均继续依照《投资参股协议》、《合资合同》、《公司章程》向公司委派相关人员。2020年3月，经双方股东协商一致，不再向公司委派上述岗位人员。</p>	
2	<p>条款内容：</p> <p>其他经营管理团队由甲方指派</p> <p>具体执行情况：</p> <p>根据《投资参股协议》的约定，合肥建投向发行人委派总会计师、销售副总监、采购副总监，力晶科技向发行人委派副总会计师、审计师，其余经营团队、经理由力晶科技指派。本条款仅重申《投资参股协议》中关于委派经营管理团队的约定，主要目的是如发行人出现经营、发展状况不及预期时，合肥国资方也能够约束力晶科技向公司投入更多精力与支持，非为委托经营特别约定事项。</p> <p>《委托经营管理合约》签订后，力晶科技根据《投资参股协议》的约定，向发行人先后委派了审计师、副审计师、副总会计师，并短期派驻了财务、行政及组织人事相关人员，向发行人传授晶圆代工厂运营经验，以及帮助发行人落地、改善相关内控制度。除上述外，公司其他经营管理团队均为发行人员工或合肥建投委派人员。</p>	未实际履行
3	<p>条款内容：</p> <p>乙方财务实行总会计师与副总会计师会签及核决制度</p> <p>具体执行情况：</p> <p>为满足合肥建投作为国有企业对下级控股企业的管理要求，同时保障力晶科技作为小股东对公司财务状况的知情权，双方在《投资参股协议》中约定由合肥建投委派总会计师，力晶科技委派副总会计师。本条为落实双方合资安排的具体措施，非为委托经营特别约定事项。</p> <p>《委托经营管理合约》签订后，合肥建投委派的总会计师和力晶科技委派的副总会计师共同执行会签及核决制度。由于上述条款并非为委托经营特别约定事项，《委托经营管理合约》终止后，双方股东均继</p>	实际履行

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
	<p>续依照《投资参股协议》、《合资合同》、《公司章程》向公司委派总会计师、副总会计师，并实行会签及核决制度。</p> <p>2020年3月，经双方股东协商一致，不再向公司委派上述岗位人员，公司财务决策由负责分管的高级管理人员按照公司章程的约定履行内部决策程序，不再实行总会计师与副总会计师会签及核决制度。</p>	
4	<p>条款内容：</p> <p>乙方采购、销售业务实行总监与副总监会签制度</p> <p>具体执行情况：</p> <p>合肥建投通过委派采购、销售岗位高级管理人员对下级控股企业采购、销售方面进行监督，该等约定在《投资参股协议》以及后续签订的《合资合同》、《公司章程》中亦有体现。合肥建投委派高管参与管控、监督合资企业运营为国有企业与外资企业合资时的通常约定，非为委托经营特别约定事项。</p> <p>《委托经营管理合约》签订后，采购总监和销售总监均由公司员工担任，与合肥建投委派的采购副总监和销售副总监共同实行会签制度，力晶科技在采购和销售业务方面均未委派人员。由于上述条款并非为委托经营特别约定事项，《委托经营管理合约》终止后，合肥建投继续依照《投资参股协议》、《合资合同》、《公司章程》向公司委派采购副总监、销售副总监并实行会签制度。</p> <p>2020年3月，经双方股东协商一致，不再向公司委派上述岗位人员，公司采购、销售业务决策由负责分管的高级管理人员按照公司章程的约定履行内部决策程序，不再实行总监与副总监会签制度。</p>	实际履行
5	<p>条款内容：</p> <p>乙方日常经营运作，包含业务、生产营运、组织人事、技术等皆委托甲方管理</p> <p>具体执行情况：</p> <p>《委托经营管理合约》签订后，发行人日常经营运作由财会部门、内审部门、销售部门、采购部门、营运部门、行政及组织人事部门、研发部门等具体负责。其中，财会部门、内审部门情况详见前款“乙方审计师、副总会计师由甲方指派”的具体执行情况，其他部门主要管理岗位的人员情况如下：</p> <p>①公司销售部门负责人为销售总监（总经理兼任），由公司员工担任；销售副总监由合肥建投委派。不存在力晶科技委派人员在公司销</p>	未实际履行

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
	<p>售相关岗位任职，或参与公司销售工作的情形。</p> <p>②公司采购部门负责人为采购总监，由公司员工担任；采购副总监由合肥建投委派。不存在力晶科技委派人员在公司采购相关岗位任职，或参与公司采购工作的情形。</p> <p>③公司营运部门负责人为营运副总经理，主要管理岗位均由公司员工担任，不存在力晶科技委派人员在公司营运相关岗位任职，或参与公司营运工作的情形。</p> <p>④公司行政及组织人事部门负责人为行政副总经理，力晶科技曾于2017年8月至2018年5月期间，短期向发行人委派行政副总经理，在帮助发行人落地、改善相关制度后即返回力晶科技，后续该岗位由公司员工或合肥建投委派人员任职。除上述情况外，不存在力晶科技委派人员在公司行政及组织人事相关岗位任职，或参与公司行政及组织人事工作的情形。</p> <p>⑤公司研发部门负责人为研发副总经理，主要管理岗位均由公司员工担任，不存在力晶科技委派人员在公司研发相关岗位任职，或参与公司研发工作的情形。</p>	

在公司设立并开始经营后，自2016年起发行人自行聘用员工，在较短时间内建立了经营团队，已具备公司运营的各方面能力，不存在要求力晶科技派驻专属团队协助公司营运的需求和必要性。除双方股东依据《公司章程》《合资合同》的约定委派人员外，发行人其他高级管理人员均由公司员工担任。发行人的日常经营运作仍以发行人自身员工和合肥国资方委派高管为主导，未将日常经营运作委托力晶科技管理。因此，上表中所述《委托经营管理合约》部分约定未实际履行。

(2) 第一条第二款“经营管理模式”的具体执行情况

本条款主要目的系约定委托经营管理模式，明确双方权利义务，督促力晶科技协助发行人在设立初期加快吸纳晶圆代工行业人才、建立运营团队，并以其在晶圆代工领域的成功经验为发行人提供咨询。具体执行情况如下：

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
1	<p>条款内容： 甲方将透过移转与授权技术、移转经营经验与经营管理系统、业务支</p>	部分履行

	<p>持互补、移转或派驻经营团队、训练当地之干部与人才等方式，达成乙方付托之经营管理任务</p> <p>具体执行情况：</p> <p>《委托经营管理合约》签订后，力晶科技与发行人签订《90nm 项目技术协议》，向发行人移转 90nm M+驱动 IC 制程技术相关技术数据及文件。此外，力晶科技在公司建厂初期，协助公司招聘了一批中国台湾地区具有晶圆制造行业相关经验的人才，委派部分管理人员协助公司结合晶圆制造行业经验及中国大陆特点，完成财务、内部控制及稽核等制度的落地。</p> <p>《委托经营管理合约》签订后，力晶科技未同发行人进行业务互补支持，详见本补充法律意见书第 12.4 题“订单互补支持”的相关回复</p>	
2	<p>条款内容：</p> <p>甲方除遴选适当人员至乙方各组织，以兼职、派驻或全职身份按相关组织核决权限执行业务外，乙方董事会下应设立经营管理委员会，由甲方之高管及合肥建投委派至乙方，依第一条第一款所列之全部人员担任委员会成员，具体协助董事会指导并督促乙方所有经理人与经营团队</p> <p>具体执行情况：</p> <p>2018 年 12 月，发行人实际设立经营管理委员会，通过经营管理委员会为公司董事会提供咨询。《委托经营管理合约》终止时，发行人同步解散了经营管理委员会</p>	实际履行

上表中所述《委托经营管理合约》中关于“业务支持互补”的约定未实际履行。双方设置“业务支持互补”约定，主要目的系表达双方的友好合作关系及长期合作愿景，同时，如发行人出现经营、发展状况不及预期时，合肥国资方也能够约束力晶科技向公司投入更多精力与支持。《委托经营管理合约》签订后，发行人日常经营运作仍以发行人自身员工和合肥国资方委派的高管为主导，在公司经营团队的努力及合肥国资方的积极协调下，公司在产品验证、业务拓展方面进展顺利，建立了独立的业务开拓能力。同时，随着发行人产能的逐步释放，发行人业务经营状况良好，公司出于独立经营的考虑亦未要求力晶科技提供业务方面的支持。因此“业务支持互补”的约定未实际履行。

（3）第二条第一款“技术移转”的具体执行情况

主要目的系重申并督促力晶科技履行《技术移转协议》项下的技术移转相关义务，使力晶科技用于出资的制程技术能尽快在发行人处落地、量产。具体执行情况如下：

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
1	条款内容： 甲方应按照技术移转协议，于乙方建置完成可进行驱动 IC 代工业务之相关技术，确保乙方能够完全掌握该技术，并可在无须另行依赖其他技术的前提下，完整地生产出本项目所涉全部合格产品。	实际履行
	具体执行情况： 2015 年 10 月，发行人、合肥建投与力晶科技签订《技术移转协议》，系与《委托经营管理合约》同期签署。力晶科技以专利技术使用权出资的相关情况，详见本补充法律意见书第 2 题之“（一）专利技术使用权出资的背景及具体情况，是否存在期限即将届满的专利，相关专利技术使用权作价 20 亿元的评估定价依据，是否存在利益输送，增资后力晶科技能否继续使用或授予其他方使用”的相关回复。	

（4）第二条第二款“经营经验导入与经营管理系统建立”的具体执行情况

本条款主要目的系重申并督促力晶科技履行《技术移转协议》项下的技术转移相关义务，加快力晶科技协助发行人落地相应的晶圆代工厂运营管理制度。具体执行情况如下：

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
1	条款内容： （一）甲方应将现行于甲方实行，具备效率与竞争力之经营管理经验导入乙方，由乙方人员建置吸收并且在乙方推行，成为乙方的企业文化或 SOP。	实际履行
	具体执行情况： 力晶科技为发行人提供了晶圆代工厂运营管理制度作为参考，并短期委派人员结合中国大陆实际情况，帮助发行人落地、改善相关制度的运作。	
2	条款内容： （二）甲方应将现行于甲方量产，具备竞争力之量产全部参数导入乙方机台，并训练乙方生产与技术人员，达成和甲方一致或超越之	实际履行

	效率与生产力。	
	<p>具体执行情况：</p> <p>力晶科技依据《技术移转协议》向发行人转移相关制程技术，并组织了相关培训，训练发行人生产及技术人员。</p>	
3	<p>条款内容：</p> <p>（三）甲方应将现行于甲方运作，具备竞争力之全部经营管理系统，包括但不限于生产管理软件、派工作业、自动化控制生产系统、会计系统、人事系统、签核流程等，导入乙方之计算机系统内，并训练乙方管理人员进行操作与问题解决能力，达成和甲方一致或超越之效率与生产力。</p>	实际履行
	<p>具体执行情况：</p> <p>力晶科技向发行人提供了相关经营管理系统作为参考，并结合中国大陆实际情况，组织了相关培训，训练发行人管理人员，帮助落地、改善相关生产、会计、人事管理系统及签核流程等。</p>	

(5) 第二条第三款“业务能力建立与订单互补支持”的具体执行情况

本条款主要目的系为了配合技术移转完成时产品验证，督促力晶科技协助发行人在设立初期快速形成业务能力，具体执行情况如下：

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
1	<p>条款内容：</p> <p>针对技术授权之制程技术及代工业务，甲方应协助建立乙方之业务能力，让乙方业务人员运用大陆之优势，开拓并争取业务订单，以达成国产化之目标</p>	发行人设立初期，阶段性部分履行
	<p>具体执行情况：</p> <p>发行人建设初期，在技术移转和产品验证的过程中，力晶科技负责将与发行人客户奇景光电和奕力科技涉及技术移转的相关 PDK（制造工艺设计包）、制程资料等技术文件和数据资料移转至发行人，以此完成发行人初期产品和工艺平台的验证，而后续与该等客户谈判、确定合作、试产、风险量产、量产以及后续客户关系维护等均由发行人独立完成。除上述两家客户外，发行人其他客户均为独立开发。具体情况详见本补充法律意见书第 12.4 题“订单互补支持”的相关回复。</p>	

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
2	条款内容： 当甲方之业务量需求超过甲方产能，且乙方之产能仍可支持时，甲方应移转订单到乙方进行生产。当乙方之业务量超过乙方产能，且甲方产能仍可支持时，乙方应移转订单到甲方。针对代工移转订价，应考虑市场行情、符合法定并且双方互利	未实际履行
	具体执行情况： 未实际履行	

在公司设立并开始经营后，自 2016 年起发行人自行聘用员工，在较短时间内建立了经营团队，在产品验证、业务拓展方面进展顺利。除双方股东依据《公司章程》《合资合同》的约定委派人员外，发行人其他高级管理人员均由公司员工担任。发行人的日常经营运作仍以发行人自身员工和合肥国资方委派高管为主导，且随着发行人产能的逐步释放，发行人业务经营状况良好，具备了自主开展业务经营及开拓客户的能力，公司出于独立经营的考虑亦未要求力晶科技提供业务方面的支持。

因此，在发行人设立初期，力晶科技协助发行人完成产品验证后，双方未再履行“协助建立乙方之业务能力”的约定，“订单互补支持”的相关约定未实际履行。

（6）第二条第四款“派驻或经营团队建立”的具体执行情况

本条款主要目的系督促力晶科技协助发行人在设立初期加快吸纳晶圆代工行业人才、建立运营团队。

根据《委托经营管理合约》，力晶科技应派驻并建立发行人所需之经营管理团队，类型包括兼职人员、派驻人员及全职人员。《委托经营管理合约》签订后，力晶科技向公司派驻的各类型人员情况如下：

① 兼职人员

序号	姓名	所在部门	职务	任职期间	具体负责工作
1	张天桂	会计部	部经理	2016年8月至2017年7月	结合中国大陆实

序号	姓名	所在部门	职务	任职期间	具体负责工作
2	庄惠雯		课长	2016年7月至2017年10月	实际情况，帮助公司落地、改善相关制度的运作
3	任芬圣	财务部	部经理	2016年7月至2017年3月	
4	刘荫	总经理室	行政副总经理	2017年8月至2018年5月	
5	陈美华	稽核室	审计师	2016年7月至2018年5月	帮助公司完善内部控制，提高公司内部审计工作质量及能力
6	潘炯升		审计师/处长	2017年12月至2018年12月	
7	林士然		副审计师	2019年1月至2020年3月	
8	陈央珠	财务副总经理室	副总会计师	2016年6月至2016年12月	参与公司财务事项审批流程，对公司财务情况进行了解
9	邱垂源			2017年1月至2019年3月	
10	李洵谕			2018年12月至2020年3月	

上述兼职人员所在岗位分为短期兼职岗位和长期兼职岗位两类。：（1）张天桂、庄惠雯、任芬圣、刘荫所在岗位为短期兼职岗位，帮助公司落地、改善相关制度后即返回力晶科技，后续该等岗位由公司自行招聘的员工任职；（2）陈美华、潘炯升、陈央珠、林士然、邱垂源、李洵谕所在岗位为长期兼职岗位，该等岗位人员系力晶科技根据《投资参股协议》向公司委派。力晶科技向公司派驻委派审计师、副总会计师岗位人员，一方面该等人员能结合晶圆制造行业的行业特点，帮助公司提高内部控制和稽核能力，传授晶圆制造行业财务核算经验，另一方面力晶科技可通过该等人员对公司财务状况和内部控制进行实现监督，防止控股股东滥用控股地位。其中，林士然、李洵谕已于2020年3月与力晶科技解除劳动关系，成为公司员工并与公司签订劳动合同；其他人员离职后返回力晶工作。

② 派驻人员

派驻人员系指由晶合集成雇佣并约定一定期间期满后即结束与公司聘雇关系的相关人员，派驻期间其薪资由晶合集成负担。公司未向力晶科技雇佣派驻人员。

③ 全职人员

全职人员系指由晶合集成雇用且正式任职于公司的人员。公司作为新设立的晶圆代工厂，存在招聘中国台湾地区具有晶圆代工行业工作经验人才的迫切需求，因此双方在《委托经营管理合约》中约定了全职人员相关条款。实际操作层面，力晶科技在入股晶合集成后，向其内部员工告知在中国大陆合资成立公司的信息，部分员工考虑到新设公司有更好的薪酬待遇以及晋升空间，报名来中国大陆工作，加入发行人并与发行人签订了劳动合同，合同中不存在返回力晶科技及其关联方工作的相关条款。该等员工自力晶科技离职后，与力晶科技或其关联方不存在劳动关系、雇佣关系或其他管控关系。

除上述“全职人员”外同时，公司也通过自行在中国台湾地区相关招聘网站上刊登了招聘信息等方式，自行招聘台籍员工。2016年11月前，相关台籍员工由力晶科技人员负责代为面试，面试合格后与晶合集成签订劳动合同；2016年11月后，台籍员工由公司人资部门自行面试。

从长期稳定发展的角度，公司更倾向于选择愿意长期在公司工作的员工。因此，公司未向力晶科技雇佣一定期间期满后即结束与公司聘雇关系的派驻人员，亦未在自愿加入发行人的台籍员工的劳动合同中约定返回力晶科技及其关联方工作的相关条款。

(7) 第二条第五款“训练全职或当地之经营人才与员工”的具体执行情况

本条款的主要目的系督促力晶科技协助发行人在设立初期完善人才队伍，提升经营团队在晶圆制造行业的经验及能力，具体执行情况如下：

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
1	条款内容： (一) 甲方应从各方面促使乙方尽速建立全职或当地之经营人才及员工，以达成经营效率目标。	实际履行
	具体执行情况： 根据《委托经营管理合约》，力晶科技在发行人设立初期协助发行人招募了一批具有晶圆制造行业经验的员工，并应发行人需求，组织了相关培训，训练发行人生产及技术人员。	

(8) 第三条关于公司独立性相关条款的具体执行情况

本条款的主要目的系强调公司与力晶科技之间应在制度、资产、财务等各方面相互独立，避免力晶科技干预公司经营，具体执行情况如下：

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
1	<p>条款内容：</p> <p>一、甲乙双方同意并了解，甲方与乙方皆为独立之公司，各自执行业务皆须满足各自之法令、公司内稽内控或审计制度、会计制度、组织签核权限等，不能因为人员重复而有混淆。相关精神与原则甲方与乙方须落实倡导，让相关人员得以遵守。</p> <p>二、乙方所需之各项系统与设备，包含软硬件或劳务服务，若由乙方专用且须支付费用向第三方购买时，由乙方发包采购付款并列为乙方资产。</p> <p>三、乙方所需有形资产（软硬件系统或设备），若需向甲方购买，则乙方可经过董事会核准后向甲方采购，并列为乙方资产。若乙方所需为甲方之无形资产，甲方应于移转技术验证完成之前无偿移转该无形资产予乙方。</p> <p>四、本项委托经营乙方除因特别需求并经董事会批准之外，无需向甲方支付本协议约定外的其他任何费用。</p> <p>具体执行情况：</p> <p>一、公司与力晶科技拥有各自独立的内部管理体系，力晶科技未将公司视为在中国大陆的子厂，公司与力晶科技之间不存在管理上的上下级关系，双方均独立运营。</p> <p>二、公司购买的各项系统与设备，均由公司支付费用，并列为公司资产，不存在与力晶科技共用或混同的情形。</p> <p>三、公司购买设备、软硬件系统时，均由公司按照内部流程决策，并列为公司资产，不存在与力晶科技共用或混同的情形。</p> <p>四、公司未向力晶科技支付委托经营相关费用。</p>	实际履行

（9）第四条“委托经营管理目标”的具体执行情况

双方约定经营目标，主要系因 2015 年时晶圆代工行业发展势态良好，出于合作初期对于公司能够尽快投产的良好预期，按照公司满产后的产能进行了估算，约定了经营目标。同时，双方在合作初期即明确公司系独立运营的主体，以及未来将在中国大陆上市的目标，力晶科技在《委托经营管理合约》项下的主要作用为协助公司建立独

立的运营能力，而非将公司作为力晶科技下属子厂进行管理，在协助公司建立运营能力的同时要求力晶科技需确保公司在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性。

本条款的具体执行情况如下：

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
1	<p>条款内容：</p> <p>一、争取乙方于建厂完成后 12 个月内开始获利，并保持持续盈利能力。</p> <p>二、争取乙方于建厂完成后第 13 至 24 个月期间净利润不低于 3 亿元，第 25-36 个月期间净利润不低于 4 亿元，第 27 至 48 个月期间净利润不低于 5 亿元，委托经营期内乙方税前内部收益率不低于 10%。</p>	未实际履行
	<p>具体执行情况：</p> <p>公司于 2017 年 10 月正式量产（建厂完成）。报告期内，公司年产能分别为 7.49 万片、18.21 万片和 26.62 万片，截至报告期末，发行人尚未达成满产，尚未形成盈利。</p>	
2	<p>条款内容：</p> <p>三、争取于建厂完成后的 5 个会计年度内达成乙方于中国大陆资本市场 IPO 需满足的除委托经营事项外的其他基本条件，同时乙方应立即启动中国大陆资本市场 IPO 申报程序。</p>	实际履行
	<p>具体执行情况：</p> <p>公司于 2020 年下旬启动上市计划，于 2020 年 11 月完成股份改制，于 2021 年 3 月召开股东大会，审议通过本次发行上市相关议案，并于 2021 年 5 月向上交所提交了上市申请。</p>	
3	<p>条款内容：</p> <p>四、甲方承诺为乙方聘雇的大陆员工提供必要培训，并保证建厂完成后 5 年内乙方具备独立经营能力，包括但不限于：</p> <p>资产完整。乙方应具有开展生产经营所必备的完整资产，包括使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产，乙方拥有健全的技术研发、应用能力。</p> <p>人员独立。乙方高级管理人员、经营团队、技术团队等均独立于甲方，为其自行聘雇的全职人员。乙方的劳动、人事及工资管理均完全独立。</p> <p>财务独立。乙方设置独立的财务部门，具有独立的财务核算体系、健</p>	实际履行

	<p>全的财务会计管理制度，能够独立核算，独立进行财务决策，已发独立纳税。</p> <p>机构独立。乙方的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，甲方及其职能部门与乙方及其职能部门之间不存在上下级关系。</p> <p>业务独立。乙方应独立于甲方，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，具备独立的产、供、销系统，甲、乙双方之间无法避免的关联交易必须遵循市场公正、公平的原则。乙方委托甲方进行产品销售或原材料采购的金额，占其主营业务收入或外购原材料总额的比例均不应超过 30%。</p>	
	<p>具体执行情况：</p> <p>发行人已具备独立经营能力，且资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，详见本问询函回复“问题 12.6 请发行人结合上述委托经营管理、委派管理人员、与力晶科技之间的技术出资及转让、订单互补支持、社保缴纳等相关事项，说明发行人是否符合《注册管理办法》第十条和第十二条的规定”之“发行人符合《注册管理办法》第十二条规定的相关条件”。</p>	

第四条第一款、第二款未实际履行的原因主要系：①2015 年双方合作初期，基于对公司建设进度的预期以及力晶科技能够为公司提供业务支持的前提，确定的盈利目标；②公司设立并开始经营后，在较短时间内建立了经营团队，已具备公司运营的各方面能力，出于独立经营的考虑，公司未要求力晶科技提供业务方面的支持，通过自身经营团队开展业务。综上，公司根据业务需求及自身运营能力逐步提升产能，从量产至满产的过程比 2015 年时各方预期的时间长，导致公司实际盈利情况与 2015 年时各方预期情况存在差异。

（10）《委托经营管理合约》其他条款的具体执行情况

《委托经营管理合约》其他条款不涉及“委托经营”相关的权利义务，均系合同常规条款，双方在《委托经营管理合约》履行过程中未发生纠纷。

（11）《投资参股协议》《公司章程》《合资合同》相关条款的具体执行情况

本条款主要目的系重申由力晶科技协助公司建立独立运营能力的安排，促进双方合作，降低投资风险。同时，股东双方按照国有企业与外资企业合资时的通常约定，明确了双方委派高管参与管控、监督合资企业运营。

2016年2月力晶科技入股后，公司变更为中外合资经营企业，合肥建投、力晶科技分别向公司委派了高级管理人员，但公司运营未由力晶科技委派经营管理团队主导，具体情况详见本条前款“第一条第一款‘委托经营管理范围’的具体执行情况”。

4、除《委托经营管理合约》及终止协议外，是否还存在其他对委托经营管理的约定

根据合肥建投、力晶科技出具的《确认函》，除《委托经营管理合约》及终止协议外，公司与合肥建投及公司与力晶科技之间不存在其他对委托经营管理的约定。

(二) 合约自 2019 年 12 月 25 日起终止但于 2020 年 1 月 2 日签订终止协议的原因，终止合约是否附带相应条件及期限

根据力晶科技出具的确认函并经本所律师访谈发行人董事会秘书，2019年末，由于公司各部门、人员配置已相对完善，业务能力及经营管理系统建立等各方面均稳步推进，《委托经营管理合约》中约定的“技术移转”“经营经验导入与经营管理系统建立”“派驻或经营团队建立”等内容均已完成，仅经营管理委员会仍在实行；而经营管理委员会作为董事会幕僚机构，仅为公司提供经营咨询与支持。而力晶科技进行业务重组后，转型为控股型公司，为公司提供咨询的能力和意愿均减弱，具体详见本补充法律意见书第 12.2 题之“（三）经营管理委员会的具体人员构成、运作情况及实际发挥的作用，与发行人董事会、股东（大）会之间的关系”的相关回复。

基于上述因素，双方于 2019 年 12 月经协商就终止《委托经营管理合约》事宜达成一致，确定于 2019 年 12 月 25 日终止《委托经营管理合约》，终止合约未附带相应条件及期限。由于中国大陆与中国台湾地区之间文件邮寄需要一定时间，因此最终协议签署落款日期为 2020 年 1 月 2 日。

2021 年 6 月，发行人、力晶科技分别出具确认函，确认签订《委托经营管理合约之终止协议》系双方真实意思表示，原协议自 2019 年 12 月 25 日起即完全终止，终止合约未附带相应条件及期限。

(三) 各方当事人对于委托经营管理解除是否存在纠纷或潜在纠纷

2021 年 6 月，发行人、力晶科技分别出具确认函，确认签订《委托经营管理合约

之终止协议》系双方真实意思表示，双方对于委托经营理解除不存在纠纷或潜在纠纷。

（四）详细说明《委托经营管理合约》终止前后对发行人经营模式、客户、供应商、技术、日常经营管理等方面的变动及影响，并梳理完善招股说明书相关信息披露情况

1、经营模式

经核查，发行人自 2017 年 10 月正式量产以来，经营模式一直为晶圆代工模式，《委托经营管理合约》终止前后，发行人的生产模式、采购模式、研发模式、营销模式、销售模式等未发生变化。《委托经营管理合约》终止前后，发行人的经营模式具体详见《招股说明书（申报稿）》“第六节业务与技术”之“一、公司的主营业务、主要产品及服务”之“（四）主要经营模式”。

2、客户、供应商

报告期内，发行人主要客户、供应商均为境内外知名半导体行业设计公司、相关领域境内外知名公司，均系发行人独立开发、谈判、维护，发行人已与主要客户、供应商建立了长期稳定的合作关系，并与部分主要客户、供应商签署了长期合作协议，不存在因为终止《委托经营管理合约》而造成客户流失或影响发行人采购的情形，《委托经营管理合约》终止未影响发行人与上述客户、供应商之间的业务合作，对于发行人客户、供应商稳定性与业务持续性方面没有影响。

3、技术

自设立以来，发行人的主营业务始终为 12 英寸半导体晶圆代工服务，目前已实现 150nm 至 90nm 制程节点的 12 英寸半导体晶圆代工平台的量产，已具备 DDIC 等工艺平台的量产能力。报告期内，公司研发团队均系公司员工，相关研发人员利用公司自有资源独立进行研发工作，力晶科技人员未参与公司技术研发。《委托经营管理合约》终止前后，发行人新产品、项目均在正常研发过程中，《委托经营管理合约》终止对于发行人技术方面没有影响。

4、日常经营管理

《委托经营管理合约》签订后，发行人未将经营管理权委托予力晶科技，发行人的经营运作仍以发行人自身员工或合肥建投委派高管为主导。《委托经营管理合约》终止前后，发行人日常经营管理方面未发生重大变化，《委托经营管理合约》终止对于发行人日常经营管理没有影响。

（五）报告期内力晶科技如何全力支持公司经营管理，使公司在业务、技术、财务等方面达到 IPO 申报条件

经核查，使发行人达到 IPO 申报条件系合肥国资方与力晶科技的共同目标之一，题述条款系双方在《合作框架协议》《投资参股协议》等相关协议中对该目标进行了明确。报告期内，力晶科技主要通过股东大会、董事会决策层面支持发行人经营管理，在业务、技术、财务方面向发行人提供的主要支持如下：

1、业务方面

发行人建设初期，在技术移转和产品验证的过程中，力晶科技负责将与发行人客户奇景光电和奕力科技涉及技术移转的相关 PDK（制造工艺设计包）、制程资料等技术文件和数据资料移转至发行人，以此完成发行人初期产品和工艺平台的验证，而后续与该等客户谈判、确定合作、试产、风险量产、量产以及后续客户关系维护等均由发行人独立完成。具体情况详见本补充法律意见书第 12.4 题“订单互补支持”的相关回复。除上述情况外，发行人的其他客户、供应商均由发行人独立开发、谈判、维护，不存在力晶科技或其委派人员参与发行人日常业务经营的情况。

2、技术方面

报告期内，力晶科技与发行人签署《90nm 项目技术协议》，力晶科技将相关技术数据及文件转让予发行人；力晶科技同发行人签署前述协议有利于发行人完成产品更新换代，在当时拥有的 90M 技术平台上进行技术升级改造，具体情况详见本补充法律意见书第 11 题“关于技术来源和先进性”的相关回复。除上述情况外，报告期内，力晶科技不存在其他对公司技术方面的支持。

3、财务方面

报告期内，力晶科技除按照《投资参股协议》向发行人履行出资义务外，未向公

司提供任何资金或担保等财务方面的支持。

4、人员方面

报告期内，力晶科技基于《委托经营管理合约》《合资合同》《投资参股协议》的约定，向公司委派管理人员，以帮助发行人落地、改善相关制度的运作，具体详见本补充法律意见书第 12.2 题“委派管理人员”的相关回复。

5、经营管理委员会相关情况

2018 年下旬，基于《委托经营管理合约》的约定，公司组建了经营管理委员会作为董事会幕僚机构，力晶科技向其指派人员，为公司提供经营咨询与支持。具体详见本补充法律意见书第 12.2 题之“（三）经营管理委员会的具体人员构成、运作情况及实际发挥的作用，与发行人董事会、股东（大）会之间的关系”。

八、《问询函》第 12.2 题：委派管理人员

根据申报材料：（1）按照委托经营协议，存在力晶科技、合肥建投委派部分管理人员的情形，委派人员所在岗位主要是财务和内审部门。2020 年 4 月起，公司各部门已无股东委派高管。（2）2018 年 12 月，发行人依据《委托经营管理合约》组建了经营管理委员会。

请发行人说明：（1）委托经营管理合约终止前后合肥建投和力晶科技委派管理人员的具体情况及其主要考虑；（2）委托经营管理期间经营决策的具体过程，列表说明委托经营管理期间及委托经营管理终止后发行人经营管理团队的变化，相关变动人员的来源及劳动关系隶属情况；（3）经营管理委员会的具体人员构成、运作情况及实际发挥的作用，与发行人董事会、股东（大）会之间的关系；（4）结合发行人经营管理团队的构成与变化、委托经营管理的具体事项及运作情况，说明委托经营管理终止前后发行人是否具备独立的经营管理层，是否拥有并独立行使经营管理权和决策权，生产经营是否与力晶科技分开且独立运作，发行人的人员、财务、机构是否独立于力晶科技。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见，请申报会计师就发行人财务是否独立于力晶科技进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）委托经营管理合约终止前后合肥建投和力晶科技委派管理人员的具体情况及其主要考虑

根据发行人自设立以来历次董事会会议记录、力晶科技及合肥建投向发行人委派人员的名单、发行人组织机构图及审批权限表以及发行人出具的说明，委托经营管理合约终止前后，合肥建投和力晶科技委派管理人员包括力晶科技按照《委托经营管理合约》短期委派的管理人员，以及双方股东按照《公司章程》《合资合同》《投资参股协议》长期委派的管理人员。具体情况如下：

（1）合肥建投向发行人委派人员的具体情况

序号	所在岗位	姓名	委派期间	具体负责工作内容
1	总会计师	朱才伟 (高管)	2016年3月至 2020年3月	负责公司财务、会计政策的制定，管理公司财务、会计各项工作
2	财会处处长	王兴亚	2016年8月至 2020年3月	负责公司财务、会计各项工作的开展
3	采购副总监	赵鑫森 (高管)	2016年4月至 2017年8月	协助采购总监督管理公司采购各项工作
4		周义亮 (高管)	2017年8月至 2019年5月	
5		王继武 (高管)	2019年5月至 2020年4月	
6	销售副总监	周义亮 (高管)	2016年4月至 2020年3月	负责管理维护客户，制定销售战略；新客户新产品导入，维持现有业务及拓展新业务

序号	所在岗位	姓名	委派期间	具体负责工作内容
7	行政副总经理	朱晓娟 (高管)	2019年10月至 2020年3月	负责公司整体行政管理和组织人事管理工作
8	审计师	朱晓娟 (高管)	2019年1月至 2019年12月	负责公司内部审计工作
9		杨幼玲 (高管)	2019年12月至 2020年4月	
10	敬业促进委员会委员长	朱晓娟 (高管)	2017年8月至 2019年12月	规范员工行为、鼓励敬业服务
11		杨幼玲 (高管)	2019年12月至 2020年11月	
		杨幼玲	2020年11月至 2021年3月	

上述人员主要系合肥建投根据《投资参股协议》《公司章程》《合资合同》等约定向公司委派高管人员，以便于合肥建投作为控股股东对公司的财务、采购、销售、行政、内审、敬业监督等方面进行监督与管理。

(2) 力晶科技向公司委派人员的具体情况

序号	所在岗位	姓名	委派期间	具体负责工作内容
1	会计部部长	张天桂	2016年8月至 2017年7月	结合中国大陆实际情况，帮助公司落地、改善相关制度的运作
2	会计部课长	庄惠雯	2016年7月至 2017年10月	
3	财务部部经理	任芬圣	2016年7月至 2017年3月	
4	行政副总经理	刘荫 (高管)	2017年8月至 2018年5月	

序号	所在岗位	姓名	委派期间	具体负责工作内容
5	审计师	陈美华 (高管)	2016年7月至 2018年5月	帮助公司完善内部控制，提高公司内部审计工作质量及能力；负责公司内部审计工作
6	审计师/处长	潘炯升 (高管)	2017年12月至 2018年12月	
7	副审计师	林士然	2019年1月至 2020年3月	
8	副总会计师	陈央珠 (高管)	2016年6月至 2016年12月	参与公司财务事项审批流程，对公司财务情况进行了解
9		邱垂源 (高管)	2017年1月至 2019年3月	
10		李洳谕 (高管)	2018年12月至 2020年3月	

上述委派人员中：（1）张天桂、庄惠雯、任芬圣、刘荫 4 人系力晶科技根据《委托经营管理合约》在短期内向公司短期委派的管理人员，其中，除刘荫外均非公司高级管理人员，主要考虑为帮助公司结合行业特点，落地、改善相关制度的运作，提高公司内部控制和稽核能力，传授财务核算经验等；（2）其余人员均系力晶科技根据《合资合同》《投资参股协议》长期委派的管理人员，主要考虑为通过参与公司财务事项审批及内部审计流程，对公司财务状况实施监督，防止控股股东滥用控股地位。

（二）委托经营管理期间经营决策的具体过程，列表说明委托经营管理期间及委托经营管理终止后发行人经营管理团队的变化，相关变动人员的来源及劳动关系隶属情况

1、委托经营管理期间经营决策的具体过程

根据发行人历次董事会会议记录、部分日常经营性会议的会议记录以及发行人出具的说明，《委托经营管理合约》终止前，公司日常经营计划由高级管理人员负责制定及执行，涉及董事会审批的事项，在提交董事会审批后执行。《委托经营管理合约》

终止前，发行人经营决策相关的主要会议如下：

会议名称	召开频率	主要决策内容	与会人员	决策机制
董事会	根据需要择期召开	根据《公司章程》需董事会决策事项	董事、总经理，以及需列席汇报议题的相关人员	董事表决
办公会	每周	就日常经营事项讨论、决策	总经理及其他高级管理人员，以及需列席说明或参与讨论的部门主管	与会高级管理人员表决
策略会议	根据需要择期召开	讨论并制定公司发展战略规划、产能规划、产品策略等	总经理、总会计师，分管业务、营运、采购、研发等部门的高级管理人员，企业规划室处长，营销业务处长、部经理等	总经理主导、决定
定价会议	每季度	就产品定价进行讨论、决策	总经理、总会计师、分管业务部门的高级管理人员，企业规划室处长，营销业务处长、部主管等	总经理主导、决定

公司董事会由公司董事进行表决，经营管理委员会委员均不参与表决。办公会由与会高级管理人员进行表决，力晶科技指派的经营管理委员会委员均不参加。策略会议、定价会议由总经理主导，和与会高级管理人员、相关部门主管进行讨论后作出决定，力晶科技委派人员与指派的经营管理委员会委员均不参加。

2、委托经营管理期间及委托经营管理终止后发行人经营管理团队的变化，相关变动人员的来源及劳动关系隶属情况

根据发行人自设立以来历次董事会会议、合肥建投及力晶科技向发行人委派高管的相关函件以及发行人出具的说明，报告期初至股改前，发行人经营管理团队人员的变化情况如下：

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
1	/	总经理	2018年1月-2020年3月	黎湘鄂	发行人员工	发行人

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属	
			2020年3月-2020年12月	蔡辉嘉	发行人员工	发行人	
2	运营	副总经理	2018年1月-2020年3月	蔡辉嘉	发行人员工	发行人	
			2020年4月-2020年12月	邱显寰	发行人员工	发行人	
		助理	2019年12月-2020年4月	邱显寰	发行人员工	发行人	
			2020年4月-2020年11月	未设置			
			2020年12月	李庆民	发行人员工	发行人	
3	采购	总监/副总经理	2018年1月-2020年11月	盛惟健	发行人员工	发行人	
			2020年11月-2020年12月	未设置			
		助理	2020年11月-2020年12月	简瑞荣	发行人员工	发行人	
		副总监	2018年1月-2019年5月	周义亮	合肥建投委派	合肥建投	
			2019年5月-2020年3月	王继武	合肥建投委派	合肥建投	
			2020年3月-2020年12月	未设置			
4	销售	总监/副总经理	2018年1月-2019年10月	黎湘鄂	发行人员工	发行人	
			2019年10月-2020年4月	未设置			
			2020年4月-2020年6月	孙志明	发行人员工	发行人	

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
			2020年6月-2020年12月	未设置		
		助理	2019年10月-2020年4月	孙志明	发行人员工	发行人
			2020年4月-2020年12月	周义亮	发行人员工	发行人
		副总监	2018年1月-2020年3月	周义亮	发行人员工	发行人
			2020年4月-2020年12月	未设置		
5	研发	副总经理	2018年1月-2019年3月	陈耿川	发行人员工	发行人
			2020年4月-2020年12月	詹奕鹏	发行人员工	发行人
		助理	2019年3月-2020年3月	詹奕鹏	发行人员工	发行人
			2020年4月-2020年12月	未设置		
6	财务	总会计师/财务负责人	2018年1月-2020年3月	朱才伟	合肥建投委派	合肥建投
			2020年4月至2020年12月	朱才伟	发行人员工	发行人
		副总会计师/助理	2018年1月-2019年3月	邱垂源	力晶科技委派	力晶科技
			2019年3月-2020年3月	李洵	力晶科技委派	力晶科技
			2020年4月-2020年12月	李洵	发行人员工	发行人
7	内审	审计师	2018年1月-2018年5月	陈美华	力晶科技委派	力晶科技

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属	
			2018年5月-2018年12月	潘炯升	力晶科技委派	力晶科技	
			2019年1月-2019年12月	朱晓娟	合肥建投委派	合肥建投	
			2019年12月-2020年4月	杨幼玲	合肥建投委派	合肥建投	
			2020年4月-2020年11月	未设置			
8	行政	副总经理	2018年1月-2018年5月	刘荫	力晶科技委派	力晶科技	
			2018年5月-2019年10月	未聘任，由采购总监盛惟健代管			
			2019年10月-2020年3月	朱晓娟	合肥建投委派	合肥建投	
			2020年4月-2020年12月	朱晓娟	发行人员工	发行人	
9	证券	董事会秘书	2020年4月-2020年12月	朱才伟	发行人员工	发行人	
10	敬业监督	敬业促进委员会委员长	2018年1月-2019年11月	朱晓娟	合肥建投委派	合肥建投	
			2019年12月-2020年11月	杨幼玲	合肥建投委派	合肥建投	
			2020年11月-2020年12月	不再为高级管理人员职位			

综上，报告期内，发行人经营管理团队主要来源于发行人员工；截至报告期末，发行人高级管理人员均由公司聘任，不涉及股东委派的情形。

（三）经营管理委员会的具体人员构成、运作情况及实际发挥的作用，与发行人董事会、股东（大）会之间的关系

1、经营管理委员会的具体人员构成

（1）经营管理委员会的构成及选拔机制

根据发行人历次董事会会议、经营管理委员会会议记录以及发行人出具的说明等，2015年10月《委托经营管理合约》签订后，公司逐步组建了自身的经营团队及相应职能部门，暂未组建经营管理委员会。2018年下旬，合肥建投希望力晶科技作为股东发挥其经验优势，为公司提供经营咨询与支持。2018年12月，经公司董事会决议，公司组建了经营管理委员会作为董事会幕僚机构，并制定了《晶合经营管理委员会执行规章》。经营管理委员会由发行人、力晶科技及合肥建投三方的指派人员共同组成，发行人、力晶科技根据所需交流事项自相应部门指派人员担任委员，并各自指派一名执行秘书。合肥建投指派其向发行人委派的高级管理人员担任观察员。委员、执行秘书、观察员根据会议召开的需求，邀请其他应邀参会人员、会务人员参加会议。经营管理委员会会议中，由力晶科技指派人员与发行人对应业务部门人员就发行人经营情况、行业发展情况等事宜定期进行交流、探讨，为董事会提供合理建议。

（2）经营管理委员会各类型人员的具体职责

经营管理委员会委员主要负责对所需交流事项提供意见及建议，并就需向董事会汇报的事项形成具体建议；执行秘书主要负责联络召开会议、撰写会议记录及协助执行经营管理委员会各项工作；会务人员主要负责协助执行秘书协调会务相关工作；观察员主要负责监督经营管理委员会运作情况；其他应邀参会人员负责就具体交流事项向委员汇报。

（3）经营管理委员会各类型人员的变动情况

经营管理委员会存续期间，经营管理委员会委员、执行秘书、观察员未发生变化，会务人员及应邀参加会议的人员根据实际需求在会议召开前由委员确定。经营管理委员会存续期间，共召开会议12次，各方指派人员主要情况如下：

①发行人指派人员

序号	身份	姓名	出席次数	当时在晶合集成的担任的职务	主要职责
1	委员	蔡辉嘉	10	营运副总经理	与力晶科技委员就营运方面信息进行交流
2	委员	盛惟健	11	采购总监	与力晶科技委员就采购方面信息进行交流

3	副执行 秘书	黎翠綾	12	企业规划处处长	组织、参与会议及制作会议记录，与力晶科技委员就企业规划方面信息进行交流
---	-----------	-----	----	---------	-------------------------------------

在经营管理委员会存续期间，上述人员均为发行人员工。除上述人员外，晶合集成还会根据交流讨论需要，不定期邀请公司其他员工出席经营管理委员会会议，具体情况如下：

序号	身份	姓名	出席次数	当时在晶合集成担任的职务	主要职责
1	应邀参会	林熙钦	2	市场/销售处处长	与力晶科技指派人员就市场信息进行交流
2	应邀参会	苏贤钧	1	客户工程服务部 部经理	
3	应邀参会	张志宏	8	市场/销售处处长	
4	应邀参会	李庆民	6	技术开发处处长	与力晶科技指派人员就技术开发趋势及进程等信息进行交流
5	应邀参会	吴佳特	4	先进整合处副处长	
6	应邀参会	林滔天	8	逻辑二部代部经理	
7	应邀参会	许宗能	2	先进整合前端组 部经理	
8	应邀参会	简瑞荣	11	采购处处长	与力晶科技指派人员就采购及成本控制方面的经验和信息进行交流
9	应邀参会	吕庆麟	2	营运企划处处长	与力晶科技指派人员就营运经验及信息进行交流
10	应邀参会	张伟瑾	9	N1 厂长室副厂长	
11	应邀参会	吴文达	10	资安室部经理	与力晶科技指派人员就信息安全方面的经验及信息进行交流
12	应邀参会	颜仲稚	1	资安室技术副理	
13	应邀参会	王兴亚	4	财会处处长	与力晶科技指派人员就财务规划、损益 平衡达成的目标设定等财务经验及信息进行交流
14	应邀参会	王云直	1	会计部部经理	
15	应邀参会	江英和	1	人力资源部部经理	与力晶科技指派人员就人资管理方面的经验及信息

					进行交流
--	--	--	--	--	------

②力晶科技指派人员

序号	身份	姓名	出席次数	当时在力晶科技担任的职务	主要职责
1	委员、主席	刘志能	12	副总经理	负责主持会议，提供企业规划与生产管理方面建议，以及向董事会汇报经营会的建议及分析
2	委员	陈章鉴	11	副总经理	提供采购方面的意见及建议
3	委员	刘坚松	8	资深处长	提供信息安全方面的意见及建议
4	委员	吴元雄	6	副总经理	提供市场讯息及行业方面的意见及建议
5	委员	刘月纯	1	资深处长	提供人力资源方面的意见及建议
6	执行秘书	林士然	12	资深处长	组织、参与会议，制作会议记录
7	会务人员	张文献	12	项目经理	协调会务相关工作
8	会务人员	林佳瑄	1	技术经理	

除上述人员外，力晶科技指派的经营管理委员会还会根据交流、讨论需要，不定期邀请力晶科技其他员工出席经营管理委员会会议，具体情况如下：

序号	身份	姓名	出席次数	当时在力晶科技担任的职务	主要职责
1	应邀参会	谢明霖	12	副总经理	力晶科技委派的监事，提供经营管理委员会运作方面的建议
2	应邀参会	王其国	2	总经理暨营运长	力晶科技委派的董事，提供公司营运方面的经验、信息及建议
3	应邀参会	许晔豪	4	副处长	与公司指派人员就市场及行业信息进行交流
4	应邀参会	戴景松	9	资深部经理	与公司指派人员就采购及成本控

序号	身份	姓名	出席次数	当时在力晶科技担任的职务	主要职责
5	应邀参会	庄铭钧	3	部经理	制方面的经验及信息进行交流
6	应邀参会	李清郎	1	部经理	
7	应邀参会	李仲熙	8	副处长	
8	应邀参会	柯亨安	8	副处长	与公司就企业规划方面的经验及信息进行交流
9	应邀参会	张秀忠	4	技术经理	
10	应邀参会	林世国	4	部经理	与公司就信息安全方面的经验及信息进行交流
11	应邀参会	王修彦	1	资深部经理	
12	应邀参会	邱垂源	3	资深处长	力晶科技委派副总会计师，与公司就财务规划、损益平衡达成的目标设定等财务经验及信息进行交流
13	应邀参会	李迦谕	12	项目经理	

③合肥建投指派人员

序号	身份	姓名	出席次数	当时在晶合集成担任的职务	主要职责
1	观察员	朱才伟	11	总会计师	参与会议，了解、监督经营管理委员会运作情况
2	观察员	周义亮	10	销售副总监兼采购副总监/销售副总监	参与会议，了解、监督经营管理委员会运作情况

除上述人员外，合肥建投指派的经营管理委员会还会根据交流、讨论需要，不定期邀请合肥建投其他员工出席经营管理委员会会议，具体情况如下：

序号	身份	姓名	出席次数	当时在晶合集成担任的职务	主要职责
1	应邀参会	王继武	3	采购副总监	参与会议，协助观察员了解、监督经营管理委员会运作情况

2、经营管理委员会的运作情况及实际发挥的作用

(1) 运作情况

①内部决策机制

经营管理委员会召开会议时，由经管会委员或应邀参会人员向经营管理委员会主席、其他委员、观察员报告各专题项目。经营管理委员会讨论事项以达成共识结论为目标，若重大事项未能达成共识或结论，由经营管理委员会主席决定采取表决产生结论，经三分之二以上委员同意通过。在经营管理委员会实际运行过程中，未发生无法达成共识需表决产生结论的情形。

②向董事会提供建议的方式

拟向董事会汇报的事项在经营管理委员会主席与委员充分讨论后，由执行秘书进行汇总整理，在就近一次董事会会议上进行汇报。

③运作情况

经营管理委员会存续期间，共召开会议 12 次，自 2019 年 1 月至 12 月每月召开一次，主要讨论事项包括当月市场、行业、采购整体状况，产能及生产营运状况，现金损益平衡达成情况，新技术开发整体进度，及信息安全等方面经验交流。2019 年 12 月，基于：（1）公司当时各部门、人员已相对完善，业务及营运等各方面均稳步推进，公司对力晶科技咨询服务的需求下降；（2）力晶科技进行重组后，将主要人员、业务、资产均注入力积电，力晶科技转型为控股型公司，为公司提供咨询的能力和意愿均减弱，公司与力晶科技协商后决定于 2019 年 12 月 25 日终止《委托经营管理合约》，并同时解散了经营管理委员会。

（2）实际发挥的作用

经营管理委员会讨论事项主要为发行人经营总体状况及趋势。经营管理委员会召开时，由发行人参会人员与力晶科技参会人员就相关议题进行交流、分析，经营管理委员会主要根据其行业经验对发行人的经营状况及趋势是否合理、是否存在风险或可优化之处进行分析，为公司董事会提供合理建议。经营管理委员会不属于公司运营管理机构，不具有对公司经营管理事项进行决策的职权。

经营管理委员会讨论议题均由发行人员工起草，相关议题中涉及生产经营的具体数据、产品结构、客户信息、价格信息等商业秘密时，发行人均会将相关信息隐去或

简化处理，避免发行人经营中的商业秘密通过经营管理委员会泄露。

3、经营管理委员会与发行人董事会、股东（大）会之间的关系

根据《公司章程》《委托经营管理合约》的约定及相关执行情况，经营管理委员会存续期间，公司的最高决策机构为董事会，公司的重大决策由合肥国资方、力晶科技委派的董事在会议上经充分讨论后表决形成，经营管理委员会仅为董事会提供建议。

《委托经营管理合约》经营管理委员会存续期间召开的董事会会议中，有 4 次董事会会议涉及听取或讨论经营管理委员会提出的建议，其中：（1）第一届董事会第 21 次会议、第 22 次会议中，董事会听取了经营管理委员会形成的研究成果及建议事项，相关事项为报告事项，不涉及董事会讨论审议。（2）第一届董事会第 23 次会议、第 24 次会议中，经合肥建投委派董事提议，将经营管理委员会提出的建议作为讨论事项向董事会提出，由全体董事进行审议。具体情况如下：

届次	序号	经营管理委员会研究成果及建议事项	审议结果
第 21 次董事会	1	协助拟定三年 LTBP 及未来财务预估；协助评估现金损益平衡可能性及相关对策；协助分析单位成本、采购单价较高的差异原因与对策；90nm 延伸技术方面公司的需求；讨论信息大门防护措施	不涉及审议事项
第 22 次董事会	1	评估现金损益平衡可行性；建议 20K 及 25K 机台准备先期指标；原物料及机台采购价格对比分析及对策；辅导信息机制、商业秘密专案执行	不涉及审议事项
第 23 次董事会	1	建议对 2020 年营运计划进行检视及追踪，尽速达成现金损益平衡目标	无异议通过
	2	建议建立新产品 tape out 至量产时间、成功率的追踪机制及相关指标，以确保新产品如期贡献订单	
	3	建议季目标订定与预算落差达订单 30%、产出 20% 时，需在公司季会前向股东汇报	
	4	建议经管会进一步发挥功能协助经营团队	
第 24 次董事会	1	建议 3 万片机台要进行投资时，根据先期指标达成状况业务拓展与价格策略，需经董事会同意后，取得预算并进行机台投资	事项 1、2 无异议通过，事项 3 参考业界做法后续讨论

届次	序号	经营管理委员会研究成果及建议事项	审议结果
	2	建议针对 2020BP 定期检讨追踪及优化投片配置	
	3	建议制定 2020 年绩效目标执行，经营团队（高管）奖惩方式	

综上，经营管理委员会存续期间，发行人最高权力机构为董事会，经营管理委员会为董事会提供经营相关建议，经营管理委员会不属于公司运营管理机构，不具有对公司经营管理事项进行决策的职权；经营管理委员会与发行人股东（大）会不存在关系。

（四）结合发行人经营管理团队的构成与变化、委托经营管理的具体事项及运作情况，说明委托经营管理终止前后发行人是否具备独立的经营管理层，是否拥有并独立行使经营管理权和决策权，生产经营是否与力晶科技分开且独立运作，发行人的人员、财务、机构是否独立于力晶科技

结合发行人经营管理团队的构成与变化、委托经营管理的具体事项及运作情况，分析如下：

（一）报告期内，发行人曾存在合肥建投、力晶科技向发行人委派部分高级管理人员的情形，该等人员系双方股东依据《投资参股协议》等向公司委派，非为委托经营特别约定事项。《委托经营管理合约》终止后，双方股东均继续依照《投资参股协议》、《合资合同》、《公司章程》向公司委派相关人员。截至报告期末，发行人高级管理人员均由公司聘任并在公司专职工作。

因此，截至报告期末，发行人具备独立的经营管理人员。

（二）经营管理委员会存续期间，发行人最高权力机构为董事会，经营管理委员会为董事会提供经营相关建议，经营管理委员会不属于公司运营管理机构，不具有对公司经营管理事项进行决策的职权；经营管理委员会与发行人股东（大）会不存在关系。

因此，委托经营管理终止前后，发行人具备独立的经营管理机构，发行人拥有并独立行使经营管理权和决策权，生产经营与力晶科技分开且独立运作。

综上，委托经营管理合约终止前后，发行人具备独立的经营管理机构，发行人拥有并独立行使经营管理权和决策权，生产经营与力晶科技分开且独立运作，发行人的财务、机构均独立于力晶科技。截至报告期末，发行人具备独立的经营管理层，发行人的人员独立于力晶科技。

九、《问询函》第 12.3 题：向控股股东子公司租赁厂房及设施

根据申报材料：（1）发行人及其子公司无自有房产及土地使用权。目前主要办公场所及全部生产场所为向合肥建投全资子公司合肥蓝科租赁，募投项目实施相关厂房系向合肥蓝科租赁。环保设施由合肥蓝科与厂房一同建设并出租给发行人使用。（2）2017 年公司与合肥蓝科、力晶科技签订的《厂房建设与租用协议》及公司与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》租入厂房及配套厂务设备；2021 年 4 月，公司与合肥蓝科签订《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》对晶合二厂及配套设施认定为经营性租赁，同期公司与合肥蓝科签订《收购意向协议》，公司承诺在该项目交付之日起 5 年内完成收购。（3）以融资租赁方式进行核算，报告期各期末，公司融资租入固定资产账面价值分别为 176,313.65 万元、169,151.82 万元和 161,990.00 万元。

请发行人说明：（1）厂房租赁合同签订的具体考虑，协议对厂房及相关土地的权属安排的具体约定及未来的具体安排；（2）发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套厂务设备的内容，各厂房的建设进度和使用情况，发行人大额固定资产、在建工程与上述厂房的关系，租用协议到期后固定资产的安置方式，结合上述情况具体说明租赁厂房的业务合理性；（3）所租赁房产及相应土地使用权是否存在瑕疵，是否履行完备的登记审批程序，相关事项存在的法律风险；（4）按照企业会计准则说明认定为融资租赁的原因，融资租赁金额的计算过程，对经营业绩的影响，收购厂房的资金来源；补充提供公司与合肥蓝科、力晶科技签订的租用协议。

请保荐机构、发行人律师对事项（1）-（3）和申报会计师对事项（2）和（4）进行核查并发表明确意见。请保荐机构和发行人律师根据《问答（二）》第 7 条的规定，充分论证上述情况是否对发行人资产完整和独立性构成重大不利影响，督促发行人做

好信息披露和风险揭示。

回复：

（一）厂房租赁合同签订的具体考虑，协议对厂房及相关土地的权属安排的具体约定及未来的具体安排

1、厂房租赁合同签订的具体考虑

2015年4月27日，合肥市政府与力晶科技签署《合作框架协议》，双方共同合作实施合肥新站综合开发试验区12英寸晶圆制造基地项目。根据《合作框架协议》约定，合肥市政府负责提供土地与厂房建设资金，由项目公司主导兴建。合肥市政府同意以租赁方式供项目公司使用该土地及厂房，租赁期限为全产能量产后20年，租期届满后，若项目营运顺利，再以相同条件续租10年。

2015年10月，合肥蓝科、力晶科技与发行人签署《合肥12吋晶圆制造基地项目厂房建设与租用协议》，合肥蓝科根据前述《合作框架协议》，负责建成12英寸晶圆制造厂所需的厂房、无尘室、厂务设施及配套设施，并租赁给发行人使用。2017年6月，合肥蓝科与晶合集成签署《电子器件厂房设施租赁合同》，合肥蓝科已按照要求将电子器件厂房基础设施建设完毕，合肥蓝科作为产权人，同意将电子器件厂房设施及土地租赁给晶合集成，租赁期间自2017年6月28日起至2037年6月27日。

上述合肥蓝科建造并向发行人出租的厂房包括发行人生产经营所使用的主体厂房，以及仓库、废水处理站、综合动力站、大宗气体站等配套房屋。其中，主体厂房面积为173,982.92平方米，约一半面积已建设洁净室等配套厂务设施，用于发行人目前已投产的“12英寸晶圆制造基地项目”（晶合一厂）；另一半主体厂房建成后尚未建设洁净室等配套厂务设施，目前尚未投入使用，未来将用于本次募集资金拟投资的“12英寸晶圆制造二厂项目”（晶合二厂）。

2021年4月，发行人与合肥蓝科签订《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》，合肥蓝科将在前述尚未投入使用的预留厂房内建设洁净室及配套厂务供应系统，并在原有主体厂房的基础上进行少量扩建，以及增加部分配套设施，租赁给发行人使用。

合肥蓝科将相关厂房以租赁方式提供给公司使用系合肥市政府与力晶科技合作初

始确定的招商引资政策之一。公司晶合二厂厂务及配套设施建设时，由于相关土地、厂房均属于合肥蓝科，因此继续由合肥蓝科负责建设。公司主营业务为晶圆代工，公司业务对于厂房专业化要求较高，合肥蓝科向公司出租的厂房系按照公司晶圆代工项目的实际需求定制化建造，相关厂房及配套设施建造成本较高，公司无法直接租赁其他厂房从事生产经营，合肥蓝科按照公司需求定制化建造该等厂房后亦很难再直接向其他方出租。因此，公司长期向合肥蓝科租赁相关厂房具有必要性及合理性。

2、协议对厂房及相关土地的权属安排的具体约定及未来的具体安排

根据前述协议约定，相关土地使用权及相关厂房的所有权归合肥蓝科所有。

根据《电子器件厂房设施租赁合同》，晶合一厂的租赁期间自 2017 年 6 月 28 日起至 2037 年 6 月 27 日；租赁期限届满后，如晶合集成无重大营运问题，自动按原条件续约至 2049 年 6 月 27 日。

根据《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》及《晶合二厂厂务及配套项目收购意向协议》，晶合二厂的租赁期限为自实际交付之日起 10 年，租赁期满后，乙方有优先承租权，展延租赁期限由双方另行协商；并且，发行人承诺在交付之日起五年内收购晶合二厂相关厂务及配套设施（不含土建结构部分），土建结构部分将由晶合集成继续租赁。根据合肥蓝科出具的承诺函，租赁期届满后，若晶合集成无重大营运问题且晶合集成需继续承租上述租赁物业中土建结构部分，合肥蓝科承诺按照市场公允价格租赁给晶合集成。

（二）发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套厂务设备的内容，各厂房的建设进度和使用情况，发行人大额固定资产、在建工程与上述厂房的关系，租用协议到期后固定资产的安置方式，结合上述情况具体说明租赁厂房的业务合理性

1、发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套厂务设备的内容，各厂房的建设进度和使用情况

发行人根据《电子器件厂房设施租赁合同》向合肥蓝科租赁的厂房及配套厂务设备已建设完毕，具体情况如下：

类型	主要内容	使用情况
房屋及建筑物	包括发行人目前生产经营使用的主体厂房以及废水处理站、仓库、综合动力站、大宗气体站等建筑物	主体厂房中，一半用于目前已用于生产经营的晶圆制造一厂项目，另一半目前尚未投入使用，未来将用于本次募集资金拟投资的“12英寸晶圆制造二厂项目”
厂务设备	包括厂房洁净室系统、水处理系统、气体系统、消防系统等设施	已投入使用
其他	厨房设备	已投入使用

发行人根据《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》向合肥蓝科租赁的厂房及配套设施尚在建设过程中，具体情况如下：

类型	主要内容	使用情况
新增建筑物	L40区域新增结构楼板及一层建筑物，建筑面积约2,800 m ² ，洁净室面积约2,500 m ² ，增设洁净室及配套厂务供应系统	尚未投入使用
二厂洁净室与厂务设施	在现有已建成的二厂厂房中，建成可容载4万片/月产能的12英寸晶圆洁净室及相关厂务设施	尚未投入使用
配套设施	在现有一厂厂区西侧，建造建筑面积500 m ² 的一层丙类化学品仓库及相关消防与机电设施	尚未投入使用

2、发行人大额固定资产、在建工程与上述厂房的关系

报告期内，发行人固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	账面原值	账面价值	账面原值	账面价值	账面原值	账面价值
固定资产	963,849.07	776,607.78	830,304.51	720,936.40	578,867.97	527,573.26
其中：房屋	189,450.20	164,395.89	189,080.29	171,257.26	186,889.85	176,227.65

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	账面原值	账面价值	账面原值	账面价值	账面原值	账面价值
及建筑物						
其中：机器设备	765,356.07	608,864.61	634,166.05	546,355.03	386,293.86	347,523.32
其中：运输工具	274.08	0.21	274.08	50.12	274.08	118.64
其中：电子设备及其他	8,768.72	3,347.06	6,784.09	3,273.99	5,410.18	3,703.65
融资租入固定资产	187,056.39	161,990.00	187,056.39	169,151.82	187,056.39	176,313.65
其中：房屋及建筑物	186,787.95	161,909.47	186,787.95	169,017.60	186,787.95	176,125.74
其中：电子设备及其他	268.44	80.53	268.44	134.22	268.44	187.91
融资租入固定资产占固定资产的比例	19.41%	20.86%	22.53%	23.46%	32.31%	33.42%
其中：房屋及建筑物	98.59%	98.49%	98.79%	98.69%	99.95%	99.94%
其中：电子设备及其他	3.06%	2.41%	3.96%	4.10%	4.96%	5.07%

上述租赁厂房及配套厂务设备等计入固定资产的房屋及建筑物、电子设备及其他，不存在租入的在建工程，由于配套厂务设备与厂房密不可分，故作为房屋及建筑物核算。

报告期各期末，公司融资租入固定资产账面价值分别为 176,313.65 万元、169,151.82 万元和 161,990.00 万元，主要为根据公司与合肥蓝科、力晶科技签订的《厂房建设与租用协议》及公司与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》所租入的厂房及配套厂务设备。报告期内，上述租赁获得的厂房及配套厂务设备原值占

发行人固定资产原值的比例分别为 32.31%、22.53%和 19.41%，占发行人固定资产中房屋及建筑物原值的比例分别为 99.95%、98.79%、98.59%，发行人房屋及建筑物主要通过上述租赁方式获得。

3、租用协议到期后固定资产的安置方式

(1) 发行人一厂相关厂房及配套厂务租用协议到期后固定资产的安置方式

根据《电子器件厂房设施租赁合同》以及合肥蓝科出具的承诺函，若发行人项目运营顺利，相关物业的租赁期限至 2049 年 6 月 27 日，相关厂房及配套的租赁期限已基本覆盖发行人生产项目厂房正常使用寿命周期，租用协议到期后，相关固定资产已折旧完毕。同时，合肥蓝科承诺，在晶合集成如约履行合约的情况下：（A）未经晶合集成同意，合肥蓝科不向其他单位或个人出租或处置上述租赁物业；（B）租赁期届满后，若晶合集成无重大营运问题且晶合集成需继续承租上述租赁物业，合肥蓝科承诺按照市场公允价格租赁给晶合集成。发行人一厂相关租用协议到期后，可视运营情况继续向合肥蓝科租赁相关厂房，固定资产的安置不存在重大风险。

(2) 发行人二厂相关厂房及配套厂务租用协议到期后固定资产的安置方式

根据《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》《晶合二厂厂务及配套项目收购意向协议》以及合肥蓝科出具的承诺函，相关租赁物交付起 5 年内，发行人将收购租赁物中的配套设施（不含土建结构部分）；租赁期限届满后，若发行人无重大营运问题且需要继续租赁协议约定租赁物中的土建结构部分，合肥蓝科承诺将按照市场公允价格租赁给发行人。发行人二厂相关租用协议到期后，可视运营情况继续向合肥蓝科租赁相关厂房，固定资产的安置不存在重大风险。

4、租赁厂房的业务合理性

合肥蓝科将相关厂房以租赁方式提供给公司使用系合肥市政府与力晶科技合作初始确定的招商引资政策之一。公司业务对于厂房专业化要求较高，合肥蓝科向公司出租的厂房系按照公司晶圆代工项目的实际需求定制化建造，相关厂房及配套设施建造成本较高。发行人主要固定资产晶圆代工业务使用的相关机器设备均安装于向合肥蓝科租赁的相关厂房中，与厂务设施及配套设施协同发挥作用，公司无法直接租赁其他

厂房从事生产经营。因此，发行人向合肥蓝科租赁相关厂房具有业务合理性。

（三）所租赁房产及相应土地使用权是否存在瑕疵，是否履行完备的登记审批程序，相关事项存在的法律风险

1、所租赁房产及相应土地使用权是否存在瑕疵

发行人向合肥蓝科租赁房产及相应土地使用权均已取得不动产权证，具体情况如下：

序号	权利人	座落地址	不动产权证号	土地用途	宗地面积(m ²)	房屋建筑面积(m ²)
1	合肥蓝科	新站区东方大道1888号1号建筑	皖(2020)合肥市不动产权第11339433号	工业用地	246,407.29	173,982.92
2	合肥蓝科	新站区东方大道1888号2号建筑	皖(2020)合肥市不动产权第11339464号	工业用地		5,664.48
3	合肥蓝科	新站区东方大道1888号3号建筑	皖(2020)合肥市不动产权第11340116号	工业用地		5,332.85
4	合肥蓝科	新站区东方大道1888号4号建筑	皖(2020)合肥市不动产权第11340109号	工业用地		26,776.98
5	合肥蓝科	新站区东方大道1888号5号建筑	皖(2020)合肥市不动产权第11340112号	工业用地		974.53
6	合肥蓝科	新站区东方大道1888号6号建筑	皖(2020)合肥市不动产权第11340106号	工业用地		587.25

序号	权利人	座落地址	不动产权证号	土地用途	宗地面积(m ²)	房屋建筑面积(m ²)
7	合肥蓝科	新站区东方大道1888号7号建筑	皖(2020)合肥市不动产权第11340103号	工业用地		241.21
8	合肥蓝科	新站区东方大道1888号8号建筑	皖(2020)合肥市不动产权第11340101号	工业用地		339.81
9	合肥蓝科	新站区东方大道1888号9号建筑	皖(2020)合肥市不动产权第11339462号	工业用地		600.6
10	合肥蓝科	新站区东方大道1888号10号建筑	皖(2020)合肥市不动产权第11339485号	工业用地		529.26
11	合肥蓝科	新站区东方大道1888号13号建筑	皖(2020)合肥市不动产权第11339439号	工业用地		105.31
12	合肥蓝科	新站区东方大道1888号14号建筑	皖(2020)合肥市不动产权第11339442号	工业用地		106.69
13	合肥蓝科	新站区东方大道1888号15号建筑	皖(2020)合肥市不动产权第11339448号	工业用地		28.72
合计				-	246,407.29	215,270.61

因此，发行人向合肥蓝科所租赁房产及相应土地使用权不存在瑕疵。

(2) 是否履行完备的登记审批程序，相关事项存在的法律风险

合肥蓝科向发行人出租的上述房屋已取得《合肥市房屋租赁备案证书》（备案证

书号：2103090AY002），发行人已履行完备的登记及租赁备案程序。发行人向合肥蓝科租赁房屋相关事项不存在法律风险。

（四）请保荐机构和发行人律师根据《问答（二）》第 7 条的规定，充分论证上述情况是否对发行人资产完整和独立性构成重大不利影响，督促发行人做好信息披露和风险揭示

1、发行人向合肥蓝科租赁厂房的具体用途、对发行人的重要程度，以及是否能够确保发行人长期使用

发行人向合肥蓝科租赁厂房的具体用途如下：

序号	物业名称	房屋建筑面积 (m ²)	具体用途
1	1号建筑	173,982.92	用于晶圆加工生产、研发以及公司员工办公
2	2号建筑	5,664.48	仓库
3	3号建筑	5,332.85	废水处理站
4	4号建筑	26,776.98	综合动力站
5	5号建筑	974.53	大宗气体站
6	6号建筑	587.25	特气供应间
7	7号建筑	241.21	硅烷供应间
8	8号建筑	339.81	化学品库
9	9号建筑	600.6	化学品库
10	10号建筑	529.26	化学品供应间
11	13号建筑	105.31	门卫
12	14号建筑	106.69	门卫
13	15号建筑	28.72	门卫

发行人向关联方合肥蓝科租赁土地、厂房作为发行人目前主要生产经营地点，用途涵盖公司生产、研发、办公，重要性较高，鉴于：

（1）根据发行人与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》，发行人向合肥蓝科租赁的厂房设施及土地的租赁期限至 2049 年 6 月 27 日。

（2）根据合肥蓝科出具的《关于厂房设施租赁的承诺函》，在发行人如约履行本合同的情况下：（A）未经发行人同意，合肥蓝科不向其他单位或个人出租或处置上述租赁物业；（B）租赁期届满后，若发行人无重大营运问题且发行人需继续承租上述租赁物业，合肥蓝科承诺按照市场公允价格租赁给发行人。

综上，发行人能够长期使用上述厂房、土地，不会对发行人正常生产经营造成重大不利影响。

2、发行人向关联方租赁物业的背景及未投入发行人的原因

根据合肥市政府与力晶科技签订的《合作框架协议》，双方共同合作实施合肥新站综合开发试验区 12 英寸晶圆制造基地项目，项目厂房建设所需资金约 20.4 亿元由合肥市政府提供，项目选址位于合肥新站区综合保税区内。合肥市政府负责提供土地与厂房建设资金，并以租赁方式供项目公司使用该土地及厂房。

合肥蓝科系合肥市国资委下属国资管理经营平台，亦系合肥建投的全资子公司，《合作框架协议》签订时，合肥综合保税区的整体基础设施的建设由合肥蓝科负责，相关土地均在合肥蓝科名下，合肥蓝科对合肥综合保税区整体办理了建设用地规划许可，因此由合肥蓝科负责落实合肥市政府招商引资相关政策，根据项目实际需要建设了相关厂房并出租给公司使用。相关厂房以租赁方式提供给公司使用系合肥市政府与力晶科技合作初始确定的招商引资政策之一，因此未投入公司。

3、租赁费用的公允性

（1）厂房及一厂配套设施的租赁费用

根据《合作框架协议》、《审计报告》以及发行人相关董事会及股东大会会议文件，发行人向合肥蓝科租赁土地、厂房及配套厂务设施的租金系按照合肥蓝科相关土

地、厂房及配套设施实际建设成本以 30 年折旧年限计算的年折旧金额收取，相关租赁价格较为优惠，系因合肥市政府招商引资政策，根据《审计报告》，公司已按照相应会计准则进行处理，具体为：公司按照最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，长期应付款的入账价值与最低租赁付款额现值的差额，确认为未确认融资费用，在租赁期内采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。融资租入资产按照竣工决算金额入账，公司对于竣工决算金额与最低租赁付款额现值的差额，确认为政府补助，计入递延收益，在租赁期内进行分摊，计入其他收益。

2021 年 3 月，公司董事会、股东大会已对上述关联租赁予以确认，独立董事发表了独立意见，上述关联交易已按照公司章程履行了相应的决策程序。

综上，公司厂房及一厂配套设施的租赁价格较为优惠，属于合肥市政府招商引资政策之一，公司厂房及一厂配套设施的租赁价格具备合理性。

（2）二厂配套设施的租赁费用的公允性

根据发行人相关董事会、股东大会会议文件以及上市公司委托建设方代建项目的相关公告，并与合肥蓝科总经理进行了访谈，公司拟租赁的二厂相关配套设施的租金按项目总投资额（暂定人民币 15 亿元，最终按照竣工决算价格调整）以 10 年回收建造成本加年投资回报率 6%的收益计算收取，该等租金价格系双方经商业谈判协商确定，双方协商在项目建造成本的基础上按照 6%的年化收益计算回报率，主要考虑了以下因素：

①合肥蓝科的融资成本。公司二厂项目由合肥蓝科出资建设，项目投资成本及收益分 10 年逐步收回，因此合肥蓝科需考虑其沉淀资金的融资成本。根据访谈了解，合肥蓝科目前融资成本约为 4.2%左右，6%的收益率首先要覆盖其融资成本。

②合肥蓝科在覆盖成本的基础上获得合理的收益。二厂相关配套设施项目的投资回报率系双方通过商业谈判协商确定，合肥蓝科在覆盖其融资成本的基础上，取得年化收益率 1.8%左右的投资收益。参考上市公司公开披露信息，其委托建设方代建项目支付的代建费费率一般在 2%-3%，但大部分项目的投资总额低于合肥蓝科上述项目，因此费率略高于合肥蓝科（1.8%）。

综上，公司二厂配套设施的租赁费用具备公允性。

4、发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套设施今后的处置方案

发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套设施今后的处置方案，详见本补充法律意见书第 12.3 题之“（二）发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套厂务设备的内容，各厂房的建设进度和使用情况，发行人大额固定资产、在建工程与上述厂房的关系，租用协议到期后固定资产的安置方式，结合上述情况具体说明租赁厂房的业务合理性”的相关回复。

5、总体结论

综上所述，发行人持续、稳定的通过上述租赁房产开展生产经营活动，未出现因合肥蓝科等相关出租方单方面原因，导致发行人不能继续租赁生产经营场所、无法从事生产、研发等经营活动的情形，未因租赁房产而对生产经营产生不利影响。合肥蓝科已出具确认函，确认租赁期限内发行人可持续租赁相关物业，合肥蓝科不会向第三方出租或处置相关物业，且租赁期满后如发行人有租赁需求亦可继续租赁使用。综上所述，发行人租赁合肥蓝科物业能够长期使用，租赁合肥蓝科物业用于生产经营对发行人的资产完整和独立性不构成重大不利影响。

十、《问询函》第 12.4 题：订单互补支持

根据提交的委托经营管理协议，存在关于订单互补支持的约定：当力晶科技之业务量需求超过力晶科技产能，且发行人之产能仍可支持时，力晶科技应移转订单到发行人进行生产。当发行人之业务量超过发行人产能，且力晶科技产能仍可支持时，发行人应移转订单到力晶科技。针对代工移转订价，应考虑市场行情、符合法定并且双方互利。

请发行人说明：（1）上述订单互补支持约定的原因及实际执行情况；（2）报告期内发行人通过力晶科技及其关联方开拓的客户、独立开拓的客户及相应占比，是否属于共用销售渠道，在订单互补支持的情况下发行人业务是否独立；（3）报告期内从

力晶科技转让订单对应的销售模式、客户、金额及占比，销售价格的公允性，委托经营协议终止前后发行人与主要客户的合作方式具体变化，对发行人生产经营的影响。

请保荐机构和发行人律师对上述事项（1）和（2），申报会计师对上述事项（3）进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）上述订单互补支持约定的原因及实际执行情况

根据发行人、力晶科技书面确认并经访谈发行人主要客户、供应商，签订《委托经营管理合约》的本意系落实《合作框架协议》项下力晶科技导入建厂经验的责任，约束力晶科技帮助公司建立独立的营运能力。《委托经营管理合约》中约定订单互补支持，主要系出于表达双方合作的友好关系及合作愿景。

在公司设立并开始经营后，自 2016 年起发行人自行聘用员工，在较短时间内建立了经营团队，在产品验证、业务拓展方面进展顺利。随着发行人产能的逐步释放，发行人业务经营状况良好，具备了自主开展业务经营及开拓客户的能力，公司出于独立经营的考虑亦未要求力晶科技提供业务方面的支持。报告期内，双方未实际履行订单互补支持相关条款。

（二）报告期内发行人通过力晶科技及其关联方开拓的客户、独立开拓的客户及相应占比，是否属于共用销售渠道，在订单互补支持的情况下发行人业务是否独立

根据《技术移转协议》、力晶科技出具的《确认函》，并经本所律师实地走访及访谈了发行人报告期内的主要客户、供应商，2015 年 10 月，晶合有限与力晶科技、合肥建投签订《技术移转协议》，约定力晶科技以三项制程技术（即 0.15um 大尺寸驱动 IC 及 90nm/0.11um 小尺寸驱动 IC 制程技术）作价 20 亿元出资晶合有限，拟投入的三项制程技术包含专利技术、技术文件及数据以及运用该等技术过程中形成的技术经验等内容。根据发行人与力晶科技的《技术移转完成证明书》，力晶科技于 2018 年 3 月 31 日已完成技转。根据双方约定，上述技术移转完成的标志之一即需要完成产品验证。

在上述技术移转和产品验证的过程中，力晶科技负责将与发行人客户奇景光电和

奕力科技涉及技术移转的相关 PDK（制造工艺设计包）、制程资料等技术文件和数据资料移转至发行人，以此完成发行人初期产品和工艺平台的验证，而后续与该等客户谈判、确定合作、试产、风险量产、量产以及后续客户关系维护等均由发行人独立完成。因此，奇景光电和奕力科技不属于报告期内发行人通过力晶科技及其关联方开拓的客户，不属于共用销售渠道，不存在订单互补支持的情形，发行人业务独立。

报告期内，除上述情况外，发行人的其他客户亦均由发行人独立开拓，不存在共用销售渠道或订单互补支持的情形，发行人业务独立。

十一、《问询函》第 12.5 题：社保缴纳情况

报告期各期末在境内缴纳社会保险、住房公积金的人数为 300 多人，占员工总人数比例 20%以上。

请发行人说明：台湾籍员工的数量、职位分布、劳动合同关系、薪酬支付与社保缴纳主体，与力晶科技是否相独立。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

根据发行人提供的员工名单及工资表、中国台湾籍员工劳动合同、社保缴纳凭证、中国台湾劳务公司代缴劳健保的相关协议并经本所律师与代缴公司确认，报告期内，发行人中国台湾籍员工均与发行人或其子公司签订了劳动合同，由发行人或其子公司承担薪酬，其中主要为制造、研发人员，具体情况如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
台籍员工数量	264	299	296
其中：			
研发人员	59	64	44

制造人员	157	182	200
销售人员	15	11	9
管理人员	33	42	44

报告期内，除日本子公司员工外，发行人台籍员工通过中国台湾第三方劳务公司怡东人事顾问股份有限公司（以下简称“怡东人事”）为其在中国台湾地区缴纳劳健保。

根据怡东人事及力晶科技出具的书面确认，怡东人事主要在中国台湾地区从事人力派遣、人力管理顾问等业务，与力晶科技之间不存在关联关系，为发行人独立采购。怡东人事的基本情况如下：

公司名称	怡东人事顾问股份有限公司			
公司统一编号	70523522			
公司所在地	台北市松山区复兴北路 101 号 9 楼			
注册日期	2000 年 6 月 5 日			
代表公司负责人	刘东奇			
经营范围	管理顾问业；其他顾问服务业；资讯软体服务业；资料处理服务业；电子资讯供应服务业；一般广告服务业；人力派遣业；其他工商服务业；产业育成业；国际贸易业；仓储业；理货包装业；就业服务业；除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务			
股份总数	47,000 股			
资本总额	47,000,000 新台币元			
实收资本总额	47,000,000 新台币元			
股东情况	怡东控股股份有限公司持股 100%，怡东控股股份有限公司的股权结构如下：			
	序号	姓名	持股数量（股）	持股比例
	1	刘东奇	4,746,800	47.47%

	2	刘少杰	444,700	4.45%
	3	刘少淳	176,600	1.77%
	4	洪彦欣	4,631,900	46.32%
	合计		10,000,000	100%
董事情况	刘东奇、刘少杰、刘少淳			

综上，本所认为，发行人中国台湾籍员工的劳动合同关系、薪酬支付与社保缴纳主体，均与力晶科技相独立。

十二、《问询函》第 12.6 题

请发行人结合上述委托经营管理、委派管理人员、与力晶科技之间的技术出资及转让、订单互补支持、社保缴纳等相关事项，说明发行人是否符合《注册管理办法》第十条和第十二条的规定。

请保荐机构、发行人律师和申报会计师说明对委托经营管理是否影响发行人独立性的结论所履行的核查程序，依据是否充分。

回复：

（一）核查程序

针对委托经营管理是否影响发行人独立性，发行人律师执行了以下核查程序：

1、取得并核查了《委托经营管理合约》，并就《委托经营管理合约》签订及履行的情况与发行人相关人员进行了访谈；

2、取得并核查了自《委托经营管理合约》签订以来，力晶科技、合肥建投向发行人委派人员的名单，并向发行人相关人员了解委派人员的岗位职责等情况，并就相关人员的具体工作内容与发行人行政部门人员进行了访谈；

3、访谈了发行人相关管理人员，就发行人设立以来运营情况、股东发挥的作用等

事项进行了解；

4、取得并核查了发行人报告期内历次高级管理人员变动相关的会议文件及股东委派文件；

5、取得并核查了自力晶科技入股以来发行人全部台籍员工的名单、曾在力晶科技任职员工的名单，并抽取部分台籍员工的劳动合同进行核查；

6、取得并核查了发行人组织机构图及审批权限表，并与发行人相关人员访谈了解各部门具体人员设置及运行情况等；

7、取得并核查了发行人自设立以来历次股东大会、董事会及其专门委员会、监事会会议文件等资料，抽取发行人日常经营性会议的会议记录，就力晶科技委派人员的参与情况进行了核查；

8、取得并核查了发行人经营管理委员会相关工作制度、会议文件，并就经营管理委员会的运作情况与发行人员工进行访谈；

9、取得并核查了发行人员工花名册，抽取部分员工合同，就发行人员工劳动关系情况进行了核查；

10、访谈了发行人主要客户、供应商，并就主要客户、供应商的开发情况访谈了发行人相关人员，取得发行人员工开发客户过程中的相关支持性证据；

11、取得了发行人、力晶科技分别出具的确认函。

（二）核查意见

经核查，发行人律师认为：

- 1、发行人符合《注册管理办法》第十条和第十二条的规定；
- 2、委托经营管理不影响发行人的独立性，该结论依据充分。

十三、《问询函》第 13 题：关于关联交易

根据申报材料：（1）合肥建投和力晶科技通过向发行人委派管理人员的方式向发行人提供企业管理、会计等相关咨询服务。发行人向合肥建投支付咨询服务费用已于**2020年3月31日**终止，向力晶科技支付的咨询服务费已于**2020年6月30日**终止。

（2）报告期各期，发行人向智成电子采购服务费分别为**177.18**万元、**152.95**万元和**372.62**万元。

请发行人说明：（1）发行人向合肥建投和力晶科技采购相关咨询服务的原因、具体内容和相关方收取服务费的具体用途；（2）委托经营管理协议终止前后提供的咨询服务以及相关人员的差异，咨询服务费于**2020年3月31日**和**2020年6月30日**方才终止的原因；（3）发行人向智成电子采购服务费的具体情况，后续是否具有持续性，相关定价公允性；（4）上述关联交易的会计处理及是否符合企业会计准则的要求。

请保荐机构、发行人律师对上述事项（1）-（3）和申报会计师对上述事项（4）进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）发行人向合肥建投和力晶科技采购相关咨询服务的原因、具体内容和相关方收取服务费的具体用途

1、发行人向合肥建投采购相关咨询服务的原因、具体内容和相关方收取服务费的具体用途

根据发行人与合肥建投签署的三份《咨询服务合约书》，双方约定的咨询服务期间分别为**2016年3月9日至2019年3月8日**、**2019年1月1日至2019年12月31日**和**2020年1月1日至2020年3月31日**。基于合肥建投熟悉大陆地区政策、法规及作业习惯，发行人委托合肥建投提供企业管理、财务、会计及采购、销售、敬业等相关咨询服务。根据约定，报告期内，合肥建投向发行人提供的咨询服务范围，包括企业管理、财务、会计、采购、销售、敬业等业务相关的制度建立、日常作业咨询、人员训练等专业服务。

报告期内，合肥建投通过向发行人委派部分管理人员的方式向发行人提供上述咨询服务，发行人向合肥建投支付咨询服务费用。咨询服务费定价系以发行人同等职级

岗位的平均薪酬为依据确定，定价合理、公允。

关于上述咨询服务费，发行人与合肥建投未就其用途进行约定，合肥建投在收取上述咨询服务费后，可就其用途自行作出安排。

2、发行人向力晶科技采购相关咨询服务的原因、具体内容和相关方收取服务费的具体用途

根据发行人与力晶科技签署的三份《咨询服务合约书》，双方约定的咨询服务期间分别为 2016 年 3 月 9 日至 2019 年 3 月 8 日、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。基于力晶科技拥有丰富的半导体领域运营管理经验，发行人委托力晶科技提供半导体产业财务、会计及审计等相关咨询服务。根据约定，报告期内，力晶科技向发行人提供的咨询服务范围如下：

年度	约定的咨询服务内容
2018 年度、 2019 年度	(1) 半导体营运稽核相关业务，包括内控内稽制度建立、日常稽核作业、流程及人员训练等； (2) 半导体营运财务风险管控、财务日常作业流程、资金管控作业及人员训练等； (3) 半导体营运会计政策及制度审定、会计作业流程建立、会计作业系统导入及维护、人员训练等。
2020 年度	(1) 半导体营运相关业务，包括企业管理、内外部关系协调、行业经验分享等； (2) 半导体营运财务风险管控、财务日常作业流程、资金管控作业及人员训练等； (3) 半导体营运会计政策及制度审定、会计作业流程建立、会计作业系统导入及维护、人员训练等。

报告期内，力晶科技通过向发行人委派部分管理人员的方式向发行人提供上述咨询服务，发行人向力晶科技支付咨询服务费用。咨询服务费定价系参考同行业可比公司的高管薪酬，以发行人同等职级的平均工资为依据确定，定价合理、公允。

报告期各期，发行人向力晶科技采购上述咨询服务确认的咨询服务费涉及岗位如

下：

单位：万元

力晶科技委派人员 任职岗位	发行人确认的咨询服务费 ¹		
	2020 年度 ⁴	2019 年度	2018 年度
董事长 ²	117.92	-	-
审计师/副审计师 ³	17.40	90.19	113.21
副总会计师	17.40	88.87	84.91
合计	152.72	179.06	198.11

注 1：以上金额为不含增值税金额。

注 2：上述“董事长”岗位对应咨询服务费系发行人就 2020 年 1-6 月期间王其国和蔡国智任职公司董事长而确认的服务费。

注 3：报告期内，力晶科技于 2018 年度向发行人委派审计师；于 2019 年度和 2020 年度向发行人委派副审计师，不再委派审计师。

注 4：2020 年度发行人向力晶科技采购上述咨询服务确认的咨询服务费系基于 2020 年实际服务天数计算。

关于上述咨询服务费，发行人与力晶科技未就其用途进行约定，力晶科技在收取上述咨询服务费后，可就其用途自行作出安排。

（二）委托经营管理协议终止前后提供的咨询服务以及相关人员的差异，咨询服务费于 2020 年 3 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日方才终止的原因

1、委托经营管理协议终止前后提供的咨询服务以及相关人员的差异

2020 年 1 月 2 日，发行人与力晶科技签署《委托经营管理合约之终止协议》，双方同意委托经营管理协议自 2019 年 12 月 25 日起即终止。

委托经营管理协议终止前后（即 2019 年 12 月 25 日前后），合肥建投和力晶科技向发行人提供的咨询服务以及相关人员的差异如下：

（1）委托经营管理协议终止前，根据双方 2019 年度签署的《咨询服务合约书》，力晶科技提供的咨询服务内容涵盖“半导体营运稽核相关业务，包括内控内稽制度建立、日常稽核作业、流程及人员训练等”。委托经营管理协议终止后，根据双方 2020 年度签署的《咨询服务合约书》，力晶科技提供的咨询服务内容不再涵盖前述内容，

并新增“半导体营运相关业务，包括企业管理、内外部关系协调、行业经验分享等”。

(2) 2019年12月17日，合肥建投委派杨幼玲担任发行人审计师、敬业促进委员会委员长，原委派人员朱晓娟不再担任审计师、敬业促进委员会委员长。

除上述差异外，委托经营管理协议终止前后，合肥建投和力晶科技向发行人提供的咨询服务以及相关人员的未发生其他变化。

2、咨询服务费于2020年3月31日和2020年6月30日方才终止的原因

根据发行人与合肥建投2020年度签署的《咨询服务合约书》，双方约定咨询服务期间为2020年1月1日至2020年3月31日；根据发行人与力晶科技2020年度签署的《咨询服务合约书》，双方约定咨询服务期间为2020年1月1日至2020年6月30日。上述合约到期终止后，各方未再续签咨询服务合约，咨询服务费相应终止。

发行人与合肥建投、力晶科技签署的《咨询服务合约书》对应的人员委派事项，系依据合肥建投、合肥芯屏、力晶科技于2016年1月20日签订的《关于合肥晶合集成电路有限公司之合资合同》作出，独立于委托经营管理协议的安排，因此，合肥建投、力晶科技向发行人提供咨询服务的行为及发行人支付咨询服务费的行为并不与委托经营管理协议同步终止。

(三) 发行人向智成电子采购服务费的具体情况，后续是否具有持续性，相关定价公允性

1、发行人向智成电子采购服务费的具体情况，后续是否具有持续性

根据发行人与智成电子于2017年5月1日签订的《产品开发、技术授权暨维护合约书》、于2019年3月4日签订的《智成权利金合同》以及于2020年3月31日签订的《智成权利金合同》，智成电子同意以其所有的110nm逻辑制程所需之Standard Cell Library授权发行人，并配合发行人的制程特性，维护发行人向智成电子授权取得之产品技术，以使其符合发行人代工客户需求，并达到效率提升、错误侦错并协助发行人推展逻辑制程代工业务。报告期各期，针对上述IP授权交易，发行人分别确认费用177.18万元、152.95万元和372.62万元。

发行人对外部授权 IP 的选择，主要受代工产品工艺技术要求驱动，未来，发行人不排除基于代工产品工艺技术要求继续向智成电子取得上述 IP 或其他类型 IP 的授权。因此，发行人与智成电子的 IP 授权交易具有持续性。

2、发行人与智成电子的上述交易相关定价公允性

根据发行人与智成电子签署的 IP 授权协议以及发行人与无关联第三方 IP 供应商签订的授权协议，报告期内，发行人与智成电子就上述授权 IP 约定的价款包括前期开发费用和权利金，其中权利金为交易价款的主要组成部分。报告期内，发行人与智成电子约定的授权 IP 权利金为单片晶圆净销售额的 1%。截至 2021 年 4 月 25 日，除智成电子授权 IP 外，发行人正在使用的其他授权 IP 权利金计提比例（按每片晶圆支付固定金额的除外）主要区间为晶圆销售金额或净额的 0.5%-1.5%。因此，发行人与智成电子的上述交易价格仍处于发行人确定的合理价格区间范围内。

对于与智成电子的上述 IP 授权交易，发行人遵循市场化交易原则，与智成电子协商确定 IP 授权价格，采购价格具备公允性。

2021 年 2 月 9 日，发行人召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认合肥晶合集成电路股份有限公司 2018 年度至 2020 年度期间关联交易的议案》；发行人全体独立董事就报告期内的关联交易事项发表了独立意见，认为包括上述 IP 授权交易在内的关联交易，交易定价公允、合理，关联交易事项按照一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。2021 年 3 月 16 日，发行人召开股东大会，审议通过了关于公司报告期内的关联交易的议案，关联股东在股东大会审议该议案时回避表决。

综上，发行人与智成电子的上述 IP 授权交易，交易相关定价具有公允性。

十四、《问询函》第 14 题：关于存在累计未弥补亏损

招股说明书披露，公司在有限责任公司整体变更为股份有限公司时，截至股改基准日 2020 年 9 月 30 日存在累计未弥补亏损。公司在报告期尚未盈利或最近一期存在

累计未弥补亏损。营业收入从 2018 年 2 亿元增长到 2020 年 15 亿元，各期扣非归母净利润在-12 亿元左右。

请发行人按照《问答（一）》第 2 条和第 13 条的要求进行相关信息披露。

请发行人说明营业收入持续上升，扣非归母净利润基本维持不变的原因。

请保荐机构、申报会计师和发行人律师分别按照《问答（一）》的要求进行核查并发表明确意见，申报会计师对说明事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）按照《问答（一）》第 2 条要求进行的核查

1、核查程序

（1）逐条对照《问答（一）》第 2 条关于尚未盈利或最近一期存在累计未弥补亏损情形的信息披露要求，对本次发行招股说明书披露内容的完整性进行了核查；

（2）了解发行人的销售、采购及生产模式等业务，实地查看经营场所，了解发行人发展战略、经营策略及未来市场布局情况，访谈公司管理层，了解尚未盈利的影响趋势风险因素等情况；

（3）获取发行人的销售预测，分析相关假设的数据基础及相关预测的合理性。

2、核查意见

经核查，本所认为：

（1）发行人已按照《问答（一）》第 2 条的要求，在招股说明书中就其尚未盈利及最近一期存在累计未弥补亏损情形进行了完整披露，符合上交所关于信息披露的相关规定。

（2）发行人尚未实现盈利，但具备获得持续经营性现金流的能力、能够持续拓展业务领域和核心客户、具有人才吸引力并保持核心研发团队的稳定性、研发投入金额逐年增加、相关战略性投入符合公司的发展要求，发行人具有持续经营的能力，报告

期内尚未盈利对公司持续经营能力不会产生重大不利影响。

（二）按照《问答（一）》第 13 条要求进行的核查

1、关于信息披露要求的核查

（1）核查程序

本所律师逐条对照《问答（一）》第 13 条关于整体变更时存在累计未弥补亏损情形的信息披露要求，对本次发行招股说明书披露内容的完整性进行了核查。

（2）核查意见

经核查，本所认为，发行人已按照《问答（一）》第 13 条的要求，在招股说明书中就其整体变更时存在累计未弥补亏损情形进行了完整披露，符合上交所关于信息披露的相关规定。

2、关于要求核查事项的核查

（1）核查程序

①查阅发行人整体变更时的有限公司董事会、股份公司创立大会决议；

②查阅发行人整体变更时的审计报告、资产评估报告及国资委备案文件、发起人协议、国资委批复文件、验资报告等文件；

③对发行人整体改制是否存在侵害债权人合法权益的情形进行分析，并查阅中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等，确认是否存在改制中侵害债权人合法权益而导致的纠纷；

④查阅发行人整体变更已完成工商登记注册相关文件；

⑤对发行人整体变更相关事项是否符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定进行分析。

（2）核查意见

经核查，本所认为：

①发行人整体变更相关事项已经有限公司董事会、股份公司创立大会表决通过，相关程序合法合规

②改制中不存在侵害债权人合法权益情形，与债权人不存在纠纷

2020年10月21日，晶合有限召开董事会，同意公司整体变更为股份公司的方案，整体变更后的注册资本为1,504,601,368元，未高于晶合有限经审计的净资产额7,353,140,545.50元，同时，公司的一切资产及债权、债务，由依法变更后的股份公司继承，不存在通过自身资产的调整或者企业间资产转移等行为侵害债权人合法权益的情形。

经查询中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在改制中侵害债权人合法权益而导致的纠纷。

③发行人整体变更已完成工商登记注册和税务登记相关程序

就整体变更为股份有限公司事宜，发行人已于2020年11月25日取得合肥市市场监督管理局向发行人核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q）。

根据《国家税务总局关于落实“三证合一”登记制度改革的通知》（税总函[2015]482号）的相关规定，2015年10月1日后新设企业领取由工商行政管理部门核发加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照后，无需再次进行税务登记，不再领取税务登记证。

④发行人整体变更相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定

a.发起人符合法定人数

根据发行人创立大会文件及全体发起人签署的《合肥晶合集成电路股份有限公司发起人协议》，发行人发起设立时的发起人共计30人，其中有半数以上的发起人在中国境内有住所，符合《公司法》第七十八条的规定。

b.筹办事项符合法律规定

根据全体发起人签署的《合肥晶合集成电路股份有限公司发起人协议》，发起人授权晶合有限董事会办理将有限公司整体变更为股份公司的相关事宜，并于前述协议中明确了各发起人的权利义务，符合《公司法》第七十九条的规定。

c.全体发起人认购的股本总额符合法律规定

根据发行人整体变更时制定的公司章程、发起人签署的《合肥晶合集成电路股份有限公司发起人协议》，全体发起人认购股本总额为 1,504,601,368 元。容诚于 2020 年 11 月 20 日出具容诚验字[2020]230Z0263 号的《验资报告》，根据该《验资报告》，发行人设立时注册资本已足额缴纳，符合《公司法》第八十条、第八十三条的规定。

发行人整体变更折合的实收股本总额为 1,504,601,368 元，不高于晶合有限净资产额，符合《公司法》第九十五条的规定。

d.发起设立时的公司章程符合法律规定

发行人发起设立时的公司章程包括了《公司法》所要求的股份有限公司章程的必备条款，符合《公司法》第七十六条第（四）项、第八十一条的规定。

e.符合股份有限公司要求的组织机构、公司住所

根据发行人取得的统一社会信用代码为 91340100343821433Q 的营业执照、全体发起人签署的《合肥晶合集成电路股份有限公司发起人协议》及发起设立时的公司章程，发行人公司名称为“合肥晶合集成电路股份有限公司”，同时其建立了股东大会、董事会、监事会等符合股份有限公司要求的组织机构，公司住所为安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号，符合《公司法》第七十六条第（五）项和第（六）项的规定。

十五、《问询函》第 22 题：关于信息披露豁免

发行人申请豁免披露的信息主要包括前五大客户及前五大供应商名称，应收账款

及应付账款等往来款前五大交易对手方名称。在招股书前五大客户和前五大原材料供应商情况中以第一名、第二名、第三名等进行替代。

请发行人说明：（1）严格按照《审核问答》第 16 条要求说明信息披露豁免的原因和依据，豁免披露后的信息是否对投资者决策判断构成重大障碍，豁免披露的信息是否尚未泄漏；（2）如果确有理由豁免披露，请修改信息披露替代方案，同一客户或供应商应有同一明确代称。

请保荐机构、申报会计师和发行人律师应审慎认定信息披露豁免事项，并按照《审核问答》要求出具核查报告。

回复：

发行人、保荐机构、发行人律师、申报会计师已依据《审核问答》第 16 条要求，重新提交《合肥晶合集成电路股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的信息披露豁免申请》《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司信息豁免披露申请的核查意见》《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司信息豁免披露的专项核查报告》《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）<关于合肥晶合集成电路股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市之申请文件信息披露豁免相关事宜的专项核查意见>》。

十六、《问询函》第 24 题：关于募投项目

招股说明书披露：（1）本次募集资金将全部投入合肥晶合集成电路股份有限公司 12 英寸晶圆制造二厂项目。本项目利用一厂建设工程项目所建设的 12 英寸集成电路芯片制造二厂厂房主体，建设一条产能为 4 万片/月的 12 英寸晶圆代工生产线，主要产品包括电源管理芯片（PMIC）、显示驱动整合芯片（DDIC）、CMOS 图像传感芯片（CIS），另外，将建设一条微生产线用于 OLED 显示驱动与逻辑工艺技术开发试产。（2）发行人本次募集资金拟投资的“12 英寸晶圆制造二厂项目”目前处于立项阶段，尚需在开工建设前办理环评相关手续。

请发行人说明：（1）募投项目所实现的制程节点情况；结合发行人相关产品的市场需求及竞争状况、技术水平等，分析发行人募投项目未来的市场空间和产能消化能力；（2）4万片/月的12英寸晶圆代工生产线与用于OLED显示驱动与逻辑工艺技术开发试产的微生产线之间的关系，新增固定资产折旧摊销额预计对公司未来业绩的影响；（3）募投项目未办理环评相关手续的原因，目前进展情况，是否存在无法获得审批的风险。

请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见，请发行人律师对上述事项（3）进行核查并发表明确意见。

回复：

募投项目未办理环评相关手续的原因，目前进展情况，是否存在无法获得审批的风险

目前，发行人就本次募投项目正在向相关部门申请备案，备案完成后将向环保主管部门申请办理环评相关审批手续。

合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局已于2021年1月13日在合肥市主持召开了《合肥晶合集成电路股份有限公司12吋晶圆制造二厂项目环境影响报告表》技术评审会，与会专家及代表经评议出具技术评审意见，认为：报告表编制较规范，基本符合相关要求，评价结论基本可信，经修改完善后可上报审批。

根据环境影响评价相关法律、法规的规定，“12英寸晶圆制造二厂项目”后续环评审批具体的办理安排包括：公司修改完善环境影响报告表，向环保主管部门提交建设项目环境影响报告表审批申请文件；环保主管部门对环境影响报告表进行审查，出具审批意见并将相关信息进行公示。此外，合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局于2021年6月11日出具《关于12吋晶圆制造二厂项目相关环评事项的说明》，“本局认为，待晶合集成完成项目发改委备案程序后，该项目环评可上报审批。”

综上，本所认为，发行人就募投项目取得环评批复不存在实质性障碍。

十七、《问询函》第 25 题：关于股东核查情况

请发行人和有关中介机构按照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》、《监管规则适用指引——发行类第 2 号》、《关于科创板落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》等要求，对相关事项进行核查和披露，并出具专项核查报告。

回复：

根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》《监管规则适用指引——发行类第 2 号》《关于科创板落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》《关于股东信息核查中“最终持有人”的理解与适用》的要求，本所已对相关事项进行核查和披露，并出具《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司证监会系统离职人员入股的专项说明》，详见本次申报文件之“7-8-9”。

（本页以下无正文，下接签章页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（一）》之签章页)



经办律师: 苏峰

苏峰

刘东亚

刘东亚

单位负责人: 王玲

王玲

二〇二一年七月十三日

北京市金杜律师事务所
关于合肥晶合集成电路股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
补充法律意见书（二）

致：合肥晶合集成电路股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“发行人”）委托，担任发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已出具《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）和《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

鉴于上交所于 2021 年 8 月 6 日下发《关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（审核）[2021]488 号）（以下简称“《问询函》”），本所现根据《问询函》的要求，就其中所涉及的法律问题进行核查，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对本所已出具的《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》的补充，并构成《法律意见书》《律师工作报告》不可分割的组成部分；本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》中对相关用语的释义、缩写适用于本补充法律意见书；本所在《法律意见书》《律师工作报告》中发表法律意见的引言、前提和假设同样适用于本补充法律意见书。对于本补充法律意见书特别说明的事项，以本补充法律意见书的说明为准。

在本补充法律意见书中，本所仅就与发行人本次发行上市有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。本所不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项及境外法律事项发表意见，在本补充法律意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告、验资报告及境外法律意见等某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所不具备核查和评价该等数据的适当资格。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市制作的《招股说明书（申报稿）》中自行引用或按照中国证监会、上交所的审核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，根据有关法律、法规和中国证监会及上交所有关规定的要求，出具本补充法律意见如下：

目录

一、《问询函》第1题：关于委托经营管理.....	4
二、《问询函》第2题：关于订单互补.....	15
三、《问询函》第3题：关于人员.....	23
四、《问询函》第5题：关于实际控制人认定.....	27
五、《问询函》第6题：关于力晶科技从事同类业务.....	41
六、《问询函》第7题：关于无形资产和技术.....	45
七、《问询函》第9题：关于其他.....	49

一、《问询函》第 1 题：关于委托经营管理

根据问询回复：2015 年 10 月 19 日，力晶科技与公司签订《委托经营管理合约》，主要目的系促进双方合作以及配合技术导入，帮助公司尽快建立独立的营运能力；同时，如发行人出现经营、发展状况不及预期时，合肥国资方也能够约束力晶科技向公司投入更多精力与支持，降低投资风险。

尽管《委托经营管理合约》的合同名称包含“委托经营”，但签订《委托经营管理合约》的本意系落实《合作框架协议》项下力晶科技导入建厂经验的责任，约束力晶科技帮助公司建立独立的营运能力，协议中并未约定委托经营的期限、委托经营的费用以及相关违约责任等在常规委托经营模式下的约定事项。在实际履行过程中，双方仅根据公司发展的需求履行了部分条款，公司与力晶科技之间相互独立，力晶科技未将公司视为在大陆的子厂，公司未将经营管理权委托予力晶科技。

请发行人说明：（1）发行人与力晶科技之间签订委托经营管理合约但仅部分履行，与委托经营协议中约定的力晶科技应将公司视为其工厂之延伸的目标实际执行不一致的合理性，是否与实际情况相符；（2）在发行人未将日常经营运作委托力晶科技管理，未执行订单互补支持等条款的情况下，发行人短期内能够满足独立性要求的合理性。

请保荐机构、发行人律师和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。请保荐机构、申报会计师和发行人律师说明对委托经营管理合约实际执行情况所履行的核查手段、获取的核查证据，对认定委托经营管理合约签订后，发行人未将经营管理权委托予力晶科技的依据是否充分发表明确意见。

回复：

（一）发行人与力晶科技之间签订委托经营管理合约但仅部分履行，与委托经营协议中约定的力晶科技应将公司视为其工厂之延伸的目标实际执行不一致的合理性，是否与实际情况相符

《委托经营管理合约》第四条约定：“甲方应将乙方视为甲方工厂之延伸，全力支持乙方之经营管理，使乙方迅速获利、扩充产能并且达成 IPO 之目标”，其中，“甲方应将乙方视为甲方工厂之延伸”系表达力晶科技合作态度、强调力晶科技应对

发行人投入大力支持，帮助发行人尽快实现“迅速获利、扩充产能并且达成 IPO 之目标”。约定该条款的目的系为了促进双方合作，约束力晶科技向发行人投入更多精力，以及降低投资风险，并非将公司“视为其工厂之延伸”作为委托经营管理的目标。

《委托经营管理合约》签订于 2015 年 10 月，签署时合肥国资方与力晶科技之间尚未正式展开合作，相关条款系双方充分考虑未来合作过程中可能遇到的问题和风险而设定。在公司设立并开始经营后，自 2016 年起自行聘用员工，在较短时间内建立了经营团队，并拥有了生产经营必需的相关技术和业务渠道，具备了公司运营的各方面能力，因此，双方仅根据公司发展的需求履行了部分条款。《委托经营管理合约》终止前，公司的重大决策由公司董事会独立进行决策，公司日常运营仍以发行人自身员工和合肥国资方委派高管为主导，公司日常运营中管理、业务、财务等方面均由发行人独立决策，与力晶科技独立，公司的客户、供应商的谈判、关系维护、协议签订等均由公司独立完成，公司内部审批流程除力晶科技委派高级管理人员参与外，不存在力晶科技其他人员参与的情形。《委托经营管理合约》履行过程中，公司与力晶科技之间相互独立，力晶科技未将公司视为在大陆的子厂，公司未将经营管理权委托予力晶科技。

2021 年 8 月，合肥市人民政府出具确认函：“一、为落实国家关于集成电路产业发展的规划，我市于 2015 年引进力晶科技股份有限公司（以下简称力晶科技）合作建设合肥晶合 12 英寸晶圆制造基地项目，着力提升自主可控的芯片制造能力。

二、2015 年 4 月，我市与力晶科技签署《12 吋晶圆制造基地项目合作框架协议书》（以下简称《合作框架协议》），后晶合集成按照协议约定与力晶科技签订《委托经营管理合约》。主要目的系促进双方合作关系，配合晶合集成建厂以及初期技术导入，如晶合集成出现经营、发展状况不及预期时，也能够约束力晶科技向晶合集成投入更多精力与支持，降低投资风险，并非将晶合集成经营管理权交予力晶科技。”

综上，“将乙方视为甲方工厂之延伸”并非委托经营管理的目标，双方根据公司发展的需求履行了部分条款与委托经营协议中“将乙方视为甲方工厂之延伸”的约定不一致存在合理性，且与实际情况相符。

（二）在发行人未将日常经营运作委托力晶科技管理，未执行订单互补支持等条款的情况下，发行人短期内能够满足独立性要求的合理性

1、公司员工及经营团队建立顺利

2015年10月《委托经营管理合约》签订后，公司逐步组建了自身的经营团队及相应职能部门。截至2017年末，公司已组建了采购、销售、生产、财务等各项公司运营所需的职能部门，员工人数达1,000余人，其中台籍员工约240余人，约110余人为曾在力晶科技任职。较多员工具备集成电路上下游行业的从业经验，除部分管理岗位由双方股东委派的高级管理人员兼任外，公司已拥有日常运营所需的人员，具备了独立营运的基础，不存在将日常营运委托给力晶科技的需求和必要性。

2、厂房等基础设施建设顺利

2015年10月，合肥建投与力晶科技签订《投资参股协议》后，合肥蓝科即开工建设晶合一厂相关基础设施，并于2016年11月完成主体厂房的建设，2017年7月完成洁净室及相关配套厂务设施的建设，并于2017年10月实现正式量产。

发行人设立、建设厂房及配套厂务设施、搬入机台设备、试生产并最终实现量产的过程中，各阶段在经营团队的提前规划下衔接紧凑，使发行人能够在较短时间内实现正式量产，具备了独立经营、开拓业务的能力。

3、技术移转进展顺利

2015年10月，合肥建投、发行人与力晶科技签署《技术移转协议》，约定了力晶科技三项制程技术移转的步骤及实施细节。力晶科技基于《技术移转协议》后续向发行人先后移转了三项制程技术所需全部专利、其他技术文件及数据、技术经验等完整的工艺平台制程技术包。技术移转完成后，发行人具备了独立运营的技术基础。

4、客户开拓及产品验证顺利

在技术移转的过程中，力晶科技负责将奇景光电和奕力科技推荐给发行人，以此完成发行人初期产品和工艺平台的验证。相关技术移转成后，发行人与奇景光电、奕力科技独立沟通、谈判签署相关合同订单，并完成试产、风险量产、量产等工作。除上述情况外，发行人其余主要客户均为发行人自主联系、独立开发。发行人在正式量产后，逐步与多家行业内知名企业建立合作，在显示驱动芯片代工领域建立了自己的客户基础，具备了独立运营的业务拓展能力。

综上所述，发行人员工及经营团队建立、厂房等基础设施建设、技术移转、客户开拓及产品验证等方面均进展顺利。因此，发行人在未将日常经营运作委托予力晶科技管理、未执行订单互补支持等条款的情况下，短期内建立起独立运营能力，具备合理性。

（三）请保荐机构、申报会计师和发行人律师说明对委托经营管理合约实际执行情况所履行的核查手段、获取的核查证据，对认定委托经营管理合约签订后，发行人未将经营管理权委托予力晶科技的依据是否充分发表明确意见

对委托经营管理合约实际执行情况，本所律师履行了以下核查手段、获取了以下核查证据：

序号	条款内容及核查手段、获取的核查证据	履行情况
1	<p>条款内容： 乙方审计师、副总会计师由甲方指派</p> <p>核查手段、获取的核查证据： 1、取得并核查了发行人历次聘任审计师、副总会计师的相关董事会决议； 2、取得并核查了力晶科技出具的确认函。</p>	实际履行
2	<p>条款内容： 其他经营管理团队由甲方指派</p> <p>核查手段、获取的核查证据： 1、取得发行人历次高级管理人员变动相关的会议文件； 2、取得并核查了《委托经营管理合约》，并就《委托经营管理合约》签订及履行的情况与发行人相关人员进行了访谈； 3、取得并核查了自《委托经营管理合约》签订以来，力晶科技、合肥建投向发行人委派人员的名单，并向发行人相关人员了解委派人员的岗位职责等情况； 4、取得并核查了自力晶科技入股以来发行人全部台籍员工的名单、曾在力晶科技任职员工的名单； 5、取得并核查了发行人组织机构图及审批权限表，并与发行人相关人员访谈了解各部门具体人员设置及运行情况等； 6、取得并核查了发行人自设立以来历次董事会会议、经营管理委员会会议记录等资料，抽取发行人日常经营性会议的会议记录，就力晶科技委</p>	未实际履行

序号	条款内容及核查手段、获取的核查证据	履行情况
	派人员的参与情况进行了核查； 7、取得并核查了发行人员工花名册，抽取部分员工合同，就发行人员工劳动关系情况进行了核查； 8、取得发行人经营管理层各项会议的文件和说明； 9、取得了力晶科技就委托经营管理相关事项出具的确认函。	
3	条款内容： 乙方财务实行总会计师与副总会计师会签及核决制度 核查手段、获取的核查证据： 1、取得并核查了发行人历次聘任总会计师、副总会计师的相关董事会决议； 2、取得并核查了发行人组织机构图及审批权限表，并与发行人相关人员访谈了解各部门具体人员设置及运行情况等。	实际履行
4	条款内容： 乙方采购、销售业务实行总监与副总监会签制度 核查手段、获取的核查证据： 1、取得发行人历次高级管理人员变动相关的会议文件； 2、取得并核查了发行人组织机构图及审批权限表，并与发行人相关人员访谈了解各部门具体人员设置及运行情况等。	实际履行
5	条款内容： 乙方日常经营运作，包含业务、生产营运、组织人事、技术等皆委托甲方管理 核查手段、获取的核查证据： 1、取得并核查了《委托经营管理合约》，并就《委托经营管理合约》签订及履行的情况与发行人相关人员进行了访谈； 2、访谈力晶科技副总经理等相关人员，了解《委托经营管理合约》签订的背景、具体条款的履行情况、部分条款未履行的原因、约定“甲方应将乙方视为甲方工厂之延伸”的原因及实际执行等； 3、访谈合肥建投总经理等相关人员，了解《委托经营管理合约》签订的背景、具体条款的履行情况、部分条款未履行的原因以及《委托经营管理合约》的解除等相关情况； 4、取得并核查了《委托经营管理合约》存续期间，力晶科技与合肥建投之间沟通的相关会议纪要； 5、取得了发行人、力晶科技、合肥建投分别出具的与《委托经营管理合	未实际履行

序号	条款内容及核查手段、获取的核查证据	履行情况
	<p>约》签订、履行、解除情况相关的确认函；</p> <p>6、取得并核查了发行人自设立以来历次董事会会议、经营管理委员会会议记录等资料，抽取发行人日常经营性会议的会议记录，就力晶科技委派人员的参与情况进行了核查；</p> <p>7、取得并核查了发行人组织机构图及审批权限表，并与发行人相关人员访谈了解各部门具体人员设置及运行情况等，抽取部分公司内部审批流程文件，核查了力晶科技相关人员的参与情况；</p> <p>8、取得并核查了自《委托经营管理合约》签订以来，力晶科技、合肥建投向发行人委派人员的名单，并向发行人相关人员了解委派人员的岗位职责等情况；</p> <p>9、取得并核查了自力晶科技入股以来发行人全部台籍员工的名单、曾在力晶科技任职员工的名单及离职证明；</p> <p>10、取得并核查了发行人员工花名册、工资表以及缴纳社保、公积金的明细，抽取部分员工合同，就发行人员工劳动关系情况进行了核查；</p> <p>11、对报告期内发行人主要客户进行实地走访/视频访谈，询问客户在与发行人的合作过程中，是否存在从力晶科技转移订单至发行人的情形，以及力晶科技及力积电是否影响发行人的销售和采购，是否存在非公平竞争、利益输送等情形；就报告期内发行人主要客户与发行人的合作情况、初次接洽情况、与力晶科技的关联关系以及历史合作情况等进行咨询并形成书面访谈记录，获取客户确认的与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系确认函、交易真实性的承诺函；</p> <p>12、就发行人客户、供应商的开发过程及订单互补的履行情况与发行人相关员工进行了访谈，了解公司销售业务的流程、客户获取方式、订单签订流程，并取得了力晶科技出具的确认函；</p> <p>13、取得发行人与主要客户谈判、确定合作以及后续客户关系维护等过程的电子邮件等支持性证据；</p> <p>14、获取报告期内发行人开发客户时与客户的沟通记录，检查发行人的主要客户订单下达方式及相关记录，查阅了发行人与主要客户签署的框架合同、订单、产能预约合同等，核查其是否与力晶科技之间有关系；</p> <p>15、获取发行人销售人员与发行人签订的劳动合同，核查其是否与力晶科技之间有关系；</p> <p>16、对报告期内主要客户收入进行核查，获取并核对客户报告期内收入明细对应的销售订单、销售出库单、销售发票、出口报关单、签收单、客户回款对应银行回单，核实销售订单的来源以及销售过程中是否存在力晶科技的参与；</p> <p>17、分析了发行人主要客户数量、客户收入金额分布、产能预约订单等</p>	

序号	条款内容及核查手段、获取的核查证据	履行情况
	<p>资料，访谈了公司管理层及销售相关人员，了解发行人业务发展中与力晶科技及其关联方的关系；</p> <p>18、取得并核查了自《委托经营管理合约》签订以来力晶科技历年公开披露的年报，并就其中与晶合集成相关事宜的披露情况进行了核查。</p>	
6	<p>条款内容：</p> <p>甲方将透过移转与授权技术、移转经营经验与经营管理系统、业务支持互补、移转或派驻经营团队、训练当地之干部与人才等方式，达成乙方付托之经营管理任务</p> <p>核查手段、获取的核查证据：</p> <p>1、核查并取得了发行人与力晶科技签订的《技术移转协议》及其补充协议、确认函，《90nm 项目技术协议》及其补充协议、确认函，并与发行人相关人员访谈了解相关协议的履行情况。</p> <p>2、取得并核查了自力晶科技入股以来发行人全部台籍员工的名单、曾在力晶科技任职员工的名单及离职证明；</p> <p>3、取得并核查了发行人员工花名册、工资表以及缴纳社保、公积金的明细；</p> <p>4、抽取部分员工合同，就发行人员工劳动关系情况进行了核查；</p> <p>5、对报告期内发行人主要客户进行实地走访/视频访谈，询问客户在与发行人的合作过程中，是否存在从力晶科技转移订单至发行人的情形，以及力晶科技及力积电是否影响发行人的销售和采购，是否存在非公平竞争、利益输送等情形；就报告期内发行人主要客户与发行人的合作情况、初次接洽情况、与力晶科技的关联关系以及历史合作情况等进行咨询并形成书面访谈记录，获取客户确认的与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系确认函、交易真实性的承诺函；</p> <p>6、就发行人客户、供应商的开发过程及订单互补的履行情况与发行人相关员工进行了访谈，了解公司销售业务的流程、客户获取方式、订单签订流程，并取得了力晶科技出具的确认函；</p> <p>7、取得发行人与主要客户谈判、确定合作以及后续客户关系维护等过程的电子邮件等支持性证据；</p> <p>8、获取报告期内发行人开发客户时与客户的沟通记录，检查发行人的主要客户订单下达方式及相关记录，查阅了发行人与主要客户签署的框架合同、订单、产能预约合同等，核查其是否与力晶科技之间有关系；</p> <p>9、获取发行人销售人员与发行人签订的劳动合同，核查其是否与力晶科技之间有关系；</p> <p>10、对报告期内主要客户收入进行核查，获取并核对客户报告期内收入</p>	部分履行

序号	条款内容及核查手段、获取的核查证据	履行情况
	<p>明细对应的销售订单、销售出库单、销售发票、出口报关单、签收单、客户回款对应银行回单，核实销售订单的来源以及销售过程中是否存在力晶科技的参与；</p> <p>11、分析了发行人主要客户数量、客户收入金额分布、产能预约订单等资料，访谈了公司管理层及销售相关人员，了解发行人业务发展中与力晶科技及其关联方的关系；</p> <p>12、取得并核查了发行人、合肥建投与力晶科技签订的《技术移转协议》及其补充协议、发行人与力晶科技就《技术移转协议》履行情况签署的确认函以及相关附录、发行人与力晶科技签订的《专利转让协议》等协议文件；</p> <p>13、取得并核查了力晶科技派驻发行人处进行技术移转支持团队的人员安排，以及发行人委派员工前往力晶科技进行培训的人员安排；并取得了发行人员工前往力晶科技培训的差旅费用签核表；</p> <p>14、查看了发行人关于技转文件的电子数据库；抽样核查了力晶科技技转的技术文件资料及附件。</p>	
7	<p>条款内容：</p> <p>甲方除遴选适当人员至乙方各组织，以兼职、派驻或全职身份按相关组织核决权限执行业务外，乙方董事会下应设立经营管理委员会，由甲方之高管及合肥建投委派至乙方，依第一条第一款所列之全部人员担任委员会成员，具体协助董事会指导并督促乙方所有经理人与经营团队</p> <p>核查手段、获取的核查证据：</p> <p>1、取得发行人经营管理委员会相关工作制度、会议文件，并向发行人了解经营管理委员会的运作情况；</p> <p>2、取得并核查了发行人自设立以来历次董事会会议、经营管理委员会会议记录等资料，抽取发行人日常经营性会议的会议记录，就力晶科技委派人员的参与情况进行了核查；</p> <p>3、取得并核查了发行人组织机构图及审批权限表，并与发行人相关人员访谈了解各部门具体人员设置及运行情况等，抽取部分公司内部审批流程文件，核查了力晶科技相关人员的参与情况；</p> <p>4、取得了力晶科技就委托经营管理相关事项出具的确认函。</p>	实际履行
8	<p>条款内容：</p> <p>甲方应按照技术移转协议，于乙方建置完成可进行驱动 IC 代工业务之相关技术，确保乙方能够完全掌握该技术，并可在无须另行依赖其他技术的前提下，完整地生产出本项目所涉全部合格产品。</p> <p>核查手段、获取的核查证据：</p> <p>1、核查并取得了发行人与力晶科技签订的《技术移转协议》及其补充</p>	实际履行

序号	条款内容及核查手段、获取的核查证据	履行情况
	<p>协议、确认函，《90nm 项目技术协议》及其补充协议、确认函，并与发行人相关人员访谈了解相关协议的履行情况。</p> <p>2、取得并核查了力晶科技用以出资的 58 项专利清单及相关专利证书，发行人受让的尚在有效期内的 44 项专利的专利变更手续相关文件；</p> <p>3、取得并核查了安徽华洲资产评估有限公司、同致信德（北京）资产评估有限公司就专利技术使用权出资出具的资产评估报告及复核报告。</p>	
9	<p>条款内容：</p> <p>（一）甲方应将现行于甲方实行，具备效率与竞争力之经营管理经验导入乙方，由乙方人员建置吸收并且在乙方推行，成为乙方的企业文化或 SOP。</p> <p>（二）甲方应将现行于甲方量产，具备竞争力之量产全部参数导入乙方机台，并训练乙方生产与技术人员，达成和甲方一致或超越之效率与生产力。</p> <p>（三）甲方应将现行于甲方运作，具备竞争力之全部经营管理系统，包括但不限于生产管理软件、派工作业、自动化控制生产系统、会计系统、人事系统、签核流程等，导入乙方之计算机系统内，并训练乙方管理人员进行操作与问题解决能力，达成和甲方一致或超越之效率与生产力。</p> <p>核查手段、获取的核查证据：</p> <p>1、核查并取得了发行人与力晶科技签订的《技术移转协议》及其补充协议、确认函，并与发行人相关人员访谈了解相关协议的履行情况；</p> <p>2、取得并核查了发行人组织机构图及审批权限表，并与发行人相关人员访谈了解各部门具体人员设置及运行情况等，抽取部分公司内部审批流程文件，核查了力晶科技相关人员的参与情况；</p> <p>3、取得并核查了自《委托经营管理合约》签订以来，力晶科技、合肥建投向发行人委派人员的名单，并向发行人相关人员了解委派人员的岗位职责等情况。</p>	实际履行
10	<p>条款内容：</p> <p>针对技术授权之制程技术及代工业务，甲方应协助建立乙方之业务能力，让乙方业务人员运用大陆之优势，开拓并争取业务订单，以达成国产化之目标。</p> <p>核查手段、获取的核查证据：</p> <p>1、取得发行人与主要客户谈判、确定合作以及后续客户关系维护等过程的电子邮件等支持性证据；</p> <p>2、获取报告期内发行人开发客户时与客户的沟通记录，检查发行人的主要客户订单下达方式及相关记录，查阅了发行人与主要客户签署的框</p>	发行人设立初期，阶段性部分履行

序号	条款内容及核查手段、获取的核查证据	履行情况
	<p>架合同、订单、产能预约合同等，核查其是否与力晶科技之间有关系；</p> <p>3、获取发行人销售人员与发行人签订的劳动合同，核查其是否与力晶科技之间有关系；</p> <p>4、对报告期内主要客户收入进行核查，获取并核对客户报告期内收入明细对应的销售订单、销售出库单、销售发票、出口报关单、签收单、客户回款对应银行回单，核实销售订单的来源以及销售过程中是否存在力晶科技的参与；</p> <p>5、分析了发行人主要客户数量、客户收入金额分布、产能预约订单等资料，访谈了公司管理层及销售相关人员，了解发行人业务发展中与力晶科技及其关联方的关系。</p>	
11	<p>条款内容：</p> <p>当甲方之业务量需求超过甲方产能，且乙方之产能仍可支持时，甲方应移转订单到乙方进行生产。当乙方之业务量超过乙方产能，且甲方产能仍可支持时，乙方应移转订单到甲方。针对代工移转订价，应考虑市场行情、符合法定并且双方互利</p> <p>核查手段、获取的核查证据：</p> <p>1、获取发行人 2018 年至 2019 年的销售收入明细及对应的销售订单、出库单、商业发票、出口报关单和签收单据，核对相关单据是否与发行人的客户一致；</p> <p>2、在发行人工作人员的陪同下，直接至银行打印发行人报告期内的银行流水，检查银行流水记载的交易对手名称、交易金额等信息是否与发行人序时账中记载的交易对手名称、交易金额等信息一致；</p> <p>3、根据银行流水、应收账款及预收账款明细账等，对客户的回款明细执行双向核对，核对客户名称是否与实际交易客户一致，是否存在第三方收款情况；</p> <p>4、检查发行人报告期内与力晶科技之间的资金往来情况，检查发行人与力晶科技的资金往来是否与双方业务相匹配；</p> <p>5、取得并核查了发行人与力晶科技及力积电的收入统计表，并将双方向同一客户提供的产品及服务进行了比对；</p> <p>6、取得并核查了发行人报告期内主要工艺平台（包括 150nm、110nm、90nm）的验证文件，取得了发行人主要客户对上述工艺平台首颗产品的量产同意书，以及邮件回复确认；</p> <p>7、取得了力晶科技及力积电与发行人重叠的主要客户签订的产能预约合同，核查了其中是否存在与晶合进行订单互补相关的条款；</p> <p>8、查询了集成电路行业的研究报告和可比公司公开资料中关于不同尺寸的晶圆价格披露内容；</p>	未实际履行

序号	条款内容及核查手段、获取的核查证据	履行情况
	<p>9、访谈了发行人技术部门和业务部门，对价格存在差异的原因进行了了解；</p> <p>10、访谈了发行人主要客户，了解以下内容：</p> <p>（1）发行人与力晶科技及力积电向同一主要客户销售产品是否具备替代性；</p> <p>（2）发行人未与奇景光电、奕力科技、合肥捷达微、敦泰电子签订框架协议是否符合行业惯例；</p> <p>（3）发行人与主要客户在 2020 年之后签署产能预约合同的原因；</p> <p>（4）发行人与力晶科技及力积电是否存在潜在的利益安排，发行人与客户之间的交易是否有力晶科技及力积电的参与，是否存在利益输送、相互或者单方让渡商业机会、损害合肥晶合利益等情形；</p> <p>（5）主要客户向发行人采购的验证情况、验证步骤以及验证通过的时点。</p>	
12	<p>条款内容：</p> <p>除技术移转协议规范之技术团队外，甲方应派驻并建立乙方所需之经营管理团队，以执行经营管理职务，类型与相关规定如下：</p> <p>（一）兼职人员：兼职人员系指具备甲方员工身分，但必须于乙方挂职以执行乙方业务之人员。此类人员之薪资由甲方负担，在移转技术验证完成之前，若因执行乙方业务时产生之差旅费及各项费用，由乙方支付。乙方可经过乙方董事会核准，支付该兼职人员薪资补贴。</p> <p>（二）派驻人员：派驻人员系指由乙方雇佣并约定一定期间期满后即结束与乙方聘雇关系之相关人员。派驻人员派驻期间之薪资由乙方负担，派驻期间之相关保险与退休，亦由乙方按照法令予以支付，甲方及乙方可给予相对优惠条件于派驻人员，吸引人员愿意派驻。</p> <p>（三）全职人员：全职人员系指由乙方雇用且正式任职乙方之人员。乙方于法令许可条件下，可以优惠条件吸引甲方相关团队（包含技术人员）成为乙方之全职人员</p> <p>核查手段、获取的核查证据：</p> <p>1、取得并核查了自《委托经营管理合约》签订以来，力晶科技、合肥建投向发行人委派人员的名单，并向发行人相关人员了解委派人员的岗位职责等情况；</p> <p>2、取得并核查了自力晶科技入股以来发行人全部台籍员工的名单、曾在力晶科技任职员工的名单及离职证明；</p> <p>3、取得并核查了发行人员工花名册、工资表以及缴纳社保、公积金的明细，抽取部分员工合同，就发行人员工劳动关系情况进行了核查。</p>	<p>发行人设立初期，阶段性部分履行</p>

经核查，本所认为，委托经营管理合约签订后，发行人未将经营管理权委托予力晶科技，且认定依据充分。

二、《问询函》第 2 题：关于订单互补

根据反馈回复：（1）报告期内，双方未实际履行订单互补支持相关条款；（2）发行人主要客户和供应商均与力晶科技重叠，奇景光电和奕力科技的工艺平台验证主要来自力晶科技，而后续与该等客户谈判、确定合作、试产、风险量产、量产以及后续客户关系维护等均由发行人独立完成；（3）发行人仅与联咏科技、集创北方签订了诸如采购契约书、晶圆代工合同等类似的框架合同，其余客户的产能预约合同均在 2020 年左右签订；（4）发行人与半导体晶圆代工领域的可比公司在每片晶圆销售平均价格存在较大差异，发行人价格在 4000 至 5000 元，发行人销售价格偏低。

请发行人说明：（1）向主要客户销售的产品类型与力晶科技向同一客户销售产品类型的异同以及是否具备替代性，主要客户工艺平台验证通过时间和验证通过的依据并提供相关依据，产能预约合同均在 2020 年以后签订的原因，未签订框架协议是否符合行业惯例；（2）列表说明 2018 年和 2019 年主要客户销售收入与客户与发行人签订合同或下达订单的对应关系，并提供相应合同或订单，报告期内发行人与力晶科技之间的资金往来情况，是否存在从力晶科技回款的情况；（3）奇景光电及奕力科技同为发行人与力晶科技客户的情况下，将相关技术移转至发行人的合理性，是否需要相关客户的重新认证，发行人与力晶科技向奇景光电、奕力科技提供产品或服务是否存在差异，相关客户与发行人签订的订单是否附属于力晶科技与相关客户所签合同，是否存在潜在利益安排；（4）与可比公司晶圆价格存在差异的原因，发行人向主要客户销售产品的价格与力晶科技销售同类产品价格的差异及原因；（5）结合上述事项说明报告期内双方未实际履行订单互补支持相关条款的依据是否充分。

请保荐机构、申报会计师和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）向主要客户销售的产品类型与力晶科技向同一客户销售产品类型的异同以及是否具备替代性，主要客户工艺平台验证通过时间和验证通过的依据并提供相关依

据，产能预约合同均在 2020 年以后签订的原因，未签订框架协议是否符合行业惯例

1、向主要客户销售的产品类型与力晶科技向同一客户销售产品类型的异同以及是否具备替代性

报告期内，对于双方均提供的半导体晶圆代工服务，主要是 90nm DDIC、110nm DDIC 和 150nm DDIC 半导体晶圆代工服务，由于发行人和力晶科技及力积电各自的设计组件、生产线设备、机台配置与能力、客户要求的产品规格参数存在差异，因而提供的产品及服务的定制化程度较高；从为客户及终端产品所实现的最终效果来看，均为通过高压元件对电压的控制与调整，实现对液晶分子的转向控制，从而达成对液晶面板的显示控制，但双方提供的代工服务存在差异。

根据对主要客户访谈，发行人及力晶科技及力积电向重合客户提供的半导体晶圆代工服务所代工的具体产品存在差异，不具备完全的相互替代性。

综上，虽然双方共同向客户提供 90nm DDIC、110nm DDIC 和 150nm DDIC 半导体晶圆代工服务，但由于各自的设计组件、生产线设备、机台配置与能力、客户要求的产品规格参数存在差异，提供的产品及服务的定制化程度较高，不可完全相互替代。

2、主要客户工艺平台验证通过时间和验证通过的依据并提供相关依据

发行人工艺平台验证包含多个不同的验证：

（1）发行人自身内部验证

“力晶科技负责将与奇景光电、奕力科技涉及技术移转的相关技术文件和数据资料移转至发行人，以此完成发行人初期产品和工艺平台的验证”，此处验证是指：在发行人的设立及运营初期，发行人自身内部开展对力晶科技出资的三项制程技术对应的工艺平台的验证，以确保技术移转的工艺平台可以向客户提供服务。2017 年 6 月 5 日，公司与力晶科技签订《技术移转协议确认函》，确认发行人已完成对三项制程技术的验证。

（2）客户验证

在发行人获得客户验证的各阶段步骤中，根据投片量、良率提升和工艺条件等指

标不同，划分为小规模试产、风险量产和大批量生产阶段。发行人主要客户对公司向客户提供服务所采用的工艺平台生产的第一颗产品验证情况如下：

序号	主要客户名称	工艺平台	该工艺平台第一颗产品开始试产的时间	该工艺平台第一颗产品开始风险量产的时间	该工艺平台第一颗产品验证通过、开始大批量生产的时间
1	联咏科技股份有限公司	90nm_1.32V/6V/32V(TDDI)	2018/8/17	2018/10/8	2019/5/15
		150nm_1.8V/18V(TV)	2020/9/24	2021/1/8	2021/5/10
		150nm_3.3V/18V(TV)	2017/12/20	2018/4/19	2018/11/12
2	北京集创北方科技股份有限公司及其关联方	N1 LCDDr 90nm-MP 1.32V_6V_32V	2020/3/13	2020/11/10	2021/2/1
		N1 LCDD 0.15um-S 3.3V_18V	2018/10/29	2020/7/29	2020/9/7
		N1 LCDD 110nm-N 1.5V_6V_32V	2018/6/12	2019/4/28	2019/8/9
		N1 LOGIC 110nm-LP 1.5V_5V	2020/2/20	2020/7/13	2021/7/15
3	奇景光电股份有限公司	110nm_1.5V/6V/32V(SDDI)	2017/9/29	2017/10/9	2018/6/4
		150nm_3.3V/13.5V(NB)	2018/4/27	2018/9/26	2020/2/18
4	奕力科技股份有限公司	90nm_1.32V/6V/32V(TDDI)	2021/1/4	2021/3/9	2021/7/13
		110nm_1.5V/6V/32V(SDDI)	2017/9/28	2017/9/28	2018/6/22
		150nm_3.3V/13.5V(NB)	2019/10/28	2020/2/10	2020/9/3
5	合肥捷达微电子有限公司及其关联方	N1 LCDDr 110nm-SUPER 1.5V_6V_32V	2018/9/26	2019/3/22	2019/12/10
		N1 LCDDr 90nm-MP 1.32V_6V_32V	2020/3/6	2020/10/29	2021/4/16
		150nm_1.8V/18V(TV)	2020/4/21	2020/10/29	2021/4/27
6	敦泰电子股份有限公司	N1 LCDDr 110nm 1.5V_6V_32V	2018/1/23	2018/8/9	2019/12/9

注：发行人在 2017 年自力晶科技技术移转和产品验证的过程中，力晶科技负责将与奇景光电、奕力科技涉及技术移转的相关技术文件和数据资料移转至发行人，以此完成发行人对力晶科技技术移转工艺平台的验证。因此，客户对上述两个产品的情况较为了解，从试产到风险量产的所需时间较短。

3、产能预约合同均在 2020 年以后签订的原因，未签订框架协议是否符合行业惯例

(1) 产能预约合同均在 2020 年以后签订的原因

① 近年来晶圆代工产能较为紧缺

根据公开资料，近年来全球晶圆代工产能紧缺，上游芯片设计企业在全全球范围内寻求稳定、可靠的晶圆代工产能。特别是 2020 年以来，随着市场对晶圆代工产能需求的上升，提前预约晶圆代工厂产能愈发重要。因此，2020 年以后与客户签订产能预约合同具备合理性。

② 发行人已与主要客户建立了较久的业务往来

发行人设立和发展初期，产能较小，与客户建立合作的时间较短，尚未形成稳定的合作关系。报告期内，发行人产能逐渐扩充，自 2018 年的 74,860 片/年，上升至 2020 年的 266,237 片/年，具备一定的业务规模，与主要客户建立了时间较久的业务往来，获得了客户的认可，建立了较为稳定的业务关系，因此，2020 年以后与客户签订产能预约合同具备合理性。

综上所述，发行人产能预约合同均在 2020 年以后签订具备合理性。

(2) 未签订框架协议是否符合行业惯例

报告期内，发行人的主要客户中，发行人与联咏科技、集创北方签订了框架协议，与部分主要客户未签订框架协议。发行人虽与部分主要客户未签订框架协议，但通过持续的订单、产能预约合同建立了稳定、持久的合作关系。根据对未签订框架协议客户的访谈，未签订框架协议符合客户通常的业务模式，符合行业惯例。

(二) 列表说明 2018 年和 2019 年主要客户销售收入与客户与发行人签订合同或下达订单的对应关系，并提供相应合同或订单，报告期内发行人与力晶科技之间的资金往来情况，是否存在从力晶科技回款的情况

1、2018 年和 2019 年主要客户销售收入与客户与发行人签订合同或下达订单的对应关系

2018 年和 2019 年主要客户销售收入与客户与发行人签订合同或下达订单的对应关系如下：

客户名称	2018 年 收入 (万元)	2019 年收 入(万 元)	2018 年签署 的订单 数量 (份)	2018 年产生 收入的 对应订 单数量 (份)	2019 年签署 的订单 数量 (份)	2019 年产生 收入的 对应订 单数量 (份)
奇景光电股份有限公司	7,600.76	9,540.79	33	38	46	52
联咏科技股份有限公司	7,533.39	32,558.13	11	9	14	19
奕力科技股份有限公司	6,114.49	3,601.30	35	35	36	27
北京集创北方科技股份有限公司及其关联方	266.44	2,423.88	6	7	11	13
敦泰电子股份有限公司	193.49	非前五大 客户	4	4	2	6
合肥捷达微电子有限公司及其关联方	非前五 大客户	2,439.84	7	4	10	10

注：敦泰电子股份有限公司 2019 年不为前五大客户，合肥捷达微电子有限公司 2018 年不为前五大客户

2、报告期内发行人与力晶科技之间的资金往来情况，是否存在从力晶科技回款的情况

报告期内，发行人与力晶科技之间的资金往来主要为发行人向力晶科技支付专业服务费、技术费及咨询服务费，以及发行人从力晶科技收到增资款，不存在发行人通过力晶科技回款的情况。

(三) 奇景光电及奕力科技同为发行人与力晶科技客户的情况下，将相关技术移转至发行人的合理性，是否需要相关客户的重新认证，发行人与力晶科技向奇景光电、奕力科技提供产品或服务是否存在差异，相关客户与发行人签订的订单是否附属于力晶科技与相关客户所签合同，是否存在潜在利益安排

1、奇景光电及奕力科技同为发行人与力晶科技客户的情况下，将相关技术移转至发行人的合理性，是否需要相关客户的重新认证

与奇景光电及奕力科技相关的技术移转属于力晶科技技术移转的一部分，技术移

转后，需要有客户进行试产、投片，进行产品的开发及验证，以确保技术移转的完成，进而形成发行人的技术文件。该等技术转移属于力晶科技向发行人转移相关技术，而非奇景光电及奕力科技将其技术移转至发行人。

奇景光电及奕力科技向发行人采购，需要对发行人的工艺平台重新认证。根据客户访谈，发行人客户在使用新的晶圆代工厂时，发行人客户的客户亦要求发行人的客户对新供应商的工艺平台进行验证。

2、发行人与力晶科技向奇景光电、奕力科技提供产品或服务是否存在差异，相关客户与发行人签订的订单是否附属于力晶科技与相关客户所签合同，是否存在潜在利益安排

报告期内，发行人与力晶科技及力积电向奇景光电、奕力科技提供设计组件，在客户进行产品设计后进行代工生产，发行人与力晶科技及力积电在产品组件、生产流程、机台设备等方面存在差异。

根据发行人与相关客户签订的有关合同、力晶科技及力积电与相关客户签订的有关合同，以及对奇景光电、奕力科技的客户访谈，相关客户与发行人签订的订单不附属于力晶科技及力积电与相关客户所签合同，不存在潜在利益安排。

（四）与可比公司晶圆价格存在差异的原因，发行人向主要客户销售产品的价格与力晶科技销售同类产品价格的差异及原因

1、与可比公司晶圆价格存在差异的原因

晶圆价格受制程、晶圆尺寸、工艺平台等影响，价格呈现较大差异，通常来讲，制程越小晶圆价格越高，晶圆尺寸越大晶圆价格越高：

（1）和台积电、联华电子、中芯国际相比，发行人制程节点与之存在差距，价格低于台积电、联华电子、中芯国际具备合理性；

（2）和华润微相比，发行人制程节点更为先进，晶圆尺寸更大，价格高于华润微具备合理性；

（3）和华虹半导体、世界先进相比，发行人与之制程节点相近，但报告期内，发行人处于发展初期，通过采取高性价比策略，快速渗透、拓展市场，价格低于华虹半导体、世界先进具备合理性；随着发行人技术、产品逐渐成熟，客户逐渐稳定，发行

人价格已逐渐上升。

综上所述，发行人与可比公司晶圆价格存在差异具备合理性。

2、发行人向主要客户销售产品的价格与力晶科技销售同类产品价格的差异及原因

对于相同制程、相同工艺平台的产品，由于客户产品设计、晶圆代工企业生产能力的不同，定制化程度较高，所需要的光罩层数、金属层数存在差异，晶圆代工企业生产的晶圆尺寸亦存在差异，发行人销售产品与力晶科技及力积电销售同类产品单价系多种产品的平均价格，不具备直接可比性，相同类型产品的价格存在差异具有合理性。

通常来讲，假设其他条件不变，光罩层数越多价格越高，金属层数越多价格越高，晶圆尺寸越大价格越高。

对于相同制程、相同工艺平台、且同为 12 英寸的半导体晶圆代工服务，发行人与力晶力积电价格不存在显著异常差异；对于相同制程、相同工艺平台、但晶圆尺寸不同的半导体晶圆代工服务，发行人价格高于力晶科技及力积电，该等差异主要系尺寸差异导致：发行人提供的 12 英寸半导体晶圆比力晶科技及力积电提供的 8 英寸半导体晶圆面积更大，价格差异具备合理性。

因此，发行人向主要客户销售产品的价格与力晶科技销售同类产品价格存在差异具备合理性。

（五）结合上述事项说明报告期内双方未实际履行订单互补支持相关条款的依据是否充分

1、双方签订订单互补条款的背景

双方签署订单互补条款的本意系落实《合作框架协议》项下力晶科技导入建厂经验的责任，约束力晶科技帮助公司建立独立的营运能力。《委托经营管理合约》中约定订单互补支持，主要系出于表达双方合作的友好关系及合作愿景。

实际执行过程中，发行人和力晶科技对各自的客户进行独立开发，提供的产品和服务存在差异，定价策略也不相同，实施订单互补在实际操作上存在难度。随着发行人产能的逐步释放，发行人业务经营状况良好，具备了自主开展业务经营及开拓客户

的能力，公司出于独立经营的考虑亦未要求力晶科技提供业务方面的支持。

2、报告期内未执行订单互补的客观依据

(1) 发行人与力晶科技及力积电向客户提供的服务存在差异

报告期内，发行人与力晶科技及力积电向同一客户提供的服务存在差异，不可完全相互替代，客户向发行人下达的订单无法直接转移至力晶科技及力积电进行生产，客户向力晶科技及力积电下达的订单亦无法直接转移至发行人进行生产。双方向同一主要客户提供半导体晶圆代工服务的具体差异情况参见本补充法律意见第 2 题之“（一）向主要客户销售的产品类型与力晶科技向同一客户销售产品类型的异同以及是否具备替代性……”的相关回复。

(2) 2018 年至 2019 年半导体行业景气度较差，力晶科技业绩逐步下滑，不具备向发行人转移订单的主观动力

根据力晶科技 2018 年、2019 年年报，2018 年第三季度后，力晶科技业绩增速放缓，并呈下降趋势。2019 年，力晶科技收入及利润大幅下跌，税后利润为-43.7 亿元新台币，为过去七年来首次亏损。

综上，考虑到力晶科技为中国台湾地区公开发行公司，股东及投资者较为关注其业绩表现，在行业景气度下降和自身业绩下滑的背景下，不具备向发行人转移订单的主观动力。

(3) 力晶科技确认报告期内未向发行人转移订单

根据力晶科技出具的确认函：

“晶合集成向主要客户销售的产品类型与本公司及关联企业向同一客户销售产品类型存在差异，不可相互替代，订单互补条款并未实际执行。

晶合集成与本公司及关联企业向奇景光电、奕力科技提供产品或服务存在差异，相关客户与晶合集成独立签署订单，不附属于本公司及关联企业与相关客户所签合同，不存在潜在利益安排。”

(4) 主要客户对发行人自身晶圆代工工艺平台均进行独立验证

报告期内，发行人的主要客户对发行人提供的晶圆代工服务从试产、风险量产到大批量生产均进行了有效验证，获得了客户的认可，具备独立向客户提供半导体晶圆代工服务的能力，不存在与力晶科技及力积电订单转移的情形。

(5) 主要客户订单和合同均直接向发行人下达，不存在从力晶科技回款情形

报告期内，发行人主要客户销售收入来自客户向发行人下达的订单或签署的合同，不存在通过力晶科技转移订单形成收入的情形，亦不存在从力晶科技回款的情形。

(6) 发行人与主要客户均独立开展沟通、谈判、下单、维护，不依赖力晶科技和力积电

报告期内，发行人具备独立面向客户开展业务的能力，报告期内，发行人与发行人客户之间的业务关系均由发行人独立谈判、维护，发行人收到的订单均由发行人客户直接向发行人下达，不存在通过订单互补获得力晶科技及力积电相关订单的情形。奇景光电、奕力科技等主要客户的订单不附属于力晶科技及力积电与相关客户所签合同，不存在潜在利益安排。

(7) 发行人与力晶科技晶圆价格存在合理差异，系双方独立与各自客户商业谈判的结果所致。若进行订单移转需要对相关产品和服务的价格重新进行商业谈判，不符合客户对于晶圆代工服务高效率、定制化、稳定性强的客观需求。

综上所述，报告期内双方未实际履行订单互补支持相关条款具有客观依据，且相关依据充分。

三、《问询函》第3题：关于人员

根据问询回复：(1) 合肥建投和力晶科技通过向发行人委派管理人员的方式向发行人提供企业管理、会计等相关咨询服务，并收取相应的咨询服务费。(2) 发行人与合肥建投、力晶科技签署的《咨询服务合约书》对应的人员委派事项，系依据《合资合同》作出，独立于委托经营管理协议的安排，因此，合肥建投、力晶科技向发行人提供咨询服务的行为及发行人支付咨询服务费的行为并不与委托经营管理协议同步终止。(3) 委派人员中包括短期委派人员与长期委派人员。

请发行人说明：合肥建投和力晶科技收取相应咨询服务费的原因及合理性；结合《合资合同》《投资参股协议》《委托经营管理合约》等相关约定及安排，清晰说明各约定间的关系以及委派人员的类型及具体构成情况，相关事项对发行人的影响。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）合肥建投和力晶科技收取相应咨询服务费的原因及合理性

合肥建投、力晶科技根据《投资参股协议》《公司章程》《合资合同》的约定长期向公司委派管理人员，该等管理人员为发行人提供了日常运营方面的管理服务，相关人员的劳动关系均在股东处，薪酬亦由股东发放。因此，发行人根据双方股东委派人员的岗位向股东支付咨询服务费，具备合理性，与《委托经营管理合约》无关。

（二）结合《合资合同》《投资参股协议》《委托经营管理合约》等相关约定及安排，清晰说明各约定间的关系以及委派人员的类型及具体构成情况，相关事项对发行人的影响

1、《合资合同》《投资参股协议》《委托经营管理合约》之间的关系

协议名称	签署主体	签订时间	主要内容
《投资参股协议》	合肥建投、力晶科技	2015年10月	主要约定双方后续投资金额、持股比例、双方股东董事会席位、委派高级管理人员岗位等公司治理层面的权利义务
《委托经营管理合约》	发行人、力晶科技	2015年10月	约定力晶科技需在经营层面对发行人进行支持，帮助发行人建立独立运营能力
《合资合同》	合肥芯屏、合肥建投、力晶科技	2016年1月	由于合资公司设立需要，根据法律法规规定签订

（1）《投资参股协议》《委托经营管理合约》之间的关系

2015年4月，合肥市人民政府与力晶科技签署了《合作框架协议》。为落实《合作框架协议》，2015年10月，合肥建投与力晶科技签署了《投资参股协议》、公司

与力晶科技签署了《委托经营管理合约》。其中，《投资参股协议》主要约定双方后续投资金额、持股比例、双方董事会席位安排、双方委派管理人员岗位等股权投资常规事项；《委托经营管理合约》主要约定力晶科技需在经营层面对发行人进行支持，帮助发行人建立独立运营能力，同时控制投资风险。由于《投资参股协议》《委托经营管理合约》系同期签署的协议，且双方股东委派管理人员事项，与力晶科技需在经营层面对发行人进行支持、帮助公司建立营运能力之间存在关联，因此《投资参股协议》《委托经营管理合约》之间在长期委派管理人员部分存在内容上的重复，并非《委托经营管理合约》项下的特别安排。

（2）《合资合同》与《投资参股协议》《委托经营管理合约》之间的关系

2016年1月，力晶科技拟出资入股发行人，力晶科技出资入股后发行人的企业性质将由内资企业变更为中外合资企业。根据当时有效的《中外合资经营企业法》的规定，“合营各方签订的合营协议、合同、章程，应报国家对外经济贸易主管部门（以下称审查批准机关）审查批准”、“合营企业各方可以现金、实物、工业产权等进行投资...上述各项投资应在合营企业的合同和章程中加以规定”、“合营企业设董事会，其人数组成由合营各方协商，在合同、章程中确定”，公司变更为中外合资经营企业需由各方股东签订合资合同。因此，为配合办理力晶科技出资入股的相关变更手续，合肥建投、合肥芯屏与力晶科技签订了《合资合同》，并延续了《投资参股协议》中对委派人员的约定。《合资合同》系履行《投资参股协议》项下力晶科技出资义务的过程中，按照法律法规的相关要求签订，与《委托经营管理合约》不存在关系。

2、合肥建投、力晶科技委派人员的类型及具体构成情况，相关事项对发行人的影响

（1）基于《投资参股协议》《合资合同》《公司章程》长期委派人员

合肥建投根据约定向公司委派总会计师等管理人员，主要作用为对公司的财务、采购、销售、行政、内审、敬业监督等方面进行监督与管理；力晶科技根据约定向公司委派审计师等管理人员，主要作用为通过参与公司财务事项审批及内部审计流程，对公司财务状况实施监督，防止控股股东滥用控股地位。上述岗位由双方股东长期委派人员担任，公司根据委派人员的岗位向股东支付咨询服务费。长期委派人员的具体

情况如下：

委派方	所在岗位	姓名	委派期间	具体负责工作内容
合肥建投	总会计师	朱才伟 (高管)	2016年3月至 2020年3月	负责公司财务、会计政策的制定，管理公司财务、会计各项工作
	财会处处长	王兴亚	2016年8月至 2020年3月	负责公司财务、会计各项工作的开展
	采购副总监	赵鑫森 (高管)	2016年4月至 2017年8月	协助采购总监督管理公司采购各项工作
		周义亮 (高管)	2017年8月至 2019年5月	
		王继武 (高管)	2019年5月至 2020年4月	
	销售副总监	周义亮 (高管)	2016年4月至 2020年3月	负责管理维护客户，制定销售战略；新客户新产品导入，维持现有业务及拓展新业务
	行政副总经理	朱晓娟 (高管)	2019年10月至 2020年3月	负责公司整体行政管理和组织人事管理工作
	审计师	朱晓娟 (高管)	2019年1月至 2019年12月	负责公司内部审计工作
		杨幼玲 (高管)	2019年12月至 2020年4月	
	敬业促进委员会委员长	朱晓娟 (高管)	2017年8月至 2019年12月	规范员工行为、鼓励敬业服务
杨幼玲 (高管)		2019年12月至 2020年11月		
杨幼玲		2020年11月至 2021年3月		
力晶科技	审计师	陈美华 (高管)	2016年7月至 2018年5月	帮助公司完善内部控制，提高公司内部审计工作质量及能力；负责公司内部审计工作
	审计师/处长	潘炯升 (高管)	2017年12月至 2018年12月	
	副审计师	林士然	2019年1月至 2020年3月	
	副总会计师	陈央珠 (高管)	2016年6月至 2016年12月	参与公司财务事项审批流程，对公司财务情况进行了了解
		邱垂源 (高管)	2017年1月至 2019年3月	
李迦谕 (高管)		2018年12月至 2020年3月		

上述人员在公司财务、采购、销售、行政、内审、敬业监督等方面提供了支持，部分管理人员后续自愿自股东处离职并加入发行人，成为发行人员工，对发行人建立独立的营运能力起到了积极作用。

(2) 基于《委托经营管理合约》短期委派人员

力晶科技入股后，为履行《委托经营管理合约》相关义务，在短期内向公司委派了部分管理人员，帮助公司结合行业特点，落地、改善相关制度的运作，提高公司内部控制和稽核能力，传授财务核算经验等。短期委派人员完成任务后即返回力晶科技，后续该岗位由公司员工或合肥建投委派人员任职，发行人未就上述短期委派人员或岗位向力晶科技支付费用。短期委派人员的具体情况如下：

委派方	所在岗位	姓名	委派期间	具体负责工作内容
力晶科技	会计部部经理	张天桂	2016年8月至 2017年7月	依据《委托经营管理合约》，帮助公司结合中国大陆实际情况，落地、改善相关制度的运作
	会计部课长	庄惠雯	2016年7月至 2017年10月	
	财务部部经理	任芬圣	2016年7月至 2017年3月	
	行政副总经理	刘荫 (高管)	2017年8月至 2018年5月	

上述人员在帮助发行人落地、改善相关制度的运作，提高公司内部控制和稽核能力，传授财务核算经验等方面提供了帮助。

报告期内，发行人经营管理团队主要来源于发行人员工；截至报告期末，发行人高级管理人员均由公司聘任，发行人具备独立的经营管理层，人员与力晶科技相独立，上述人员委派安排未对公司独立性造成重大不利影响。

四、《问询函》第5题：关于实际控制人认定

根据问询回复：(1) 2019年12月以前，发行人最高权力机构董事会，有9名董事。公司章程规定重大经营、财务、人事事项需2/3董事同意，部分事项需要一致批准。而合肥建投占5席，未达2/3。回复中称合肥国资方委派董事在发行人董事会

中占实质主导地位；（2）公司董事长提名人为力晶科技；（3）公司高管成员包括行使敬业监督职能的敬业促进委员会委员长，由合肥建投进行委派；（4）回复中列式了报告期内公司高级管理人员的变化情况，但未说明相关人员的提名情况；（5）公司组建了经营管理委员会作为董事会幕僚机构，其中合肥建投指派人员的职责主要为监督。

请发行人说明：（1）结合《合资合同》《公司章程》等相关协议约定，说明董事长的职责及具体产生方式，董事长的提名人为力晶科技的原因，以及在合肥建投委派董事未达 2/3 情况下合肥国资方委派董事在董事会中占实质主导地位的依据是否充分；（2）行使敬业监督职能高管的具体职能行使情况，该职位是否主要针对与力晶科技合作进行设置，报告期内的实际执行情况；（3）报告期内公司高级管理人员的提名情况，是否主要由力晶科技进行提名及主导；（4）结合上述情况，以及曾签署委托经营管理合约、第二大股东从事同类型业务、经营管理委员会等情况，说明公司是否实质为力晶科技控制或合肥市国资委与力晶科技共同控制，发行人最近两年实际控制人是否发生变更，是否通过实际控制人认定进而规避同业竞争。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）结合《合资合同》《公司章程》等相关协议约定，说明董事长的职责及具体产生方式，董事长的提名人为力晶科技的原因，以及在合肥建投委派董事未达 2/3 情况下合肥国资方委派董事在董事会中占实质主导地位的依据是否充分

1、结合《合资合同》《公司章程》等相关协议约定，说明董事长的职责及具体产生方式

公司股改前，根据《投资参股协议》《合资合同》《公司章程》，董事长的职责及具体产生方式如下：

相关协议名称	董事长的职责	具体产生方式
《投资参股协议》（甲方：合肥建投，乙方：力晶科技）	董事长行使下列职权： （1）对外行使晶合集成法定代表人职权；	甲乙双方同意由乙方推举乙方入资之后的首任董事长，并由甲方推举乙方入资之后的首任副董事长。董事长与副董事长人选确定后，按照《中华人民共和国中外

	<p>(2) 召集、主持董事会会议;</p> <p>(3) 检查、督促董事会决议的执行;</p> <p>(4) 签署董事会重要文档和其他应由晶合集成法定代表人签署的文档;</p> <p>(5) 在发生不可抗力的紧急情况下,对晶合集成事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权,并在事后实时向董事会报告;</p>	<p>合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》等中国法律法规,报请商务部核准后经晶合集成董事会选举产生。甲方承诺促请晶合集成董事会,通过选举乙方推举之董事长人选成为乙方入资之后的首任董事长。董事长为晶合集成的法定代表人,如董事长不能行使职权,应由副董事长或董事长指定的其它董事代行职权。</p>
<p>《公司章程》 (甲方:合肥芯屏,乙方:力晶科技,丙方:合肥建投)</p>	<p>(6) 公司章程、董事会授予的其他职权。</p>	<p>董事会设一名董事长,甲、乙、丙三方同意由乙方委派乙方入资之后的首任董事长,并由甲方及丙方共同委派乙方入资之后的首任副董事长。董事长与副董事长人选确定后,按照《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》等中国法律法规,报请商务部核准产生。董事长为合资公司的法定代表人,如董事长不能行使职权,应由副董事长或董事长指定的其他董事代行职权。首任董事长任期届满后,由甲、乙、丙三方依投资参股协议的精神协商新任董事长人选。</p>
<p>《合资合同》 (甲方:合肥芯屏,乙方:力晶科技,丙方:合肥建投)</p>		<p>叁方同意由乙方委派的一名董事担任乙方入资之后的首任董事长,由甲方及丙方共同委派一名董事担任乙方入资之后的首任副董事长。董事长与副董事长人选确定后,按照合资法等中国法律法规,报请商务部核准产生。乙方入资后的首任合资公司董事长由乙方委派。董事长为合资公司的法定代表人,如董事长不能行使职权,应由副董事长或董事长指定的其他董事代行职权。首任董事长任期届满后,由甲、乙、丙三方依投资参股协议的精神协商新任董事长人选。</p>

公司股改后，根据《公司章程》，董事长由全体董事选举产生，未再约定董事长由力晶科技推荐。

2、董事长的提名人为力晶科技的原因

（1）董事长的提名人为力晶科技的原因

力晶科技系国际知名的晶圆制造企业，在晶圆代工领域具有多年的行业经验，由力晶科技推荐具有相关行业经验的人选担任董事长，对于公司在行业内的形象、知名度以及与产业链上下游合作伙伴沟通方面有一定帮助。因此，发行人股改前，经双方协商，董事长人选由力晶科技推荐，并在合肥国资方对其背景审核后，提交董事会审议通过。发行人股改时，公司董事长未进行更换。

（2）董事长的提名人为力晶科技不会对合肥国资方对发行人的控制力造成重大不利影响

根据《投资参股协议》《合资合同》《公司章程》，公司股改前，最高权力机构为董事会，公司董事长的主要职责包括担任公司法定代表人、对外代表公司，以及召集、主持董事会会议等。在董事会会议上，董事长除负责主持董事会会议外，与其他董事拥有的表决权相同，发行人重大事项由董事会集体决策，董事长无法单独决策重大事项。此外，发行人重大事项除由董事会审议外，尚需履行相关国资审批程序。因此，发行人股改前由力晶科技提名董事长不会对合肥国资方对董事会的控制力造成重大不利影响。

2020年11月，公司整体变更为股份有限公司，根据发行人股改后的《公司章程》，董事长由全体董事选举产生，未再约定董事长由力晶科技推荐。发行人现任董事长于2020年4月由力晶科技推荐并经董事会聘任，发行人在股改时未对主要董事、高级管理人员成员进行重大调整，公司董事长亦未进行更换。股改后，发行人最高权力机构为股东大会，重大事项在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，并履行相关国资审批程序，董事长无法单独决策重大事项。在董事会会议上，董事长除负责主持董事会会议外，与其他董事拥有的表决权相同，亦无法单独决策重大事项。因此，发行人股改后由力晶科技提名的董事担任董事长事宜不会对合肥国资方对发行人的控制力造成重大不利影响。

综上，发行人股改前，董事长的提名人为力晶科技具有合理的原因，发行人股改

后，未再约定董事长由力晶科技推荐；由力晶科技提名的董事担任董事长事宜不会对合肥国资方对发行人的控制力造成重大不利影响。

3、合肥建投委派董事未达 2/3 情况下合肥国资方委派董事在董事会中占实质主导地位的依据是否充分

(1) 董事会席位设置的原因及背景

2015 年 4 月，合肥市人民政府与力晶科技签订《合作框架协议》中即约定，项目设董事 9 席，其中合肥国资方指派 5 席董事，力晶科技指派 4 席董事。该等董事会席位设置的原因主要系在双方合作初期，投资项目的前景不明朗，力晶科技出于降低其在中国大陆投资风险及增强在合资企业重大决策等方面的参与度等考虑，合肥市人民政府出于招商引资需要及保护小股东利益考虑，经双方友好协商确定，并在《合作框架协议》中对于合资公司的董事会席位进行了明确约定。

(2) 首任董事长系双方协商确定，且非力晶科技员工

2016 年 3 月，发行人首届董事会成立，并推选陆祎担任董事长，任期四年。2019 年 12 月前，发行人董事长一直由陆祎担任。陆祎系美籍华人，毕业于中国科学技术大学，后前往美国华盛顿大学、伊利诺伊大学香槟分校、佛罗里达大学深造并取得博士学位，曾在美国 Intel 公司、Anax 半导体公司工作，具备集成电路行业经验。陆祎主要系因其与合肥国资方、力晶科技均具有良好的关系，有利于合资初期股东双方之间的沟通及关系维护；陆祎从未在力晶科技担任任何职务，身份相对独立，更加能够从合资公司利益的角度在董事会中发挥作用。因此，经双方协商，由力晶科技推荐陆祎为公司首任董事长人选，并在合肥国资方对其背景审核后，提交董事会审议通过。

(3) 董事会未发生力晶科技委派董事单方面反对或弃权而无法形成决策的情形

公司召开董事会会议前，相关议案需提交合肥建投先行内部审议，合肥建投审议通过后再由其委派的董事在董事会会议上进行表决。合肥国资方委派董事在发行人董事会中占实质主导地位，报告期内公司历次董事会会议上力晶科技委派董事均未对相关审议事项投反对票。仅在董事会审议合肥建投向发行人提供委托贷款及担保等相关

事项时，出现过 1 次合肥国资方全体委派董事投同意票，力晶科技 2 名委派董事弃权、2 名委派董事同意，但仍获得董事会通过的情况。未发生因力晶科技委派董事单方面反对而无法形成决策的情形。未发生因力晶科技委派董事单方面反对而无法形成决策的情形。

（4）合肥市人民政府出具的确认函

2021 年 8 月，合肥市人民政府出具确认函：“晶合集成自成立以来，均系在合肥国资方的主导下建设、发展，并未将经营管理权交予力晶科技，合肥市国资委一直系晶合集成的实际控制人，不存在晶合集成实质为力晶科技控制或合肥市国资委与力晶科技共同控制的情形。”

综上，2019 年 12 月前，合肥建投委派董事虽未达 2/3，但董事会席位设置具备合理的背景，首任董事长虽由力晶科技推荐，但其身份相对独立，董事会执行层面亦未发生因力晶科技委派董事单方面反对或弃权而无法形成决策的情形，公司董事会实际运营层面由合肥国资方委派董事占实质主导地位依据充分。

（二）行使敬业监督职能高管的具体职能行使情况，该职位是否主要针对与力晶科技合作进行设置，报告期内的实际执行情况

1、行使敬业监督职能高管的具体职能行使情况

（1）敬业促进委员会的成立目的及主要职能

根据发行人《敬业促进委员会组织章程》《敬业规范》，发行人成立敬业促进委员会的主要目的系树立企业风气、规范员工行为、鼓励敬业服务、查处敬业案件等，维护企业良性运行。发行人倡导敬业为荣的观念，要求全体员工诚信从事所涉业务活动，在与业务之上下游利害关系人互动时，恪守敬业规范与诚信原则，不允许任何员工因贪污舞弊、索贿受贿等行为获取不正当利益。

发行人的员工在日常工作中，遇到涉及请托关说、赠受财物、交际应酬及其他涉及个人利益与公司利益冲突的事宜，可通过发行人网站中的“敬业举报系统”进行敬业申报。敬业促进委员会每月会对“敬业举报系统”中的申报案件进行汇总，于每年度末对敬业申报内容进行统计核查。

发行人敬业促进委员会会议由委员长视需要不定期召开，负责处理公司员工申报的敬业案件，并向董事会报告处理结果。

（2）敬业促进委员会委员长的具体职能

根据发行人《敬业促进委员会组织章程》，公司敬业促进委员会委员长的具体职能为：

①敬业促进委员会委员长负责会议的主持与召集；

②敬业促进委员会会议由委员长视需要不定期召开委员会议；

③敬业促进委员会可视审核案件的性质，由敬业促进委员会委员长决定审议的形式为书面或现场召开；

④敬业促进委员会审议结果由敬业促进委员会委员长核准后方得执行，敬业公告提交总经理签发。

（3）敬业促进委员会人员构成

自 2017 年 9 月敬业促进委员会成立至报告期末，公司敬业促进委员会的人员构成及变化情况具体如下：

日期	委员长	委员			
2017.9 至 2018.5	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	陈美华（审计师）	-
2018.5 至 2019.1	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	潘炯升（审计师）	-
2019.1	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	林士然（副审计师）	-
2019.1 至 2019.12	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	林士然（副审计师）	刘桂云（党委办公室主任）
2019.12 至 2020.4	杨幼玲	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	林士然（副审计师）	刘桂云（党委办公室主任）
2020.4 至 2020.8	杨幼玲	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	王兴亚（财会处处长）	刘桂云（党委办公室主任）

2020.8 至 2020.12	杨幼玲	施雪峯（法务 室副处长）	江英和（人力资 源部部长）	王兴亚（财 会处处长）	林士然（总经 理特别助理）
---------------------	-----	-----------------	------------------	----------------	------------------

（4）该职位是否主要针对与力晶科技合作进行设置

发行人敬业促进委员会系为规范员工行为、树立企业风气而设立，敬业促进委员会委员长主要职责系主持公司敬业监督工作，并非针对与力晶科技合作进行设置。

（5）报告期内的实际执行情况

报告期内，敬业促进委员会共计召开 11 次会议，均由敬业委员会委员长主持，相关会议具体情况如下：

序号	召开日期	会议主要内容及处理结果	董事会汇报情况
1	2018.6.28	审议一起员工违反公司出勤规定事件。各委员依调查结果讨论后，违反出勤规定属实者给予大过 1 次，并追回虚报加班费用及公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第十七次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
2	2018.7.11	审议一起员工工作能力不足检举事件。各委员依调查结果讨论后，要求该员工所属部门畅通内部沟通管道，以化解工作中存在的问题	处理结果在晶合有限第一届第十七次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
3	2019.1.10	审议一起员工工作能力不足、二起员工违反公司出勤规定及一起员工违反公司住宿规定检举事件。各委员依调查结果讨论后，违反出勤规定属实者给予申诫 1 次、并追回虚报加班费用；违反住宿规定属实者，取消入住公司宿舍权利。以上四起案件公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十一次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
4	2019.4.11	审议一起员工作业疏失及一起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，违反敬业规范属实者给予申诫 1 次，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十二次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
5	2019.6.19	审议二起员工违反工作纪律及一起员工在外行为影响其他同事。各委员依调查结果讨论后，违反工作纪律属实者给予扣二个月绩效，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十三次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报

序号	召开日期	会议主要内容及处理结果	董事会汇报情况
		知	
6	2019.9.5	审议一起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，未有违反敬业规范之情况，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十三次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
7	2019.10.24	审议一起拖欠供应商货款。各委员依调查结果讨论后，检举不属实，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十四次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
8	2019.12.17	审议一起员工违反工作纪律。各委员依调查结果讨论后，未有违反工作纪律之情况，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十五次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
9	2020.1.15	审议一起采购品项不符合招标需求。各委员依调查结果讨论后，检举不属实	处理结果在晶合有限第一届第二十五次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
10	2020.8.27	审议一起采购品项指定单一品牌及一起员工泄露供应商报价。各委员依调查结果讨论后，检举不属实，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第二届第四次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
11	2020.11.5	审议一起员工违反公司住宿补贴规定。各委员依调查结果讨论后，违反住宿补贴规定属实者给予记过 1 次，并追回虚报住宿补贴及取消领取补贴资格，同时公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第三次会议中作为报告事项向董事会汇报

（三）报告期内公司高级管理人员的提名情况，是否主要由力晶科技进行提名及主导

报告期内公司高级管理人员中，除根据《公司章程》由股东双方委派的岗位外，其余高级管理人员的聘任由总经理根据公司发展的需求及行业经验物色公司所需的相关人才并推荐给董事会，由董事会决定是否聘任。

报告期初，发行人的高级管理人员及提名情况如下：

序号	任职起始时间	姓名	职务	提名情况
1	2016.3	黎湘鄂	总经理	经力晶科技推荐、合肥建投审核，董事会同意由初期加入公司的员工中资历、晶圆代工厂营运经验最丰富的员工担任总经理
2	2016.3	蔡辉嘉	副总经理	根据公司经营需要，由总经理推荐，董事会聘任
3	2017.10	盛惟健	采购总监	
4	2017.12	陈耿川	研发副总经理	
5	2016.3	朱才伟	总会计师	根据《投资参股协议》《合资合同》《公司章程》的约定，由合肥建投委派，董事会聘任
6	2016.3	周义亮	销售副总监兼采购副总监	
7	2017.1	邱垂源	副总会计师	根据《投资参股协议》《合资合同》《公司章程》的约定，由力晶科技委派，董事会聘任
8	2016.7	陈美华	审计师	
9	2017.8	刘荫	行政副总经理	根据《委托经营管理合约》的约定，由力晶科技委派，董事会聘任

报告期内，发行人新增高级管理人员的提名情况如下：

序号	任职起始时间	姓名	职务	提名情况
1	2019.3	詹奕鹏	研发协理	根据公司经营需要，由总经理推荐，董事会聘任
2	2019.10	孙志明	业务协理	
3	2019.12	蔡嘉辉	执行副总经理	
4	2019.12	邱显寰	营运协理	
5	2020.4	朱才伟	董事会秘书	
6	2020.4	邱显寰	营运副总经理	
7	2020.4	孙志明	业务副总经理	
8	2020.4	詹奕鹏	研发副总经理	
9	2020.11	简瑞荣	采购协理	
10	2020.12	李庆民	营运副总经理室公司协理	
11	2020.3	蔡嘉辉	总经理	经股东双方协商、合肥建投审

序号	任职起始时间	姓名	职务	提名情况
				核，董事会聘任
12	2018.1	朱晓娟	审计师、敬业委员会 委员长	根据《投资参股协议》《合资合同》《公司章程》的约定，由合肥建投委派，董事会聘任
13	2019.5	王继武	采购副总监	
14	2019.10	朱晓娟	行政副总	
15	2019.12	杨幼玲	审计师、敬业委员会 委员长	
16	2018.5	潘炯升	审计师	根据《投资参股协议》《合资合同》《公司章程》的约定，由力晶科技委派，董事会聘任
17	2019.3	李洳谕	副总会计师	

综上，报告期内，发行人新增的高级管理人员中，除 2020 年 3 月前审计师、副总会计师由力晶科技委派外，其他高级管理人员均非力晶科技提名，不存在主要由力晶科技进行提名及主导的情形。

（四）结合上述情况，以及曾签署委托经营管理合约、第二大股东从事同类型业务、经营管理委员会等情况，说明公司是否实质为力晶科技控制或合肥市国资委与力晶科技共同控制，发行人最近两年实际控制人是否发生变更，是否通过实际控制人认定进而规避同业竞争

1、前述情况以及曾签署委托经营管理合约、第二大股东从事同类型业务、经营管理委员会等情况对于发行人实际控制人认定的影响

（1）发行人董事会席位设置及首任董事长由力晶科技推荐

①公司成立初期，为控制公司经营决策风险，重大事项由绝对多数董事通过有利于公司稳健运营，因此当时有效的《公司章程》约定，公司部分重大事项需全体董事或 2/3 以上董事投赞成票方能通过。发行人 2019 年 12 月前的董事会席位设置，系力晶科技出于降低其在中国大陆投资风险及增强在合资企业重大决策等方面的参与度等考虑，合肥国资方出于招商引资需要及保护小股东利益考虑，经双方友好协商确定，具有合理的背景。

②公司董事长的主要职责包括担任公司法定代表人、对外代表公司，以及召集、主持董事会会议等，力晶科技系国际知名的晶圆制造企业，在晶圆代工领域具有多年

的行业经验，由力晶科技推荐具有相关行业经验的人选担任董事长，对于公司在行业内的形象、知名度以及与产业链上下游合作伙伴沟通方面有一定帮助，因此，经双方协商，由力晶科技推荐公司董事长人选，并在合肥国资方对其背景审核后，提交董事会审议通过。

③发行人首任董事长系由双方协商确定且非力晶科技员工，身份相对独立；报告期内公司历次董事会会议上均未发生因力晶科技委派董事单方面反对或弃权而无法形成决策的情形。

综上，基于上述情况，发行人 2019 年 12 月前董事会席位设置及首任董事长由力晶科技推荐的情形未对合肥市国资委的实际控制人的地位造成重大不利影响。

(2) 曾签署委托经营管理合约、第二大股东从事同类型业务、发行人曾设置经营管理委员会

①发行人虽曾与力晶科技签署《委托经营管理合约》，在实际履行过程中，双方仅履行了《委托经营管理合约》中的部分条款，公司未将经营管理权委托予力晶科技。

②发行人的晶圆代工业务和技术在制程节点、代工晶圆尺寸、金属制程、技术路线、产品特性等方面与力晶科技和力积电存在一定差异，发行人与力晶科技及力积电的主要客户、供应商重叠具备合理性，不会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平竞争和利益输送，亦不存在对发行人利益造成重大损害的情形及风险。

③经营管理委员会存续期间，发行人最高权力机构为董事会，经营管理委员会为董事会提供经营相关建议，经营管理委员会不属于公司运营管理机构，不具有对公司经营管理事项进行决策的职权。

综上，基于上述情况，发行人曾与力晶科技签署《委托经营管理合约》、第二大股东从事同类型业务、发行人曾设置经营管理委员会的情形对合肥市国资委的实际控制人地位无实质影响。

2、不存在力晶科技单方控制发行人的情形

(1) 力晶科技在公司最高权力机构中未占主导地位

公司股改前，最高权力机构为董事会，力晶科技持有公司的股权比例均在 50%以下，委派的董事人数未达半数。自 2016 年 3 月公司设立董事会至股改前，公司共计召开 33 次董事会，历次董事会会议上力晶科技委派董事均未对相关审议事项投反对票。仅在董事会审议合肥建投向发行人提供委托贷款及担保等相关事项时，出现过 1 次合肥国资方全体委派董事投同意票，力晶科技 2 名委派董事弃权、2 名委派董事同意，但仍获得董事会通过的情况。未发生因力晶科技委派董事单方面反对而无法形成决策的情形。

公司股改后，最高权力机构为股东大会，力晶科技持有公司的股份比例为 27.44%，提名的董事人数未达半数。

（2）力晶科技委派高级管理人员数量较少且主要起监督作用

自 2016 年 3 月至 2020 年期间，力晶科技向发行人委派高级管理人员包括行政副总经理、审计师、财务副总经理，其中，行政副总经理仅在公司短期任职，在帮助公司结合行业特点，落地、改善相关制度的运作后即返回；审计师、财务副总经理为力晶科技长期委派岗位，主要作用为通过参与公司财务事项审批及内部审计流程，对公司财务状况实施监督，防止控股股东滥用控股地位。

综上所述，力晶科技在公司最高权力机构中未占主导地位，力晶科技委派高级管理人员数量较少且主要起监督作用，不存在力晶科技单方控制发行人的情形。

3、不存在合肥市国资委与力晶科技共同控制的情形

根据合肥建投、力晶科技出具的确认函，力晶科技与合肥市人民政府、合肥市国资委、合肥国资方之间从未签订一致行动协议，亦不存在与发行人控制权相关的约定或类似安排，不存在合肥市国资委与力晶科技共同控制发行人的情形。

4、各方对于公司控制权的确认

（1）合肥市人民政府关于公司控制权的确认

2021 年 8 月，合肥市人民政府出具确认函：

“一、为落实国家关于集成电路产业发展的规划，我市于 2015 年引进力晶科技股

份有限公司（以下简称力晶科技）合作建设合肥晶合 12 英寸晶圆制造基地项目，着力提升自主可控的芯片制造能力。

二、2015 年 4 月，我市与力晶科技签署《12 吋晶圆制造基地项目合作框架协议书》（以下简称《合作框架协议》），后晶合集成按照协议约定与力晶科技签订《委托经营管理合约》。主要目的系促进双方合作关系，配合晶合集成建厂以及初期技术导入，如晶合集成出现经营、发展状况不及预期时，也能够约束力晶科技向晶合集成投入更多精力与支持，降低投资风险，并非将晶合集成经营管理权交予力晶科技。

三、除《合作框架协议》外，我市与力晶科技之间未签署其他与晶合集成相关的协议，不存在关于晶合集成控制权的任何协议或安排。

四、晶合集成自成立以来，均系在合肥国资方的主导下建设、发展，并未将经营管理权交予力晶科技，合肥市国资委一直系晶合集成的实际控制人，不存在晶合集成实质为力晶科技控制或合肥市国资委与力晶科技共同控制的情形。”

（2）合肥建投关于公司控制权的确认

2021 年 3 月及 8 月，合肥建投出具确认函：

“自晶合集成成立以来，本公司一直系晶合集成的直接或间接控股股东，且不存在与力晶科技股份有限公司共同控制晶合集成的情形。”

“本公司及下属合肥芯屏从未与力晶科技签订一致行动协议，本企业与力晶科技之间不存在关于晶合集成控制权的任何协议或安排，不存在晶合集成实质为力晶科技控制或合肥市国资委与力晶科技共同控制的情形。”

（3）力晶科技关于公司控制权的确认

2021 年 3 月及 8 月，力晶科技出具确认函：

“自入股晶合集成以来，本企业充分认可合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”）方的控股股东地位，对晶合集成重大决策战略方针、企业发展方向、经营决策、重大投资等具有决定性影响力，认可并尊重合肥市国有资产监督管理委员会（以下简称“合肥市国资委”）作为晶合集成实际控制人的地位，本企业自入股

以来未以任何形式谋求对晶合集成的控制权，亦不存在与合肥市国资委共同控制晶合集成的情形。

2019年12月前，根据晶合集成的公司章程及合资合同，晶合集成的董事会由9名董事组成，其中本企业有权委派4名董事，且晶合集成的重大事项需经2/3以上出席会议董事投赞成票方可通过。该等董事会席位设置系出于保护本企业在中国大陆投资安全性考虑而与合肥国资委、合肥建投方协商确定，自本企业入股晶合集成以来，不存在通过委派的董事阻碍或影响合肥建投方、合肥市国资委对于晶合集成的控制权的情形。”

“本企业认可并尊重合肥市国有资产监督管理委员会（以下简称“合肥市国资委”）作为晶合集成实际控制人的地位，且从未与合肥市人民政府、合肥市国资委、合肥建投或合肥芯屏中的一方或多方签订一致行动协议，本企业与合肥市人民政府、合肥市国资委、合肥建投或合肥芯屏之间不存在关于晶合集成控制权的任何协议或安排，不存在晶合集成实质为本企业控制或合肥市国资委与本企业共同控制的情形。”

5、结论意见

综上，发行人自设立以来一直由合肥市国资委实际控制，不存在力晶科技实质控制发行人或合肥市国资委与力晶科技共同控制发行人的情形，发行人最近两年实际控制人未发生变更，不存在通过实际控制人认定进而规避同业竞争的情形。

五、《问询函》第6题：关于力晶科技从事同类业务

根据申报材料：力晶科技及其关联企业力积电从事晶圆代工业务，与发行人主营业务属于同一类型业务。

请发行人披露力晶科技与公司从事同类型业务的情况以及对发行人的影响，并就发行人与第二大股东力晶科技间存在同类业务的情况作重大事项提示和风险提示。

请发行人说明：（1）结合对与力晶科技之间重叠客户、供应商的销售与采购金额占比较高的情况，充分分析是否会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平

竞争、是否会导致利益输送、相互或者单方让渡商业机会情形，是否存在损害发行人利益的情形及风险；（2）公司与力晶科技从事同类型业务的情况下是否对发行人相关产品及业务拓展造成不利影响，双方未来的发展规划。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）结合对与力晶科技之间重叠客户、供应商的销售与采购金额占比较高的情况，充分分析是否会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平竞争、是否会导致利益输送、相互或者单方让渡商业机会情形，是否存在损害发行人利益的情形及风险

1、发行人具备独立、完善的公司治理结构

力晶科技与发行人独立开展经营，力晶科技作为发行人股东，通过委派董事正常参与发行人具体生产经营管理，不存在通过股东地位及委派董事影响导致双方非公平竞争、利益输送、相互或单方让渡商业机会的情形。

为防范非公平竞争、利益输送或相互或者单方让渡商业机会，发行人制定了《关联交易实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等，在《公司章程（上市后适用）》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度中对公司重大投资、交易、资金往来的审议和决策程序等进行了规定，并制定了研发、采购、生产、销售、人力资源管理、财务管理等业务及财务相关的管理制度，对公司各类业务审批、执行、管理等事项进行了规定，从而避免利益输送及利益冲突，保持公司独立性，保障公司及股东的利益。

2、发行人与力晶科技及力积电的服务存在差异

发行人与力晶科技在技术方面存在差异，双方提供的晶圆代工服务存在差异，不具备完全的互相替代性。

3、全球晶圆代工市场规模巨大，客户、供应商重叠具备合理性

全球晶圆代工市场规模巨大，发行人与力晶科技及力积电均具有较大发展空间，

同一客户在多个晶圆代工厂同时下单、同一供应商同时向多个晶圆代工企业供货等情形具备合理性，发行人与力晶科技及力积电供应商重叠具备合理性。

4、发行人前五大客户及前五大供应商与发行人不存在关联关系

发行人前五大客户中，集创北方为发行人股东，持有发行人 8,801,412 股，持股比例 0.58%。发行人的前五大客户和供应商均为行业知名企业，与发行人、实际控制人和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在配合发行人进行利益输送的情形。

5、发行人独立向客户提供服务，没有力晶科技及力积电参与

根据对发行人主要客户的访谈，发行人主要客户向发行人、力晶科技及力积电的采购决策均由客户独立作出，向发行人采购和向力晶科技及力积电采购互不影响。发行人和发行人客户之间的晶圆投产、价格确定均由发行人客户与发行人独立进行，并由客户对发行人的工艺平台进行验证。客户向发行人采购的过程中没有力晶科技及力积电的参与，发行人与力晶科技及力积电之间不存在非公平竞争，不存在通过发行人客户进行利益输送、相互或者单方让渡商业机会情形。

6、发行人独立向供应商采购，没有力晶科技及力积电参与

报告期内，发行人的供应商均由发行人独立开发、谈判、维护。发行人的主要原材料和设备采购均由发行人独立决策、独立执行。力晶科技及力积电不参与发行人采购的任何环节，发行人与力晶科技及力积电之间不存在非公平竞争，不存在通过发行人供应商进行利益输送、相互或者单方让渡商业机会情形。

7、力晶科技已签署相关承诺函

力晶科技已于 2021 年 3 月签署关于独立性与同业竞争的《承诺函》，并承诺：

“2018 年 1 月至今，本公司及本公司下属企业与晶合集成存在部分客户、供应商重叠，该等重叠的客户、供应商均系双方独立开发、谈判、维护，不存在非公平竞争、通过重叠客户或供应商进行利益输送、相互或单方让渡商业机会等情形。”

力晶科技已于 2021 年 8 月签署《确认函》，并承诺：

“晶合集成与本公司及力积电等本公司关联企业之间存在部分客户重叠的情形，但双方之间对于销售均独立作出决策，本公司及力积电等本公司关联企业从未干预或影响晶合集成的销售决策过程，从未干预或影响晶合集成的客户向晶合集成采购的决策过程，亦不存在晶合集成通过本公司及力积电等本公司关联企业进行销售的情形。”

“晶合集成与本公司及力积电等本公司关联企业之间存在部分供应商重叠的情形，但双方之间对于采购均独立作出决策，本公司从未干预或影响晶合集成的采购决策过程，亦不存在晶合集成通过本公司进行采购的情形。”

“晶合集成与本公司及力积电等本公司关联企业间不存在非公平竞争、不存在利益输送、相互或者单方让渡商业机会情形，本公司不存在损害晶合集成利益的情形。”

综上所述，发行人与力晶科技及力积电之间的客户重叠、供应商重叠具备合理性，不会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平竞争、不会导致利益输送、相互或者单方让渡商业机会情形，不存在损害发行人利益的情形及风险。

（二）公司与力晶科技从事同类型业务的情况下是否对发行人相关产品及业务拓展造成不利影响，双方未来的发展规划

芯片设计企业通过向多个晶圆代工厂下单，分散供应商，降低供货风险，保证产品的多样性，任一晶圆代工企业（包括力晶科技及力积电）无法通过其在客户中的供货地位，来影响客户的采购决策，发行人与力晶科技从事同类型业务不会影响发行人客户和业务拓展。

在未来发展规划方面，发行人与力晶科技及力积电存在一定差异，具体情况如下：

主体	未来发展规划
发行人	目前正在进行 55nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的研发，并已投入大量资源，积极从事 MCU、CIS、PMIC、Mini LED 等晶圆代工工艺平台的研发工作。同时，拟将募集资金运用于后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目、微控制器芯片工艺平台研发项目、40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目、28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目。
力晶科技及力积电	1、逻辑及特殊应用产品晶圆代工平台：BSI CMOS 影像感测平台、25nm 逻辑平台、40nm 内存整合芯片平台、3D 整合芯片技术平台、第三代半导体功率组件平台等晶圆代工平台等；

主体	未来发展规划
	2、内存产品晶圆代工平台：提供 30/25nm 及其以下制程的 DRAM 代工平台及 28nm NAND Flash 代工产品，并开发 48nm NOR Flash 代工产品等。

发行人正在进行 55nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的研发，拟将募集资金运用于后照式 CMOS 图像传感器、微控制器等特色工艺平台的研发，及 40nm 以下制程的研发。力积电未来计划开发的下一代新产品及服务主要涉及逻辑及特殊应用产品晶圆代工平台和内存产品晶圆代工平台，与发行人在工艺平台、制程节点上存在较大差异。

综上所述，发行人与力晶科技及力积电从事同类型业务的情况下不会对发行人相关产品及业务拓展造成不利影响。发行人与力晶科技及力积电的未来发展方向在工艺平台、制程节点方面存在差异。

六、《问询函》第 7 题：关于无形资产和技术

根据问询回复：（1）2015 年 10 月，晶合有限与力晶科技、合肥建投签订《技术转移协议》，约定力晶科技以三项制程技术作价 20 亿元出资晶合有限，包括专利技术、技术文件及数据以及技术经验等内容，所涉及的 58 项专利使用权的到期时间在 2016 年至 2025 年，截至问询函回复出具之日，上述发明专利权中 14 项已到期，但 2018 年和 2019 年末，发行人对无形资产进行了减值测试未发现减值迹象；（2）2018 年导入 90nmM+ 技术平台；（3）报告期内，发行人向智成电子采购 IP 授权交易分别为 177.18 万元、152.95 万元和 372.62 万元，智成电子系力晶科技控制公司。未来发行人不排除基于代工产品工艺技术要求继续向智成电子取得上述 IP 或其他类型 IP 的授权。发行人与智成电子的 IP 授权交易具有持续性。

请发行人说明：（1）结合力晶科技转让技术的相关情况，说明相关技术文件及力晶科技相关技术经验等内容转移至发行人的具体实施过程，相关技术转让后短期内独立获取客户的原因；（2）专利到期对于专利作价、专利技术保护和相关技术使用的影响，2018 年和 2019 年专利到期事项未对 2018 年和 2019 年末无形资产减值产生影响的合理性；（3）发行人向智成电子采购 IP 授权交易的原因，在发行人生产经营及技

术方面的作用，发行人目前技术与力晶科技之间的关系，是否存在技术依赖。

请保荐机构、发行人律师和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）结合力晶科技转让技术的相关情况，说明相关技术文件及力晶科技相关技术经验等内容转移至发行人的具体实施过程，相关技术转让后短期内独立获取客户的原因

1、相关技术文件及力晶科技相关技术经验等内容转移至发行人的具体实施过程

2015年10月，晶合集成与力晶科技、合肥建投签订《技术移转协议》，约定力晶科技将150nm、110nm、90nm驱动IC技术移转予发行人，其中包括工艺平台数据、技术文件、相关专利文件等材料。相关技术文件及相关技术经验由力晶科技转移至发行人的具体实施过程如下：

（1）技术整备、导入及验证

力晶科技于发行人建厂期间对涉及移转的技术进行整备，确保技术文件完整，以便向发行人移转。在发行人建厂完成后，力晶科技将整理好的移转技术数据全部交由发行人，其中包括工艺平台参数、制程技术流程、配套IP技术数据等。针对移转的150nm、110nm、90nm的三项制程技术，发行人自身内部开展验证，以确保技术移转的工艺平台可以向客户提供服务。2017年6月5日，公司与力晶科技签订《技术移转协议确认函》，确认发行人已完成对三项制程技术的验证。

（2）技术转移团队建置及人才培育

力晶科技组建一支技术移转团队，负责进行技术移转与发行人员工培训事宜，确保相关技术的顺利实施。该团队中包括黄光工程部、蚀刻工程部、薄膜工程部、扩散工程部、制造部、自动化工程部、厂务部、分析技术部等专业技术人员，协助发行人进行技术移转工作。

发行人亦将部分员工委派至力晶科技进行培训，使发行人能更好的进行技术承接，培训结束后受训人员返回发行人处进行工作。

（3）技术移转完成

在承接以上技术、专利文件且各项技术指标达成产品验证及其他技术移转条件后，力晶科技技术移转完成。根据发行人与力晶科技的《技术移转完成证明书》，力晶科技于 2018 年 3 月 31 日已完成技转。

2、相关技术移转后短期内独立获取客户的原因

在技术移转的过程中，为协助发行人完成初期产品和工艺平台的技术移转验证工作，力晶科技负责将与奇景光电和奕力科技涉及技术移转的相关 PDK（制造工艺设计包）、制程资料等技术文件和数据资料移转至发行人。相关技术移转完成后，发行人与奇景光电、奕力科技独立沟通、谈判签署相关合同订单，随后完成试产、风险量产、量产等工作，并与奇景光电和奕力科技建立了稳定的合作关系，具备合理性。

除上述情况外，发行人其余主要客户均为发行人自主联系、独立开发，双方通过邮件、电话等沟通确认需求，正式订单主要通过邮件等方式进行下达。发行人销售团队于 2016 年 12 月开始接触联咏科技，至 2017 年 8 月签订正式订单；于 2017 年 4 月开始接触集创北方，至 2017 年 12 月签订正式订单；于 2017 年 6 月开始接触合肥捷达微电子有限公司、天钰科技股份有限公司、深圳天德钰科技股份有限公司，至 2018 年 6 月签订正式订单。发行人获取该等客户均经历了完整的前期接洽、沟通讨论、工程开发、产品验证、订单签署过程，具备合理性。

综上，在技术移转完成后，发行人获取主要客户均经历了完整的前期接洽、沟通讨论、工程开发、产品验证、订单签署等过程，具备合理性。

（二）专利到期对于专利作价、专利技术保护和相关技术使用的影响，2018 年和 2019 年专利到期事项未对 2018 年和 2019 年末无形资产减值产生影响的合理性

1、专利到期对于专利作价、专利技术保护和相关技术使用的影响

发行人 2015 年 10 月与力晶科技、合肥建投签订《技术移转协议》，约定力晶科技以三项制程技术作价 20 亿元出资晶合有限，包括专利技术、技术文件及数据以及技术经验等内容，所涉及的 58 项专利使用权的到期时间在 2016 年至 2025 年。2015 年《技术移转协议》签署时，相关标的专利尚未到期，但作价时已考虑部分专利即将到期的影响。虽然部分标的专利即将到期，但其仍具有相当的使用价值，专利到期并不影响发行人对相关专利技术的使用。

此外，发行人高度重视产品研发与技术创新，报告期内研发费用呈持续上升趋势，

并在新技术、新产品研发的过程中持续申请新的专利以加强技术保护，部分专利到期对发行人专利保护影响相对有限。前述专利到期不会对标的公司生产经营产生重大不利影响。

2、2018年和2019年专利到期事项对2018年和2019年末无形资产减值的影响

发行人报告期内发生减值的无形资产系发行人无形资产中核算的专利权及非专利技术，包括发行人自力晶科技移转并计入无形资产的58项专利权和1项非专利技术（90nm M+驱动IC制程），广泛应用于公司生产制造过程的各个环节及工艺流程，共同对产品发挥作用。

由于难以对单项专利的可收回金额进行估计，因此发行人以资产组为基础确定可收回金额。公司以2018年末及2019年末为基准日对上述专利权及非专利技术构成的资产组采用收益法进行减值测试过程中，已考虑专利到期因素的影响。经测算前述基准日资产组的可收回金额高于账面价值，因此未计提减值准备。

为确保减值测试准确性，发行人委托安徽安建资产评估有限责任公司及同致信德（北京）资产评估有限公司分别对2018年及2019年减值测试进行了评估，同时同致信德（北京）资产评估有限公司对安徽安建资产评估有限责任公司出具的2018年减值测试评估报告进行了复核，相关评估结果显示评估基准日无需计提减值准备。

（三）发行人向智成电子采购IP授权交易的原因，在发行人生产经营及技术方面的作用，发行人目前技术与力晶科技之间的关系，是否存在技术依赖

1、发行人向智成电子采购IP授权交易的原因，在发行人生产经营及技术方面的作用

根据智成电子公开资料，智成电子成立于2001年，为客户提供IP、IC、Module等产品设计服务方案，是一家拥有专业晶片研发技术的公司。

发行人向智成电子采购IP授权的内容为110nm标准单元库。标准单元库是集成电路芯片后端设计过程中的基础部分，运用智成电子预先设计好的优化的单元库进行自动逻辑综合和版图布局布线，以提升被授权人的客户引入效率。采用标准单元库IP授权系晶圆代工行业特征，具有行业普遍性，IP授权商在晶圆代工企业对通用的逻辑单元库和布局布线进行事先设计及验证，并以标准单元库的形式向晶圆代工企业授权并提供客户直接在设计时使用，以减少晶圆代工企业客户重复工作，缩短客户引入的

时间。如不进行标准单元库 IP 采购，将降低客户引入的效率，但不会对晶圆代工企业的生产工艺造成实质影响。

除了向智成电子采购标准单元库 IP 授权以外，发行人亦向寅通科技股份有限公司、円星科技股份有限公司采购标准单元库 IP 授权服务。随着发行人工艺平台种类进一步增加，制程水平不断提高，未来将与更多 IP 授权商进行合作，以避免单个授权商因不可抗力等原因无法继续提供 IP 授权时可能对发行人带来的不利影响。前述 3 家 IP 授权商提供的标准单元库在进行部分调整后即可实现相互替代，发行人对智成电子提供的 110nm 标准单元库 IP 授权不存在依赖。

2、发行人目前技术与力晶科技之间的关系，是否存在技术依赖

发行人对于 IP 供应商的选择，需要综合考虑供应商的资质、品牌、IP 在业界被采用的量产记录、客户口碑和 IP 质量，以及性价比等多个维度。发行人向智成电子采购 IP 服务具有商业合理性，系根据自身业务需要独立完成相关 IP 授权采购。上述采购流程系发行人综合判断 IP 供应商服务能力、品牌质量、性价比等因素后独立作出，符合发行人内部采购制度，与力晶科技的研发和技术体系无关。

报告期内，发行人对技术进行持续自主研发并创新升级，以满足不同客户针对不同制程节点、不同工艺平台的产品需求，并形成了稳定的研发人员团队，团队成员均与发行人直接签署劳动合同。同时，发行人不断将研发投入所形成的科研成果及核心技术通过申请专利等方式进行保护，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人已形成与主营业务收入相关的发明专利共 71 件，不依赖于力晶科技的研发团队、科研成果及专利和非专利技术，具有独立研发能力。

综上，智成电子提供的 110nm 标准单元库 IP 授权主要用于提升发行人客户引入效率，但不会对晶圆代工企业的生产工艺造成实质影响。发行人对智成电子提供的 110nm 标准单元库 IP 授权不存在依赖。发行人在研发机制、研发团队、专利申请各方面均具备独立性，不依赖于力晶科技的研发和技术体系。

七、《问询函》第 9.2 题

报告期内，报告期内除日本子公司员工外，发行人台籍员工通过中国台湾第三方劳务公司怡东人事顾问股份有限公司为其在中国台湾地区缴纳劳健保。

请结合相关法律法规规定说明上述代缴社保相关情形是否符合相关法律法规规定以及对公司的影响。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）发行人通过第三方劳务公司为台籍员工在中国台湾地区缴纳劳健保的原因

发行人的主营业务为 12 英寸半导体晶圆代工服务，中国台湾地区在晶圆代工行业较为领先，相关人才较为充裕，公司作为快速发展阶段的晶圆代工厂，存在招聘中国台湾地区具有晶圆代工行业工作经验人才的需求。考虑到中国台湾籍员工有在中国台湾地区缴纳劳健保的需求，且其在中国大陆地区缴纳社会保险的意愿不强，因此，发行人通过第三方劳务公司为中国台湾籍员工在中国台湾地区缴纳劳健保，同时，中国台湾籍员工在与公司签订的相关劳动合同中承诺放弃在中国大陆缴纳社会保险。此外，公司还为中国台湾籍员工在购买了商业保险作为补充。

（二）中国大陆对于社会保险相关法律、法规规定

根据《中华人民共和国社会保险法》第四条规定：“中华人民共和国境内的用人单位和个人依法缴纳社会保险费”，第五十八条规定：“用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记”，第八十四条规定：“用人单位不办理社会保险登记的，由社会保险行政部门责令限期改正；逾期不改正的，对用人单位处应缴社会保险费数额一倍以上三倍以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上三千元以下的罚款。”

根据《香港澳门台湾居民在内地（大陆）参加社会保险暂行办法》第二条规定：“在内地（大陆）依法注册或者登记的企业、事业单位、社会组织、有雇工的个体经济组织等用人单位（以下统称用人单位）依法聘用、招用的港澳台居民，应当依法参加职工基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险，由用人单位和本人按照规定缴纳社会保险费。”

（三）中国台湾地区对于缴纳劳健保的相关法规规定

1、劳工保险

根据台湾律师出具的法律意见，中国台湾地区《劳工保险条例》规定，被保险人受派遣出国考察、研习或提供服务者，可以继续参加劳工保险（以下简称“劳保”）；被保险人受派遣出国考察、研习或提供服务的情形下，是否可以继续参加劳保，应依个案事实认定雇佣关系判断。如投保单位故意为不合《劳工保险条例》之人员办理参加保险手续，台湾行政院劳动部劳工保险局可以取消被保险人之加保资格，违法加保期间之年资无法并计，已缴之劳保保险费亦不退还，且得依法追还已领取之保险给付。

第三方劳务公司怡东人事与发行人中国台湾籍员工之间并不存在实质雇佣关系，不符合《劳工保险条例》，台湾行政院劳动部劳工保险局可以取消台籍员工加入劳保的资格，违法参加劳保期间之年资无法并计，已缴之劳保保险费亦不退还，且劳保局可以依法追还台籍员工已领取之保险给付。

2、全民健康保险

根据台湾律师出具的法律意见，中国台湾地区《全民健康保险法》规定，具有中国台湾籍、符合最近 2 年内曾有参加台湾全民健康保险（以下简称“健保”）纪录且在中国台湾地区设有户籍，或参加健保前 6 个月继续在中国台湾地区设有户籍，或参加健保时已在台湾地区设有户籍之公职或受雇者，应参加健保。发行人中国台湾籍员工符合前述要件者，不论是否具有与第三方劳务公司的雇佣关系，均可以参加健保；于受雇时，以健保法第一类被保险人下受雇者身分加保，于无职业时，以眷属身分或第六类被保险人下无职业一般家户户长或家户代表加保健保。

第三方劳务公司怡东人事为台籍员工以健保法第一类被保险人下受雇者身分加保，但因怡东人事与台籍员工并非实质雇佣关系，台籍员工属于无职业的类别，应以第六类被保险人下无职业一般家户户长或家户代表加保健保。怡东人事为台籍员工参加健保的方式不符合健保法的规定，但健保法并未就前述不合法加保订有相关处罚。

综上，公司作为实际用人单位通过第三方劳务公司怡东人事为台籍员工缴纳劳保、健保的行为不完全符合中国台湾地区《劳工保险条例》和《全民健康保险法》的相关规定，但是上述法规并未对实际用人单位需要承担的相应法律责任和处罚进行规定。

（四）发行人通过第三方劳务公司代缴劳健保事宜对于发行人经营成果的影响

根据发行人测算，报告期内，发行人为中国台湾籍员工实际缴纳劳健保、未在中国大陆缴纳社会保险对发行人经营成果的影响如下：

单位：人民币万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
发行人为中国台湾籍员工实际缴纳劳健保的金额 (a)	468.88	555.63	560.10
发行人应为中国台湾籍员工缴纳社会保险的金额 (b)	1,460.51	1,423.38	413.61
差额 (b-a)	991.63	867.75	-146.49
营业总成本 (c)	123,918.17	169,998.65	255,660.04
发行人应为中国台湾籍员工缴纳社会保险的金额占营业总成本的比例 (b/c)	1.18%	0.84%	0.16%
差额占营业总成本的比例 [(b-a)/c]	0.80%	0.51%	-0.06%

注：2020 年度，国家在疫情期间推出了社保减免政策，因此，发行人应为中国台湾籍员工缴纳社会保险的金额大幅降低。

发行人报告期内应当为中国台湾籍员工在中国大陆缴纳社会保险的金额与发行人为中国台湾籍员工缴纳劳健保的金额的差额占发行人营业总成本的比例分别为 0.80%、0.51%、-0.06%，发行人通过第三方劳务公司代缴劳健保事对发行人的经营成果影响较小。

(五) 发行人通过第三方劳务公司代缴劳健保事宜未曾受到行政处罚

发行人通过第三方劳务公司为中国台湾籍员工代缴劳健保的行为未完全符合《中华人民共和国社会保险法》《香港澳门台湾居民在内地（大陆）参加社会保险暂行办法》中“为其员工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记”的相关规定，但发行人通过第三方劳务公司代缴劳健保的方式，已实质履行为中国台湾籍员工实际缴纳社会保险费的义务。

根据本所律师对合肥市新站区劳动局仲裁监察处的访谈，发行人目前社保的缴纳方式符合要求，2018 年 1 月 1 日至今无举报、投诉的情形。

根据合肥市人力资源和社会保障局出具的证明：未发现发行人劳动用工违法行为，无人力资源社会保障行政部门行政处罚的不良记录。

(六) 不会对本次发行上市造成重大不利影响

发行人委托第三方劳务公司代缴台籍员工劳健保的行为是基于自身业务经营及台

籍员工意愿产生，虽未完全符合《中华人民共和国社会保险法》及相关规定，但已实际履行了为其台籍员工缴纳社会保险的义务，保障了台籍员工享有的社会保险权利，具有合理性。发行人作为实际用人单位通过第三方劳务公司怡东人事为台籍员工缴纳劳保、健保的行为不完全符合中国台湾地区《劳工保险条例》和《全民健康保险法》的相关规定，但是上述法规并未对实际用人单位需要承担的相应法律责任和处罚进行规定。此外，发行人不存在因未为员工缴纳社会保险而受到行政处罚的情形。因此，发行人通过第三方劳务公司代缴劳健保事对发行人的经营成果影响较小。

综上，发行人委托第三方劳务公司为中国台湾籍员工代缴劳健保不会对本次发行上市造成重大不利影响。

八、《问询函》第 9.3 题

公司于 2017 年在日本设立子公司，员工主要来源于 Synaptics 公司，日本晶合所取得的知识产权权益归属于晶合集成。2017 年前后 Synaptics 公司拟进行业务转型，晶合集成获得吸纳曾于 Synaptics 日本子公司任职的研发团队的机会。

请发行人说明：相关人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，相关研发成果是否涉及其原任职单位的技术成果，是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

发行人日本子公司吸纳曾于 Synaptics 日本子公司任职的研发团队，截至 2020 年 12 月 31 日，日本晶合共有 14 名员工，其中 9 名曾任职于 Synaptics 日本子公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，日本晶合员工作为发明人、在发行人任职期间自主研发并取得的授权专利共计 3 项，具体情况如下：

序号	权利人	发明人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	国别
1	晶合集成	田矢真敏；中野纪夫；熊谷裕弘	发明专利	半导体元件的制造方法	ZL201910103609.4	2019/02/01	中国

序号	权利人	发明人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	国别
2	晶合集成	小嶋英充	发明专利	ラッチ回路	特许第 6761074 号	2019/05/21	日本
3	晶合集成	小嶋英充	发明专利	SRAM、半 导体集積回 路及び LCDドラ イバ	特许第 6801053 号	2019/06/19	日本

日本晶合全体员工均已出具确认函：“本人从原单位离职后加入日本晶合，不存在违反原单位竞业禁止及保密义务或其他约定的情形，亦不存在任何同原单位纠纷或潜在纠纷。”

根据日本律师出具的法律意见书，日本晶合与其他第三方无专利诉讼案件，日本员工与原单位之间不存在诉讼案件。

综上所述，日本子公司相关人员不存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，相关研发成果不涉及其原任职单位的技术成果，不存在纠纷或潜在纠纷。

九、《问询函》第 9.5 题

请发行人和有关中介机构按照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》《关于科创板落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》等要求，对相关事项进行核查和披露，并出具专项核查报告。

答：

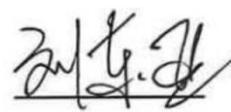
本所已根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》《关于科创板落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》对股东事项进行了核查，更新《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司股东信息披露专项核查报告》，具体详见本次申报文件之“7-8-7 发行人律师关于合肥晶合集成电路股份有限公司股东信息披露的专项核查报告”。

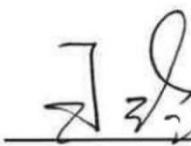
（本页以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（二）》之签章页）



经办律师：
苏 峥


刘东亚

单位负责人：
王 玲

2021年 8 月 31 日

北京市金杜律师事务所
关于合肥晶合集成电路股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
补充法律意见书（三）

致：合肥晶合集成电路股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已出具《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市之补充法律意见书（一）》（以下简称《补充法律意见书（一）》）和《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（二）》（以下简称《补充法律意见书（二）》）。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 12 日出具了《合肥晶合集成电路股份有限公司审计报告》（容诚审字[2021]第 230Z3811 号）（以下简称《三年及一期审计报告》）对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度，2021 年 1 月至 6 月期间（以下简称最近一期）财务报表进行审计，并出具了《合肥晶合集成电路股份有限公司内部控制鉴证报告》（以下简称《2021 年半年度内控报告》）。本所现根据《三年及一期审计报告》《2021 年半年度内控报告》及发行人招股说明书和其他相关申报文件的修改和变动，就其中所涉及的法律问题，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对本所已出具的《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》的补充，并构成《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》不可分割的一部分；本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》中对相关用语的释义、缩写适用于本补充法律意见书；本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》中发表法律意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见书。对于本补充法律意见书特别说明的事项，以本补充法律意见书的说明为准。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市制作的《招股说明书（申报稿）》中自行引用或按照中国证监会、上交所的审核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，出具补充法律意见如下：

目录

第一部分 发行人本次发行上市相关情况的更新	5
一、 本次发行上市的批准和授权	5
二、 发行人本次发行上市的主体资格	5
三、 本次发行上市的实质条件	5
四、 发行人的独立性及其变化情况	8
五、 发起人和股东的变化情况	9
六、 发行人的股本及其演变	12
七、 发行人的业务	12
八、 关联交易及同业竞争及其变化情况	14
九、 发行人的主要财产及其变化情况	33
十、 发行人的重大债权债务变化情况	39
十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并	45
十二、 发行人公司章程的制定与修改	46
十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	46
十四、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化	47
十五、 发行人的税务及其变化情况	48
十六、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准的变化情况	49
十七、 发行人的劳动与社会保障及其变化情况	50
十八、 发行人募集资金的运用	51
十九、 诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况	52

二十、 发行人《招股说明书（申报稿）》法律风险的评价	54
二十一、 本次发行上市的总体结论性意见	54
第二部分 财务数据更新至 2021 年 6 月 30 日后《问询函》中涉及的相关问题回复内容的更新	55
一、 《问询函》第 1 题：关于实际控制人认定	55
二、 《问询函》第 4 题：关于第二大股东力晶科技从事同类型业务	56
三、 《问询函》第 11 题：关于技术来源和先进性	57
四、 《问询函》第 12.2 题：委派管理人员	59
五、 《问询函》第 12.3 题：向控股股东子公司租赁厂房及设施	63
六、 《问询函》第 12.5 题：社保缴纳情况	65
七、 《问询函》第 24 题：关于募投项目	66
八、 《第二轮问询函》第 5 题：关于实际控制人认定	67
九、 《第二轮问询函》第 7 题：关于无形资产和技术	71
十、 《第二轮问询函》第 9.2 题	72
十一、 《第二轮问询函》第 9.3 题	74
附件一：发行人及其子公司拥有的知识产权	78

第一部分 发行人本次发行上市相关情况的更新

一、 本次发行上市的批准和授权

根据发行人提供的董事会和股东大会的会议文件并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人于 2021 年 3 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会对本次发行上市的批准和授权仍在有效期内，该次股东大会通过的与发行人本次发行上市有关的各项议案仍然有效。

发行人本次发行尚需上交所科创板股票上市委员会的审核，并报中国证监会履行发行注册程序；本次发行完成后，发行人股票于上交所上市交易尚待获得上交所审核同意。

二、 发行人本次发行上市的主体资格

根据发行人工商档案资料、《营业执照》《企业信用报告》、合肥新站高新技术产业开发区市场监督管理局出具《证明》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>），截至本补充法律意见书出具日，发行人仍为合法存续的股份有限公司，不存在根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》需要终止的情形，发行人仍具备本次发行上市的主体资格。

三、 本次发行上市的实质条件

（一） 本次发行上市符合《公司法》《证券法》的相关条件

1、 根据发行人本次发行上市相关股东大会决议及发行人书面说明，发行人本次发行的股票为每股面值 1.00 元的人民币普通股股票，每股的发行条件和价格相同，每一股份具有同等权利，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、 发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事和董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

3、根据《三年及一期审计报告》、发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》、发行人及其境内子公司相关主管部门出具的证明及发行人书面说明，截至本补充法律意见书出具日，发行人依法存续，不存在因违法经营而被相关主管部门责令停业整顿或吊销营业执照的情形，不存在根据法律、法规及《公司章程》规定需要终止的情形。发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

4、根据《三年及一期审计报告》，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

5、根据发行人及其子公司所在地公安机关出具的证明、发行人控股股东出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司之机构股东有关事项的调查函》及发行人书面说明，并经本所律师核查，发行人及其控股股东最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

（二）本次发行上市符合《注册管理办法》规定的相关条件

1、如本补充法律意见书第一部分“二、发行人本次发行上市的主体资格”所述，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司；发行人已依法设立股东大会、董事会、监事会以及相关职能部门，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

2、根据《三年及一期审计报告》《2021年半年度内控报告》和发行人书面说明，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具标准无保留意见的《三年及一期审计报告》；根据《2021年半年度内控报告》和发行人书面说明，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具标准无保留意见的《三年及一期审计报告》，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

(1) 如本补充法律意见书第一部分“四、发行人的独立性及其变化情况”所述，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立；如本补充法律意见书第一部分“八、关联交易及同业竞争及其变化情况”所述，发行人与控股股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项之规定。

(2) 如本补充法律意见书第一部分“七、发行人的业务”所述，截至本补充法律意见书出具日，发行人的主营业务最近两年内未发生重大不利变化；如本补充法律意见书第一部分“十四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”所述，发行人的董事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内未发生重大不利变化；如本补充法律意见书第一部分“五、发起人和股东”所述，发行人的股权权属清晰，截至本补充法律意见书出具日，控股股东和受控股股东支配的股东持有的发行人股份权属清晰，最近两年控制权稳定、实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项之规定。

(3) 如本补充法律意见书第一部分“九、发行人的主要财产及其变化情况”“十、发行人的重大债权债务变化情况”及“十八、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况”所述，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项之规定。

4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策：

(1) 如本补充法律意见书第一部分“七、发行人的业务”所述，根据工商、税务等相关政府部门出具的证明文件和发行人书面说明，经本所律师核查，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定。

(2) 如本补充法律意见书第一部分“十八、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况”所述，根据发行人及其子公司所在地相关政府部门出具的证明文件、发行人控股股东出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司之机构股东有关事项的调查函》及发行人书面说明，并经本所律师核查，最近三年内，发行人及其控股股东不存在贪污、贿

赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

(3) 如本补充法律意见书第一部分“十八、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况”所述，根据发行人董事、监事和高级管理人员填写的《董事、监事、高级管理人员调查表》，经本所律师核查，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第三款的规定。

(三) 本次发行上市符合《上市规则》规定的相关条件

1、本次发行上市符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》规定的发行条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定。

2、根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》及《招股说明书（申报稿）》，本次发行上市后股本总额不少于 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

3、根据《招股说明书（申报稿）》和本次发行上市相关股东大会决议，发行人股本总额超过 4 亿元，本次发行完成后，发行人公开发行的股份数将达到本次发行后发行人股份总数的 10%以上，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

4、根据《三年及一期审计报告》、保荐机构出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司预计市值的分析报告》及发行人书面说明，发行人申请本次发行上市，预计市值不低于 30 亿元，且最近一年营业收入不低于 3 亿元，符合《上市规则》第 2.1.2 条第（四）项规定的市值和财务指标标准及第 2.1.1 条第（四）项的规定。

综上，本所律师认为，发行人仍具备本次发行上市的实质条件。

四、 发行人的独立性及其变化情况

根据发行人提供的业务合同台账、订单台账及重大业务合同、订单等相关文件资

料、发行人高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师审阅发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》及《三年及一期审计报告》《2021年半年度内控报告》等书面材料，以及发行人的确认，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人业务、资产、人员、机构及财务独立性情况未发生变化，发行人资产完整且仍具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

五、发起人和股东的变化情况

根据发行人提供的资料并经本所核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的股东变化情况如下：

1、中小企业基金

根据中小企业基金的工商档案，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），中小企业基金的合伙人结构发生变更。截至2021年6月30日，中小企业基金的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司	普通合伙人	4,500.00	1.00
2	国家中小企业发展基金有限公司	有限合伙人	110,000.00	24.44
3	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	109,500.00	24.33
4	安信证券股份有限公司	有限合伙人	25,000.00	5.56
5	深圳市汇通金控基金投资有限公司	有限合伙人	45,000.00	10.00
6	新余市华邦投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	56,000.00	12.44
7	万科企业股份有限公司	有限合伙人	30,000.00	6.67
8	山证创新投资有限公司	有限合伙人	30,000.00	6.67
9	深圳市创东方富盛投资企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000.00	4.44

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
10	舟山保泰盈股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	2.22
11	山西交通产业基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	2.22
合计		—	450,000.00	100.00

2、海通创新

根据海通创新的工商档案，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，海通创新已增资并于 2021 年 6 月 16 日完成工商变更登记，变更后的注册资本为 930,000 万元人民币，股东仍为海通证券股份有限公司。

3、中金浦成

根据中金浦成的营业执照，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，中金浦成已增资并于 2021 年 7 月 28 日、2021 年 11 月 15 日进行了两次增资，变更后的注册资本为 600,000 万元人民币，股东仍为中国国际金融股份有限公司。

4、惠友豪创

根据惠友豪创的工商档案，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），中小企业基金的合伙人结构发生变更，杨庆将持有的惠友豪创 1,000 万元出资额转让给刘君，已于 2021 年 9 月 1 日完成工商变更手续。前述变更完成后，惠友豪创的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	深圳市惠友创盈投资管理有限公司	普通合伙人	0.01	0.00001
2	杨庆	有限合伙人	49,000.00	40.83
3	周祥书	有限合伙人	12,000.00	10.00
4	杨林	有限合伙人	10,000.00	8.33

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
5	深圳市创荟投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8,800.00	7.33
6	共青城坤翎豪创投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7,200.00	6.00
7	孙义强	有限合伙人	5,000.00	4.17
8	刘晨露	有限合伙人	5,000.00	4.17
9	深圳市伯翰创盈信息服务合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	4.17
10	深圳市瑞成永泽投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	4.17
11	深圳市创欣诚创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	4.17
12	深圳市前海君爵投资管理有限公司	有限合伙人	5,000.00	4.17
13	苏州锦天前程投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	0.83
14	深圳市新思哲投资管理有限公司	有限合伙人	1,000.00	0.83
15	刘君	有限合伙人	1,000.00	0.83
	合计	-	120,000.01	100.00

5、集创北方

根据集创北方的股东名册，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），集创北方于2021年12月16日完成增资的工商变更登记，变更后的总股数为43,106.52万股。

根据发行人的股东名册、发行人的确认，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，除上述变化外，发行人的股东未发生其他变化。本所律师认为，发行人的股东人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

六、 发行人的股本及其演变

根据发行人提供的股东名册、本所律师对发行人股东的补充问卷调查、发行人的工商档案、《公司章程》及发行人确认，并经本所律师核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人的股份结构未发生变化。

根据发行人股东的补充问卷调查确认、发行人说明，并经本所律师检索国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），截至本补充法律意见书出具日，发行人股东所持发行人的股份未设置质押。

七、 发行人的业务

（一）经营范围和经营方式

根据发行人持有的《营业执照》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人的经营方式和经营范围未发生变化。

发行人境内子公司情况详见本补充法律意见书之“九、发行人的主要财产及其变化情况”之“0 发行人的子公司”。

根据发行人及其子公司所在地工商、税务等相关政府部门出具的证明文件，并经本所律师核查，本所律师认为，发行人及其子公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规的规定，已经取得经营所需的相关业务资质及许可。

（二）境外业务

根据《三年及一期审计报告》、发行人提供的工商资料及书面确认并经本所律师核查，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人拥有 1 家境外子公司（日本晶合），主要从事集成电路设计服务及技术开发。发行人境外子公司的具体情况详见律师工作报告“十、发行人的主要财产”之“（五）发行人的子公司”。

（三）发行人的主营业务

根据《招股说明书（申报稿）》《三年及一期审计报告》，截至本补充法律意见书出具日，发行人主要从事 12 英寸晶圆代工业务。发行人的主营业务未发生变化。

（四）主要业务资质和许可

经本所律师核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人持有的辐射安全许可证、高新技术企业证书办理了更名手续，证书中的企业名称/单位名称由晶合有限变更为晶合集成，除上述变化外，发行人及其控股子公司与其主营业务相关的主要业务资质和许可未发生变化。

（五）发行人的持续经营能力

根据发行人最新的《营业执照》《三年及一期审计报告》及发行人确认，并经本所核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人依法存续，发行人的主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情况，不存在影响其持续经营的法律障碍。

（六）发行人合作研发的相关情况

根据发行人与相关合作方签订的协议和发行人书面说明，截至本补充法律意见书出具日，发行人正在从事的合作研发项目具体情况如下：

序号	合作方	合作内容	研发成果归属	合作期间	保密措施
1	合肥海图微电子有限公司	高集成度 CMOS 图像传感器设计与制造关键技术研发	项目执行过程中产生的知识产权，与制程技术、PDK 相关的知识产权归属于晶合集成，与产品设计相关的知识产权归属于海图微电子，后续基于项目所开发、修改、增进、改良、衍生或更新的相关设计及技术成果的知识产权和相应权益为各自独有	2020/10/1-2023/9/30	已签署保密协议
2	杰华特微电子（杭	150nm 高压/超高压	杰华特享有优先在发行人工艺线上联合开发 BCD 产	2020/11/01-2027/06/29	已签署保密协议

序号	合作方	合作内容	研发成果归属	合作期间	保密措施
	州)有限公司	电源管理芯片技术平台	品, 杰华特拥有项目工艺技术的独家使用权, 发行人对杰华特在本项目的器件结构、工艺流程及子流程等工艺技术严格保密, 在独家使用权期间不得将此揭露、应用于其他方, 不得对外直接、间接变相公开、转让		
3	思特威(上海)电子科技有限公司	90 纳米 CMOS 后照度图像传感器平台 (90BSI)	双方合作期间涉及的各类知识产权, 如果属于一方独立开发或拥有的, 则该部分知识产权始终为一方所专有, 另一方如需使用该部分知识产权应当事先征得一方的书面同意或授权	2020/3/20-2025/3/19	已签署保密协议
4	合作方一	150nm BCD 电源管理芯片技术平台	双方合作期间合作开发的技术和相关的信息参数仅适用于双方合作的项目, 任何其他第三方使用需要经合作方一同意	2021/3/18-2024/3/17	签署保密协议

八、关联交易及同业竞争及其变化情况

(一) 关联方

根据《公司法》《上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定, 并经本所律师核查, 截至 2021 年 6 月 30 日, 发行人的主要关联方如下:

1、发行人的控股股东、实际控制人

发行人的控股股东为合肥建投，实际控制人为合肥市国资委。合肥建投的具体情况，详见律师工作报告“六、发起人和股东”之“（五）发行人的控股股东及实际控制人”。

2、发行人的控股股东直接或间接控制的其他企业

发行人控股股东合肥建投直接或间接控制的其他企业为发行人的关联方。截至2021年6月30日，除发行人及其控股子公司以外，发行人控股股东直接或间接控制的其他主要企业如下：

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
1	合肥芯屏	2016年1月18日	合肥市包河区武汉路229号	投资管理、资产管理；投资咨询。
2	合肥蓝科	2008年11月5日	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内	项目投资；基础设施建设；自营和代理各类商品和技术进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术）；房产租赁；仓储（除危险品）物流；房地产开发及经营；科技工业园开发及管理；物业管理；酒店管理；展览展示服务；会议服务。
3	合肥燃气	1995年11月13日	合肥市蜀山区合作化南路466号	燃气生产、销售和管道输配；市政公用工程、燃气工程、供暖工程及配套工程的设计、建设、安装、维修、服务、监理、咨询；房屋建筑工程的监理及咨询；机电设备安装，装修装饰工程，土方工程，铆焊加工；燃气器具制造经营；燃气设备及智能安全家居产品生产销售与安装维修；商务信息咨询；教育信息咨询；保险信息咨询；能源项

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				目建设、开发利用、运营管理；汽车货物运输；自有房产及设备租赁。
4	合肥供水	1994年7月21日	安徽省合肥市屯溪路70号	自来水生产与供应、管道安装、水质监测、水表阀门修理、科研设计、工程监理、自有固定资产租赁。
5	百大购物	2012年6月27日	安徽省合肥市蜀山区望江西路218号	预包装食品批发兼零售（在许可证有效期内经营）；保健食品销售（李宝赢堂牌参茸酒）（在许可证有效期内经营）；日用百货、针纺织品、鞋帽、服装、五金交电、化工产品（除危险品）、文体用品、办公用品、金银珠宝玉器、家具、皮革制品、钟表眼镜、照相器材、工艺品、儿童游乐设施、通讯设备、家电、电子产品、计算机软硬件及配件、劳保用品、建材、装饰材料、儿童用品销售；卷烟零售；合肥通卡代收代付（在协议范围内经营）；物业服务；企业管理咨询；房屋租赁。
6	百大合家福	2000年6月15日	安徽省合肥市沿河路118号	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品、含散装熟食）销售、保健食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售、热食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				制售、糕点类食品制售、自制饮品制售、其他类食品制售；酒、卷烟零售、农副产品、餐饮服务（现场制售：面点、熟食、豆制品、泡菜、中餐）；农产品收购；日用百货、针纺织品、家用电器及电子产品、通讯器材销售；家具、文体用品、五金车件、化工产品（除危险品）、建筑材料、劳保用品、汽车（除小轿车）及配件、摩托车及配件、花卉、玩具、宠物用品销售、自行车、电动车、服装、黄金制品、珠宝首饰零售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定和禁止企业经营商品除外）；医疗器械销售（除国家限制项目）、音像制品、图书；儿童娱乐服务；彩扩服务；房屋租赁、场地出租（涉及许可在许可证有效期内经营）；停车场服务项目；特殊医学用途配方食品销售；网络表演；为本超市销售产品提供配送服务。
7	合肥市建设投资有限公司	1992年4月15日	合肥市滨湖新区武汉路229号	项目投资、股权投资、资产重组及并购（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房屋租赁。
8	合肥市交通投资控股有	2004年2月11日	安徽省合肥市梅山路77号	公路项目建设、营运、收费、咨询及服务；城乡交通基础设施及相关

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
	限公司			产业的投资与运营；营运授权范围内的国有资产；按照法定程序处置、租赁所属企业土地和房屋资产；国内广告制作、代理、发布；公路服务区经营、策划及住宿、餐饮服务；车辆救援服务及汽车维修；交通工程物资销售；道路普通货运；仓储服务；实业投资；旅游项目的投资开发。
9	合肥城建投资控股有限公司	2001年12月6日	合肥市滨湖区武汉路229号	城市建设项目开发和经营，房地产综合开发，对项目和企业进行投资，参股和收购，物资贸易，房屋租赁。
10	合肥百货大楼集团股份有限公司	1996年7月29日	安徽省合肥市长江中路150号	预包装食品、酒、乳制品销售，烟、西药制剂及中成药零售，汽车运输，土产品、纺织品、服装、工艺美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品、针织品、家具、食用农产品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售及为网上销售提供服务，自制饮品销售，糕点类食品制售，保健食品、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、音像制品、书刊、电子出版物及设备的零售，接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务，进出口业务，黄金饰品零售及修旧改制，服装、鞋帽、塑料制品

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				加工，房屋租赁，玩具及轨道赛车服务，餐饮、停车服务。
11	合肥丰乐种业股份有限公司	1997年4月16日	合肥市蜀山区创业大道4号	农作物种子、种苗生产、销售；大米、芝麻、棉花生产、销售；肥料销售；农药、专用肥、植物生长素、食用香料香精、薄荷脑及薄荷油、茶叶生产、销售；粮食作物、油料作物种植、储藏、运输、销售；农副产品及其深加工产品、花卉、包装材料生产、销售；农业高新技术开发及成果转让；农业技术咨询、技术服务；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；农业机械类产品的出口和种子的进出口业务。
12	合肥科融高科技产业投资有限公司	2009年11月10日	安徽省合肥市滨湖新区武汉路229号	高科技产业风险投资，企业参股、并购及重组，项目投资及运营，股权管理。
13	合肥市轨道交通集团有限公司	2009年6月2日	安徽省合肥市阜阳路17号	城市轨道交通系统项目策划、投资、建设、运营、管理及资源开发；系统设备租赁、销售；轨道交通沿线及相关地区、地下空间资源开发及管理；物业管理；酒店管理；城市基础设计及咨询；代理设计、制作、发布国内广告。
14	合肥金太阳能源科技股	2010年12月30日	安徽省合肥市高新区黄山路630	大中型光伏并网电站、小型并（离）网光伏发电系统、光伏建筑

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
	份有限公司		号	一体化项目勘测设计、施工安装、工程总承包服务、运营管理；系统集成；技术咨询。
15	合肥文旅博览集团有限公司	2002年4月30日	安徽省合肥市政 务文化新区习友 路988号	高端现代服务业投融资平台研发；文化体育产业策划、投资、运营管理；旅游产业策划、投资、运营管理；会展场馆运营、展会开发、广告搭建及展会综合配套服务；酒店投资运营及受托管理；餐饮管理；物业管理；教育投资及咨询；大健康产业、休闲养老产业投资建设运营管理；公益设施、基本建设项目开发、经营、融资管理；资产经营管理；投资管理；房地产综合开发、销售；供应链管理；电子商务、农业支撑服务；中介服务；房屋、停车场租赁、管理；企业管理咨询；信息技术咨询。
16	合肥市水务环境建设投资有限公司	2000年8月8日	安徽省合肥市包 河区包河大道 398号A座1-7 楼	水务和环境项目的投资、建设、运营、管理；承担政府性项目的投资、融资、委托代建、运营和管理任务；受政府委托从事土地一级开发，土地收储、拆迁、整理、基础配套等熟化工作；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；对全资、控股、参股企业行使

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				出资者权利；房屋租赁；承担市政府授权的其他工作。
17	合肥通航控股有限公司	2015年10月19日	合肥市包河区徽州大道1号骆岗机场	机场运营、资产管理、设备维修、物业管理、企业管理、投资咨询、企业策划、航空投资、计算机系统集成、数据处理。
18	建投资本	2016年1月11日	合肥市包河区武汉路229号	投资管理、资产管理。
19	合肥市乡村振兴投资有限责任公司	2013年1月9日	安徽省合肥市包河区包河大道398号建投综合办公区A座8-9楼	农业、文化旅游产业项目投资及运营管理；农村基础设施建设及人居环境建设；乡村旅游开发；特色小镇开发及田园综合体开发；农产品生产种植与销售；城市基础设施建设；土地整治；土地储备业务。
20	安徽环巢湖生态发展有限公司	2004年10月18日	安徽省巢湖市巢庐路（原东庵林场）	生态产业投资与建设，休闲旅游产业、文化旅游产业的投资与运营，旅游景区的开发、建设、运营，旅行社、旅游交通服务，文化演艺与婚庆、展览服务，旅游商品开发与销售，酒店管理，物业管理，会议、培训服务，旅游策划与管理咨询，文化体育运动的组织与服务。
21	合肥市电动汽车充电设施投资运营有限公司	2015年2月15日	合肥市蜀山区合作化南路466号燃气大厦22-24层	各类工程建设活动；电气安装服务；供电业务；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试。以自有资金从事投资活动；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；新

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；汽车租赁；信息系统集成服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；软件开发；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；品牌管理；充电桩销售；电气设备修理；专用设备修理；停车场服务。
22	合肥市综合管廊投资运营有限公司	2016年12月23日	合肥市包河区武汉路229号建投大厦	各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电气安装服务。市政设施管理；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；工程技术服务；工程管理服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动。
23	合肥融科项目投资有限公司	2010年11月11日	合肥市新站区大禹路与东方大道交口西北角合肥综合保税区进口商品展示中心大楼12-14层	项目投资。
24	合肥市引江济淮投资有限公司	2017年8月30日	安徽省合肥市经济技术开发区九龙路118号	引江济淮主体工程沿线土地、岸线、水资源、生态旅游综合开发和经营；产业投资、项目建设、项目

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				管理与运营；股权投资；文化旅游、休闲、养老、健康产业的物业投资、管理。
25	合肥市建庐建设投资有限公司	2017年12月21日	合肥市庐江县庐城镇晨光路17号东方水岸写字楼15层	县域基础设施项目投资、建设、运营和管理。
26	安徽中安智通科技股份有限公司	2015年12月16日	合肥市包河区常青街道姚公社居委南屏路555号	城市智能交通系统设计施工、产品研发、技术服务和销售；城市交通项目投资；交通设施和器材的研发、设计、制作、安装及维护维修；机械式立体停车设备、智能车位引导等自动化控制系统及系统集成的研发设计、生产制造销售、技术服务；停车场相关设计施工、技术服务、管理服务；软件开发；广告发布、传媒灯箱、信息咨询服务；住房及商用房租赁；物业管理。
27	合肥市住房租赁发展股份有限公司（以下简称合肥租赁）	2020年5月18日	安徽省合肥市蜀山区长江西路460号合房租赁办公区	住房租赁，商业房产运营，房地产开发、咨询、代理、经纪，房屋建筑工程施工，室内外装饰工程设计施工，酒店管理，物业管理，停车场（库）运营，户外广告、道路绿化及工程施工咨询，家具及家用电器用品出租服务，计算机和网络安全技术服务，互联网信息服务。

此外，过去 12 个月内发行人控股股东直接或间接控制的其他企业亦为发行人的关联方。

3、发行人的控股子公司

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人在中国境内拥有 2 家控股子公司，在中国境外拥有 1 家控股子公司。上述公司的具体情况，详见律师工作报告“十、发行人的主要财产”之“（五）发行人的子公司”。

4、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

发行人现任董事、监事、高级管理人员以及过去 12 个月内曾经担任发行人董事、监事、高级管理人员的人员构成发行人关联方，上述人员的具体情况，详见律师工作报告“十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”及本补充法律意见第一部分之“十四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”。此外，与上述人员关系密切的家庭成员亦构成发行人的关联方。

5、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者由前述人员（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者除独立董事外的前述人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织的情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	智慧记忆科技股份有限公司	蔡国智担任董事
2	Xsense Technology Corporation	蔡国智担任董事
3	合肥建投	陆勤航担任董事兼总经理、黄颢担任董事兼副总经理
4	启迪控股股份有限公司	陆勤航担任董事
5	建投资本	黄颢担任董事
6	合肥德轩投资管理有限公司	黄颢担任董事

序号	关联方名称	关联关系说明
7	合肥京东方显示技术有限公司	黄颢担任董事长
8	合肥市信实产业投资基金（有限合伙）	黄颢担任执行事务合伙人委派代表
9	合肥奕斯伟封测控股有限公司	黄颢担任董事
10	合肥硕中封测技术有限公司	黄颢担任董事
11	合肥维信诺科技有限公司	黄颢担任董事
12	蔚来控股有限公司	黄颢担任董事
13	启迪新基建产业（合肥）集团有限公司	黄颢担任董事
14	合肥德电新能源汽车股份有限公司	黄颢担任董事
15	合肥神州数码信创控股有限公司	黄颢担任董事
16	智丰科技股份有限公司	郑素芬担任总经理
17	新相科技股份有限公司	郑素芬担任董事长
18	顺立投资股份有限公司	郑素芬担任董事
19	瑞相科技股份有限公司	郑素芬担任董事
20	晶相光电股份有限公司	郑素芬担任董事
21	力相光学股份有限公司	郑素芬担任董事
22	宏丽数位创意股份有限公司	郑素芬担任董事
23	智合精准医学科技股份有限公司	郑素芬担任董事
24	智成电子	郑素芬担任董事
25	景睿科技股份有限公司	郑素芬担任董事
26	力晶微元科技股份有限公司	郑素芬担任董事长
27	智仁科技开发股份有限公司	郑素芬担任董事
28	英达投资股份有限公司	胡竞英担任董事长且控制
29	疯狂秀股份有限公司	胡竞英担任董事
30	中兴农林开发股份有限公司	胡竞英担任董事
31	合富润生企业管理咨询（上海）有限公司	胡竞英担任董事
32	合润生活国际有限公司	胡竞英担任董事
33	益宠生医股份有限公司	胡竞英担任董事

此外，过去 12 个月内发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者除独立董事外的前述人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织亦为发行人的关联方。

6、直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织

截至 2021 年 6 月 30 日，除合肥建投以外，直接持有发行人 5%以上股份的股东为合肥芯屏、力晶科技、美的创新。

美的集团直接持有美的创新 70%的股权，并通过全资子公司佛山市美的空调工业投资有限公司间接持有美的创新 30%的股权，亦系发行人的关联方。

7、直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织

截至 2021 年 6 月 30 日，直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织包括：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	力信投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
2	世仁投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
3	富硕投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
4	智典国际股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
5	世成科技股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
6	智仁科技开发股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
7	智慧记忆体科技股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
8	Deutron Japan Corp.	力晶科技直接或间接控制
9	智翔投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
10	智成电子	力晶科技直接或间接控制
11	力相光学股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
12	广东美云智数科技有限公司	美的创新直接或间接控制
13	深圳数智场景定位科技有限公司	美的创新直接或间接控制

序号	关联方名称	关联关系说明
14	上海美仁半导体有限公司	美的创新直接或间接控制

此外，过去 12 个月内直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织亦为发行人的关联方。

8、直接控制上市公司的法人的董事、监事、高级管理人员及其控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

(1) 直接控制发行人的法人的董事、监事、高级管理人员

直接控制发行人的法人为合肥建投，截至 2021 年 6 月 30 日，合肥建投的董事、监事、高级管理人员及其控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织如下：

序号	关联方姓名	关联关系说明
1	李宏卓	合肥建投董事长
2	陈小蓓	合肥建投董事
3	陆勤航	合肥建投董事兼总经理
4	黄颢	合肥建投董事兼副总经理
5	倪敬东	合肥建投董事
6	吴子能	合肥建投董事
7	杨雪蕾	合肥建投董事
8	黄跃明	合肥建投监事
9	杨国庆	合肥建投监事
10	范红金	合肥建投监事
11	田胜彬	合肥建投监事
12	朱庆	合肥建投监事
13	罗文萍	合肥建投高级管理人员

过去 12 个月内曾经担任合肥建投董事、监事、高级管理人员的人员构成发行人关联方。

(2) 前述关联自然人直接或者间接控制的法人或其他组织

前述关联自然人中，陆勤航、黄灏亦系发行人董事。除陆勤航、黄灏外，其他关联自然人控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	合肥维信诺科技有限公司	李宏卓担任董事长
2	建投资本	李宏卓担任董事长，陈小蓓、罗文萍担任董事
3	合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
4	合肥芯屏	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
5	合肥新站高新创业投资合伙企业（有限合伙）	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
6	合肥市乡村振兴产业投资合伙企业（有限合伙）	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
7	合肥市大数据资产运营有限公司	陈小蓓担任董事
8	合肥通航控股有限公司	陈小蓓担任董事
9	安徽省合肥联合发电有限公司	陈小蓓担任董事
10	合肥高特佳创业投资有限责任公司	陈小蓓担任董事
11	合肥百货大楼集团股份有限公司	陈小蓓担任董事
12	合肥丰乐种业股份有限公司	陈小蓓担任董事
13	合肥市水务环境建设投资有限公司	吴子能担任董事长
14	合肥市铭城建设发展有限公司	吴子能担任董事长
15	合肥市环巢湖建设发展有限公司	吴子能担任董事长
16	合肥泽众城市智能科技有限公司	吴子能担任副董事长
17	安徽庐铜铁路有限公司	吴子能担任副董事长
18	铜陵江北港铁路专用线有限责任公司	吴子能担任副董事长
19	合肥新桥国际机场有限公司	吴子能担任副董事长
20	合肥龙和投资咨询有限公司	黄跃明担任董事兼总经理

序号	关联方名称	关联关系说明
21	合肥科融高科技产业投资有限公司	黄跃明担任执行董事兼总经理
22	合肥二号线轨道交通有限公司	田胜彬担任董事
23	合肥市建庐建设投资有限公司	田胜彬担任董事长
24	合肥建翔投资有限公司	田胜彬担任董事
25	合肥市建设投资有限公司	罗文萍担任执行董事兼总经理
26	合肥市乡村振兴投资有限责任公司	杨雪蕾担任执行董事

除此之外，前述关联自然人过去 12 个月内曾经担任董事、高级管理人员的法人或其他组织亦为发行人的关联方。

9、其他关联方

除上述关联方外，发行人的其他关联方还包括其他根据《上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定认定的关联方。

10、关联方信息披露

根据发行人的书面说明，并经本所律师核查，发行人已在《招股说明书（申报稿）》中按照《公司法》《企业会计准则》和中国证监会的相关规定认定并披露关联方。

11、注销或转让重要关联方

根据发行人控股股东填写的调查表和发行人的书面说明，并经本所律师核查，报告期内，发行人不存在注销或转让的子公司，亦不存在与发行人存在关联交易的关联方注销或转让的情形。

(二) 关联交易

根据《三年及一期审计报告》和发行人书面说明，并经本所律师核查，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，发行人与关联方发生的关联交易情况如下：

1、向关联方采购商品及接受服务

报告期内，发行人向关联方采购商品及接受服务的相关情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年1-6月	
		金额	占比
合肥燃气	采购燃气	236.11	0.21%
合肥供水	采购厂区用水	235.92	0.21%
智成电子	采购服务	243.81	0.21%
合肥租赁	房屋租赁	71.40	0.06%
关联采购合计		787.23	0.69%

2021年1月1日至2021年6月30日期间，发行人向合肥供水、合肥燃气采购厂区用水、燃气的价格与合肥供水、合肥燃气向第三方销售的价格一致；发行人向智成电子采购服务为授权许可知识产权（IP），双方定价模式与发行人与其他同类供应商的定价模式一致，且价格处于同类供应商报价范围区间内。

综上，本所认为，发行人与关联方之间的上述关联交易价格公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

2、向关联方销售商品及提供服务

2021年1月1日至2021年6月30日期间，发行人未向关联方销售商品及提供服务。

3、关联租赁

发行人因经营需要向关联方合肥蓝科租赁土地、厂房及厂务设施，均位于安徽省合肥市瑶海区综合保税区内西淝河路88号，为发行人的注册地及主要办公场所。

发行人于2021年1月1日实施新租赁准则，按照新租赁准则相关要求，发行人将上述租入的土地、厂房及配套厂务设备调整计入使用权资产，相关负债调整计入租赁负债，发行人2021年度与土地、厂房及配套厂务设备相关的租赁负债增减变动情况列示如下：

单位：万元

关联方	2020年 12月31日	会计政策变 更	2021年 1月1日	本期增加	本期减少	2021年 12月31日
合肥蓝科	-	188,444.99	188,444.99	174,353.91	16,349.88	346,449.02

本所认为，合肥蓝科系依据合肥市人民政府相关政策向公司出租厂房，租赁价格虽低于市场价格，但公司已按照相应会计准则进行会计处理，该等关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

4、关联担保情况

截至2021年12月31日，发行人接受关联方担保的情况如下：

单位：万元

担保方	出借人	借款余额（含 一年内到期的 长期借款）	借款日期	到期日	担保是否 已经履行 完毕	是否提 供反担 保
合肥建投	华泰资产	130,000.00	2018/9/28	2028/9/27	否	是
		30,000.00	2018/10/30	2028/10/29	否	是
		42,000.00	2018/11/8	2028/11/7	否	是
		90,000.00	2019/7/18	2029/7/17	否	是
		8,000.00	2019/8/29	2029/8/28	否	是
	平安银行合 肥分行	78,740.00	借款发放日	2027/10/10	否	是
	兴业银行合 肥分行	16,806.00	借款发放日	2028/1/7	否	是
		47,000.00	借款发放日	2027/10/10	否	是
	中国银行北 城支行	67,397.69	借款发放日	2028/1/15	否	是
		23,170.73	2021/3/19	2027/10/10	否	是

截至2021年12月31日，根据发行人与合肥市建设投资控股（集团）有限公司签订的《反担保合同》及《反担保合同补充协议》，发行人已就合肥市建设投资控股（集团）有限公司为发行人上述借款的担保提供反担保。

2021年7月1日，发行人与合肥市建设投资控股（集团）有限公司签订《动产浮动抵押合同》，约定合肥市建设投资控股（集团）有限公司对于发行人所有的晶合一期5万片月产能所对应的机器设备及原物料中海关监管期限已届满的部分有权变卖处分和优先受偿，对于抵押人其余在海关监管期限内的机器设备及原物料，在海关监管期限届满后合肥市建设投资控股（集团）有限公司自动享有前述权利。

2021年8月5日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司对本公司所有的海关监管期限届满的部分机器设备办理了抵押登记，已办理抵押登记的机器设备于2021年12月31日的账面原值、累计折旧及账面价值如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
机器设备	330,178.75	132,341.26	197,837.49

5、关联方资金拆借

2021年度，发行人未发生与关联方资金拆借的情形。

6、关键管理人员薪酬

2021年度，发行人向关键管理人员支付薪酬，关联交易金额为2,168.94万元。

7、关联方往来余额

（1）应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2021年12月31日	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	李洳谕	1.16	-
其他应收款	合肥燃气	40.00	-
其他应收款	智成电子	0.06	0.003
其他应收款	合肥租赁	21.90	-

（2）应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2021年12月31日
其他应付款	蔡辉嘉	0.51
其他应付款	周义亮	0.10
其他应付款	简瑞荣	0.38
其他应付款	邱显寰	0.34
其他应付款	蔡国智	0.17
其他应付款	合肥蓝科	129.91
	晶相光电	1,821.97
应付账款	合肥燃气	57.90
应付账款	智成电子	583.47
租赁负债	合肥蓝科	184,856.98

根据《三年及一期审计报告》、发行人相关会议资料、发行人的书面说明，并经本所律师核查，上述报告期内发生的发行人关联方与发行人所发生的关联交易，交易价格及条件均符合公允原则，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（三）同业竞争

截至本补充法律意见书出具日，发行人从事 12 英寸晶圆代工业务。根据合肥建投提供的对外投资企业清单并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统、天眼查网站等方式进行核查，合肥建投除投资发行人外，未控制其他从事晶圆代工业务的公司，合肥建投及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争。

（四）发行人对关联交易和同业竞争事项的披露

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人已在《招股说明书（申报稿）》中对有关减少和规范关联交易的措施及避免同业竞争的承诺进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

九、发行人的主要财产及其变化情况

（一）土地使用权和房屋所有权变化情况

1、自有物业

截至本补充法律意见书出具日期间，发行人无自有物业。

2、租赁物业

经发行人确认并经本所律师核查发行人及其子公司的租赁协议及租赁物业产权证明，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司承租用于办公、生产经营的房产共计 3 处，面积合计约 215,654.47 平方米，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积 (m ²)	租赁期限	用途
1	晶合集成	合肥蓝科	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号	215,270.61	2017 年 6 月 28 日至 2037 年 6 月 27 日	生产办公
2	上海晶合	上海莘泽创业投资管理股份有限公司	上海市张江高科技园区盛夏路 608 号 2 幢 5 层 502 室	141.15	2019 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日	办公
3	日本晶合	マスター・プロパティーズ株式会社	東京都立川市曙町一丁目 13 番 11 号	242.71	2016 年 11 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日	办公
4	晶合集成	深圳市唐庄实业有限公司	深圳市福田区深南西路车公庙工业区	130.96	2021 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日	办公

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人不存在租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产的情形。

（二）在建工程

根据《三年及一期审计报告》《招股说明书（申报稿）》以及发行人书面说明，截至本补充法律意见出具日，发行人的在建工程主要为公司新购置待安装机台设备。截至 2021 年 6 月 30 日，发行人在建工程的账面余额为 132,959.17 万元。

（三）商标、专利等无形资产变化情况

1、注册商标

根据发行人提供的《商标注册证》、商标注册代理机构出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于中国境外注册商标相关事宜的确认函》、国家知识产权局出具的《商标初步审定公告》，并经本所律师核查，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司共拥有 108 项注册商标，其中，在中国境内注册的商标 17 项，在中国境外注册的商标 91 项，该等商标的具体情况详见本补充法律意见书附件。

2、注册专利

根据发行人提供的专利证书等相关文件、专利注册代理机构出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于中国境外注册专利相关事宜的确认函》、国家知识产权局查询结果并查询国家知识产权局综合服务平台专利检索及分析系统（<http://pss-system.cnipa.gov.cn>），并经本所律师核查，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司在中国境内共拥有 163 项已授权专利，在中国境外共拥有 55 项已授权专利。该等专利注册的具体情况详见本补充法律意见附件。

3、互联网域名

截至 2021 年 6 月 30 日，根据发行人提供的域名证书，并经本所律师核查工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统（<http://beian.miit.gov.cn>），发行人及其子公司合法拥有 1 项注册域名。该等域名的具体情况如下：

序号	注册域名	注册所有权人	注册日期	到期日期
1	nexchip.com.cn	晶合集成	2015 年 9 月 16 日	2023 年 9 月 16 日

4、发行人使用的授权许可知识产权（IP）

截至 2021 年 6 月 30 日，公司正在使用的授权许可知识产权（IP）情况如下：

序号	许可方	授权许可内容	合同定价依据	有效期限
1	美商矽成积体电路股份有限公司	110纳米嵌入式闪存技术	开发服务费用	2019年1月31日-2025年1月30日
2	円星科技股份有限公司	90纳米编译器IP	开发服务费及权利金	2019年1月25日-2022年1月24日
		150纳米标准单元库	开发服务费及权利金	2019年1月25日-2022年1月24日
		150纳米标准单元库	开发服务费及权利金	2019年10月16日-2022年10月15日
		90纳米编译器IP	开发服务费及权利金	2020年4月1日-2023年3月31日
		90纳米编译器IP	开发服务费及权利金	2019年10月16日-2022年10月15日
3	力旺电子股份有限公司	单次可编程IP	设计服务费及权利金等	2019年1月25日-2024年1月24日
		单次可编程（反熔丝）IP	设计服务费及权利金等	2018年7月15日-2021年7月14日
		单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2019年1月25日-2024年1月24日
		单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2020年8月18日-2025年8月17日
		单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2021年3月3日-2026年3月2日
		单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2020年10月12日-2025年10月11日

序号	许可方	授权许可内容	合同定价依据	有效期限
		单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2021年3月2日-2026年3月1日
		单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2021年5月10日-2026年5月9日
		单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2021年6月18日-2026年6月17日
4	智成电子	110纳米标准单元库	量产权利金	2020年1月1日-2022年12月31日
5	寅通科技股份有限公司	80纳米集成电路IP	技术开发费及量产权利金	2019年3月8日-2024年3月7日
		90纳米集成电路IP	技术开发费及量产权利金	2019年4月1日-2024年3月31日
		集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2019年4月1日-2024年3月31日
		110纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2019年7月18日-2024年7月17日
		55纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2019年10月25日-2024年10月24日
		集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2018年2月28日-2023年2月27日
		110纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2018年5月22日-2023年5月21日
		90纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2018年6月11日-2023年6月10日
		55纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2020年4月15日-2025年4月14日
		110纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2020年9月1日-2025年8月31日

序号	许可方	授权许可内容	合同定价依据	有效期限
		90纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2021年6月15日-2026年6月14日
6	亿而得微电子股份有限公司	多次可编程电路模块	产品开发费用、权利金	2019年7月19日-2024年7月18日
		集成电路模块	产品开发费用、权利金	2017年11月1日-2023年10月31日
7	成都锐成芯微科技股份有限公司	110纳米低功耗嵌入式存储工艺平台模拟IP	技术秘密使用费，并根据实际发生金额结算、支付版税费用	2020年4月1日-2030年3月31日
		110纳米多次可编程电路	技术秘密使用费，并根据实际发生金额结算、支付版税费用	2020年4月1日-2030年3月31日
		90纳米多晶硅熔丝IP	支付版税费用	2021年5月10日-2030年5月9日
		150纳米多晶硅熔丝IP	支付版税费用	-
8	珠海创飞芯科技有限公司	110单次可编程（反熔丝）技术	授权产品的使用提成费用	2021年6月1日起至达成新协议前永久有效

(四) 主要生产经营设备

根据《三年及一期审计报告》、重大生产经营设备的购置合同、履行凭证及发行人说明，发行人的主要生产经营设备包括机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等。截至2021年6月30日，机器设备的账面价值为971,757.33万元、电子设备及其其他的账面价值为7,331.34万元、运输工具的账面价值为0.21万元。

(五) 发行人的子公司

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自《法律意见书》出具日至本补充法

律意见书出具日期间，发行人子公司北京晶芯成、南京晶驱、日本晶合的基本情况未发生变化。发行人新增一家境内控股子公司合肥新晶集成电路有限公司（以下简称新晶集成），具体情况如下：

发行人持有新晶集成 100% 股权，新晶集成为发行人全资子公司。根据合肥市新站区市场监督管理局 2021 年 9 月 6 日向新晶集成核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340100MA8N4PFB89），新晶集成的基本情况如下表所示：

公司名称	合肥新晶集成电路有限公司
住所	合肥市新站区综合保税区内西淝河路 88 号
法定代表人	周义亮
注册资本	400,000 万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注：2021 年 12 月 20 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于新晶集成增资扩股案的议案》，新晶集成拟引入外部投资人筹集资本金。截至本补充法律意见出具日，发行人正在与投资人谈判沟通，尚未签署增资协议。

（六）主要财产所有权或使用权的受限制情况

根据发行人提供的相关债权合同、担保合同、不动产登记簿、经本所律师核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人及其子公司主要财产存在权利受限的情况未发生重大改变。

十、发行人的重大债权债务变化情况

根据发行人的说明，并经本所律师核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人的重大债权债务变化情况如下：

（一）重大合同的变化情况

根据发行人确认并经本所律师核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间新增的对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同如下：

1、销售合同

根据发行人提供的相关文件及说明，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人及其子公司与报告期各期前五大的客户签署的正在履行的或已经履行完毕的合同或各期金额最高的订单情况如下：

序号	供应主体	客户	有效期/订单日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
1	晶合集成	集创北方	2021/05/12-2023/12/31	150nm、110nm、90nm、55nm 晶圆代工产能预约	71,935.55 万元产能预约金	正在履行
2	晶合集成	敦泰电子股份有限公司	2021/05/23-2023/12/31	110nm、90nm、55nm 晶圆代工产能预约	1,990.50 万美元产能预约金	正在履行
3	晶合集成	深圳天德钰科技股份有限公司	2021/05/12-2023/12/31	150nm、110nm、90nm、55nm 晶圆代工	11,847.79 万元产能预约金	正在履行
4	晶合集成	天钰科技股份有限公司	2021/05/12-2023/12/31	150nm、110nm、90nm、55nm 晶圆代工	3,171.12 万美元产能预约金	正在履行
5	晶合集成	奕力科技股份有限公司	2021/5-2023/12/31	150nm、110nm、90nm、55nm 晶圆代工	7,834 万美元产能预约金	正在履行
6	晶合集成	联咏科技股份有限公司	2021/04/01-2023/03/31	晶圆代工服务及晶圆产品	/	正在履行

序号	供应主体	客户	有效期/订单日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
7	晶合集成	联咏科技股份有限公司	2021/05/21-2021/12/31	90nm TDDI、90nm 其他、150nm LDDI	606 万美元产能预约金	正在履行
8	晶合集成	联咏科技股份有限公司	2021/06/02-2023/12/31	150nm、90nm 产能	14,860.80 万美元产能预约金	正在履行
9	晶合集成	奇景光电股份有限公司	2021/05/23-2023/12/31	150nm、110nm 晶圆代工	2,520 万美元产能预约金	正在履行

2、采购合同

根据发行人提供的相关文件及说明，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人及其子公司与报告期各期前五大原材料供应商签署的正在履行的正在履行的或已经履行完毕的合同或各期金额最高的采购订单情况如下：

序号	采购主体	供应商	签订日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
1	晶合集成	环球晶圆股份有限公司	2021/06/01	2022、2023 年硅晶圆产能	2,772 万美元预付款	正在履行
2	晶合集成	环球晶圆股份有限公司	2021/06/07	2022 至 2024 年 12 吋磊晶硅晶圆产能	550.80 万美元预付款	正在履行
3	晶合集成	Applied Materials South East Asia Pte. Ltd	2021/05/25	零部件	33.58 万美元	已履行
4	晶合集成	Wah Lee Industrial	2021/01/26	化学品	70.49 万美元	已履行

序号	采购主体	供应商	签订日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
		Corp.			元	
5	晶合集成	Rohm and Haas Electronic Materials CMPAsica Inc.	2021/06/24	化学品	349.07 万美元	正在履行
6	晶合集成	Siltronic Singapore Pte.Ltd	2021/03/16	硅晶圆	270 万美元	已履行

3、借款合同

根据发行人提供的相关文件及说明，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司正在履行及已履行完毕的授信、借款及担保合同如下：

序号	借款人/额度申请人	贷款人/额度授予人	签订日期	合同金额	贷款/授信期限	目前履行情况	担保情况
1	晶合有限	平安银行合肥分行	2017/04/11	50 亿元授信	2017/04/11-2027/04/10	正在履行	合肥建投为 50 亿授信中的 11 亿元提供担保
2	晶合有限	平安银行合肥分行	2018/02/24	11 亿元借款	120 个月	正在履行	
3	晶合集成	平安银行合肥分行	2021/03/19	5 亿元借款	2021/04/01-2027/10/10	正在履行	合肥建投提供最高额为 8.5 亿元的担保
4	晶合集成	平安银行合肥分行	2021/06/09	3.5 亿元借款	2021/06/15-2027/10/10	正在履行	
5	晶合有限	兴业银行合肥分行	2017/05/18	5 亿元授信	2017/05/18-2018/05/17	已履行	合肥建投提供最高

序号	借款人/额度申请人	贷款人/额度授予人	签订日期	合同金额	贷款/授信期限	目前履行情况	担保情况
6	晶合有限	兴业银行合肥分行	2020/11/17	11.68 亿元 授信	至 2021/03/04	已履行	额为 7 亿元的担保
7	晶合有限	兴业银行合肥分行	2018/01/08	7 亿元借款	2018/01/08- 2028/01/07	正在履行	
8	晶合集成	兴业银行合肥分行	2021/04/01	5 亿元授信	2021/04/01- 2021/10/29	已履行	
9	晶合集成	兴业银行合肥分行	2020/10/30	3 亿元授信	2020/10/30- 2021/10/29	已履行	-
10	晶合有限	中国银行北城支行	2017/11/14	7 亿元授信	生效之日起 至 2018/09/21	已履行	合肥建投提供担保
11	晶合有限	中国银行北城支行	2017/11/14	7 亿元借款	实际提款日 起 120 个月	正在履行	
12	晶合集成	中国银行北城支行	2021/03/17	2.5 亿元借 款	实际提款日 起 80 个月	正在履行	
13	晶合有限	中国银行北城支行 (受合肥建投委托提供贷款)	2018/04/28	8.05 亿借 款	提款日起 6 个月	已履行	-
14	晶合有限	华泰资产管理有限 公司	2018/08/20	不超过 30 亿投资本金	10 年	正在履行	合肥建投提供担保
15	晶合集成	中国光大 银行股份 有限公司	2021/03/22	2 亿元授信	2021/03/23- 2024/03/22	正在履行	-

序号	借款人/额度申请人	贷款人/额度授予人	签订日期	合同金额	贷款/授信期限	目前履行情况	担保情况
		合肥分行					
16	晶合集成	合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	2021/02/10	2 亿元授信	2021/02/10-2022/01/05	正在履行	-
17	晶合集成	招商银行股份有限公司合肥分行	2021/06/09	3 亿元授信	2021/06/09-2022/06/08	正在履行	-

4、对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的其他合同

除本节之“（一）重大合同”之“1、销售合同”已披露的合同外，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人签订的产能预约金金额前五大的合同如下：

（1）2021 年 6 月 1 日，发行人同成都爱旗科技有限公司签订《2022-2023 产能预约合同》，约定发行人为成都爱旗科技有限公司预留 150nm 产能，合同期限为 2021 年 6 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（2）2021 年 6 月 10 日，发行人同客户一签订《2022-2023 150nm BCDAE(MTK M153)合同》，约定发行人为客户一预留并投入 150nm BCDAE(MTK M153)晶圆 2022 年及 2023 年产能，合同期限为 2021 年 6 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日。

（3）2021 年 5 月 26 日，发行人同思特威签订《2022-2023 产能预约合同》，约定发行人为思特威预留相关晶圆代工产能，合同期限为 2021 年 5 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。

(4) 2021年5月31日，发行人同客户二签订《2022-2023产能预约合同》，约定发行人为客户二预留110nm产能，合同期限为2021年5月31日至2023年12月31日。

(5) 2021年5月12日，发行人同客户三签订《2022-2023产能预约合同》，约定发行人为客户三预留150nm产能，合同期限为2021年5月12日至2023年12月31日。

(二) 合同主体及合同的履行

上述适用中国法律的重大合同内容和形式不违反中国法律、行政法规的禁止性规定，发行人及其子公司作为上述适用中国法律的重大合同的主体，继续履行该等合同不存在实质性法律障碍。

(三) 侵权之债

根据发行人说明、相关工商行政管理部门、人事劳动社会保障部门、税务部门等出具的证明，经本所律师在发行人及其子公司相关主管部门政府网站核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人及其子公司报告期内没有因知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

(四) 发行人与关联方之间的重大债权债务关系及相互提供担保情况

根据《三年及一期审计报告》并经本所律师核查，截至报告期末，除本补充法律意见第一部分“八、关联交易及同业竞争及其变化”及“十、发行人的重大债权债务变化情况”所述之外，发行人与其关联方之间不存在其他重大债权债务关系，亦不存在其他相互提供担保的情况。

(五) 发行人的其他应收、应付款

根据《三年及一期审计报告》并经本所律师核查，本期间内，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款是因正常的经营及投资活动发生，合法有效。

十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并

根据发行人的说明并经本所律师核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人无重大资产收购、出售或拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十二、 发行人公司章程的制定与修改

根据发行人提供的《公司章程》、工商登记资料、股东大会会议文件及发行人说明，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>），自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日，《公司章程》及《发行人章程》未进行修改。

十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

根据发行人确认，并经本所律师核查发行人会议资料，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间：

（一）发行人的组织结构没有发生变化；

（二）发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则内容没有发生变化；

（三）发行人共召开了 2 次股东大会、5 次董事会会议，未召开监事会会议，主要情况如下：

1、根据发行人提供的股东大会会议决议、会议记录、会议通知等相关文件，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人共召开了 2 次股东大会，其主要情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间
1	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 8 月 27 日
2	2021 年第二次临时股东大会	2021 年 12 月 20 日

2、根据发行人提供的董事会会议决议、会议记录、会议通知等相关文件，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人共召开了 5 次董事会，其主要情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间
1	第一届董事会第五次会议	2021年5月26日
2	第一届董事会第六次会议	2021年8月12日
3	第一届董事会第七次会议	2021年10月11日
4	第一届董事会第八次会议	2021年11月30日
5	第一届董事会第九次会议	2021年12月28日

经本所律师核查上述会议的召开通知、会议议案、会议决议、会议记录等文件资料，本所律师认为，发行人上述股东大会、董事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

十四、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

(一) 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况

自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员范围未发生变化。经本所律师核查，发行人的董事、监事、高级管理人员任职符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 发行人董事、监事及高级管理人员变化情况

根据发行人提供的股东大会、董事会、监事会决议等相关文件，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人董事、监事、高级管理人员变化如下：

2021年11月30日，发行人召开第一届董事会第八次会议，聘任周义亮为公司副总经理。

2021年11月26日，合肥建投向晶合集成发出《关于调整晶合公司董事人选的函》，推荐陈小蓓担任公司董事，接任黄颢的董事职务。2021年12月20日，晶合集成召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于更换董事的议案》，同意选举陈小蓓为公司董事。

除上述情况，发行人董事、监事及高级管理人员未发生其他变化。

十五、 发行人的税务及其变化情况

(一) 税务登记及税种、税率

根据更新的《三年及一期审计报告》《主要税种纳税情况说明的专项审核报告》及发行人书面确认，并经本所律师核查，最近一期，发行人及境内下属企业执行的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、13%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地面积	5 元/平方米

本所律师认为，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其境内子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

(二) 税收优惠

根据《三年及一期审计报告》《2021 年半年度主要税种纳税情况专项说明》及发行人的说明，最近一期，发行人享有的税收优惠无重大变化。

(三) 财政补贴

根据《三年及一期审计报告》及发行人的说明，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，发行人及其境内控股子公司获得的与资产相关的政府补助为 3,504.14 万元，与收益相关的政府补助为 837.76 万元。

(四) 税务合规证明

2021 年 7 月 16 日，国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局向晶合集成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经征管系统查询，该纳税人自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日一直正常申报纳税，未发生违法违规等行为被税务机关处罚的情形。”

2021年7月14日，国家税务总局南京市秦淮区税务局向南京晶驱出具《涉税信息查询结果告知书》，“经税收管理系统查询，你单位2020年12月1日至2021年6月30日期间暂未发现该企业存在逾期申报等违法违规记录。”

2021年7月13日，国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所（办税服务厅）向北京晶芯成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经查询，晶芯成（北京）科技有限公司为我局登记户，该单位于2021年01月01日至2021年7月13日在我局无缴纳税款。根据税务核心系统记载，该企业在此期间未接受过行政处罚，该单位企业所得税征收方式为查账征收。”

2021年7月16日，国家税务总局上海市浦东新区税务局向上海晶合出具《税务证明》，“在2021年1月1日至2021年6月30日期间，能按税法的规定按期办理纳税申报，暂未发现有欠税、偷逃税款和重大违反税收管理法规的情形。”

（五）税务处罚

最近一期，发行人及其子公司无新增税务处罚情况。

十六、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准的变化情况

（一）环境保护

1、根据发行人说明及其提供的文件，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人及其子公司环境污染的具体环节、主要环境污染物、主要处理设施及处理能力未发生变动。

2、根据发行人说明及其提供的文件并经本所律师核查，发行人原募集资金投资项目已获得了有关环境保护主管部门关于该等项目环境影响报告书的审查批复，同意建设该等项目，具体情况如下：

2021年11月29日，合肥市生态环境局出具了《关于合肥新晶集成电路有限公司12吋晶圆制造项目环境影响报告表的批复》（环建审[2021]12064号）。

除上述情况外，《法律意见书》“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”披露的“环评批复及环保验收情况”内容未发生变动。

3、根据发行人说明并经本所律师核查，发行人募集资金投资项目已获得了有关环境保护主管部门关于该等项目环境影响报告书的审查批复，同意建设该等项目，具体

情况如下：

2021年9月15日，合肥市生态环境局出具《关于合肥晶合集成电路股份有限公司合肥晶合集成电路先进工艺研发项目环境影响报告表的批复》（环建审[2021]12048号）。

4、2021年7月12日，合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局向发行人出具《证明》，“该公司自2021年1月1日以来，未发生过环境污染事故，也未因环境违法行为受到环保行政处罚或立案调查。”

5、根据发行人确认及本所律师通过网络公开信息检索等方式核查，最近一期，发行人不存在因经营活动违反环境保护法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件而受到处罚的情况。

（二）产品质量和技术监督标准

根据发行人确认及本所律师通过网络公开信息检索等方式核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情况。

（三）安全生产

根据发行人书面说明，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，北京晶芯成、南京晶驱无实际经营，日本晶合不从事生产，不涉及安全生产相关事项，不涉及安全生产相关事项。发行人安全生产合规情况如下：

2021年7月6日，合肥市新站高新技术产业开发区应急管理局出具《关于合肥晶合集成电路股份有限公司安全生产有关情况的证明》，“自2021年1月1日至今，我局未发现合肥晶合集成电路股份有限公司在合肥新站高新技术产业开发区发生重大安全生产事故，也未因违反安全生产法律法规而受到我局安全生产行政处罚。”

根据上述安全生产监督管理部门出具的证明、发行人书面确认并经本所律师核查，发行人及其子公司的生产经营符合安全生产监督管理要求，最近三年未发生过安全生产事故，未受过安全生产方面的行政处罚。

十七、 发行人的劳动与社会保障及其变化情况

1、劳动合同

根据发行人提供的《劳动合同》模板，并经本所律师抽样核查发行人与员工签署的《劳动合同》，该等劳动合同的内容、形式符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的要求。

2、社会保险缴纳情况

根据发行人提供的统计资料及社会保险及住房公积金缴纳凭证，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其境内子公司员工共 2,051 人，已为其中 1,573 人缴纳社会保险，已为其中 1,669 人缴纳住房公积金。

发行人及其子公司未为全部员工缴纳社会保险的原因主要为（1）存在个别当月社会保险扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳社会保险；（2）在境内任职的中国台湾籍员工按照台湾地区法规缴纳了劳健保；（3）在境内任职的外籍员工未缴纳社会保险；（4）境外子公司员工遵循当地法律相关规定缴纳社会保险。

发行人及其子公司未为全部员工缴纳住房公积金的原因主要为：（1）存在个别当月住房公积金扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳住房公积金；（2）在境内任职的中国台湾籍、外籍员工未缴纳住房公积金；（3）境外子公司员工遵循当地法律相关规定无需缴纳住房公积金。

2021 年 7 月 13 日，合肥市人力资源和社会保障局出具证明：经核实，晶合集成依法足额缴纳各项社会保险费，自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 13 日未发现劳动用工违法行为，无人力资源社会保障行政部门处罚的不良记录。

2021 年 7 月 13 日，合肥市住房公积金管理中心出具证明：晶合集成自 2016 年 7 月在我中心开户缴存职工住房公积金，该公司住房公积金缴存正常，未发现违反住房公积金相关法律法规的行为，公司未因住房公积金问题而受到行政处罚。

十八、 发行人募集资金的运用

2021 年 8 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更上市募投项目的议案》，公司拟公开发行 A 股普通股股票，实际募集资金总额将视市场情况及询价确定的发行价格确定，实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	实施主体	拟使用募集资金金额
1	合肥晶合集成电路先进工艺研发项目	晶合集成	49.0
1.1	后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）	晶合集成	6.0
1.2	微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）	晶合集成	3.5
1.3	40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目	晶合集成	15.0
1.4	28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目	晶合集成	24.5
2	收购制造基地厂房及厂务设施	晶合集成	31.0
3	补充流动资金及偿还贷款	晶合集成	15.0
合计		-	95.0

发行人“合肥晶合集成电路先进工艺研发项目”的实施地点为安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号，位于发行人厂区范围内，募投项目实施相关厂房系向合肥蓝科租赁，合肥蓝科已取得相关房屋的不动产权证，具体情况如律师工作报告“十、发行人的主要财产”之“（一）土地使用权及房屋所有权”所述。

发行人“合肥晶合集成电路先进工艺研发项目”已由合肥新站高新技术产业开发区经贸局于 2021 年 8 月 20 日完成项目备案（项目代码：2108-340163-04-05-220549）。

发行人“合肥晶合集成电路先进工艺研发项目”已于 2021 年 9 月 15 日取得合肥市生态环境局出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司合肥晶合集成电路先进工艺研发项目环境影响报告表的批复》（环建审[2021]12048 号）。

本所认为，发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、投资项目管理、环境保护、土地管理及其他法律、行政法规和规章的规定。

十九、 诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况

（一）发行人及其下属公司

经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/>）、信用中国网（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、

国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、人民法院公告网（<http://rmfygg.court.gov.cn/>）、中国检察网（<http://www.12309.gov.cnajxxgk.jcy.gov.cn/12309/index.shtml>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>），访谈发行人董事、监事和高级管理人员并根据发行人书面确认，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚。

（二）持有发行人 5%以上股份的股东

根据持有发行人 5%以上股份的主要股东填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》、持有发行人 5%以上股份的主要股东出具的承诺函、境外法律意见书，并经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/>）、信用中国网（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、人民法院公告网（<http://rmfygg.court.gov.cn/>）、中国检察网（<http://www.12309.gov.cnajxxgk.jcy.gov.cn/12309/index.shtml>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，截至本补充法律意见书出具日，持有发行人 5%以上股份的主要股东不存在对晶合集成产生影响的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

根据发行人董事、监事、高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》、核心技术人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司核心技术人员调查表》，中国证监会安徽监管局诚信信息查询结果，并经本所律师查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、人民法院公告网（<http://rmfygg.court.gov.cn/>）等网站，截至本补充法律意见书出具日，发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

二十、 发行人《招股说明书（申报稿）》法律风险的评价

本所已参与《招股说明书（申报稿）》的编制和讨论，已审阅了《招股说明书（申报稿）》及其摘要，并特别审阅了其中引用《法律意见书》及本补充法律意见书的相关内容。本所认为，发行人《招股说明书（申报稿）》引用的《法律意见书》及本补充法律意见书相关内容与《法律意见书》及本补充法律意见书无矛盾之处。本所以对发行人《招股说明书（申报稿）》及其摘要中引用《法律意见书》及本补充法律意见书的相关内容无异议，确认《招股说明书（申报稿）》不致因引用《法律意见书》及本补充法律意见书的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十一、 本次发行上市的总体结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，发行人自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间内所发生的变化，不会对《法律意见书》中本所律师发表的结论意见构成影响，本所律师发表的结论意见依然有效。

第二部分 财务数据更新至 2021 年 6 月 30 日后《问询函》中涉 及的相关问题回复内容的更新

一、《问询函》第 1 题：关于实际控制人认定

根据申报材料：（1）发行人控股股东为合肥建投，直接持有发行人 31.14% 的股份，并通过合肥芯屏控制发行人 21.85% 的股份，合计控制发行人 52.99% 的股份，系发行人的控股股东。发行人实际控制人为合肥市国资委，直接持有合肥建投 100% 的股权。（2）2015 年 10 月，公司与第二大股东力晶科技签订《委托经营管理合约》，约定公司委托力晶科技进行经营管理。根据保荐工作报告，2019 年 12 月以前，发行人最高权力机构董事会，有 9 名董事。公司章程规定重大经营、财务、人事事项需 2/3 董事同意。而合肥建投占 5 席，未达 2/3。（3）目前，公司董事长蔡国智的提名人为力晶科技。

请发行人披露合肥建投能够控制合肥芯屏的原因。

请发行人说明：……（3）力晶科技是否将发行人并入合并报表；……。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见，请申报会计师对上述事项（3）进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（四）力晶科技是否将发行人并入合并报表

根据力晶科技公开披露的 2016 年至 2021 年 1-6 月的年度报告、半年度报告及审计报告，自 2016 年 2 月力晶科技入股公司至今，力晶科技均未将公司纳入合并报表范围，仅作为参股投资企业列示。

二、《问询函》第4题：关于第二大股东力晶科技从事同类型业务

根据保荐工作报告，力晶科技及其关联企业力积电从事晶圆代工业务，与发行人主营业务属于同一类型业务。在定位方面，双方均定位于晶圆代工领域；主要产品方面，发行人晶圆代工服务主要为制程为 90nm-150nm 的 12 英寸晶圆代工，力晶科技及力积电晶圆代工服务主要为制程为 65nm 及以上的 12 英寸、8 英寸晶圆代工；工艺平台方面，发行人主要工艺平台为 DDIC 晶圆代工，力晶科技及力积电主要工艺平台为 DDIC、PMIC、分离式元件、Flash、影像感测 IC、记忆体整合芯片。同时，发行人与力晶科技及力积电主要客户、供应商存在重叠的情形。

请发行人：……（2）报告期内力晶科技及其关联企业晶圆代工业务的收入规模及毛利情况；（3）发行人与力晶科技及力积电的主要客户、供应商重叠的具体情况和原因……。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（二）报告期内力晶科技及其关联企业晶圆代工业务的收入规模及毛利情况

4、2021 年 1-6 月

2021 年 1-6 月，力积电具备晶圆代工产能，力晶科技不具备晶圆代工产能，其晶圆代工业务收入规模及毛利情况如下：

单位：千新台币

项目	力晶科技	力积电
营业收入	-	28,573,900
其中：晶圆代工	-	28,554,693
包装元件	-	19,207

营业成本	-	18,082,416
毛利	-	10,491,484
毛利率*	-	36.72%

注：力积电未单独披露晶圆代工营业成本，但除晶圆代工外营收规模较小，晶圆代工毛利率与整体毛利率相近，数据出自力晶科技、力积电 2021 年半年报。

(三) 发行人与力晶科技及力积电的主要客户、供应商重叠的具体情况和原因，是否会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平竞争、利益输送等情形，是否存在损害发行人利益的情形及风险

1、发行人与力晶科技及力积电的主要客户重叠情况和原因

(1) 具体情况

报告期内，发行人前五大客户占发行人营业收入的比重分别为 99.74%、94.70%、89.80%和 78.31%，发行人前五大客户占力晶科技及力积电营业收入比重分别为 15.61%、14.22%、14.63%和 14.27%，2020 年度，联咏科技、集创北方、合肥捷达微电子有限公司及其关联方在力晶科技及力积电的收入占比中均不足 1.5%，其客户重要性在力晶科技及力积电较低。

2、发行人与力晶科技及力积电的主要供应商重叠情况和原因

(1) 具体情况

根据发行人取得的报告期内力晶科技及力积电采购占比达 90%以上的原材料供应商明细表（采购占比由大到小排序，合计占比达 90%以上），报告期内，2018 年至 2020 年及 2021 年 1-6 月，发行人与力晶科技及力积电的主要原材料供应商存在重叠较高的情形，发行人在报告期内向重叠原材料供应商采购的金额分别为 2.37 亿元、2.94 亿元、5.40 亿元和 4.00 亿元，占发行人向原材料供应商采购总额的比重分别为 83.30%、88.99%、85.34%和 82.37%。

三、《问询函》第 11 题：关于技术来源和先进性

根据申报材料：（1）招股说明书对核心技术情况披露较为简单。公司取得力晶科技相关技术后，对工艺流程及参数指标进行优化，形成了现有技术平台。（2）核心技

术人员多为中国台湾籍且具有力晶科技任职背景，部分曾有中芯国际、联华电子等工作经历。（3）截至 2020 年 12 月 31 日，发行人发明专利数量 2018 年为 0 项，2019 年为 2 项，2020 年为 71 项。（4）2015 年 10 月，《技术移转协议》约定力晶科技提供驱动 IC 代工所需之制程技术予公司，用以出资的转移技术作价 20 亿元。（5）2020 年 9 月，力晶科技将用于出资的 58 项专利技术使用权中尚在有效期的 44 项无偿转让给晶合有限。（6）2018 年 4 月、2021 年 4 月，发行人同力晶科技签订了《90nm 项目技术协议》及《补充协议》，约定力晶科技向公司移转 90nm M+驱动 IC 制程技术相关技术数据及文件，公司需合计支付 500 万美元。

请发行人详细披露核心技术的形成过程，力晶科技在发行人技术发展过程中的作用，现有技术平台和技术先进性的具体表征。

请发行人说明：（1）自身研发团队取得力晶科技技术后改进优化所取得的技术成果，对公司业务及生产经营的影响；……。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。请发行人律师说明对核心技术人员是否存在违反竞业禁止、保密协议的情形，是否使用原任职单位技术成果，是否存在纠纷或潜在纠纷事项的核查情况及核查结论。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（一）自身研发团队取得力晶科技技术后改进优化所取得的技术成果，对公司业务及生产经营的影响

2、对公司业务及生产经营的影响

报告期内，2018 年至 2020 年及 2021 年 1-6 月，发行人晶圆代工业务收入分别为 21,765.95 万元、53,336.01 万元、151,186.11 万元及 160,194.97 万元，实现了稳健增长。

四、《问询函》第 12.2 题：委派管理人员

根据申报材料：（1）按照委托经营协议，存在力晶科技、合肥建投委派部分管理人员的情形，委派人员所在岗位主要是财务和内审部门。2020 年 4 月起，公司各部门已无股东委派高管。（2）2018 年 12 月，发行人依据《委托经营管理合约》组建了经营管理委员会。

请发行人说明：……（2）委托经营管理期间经营决策的具体过程，列表说明委托经营管理期间及委托经营管理终止后发行人经营管理团队的变化，相关变动人员的来源及劳动关系隶属情况；……。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见，请申报会计师就发行人财务是否独立于力晶科技进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（二）委托经营管理期间经营决策的具体过程，列表说明委托经营管理期间及委托经营管理终止后发行人经营管理团队的变化，相关变动人员的来源及劳动关系隶属情况

2、委托经营管理期间及委托经营管理终止后发行人经营管理团队的变化，相关变动人员的来源及劳动关系隶属情况

根据发行人自设立以来历次董事会会议、合肥建投及力晶科技向发行人委派高管的相关函件以及发行人出具的说明，报告期初至股改前，发行人经营管理团队人员的变化情况如下：

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
1	/	总经理	2018 年 1 月-	黎湘鄂	发行人员工	发行人

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属	
			2020年3月				
			2020年3月-报告期末	蔡辉嘉	发行人员工	发行人	
2	运营	副总经理	2018年1月-2020年3月	蔡辉嘉	发行人员工	发行人	
			2020年4月-报告期末	邱显寰	发行人员工	发行人	
		助理	2019年12月-报告期末	邱显寰	发行人员工	发行人	
			2020年4月-2020年11月	未设置			
			2020年12月-报告期末	李庆民	发行人员工	发行人	
3	采购	总监/副总经理	2018年1月-2020年11月	盛惟健	发行人员工	发行人	
			2020年11月-报告期末	未设置			
		助理	2020年11月-报告期末	简瑞荣	发行人员工	发行人	
		副总监	2018年1月-2019年5月	周义亮	合肥建投委派	合肥建投	
			2019年5月-2020年3月	王继武	合肥建投委派	合肥建投	
			2020年3月-报告期末	未设置			
		4	销售	总监/副总经理	2018年1月-2019年10月	黎湘鄂	发行人员工

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
			2019年10月-2020年4月	未设置		
			2020年4月-2020年6月	孙志明	发行人员工	发行人
			2020年6月-报告期末	未设置		
		助理	2019年10月-2020年4月	孙志明	发行人员工	发行人
			2020年4月-报告期末	周义亮	发行人员工	发行人
		副总监	2018年1月-2020年3月	周义亮	发行人员工	发行人
			2020年4月-报告期末	未设置		
		5	研发	副总经理	2018年1月-2019年3月	陈耿川
2020年4月-报告期末	詹奕鹏				发行人员工	发行人
助理	2019年3月-2020年3月			詹奕鹏	发行人员工	发行人
	2020年4月-报告期末			未设置		
6	财务	总会计师/财务负责人	2018年1月-2020年3月	朱才伟	合肥建投委派	合肥建投
			2020年4月至报告期末	朱才伟	发行人员工	发行人
		副总会计师/协	2018年1月-	邱垂源	力晶科技委派	力晶科技

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
		理	2019年3月			
			2019年3月-2020年3月	李洵	力晶科技委派	力晶科技
			2020年4月-报告期末	李洵	发行人员工	发行人
7	内审	审计师	2018年1月-2018年5月	陈美华	力晶科技委派	力晶科技
			2018年5月-2018年12月	潘炯升	力晶科技委派	力晶科技
			2019年1月-2019年12月	朱晓娟	合肥建投委派	合肥建投
			2019年12月-2020年4月	杨幼玲	合肥建投委派	合肥建投
			2020年4月-报告期末	未设置		
8	行政	副总经理	2018年1月-2018年5月	刘荫	力晶科技委派	力晶科技
			2018年5月-2019年10月	未聘任，由采购总监盛惟健代管		
			2019年10月-2020年3月	朱晓娟	合肥建投委派	合肥建投
			2020年4月-报告期末	朱晓娟	发行人员工	发行人
9	证券	董事会秘书	2020年4月-报告期末	朱才伟	发行人员工	发行人
10	敬业监督	敬业促进委员会委员长	2018年1月-2019年11月	朱晓娟	合肥建投委派	合肥建投

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
			2019年12月- 2020年11月	杨幼玲	合肥建投委派	合肥建投
			2020年11月- 报告期末	不再为高级管理人员职位		

综上，报告期内，发行人经营管理团队主要来源于发行人员工；截至报告期末，发行人高级管理人员均由公司聘任，不涉及股东委派的情形。

五、《问询函》第 12.3 题：向控股股东子公司租赁厂房及设施

根据申报材料：（1）发行人及其子公司无自有房产及土地使用权。目前主要办公场所及全部生产场所为向合肥建投全资子公司合肥蓝科租赁，募投项目实施相关厂房系向合肥蓝科租赁。环保设施由合肥蓝科与厂房一同建设并出租给发行人使用。（2）2017 年公司与合肥蓝科、力晶科技签订的《厂房建设与租用协议》及公司与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》租入厂房及配套厂务设备；2021 年 4 月，公司与合肥蓝科签订《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》对晶合二厂及配套设施认定为经营性租赁，同期公司与合肥蓝科签订《收购意向协议》，公司承诺在该项目交付之日起 5 年内完成收购。（3）以融资租赁方式进行核算，报告期各期末，公司融资租入固定资产账面价值分别为 176,313.65 万元、169,151.82 万元和 161,990.00 万元。

请发行人说明：（1）厂房租赁合约签订的具体考虑，协议对厂房及相关土地的权属安排的具体约定及未来的具体安排；（2）发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套厂务设备的内容，各厂房的建设进度和使用情况，发行人大额固定资产、在建工程与上述厂房的关系，租用协议到期后固定资产的安置方式，结合上述情况具体说明租赁厂房的业务合理性；……。

请保荐机构、发行人律师对事项（1）-（3）和申报会计师对事项（2）和（4）进行核查并发表明确意见。请保荐机构和发行人律师根据《问答（二）》第 7 条的规定，

充分论证上述情况是否对发行人资产完整和独立性构成重大不利影响，督促发行人做好信息披露和风险揭示。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（一）厂房租赁合同签订的具体考虑，协议对厂房及相关土地的权属安排的具体约定及未来的具体安排

2、协议对厂房及相关土地的权属安排的具体约定及未来的具体安排

2021年8月12日，公司召开2021年第一届第六次董事会审议通过了《关于变更上市募投项目的议案》。2021年8月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。募投项目变更后，拟使用31亿募集资金用于收购制造基地厂房及厂务设施，以保证发行人的独立性及资产的完整性。

（二）发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套厂务设备的内容，各厂房的建设进度和使用情况，发行人大额固定资产、在建工程与上述厂房的关系，租用协议到期后固定资产的安置方式，结合上述情况具体说明租赁厂房的业务合理性

2、发行人大额固定资产、在建工程与上述厂房的关系

报告期内，发行人固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	
	账面原值	账面价值
固定资产	1,192,519.62	981,761.60
其中：房屋及建筑物	2,914.92	2,672.79
其中：机器设备	1,175,720.18	971,757.33
其中：运输工具	274.08	0.14
其中：电子设备及其他	13,610.44	7,331.34

项目	2021年6月30日	
	账面原值	账面价值
融资租入固定资产	187,056.39	158,409.08
其中：房屋及建筑物	186,787.95	158,355.40
其中：电子设备及其他	268.44	53.69
融资租入固定资产占固定资产的比例	15.69%	16.14%
其中：房屋及建筑物	98.46%	98.34%
其中：电子设备及其他	1.93%	0.73%

注：发行人自 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则，将融资租入固定资产调整计入使用权资产。为保证 2018 年至 2021 年 1-6 月数据可比，上表 2021 年 1-6 月“融资租入固定资产占固定资产的比例”计算方式为融资租入固定资产金额/（固定资产金额+融资租入固定资产金额）

上述租赁厂房及配套厂务设备等计入固定资产的房屋及建筑物、电子设备及其他，不存在租入的在建工程，由于配套厂务设备与厂房密不可分，故作为房屋及建筑物核算。

报告期各期末，公司融资租入固定资产账面价值分别为 176,313.65 万元、169,151.82 万元、161,990.00 万元和 158,409.08 万元，主要为根据公司与合肥蓝科、力晶科技签订的《厂房建设与租用协议》及公司与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》所租入的厂房及配套厂务设备。报告期内，上述租赁获得的厂房及配套厂务设备原值占发行人固定资产原值的比例分别为 32.31%、22.53%、19.41%和 15.69%，占发行人固定资产中房屋及建筑物原值的比例分别为 99.95%、98.79%、98.59%和 98.46%，发行人房屋及建筑物主要通过上述租赁方式获得。

六、《问询函》第 12.5 题：社保缴纳情况

报告期各期末在境内缴纳社会保险、住房公积金的人数为 300 多人，占员工总人数比例 20%以上。

请发行人说明：台湾籍员工的数量、职位分布、劳动合同关系、薪酬支付与社保缴纳主体，与力晶科技是否相独立。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

根据发行人提供的员工名单及工资表、中国台湾籍员工劳动合同、社保缴纳凭证、中国台湾劳务公司代缴劳健保的相关协议并经本所律师与代缴公司确认，报告期内，发行人中国台湾籍员工均与发行人或其子公司签订了劳动合同，由发行人或其子公司承担薪酬，其中主要为制造、研发人员，具体情况如下：

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
台籍员工数量	288	264	299	296
其中：				
研发人员	72	59	64	43
制造人员	165	157	182	200
销售人员	16	15	11	9
管理人员	35	33	42	44

七、《问询函》第24题：关于募投项目

招股说明书披露：（1）本次募集资金将全部投入合肥晶合集成电路股份有限公司12英寸晶圆制造二厂项目。本项目利用一厂建设工程项目所建设的12英寸集成电路芯片制造二厂厂房主体，建设一条产能为4万片/月的12英寸晶圆代工生产线，主要产品包括电源管理芯片（PMIC）、显示驱动整合芯片（DDIC）、CMOS图像传感芯片（CIS），另外，将建设一条微生产线用于OLED显示驱动与逻辑工艺技术开发试产。（2）发行人本次募集资金拟投资的“12英寸晶圆制造二厂项目”目前处于立项阶

段，尚需在开工建设前办理环评相关手续。

请发行人说明：（1）募投项目所实现的制程节点情况；结合发行人相关产品的市场需求及竞争状况、技术水平等，分析发行人募投项目未来的市场空间和产能消化能力；（2）4万片/月的12英寸晶圆代工生产线与用于OLED显示驱动与逻辑工艺技术开发试产的微生产线之间的关系，新增固定资产折旧摊销额预计对公司未来业绩的影响；（3）募投项目未办理环评相关手续的原因，目前进展情况，是否存在无法获得审批的风险。

请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见，请发行人律师对上述事项（3）进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

2021年11月4日，合肥新品集成电路有限公司12吋晶圆制造项目已由合肥新站高新技术产业开发区经贸局完成项目备案（项目代码：2111-340163-04-01-543967）。2021年11月29日，合肥市生态环境局出具了《关于合肥新品集成电路有限公司12吋晶圆制造项目环境影响报告表的批复》（环建审[2021]12064号）。

八、《第二轮问询函》第5题：关于实际控制人认定

根据问询回复：（1）2019年12月以前，发行人最高权力机构董事会，有9名董事。公司章程规定重大经营、财务、人事事项需2/3董事同意，部分事项需要一致批准。而合肥建投占5席，未达2/3。回复中称合肥国资方委派董事在发行人董事会中占实质主导地位；（2）公司董事长提名人为力晶科技；（3）公司高管成员包括行使敬业监督职能的敬业促进委员会委员长，由合肥建投进行委派；（4）回复中列式了报告期内公司高级管理人员的变化情况，但未说明相关人员的提名情况；（5）公司组建了经营管理委员会作为董事会幕僚机构，其中合肥建投指派人员的职责主要为监督。

请发行人说明：（1）结合《合资合同》《公司章程》等相关协议约定，说明董事

长的职责及具体产生方式，董事长的提名人为力晶科技的原因，以及在合肥建投委派董事未达 2/3 情况下合肥国资方委派董事在董事会中占实质主导地位的依据是否充分；

(2) 行使敬业监督职能高管的具体职能行使情况，该职位是否主要针对与力晶科技合作进行设置，报告期内的实际执行情况；(3) 报告期内公司高级管理人员的提名情况，是否主要由力晶科技进行提名及主导；(4) 结合上述情况，以及曾签署委托经营管理合约、第二大股东从事同类型业务、经营管理委员会等情况，说明公司是否实质为力晶科技控制或合肥市国资委与力晶科技共同控制，发行人最近两年实际控制人是否发生变更，是否通过实际控制人认定进而规避同业竞争。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（二）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（二）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

(二) 行使敬业监督职能高管的具体职能行使情况，该职位是否主要针对与力晶科技合作进行设置，报告期内的实际执行情况

1、行使敬业监督职能高管的具体职能行使情况

(3) 敬业促进委员会人员构成

自 2017 年 9 月敬业促进委员会成立至报告期末，公司敬业促进委员会的人员构成及变化情况具体如下：

日期	委员长	委员			
2017.9 至 2018.5	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	陈美华（审计师）	-
2018.5 至 2019.1	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	潘炯升（审计师）	-

2019.1	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	林士然（副审计师）	-
2019.1至2019.12	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	林士然（副审计师）	刘桂云（党委办公室主任）
2019.12至2020.4	杨幼玲	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	林士然（副审计师）	刘桂云（党委办公室主任）
2020.4至2020.8	杨幼玲	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	王兴亚（财会处处长）	刘桂云（党委办公室主任）
2020.8至2021.3	杨幼玲	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	王兴亚（财会处处长）	林士然（总经理特别助理）
2021.3至报告期末	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	王兴亚（财会处处长）	林士然（总经理特别助理）

(5) 报告期内的实际执行情况

报告期内，敬业促进委员会共计召开 14 次会议，均由敬业委员会委员长主持，相关会议具体情况如下：

序号	召开日期	会议主要内容及处理结果	董事会汇报情况
1	2018.6.28	审议一起员工违反公司出勤规定事件。各委员依调查结果讨论后，违反出勤规定属实者给予大过 1 次，并追回虚报加班费用及公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第十七次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
2	2018.7.11	审议一起员工工作能力不足检举事件。各委员依调查结果讨论后，要求该员工所属部门畅通内部沟通管道，以化解工作中存在的问题	处理结果在晶合有限第一届第十七次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
3	2019.1.10	审议一起员工工作能力不足、二起员工违反公司出勤规定及一起员工违反	处理结果在晶合有限第一届第二十一次董事会

序号	召开日期	会议主要内容及处理结果	董事会汇报情况
		公司住宿规定检举事件。各委员依调查结果讨论后，违反出勤规定属实者给予申诫 1 次、并追回虚报加班费用；违反住宿规定属实者，取消入住公司宿舍权利。以上四起案件公告厂内周知	会议中作为报告事项向董事会汇报
4	2019.4.11	审议一起员工作业疏失及一起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，违反敬业规范属实者给予申诫 1 次，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十二次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
5	2019.6.19	审议二起员工违反工作纪律及一起员工在外行为影响其他同事。各委员依调查结果讨论后，违反工作纪律属实者给予扣二个月绩效，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十三次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
6	2019.9.5	审议一起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，未有违反敬业规范之情况，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十三次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
7	2019.10.24	审议一起拖欠供应商货款。各委员依调查结果讨论后，检举不属实，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十四次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
8	2019.12.17	审议一起员工违反工作纪律。各委员依调查结果讨论后，未有违反工作纪律之情况，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十五次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
9	2020.1.15	审议一起采购品项不符合招标需求。	处理结果在晶合有限第

序号	召开日期	会议主要内容及处理结果	董事会汇报情况
		各委员依调查结果讨论后，检举不属实	一届第二十五次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
10	2020.8.27	审议一起采购品项指定单一品牌及一起员工泄露供应商报价。各委员依调查结果讨论后，检举不属实，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第二届第四次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
11	2020.11.5	审议一起员工违反公司住宿补贴规定。各委员依调查结果讨论后，违反住宿补贴规定属实者给予记过 1 次，并追回虚报住宿补贴及取消领取补贴资格，同时公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第三次会议中作为报告事项向董事会汇报
12	2021.1.22	审议一起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，未有违反敬业规范之情况，并公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第三次会议中作为报告事项向董事会汇报
13	2021.3.18	审议二起员工违反公司工作纪律。各委员依调查结果讨论后，违反工作纪律属实者给予解雇，并公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第五次会议中作为报告事项向董事会汇报
14	2021.5.19	审议二起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，违反敬业规范属实者分别给予申诫 1 次和记过 1 次，并公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第六次会议中作为报告事项向董事会汇报

九、《第二轮问询函》第 7 题：关于无形资产和技术

根据问询回复：（1）2015 年 10 月，晶合有限与力晶科技、合肥建投签订《技术转移协议》，约定力晶科技以三项制程技术作价 20 亿元出资晶合有限，包括专利技术、

技术文件及数据以及技术经验等内容，所涉及的 58 项专利使用权的到期时间在 2016 年至 2025 年，截至问询函回复出具日，上述发明专利权中 14 项已到期，但 2018 年和 2019 年末，发行人对无形资产进行了减值测试未发现减值迹象；（2）2018 年导入 90nmM+技术平台；（3）报告期内，发行人向智成电子采购 IP 授权交易分别为 177.18 万元、152.95 万元和 372.62 万元，智成电子系力晶科技控制公司。未来发行人不排除基于代工产品工艺技术要求继续向智成电子取得上述 IP 或其他类型 IP 的授权。发行人与智成电子的 IP 授权交易具有持续性。

请发行人说明：……（3）发行人向智成电子采购 IP 授权交易的原因，在发行人生产经营及技术方面的作用，发行人目前技术与力晶科技之间的关系，是否存在技术依赖。

请保荐机构、发行人律师和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（二）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（二）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（三）发行人向智成电子采购 IP 授权交易的原因，在发行人生产经营及技术方面的作用，发行人目前技术与力晶科技之间的关系，是否存在技术依赖

报告期内，发行人对技术进行持续自主研发并创新升级，以满足不同客户针对不同制程节点、不同工艺平台的产品需求，并形成了稳定的研发人员团队，团队成员均与发行人直接签署劳动合同。同时，发行人不断将研发投入所形成的科研成果及核心技术通过申请专利等方式进行保护，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人已形成与主营业务收入相关的发明专利共 71 件，不依赖于力晶科技的研发团队、科研成果及专利和非专利技术，具有独立研发能力。

十、《第二轮问询函》第 9.2 题

报告期内，报告期内除日本子公司员工外，发行人台籍员工通过中国台湾第三方劳务公司怡东人事顾问股份有限公司为其在中国台湾地区缴纳劳健保。

请结合相关法律法规规定说明上述代缴社保相关情形是否符合相关法律法规规定以及对公司的影响。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（二）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（二）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（四）发行人通过第三方劳务公司代缴劳健保事宜对于发行人经营成果的影响

根据发行人测算，报告期内，发行人为中国台湾籍员工实际缴纳劳健保、未在中国大陆缴纳社会保险对发行人经营成果的影响如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月
发行人为中国台湾籍员工实际缴纳劳健保的金额（a）	468.88	555.63	560.10	307.08
发行人应为中国台湾籍员工缴纳社会保险的金额（b）	1,460.51	1,423.38	413.61	620.57
差额（b-a）	991.63	867.75	-146.49	313.49
营业总成本（c）	123,918.17	169,998.65	255,660.04	152,679.28
发行人应为中国台湾籍员工缴纳社会保险的金额占营业总成本的比例（b/c）	1.18%	0.84%	0.16%	0.41%
差额占营业总成本的比例 [(b-a)/c]	0.80%	0.51%	-0.06%	0.21%

注：2020 年度，国家在疫情期间推出了社保减免政策，因此，发行人应为中国台湾籍员工缴纳社会保险的金额大幅降低。

发行人报告期内应当为中国台湾籍员工在中国大陆缴纳社会保险的金额与发行人为中国台湾籍员工缴纳劳健保的金额的差额占发行人营业总成本的比例分别为 0.80%、

0.51%、-0.06%、0.21%，发行人通过第三方劳务公司代缴劳健保事对发行人的经营成果影响较小。

十一、《第二轮问询函》第 9.3 题

公司于 2017 年在日本设立子公司，员工主要来源于 Synaptics 公司，日本晶合所取得的知识产权权益归属于晶合集成。2017 年前后 Synaptics 公司拟进行业务转型，晶合集成获得吸纳曾于 Synaptics 日本子公司任职的研发团队的机会。

请发行人说明：相关人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，相关研发成果是否涉及其原任职单位的技术成果，是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（二）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（二）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

发行人日本子公司吸纳曾于 Synaptics 日本子公司任职的研发团队，截至 2021 年 6 月 30 日，日本晶合共有 15 名员工，其中 9 名曾任职于 Synaptics 日本子公司。

截至 2021 年 6 月 30 日，日本晶合员工作为发明人、在发行人任职期间自主研发并取得的授权专利共计 12 项，具体情况如下：

序号	权利人	发明人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	国别
1	发行人	田矢真敏； 中野纪夫； 熊谷裕弘	发明专利	半导体元件的 制造方法	ZL2019101 03609.4	2019/02/01	中国
2	发行人	小嶋英充	发明专利	ラッチ回路	特许第 6761074 号	2019/05/21	日本
3	发行人	小嶋英充	发明专利	SRAM、半導 体集積回路及	特许第 6801053 号	2019/06/19	日本

序号	权利人	发明人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	国别
				び LCD ドライバ			
4	发行人	川村昌靖; 夏目秀隆; 藤井康博; 熊谷裕弘	发明专利	容量性半導体素子	特许第 6831067号	2019/04/25	日本
5	发行人	田矢真敏; 中野纪夫; 熊谷裕弘	发明专利	半導体素子の製造方法	特许第 6826795号	2019/01/09	日本
6	发行人	田矢真敏; 中野纪夫; 熊谷裕弘	发明专利	高耐庄半導体素子及びその製造方法	特许第 6892889号	2019/04/15	日本
7	北京晶 芯成	夏目秀隆; 田矢真敏; 藤井康博; 中野纪夫	发明专利	半导体测试结构	ZL2020111 59567.5	2020/10/27	中国
8	发行人	田矢真敏; 中野纪夫; 熊谷裕弘	发明专利	高耐压半导体元件及其制造方法	ZL2019102 99871.0	2019/04/15	中国
9	北京晶 芯成	大田裕之	发明专利	一种半导体装置的制备方法	ZL2020111 36147.5	2020/10/22	中国
10	北京晶 芯成	藤井康博; 李波; 陈信 全	发明专利	半导体器件	ZL2020111 22488.7	2020/10/20	中国
11	北京晶 芯成	田矢真敏; 石田浩; 中 野纪夫	发明专利	功率半导体器件及制造方法	ZL2020113 33530.X	2020/11/25	中国

序号	权利人	发明人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	国别
12	北京晶芯成	小嶋英充； 藤井康博	发明专利	半导体存储器件	ZL202011572842.6	2020/12/28	中国

日本晶合全体员工均已出具确认函：“本人从原单位离职后加入日本晶合，不存在违反原单位竞业禁止及保密义务或其他约定的情形，亦不存在任何同原单位纠纷或潜在纠纷。”

根据日本律师出具的法律意见书，日本晶合与其他第三方无专利诉讼案件，日本员工与原单位之间不存在诉讼案件。

综上所述，日本子公司相关人员不存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，相关研发成果不涉及其原任职单位的技术成果，不存在纠纷或潜在纠纷。

（本页以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（三）》之签章页）



经办律师： 苏峰
苏峰

刘东亚
刘东亚

单位负责人： 王玲
王玲

二〇二一年十二月十九日

附件一：发行人及其子公司拥有的知识产权

1、境内注册商标

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式
1	晶合集成	Nexchip	26296999A	9	2018/11/07-2028/11/06	原始取得
2	晶合集成	Nexchip	26258933	25	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
3	晶合集成	Nexchip	26283789	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
4	晶合集成	Nexchip	26255490	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
5	晶合集成	晶合	26295138A	9	2018/11/07-2028/11/06	原始取得
6	晶合集成	晶合	26261189	25	2018/10/28-2028/10/27	原始取得

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式
7	晶合集成	晶合	26283543	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
8	晶合集成	晶合	26258453	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
9	晶合集成	晶合集成	26296982A	9	2018/11/07-2028/11/06	原始取得
10	晶合集成	晶合集成	26257005	25	2018/10/28-2028/10/27	原始取得
11	晶合集成	晶合集成	26279879	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
12	晶合集成	晶合集成	26258966	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
13	晶合集成		26279826	9	2018/12/07-2028/12/06	原始取得

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式
14	晶合集成		43218141	25	2020/10/14-2030/10/13	原始取得
15	晶合集成		26279830	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
16	晶合集成		26273278	40	2019/12/14-2029/12/13	原始取得
17	晶合集成		36794768	25	2020/08/21-2030/08/20	原始取得

2、境外商标情况

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
1	晶合有限	Nexchip	6098177	9	2018/11/16-2028/11/15	原始取得	日本
2	晶合有限	Nexchip	6071853	25	2018/08/17- 2028/08/16	原始取得	日本
3	晶合有限	Nexchip	6098177	35	2018/11/16- 2028/11/15	原始取得	日本
4	晶合有限	Nexchip	6071853	40	2018/08/17- 2028/08/16	原始取得	日本
5	晶合有限	晶合	6050343	9	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
6	晶合有限	晶合	6070505	25	2018/08/10- 2028/08/09	原始取得	日本

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
7	晶合有限	晶合	6050343	35	2018/06/08- 2028/06/07	原始取得	日本
8	晶合有限	晶合	6070505	40	2018/08/10- 2028/08/09	原始取得	日本
9	晶合有限	晶合集成	6050344	9	2018/06/08- 2028/06/07	原始取得	日本
10	晶合有限	晶合集成	6071852	25	2018/08/17- 2028/08/16	原始取得	日本
11	晶合有限	晶合集成	6050344	35	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
12	晶合有限	晶合集成	6071852	40	2018/08/17- 2028/08/16	原始取得	日本
13	晶合有限		6050345	9	2018/06/08- 2028/06/07	原始取得	日本

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
14	晶合有限		6070504	25	2018/08/10- 2028/08/09	原始取得	日本
15	晶合有限		6050345	35	2018/06/08- 2028/06/07	原始取得	日本
16	晶合有限		6070504	40	2018/08/10- 2028/08/09	原始取得	日本
17	晶合有限	Nexchip	01919639	9	2018/06/16- 2028/06/15	原始取得	中国台湾
18	晶合集成	Nexchip	01923633	25	2018/07/01- 2028/06/30	原始取得	中国台湾
19	晶合有限	Nexchip	01920983	35	2018/06/16- 2028/06/15	原始取得	中国台湾
20	晶合集成	Nexchip	01912745	40	2018/05/01- 2028/04/30	原始取得	中国台湾
21	晶合有限	晶合	01919637	9	2018/06/16- 2028/06/15	原始取得	中国台湾

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
22	晶合集成	晶合	01909401	25	2018/04/16- 2028/04/15	原始取得	中国台湾
23	晶合有限	晶合	01920981	35	2018/06/16- 2028/06/15	原始取得	中国台湾
24	晶合集成	晶合	01912743	40	2018/05/01- 2028/04/30	原始取得	中国台湾
25	晶合有限	晶合集成	01919636	9	2018/06/16- 2028/06/15	原始取得	中国台湾
26	晶合集成	晶合集成	01909400	25	2018/04/16- 2028/04/15	原始取得	中国台湾
27	晶合有限	晶合集成	01920980	35	2018/06/16- 2028/06/15	原始取得	中国台湾
28	晶合集成	晶合集成	01918174	40	2018/06/01- 2028/05/31	原始取得	中国台湾

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
29	晶合有限		01919638	9	2018/06/16- 2028/06/15	原始取得	中国台湾
30	晶合集成		01909402	25	2018/04/16- 2028/04/15	原始取得	中国台湾
31	晶合有限		01920982	35	2018/06/16- 2028/06/15	原始取得	中国台湾
32	晶合集成		01912744	40	2018/05/01- 2028/04/30	原始取得	中国台湾
33	晶合有限	Nexchip	5513533	9	2018/07/10- 2028/07/09	原始取得	美国
34	晶合有限	Nexchip	5513299	25	2018/07/10- 2028/07/09	原始取得	美国
35	晶合有限	Nexchip	5559722	35	2018/09/11- 2028/09/10	原始取得	美国
36	晶合有限	Nexchip	5513440	40	2018/07/10- 2028/07/09	原始取得	美国
37	晶合有限	晶合	5523772	9	2018/07/24- 2028/07/23	原始取得	美国

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
38	晶合有限	晶合	5518583	25	2018/07/17- 2028/07/16	原始取得	美国
39	晶合有限	晶合	5513532	35	2018/07/10- 2028/07/09	原始取得	美国
40	晶合有限	晶合	5518584	40	2018/07/17- 2028/07/16	原始取得	美国
41	晶合有限	晶合集成	5518591	25	2018/07/17- 2028/07/16	原始取得	美国
42	晶合有限	晶合集成	5523770	9	2018/07/24- 2028/07/23	原始取得	美国
43	晶合有限	晶合集成	5523769	35	2018/07/24- 2028/07/23	原始取得	美国
44	晶合有限	晶合集成	5513586	40	2018/07/10- 2028/07/09	原始取得	美国

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
45	晶合有限		5523767	9	2018/07/24- 2028/07/23	原始取得	美国
46	晶合有限		5523806	25	2018/07/24- 2028/07/23	原始取得	美国
47	晶合有限		5523768	35	2018/07/24- 2028/07/23	原始取得	美国
48	晶合有限		5523807	40	2018/07/24- 2028/07/23	原始取得	美国
49	晶合有限	Nexchip	018074417	9	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
50	晶合有限	Nexchip	018074417	35	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
51	晶合有限	Nexchip	018074417	40	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
52	晶合有限		018073971	9	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
53	晶合有限		018073971	35	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
54	晶合有限		018073971	40	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
55	晶合有限		018073976	9	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
56	晶合有限		018073976	35	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
57	晶合有限		018073976	40	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
58	晶合有限	Nexchip	4196328	35	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度
59	晶合有限	Nexchip	4196329	40	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度
60	晶合有限		4216333	35	2019/06/25-2029/06/24	原始取得	印度
61	晶合有限		4216334	40	2019/06/25- 2029/06/24	原始取得	印度
62	晶合有限		4196323	9	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度
63	晶合有限		4196324	35	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度
64	晶合有限		4196325	40	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
65	晶合有限	Nexchip	401603379	35	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
66	晶合有限	Nexchip	401603380	40	2020/05/07- 2030/05/06	原始取得	韩国
67	晶合集成	Nexchip	401684625	9	2021/1/20-2031/1/19	原始取得	韩国
68	晶合有限	 Nexchip	401605036	35	2020/05/12- 2030/05/11	原始取得	韩国
69	晶合有限	 Nexchip	401605037	40	2020/05/12- 2030/05/11	原始取得	韩国
70	晶合集成	 Nexchip	401684665	9	2021/1/20-2031/1/19	原始取得	韩国
71	晶合有限		401603377	9	2020/05/07- 2030/05/06	原始取得	韩国
72	晶合有限		401603378	35	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
73	晶合有限		401599318	40	2020/04/23- 2030/04/22	原始取得	韩国
74	晶合有限	Nexchip	40201926832S	35	2019/12/12- 2029/12/11	原始取得	新加坡
75	晶合有限	Nexchip	40201926831T	40	2019/12/12- 2029/12/11	原始取得	新加坡
76	晶合集成	Nexchip	40201926806V	9	2019/12/11-2029/12/10	原始取得	新加坡
77	晶合有限	 Nexchip	40201925814T	35	2019/11/28- 2029/11/27	原始取得	新加坡
78	晶合集成	 Nexchip	40201925815S	40	2019/11/28-2029/11/27	原始取得	新加坡
79	晶合集成	 Nexchip	40201926869 W	9	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
80	晶合有限		40201926842V	9	2019/12/12- 2029/12/11	原始取得	新加坡
81	晶合有限		40201926838P	35	2019/12/12- 2029/12/11	原始取得	新加坡
82	晶合集成		40201926847Q	40	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
83	晶合集成	 Nexchip	TM201904435 7	9	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
84	晶合集成	 Nexchip	TM201904436 2	35	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚
85	晶合集成	 Nexchip	TM201904436 4	40	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚
86	晶合集成	Nexchip	TM201904534 6	9	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
87	晶合集成	Nexchip	TM201904534 8	35	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
88	晶合集成	Nexchip	TM201904535 0	40	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
89	晶合集成		TM201904535 2	9	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
90	晶合集成		TM201904535 5	35	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
91	晶合集成		TM201904535 7	40	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚

3、境内专利

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
1	晶合集成	发明专利	光学光刻方法	ZL03155531.4	2003/08/28	继受取得
2	晶合集成	发明专利	具有自行对准接触窗的半导体元件及其制造方法	ZL200510065580.3	2005/04/18	继受取得
3	晶合集成	发明专利	导线的制造方法	ZL200510065608.3	2005/04/18	继受取得
4	晶合集成	发明专利	半导体元件及其制造方法	ZL200610005891.5	2006/01/19	继受取得
5	晶合集成	发明专利	导线的制造方法以及缩小导线与图案间距的方法	ZL200510129767.5	2005/12/05	继受取得
6	晶合集成	发明专利	电路结构及用以定义此电路结构的光掩模	ZL200710161775.7	2007/09/26	继受取得
7	晶合集成	发明专利	监控光刻工艺的方法与监控标记	ZL200810093317.9	2008/04/18	继受取得
8	晶合集成	发明专利	分栅式非易失性存储器及其制备方法	ZL201810796277.8	2018/07/19	原始取得
9	晶合集成	发明专利	一种晶元破片分析装置及其晶元破片分析方法	ZL201810897300.2	2018/08/08	原始取得
10	晶合集成	发明专利	一种裂片装置及方法	ZL201810920343.8	2018/08/14	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
11	晶合集成	发明专利	一种半导体结构制造方法	ZL201810980356.4	2018/08/27	原始取得
12	晶合集成	发明专利	MOS 场效应晶体管及其制造方法	ZL201811237197.5	2018/10/23	原始取得
13	晶合集成	发明专利	一种非易失性存储器及其制作方法	ZL201811345719.3	2018/11/13	原始取得
14	晶合集成	发明专利	一种非易失性存储器及其制作方法	ZL201811354139.0	2018/11/14	原始取得
15	晶合集成	发明专利	沟槽隔离结构的形成方法	ZL201910048694.9	2019/01/18	原始取得
16	晶合集成	发明专利	一种存储器及其制造方法	ZL201910104747.4	2019/02/01	原始取得
17	晶合集成	发明专利	高耐压半导体元件及其制造方法	ZL201910299871.0	2019/04/15	原始取得
18	晶合集成	发明专利	预处理方法、金属硅化物的形成方法以及半导体处理装置	ZL201910611966.1	2019/07/08	原始取得
19	晶合集成	发明专利	沟槽制作方法及半导体隔离结构制作方法	ZL201911268173.0	2019/12/11	原始取得
20	晶合集成	发明专利	半导体集成器件的阱制备方法和阱注入光罩组	ZL201911303991.X	2019/12/17	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
21	晶合集成	发明专利	一种半导体器件的制造方法及其形成的半导体器件	ZL201911326563.9	2019/12/20	原始取得
22	晶合集成	发明专利	扩散型场效应晶体管的形成方法	ZL202010043997.4	2020/01/15	原始取得
23	晶合集成	发明专利	半导体器件及其制造方法	ZL202010099798.5	2020/02/18	原始取得
24	晶合集成	发明专利	半导体元件的制造方法	ZL201910103609.4	2019/02/01	原始取得
25	晶合集成	发明专利	一种建立光学数据校正模型的方法	ZL202010219356.X	2020/03/25	原始取得
26	晶合集成	发明专利	一种晶圆的退火方法	ZL202010372489.0	2020/05/06	原始取得
27	晶合集成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202010454977.6	2020/05/26	原始取得
28	晶合集成	实用新型	一种液位测量仪	ZL201820995525.7	2018/06/25	原始取得
29	晶合集成	实用新型	双灯丝离子源装置	ZL201821163226.3	2018/07/23	原始取得
30	晶合集成	实用新型	用于半导体设备的安装位检测装置	ZL201821130870.0	2018/07/17	原始取得
31	晶合集成	实用新型	用于半导体设备的定位装置	ZL201821147988.4	2018/07/19	原始取得
32	晶合集成	实用新型	一种气体供应装置	ZL201821192419.1	2018/07/24	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
33	晶合集成	实用新型	一种载台及载具	ZL201821719617.9	2018/10/22	原始取得
34	晶合集成	实用新型	一种气体除尘装置及具有该气体除尘装置的气体处理装置	ZL201821753440.4	2018/10/26	原始取得
35	晶合集成	实用新型	掩膜板	ZL201821957502.3	2018/11/23	原始取得
36	晶合集成	实用新型	可感测基片破损的片盒	ZL201822002991.3	2018/11/30	原始取得
37	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的不间断储水装置及半导体设备	ZL201920706945.3	2019/05/17	原始取得
38	晶合集成	实用新型	一种防干扰装置及半导体制程机台	ZL201921016248.1	2019/07/02	原始取得
39	晶合集成	实用新型	流速调节装置	ZL201921235650.9	2019/08/01	原始取得
40	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的组件调整装置	ZL201921439572.4	2019/09/02	原始取得
41	晶合集成	实用新型	一种半导体设备夹持装置	ZL201921604162.0	2019/09/25	原始取得
42	晶合集成	实用新型	半导体检测机台	ZL201921654723.8	2019/09/30	原始取得
43	晶合集成	实用新型	一种光罩	ZL202020368355.7	2020/03/23	原始取得
44	晶合集成	实用新型	一种晶体管结构	ZL202020257664.7	2020/03/04	原始取得
45	晶合集成	实用新型	封装芯片的移除装置	ZL201922312082.4	2019/12/20	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
46	晶合集成	实用新型	多次可编程存储器的单元结构	ZL202020331150.1	2020/03/16	原始取得
47	晶合集成	实用新型	一种非易失性存储器结构	ZL202020519501.1	2020/04/10	原始取得
48	晶合集成	实用新型	一种非易失性存储器结构	ZL202020519503.0	2020/04/10	原始取得
49	晶合集成	实用新型	一种半导体器件	ZL202020333222.6	2020/03/17	原始取得
50	晶合集成	实用新型	半导体器件	ZL202020247738.9	2020/03/02	原始取得
51	晶合集成	实用新型	封装结构	ZL202020404622.1	2020/03/24	原始取得
52	晶合集成	实用新型	一种半导体结构及其应用的半导体器件	ZL202020778398.2	2020/05/12	原始取得
53	晶合集成	实用新型	嵌入式焊盘结构	ZL202020252537.8	2020/03/04	原始取得
54	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的腔室及半导体设备	ZL202020604243.7	2020/04/21	原始取得
55	晶合集成	实用新型	量测机台	ZL202020832666.4	2020/05/15	原始取得
56	晶合集成	实用新型	一种转接装置	ZL202021137450.2	2020/06/18	原始取得
57	晶合集成	实用新型	一种半导体的测试装置	ZL202021166959.X	2020/06/22	原始取得
58	晶合集成	实用新型	一种基板表面污染物取样装置	ZL202021248626.1	2020/06/30	原始取得
59	晶合集成	实用新型	封装芯片的开封装置	ZL202021282186.1	2020/07/02	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
60	晶合集成	实用新型	一种晶圆侦测设备	ZL202021283661.7	2020/07/03	原始取得
61	晶合集成	实用新型	研磨垫中心校准治具	ZL202021581370.6	2020/08/03	原始取得
62	晶合集成	实用新型	流体测量治具	ZL202021618739.6	2020/08/06	原始取得
63	晶合集成	实用新型	研磨后清洗装置和化学机械研磨设备	ZL202021645116.8	2020/08/10	原始取得
64	晶合集成	实用新型	化学机械研磨装置	ZL202021645079.0	2020/08/10	原始取得
65	晶合集成	实用新型	一种用于化学机械研磨的清洗装置	ZL202021794843.0	2020/08/25	原始取得
66	晶合集成	实用新型	一种半导体设备	ZL202021873549.9	2020/09/01	原始取得
67	晶合集成	实用新型	进样装置	ZL202021935217.9	2020/09/03	原始取得
68	晶合集成	实用新型	晶圆表面金属离子收集装置	ZL202022409723.0	2020/10/23	原始取得
69	晶合集成	实用新型	吹气管、吹气式液位计和硅片清洗装置	ZL202022619232.9	2020/11/12	原始取得
70	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202010983155.7	2020/09/18	原始取得
71	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202011001446.8	2020/09/22	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
72	北京晶芯成	发明专利	SRAM 器件及其形成方法	ZL202010998495.7	2020/09/22	原始取得
73	北京晶芯成	发明专利	半导体器件及其制造方法	ZL202011012426.0	2020/09/24	原始取得
74	北京晶芯成	发明专利	一种浅沟槽隔离结构的制 作方法	ZL202011021046.3	2020/09/25	原始取得
75	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制备方 法	ZL202011019411.7	2020/09/25	原始取得
76	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造 方法	ZL202011039422.1	2020/09/28	原始取得
77	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其形成 方法	ZL202011059138.0	2020/09/30	原始取得
78	北京晶芯成	发明专利	一种金属互连结构的形成 方法	ZL202011054620.5	2020/09/30	原始取得
79	北京晶芯成	发明专利	LDMOS 晶体管及其制造方 法	ZL202011054657.8	2020/09/30	原始取得
80	北京晶芯成	发明专利	浅沟槽隔离结构的制造方 法及其形成的浅沟槽隔离 结构	ZL202011069600.5	2020/10/09	原始取得
81	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆表面处理方法和	ZL202011069584.X	2020/10/09	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			表面处理装置			
82	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011069193.8	2020/10/09	原始取得
83	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202011073751.8	2020/10/10	原始取得
84	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆背封结构及其制造方法	ZL202011084965.5	2020/10/12	原始取得
85	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法与制造系统	ZL202011081316.X	2020/10/12	原始取得
86	北京晶芯成	发明专利	测试结构及其测试方法	ZL202011106814.5	2020/10/16	原始取得
87	北京晶芯成	发明专利	一种沟槽的形成方法	ZL202011106813.0	2020/10/16	原始取得
88	北京晶芯成	发明专利	半导体器件的制备方法	ZL202011106699.1	2020/10/16	原始取得
89	北京晶芯成	发明专利	一种沟槽的形成方法	ZL202011106690.0	2020/10/16	原始取得
90	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202011106407.4	2020/10/16	原始取得
91	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202011106406.X	2020/10/16	原始取得
92	北京晶芯成	发明专利	一种介质层缺陷检测的测	ZL202011114851.0	2020/10/19	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			试结构			
93	北京晶芯成	发明专利	一种电介质击穿测试结构	ZL202011114835.1	2020/10/19	原始取得
94	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆中心的校正方法及系统	ZL202011114387.5	2020/10/19	原始取得
95	北京晶芯成	发明专利	Nor 闪存结构及其制作方法	ZL202011122506.1	2020/10/20	原始取得
96	北京晶芯成	发明专利	半导体器件	ZL202011122488.7	2020/10/20	原始取得
97	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆电性测试方法及测试设备	ZL202011121614.7	2020/10/20	原始取得
98	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法	ZL202011136464.7	2020/10/22	原始取得
99	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法	ZL202011136463.2	2020/10/22	原始取得
100	北京晶芯成	发明专利	一种半导体装置的制备方法	ZL202011136147.5	2020/10/22	原始取得
101	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法及点胶装置	ZL202011135589.8	2020/10/22	原始取得
102	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011135359.1	2020/10/22	原始取得
103	北京晶芯成	发明专利	半导体数据分析方法、系统及计算机可读存储介质	ZL202011160229.3	2020/10/27	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
104	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构	ZL202011159567.5	2020/10/27	原始取得
105	北京晶芯成	发明专利	SONOS 存储器及其制造方法	ZL202011159566.0	2020/10/27	原始取得
106	北京晶芯成	发明专利	隔离结构的制作方法、DAC 器件及其制作方法	ZL202011159556.7	2020/10/27	原始取得
107	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制备方法	ZL202011159377.3	2020/10/27	原始取得
108	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制造方法	ZL202011176040.3	2020/10/29	原始取得
109	北京晶芯成	发明专利	半导体隔离结构及其制备方法	ZL202011184712.5	2020/10/30	原始取得
110	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的结构及其制备方法	ZL202011207288.1	2020/11/03	原始取得
111	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202011207284.3	2020/11/03	原始取得
112	北京晶芯成	发明专利	LDMOS 晶体管及其制造方法	ZL202011206497.4	2020/11/03	原始取得
113	北京晶芯成	发明专利	MIM 电容器的制作方法	ZL202011206496.X	2020/11/03	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
114	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202011213725.0	2020/11/04	原始取得
115	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202011213310.3	2020/11/04	原始取得
116	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202011213304.8	2020/11/04	原始取得
117	北京晶芯成	发明专利	一种静态随机存取存储器及其制造方法	ZL202011235571.5	2020/11/09	原始取得
118	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆清洗位置的监测装置及监测方法	ZL202011235545.2	2020/11/09	原始取得
119	北京晶芯成	发明专利	气体置换装置及光阻烘烤设备	ZL202011243682.0	2020/11/10	原始取得
120	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构及其形成方法、半导体器件的测试方法	ZL202011243675.0	2020/11/10	原始取得
121	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构及半导体钝化层的质量测试方法	ZL202011242883.9	2020/11/10	原始取得
122	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制造方	ZL202011251097.5	2020/11/11	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			法			
123	北京晶芯成	发明专利	一种洁净室过滤装置	ZL202011249788.1	2020/11/11	原始取得
124	北京晶芯成	发明专利	半导体隔离结构及其制作方法	ZL202011275119.1	2020/11/16	原始取得
125	北京晶芯成	发明专利	一种自动调整半导体设备平衡性的装置及方法	ZL202011283036.7	2020/11/17	原始取得
126	北京晶芯成	发明专利	一种半导体设备的报警方法	ZL202011283029.7	2020/11/17	原始取得
127	北京晶芯成	发明专利	功率半导体器件及制造方法	ZL202011333530.X	2020/11/25	原始取得
128	北京晶芯成	发明专利	一种光学邻近校正模型的建模方法及建模系统	ZL202011359576.9	2020/11/27	原始取得
129	北京晶芯成	发明专利	半导体生产过程中的参数监控方法、系统及计算机可读存储介质	ZL202011367625.3	2020/11/30	原始取得
130	北京晶芯成	发明专利	半导体产品的良率分析及良率分析系统	ZL202011384551.4	2020/12/02	原始取得
131	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆失效的分析方法	ZL202011419830.X	2020/12/08	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			及系统			
132	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011424911.9	2020/12/09	原始取得
133	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011565146.2	2020/12/25	原始取得
134	北京晶芯成	发明专利	一种曝光位置的确定方法及系统	ZL202011579234.8	2020/12/28	原始取得
135	北京晶芯成	发明专利	半导体存储器件	ZL202011572842.6	2020/12/28	原始取得
136	北京晶芯成	发明专利	ESD 保护电路、ESD 保护结构及其制造方法	ZL202110010268.3	2021/01/06	原始取得
137	北京晶芯成	发明专利	半导体器件的形成方法	ZL202110010266.4	2021/01/06	原始取得
138	北京晶芯成	发明专利	化学机械研磨方法	ZL202110051576.0	2021/01/15	原始取得
139	北京晶芯成	发明专利	一种集成半导体器件	ZL202110248935.1	2021/03/08	原始取得
140	北京晶芯成	发明专利	静态随机存储器的制备方法	ZL202110252700.X	2021/03/09	原始取得
141	北京晶芯成	发明专利	一种化学机械研磨方法及其分析系统	ZL202110281539.9	2021/03/16	原始取得
142	北京晶芯成	发明专利	一种半导体元件的制造方	ZL202110306176.X	2021/03/23	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			法			
143	南京晶驱	发明专利	晶圆裂片方法及其应用	ZL202010931740.2	2020/09/08	原始取得
144	南京晶驱	发明专利	一种检测半导体设备检测感度的方法和检测系统	ZL202010938526.X	2020/09/09	原始取得
145	南京晶驱	发明专利	一种光阻层阻挡能力的检测方法及其检测系统	ZL202010937768.7	2020/09/09	原始取得
146	南京晶驱	发明专利	一种半导体器件制造方法	ZL202010938519.X	2020/09/09	原始取得
147	南京晶驱	发明专利	刻蚀方法	ZL202010998512.7	2020/09/22	原始取得
148	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL202011005773.0	2020/09/23	原始取得
149	南京晶驱	发明专利	一种浅沟槽结构制备方法	ZL202011012959.9	2020/09/24	原始取得
150	南京晶驱	发明专利	半导体结构的制作方法	ZL202011013439.X	2020/09/24	原始取得
151	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL202010937769.1	2020/09/09	原始取得
152	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL202011021798.X	2020/09/25	原始取得
153	南京晶驱	发明专利	一种浅沟槽隔离结构的制造方法	ZL202011019947.9	2020/09/25	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
154	南京晶驱	发明专利	半导体结构的制造方法	ZL202011019302.5	2020/09/25	原始取得
155	南京晶驱	发明专利	电容器及其制备方法	ZL202011037143.1	2020/09/28	原始取得
156	南京晶驱	发明专利	一种静电放电防护线路	ZL202011099926.2	2020/10/15	原始取得
157	南京晶驱	发明专利	半导体器件的制备方法	ZL202011093528.X	2020/10/14	原始取得
158	南京晶驱	发明专利	一种版图边界图案的修正方法与修正系统	ZL202011095237.4	2020/10/14	原始取得
159	南京晶驱	发明专利	MOS 晶体管及其制造方法	ZL202011093599.X	2020/10/14	原始取得
160	南京晶驱	发明专利	电容的测量结构及测量方法	ZL202011093598.5	2020/10/14	原始取得
161	南京晶驱	发明专利	一种光刻图形的仿真方法及仿真系统	ZL202011135351.5	2020/10/22	原始取得
162	南京晶驱	发明专利	图形显影情况的检测方法	ZL202011189007.4	2020/10/30	原始取得
163	南京晶驱	发明专利	光强阈值的获取方法以及辅助图形显影情况的检测方法	ZL202011185018.5	2020/10/30	原始取得

4、境外专利

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
1	晶合有限	发明专利	Semiconductor device having reduced interconnect-line parasitic capacitance	US 6,531,776 B2	2001/08/29	继受取得	美国
2	晶合有限	发明专利	Method for forming stepped contact hole for semiconductor devices	US 6,444,574 B1	2001/09/06	继受取得	美国
3	晶合有限	发明专利	Method of forming stepped contact trench for semiconductor devices	US 6,583,055 B1	2002/01/25	继受取得	美国
4	晶合有限	发明专利	Method for automatically controlling defect -specification in a semiconductor manufacturing process	US 6,807,454 B2	2003/03/17	继受取得	美国
5	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing semiconductor device with formation of a heavily doped region by implantation through an insulation layer	US 6,670,254 B1	2002/10/01	继受取得	美国
6	晶合有限	发明专利	Semiconductor device formed on silicon-on-insulator substrate	US 6,828,633 B2	2003/02/26	继受取得	美国
7	晶合有限	发明专利	Silicon-on-insulator device structure	US 7,019,582 B2	2004/09/29	继受取得	美国
8	晶合有限	发明专利	Method for producing a gate	US 6,699,755 B1	2003/03/24	继受取得	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
9	晶合有限	发明专利	Half-tone phase shift mask and patterning method using thereof	US 7,461,472 B2	2003/06/16	继受取得	美国
10	晶合有限	发明专利	Method of improving a resolution of contact hole patterns by utilizing alternate phase shift principle	US 7,008,733 B2	2003/09/25	继受取得	美国
11	晶合有限	发明专利	Re-performable spin-on process	US 6,881,590 B2	2003/08/25	继受取得	美国
12	晶合有限	发明专利	Method for fabricating a through hole on a semiconductor substrate	US 6,995,086 B2	2004/06/28	继受取得	美国
13	晶合有限	发明专利	Method for forming a titanium nitride layer	US 7,030,015 B2	2004/09/16	继受取得	美国
14	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing semiconductor device	US 7,056,787 B2	2005/01/12	继受取得	美国
15	晶合有限	发明专利	Method of forming contact hole and method of fabricating semiconductor device	US 7,098,124 B2	2005/05/31	继受取得	美国
16	晶合有限	发明专利	Semiconductor device having self-aligned contact	US 7,612,433 B2	2005/09/21	继受取得	美国
17	晶合有限	发明专利	Manufacturing method of semiconductor device having self-aligned contact	US 7,803,692 B2	2009/09/18	继受取得	美国
18	晶合有限	发明专利	Method of fabricating conductive lines with silicide layer	US 7,550,372 B2	2005/08/29	继受取得	美国
19	晶合有限	发明专利	Method for forming buried doped region	US 7,465,632 B2	2005/10/28	继受取得	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
20	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing self-aligned contact openings	US 7,429,527 B2	2007/09/11	继受取得	美国
21	晶合有限	发明专利	Method of fabricating semiconductor device	US 7,268,055 B2	2005/11/07	继受取得	美国
22	晶合有限	发明专利	Method for manufacturing gate dielectric layer	US 7,273,787 B2	2005/11/18	继受取得	美国
23	晶合有限	发明专利	Method for forming contact window	US 8,722,538 B2	2012/09/12	继受取得	美国
24	晶合有限	发明专利	Method for manufacturing semiconductor device	US 8,822,303 B2	2012/09/15	继受取得	美国
25	晶合有限	发明专利	SPLIT-GATE NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATION METHOD THEREOF	US10,636,801 B2	2018/11/25	原始取得	美国
26	晶合有限	发明专利	METHOD OF FORMING METAL SILICIDE LAYER, SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FABRICATING SAME	US10,490,647 B1	2018/08/31	原始取得	美国
27	晶合有限	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY CELL, ARRAY AND FABRICATION METHOD	US10,726,894 B2	2018/11/25	原始取得	美国
28	晶合有限	发明专利	SILICON ISLAND STRUCTURE AND METHOD OF FABRICATING SAME	US 10,490,441 B1	2018/10/18	原始取得	美国
29	晶合有限	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME	US 10,854,758 B2	2019/02/18	原始取得	美国
30	晶合集成	发明专利	Pre-processing method, method	US10,916,417B2	2020/06/16	原始取得	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			for forming metal silicide and semiconductor processing apparatus			得	
31	晶合集成	发明专利	METHOD OF FABRICATING MOSFET	US10,957,776B2	2020/05/21	原始取得	美国
32	晶合集成	发明专利	METHOD FOR FORMING SEMICONDUCTOR STRUCTURE	US10,930,545B2	2019/06/27	原始取得	美国
33	晶合集成	发明专利	CURRENT SOURCE USING EMITTER REGION AS BASE REGION ISOLATION STRUCTURE	US10,950,601B2	2019/04/15	原始取得	美国
34	晶合集成	发明专利	MOSFET AND METHOD OF FABRICATING SAME	US10,971,595B2	2018/12/17	原始取得	美国
35	晶合集成	发明专利	DIFFUSED FIELD-EFFECT TRANSISTOR AND METHOD OF FABRICATING SAME	US11,024,722B1	2020/03/25	原始取得	美国
36	晶合集成	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME	US10,916,664B2	2020/09/19	原始取得	美国
37	晶合集成	发明专利	以交替式相位移原理改善接触洞图案解析度之方法	I313889	2003/07/21	继受取得	中国台湾
38	晶合集成	发明专利	制作通孔的方法	I240988	2004/01/07	继受取得	中国台湾
39	晶合集成	发明专利	浅沟渠隔离结构的制造方法	I234228	2004/05/12	继受取得	中国台湾
40	晶合集成	发明专利	具有自行对准接触窗之半导体元件及其制造方法	I254409	2005/02/16	继受取得	中国台湾

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
41	晶合集成	发明专利	导线的制造方法	I254365	2005/01/27	继受取得	中国台湾
42	晶合集成	发明专利	自行对准接触窗开口的制作方法	I301997	2005/06/17	继受取得	中国台湾
43	晶合集成	发明专利	半导体元件及其制造方法	I267190	2005/08/29	继受取得	中国台湾
44	晶合集成	发明专利	隔离结构的制造方法	I300968	2006/06/28	继受取得	中国台湾
45	晶合集成	发明专利	光罩复验方法与系统	I305004	2006/07/17	继受取得	中国台湾
46	晶合集成	发明专利	管制规格界限之制定方法	I305838	2006/09/29	继受取得	中国台湾
47	晶合集成	发明专利	分离闸极快闪记忆体的故障检测方法	I301982	2006/09/28	继受取得	中国台湾
48	晶合集成	发明专利	接触窗的形成方法	I473206	2012/07/03	继受取得	中国台湾
49	晶合集成	发明专利	半导体元件的制造方法	I464831	2012/06/27	继受取得	中国台湾
50	晶合集成	发明专利	分栅式非挥发性记忆体及其制备方法	I720350	2018/10/09	原始取得	中国台湾
51	晶合集成	发明专利	ラッチ回路	特许第 6761074 号	2019/05/21	原始取得	日本
52	晶合集成	发明专利	SRAM、半導体集積回路及び LCD ドライバ	特许第 6801053 号	2019/06/19	原始取得	日本
53	晶合集成	发明专利	容量性半導体素子	特许第 6831067 号	2019/04/25	原始取得	日本

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
54	晶合集成	发明专利	半导体素子の製造方法	特许第 6826795 号	2019/01/09	原始取得	日本
55	晶合集成	发明专利	高耐庄半导体素子及びその製造方法	特许第 6892889 号	2019/04/15	原始取得	日本

北京市金杜律师事务所
关于合肥晶合集成电路股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
补充法律意见书（四）

致：合肥晶合集成电路股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“发行人”）委托，担任发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已于2021年4月26日出具《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），于2021年7月23日出具《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”），于2021年8月31日出具《北京市金

杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”），于 2021 年 12 月 29 日出具《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）。

鉴于上交所于 2022 年 3 月 8 日下发《关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市委问询问题》（以下简称“《上市委问询问题》”），本所现根据《上市委问询问题》的要求，就其中所涉及的法律问题进行核查，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对本所已出具的《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》的补充，并构成《法律意见书》《律师工作报告》不可分割的组成部分；本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》中对相关用语的释义、缩写适用于本补充法律意见书；本所在《法律意见书》《律师工作报告》中发表法律意见的引言、前提和假设同样适用于本补充法律意见书。对于本补充法律意见书特别说明的事项，以本补充法律意见书的说明为准。

在本补充法律意见书中，本所仅就与发行人本次发行上市有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。本所不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项及境外法律事项发表意见，在本补充法律意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告、验资报告及境外法律意见等某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所不具备核查和评价该等数据的适当资格。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市制作的《招股说明书（申报稿）》及《招股说明书（上会稿）》中自行引用或按照中国证监会、上交所的审核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，根据有关法律、法规和中国证监会及上交所有关规定的要求，出具本补充法律意见如下：

目录

一、《上市委问询问题》第 2 题.....	5
二、《上市委问询问题》第 3 题.....	12

一、《上市委问询问题》第 2 题

发行人披露：（1）发行人控股股东为合肥建投。合肥建投通过直接及间接方式，合计控制发行人 52.99%的股份，发行人的实际控制人为合肥市国资委；（2）2019 年 12 月以前，发行人的最高权力机构董事会由 9 名董事组成，合肥建投占 5 席，不足三分之二。发行人的章程规定，发行人的重大经营、财务、人事事项需三分之二以上董事同意，部分事项需要全体董事一致同意；（3）发行人的董事长蔡国智、总经理蔡辉嘉为力积电或力晶科技前员工。

请发行人说明：（1）发行人作为合肥市国资委控制的企业，是否在组织建设、重大经营与投资决策、重要人事任免等方面纳入合肥市对国资企业的管理体系，接受合肥市有关部门的监督与管理；（2）在董事长和总经理均为力积电或力晶科技前员工、合肥建投因委派董事不足董事会议席三分之二而无法单独决定重大事项的情况下，认定合肥国资方委派董事在董事会中占实质主导地位是否依据充分，发行人是否实质为力晶科技控制或合肥市国资委与力晶科技共同控制，发行人是否存在通过实际控制人认定而规避同业竞争的情形。

请保荐机构、发行人律师说明核查程序，并发表明确意见。

回复：

（一）发行人作为合肥市国资委控制的企业，是否在组织建设、重大经营与投资决策、重要人事任免等方面纳入合肥市对国资企业的管理体系，接受合肥市有关部门的监督与管理

根据合肥市政府、合肥市国资委、合肥建投及力晶科技出具的相关确认文件、发行人及发行人子公司提供的工商档案文件、发行人报告期内历次董事会、股东大会会议文件及发行人董事、高级管理人员选聘相关文件、发行人履行国资汇报、备案或审批程序的相关文件、发行人及晶合有限历次修订后的公司章程、《审计报告》、合肥市政府与力晶科技签署的《合作框架协议》及《委托经营管理合约》、合肥市国资委对于市属国有企业管理的相关法规及文件，经本所律师访谈发行人相关管理人员，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）、企查查（<http://www.qcc.com>）、合肥市人民政府（www.hefei.gov.cn/）、合肥市国资委（gzw.hefei.gov.cn/）、合肥建投（<https://www.hfjtjt.com/>）等公开披露信息，经核查，

发行人在组织建设、重大经营与投资决策、重要人事任免等方面纳入合肥市对国有企业的管理体系，接受合肥市有关部门的监督与管理的具体情况如下：

1、组织建设方面

发行人作为国有控股企业成立了党委会，隶属于中共合肥新站高新技术产业开发区企业委员会。发行人党委会在批准设立、党员管理、党支部换届等方面均受中共合肥新站高新技术产业开发区企业委员会管理。此外，经合肥新站高新技术产业开发区总工会批准，发行人成立了工会组织。发行人工会在组织职工参与本单位的民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督等方面发挥了重要的积极作用。

2、重大经营与投资决策

公司重大经营与投资决策事项已纳入国资监管体系，具体如下：

（1）公司重大事项决策均需提交合肥建投内部审议

股改前，公司最高权力机构为董事会；股改后，公司最高权力机构为股东大会。公司召开董事会、股东大会会议前，相关议案需提交合肥建投先行内部审议，合肥建投审议通过后再由其委派的董事在董事会会议上或在股东大会会议上进行表决。

（2）公司设立、产权变动及实施员工持股计划

公司设立、历次股权变动、实施员工持股计划以及股改均按照《企业国有资产交易监督管理办法》等规定，履行了国有及国有控股企业相关的审批、资产评估及备案等程序。2021年4月，合肥市国资委出具《关于确认合肥晶合集成电路股份有限公司历史沿革中涉及国有股权变动事项合规性的函》，确认“晶合集成的设立、历次股权变动、股改等事项均履行了审批程序，符合国资监管的有关规定，不存在损害国有股东权益及造成国有资产流失的情形”。

（3）公司本次发行上市

公司本次发行上市的方案、募集资金用途以及变更募集资金投资项目等事宜，均按照国有控股企业的要求，履行了相关国资审批程序。

（4）投资设立子公司、分公司，及重要子公司股权变动

公司设立子公司、分公司，均按照《合肥市属国有企业投资管理暂行办法》中对于国有控股企业的相关规定，履行了国资审批程序，经合肥建投请示合肥市国资委批

准同意后实施；此外，2021年12月，发行人子公司新晶集成引入外部投资人进行增资扩股事宜，亦履行了国有控股企业相关的国资审批、资产评估及备案等程序。

（5）重大采购招投标

公司在确定机台、设备等重大采购的采购方式时，按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》《合肥市2016年公共资源集中交易目录》《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市2016年市级政府集中采购目录及限额标准的通知》中对于国有控股企业相关项目的规定，履行了国资审批程序，经合肥建投、合肥市公共资源交易监督管理局、合肥市政府审批后实施。

3、重要人事任免

发行人作为合肥市国资委控制的企业，董事长及总经理的聘任需履行国资审批程序，发行人历任董事长、总经理在聘任前，均已履行国资审批程序。

综上，本所认为，发行人作为合肥市国资委控制的企业，在组织建设、重大经营与投资决策、重要人事任免等方面均纳入合肥市对国资企业的管理体系，接受合肥市有关部门的监督与管理。

（二）在董事长和总经理均为力积电或力晶科技前员工、合肥建投因委派董事不足董事会席三分之二而无法单独决定重大事项的情况下，认定合肥国资方委派董事在董事会中占实质主导地位是否依据充分，发行人是否实质为力晶科技控制或合肥市国资委与力晶科技共同控制，发行人是否存在通过实际控制人认定而规避同业竞争的情形

1、董事长和总经理均为力积电或力晶科技前员工的相关情况

根据合肥市政府、合肥市国资委、合肥建投及力晶科技出具的相关确认文件、发行人报告期内历次董事会、股东大会会议文件及发行人董事、高级管理人员选聘相关文件、发行人内部管理制度、发行人履行国资汇报、备案或审批程序的相关文件，经本所律师访谈发行人董事、高级管理人员及主要股东，并经核查，发行人董事长和总经理均为力积电或力晶科技前员工的相关情况如下：

公司董事长的主要职责包括担任公司法定代表人、对外代表公司，以及召集、主持董事会会议等，力晶科技系国际知名的晶圆制造企业，在晶圆代工领域具有多年的行业经验，由力晶科技推荐具有相关行业经验的人选担任董事长，对于公司在行业内

的形象、知名度以及与产业链上下游合作伙伴沟通方面具有一定帮助。因此，在双方合作初期协商，由力晶科技推荐公司董事长人选，并在合肥国资方对其背景审核后，提交董事会审议通过。发行人股改后，根据公司章程，公司董事长由董事会选举产生，未再约定董事长由力晶科技推荐，但公司董事会考虑到经营策略的稳定以及对外企业形象，未更换董事长人选。在董事会会议上，董事长除负责主持董事会会议外，与其他董事拥有的表决权相同，发行人重大事项由董事会集体决策，董事长无法单独决策重大事项。此外，发行人重大事项除由董事会审议外，尚需履行相关国资审批程序。

公司总经理蔡辉嘉于 2016 年 6 月自力晶科技离职并加入公司，已与公司签署了劳动合同，自力晶科技离职后与力晶科技及下属公司不再存在劳动关系、雇佣关系或其他受力晶科技管控的关系。公司总经理的主要职责包括主持公司的生产经营管理工作、组织实施董事会决议等，系公司经营计划执行层面的负责人，对于公司董事会、股东大会决策无重大影响。

此外，发行人在选举、聘任董事长及总经理前，均履行了国资相关审批程序。

因此，董事长和总经理均为力积电或力晶科技前员工不会对合肥市国资委在发行人的实际控制人地位造成重大不利影响。

2、历史上合肥建投因委派董事不足董事会议席三分之二而无法单独决定重大事项的相关情况

根据发行人出具的说明、合肥市政府、合肥市国资委、合肥建投及力晶科技出具的相关确认文件、发行人及晶合有限历次修订后的公司章程及合资合同、合肥市政府与力晶科技签署的《合作框架协议》及《委托经营管理合约》、发行人报告期内历次董事会、股东大会会议文件，经本所律师访谈发行人董事、高级管理人员及主要股东，并经核查，历史上合肥建投因委派董事不足董事会议席三分之二而无法单独决定重大事项的相关情况：

（1）董事会席位设置的原因及背景

2015 年 4 月，合肥市人民政府与力晶科技签订《合作框架协议》中即约定，项目设董事 9 席，其中合肥国资方指派 5 席董事，力晶科技指派 4 席董事。该等董事会席位设置的原因主要系在双方合作初期，投资项目的前景不明朗，力晶科技出于降低其在中国大陆投资风险及增强在合资企业重大决策等方面的参与度等考虑，合肥市人民政府

政府出于招商引资需要及保护小股东利益考虑，经双方友好协商确定，并在《合作框架协议》中对于合资公司的董事会席位进行了明确约定。

（2）董事会未发生力晶科技委派董事单方面反对或弃权而无法形成决策的情形

公司召开董事会会议前，相关议案需提交合肥建投先行内部审议，合肥建投审议通过后再由其委派的董事在董事会会议上进行表决。合肥国资方委派董事在发行人董事会中占实质主导地位，报告期内公司历次董事会会议上力晶科技委派董事均未对相关审议事项投反对票。仅在董事会审议合肥建投向发行人提供委托贷款及担保等相关事项时，出现过 1 次合肥国资方全体委派董事投同意票，力晶科技 2 名委派董事弃权、2 名委派董事同意，但仍获得董事会通过的情况。未发生因力晶科技委派董事单方面反对而无法形成决策的情形。未发生因力晶科技委派董事单方面反对而无法形成决策的情形。

（3）合肥市人民政府出具的确认函

2021 年 8 月，合肥市人民政府出具确认函：“晶合集成自成立以来，均系在合肥国资方的主导下建设、发展，并未将经营管理权交予力晶科技，合肥市国资委一直系晶合集成的实际控制人，不存在晶合集成实质为力晶科技控制或合肥市国资委与力晶科技共同控制的情形。”

（4）力晶科技出具的确认函

2021 年 3 月及 8 月，力晶科技分别出具确认函：“自入股晶合集成以来，本企业充分认可合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”）方的控股股东地位，对晶合集成重大决策战略方针、企业发展方向、经营决策、重大投资等具有决定性影响力，认可并尊重合肥市国有资产监督管理委员会（以下简称“合肥市国资委”）作为晶合集成实际控制人的地位，本企业自入股以来未以任何形式谋求对晶合集成的控制权，亦不存在与合肥市国资委共同控制晶合集成的情形。

2019 年 12 月前，根据晶合集成的公司章程及合资合同，晶合集成的董事会由 9 名董事组成，其中本企业有权委派 4 名董事，且晶合集成的重大事项需经 2/3 以上出席会议董事投赞成票方可通过。该等董事会席位设置系出于保护本企业在中国大陆投资安全性考虑而与合肥国资委、合肥建投方协商确定，自本企业入股晶合集成以来，不存在通过委派的董事阻碍或影响合肥建投方、合肥市国资委对于晶合集成的控制权的情

形。”

“本企业认可并尊重合肥市国有资产监督管理委员会（以下简称“合肥市国资委”）作为晶合集成实际控制人的地位，且从未与合肥市人民政府、合肥市国资委、合肥建投或合肥芯屏中的一方或多方签订一致行动协议，本企业与合肥市人民政府、合肥市国资委、合肥建投或合肥芯屏之间不存在关于晶合集成控制权的任何协议或安排，不存在晶合集成实质为本企业控制或合肥市国资委与本企业共同控制的情形。”

因此，历史上合肥建投因委派董事不足董事会议席三分之二而无法单独决定重大事项的相关情况不会对合肥市国资委在发行人的实际控制人地位造成重大不利影响。

3、认定合肥国资方委派董事在董事会中占实质主导地位是否依据充分

基于上述，虽然董事长和总经理均为力积电或力晶科技前员工，2019年12月前，合肥建投委派董事虽未达2/3，但董事会席位设置具备合理的背景，董事会执行层面亦未发生因力晶科技委派董事单方面反对或弃权而无法形成决策的情形，结合合肥市人民政府和力晶科技的确认，认定发行人董事会实际运营层面由合肥国资方委派董事占实质主导地位依据充分。

4、发行人是否实质为力晶科技控制或合肥市国资委与力晶科技共同控制

根据合肥市政府、合肥市国资委、合肥建投及力晶科技出具的相关确认文件、发行人提供的工商档案文件、发行人及晶合有限历次修订后的公司章程及合资合同、发行人及晶合有限历次股东大会、董事会会议文件、发行人主要股东出具的承诺文件，经本所律师访谈发行人董事、高级管理人员、主要股东及力晶科技高级管理人员，并经核查，发行人不存在实质为力晶科技控制或合肥市国资委与力晶科技共同控制的情形，具体情况如下：

（1）不存在力晶科技单方控制发行人的情形

①力晶科技在发行人最高权力机构中未占主导地位

发行人股改前，最高权力机构为董事会，力晶科技持有晶合有限的股权比例均在50%以下，委派的董事人数未达半数；自2016年3月晶合有限设立董事会至股改前，晶合有限共计召开33次董事会，历次董事会会议上力晶科技委派董事均未对相关审议事项投反对票。仅在董事会审议合肥建投向发行人提供委托贷款及担保等相关事项时，出现过1次合肥国资方全体委派董事投同意票，力晶科技2名委派董事弃权、2名委派

董事同意，但仍获得董事会通过的情况。未发生因力晶科技委派董事单方面反对而无法形成决策的情形。

发行人股改后，最高权力机构为股东大会，力晶科技持有发行人的股份比例为27.44%，提名的董事人数仅为1/3。

②力晶科技委派高级管理人员数量较少且主要起监督作用

自2016年3月至2020年期间，力晶科技向发行人委派高级管理人员包括行政副总经理、审计师、财务副总经理，其中，行政副总经理仅在发行人短期任职，在帮助发行人结合行业特点，落地、改善相关制度的运作后即返回；审计师、财务副总经理为力晶科技长期委派岗位，主要作用为通过参与发行人财务事项审批及内部审计流程，对发行人财务状况实施监督，防止控股股东滥用控股地位。

力晶科技在发行人最高权力机构中未占主导地位，力晶科技委派高级管理人员数量较少且主要起监督作用，不存在力晶科技单方控制发行人的情形。

(2) 不存在合肥市国资委与力晶科技共同控制的情形

根据合肥建投、力晶科技出具的确认函，力晶科技与合肥市人民政府、合肥市国资委、合肥国资方之间从未签订一致行动协议，亦不存在与发行人控制权相关的约定或类似安排，不存在合肥市国资委与力晶科技共同控制发行人的情形。

因此，发行人不存在实质为力晶科技控制或合肥市国资委与力晶科技共同控制的情形。

5、发行人是否存在通过实际控制人认定而规避同业竞争的情形

报告期内，发行人与力晶科技及力积电均从事晶圆代工业务。力晶科技与发行人独立开展经营，力晶科技作为发行人股东，通过委派董事正常参与发行人具体生产经营管理，不存在通过股东地位及委派董事导致双方非公平竞争、利益输送、相互或单方让渡商业机会的情形。发行人自设立以来一直由合肥市国资委实际控制，控股股东始终为合肥建投，发行人不存在与控股股东及其控制的其他企业从事相同或相似业务的情形，不存在同业竞争情况。

除此，力晶科技已承诺：“除力积电外，本公司及本公司下属企业目前不存在在中国境内外，以任何方式直接或间接从事与晶合集成及其控股子公司所从事的主营业

务相同或相似业务的情形。本公司目前及将来不会利用股东地位谋求不正当利益或作出不利于晶合集成而有利于本公司下属企业的任何决定，不会损害晶合集成及其他股东的合法权益。若因违反本承诺函的任何条款而导致晶合集成遭受损失的，本公司将依法赔偿，最终赔偿方案由双方协商确定或由有管辖权的法院作出的生效判决确定。本公司保证将严格遵循相关法律法规和上海证券交易所及中国证监会的要求，确保晶合集成按照上市公司的规范独立自主经营，保证晶合集成的资产、业务、财务、人员、机构独立。”

因此，发行人不存在通过实际控制人认定而规避同业竞争的情形。

综上，本所认为，认定合肥国资方委派董事在董事会中占实质主导地位依据充分，发行人不存在实质为力晶科技控制或合肥市国资委与力晶科技共同控制的情形，发行人不存在通过实际控制人认定而规避同业竞争的情形。

二、《上市委问询问题》第3题

发行人披露：（1）2015年10月，发行人与力晶科技签订《委托经营管理合约》，约定力晶科技应将公司视为其工厂之延伸，以便扩充产能并且达到IPO的目标。2020年1月2日，发行人与力晶科技签约，终止上述《委托经营管理合约》。发行人声称，上述合约中的“日常经营运作，包含业务、生产营运、组织人事、技术等皆委托力晶科技管理”等条款未实际履行，发行人未将经营管理权委托予力晶科技；（2）发行人主要客户和供应商均与力晶科技重叠，奇景光电和奕力科技的工艺平台验证主要来自力晶科技，后续与该等客户谈判、确定合作、试产、风险量产、量产以及后续客户关系维护等则由发行人独立完成；（3）根据《合作框架协议》《委托经营管理合约》，在力晶科技入股发行人后，部分员工从力晶科技离职后加入发行人。发行人还通过在中国台湾地区相关媒体刊登招聘信息等方式，自行招聘中国台湾地区员工。截至2021年6月30日，发行人拥有在职中国台湾员工288名，其中111名在加入发行人前曾在力晶科技、力积电或力积电子工作；（4）合肥建投和力晶科技通过向发行人委派管理人员的方式向发行人提供企业管理、会计等相关咨询服务，并收取相应的咨询服务费；委派人员中包括短期委派人员与长期委派人员。发行人于2018年、2019年向力晶科技分别支付专业服务费和技术费1,707.20万元和2,057.75万元，于2018年、2019年、2020年向合肥建投分别支付咨询服务费696.22万元、672.40万元和199.68万元。

请发行人结合与力晶科技的合作历史和自身未来发展规划说明：（1）发行人在人员、技术、业务等方面是否对力晶科技持续存在重大依赖，现在及将来是否会与力晶科技及其子公司持续存在同业竞争，发行人在人员、技术、业务方面是否具备独立性；（2）发行人存在部分员工曾在力晶科技、力积电或力积电子工作的经历，是否存在违反竞业限制、保密条款的风险；（3）发行人支付上述专业服务费、技术费和咨询服务费的原因及合理性，上述费用的计算过程和定价公允性。

请保荐代表人、发行人律师发表核查意见。

回复：

（一）发行人在人员、技术、业务等方面是否对力晶科技持续存在重大依赖，现在及将来是否会与力晶科技及其子公司持续存在同业竞争，发行人在人员、技术、业务方面是否具备独立性

1、发行人在人员、技术、业务等方面是否对力晶科技持续存在重大依赖，是否具备独立性

根据发行人出具的说明、《招股说明书（上会稿）》《审计报告》、合肥市政府、合肥市国资委、合肥建投及力晶科技出具的相关确认文件、发行人及晶合有限历次修订后的公司章程及合资合同、合肥市政府与力晶科技签署的《合作框架协议》及《委托经营管理合约》、发行人提供的花名册、发行人报告期内历次董事会、股东大会会议文件及发行人董事、高级管理人员选聘相关文件、发行人技术相关协议、发行人采购及销售合同、本所律师访谈发行人客户、供应商的访谈笔录，经本所律师访谈发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、力晶科技高级管理人员，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）、企查查（<http://www.qcc.com>）、百度（<http://www.baidu.com>）、谷歌（<http://www.google.com>）等公开披露信息，经核查，发行人在人员、技术、业务等方面的具体情况如下：

（1）人员方面

根据《合作框架协议》《委托经营管理合约》，2016年，力晶科技在入股发行人后，部分员工考虑到更好的职业发展空间，从力晶科技离职并加入发行人，该等员工自力晶科技离职后与力晶科技及关联公司不再存在劳动关系、雇佣关系或其他受力晶科技管控的关系。同时，发行人也通过在中国台湾地区相关招聘网站上刊登招聘信息

等方式，自行招聘中国台湾员工。截至 2021 年 6 月 30 日，发行人拥有在职中国台湾员工 288 名，其中 111 名中国台湾员工加入公司前曾在力晶科技、力积电或力积电子工作。截至本补充法律意见书出具日，发行人员工均与发行人签署了劳动合同，并解除了与前任雇主的劳动合同。

2018 年 5 月前，力晶科技根据《委托经营管理合约》在短期内向发行人委派部分管理人员，协助发行人结合晶圆制造行业经验及中国大陆特点，完成财务、内部控制及稽核等制度的落地，完成任务后即返回力晶科技；2020 年 3 月前，力晶科技根据《合资合同》《投资参股协议》向发行人委派审计师等管理人员，主要作用为通过参与发行人财务事项审批及内部审计流程，对发行人财务状况实施监督，防止控股股东滥用控股地位。上述人员在帮助发行人落地、改善相关制度的运作，提高发行人内部控制和稽核能力，传授财务核算经验等方面提供了帮助。截至报告期末，发行人高级管理人员均由发行人聘任，不涉及股东委派的情形。

因此，报告期内，发行人人员方面对力晶科技不存在重大依赖，具备独立性。

（2）技术方面

在 LCD 工艺平台方面，发行人 150nm-90nm LCD 显示驱动芯片技术为在力晶科技的技转技术基础上进行改良优化、创新升级后形成。2015 年，力晶科技依据《技术移转协议》，将 LCD 显示驱动芯片代工相关的 90 纳米、110 纳米、150 纳米工艺制程的基础技术文件及规格文件提供给发行人，并于 2018 年 3 月 31 日完成技转。2018 年，发行人同力晶科技签订了《90nm 项目技术协议》，导入 90nm M+ 技术平台。在取得力晶科技转让的相关技术后，为更好地满足客户需求，提升自身的市场竞争力，发行人针对市场需求，由发行人自身的研发团队采取了一系列技术研发措施，对工艺结构和工艺流程进行了自主设计和创新升级，形成了发行人的核心技术平台，并将部分技术成果申请并获得了专利。

在其他工艺平台方面，发行人 LED 显示驱动、CIS、E-tag、MCU、PMIC 以及 55nm 逻辑及显示驱动芯片等领域的核心技术平台均为自主研发。未来，发行人将利用上市募集资金投入至 40nm、28nm 等更先进制程平台的自主研发，进一步增强先进制程服务能力，拓宽产品结构。

在研发团队方面，发行人现研发团队已超过 400 人，研发团队均与发行人签署劳

动合同，独立自主。

在专利方面，发行人已取得境内外专利合计超过 200 项，另有近 200 项专利在审，并承担了多项省内重点研发项目。

因此，报告期内，发行人技术方面对力晶科技不存在重大依赖，具备独立性。

（3）业务方面

①在客户开拓方面

发行人建设初期（2016 年），根据发行人与力晶科技签订的《技术移转协议》，力晶科技向发行人引荐了奇景光电和奕力科技两家客户，以进行技术平台验证、满足技转完成条件；发行人于 2017 年 9 月、11 月分别和奕力科技及奇景光电确认了技术转让平台的适用性后，与奇景光电、奕力科技独立沟通、谈判签署相关合同订单，并完成后续试产、风险量产、量产以及客户关系维护等工作。2016 年 11 月，发行人独立与联咏科技建立了合作意向，2017 年 3 月，发行人选定联咏科技作为 150nm 工艺平台首个客户，由于当时发行人的工厂尚未竣工，尚不具备生产能力，因此力晶科技应发行人要求在其工厂内配合对 150nm 平台进行了验证。此外，由于发行人在 2018 年 6 月前不具备光罩设计能力，发行人曾委托力晶科技在 2018 年 6 月前协助发行人针对奇景光电、奕力科技、联咏科技、集创北方、敦泰电子等主要客户进行光罩设计；2018 年 7 月后发行人具备光罩设计能力，力晶科技不再参与该环节。

除上述情况外，发行人全部客户均由发行人独立开发、谈判及维护，无力晶科技及力积电参与，主要包括：发行人与客户对接的销售人员均为发行人员工，与发行人签署独立劳动关系合同，与力晶科技不存在劳动关系；发行人销售人员与客户通过邮件、电话、现场拜访等方式取得联系，沟通确认需求，正式订单由客户主要通过邮件等方式直接向发行人下达，发行人与客户的销售合同均由发行人与客户直接签署，前述过程无力晶科技及力积电参与。

②在供应商开拓方面

发行人建设初期，根据发行人与力晶科技签订的《技术移转协议》，发行人自力晶科技处取得了相关技术文件，其中的《合格供应商名单》载明了技转平台涉及的所需主要设备、原材料的供应商名称，由于集成电路行业上游设备及原材料行业集中度较高，该名单中供应商主要为行业知名企业。在发行人生产经营初期，为确保技转成

功、品质稳定，发行人结合过往行业经验及生产经营的实际需要，主要向《合格供应商名单》中载明的供应商进行采购；该采购过程均为发行人独立谈判、议价，并由发行人与供应商独立签署协议或订单，无力晶科技及力积电参与。

技转完成后，为加强成本控制、保证晶圆代工服务质量、提高生产效率和存货周转效率，公司已建立严格的采购流程和供应商管理体系。截至本补充法律意见出具日，发行人已通过独立开拓的方式，与中微半导体、屹唐半导体、北方华创、液化空气及其关联企业、重庆超硅半导体有限公司等《合格供应商名单》外的知名供应商建立了良好的采购合作关系，扩大供应商范围，降低供应链风险。

发行人与供应商独立联系并建立合作，主要包括：发行人与供应商对接的采购人员均为发行人员工，与发行人签署独立劳动关系合同，与力晶科技不存在劳动关系；发行人采购人员与供应商通过邮件、电话、现场拜访等方式取得联系，沟通确认发行人需求，正式订单由发行人直接向供应商下达，发行人与供应商的采购合同均由发行人与供应商直接签署，前述过程无力晶科技及力积电参与。

因此，报告期内，发行人业务方面对力晶科技不存在重大依赖，具备独立性。

综上，报告期内，发行人在人员、技术、业务等方面对力晶科技持续不存在重大依赖，具备独立性。

2、现在及将来是否会与力晶科技及其子公司持续存在同业竞争

根据合肥市政府、合肥市国资委、合肥建投及力晶科技出具的相关确认文件、发行人主要股东出具的承诺文件，经本所律师访谈发行人主要股东，并经核查，发行人现在及将来不会与力晶科技及其子公司持续存在同业竞争，具体情况如下：

如前所述，发行人实际控制人为合肥市国资委，力晶科技为发行人第二大股东，发行人与力晶科技及其子公司之间不构成《科创板注册管理办法》所规定的同业竞争。

根据力晶科技出具的确认函，力晶科技自入股以来未以任何形式谋求对晶合集成的控制权，亦不存在与合肥市国资委共同控制晶合集成的情形，将来亦不谋求对发行人的控制权。力晶科技及力晶科技下属企业在资产、业务、人员、机构、财务等方面均与晶合集成相互独立，不存在与晶合集成共用资产或资产混同、相互参与业务开拓、人员在晶合集成兼职或领薪、与晶合集成机构混同等影响晶合集成独立性的情形。除力晶科技向晶合集成提名并获晶合集成聘任的董事在晶合集成董事会层面参与公司重

大事项的决策外，力晶科技及力晶科技下属企业不存在干预晶合集成采购、生产、销售、研发、财务、人事等日常经营决策的情形。除力积电外，力晶科技及力晶科技下属企业目前不存在在中国境内外，以任何方式直接或间接从事与晶合集成及其控股子公司所从事的主营业务相同或相似业务的情形。力晶科技目前及将来不会利用股东地位谋求不正当利益或作出不利于晶合集成而有利于力晶科技下属企业的任何决定，不会损害晶合集成及其他股东的合法权益。力晶科技保证将严格遵循相关法律法规和上海证券交易所及中国证监会的要求，确保晶合集成按照上市公司的规范独立自主经营，保证晶合集成的资产、业务、财务、人员、机构独立。

综上，发行人现在及将来不会与力晶科技及其子公司存在同业竞争。

综上所述，本所认为，报告期内，发行人在人员、技术、业务等方面对力晶科技持续不存在重大依赖，具备独立性；发行人现在及将来不会与力晶科技及其子公司存在同业竞争。

（二）发行人存在部分员工曾在力晶科技、力积电或力积电子工作的经历，是否存在违反竞业限制、保密条款的风险

根据力晶科技出具的确认函，发行人曾在力晶科技、力积电或力积电子工作的员工不存在违反原任职单位竞业限制义务及保密条款的情形，力晶科技、力积电或力积电子与发行人及上述员工之间不存在争议或纠纷。

根据中国台湾地区律师出具的法律意见书，发行人来自于中国台湾地区的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未提供任何中国台湾公司竞业禁止的承诺，包含其未与任何前任雇主签署离职后竞业禁止的约定

经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）、企查查（<http://www.qcc.com>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）、人民法院公告网（<https://rmfygg.court.gov.cn/>）等公开披露信息，截至本补充法律意见出具日，发行人不存在与员工违反竞业限制或保密义务相关的纠纷。

综上，本所认为，发行人曾在力晶科技、力积电或力积电子工作的员工不存在违反竞业限制、保密条款的风险。

（三）发行人支付上述专业服务费、技术费和咨询服务费的原因及合理性，上述

费用的计算过程和定价公允性

根据发行人与合肥建投签署的咨询服务合约、发行人与力晶科技签订的《90nm 项目技术协议》、发行人关联交易决策文件等资料，并经本所律师与发行人、合肥建投、力晶科技相关人员进行访谈，发行人支付上述专业服务费、技术费和咨询服务费的具体情况如下：

1、发行人报告期向力晶科技支付专业服务费、技术费，向合肥建投支付咨询服务费情况

单位：万元

公司名称	交易内容	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
力晶科技	技术费	-	-	2,031.58	1,372.64
力晶科技	专业服务费	-	-	26.17	334.56
合肥建投	咨询服务	-	199.69	672.40	696.23

2、发行人向力晶科技支付专业服务费、技术费的原因及合理性，上述费用的计算过程和定价公允性

（1）发行人向力晶科技支付技术费

报告期各期，发行人向力晶科技支付的技术费分别为 1,372.64 万元、2,031.58 万元、0.00 万元和 0.00 万元，主要系 90nm 相关技术平台的后续技术移转费用。

根据发行人与力晶科技签订的《90nm 项目技术协议》，合同金额 500 万美元。发行人为在原有面板驱动芯片基础上，强化产品应用，与力晶科技签订该技术转让协议，导入 90nm 衍生技术及 90nm M+ 技术平台，并于 2018 年度、2019 年度向力晶科技分别支付技术费 200.00 万美元、300.00 万元美元。

根据致远国际财务顾问股份有限公司出具的《无形资产价值评估分析报告》，以上 90nm 衍生技术及 90nm M+ 技术平台采取重置成本法评估的价值为 512-539 万美元，与交易价格不存在重大差异，并履行了关联交易审批程序，定价合理、公允。

（2）发行人向力晶科技支付专业服务费

报告期各期，发行人向力晶科技支付的专业服务费分别为 334.56 万元、26.17 万元、0.00 万元和 0.00 万元，主要系投产初期公司不具备光罩设计能力，因此向力晶科技采

购的光罩设计服务。采购价格系遵循市场化交易原则，双方协商确定，并履行了关联交易审批程序，价格具备公允性。

3、发行人向合肥建投支付咨询服务费的原因及合理性，上述费用的计算过程和定价公允性

根据《投资参股协议》《合资合同》，合肥建投向发行人委派管理人员，提供企业管理、财务、会计及采购、销售、敬业等相关咨询服务。发行人与合肥建投签署的三份《咨询服务合约书》，双方约定的咨询服务期间分别为 2016 年 3 月 9 日至 2019 年 3 月 8 日、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。根据约定，报告期内，合肥建投向发行人提供的咨询服务范围，包括企业管理、财务、会计、采购、销售、敬业等业务相关的制度建立、日常作业咨询、人员训练等专业服务。

报告期内，合肥建投通过向发行人委派部分管理人员的方式向发行人提供上述咨询服务，发行人向合肥建投支付咨询服务费用。咨询服务费定价系以发行人同等职级岗位的平均薪酬为依据确定，并履行了关联交易审批程序，定价合理、公允。

报告期各期，发行人向合肥建投采购上述咨询服务确认的咨询服务费涉及岗位如下：

单位：万元

合肥建投委派人员 任职岗位	发行人确认的咨询服务费 ¹		
	2020 年度 ²	2019 年度	2018 年度
副董事长	56.60	233.96	226.42
敬业促进委员会委员长	30.49	125.47	125.47
总会计师	28.15	116.04	115.09
审计师	28.15	-	-
采购副总监	21.11	51.64	84.91
销售副总监	21.11	86.79	86.79
财务部门负责人	14.07	58.49	57.55

¹ 以上金额为不含增值税金额。

² 2020 年度发行人向合肥建投采购上述咨询服务确认的咨询服务费系基于 2020 年实际服务天数计算。

合肥建投委派人员 任职岗位	发行人确认的咨询服务费 ¹		
	2020 年度 ²	2019 年度	2018 年度
合计	199.69	672.40	696.23

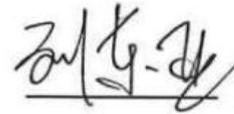
综上，本所认为，发行人向力晶科技支付的专业服务费用为公司投产初期公司向力晶科技支付的光罩设计服务费用，采购价格系遵循市场化交易原则，具备公允性；支付的技术费为公司向力晶科技支付的 90nm 相关技术平台的后续技术移转费用，定价合理、公允；3、发行人向合肥建投采购相关咨询服务，主要是由于合肥建投熟悉大陆地区政策、法规及作业习惯，发行人委托合肥建投提供企业管理、财务、会计及采购、销售、敬业等相关咨询服务，咨询服务费定价系以发行人同等职级岗位的平均薪酬为依据确定，定价合理、公允。

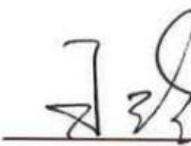
（本页以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（四）》之签章页）



经办律师： 
苏 峥


刘东亚

单位负责人： 
王 玲

二〇二二年三月九日

北京市金杜律师事务所
关于合肥晶合集成电路股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
补充法律意见书（五）

致：合肥晶合集成电路股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已出具《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市之补充法律意见书（一）》（以下简称《补充法律意见书（一）》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（二）》（以下简称《补充法律意见书（二）》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（三）》（以下简称《补充法律意见书（三）》）和《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（四）》（以下简称《补充法律意见书（四）》）。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 15 日出具了《合肥晶合集成电路股份有限公司审计报告》（容诚审字[2022]第 230Z0100 号）（以下简称《2019-2021 年度审计报告》）对公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度（以下简称报告期）财务报表进行审计，并出具了《合肥晶合集成电路股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0082 号）（以下简称《2021 年度内控报告》）。本所现根据《2019-2021 年度审计报告》《2021 年度内控报告》及发行人招股说明书和其他相关申报文件的修改和变动，就其中所涉及的法律问题，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对本所已出具的《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》的补充，并构成《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》不可分割的一部分；本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》中对相关用语的释义、缩写适用于本补充法律意见书；本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》中发表法律意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见书。对于本补充法律意见书特别说明的事项，以本补充法律意见书的说明为准。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市制作的《招股说明书（注册稿）》中自行引用或按照中国证监会、上交所的审核要

求引用本补充法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，出具补充法律意见如下：

目录

第一部分 发行人本次发行上市相关情况的更新.....	5
一、本次发行上市的批准和授权.....	5
二、发行人本次发行上市的主体资格.....	5
三、本次发行上市的实质条件.....	5
四、发行人的独立性及其变化情况.....	9
五、发起人和股东的变化情况.....	9
六、发行人的股本及其演变.....	21
七、发行人的业务.....	21
八、关联交易及同业竞争及其变化情况.....	22
九、发行人的主要财产及其变化情况.....	31
十、发行人的重大债权债务变化情况.....	35
十一、发行人的重大资产变化及收购兼并.....	40
十二、发行人公司章程的制定与修改.....	40
十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	40
十四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化.....	41
十五、发行人的税务及其变化情况.....	42
十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准的变化情况.....	43
十七、发行人的劳动与社会保障及其变化情况.....	45
十八、发行人募集资金的运用.....	46
十九、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况.....	46
二十、发行人《招股说明书（注册稿）》法律风险的评价.....	47
二十一、本次发行上市的总体结论性意见.....	48
第二部分 财务数据更新至 2021 年 12 月 31 日后《问询函》中涉及的相关问题回复内容的更新.....	49
附件一：发行人及其子公司拥有的知识产权.....	68

第一部分 发行人本次发行上市相关情况的更新

一、 本次发行上市的批准和授权

根据发行人提供的董事会和股东大会的会议文件并经本所律师核查，2022年3月，发行人分别召开第一届董事会第十次会议、2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于延长合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案有效期的议案》等相关议案，具体内容如下：

2021年3月16日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于合肥晶合集成电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案的议案》。根据股东大会审议，本次发行方案有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。根据公司本次A股股票发行并上市事宜的进展，经董事会研究，拟决定将本次A股股票发行并上市方案的有效期限延长至：本次议案经2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。原发行上市方案其它内容不变。

本所认为，发行人本次发行上市已获得的批准及授权仍然有效；发行人本次发行尚需上交所科创板股票上市委员会的审核，并报中国证监会履行发行注册程序；本次发行完成后，发行人股票于上交所上市交易尚待获得上交所审核同意。

二、 发行人本次发行上市的主体资格

根据发行人工商档案资料、《营业执照》《企业信用报告》、合肥新站高新技术产业开发区市场监督管理局出具的证明，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>），截至本补充法律意见书出具日，发行人仍为合法存续的股份有限公司，不存在根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》需要终止的情形，发行人仍具备本次发行上市的主体资格。

三、 本次发行上市的实质条件

（一） 本次发行上市符合《公司法》《证券法》的相关条件

1、根据发行人本次发行上市相关股东大会决议及发行人书面说明，发行人本次发行的股票为每股面值 1.00 元的人民币普通股股票，每股的发行条件和价格相同，每一股份具有同等权利，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事和董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

3、根据《2019-2021 年度审计报告》、发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》、发行人及其境内子公司相关主管部门出具的证明及发行人书面说明，截至本补充法律意见书出具日，发行人依法存续，不存在因违法经营而被相关主管部门责令停业整顿或吊销营业执照的情形，不存在根据法律、法规及《公司章程》规定需要终止的情形。发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

4、根据《2019-2021 年度审计报告》，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

5、根据发行人及其子公司所在地公安机关出具的证明、发行人控股股东填写的调查表及发行人书面说明，并经本所律师核查，发行人及其控股股东最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

（二）本次发行上市符合《注册管理办法》规定的相关条件

1、如本补充法律意见书第一部分“二、发行人本次发行上市的主体资格”所述，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司；发行人已依法设立股东大会、董事会、监事会以及相关职能部门，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

2、根据《2019-2021 年度审计报告》《2021 年度内控报告》和发行人书面说明，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露

规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具标准无保留意见的《2019-2021 年度审计报告》；根据《2021 年度内控报告》和发行人书面说明，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具标准无保留意见的《2019-2021 年度审计报告》，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

（1）如本补充法律意见书第一部分“四、发行人的独立性及其变化情况”所述，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立；如本补充法律意见书第一部分“八、关联交易及同业竞争及其变化情况”所述，发行人与控股股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项之规定。

（2）如本补充法律意见书第一部分“七、发行人的业务”所述，截至本补充法律意见书出具日，发行人的主营业务最近两年内未发生重大不利变化；如本补充法律意见书第一部分“十四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”所述，发行人的董事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内未发生重大不利变化；如本补充法律意见书第一部分“五、发起人和股东”所述，发行人的股权权属清晰，截至本补充法律意见书出具日，控股股东和受控股股东支配的股东持有的发行人股份权属清晰，最近两年控制权稳定、实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项之规定。

（3）如本补充法律意见书第一部分“九、发行人的主要财产及其变化情况”“十、发行人的重大债权债务变化情况”及“十八、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况”所述，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项之规定。

4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策：

（1）如本补充法律意见书第一部分“七、发行人的业务”所述，根据工商、税务等相关政府部门出具的证明文件和发行人书面说明，经本所律师核查，发行人生产经

营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定。

(2) 如本补充法律意见书第一部分“十八、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况”所述，根据发行人及其子公司所在地相关政府部门出具的证明文件、发行人控股股东填写的调查表及发行人书面说明，并经本所律师核查，最近三年内，发行人及其控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

(3) 如本补充法律意见书第一部分“十八、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况”所述，根据发行人董事、监事和高级管理人员填写的调查表，经本所律师核查，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第三款的规定。

(三) 本次发行上市符合《上市规则》规定的相关条件

1、本次发行上市符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》规定的发行条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定。

2、根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》及《招股说明书（注册稿）》，本次发行上市后股本总额不少于 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

3、根据《招股说明书（注册稿）》和本次发行上市相关股东大会决议，发行人股本总额超过 4 亿元，本次发行完成后，发行人公开发行的股份数将达到本次发行后发行人股份总数的 10%以上，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

4、根据《2019-2021 年度审计报告》、保荐机构出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司预计市值的分析报告》及发行人书面说明，发行人申请本次发行上市，预计市值不低于 30 亿元，且最近一年营业收入不低于 3 亿元，符合《上市规则》第

2.1.2 条第（四）项规定的市值和财务指标标准及第 2.1.1 条第（四）项的规定。

综上，本所律师认为，发行人仍具备本次发行上市的实质条件。

四、 发行人的独立性及其变化情况

根据发行人提供的业务合同台账、订单台账及重大业务合同、订单等相关文件资料、发行人高级管理人员填写的调查表，并经本所律师审阅发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》及《2019-2021 年度审计报告》《2021 年度内控报告》等书面材料，以及发行人的确认，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人业务、资产、人员、机构及财务独立性情况未发生变化，发行人资产完整且仍具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

五、 发起人和股东的变化情况

根据发行人提供的资料并经本所核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的股东变化情况如下：

1、 惠友豪创

根据惠友豪创的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日日，惠友豪创的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	杨庆	有限合伙人	49000	40.8333%
2	周祥书	有限合伙人	12000	10.0000%
3	杨林	有限合伙人	10000	8.3333%
4	深圳市创荟投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8800	7.3333%
5	共青城坤翎豪创投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7200	6.0000%
6	刘晨露	有限合伙人	5000	4.1667%
7	孙义强	有限合伙人	5000	4.1667%
8	深圳市伯翰创盈信息服务合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5000	4.1667%
9	深圳市瑞成永泽投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5000	4.1667%

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
10	深圳市前海君爵投资管理有限公司	有限合伙人	5000	4.1667%
11	深圳市创欣诚创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5000	4.1667%
12	苏州锦天前程投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	1000	0.8333%
13	刘军	有限合伙人	1000	0.8333%
14	深圳市新思哲投资管理有限公司	有限合伙人	1000	0.8333%
15	深圳市惠友创盈投资管理有限公司	普通合伙人	0.01	0%
	合计	-	120,000.01	100.00%

深圳市伯翰创盈信息服务合伙企业（有限合伙）已将其持有惠友豪创的全部出资额转让给王赫，并于 2022 年 1 月 26 日办理完成工商变更。

2、海通创新

根据海通创新的工商档案，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，海通创新已增资并于 2021 年 12 月 2 日完成工商变更登记，变更后的注册资本为 1,150,000 万元人民币，股东仍为海通证券股份有限公司。

3、集创北方

根据集创北方的股东名册并经本所律师核查，集创北方的股东结构发生变更。截至 2021 年 12 月 31 日，集创北方的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例
1	张晋芳	76,687,466	17.7899%
2	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	41,152,542	9.5467%
3	北京永昌寰宇投资有限公司	28,332,633	6.5727%
4	北京永昌环宇投资中心（有限合伙）	17,158,980	3.9806%
5	北京集智非凡科技中心（有限合伙）	17,888,483	4.1498%
6	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	16,098,932	3.7347%
7	天津海松股权投资合伙企业（有限合伙）	14,809,938	3.4357%
8	北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	13,048,091	3.0269%
9	宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限	12,823,803	2.9749%

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例
	合伙)		
10	国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业 (有限合伙)	10,780,579	2.5009%
11	珠海科技创业投资有限公司	10,089,921	2.3407%
12	珠海大横琴创新发展有限公司	10,089,921	2.3407%
13	厦门源峰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,464,197	1.7316%
14	北京集创寰宇科技中心(有限合伙)	7,394,492	1.7154%
15	维沃移动通信有限公司	6,856,452	1.5906%
16	深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)	6,509,036	1.5100%
17	集创芯恒(珠海)科技中心(有限合伙)	5,305,339	1.2308%
18	苏州哲思灵行投资合伙企业(有限合伙)	5,120,775	1.1879%
19	上海聚源载兴投资中心(有限合伙)	4,997,900	1.1594%
20	厦门南圉秋风投资合伙企业(有限合伙)	4,847,171	1.1245%
21	北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	4,491,908	1.0420%
22	天津海松飞跃股权投资合伙企业(有限合伙)	4,388,130	1.0180%
23	北京欧镭德芯科技中心(有限合伙)	4,080,033	0.9465%
24	哈勃科技创业投资有限公司	4,035,971	0.9363%
25	苏州芯动能显示科技创业投资合伙企业(有限合 伙)	3,428,226	0.7953%
26	厦门源峰磐松股权投资合伙企业(有限合伙)	3,428,226	0.7953%
27	思凯(珠海横琴)科技有限公司	3,291,097	0.7635%
28	北京芯动能投资基金(有限合伙)	3,078,990	0.7143%
29	北京光荣联盟半导体照明产业投资中心(有限合 伙)	2,832,861	0.6572%
30	苏州元禾厚望睿芯创业投资合伙企业(有限合 伙)	2,742,581	0.6362%
31	建信领航战略性新兴产业发展基金(有限合伙)	2,742,581	0.6362%
32	井冈山晨睿股权投资合伙企业(有限合伙)	2,742,581	0.6362%
33	天津海河集睿股权投资基金合伙企业(有限合 伙)	2,742,581	0.6362%
34	集创芯通(珠海)科技中心(有限合伙)	2,615,758	0.6068%
35	集创芯弘(珠海)科技中心(有限合伙)	2,480,200	0.5754%
36	北京晋睿博远科技有限公司	2,400,000	0.5568%
37	欧镭德弘(珠海)科技中心(有限合伙)	2,231,117	0.5176%
38	湖南湘江祥鹏股权投资合伙企业(有限合伙)	2,216,183	0.5141%

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例
39	北京丝路华创贰号股权投资中心(有限合伙)	2,125,500	0.4931%
40	厦门新鼎哨哥玖号股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0.4640%
41	无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,796,763	0.4168%
42	集创芯领(珠海)科技中心(有限合伙)	1,665,400	0.3863%
43	嘉兴鼎峰佳创创业投资合伙企业(有限合伙)	1,464,533	0.3397%
44	北京集成电路设计与封测股权投资中信(有限合伙)	1,416,632	0.3286%
45	北京欧镭德芯诚科技中心(有限合伙)	1,383,063	0.3208%
46	辽宁和生中富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,371,290	0.3181%
47	嘉兴创领隆顺股权投资合伙企业(有限合伙)	1,371,290	0.3181%
48	苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,371,290	0.3181%
49	三亚星睿壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,371,290	0.3181%
50	广德远润创芯股权投资合伙企业(有限合伙)	1,371,290	0.3181%
51	中国互联网投资基金(有限合伙)	1,371,290	0.3181%
52	深圳中深新创股权投资合伙企业(有限合伙)	1,371,290	0.3181%
53	中青芯鑫鼎橡(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)	1,371,290	0.3181%
54	深圳前海中明股权投资基金管理企业(有限合伙)	1,332,036	0.3090%
55	欧镭德鑫(珠海)科技中心(有限合伙)	1,252,847	0.2906%
56	北京丝路云和投资中心(有限合伙)	1,227,141	0.2847%
57	集芯领睿(珠海)科技中心(有限合伙)	1,200,962	0.2786%
58	湖南泉清投资合伙企业(有限合伙)	1,192,806	0.2767%
59	集创芯盛(珠海)科技中心(有限合伙)	1,184,207	0.2747%
60	共青城哲灵丰升投资管理合伙企业(有限合伙)	1,167,896	0.2709%
61	北京汇智合盛电子科技有限公司	1,111,300	0.2578%
62	SK 海力士(无锡)投资有限公司	1,097,032	0.2545%
63	江苏惠泉君海荣芯投资合伙企业(有限合伙)	1,097,032	0.2545%
64	集创芯美(珠海)科技中心(有限合伙)	1,012,088	0.2348%
65	集创芯兴(珠海)科技中心(有限合伙)	973,433	0.2258%
66	陕西葆晟控股有限公司	934,977	0.2169%

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例
67	新疆 TCL 股权投资有限合伙	898,382	0.2084%
68	集创芯卓(珠海)科技中心(有限合伙)	852,813	0.1978%
69	芜湖纪源灿辉创业投资合伙企业(有限合伙)	822,774	0.1909%
70	珠海景祥恒盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	822,774	0.1909%
71	德芯非凡(珠海)科技中心(有限合伙)	814,470	0.1873%
72	珠海景祥宏利股权投资基金合伙企业(有限合伙)	807,194	0.1873%
73	集芯卓宇(珠海)科技中心(有限合伙)	709,800	0.1647%
74	苏州纪源皓月创业投资合伙企业(有限合伙)	708,655	0.1644%
75	欧铎德盛(珠海)科技中心(有限合伙)	691,773	0.1605%
76	平潭宝盛股权投资合伙企业(有限合伙)	685,645	0.1591%
77	北京屹唐中艺投资中心(有限合伙)	685,645	0.1591%
78	嘉兴智徽股权投资合伙企业(有限合伙)	685,645	0.1591%
79	南京又东华兴创业投资合伙企业(有限合伙)	685,645	0.1591%
80	北京兴投优选创业投资基金(有限合伙)	685,645	0.1591%
81	珠海华金尚盈二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	685,645	0.1591%
82	共青城合盛犇犇股权投资合伙企业(有限合伙)	685,645	0.1591%
83	无锡芯创智享股权投资合伙企业(有限合伙)	685,645	0.1591%
84	北京中璟三号股权投资合伙企业(有限合伙)	685,645	0.1591%
85	曲水泉禾企业管理有限责任公司	685,645	0.1591%
86	银河芯动能壹号股权投资基金(烟台)合伙企业(有限合伙)	685,645	0.1591%
87	苏州工业园区中鑫致远投资中心(有限合伙)	685,645	0.1591%
88	珠海鲸芯一号集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	685,645	0.1591%
89	北京芯创科技一期创业投资中心(有限合伙)	650,904	0.1510%
90	宁波瀚澜企业管理合伙企业(有限合伙)	650,904	0.1510%
91	湖南湘江盛世光保股权投资合伙企业(有限合伙)	617,080	0.1432%
92	烟台德泰新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)	575,942	0.1336%
93	苏州纪源皓元创业投资合伙企业(有限合伙)	525,506	0.1219%
94	刘宏辉	484,072	0.1123%

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例
95	天铭京福(台州)创业投资合伙企业(有限合伙)	274,258	0.0636%
96	北京国泰嘉泽创业投资中心(有限合伙)	212,828	0.0494%
	合计	431,065,156	100%

4、合肥晶炯

根据合肥晶炯的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶炯的合伙人结构发生变更。截至2021年12月31日，合肥晶炯的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例	在发行人处任职情况
1	蔡国智	有限合伙人	575	25.5091%	董事长
2	蔡辉嘉	有限合伙人	510	22.6254%	总经理
3	邱显寰	有限合伙人	380	16.8582%	副总经理
4	李洳渝	有限合伙人	200	8.8727%	助理
5	黄晋德	有限合伙人	148	6.5658%	业务一处技术处长
6	林士然	有限合伙人	100	4.4364%	深圳办公室主任
7	王建智	有限合伙人	40	1.7745%	先进整合后端组经理
8	许嘉哲	有限合伙人	36	1.5971%	产品工程处技术副理
9	吴建宏	有限合伙人	30	1.3309%	微影开发部副理
10	古哲安	有限合伙人	20	0.8873%	制程一课副理
11	田俊鹏	有限合伙人	16	0.7098%	系统课副理
12	黄浩玮	有限合伙人	16	0.7098%	先进整合一组技术副理
13	林政纬	有限合伙人	16	0.7098%	制程二课副理
14	吴家頔	有限合伙人	16	0.7098%	制程二课副理
15	蔡汉郅	有限合伙人	12	0.5324%	设备自动化课副理
16	邱一峯	有限合伙人	12	0.5324%	空调课技术副理
17	郑子锋	有限合伙人	12	0.5324%	设备一课技术副理
18	苏耕乐	有限合伙人	12	0.5324%	逻辑一课技术副理
19	毛泽民	有限合伙人	12	0.5324%	业务二课技术副理
20	沈俊明	有限合伙人	12	0.5324%	制程一课技术副理
21	柯孟志	有限合伙人	10	0.4436%	制造部技术副理
22	陈思皓	有限合伙人	10	0.4436%	缺陷改善课副理

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例	在发行人处任职情况
23	简瑞荣	有限合伙人	10	0.4436%	助理
24	陈依柏	有限合伙人	8	0.3549%	故障分析课主任工程师
25	王振择	有限合伙人	8	0.3549%	制造二课主任工程师
26	张正一	有限合伙人	7.9	0.3505%	量测技术部经理
27	张琳琳	有限合伙人	5	0.2218%	故障分析课主任工程师
28	江冬冬	有限合伙人	5	0.2218%	扩散生产科生产线主任
29	李晗飞	有限合伙人	5	0.2218%	制造二课主任工程师
30	翟伟	有限合伙人	5	0.2218%	设备三课主任工程师
31	张振华	有限合伙人	5	0.2218%	设备一课主任工程师
32	合肥晶策	普通合伙人	0.2	0.0089%	/
合计			2,254.1	100%	-

5、合肥晶本

根据合肥晶本的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶本的合伙人结构发生变更。截至 2021 年 12 月 31 日，合肥晶本的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	张润生	有限合伙人	12	2.6019%	制程一课技术副理
2	计豪	有限合伙人	12	2.6019%	营运系统课技术副理
3	王厚有	有限合伙人	12	2.6019%	制程一课副理
4	邢志同	有限合伙人	12	2.6019%	设备二课副理
5	凌军	有限合伙人	12	2.6019%	制造信息课技术副理
6	刘秀梅	有限合伙人	12	2.6019%	光学模型组技术副理
7	李强	有限合伙人	12	2.6019%	制程供应课技术副理
8	彭萍	有限合伙人	12	2.6019%	制程一课技术副理
9	詹霄飞	有限合伙人	12	2.6019%	逻辑二课副理
10	杨排	有限合伙人	12	2.6019%	营运系统课技术副理
11	顾炜	有限合伙人	12	2.6019%	大客户课技术副理
12	祝进专	有限合伙人	10	2.1683%	逻辑一课副理
13	王梦慧	有限合伙人	10	2.1683%	制程开发课代副理
14	严俊生	有限合伙人	10	2.1683%	保安课代副理
15	涂程林	有限合伙人	10	2.1683%	制程一课副理

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
16	汪高生	有限合伙人	10	2.1683%	网络系统课副理
17	刘波	有限合伙人	10	2.1683%	洁净及化学分析课副理
18	邵迎亚	有限合伙人	10	2.1683%	整合一课代副理
19	徐东东	有限合伙人	10	2.1683%	大数据分析课副理
20	童佳佳	有限合伙人	10	2.1683%	环保课代副理
21	金良民	有限合伙人	10	2.1683%	行政系统课副理
22	蔡永霞	有限合伙人	10	2.1683%	品质体系稽核课副理
23	李倩娣	有限合伙人	10	2.1683%	平台课副理
24	简瑞荣	有限合伙人	10	2.1683%	协理
25	封瑞	有限合伙人	10	2.1683%	工业工程二课主任工程师
26	张海英	有限合伙人	8	1.7346%	网络系统课主任工程师
27	王冰	有限合伙人	8	1.7346%	客户工程二部代部经理
28	唐昌玉	有限合伙人	8	1.7346%	工业工程一课副理
29	冯维	有限合伙人	8	1.7346%	物管部副理
30	李青	有限合伙人	8	1.7346%	资源课主任工程师
31	张倩倩	有限合伙人	8	1.7346%	行政系统课主任工程师
32	巫瑶瑶	有限合伙人	8	1.7346%	生产管理课主任工程师
33	未东洋	有限合伙人	8	1.7346%	经营与营运系统部主任工程师
34	高亮	有限合伙人	8	1.7346%	系统课副理
35	徐国宝	有限合伙人	8	1.7346%	营运系统课主任工程师
36	田春	有限合伙人	8	1.7346%	资安室主任工程师
37	胡旺能	有限合伙人	8	1.7346%	制造部主任工程师
38	张兴才	有限合伙人	8	1.7346%	厂务课副理
39	檀翠琴	有限合伙人	8	1.7346%	经营系统课技术副理
40	刘伟	有限合伙人	8	1.7346%	网络系统课主任工程师
41	黄风	有限合伙人	8	1.7346%	制造一课主任工程师
42	夏海峰	有限合伙人	8	1.7346%	应急管理课主任工程师
43	丁超	有限合伙人	8	1.7346%	制造二课技术副理
44	周静	有限合伙人	8	1.7346%	经营系统课主任工程师
45	黄玉	有限合伙人	8	1.7346%	制造二课主任工程师
46	郑兴华	有限合伙人	8	1.7346%	营运系统课主任工程师
47	唐鹤飞	有限合伙人	8	1.7346%	网络系统课主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
48	葛礼玉	有限合伙人	8	1.7346%	平台服务课主任工程师
49	黎翠綾	有限合伙人	5	1.0841%	企业规划室资深处长
50	合肥晶策	普通合伙人	0.2	0.0434%	/
合计			461.2	100%	-

6、合肥晶辽

根据合肥晶辽的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶辽的合伙人结构发生变更。截至 2021 年 12 月 31 日，合肥晶辽的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	许凯迪	有限合伙人	12	4.0789%	自动化系统课技术副理
2	王曼真	有限合伙人	12	4.0789%	制程三课副理
3	钟尚仁	有限合伙人	12	4.0789%	气体化学课技术副理
4	林胜雄	有限合伙人	12	4.0789%	制程供应课副理
5	刘志铭	有限合伙人	12	4.0789%	系统整合课副理
6	陈宏玮	有限合伙人	12	4.0789%	制程一课副理
7	曾凯慧	有限合伙人	12	4.0789%	解析设备课副理
8	翁文杰	有限合伙人	12	4.0789%	制程二课技术副理
9	曾盟善	有限合伙人	12	4.0789%	制程二课技术副理
10	蔡輝堂	有限合伙人	12	4.0789%	layout课副理
11	黄晋德	有限合伙人	12	4.0789%	业务一处资深处长
12	吴德刚	有限合伙人	10	3.3990%	工业工程二课副理
13	林宗晔	有限合伙人	10	3.3990%	设备信息课副理
14	何瑞凤	有限合伙人	10	3.3990%	基准情报一课代副理
15	蔡孟孺	有限合伙人	10	3.3990%	客户工程一部副理
16	简瑞荣	有限合伙人	10	3.3990%	协理
17	黄绍铭	有限合伙人	8	2.7192%	制程一课技术副理
18	丘卓册	有限合伙人	8	2.7192%	空调课主任工程师
19	黄任逢	有限合伙人	8	2.7192%	设备一课主任工程师
20	林宏展	有限合伙人	8	2.7192%	设备一课主任工程师
21	张建烜	有限合伙人	8	2.7192%	空调课主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
22	刘铭哲	有限合伙人	8	2.7192%	设备二课技术副理
23	林子荏	有限合伙人	8	2.7192%	制程一课技术副理
24	张家玮	有限合伙人	8	2.7192%	逻辑一课主任工程师
25	江承达	有限合伙人	8	2.7192%	量测制程课主任工程师
26	蔡志宏	有限合伙人	8	2.7192%	安环体系课副理
27	刘凯文	有限合伙人	8	2.7192%	制程二课技术副理
28	蔡明洋	有限合伙人	8	2.7192%	制程一课技术副理
29	汤志英	有限合伙人	8	2.7192%	电力课主任工程师
30	张伟瑾	有限合伙人	8	2.7192%	N1厂厂长
31	合肥晶策	普通合伙人	0.2	0.0680%	/
合计			294.2	100%	-

曾凯慧、林胜雄已将其持有合肥晶辽的全部出资份额转让给蔡信裕、王曼真，并于2022年3月5日办理完成工商变更。

7、合肥晶妥

根据合肥晶妥的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶妥的合伙人结构发生变更。截至2021年12月31日，合肥晶妥的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	黄晋德	有限合伙人	15	6.2448%	业务一处资深处长
2	崔洁	有限合伙人	5	2.0816%	平台服务课主任工程师
3	柯焱	有限合伙人	5	2.0816%	制程一课主任工程师
4	张东杰	有限合伙人	5	2.0816%	设备信息课主任工程师
5	彭涛	有限合伙人	5	2.0816%	工业工程二课主任工程师
6	孙航海	有限合伙人	5	2.0816%	设备信息课主任工程师
7	张静	有限合伙人	5	2.0816%	先进整合一组主任工程师
8	储挺进	有限合伙人	5	2.0816%	Methodology 课主任工程师
9	葛键	有限合伙人	5	2.0816%	流程整合组主任工程师
10	孟娟	有限合伙人	5	2.0816%	技术一课主任工程师
11	王丽雅	有限合伙人	5	2.0816%	失效分析课代副理
12	目晶晶	有限合伙人	5	2.0816%	可靠性工程课主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
13	张国庆	有限合伙人	5	2.0816%	设备一课主任工程师
14	丁璇璇	有限合伙人	5	2.0816%	行政与网络系统部主任工程师
15	俞佩佩	有限合伙人	5	2.0816%	失效分析课主任工程师
16	王云龙	有限合伙人	5	2.0816%	消防管理课主任工程师
17	黎翠绫	有限合伙人	5	2.0816%	企业规划室资深处长
18	许飞	有限合伙人	5	2.0816%	制程开发课主任工程师
19	周芹芹	有限合伙人	5	2.0816%	营运系统课主任工程师
20	马忠祥	有限合伙人	5	2.0816%	逻辑一课代副理
21	刘利娟	有限合伙人	5	2.0816%	制程品质工程课主任工程师
22	颜传奇	有限合伙人	5	2.0816%	安环体系课主任工程师
23	叶秀平	有限合伙人	5	2.0816%	总经理室主任管理师
24	葛祥福	有限合伙人	5	2.0816%	制程品质工程课主任工程师
25	宋明明	有限合伙人	5	2.0816%	逻辑三课主任工程师
26	谢烈翔	有限合伙人	5	2.0816%	逻辑三课主任工程师
27	吴俊	有限合伙人	5	2.0816%	行政系统课主任工程师
28	徐恩杰	有限合伙人	5	2.0816%	网络系统课主任工程师
29	陈国彬	有限合伙人	5	2.0816%	制程品质工程课主任工程师
30	马成	有限合伙人	5	2.0816%	经营管理组主任工程师
31	郝利兰	有限合伙人	5	2.0816%	洗净工程部主任工程师
32	谭倩倩	有限合伙人	5	2.0816%	经营与营运系统部主任工程师
33	操梦雅	有限合伙人	5	2.0816%	先进整合一组主任工程师
34	李磊	有限合伙人	5	2.0816%	风险控制部主任工程师
35	曹文强	有限合伙人	5	2.0816%	经营系统课主任工程师
36	侯丹丹	有限合伙人	5	2.0816%	制成品质工程课主任工程师
37	高创	有限合伙人	5	2.0816%	制程一课主任工程师
38	李波	有限合伙人	5	2.0816%	逻辑二课代副理
39	韩小琴	有限合伙人	5	2.0816%	制程一课主任工程师
40	吕玉波	有限合伙人	5	2.0816%	供应商管理科主任工程师
41	王博	有限合伙人	5	2.0816%	出货品质保证课主任工程师
42	程洋	有限合伙人	5	2.0816%	核心技术一部代副理
43	马婷	有限合伙人	5	2.0816%	元件二课代副理
44	郑鹏	有限合伙人	5	2.0816%	设备一课主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
45	张永仓	有限合伙人	5	2.0816%	制程一课主任工程师
46	王琳	有限合伙人	5	2.0816%	安环体系课主任工程师
47	合肥晶策	普通合伙人	0.2	0.0833%	/
合计			240.2	100%	-

8、合肥晶雄

根据合肥晶雄的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶雄的合伙人结构发生变更。截至2021年12月31日，合肥晶雄的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	黄南翔	有限合伙人	35.999936	23.9680%	生管物管部代经理
2	陈文璟	有限合伙人	20.0000312	13.3156%	制程整合部副理
3	李维泽	有限合伙人	11.9999286	7.9893%	制程一课技术副理
4	简瑞荣	有限合伙人	10.0000156	6.6578%	助理
5	陈欣蕙	有限合伙人	7.9999524	5.3262%	元件一课技术副理
6	蔡君正	有限合伙人	7.9999524	5.3262%	先进整合前端组技术副理
7	陈佳局	有限合伙人	6.0000394	3.9947%	经营系统课副理
8	萧凯彰	有限合伙人	6.0000394	3.9947%	水处理课副理
9	赖韦伶	有限合伙人	5.0000078	3.3289%	制程整合技术处主任工程师
10	姚怡雯	有限合伙人	5.0000078	3.3289%	核心技术二部主任工程师
11	陈俊雄	有限合伙人	5.0000078	3.3289%	统计设备管制课代副理
12	葛年翔	有限合伙人	5.0000078	3.3289%	制程二课主任工程师
13	沈丞伟	有限合伙人	5.0000078	3.3289%	设备二课主任工程师
14	郑淙徽	有限合伙人	5.0000078	3.3289%	量测设备课主任工程师
15	林岳煌	有限合伙人	5.0000078	3.3289%	扩散生产课主任工程师
16	李奇威	有限合伙人	5.0000078	3.3289%	薄膜生产课生产线主任
17	黄晋德	有限合伙人	2.9999446	1.9973%	业务一处资深处长
18	郭千琦	有限合伙人	1.0000316	0.6658%	模型器件组技术副理
19	合肥晶策	普通合伙人	0.2000664	0.1332%	/
合计			150.2	10%	-

根据发行人的股东名册、发行人的确认，并经本所律师核查，截至本补充法律意

见书出具日，除上述变化外，发行人的股东未发生其他变化。本所律师认为，发行人的股东人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

六、 发行人的股本及其演变

根据发行人提供的股东名册、本所律师对发行人股东的补充问卷调查、发行人的工商档案、《公司章程》及发行人确认，并经本所律师核查，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人的股份结构未发生变化。

根据发行人股东的补充问卷调查确认、发行人说明，并经本所律师检索国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），截至本补充法律意见书出具日，发行人股东所持发行人的股份未设置质押。

七、 发行人的业务

（一）经营范围和经营方式

根据发行人持有的《营业执照》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人的经营方式和经营范围未发生变化。

发行人境内子公司情况详见本补充法律意见书之“九、发行人的主要财产及其变化情况”之“0 发行人的子公司”。

根据发行人及其子公司所在地工商、税务等相关政府部门出具的证明文件，并经本所律师核查，本所律师认为，发行人及其子公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规的规定，已经取得经营所需的相关业务资质及许可。

（二）境外业务

根据《2019-2021 年度审计报告》、发行人提供的工商资料及书面确认并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人拥有 1 家境外子公司（日本晶合），主要从事集成电路设计服务及技术开发。发行人境外子公司的具体情况详见律师工作报告“十、发行人的主要财产”之“（五）发行人的子公司”。

(三) 发行人的主营业务

根据《招股说明书（注册稿）》《2019-2021 年度审计报告》，截至本补充法律意见书出具日，发行人主要从事 12 英寸晶圆代工业务。发行人的主营业务未发生变化。

(四) 主要业务资质和许可

经本所律师核查，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人新取得的主要经营资质证书情况如下：

资质名称	持证主体	证书/登记编号	授予单位/登记机关	有效期限
辐射安全许可证	新晶集成	皖环辐证[A0813]	安徽省生态环境厅、合肥市生态环境局	2022 年 1 月 4 日至 2027 年 1 月 3 日
排污许可证	发行人	91340100343821433Q001W	合肥市生态环境局	2022 年 1 月 4 日至 2027 年 1 月 3 日
排污许可证	新晶集成	91340100MA8N4PFB89001V	合肥市生态环境局	2022 年 2 月 11 日至 2027 年 2 月 10 日

(五) 发行人的持续经营能力

根据发行人最新的《营业执照》《2019-2021 年度审计报告》及发行人确认，并经本所核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人依法存续，发行人的主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情况，不存在影响其持续经营的法律障碍。

(六) 发行人合作研发的相关情况

根据发行人与相关合作方签订的协议和发行人书面说明，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人正在从事的合作研发项目情况未发生变化。

八、 关联交易及同业竞争及其变化情况

(一) 关联方

根据《公司法》《上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，并经本所律师核查，2021 年 6 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人的主要关联方变化如下：

1、发行人的控股股东、实际控制人

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人的控股股东仍为合肥建投，实际控制人仍为合肥市国资委，未发生变化。

2、发行人的控股股东直接或间接控制的其他企业的变化情况

发行人控股股东合肥建投直接或间接控制的其他企业为发行人的关联方。截至 2021 年 12 月 31 日，发行人控股股东新增加的直接或间接控制的其他主要企业情况如下：

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
1	合肥建新投资有限公司	2020 年 2 月 20 日	合肥市新站区新站工业物流园内 A 组团 E 区宿舍楼 15 幢 604、605 室	项目投资。

3、发行人的控股子公司的变化情况

2021 年 6 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人新设一家控股子公司新品集成。截至 2021 年 12 月 31 日，新品集成的基本情况如下表所示：

公司名称	合肥新品集成电路有限公司
住所	合肥市新站区综合保税区内西淝河路 88 号
法定代表人	周义亮
注册资本	400,000 万元

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

4、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员的变化情况

2021年11月26日，合肥建投向晶合集成发出《关于调整晶合公司董事人选的函》，推荐陈小蓓担任公司董事，接任黄颖的董事职务。2021年12月，发行人召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司更换董事的议案》，同意选举陈小蓓为公司董事。此外，与上述人员关系密切的家庭成员亦构成发行人的关联方。

5、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者由前述人员（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织的变化情况

由于陈小蓓于2021年12月被选举为发行人董事，陈小蓓及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织为发行人新增关联方，截至2021年12月31日，该等法人或其他组织情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	合肥建投	陆勤航担任董事兼总经理、陈小蓓担任董事兼副总经理兼董事会秘书
2	启迪控股股份有限公司	陆勤航担任董事
3	合肥建投资本管理有限公司	陈小蓓担任董事
4	安徽省合肥联合发电有限公司	陈小蓓担任董事
5	合肥通航控股有限公司	陈小蓓担任董事
6	合肥市大数据资产运营有限公司	陈小蓓担任董事
7	合肥高特佳创业投资有限责任公司	陈小蓓担任董事
8	合肥丰乐种业股份有限公司	陈小蓓担任董事
9	合肥中科微电子创新中心有限公司	陈小蓓担任董事
10	合肥百货大楼集团股份有限公司	陈小蓓担任董事

序号	关联方名称	关联关系说明
11	合肥京东方显示技术有限公司	陈小蓓担任董事长
12	合肥维信诺科技有限公司	陈小蓓担任董事
13	蔚来控股有限公司	陈小蓓担任董事
14	合肥德轩投资管理有限公司	陈小蓓担任董事

6、直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织的变化情况

截至 2021 年 12 月 31 日，直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织未发生变化。

7、直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织的变化情况

截至 2021 年 12 月 31 日，直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织增加 2 家，相关情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	杭州矗元企业管理合伙企业（有限合伙）	力晶科技直接或间接控制
2	宏丽数位创意股份有限公司	力晶科技直接或间接控制

8、直接控制上市公司的法人的董事、监事、高级管理人员及其控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织的变化情况

(1) 直接控制发行人的法人的董事、监事、高级管理人员的变化情况

直接控制发行人的法人为合肥建投，截至 2021 年 12 月 31 日，合肥建投的董事、监事、高级管理人员的变化情况如下：

序号	关联方姓名	关联关系说明
1	黄颢	原担任合肥建投董事兼副总经理，已不再担任任何职务
2	陈小蓓	原担任合肥建投董事，现兼任副总经理、董事会秘书
3	吴子能	原担任合肥建投董事，现兼任副总经理

序号	关联方姓名	关联关系说明
4	杨雪蕾	原担任合肥建投董事，现兼副总经理
5	田胜彬	原担任合肥建投监事，现兼副总经理

(2) 前述关联自然人直接或者间接控制的法人或其他组织的变化情况

前述关联自然人中，陈小蓓亦系发行人董事；吴子能、杨雪蕾原系发行人的关联自然人，截至 2021 年 12 月 31 日，其控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织范围未发生变化；田胜彬担任董事、高级管理人员的法人或其他组织新增 2 家，相关情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	合肥市住房租赁发展股份有限公司	田胜彬担任董事
2	合肥市综合管廊投资运营有限公司	田胜彬担任董事

9、其他关联方

除上述关联方外，发行人的其他关联方还包括其他根据《上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定认定的关联方。

10、关联方信息披露

根据发行人的书面说明，并经本所律师核查，发行人已在《招股说明书（注册稿）》中按照《公司法》《企业会计准则》和中国证监会的相关规定认定并披露关联方。

11、注销或转让重要关联方

根据发行人控股股东填写的调查表和发行人的书面说明，并经本所律师核查，报告期内，发行人不存在注销或转让的子公司，亦不存在与发行人存在关联交易的关联方注销或转让的情形。

(二) 关联交易

根据《2019-2021 年度审计报告》和发行人书面说明，并经本所律师核查，2021

年度，发行人与关联方发生的关联交易情况如下：

1、向关联方采购商品及接受服务

2021 年度，发行人向关联方采购商品及接受服务的相关情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021 年度	
		金额	占当期营业成本的比例
合肥燃气	采购燃气	596.20	0.20%
合肥供水	采购厂区用水	633.39	0.21%
智成电子	采购服务	784.48	0.26%
合肥租赁	房屋租赁	142.80	0.05%
关联采购合计		2,156.87	0.72%

2021 年度，发行人向合肥供水、合肥燃气采购厂区用水、燃气的价格与合肥供水、合肥燃气向第三方销售的价格一致；发行人向智成电子采购服务为授权许可知识产权（IP），双方定价模式与发行人与其他同类供应商的定价模式一致，且价格处于同类供应商报价范围区间内。

综上，本所认为，发行人与关联方之间的上述关联交易价格公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

2、向关联方销售商品及提供服务

2021 年度，发行人向关联方销售商品及服务的相关情况如下：

关联方	关联交易内容	2021 年度	
		金额	占当期营业收入的比例
晶相光电	销售商品	6.23	0.00%

3、关联租赁

发行人因经营需要向关联方合肥蓝科租赁土地、厂房及厂务设施，均位于安徽省合肥市瑶海区综合保税区内西淝河路 88 号，为发行人的注册地及主要办公场所。

发行人于 2021 年 1 月 1 日实施新租赁准则，按照新租赁准则相关要求，发行人将上述租入的土地、厂房及配套厂务设备调整计入使用权资产，相关负债调整计入租赁负债，发行人 2021 年度与土地、厂房及配套厂务设备相关的租赁负债增减变动情况列示如下：

单位：万元

关联方	2020 年 12 月 31 日	会计政策变 更	2021 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
合肥蓝科	-	188,444.99	188,444.99	174,353.91	16,349.88	346,449.02

本所认为，合肥蓝科系依据合肥市人民政府相关政策向公司出租厂房，租赁价格虽低于市场价格，但公司已按照相应会计准则进行会计处理，该等关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

4、关联担保情况

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人接受关联方担保的情况如下：

单位：万元

担保方	出借人	借款余额（含 一年内到期的 长期借款）	借款日期	到期日	担保是否 已经履行 完毕	是否提 供反担 保
合肥建投	华泰资产	130,000.00	2018/9/28	2028/9/27	否	是
		30,000.00	2018/10/30	2028/10/29	否	是
		42,000.00	2018/11/8	2028/11/7	否	是
		90,000.00	2019/7/18	2029/7/17	否	是
		8,000.00	2019/8/29	2029/8/28	否	是
	平安银行合 肥分行	78,740.00	借款发放日	2027/10/10	否	是
	兴业银行合 肥分行	16,806.00	借款发放日	2028/1/7	否	是
		47,000.00	借款发放日	2027/10/10	否	是

担保方	出借人	借款余额（含 一年内到期的 长期借款）	借款日期	到期日	担保是否 已经履行 完毕	是否提 供反担 保
	中国银行北 城支行	67,397.69	借款发放日	2028/1/15	否	是
		23,170.73	2021/3/19	2027/10/10	否	是

截至 2021 年 12 月 31 日，根据发行人与合肥市建设投资控股（集团）有限公司签订的《反担保合同》及《反担保合同补充协议》，发行人已就合肥市建设投资控股（集团）有限公司为发行人上述借款的担保提供反担保。

2021 年 7 月 1 日，发行人与合肥市建设投资控股（集团）有限公司签订《动产浮动抵押合同》，约定合肥市建设投资控股（集团）有限公司对于发行人所有的晶合一期 5 万片月产能所对应的机器设备及原物料中海关监管期限已届满的部分有权变卖处分和优先受偿，对于抵押人其余在海关监管期限内的机器设备及原物料，在海关监管期限届满后合肥市建设投资控股（集团）有限公司自动享有前述权利。

2021 年 8 月 5 日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司对本公司所有的海关监管期限届满的部分机器设备办理了抵押登记，已办理抵押登记的机器设备于 2021 年 12 月 31 日的账面原值、累计折旧及账面价值如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
机器设备	330,178.75	132,341.26	197,837.49

5、关联方资金拆借

2021 年度，发行人未发生与关联方资金拆借的情形。

6、关键管理人员薪酬

2021 年度，发行人向关键管理人员支付薪酬，关联交易金额为 2,168.94 万元。

7、关联方往来余额

（1）应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2021年12月31日	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	李迦谕	1.16	-
其他应收款	合肥燃气	40.00	-
其他应收款	智成电子	0.06	0.003
其他应收款	合肥租赁	21.90	-

(2) 应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2021年12月31日
其他应付款	蔡辉嘉	0.51
其他应付款	周义亮	0.10
其他应付款	简瑞荣	0.38
其他应付款	邱显寰	0.34
其他应付款	蔡国智	0.17
其他应付款	合肥蓝科	129.91
其他应付款	晶相光电	1,821.97
应付账款	合肥燃气	57.90
应付账款	智成电子	583.47
应付账款	合肥供水	13.36
租赁负债	合肥蓝科	346,449.02

注：上表中晶相光电他应付款系晶相光电缴纳的产能保证金；合肥蓝科租赁负债系发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套厂务设备形成，具体情况详见本补充法律意见书之“九、关联交易及同业竞争及其变化情况”之“0 关联交易”之“3、关联租赁”。

根据《2019-2021 年度审计报告》、发行人相关会议资料、发行人的书面说明，并经本所律师核查，上述报告期内发生的发行人关联方与发行人所发生的关联交易，交易价格及条件均符合公允原则，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

(三) 同业竞争

截至本补充法律意见书出具日，发行人从事 12 英寸晶圆代工业务。根据合肥建投提供的对外投资企业清单并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统、天眼查网站等方式进行核查，合肥建投除投资发行人外，未控制其他从事晶圆代工业务的公司，合肥建投及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争。

(四) 发行人对关联交易和同业竞争事项的披露

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人已在《招股说明书（注册稿）》中对有关减少和规范关联交易的措施及避免同业竞争的承诺进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

九、 发行人的主要财产及其变化情况

(一) 土地使用权和房屋所有权变化情况

1、自有物业

截至本补充法律意见书出具日期间，发行人无自有物业。

2、租赁物业

经发行人确认并经本所律师核查发行人及其子公司的租赁协议及租赁物业产权证明，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司承租用于办公、生产经营的房产共计 4 处，面积合计约 215,785.43 平方米，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积 (m ²)	租赁期限	用途
1	晶合集成	合肥蓝科	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号	215,270.61	2017 年 6 月 28 日至 2037 年 6 月 27 日	生产办公
2	上海晶合	上海莘泽创业投资管理股份	上海市浦东新区区盛夏路 608 号 3 幢 5 层 502 室	141.15	2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日	办公

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积 (m ²)	租赁期限	用途
		有限公司				
3	日本晶合	マスター・プロパティーズ株式会社	東京都立川市曙町一丁目13番11号	242.71	2021年5月1日至2023年4月30日	办公
4	晶合集成	深圳市唐庄实业有限公司	深圳市福田区深南西路车公庙工业区	130.96	2021年6月1日至2023年5月31日	办公

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人不存在租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产的情形。

(二) 在建工程

根据《2019-2021 年度审计报告》《招股说明书（注册稿）》以及发行人书面说明，截至本补充法律意见出具日，发行人的在建工程主要为公司新购置待安装机台设备。截至 2021 年 12 月 31 日，发行人在建工程的账面余额为 332,905.83 万元。

(三) 商标、专利等无形资产变化情况

1、注册商标

根据发行人提供的《商标注册证》、商标注册代理机构出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于中国境外注册商标相关事宜的确认函》、国家知识产权局出具的《商标初步审定公告》，并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司共拥有 113 项注册商标，其中，在中国境内注册的商标 22 项，在中国境外注册的商标 91 项，该等商标的具体情况详见本补充法律意见书附件。

2、注册专利

根据发行人提供的专利证书等相关文件、专利注册代理机构出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于中国境外注册专利相关事宜的确认函》、国家知识产权局查询结果并查询国家知识产权局综合服务平台专利检索及分析系统（<http://pss-system.cnipa.gov.cn>），并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司在中国境内共拥有 198 项已授权专利，在中国境外共拥有 58 项已授权专利。该等专利注册的具体情况详见本补充法律意见附件。

3、集成电路布图设计

根据发行人提供的《集成电路布图设计登记证书》、国家知识产权局网站的查询结果，并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司合法拥有集成电路布图设计专有权 1 项，具体情况如下：

序号	权利人	设计名称	申请号	申请日
1	晶合集成	90FCIS_1.32V_3.3V ESD sample layout	21560372.9	2021/08/20

4、互联网域名

截至 2021 年 12 月 31 日，根据发行人提供的域名证书，并经本所律师核查工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统（<http://beian.miit.gov.cn>），发行人及其子公司拥有的域名情况没有发生变化。

5、发行人使用的授权许可知识产权（IP）

2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，公司新取得的授权许可知识产权（IP）情况如下：

序号	合同相对方	授权内容	合同金额或 定价依据	有效期限
1	力旺电子股份有限公司	单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2021年8月10日- 2026年8月9日
		单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及	2021年8月10日-

序号	合同相对方	授权内容	合同金额或定价依据	有效期限
		丝) 技术	权利金等	2026年8月9日
2	智成电子	110纳米标准单元库	量产权利金	2021年7月1日- 2022年12月31日
3	珠海创飞芯科技有限公司	90单次可编程(反熔丝) 技术	授权产品的使用提成费用	2021年8月2日起 至达成新协议前永久有效
		110单次可编程(反熔丝) 技术	授权产品的使用提成费用	2021年6月1日- 2026年5月31日
		90单次可编程(反熔丝) 技术	授权产品的使用提成费用	2021年8月2日- 2026年8月1日
4	IMEC VZW	28纳米集成电路IP	分期支付使用费	2021年12月23日- 2023年6月23日

(四) 主要生产经营设备

根据《审计报告》、重大生产经营设备的购置合同、履行凭证及发行人说明，发行人的主要生产经营设备包括机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等。截至2021年12月31日，机器设备的账面价值为1,618,943.07万元、电子设备及其他的账面价值为11,002.59万元、运输工具的账面价值为0.07万元。

(五) 发行人的子公司

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人拥有北京晶芯成、南京晶驱、日本晶合、新品集成4家控股子公司，其中新品集成的情况发生变化，具体情况如下：

2021年12月20日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于新品集成增资扩股案的议案》，新品集成拟引入外部投资人筹集资本金。

2021年12月31日，合肥市国资委出具《关于同意对合肥新品集成电路有限公司增资扩股的批复》（合国资产权[2021]124号），同意采用非公开交易方式引入合作方

对新晶集成合计增资 60 亿元。增资后，发行人持有晶集成 52.02%股权，合作方持有 47.98%的股权，晶集成仍为发行人控股子公司。

发行人及晶集成已与北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、建航晶合股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司签订《增资协议》；合肥建投及晶集成已与前述投资人签订《增资协议之补充协议》；前述增资协议对应的 49 亿元认购款已实际缴纳，尚待与其他投资人完成增资协议的签署并完成剩余 11 亿元认购款的缴纳及本次增资的工商变更。

（六）主要财产所有权或使用权的受限制情况

根据发行人提供的相关债权合同、担保合同、不动产登记簿、经本所律师核查，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人及其子公司主要财产存在权利受限的情况未发生重大改变。

十、发行人的重大债权债务变化情况

根据发行人的说明，并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人的重大债权债务变化情况如下：

（一）重大合同的变化情况

根据发行人确认并经本所律师核查，自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人新增的对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同如下：

1、销售合同

根据发行人提供的相关文件及说明，自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人及其子公司与报告期各期前五大的客户新签署的重大销售合同情况如下：

序号	供应主体	客户	有效期/订单日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
1	晶集成	集创北方	2021/12/25-	150nm、110nm、	102,669.11	正在履行

序号	供应主体	客户	有效期/订单日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
			2026/12/31	90nm、55nm、40nm 等晶圆代工产能预约	万元产能预约金	
2	晶合集成	敦泰电子股份有限公司	2021/10/25-2026/12/31	150nm、110nm、55nm 晶圆代工产能预约	1,385.10 万美元	正在履行
3	晶合集成	深圳天德钰科技股份有限公司	2021/12/30-2026/12/31	110nm、90nm、55nm、40nm 晶圆代工产能预约	50,890.04 万元产能预约金	正在履行
4	晶合集成	奕力科技股份有限公司	2021/10/01-2022/12/31	110nm 晶圆代工预约	/	正在履行
5	晶合集成	奇景光电股份有限公司	2021/11/01-2026/12/31	150nm、110nm、90nm、55nm 晶圆代工产能预约	3,821.85 万美元	正在履行

2、采购合同

根据发行人提供的相关文件及说明，自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人及其子公司与报告期各期前五大原材料供应商新签署的重大采购合同情况如下：

序号	采购主体	供应商	签订日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
1	晶合集成	Applied Materials South East Asia Pte. Ltd	2021/11/25	零部件	75.84 万美元	正在履行

序号	采购主体	供应商	签订日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
2	晶合集成	Wah Lee Industrial Corp.	2021/07/14	化学品	103.60 万美元	正在履行

3、借款合同

根据发行人提供的相关文件及说明，自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人及其子公司新签订的重大授信、借款及担保合同如下：

序号	借款人/额度申请人	贷款人/额度授予人	签订日期	合同金额	贷款/授信期限	目前履行情况	担保情况
1	晶合集成	平安银行合肥分行	2021/11/01	50 亿元授信	2021/11/01-2022/10/31	正在履行	合肥建投为 50 亿授信中的 11 亿元提供担保
2	晶合集成	平安银行合肥分行	2021/12/21	3,000 万美元借款	2021/12/21-2022/03/20	已履行	-
3	晶合集成	兴业银行合肥分行	2021/12/15	19 亿元授信	2021/12/15-2022/12/09	正在履行	合肥建投提供最高额为 7 亿元的担保
4	晶合集成	兴业银行合肥分行	2021/10/11	6 亿元授信	2021/10/11-2021/10/29	已履行	-
5	晶合集成	合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支	2021/12/30	10 亿元授信	2021/12/30-2022/10/15	正在履行	-

序号	借款人/额度申请人	贷款人/额度授予人	签订日期	合同金额	贷款/授信期限	目前履行情况	担保情况
		行					
6	晶合集成	招商银行股份有限公司合肥分行	2021/08/16	10 亿元授信	2021/08/16-2022/08/15	正在履行	-
7	晶合集成	中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	2021/12/21	1.54 亿元借款	首次提款日起 3 个月	正在履行	-
8	晶合集成	中信银行股份有限公司合肥分行	2021/12	1,700 万美元	2021/12-2022/03	已履行	-

4、对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的其他合同

(1) 产能预约金合同

除本节之“（一）重大合同”之“1、销售合同”已披露的合同外，自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人与主要客户新签订的产能预约金合同如下：

①2021 年 11 月 8 日，发行人同客户一签订《产能预约合同》，约定发行人为客户一预留 2024 至 2026 年 150nm 晶圆代工产能，合同期限为 2021 年 11 月 8 日至 2026 年 12 月 31 日。

②2021 年 11 月 16 日，发行人同 Sitronix Technology Corporation（矽创电子股份有限公司）签订《产能预约合同》，约定发行人为 Sitronix Technology Corporation（矽创电子股份有限公司）预留 2024 年-2026 年 110nm、90nm、55nm、40nm 晶圆代工产能。

③2021年10月25日，发行人同客户三签订《2024-2026产能预约合同》，约定发行人为客户三预留2024-2026年150nm、110nm、55nm晶圆代工产能，合同期限为2021年10月25日至2026年12月31日。

（2） 新晶集成增资相关合同

2021年12月30日，发行人及新晶集成与北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、建航晶合股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司签订《增资协议》，约定外部投资者拟以货币方式合计出资60亿元认购新晶集成新增注册资本368,890.26万元，增资完成后，发行人持有新晶集成52.02%的股权。其中：北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）出资20亿元，中国东方资产管理股份有限公司出资4亿元，建航晶合股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）出资15亿元，农银金融资产投资有限公司出资10亿元。截至本招股说明书签署日，前述增资协议对应的49亿元认购款已实际缴纳，尚待与其他投资人完成增资协议的签署并完成剩余11亿元认购款的缴纳及本次增资的工商变更。

同日，合肥建投及新晶集成已与北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、建航晶合股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司签订《增资协议之补充协议》，约定交割日后1.5年起至满3年止，若投资者所持新晶集成股权未能转换为上市公司股票，合肥建投有权自行或指定第三方（第三方不含发行人及其控股子公司）向投资者发出收购通知，以现金方式受让外部投资者持有新晶集成的全部股权。

（二） 合同主体及合同的履行

上述适用中国法律的重大合同内容和形式不违反中国法律、行政法规的禁止性规定，发行人及其子公司作为上述适用中国法律的重大合同的主体，继续履行该等合同不存在实质性法律障碍。

（三） 侵权之债

根据发行人说明、相关工商行政管理部门、人事劳动社会保障部门、税务部门等

出具的证明，经本所律师在发行人及其子公司相关主管部门政府网站核查，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人及其子公司报告期内没有因知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（四）发行人与关联方之间的重大债权债务关系及相互提供担保情况

根据《2019-2021 年度审计报告》并经本所律师核查，截至报告期末，除本补充法律意见第一部分“八、关联交易及同业竞争及其变化”及“十、发行人的重大债权债务变化情况”所述之外，发行人与其关联方之间不存在其他重大债权债务关系，亦不存在其他相互提供担保的情况。

（五）发行人的其他应收、应付款

根据《2019-2021 年度审计报告》并经本所律师核查，报告期内，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款是因正常的经营及投资活动发生，合法有效。

十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并

根据发行人的说明并经本所律师核查，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人无重大资产收购、出售或拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十二、 发行人公司章程的制定与修改

根据发行人提供的《公司章程》、工商登记资料、股东大会会议文件及发行人说明，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>），自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日，《公司章程》及《发行人章程》未进行修改。

十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

根据发行人确认，并经本所律师核查发行人会议资料，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间：

（一）发行人的组织结构没有发生变化；

(二) 发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则内容没有发生变化;

(三) 发行人共召开了 1 次股东大会、1 次董事会会议, 未召开监事会会议, 主要情况如下:

1、根据发行人提供的股东大会会议决议、会议记录、会议通知等相关文件, 自《补充法律意见书(三)》出具日至本补充法律意见书出具日期间, 发行人共召开了 1 次股东大会, 其主要情况如下:

序号	会议届次	会议召开时间
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 16 日

2、根据发行人提供的董事会会议决议、会议记录、会议通知等相关文件, 自《补充法律意见书(三)》出具日至本补充法律意见书出具日期间, 发行人共召开了 1 次董事会, 其主要情况如下:

序号	会议届次	会议召开时间
2	第一届董事会第十次会议	2022 年 3 月 15 日

经本所律师核查上述会议的召开通知、会议议案、会议决议、会议记录等文件资料, 本所律师认为, 发行人上述股东大会、董事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

十四、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

(一) 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况

自《补充法律意见书(三)》出具日至本补充法律意见书出具日期间, 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员范围未发生变化。经本所律师核查, 发行人的董事、监事、高级管理人员任职符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 发行人董事、监事及高级管理人员变化情况

根据发行人提供的股东大会、董事会、监事会决议等相关文件, 自《补充法律意见书(三)》出具日至本补充法律意见书出具日期间, 发行人董事、监事、高级管理

人员未发生变化。

十五、 发行人的税务及其变化情况

（一）税务登记及税种、税率

根据《2019-2021 年度审计报告》《主要税种纳税情况说明的专项审核报告》及发行人书面确认，并经本所律师核查，2021 年度，发行人及境内下属企业执行的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、13%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地面积	5 元/平方米

本所律师认为，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其境内子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

（二）税收优惠

根据《2019-2021 年度审计报告》《主要税种纳税情况专项说明》及发行人的说明，2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人享有的税收优惠无重大变化。

（三）财政补贴

根据《2019-2021 年度审计报告》及发行人的说明，2021 年度，发行人及其境内控股子公司获得的计入当期损益的政府补助金额为 18,975.01 万元。

（四）税务合规证明

2022 年 1 月 28 日，国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局向晶合集成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经金三征管系统查询，该纳税人自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日一直正常申报纳税，未发生违法违规等行为被税务机关

处罚的情形。”

2022年1月13日，国家税务总局南京市秦淮区税务局向南京晶驱出具《涉税信息查询结果告知书》，“经税收管理系统查询，你单位2020年08月01日至2021年12月31日期间，未发现违法违规记录。”

2022年1月19日，国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所（办税服务厅）向北京晶芯成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经查询，晶芯成（北京）科技有限公司为我局登记户，该单位于2021年06月30日至2021年12月31日在我局无缴纳税款。根据税务核心系统记载，该企业在此期间未接受过行政处罚，该单位企业所得税征收方式为查账征收。”

2022年1月28日，国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局出具《涉水信息查询结果告知书》，“经金三征管系统查询，该纳税人自2021年7月1日至2021年12月31日一直正常申报纳税，未发生违法违规等行为被税务机关处罚的情形。”

（五）税务处罚

自2021年7月1日至2021年12月31日期间，发行人及其子公司无新增税务处罚情况。

十六、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准的变化情况

（一）环境保护

1、 根据发行人说明及其提供的文件，自2021年7月1日至2021年12月31日期间，发行人新增主要环境污染物的处理设施及处理能力情况如下：

处理设备名称	数量 (套)	主要用途	处理能力	运行情况
污水处理站-含氟废水处理系统	1	处理含氟废水	960吨/天	正常
污水处理站-研磨废水处理系统	1	处理研磨废水	480吨/天	正常
污水处理站-有机废水	1	处理有机废水	480吨/天	正常

处理系统				
污水处理站-含氨废水处理系统	1	处理含氨废水	720 吨/天	正常

2、根据发行人说明及其提供的文件并经本所律师核查，2021年7月1日至2021年12月31日期间，发行人新增建设项目已获得了有关环境保护主管部门关于该等项目环境影响报告书的审查批复，同意建设该等项目，具体情况如下：

(1) 2021年9月15日，合肥市生态环境局出具了《关于合肥晶合集成电路有限公司合肥晶合集成电路先进工艺研发项目环境影响报告表的批复》（环建审[2021]12048号）。

(2) 2021年11月29日，合肥市生态环境局出具了《关于合肥新晶集成电路有限公司12吋晶圆制造项目环境影响报告表的批复》（环建审[2021]12064号）。

3、环保合规证明

2022年1月12日，合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局向发行人出具《证明》，“该公司自2021年6月30日以来，未发生过环境污染事故，也未因环境违法行为受到环保行政处罚或立案调查。”

2022年1月12日，合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局向新晶集成出具《证明》，“该公司自2021年6月30日以来，未发生过环境污染事故，也未因环境违法行为受到环保行政处罚或立案调查。”

4、根据发行人确认及本所律师通过网络公开信息检索等方式核查，自2021年7月1日至2021年12月31日期间，发行人不存在因经营活动违反环境保护法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件而受到处罚的情况。

(二) 产品质量和技术监督标准

根据发行人确认及本所律师通过网络公开信息检索等方式核查，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情况。

(三) 安全生产

根据发行人书面说明，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书

出具日期间，北京晶芯成、南京晶驱无实际经营，日本晶合不从事生产，不涉及安全生产相关事项，不涉及安全生产相关事项。发行人及晶合集成安全生产合规情况如下：

2022年1月12日，合肥市新站高新技术产业开发区应急管理局出具《关于合肥晶合集成电路股份有限公司安全生产有关情况的证明》，“自2021年6月30日至今，我局未发现合肥晶合集成电路股份有限公司在合肥新站高新技术产业开发区发生重大安全生产事故，也未因违反安全生产法律法规而受到我局安全生产行政处罚。”

2022年2月23日，安徽省应急管理厅出具《拟上市（挂牌）企业安全生产相关情况证明》，“合肥晶合集成电路有限公司自2021年6月30日至2022年2月15日，在合肥市辖区内未发生亡人生产安全事故。”

根据上述安全生产监督管理部门出具的证明、发行人书面确认并经本所律师核查，发行人及其子公司的生产经营符合安全生产监督管理要求，最近三年未发生过安全生产事故，未受过安全生产方面的行政处罚。

十七、 发行人的劳动与社会保障及其变化情况

1、 劳动合同

根据发行人提供的《劳动合同》模板，并经本所律师抽样核查发行人与员工签署的《劳动合同》，该等劳动合同的内容、形式符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的要求。

2、 社会保险缴纳情况

根据发行人提供的统计资料及社会保险及住房公积金缴纳凭证，截至2021年12月31日，发行人及其境内子公司员工共2,720人，已为其中2,186人缴纳社会保险，已为其中2,277人缴纳住房公积金。

发行人及其子公司未为全部员工缴纳社会保险的原因主要为（1）存在个别当月社会保险扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳社会保险；（2）在境内任职的中国台湾员工按照中国台湾地区相关规定缴纳了劳健保；（3）在境内任职的中国香港员工、外籍员工未缴纳社会保险；（4）境外子公司员工遵循当地法律相关规定缴纳社会保险。

发行人及其子公司未为全部员工缴纳住房公积金的原因主要为：（1）存在个别当

月住房公积金扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳住房公积金；（2）在境内任职的中国台湾员工、中国香港员工、外籍员工未缴纳住房公积金；（3）境外子公司员工遵循当地法律相关规定无需缴纳住房公积金。

2022年3月7日，合肥市人力资源和社会保障局出具证明：经核实，晶合集成依法足额缴纳各项社会保险费，自2018年1月1日至2022年3月7日未发现劳动用工违法行为，无人力资源社会保障行政部门处罚的不良记录。

2022年3月7日，合肥市住房公积金管理中心出具证明：晶合集成自2016年7月在我中心开户缴存职工住房公积金，该公司住房公积金缴存正常，未发现违反住房公积金相关法律法规的行为，公司未因住房公积金问题而受到行政处罚。

2022年3月7日，合肥市人力资源和社会保障局出具证明：经核实，新晶集成依法足额缴纳各项社会保险费，自2021年8月24日至2022年3月7日未发现劳动用工违法行为，无人力资源社会保障行政部门处罚的不良记录。

2022年3月7日，合肥市住房公积金管理中心出具证明：新晶集成自2021年12月在我中心开户缴存职工住房公积金，该公司住房公积金缴存正常，未发现违反住房公积金相关法律法规的行为，公司未因住房公积金问题而受到行政处罚。

十八、 发行人募集资金的运用

自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人本次发行上市募集资金投资项目的项目备案文件及环评备案文件未发生变化。

十九、 诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况

（一）发行人及其下属公司

经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/>）、信用中国网（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、中国裁判文书网

(<http://wenshu.court.gov.cn/>)、人民法院公告网(<http://rmfygg.court.gov.cn/>)、中国检察网(<http://www.12309.gov.cnajxxgk.jcy.gov.cn/12309/index.shtml>)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)，访谈发行人董事、监事和高级管理人员并根据发行人书面确认，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚。

(二) 持有发行人 5%以上股份的股东

根据持有发行人 5%以上股份的主要股东填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》、持有发行人 5%以上股份的主要股东出具的承诺函、境外法律意见书，并经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏(<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/>)、信用中国网(<https://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/index.html>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)、人民法院公告网(<http://rmfygg.court.gov.cn/>)、中国检察网(<http://www.12309.gov.cnajxxgk.jcy.gov.cn/12309/index.shtml>)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)等网站查询，截至本补充法律意见书出具日，持有发行人 5%以上股份的主要股东不存在对晶合集成产生影响的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

(三) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

根据发行人董事、监事、高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》、核心技术人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司核心技术人员调查表》，中国证监会安徽监管局诚信信息查询结果，并经本所律师查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)、中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)、人民法院公告网(<http://rmfygg.court.gov.cn/>)等网站，截至本补充法律意见书出具日，发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

二十、 发行人《招股说明书（注册稿）》法律风险的评价

经审阅发行人《招股说明书（注册稿）》所引用的《律师工作报告》《法律意见

书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》及本补充法律意见书相关内容部分，金杜认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人《招股说明书（注册稿）》及其摘要引用相关内容与《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》及本补充法律意见书不存在矛盾之处。金杜确认，《招股说明书（注册稿）》及其摘要不致因引用《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》及本补充法律意见书的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十一、 本次发行上市的总体结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，发行人自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间内所发生的变化，不会对《补充法律意见书（三）》中本所律师发表的结论意见构成影响，本所律师发表的结论意见依然有效。

第二部分 财务数据更新至 2021 年 12 月 31 日后《问询函》中涉 及的相关问题回复内容的更新

一、《问询函》第 11 题：关于技术来源和先进性

根据申报材料：（1）招股说明书对核心技术情况披露较为简单。公司取得力晶科技相关技术后，对工艺流程及参数指标进行优化，形成了现有技术平台。（2）核心技术人员多为中国台湾籍且具有力晶科技任职背景，部分曾有中芯国际、联华电子等工作经历。（3）截至 2020 年 12 月 31 日，发行人发明专利数量 2018 年为 0 项，2019 年为 2 项，2020 年为 71 项。（4）2015 年 10 月，《技术移转协议》约定力晶科技提供驱动 IC 代工所需之制程技术予公司，用以出资的转移技术作价 20 亿元。（5）2020 年 9 月，力晶科技将用于出资的 58 项专利技术使用权中尚在有效期的 44 项无偿转让给晶合有限。（6）2018 年 4 月、2021 年 4 月，发行人同力晶科技签订了《90nm 项目技术协议》及《补充协议》，约定力晶科技向公司移转 90nm M+ 驱动 IC 制程技术相关技术数据及文件，公司需合计支付 500 万美元。

请发行人详细披露核心技术的形成过程，力晶科技在发行人技术发展过程中的作用，现有技术平台和技术先进性的具体表征。

请发行人说明：（1）自身研发团队取得力晶科技技术后改进优化所取得的技术成果，对公司业务及生产经营的影响；……。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。请发行人律师说明对核心技术人员是否存在违反竞业禁止、保密协议的情形，是否使用原任职单位技术成果，是否存在纠纷或潜在纠纷事项的核查情况及核查结论。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（一）自身研发团队取得力晶科技技术后改进优化所取得的技术成果，对公司业

务及生产经营的影响

2、对公司业务及生产经营的影响

报告期内，发行人晶圆代工业务收入分别为 53,336.01 万元、151,186.11 万元及 542,084.44 万元，实现了稳健增长。

二、《问询函》第 12.2 题：委派管理人员

根据申报材料：（1）按照委托经营协议，存在力晶科技、合肥建投委派部分管理人员的情形，委派人员所在岗位主要是财务和内审部门。2020 年 4 月起，公司各部门已无股东委派高管。（2）2018 年 12 月，发行人依据《委托经营管理合约》组建了经营管理委员会。

请发行人说明：……（2）委托经营管理期间经营决策的具体过程，列表说明委托经营管理期间及委托经营管理终止后发行人经营管理团队的变化，相关变动人员的来源及劳动关系隶属情况；……。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见，请申报会计师就发行人财务是否独立于力晶科技进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（二）委托经营管理期间经营决策的具体过程，列表说明委托经营管理期间及委托经营管理终止后发行人经营管理团队的变化，相关变动人员的来源及劳动关系隶属情况

2、委托经营管理期间及委托经营管理终止后发行人经营管理团队的变化，相关变动人员的来源及劳动关系隶属情况

根据发行人自设立以来历次董事会会议、合肥建投及力晶科技向发行人委派高管

的相关函件以及发行人出具的说明，2018年初至报告期末，发行人经营管理团队人员的变化情况如下：

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
1	/	总经理	2018年1月-2020年3月	黎湘鄂	发行人员工	发行人
			2020年3月-报告期末	蔡辉嘉	发行人员工	发行人
2	运营	副总经理	2018年1月-2020年3月	蔡辉嘉	发行人员工	发行人
			2020年4月-报告期末	邱显寰	发行人员工	发行人
		助理	2019年12月-报告期末	邱显寰	发行人员工	发行人
			2020年4月-2020年11月	未设置		
			2020年12月-报告期末	李庆民	发行人员工	发行人
3	采购	总监/副总经理	2018年1月-2020年11月	盛惟健	发行人员工	发行人
			2020年11月-报告期末	未设置		
		助理	2020年11月-报告期末	简瑞荣	发行人员工	发行人
		副总监	2018年1月-2019年5月	周义亮	合肥建投委派	合肥建投
			2019年5月-2020年3月	王继武	合肥建投委派	合肥建投
			2020年3月-报	未设置		

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属	
			告期末				
4	销售	总监/副总经理	2018年1月- 2019年10月	黎湘鄂	发行人员工	发行人	
			2019年10月- 2020年4月	未设置			
			2020年4月- 2020年6月	孙志明	发行人员工	发行人	
			2020年6月- 2021年11月	未设置			
			2021年11月- 报告期末	周义亮	发行人员工	发行人	
		助理	2019年10月- 2020年4月	孙志明	发行人员工	发行人	
			2020年4月- 2021年11月	周义亮	发行人员工	发行人	
			2021年11月- 报告期末	未设置			
		副总监	2018年1月- 2020年3月	周义亮	发行人员工	发行人	
			2020年4月-报 告期末	未设置			
5	研发	副总经理	2018年1月- 2019年3月	陈耿川	发行人员工	发行人	
			2020年4月-报 告期末	詹奕鹏	发行人员工	发行人	
		助理	2019年3月- 2020年3月	詹奕鹏	发行人员工	发行人	

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
			2020年4月-报告期末	未设置		
6	财务	总会计师/财务负责人	2018年1月-2020年3月	朱才伟	合肥建投委派	合肥建投
			2020年4月至报告期末	朱才伟	发行人员工	发行人
		副总会计师/助理	2018年1月-2019年3月	邱垂源	力晶科技委派	力晶科技
			2019年3月-2020年3月	李迦谕	力晶科技委派	力晶科技
			2020年4月-报告期末	李迦谕	发行人员工	发行人
7	内审	审计师	2018年1月-2018年5月	陈美华	力晶科技委派	力晶科技
			2018年5月-2018年12月	潘炯升	力晶科技委派	力晶科技
			2019年1月-2019年12月	朱晓娟	合肥建投委派	合肥建投
			2019年12月-2020年4月	杨幼玲	合肥建投委派	合肥建投
			2020年4月-报告期末	未设置		
8	行政	副总经理	2018年1月-2018年5月	刘荫	力晶科技委派	力晶科技
			2018年5月-2019年10月	未聘任，由采购总监盛惟健代管		
			2019年10月-	朱晓娟	合肥建投委派	合肥建投

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
			2020年3月			
			2020年4月-报告期末	朱晓娟	发行人员工	发行人
9	证券	董事会秘书	2020年4月-报告期末	朱才伟	发行人员工	发行人
10	敬业监督	敬业促进委员会委员长	2018年1月-2019年11月	朱晓娟	合肥建投委派	合肥建投
			2019年12月-2020年11月	杨幼玲	合肥建投委派	合肥建投
			2020年11月-报告期末	不再为高级管理人员职位		

综上，2018年初至报告期末，发行人经营管理团队主要来源于发行人员工；截至报告期末，发行人高级管理人员均由公司聘任，不涉及股东委派的情形。关于独立性。

三、《问询函》第12.2题：向控股股东子公司租赁厂房及设施

根据申报材料：（1）发行人及其子公司无自有房产及土地使用权。目前主要办公场所及全部生产场所为向合肥建投全资子公司合肥蓝科租赁，募投项目实施相关厂房系向合肥蓝科租赁。环保设施由合肥蓝科与厂房一同建设并出租给发行人使用。（2）2017年公司与合肥蓝科、力晶科技签订的《厂房建设与租用协议》及公司与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》租入厂房及配套厂务设备；2021年4月，公司与合肥蓝科签订《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》对晶合二厂及配套设施认定为经营性租赁，同期公司与合肥蓝科签订《收购意向协议》，公司承诺在该项目交付之日起5年内完成收购。（3）以融资租赁方式进行核算，报告期各期末，公司融资租入固定资产账面价值分别为176,313.65万元、169,151.82万元和161,990.00万元。

请发行人说明：……（2）发行人大额固定资产、在建工程与上述厂房的关系……。

请保荐机构、发行人律师对事项（1）-（3）和申报会计师对事项（2）和（4）进行核查并发表明确意见。请保荐机构和发行人律师根据《问答（二）》第7条的规定，充分论证上述情况是否对发行人资产完整和独立性构成重大不利影响，督促发行人做好信息披露和风险揭示。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

2、发行人大额固定资产、在建工程与上述厂房的关系

报告期内，发行人固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面原值	账面价值	账面原值	账面价值	账面原值	账面价值
固定资产	1,912,854.87	1,632,598.75	963,849.07	776,607.78	830,304.51	720,936.40
其中：房屋及建筑物	2,964.35	2,653.02	189,450.20	164,395.89	189,080.29	171,257.26
其中：机器设备	1,890,601.76	1,618,943.07	765,356.07	608,864.61	634,166.05	546,355.03
其中：运输工具	274.08	0.07	274.08	0.21	274.08	50.12
其中：电子设备及其他	19,014.68	11,002.59	8,768.72	3,347.06	6,784.09	3,273.99
融资租入固定资产	325,766.54	291,688.85	187,056.39	161,990.00	187,056.39	169,151.82
其中：房屋及建筑物	325,498.10	291,662.00	186,787.95	161,909.47	186,787.95	169,017.60
其中：电子设备及其他	268.44	26.84	268.44	80.53	268.44	134.22
融资租入固定资产占固定资产的比例	14.55%	15.16%	19.41%	20.86%	22.53%	23.46%
其中：房屋及建筑	99.10%	99.10%	98.59%	98.49%	98.79%	98.69%

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面原值	账面价值	账面原值	账面价值	账面原值	账面价值
物						
其中：电子设备及 其他	1.39%	0.24%	3.06%	2.41%	3.96%	4.10%

注：发行人自 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则，将融资租入固定资产调整计入使用权资产。为保证 2019 年至 2021 年数据可比，上表 2021 年“融资租入固定资产占固定资产的比例”计算方式为融资租入固定资产金额/（固定资产金额+融资租入固定资产金额）

上述租赁厂房及配套厂务设备等计入固定资产的房屋及建筑物、电子设备及其他，不存在租入的在建工程，由于配套厂务设备与厂房密不可分，故作为房屋及建筑物核算。

报告期各期末，公司融资租入固定资产账面价值分别为 169,151.82 万元、161,990.00 万元和 291,688.85 万元，主要为根据公司与合肥蓝科、力晶科技签订的《厂房建设与租用协议》及公司与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》和《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》所租入的厂房及配套厂务设备。报告期内，上述租赁获得的厂房及配套厂务设备原值占发行人固定资产原值的比例分别为 22.53%、19.41%和 14.55%，占发行人固定资产中房屋及建筑物原值的比例分别为 98.79%、98.59%和 99.10%，发行人房屋及建筑物主要通过上述租赁方式获得。

四、《问询函》第 12.5 题：社保缴纳情况

报告期各期末在境内缴纳社会保险、住房公积金的人数为 300 多人，占员工总人数比例 20%以上。

请发行人说明：台湾籍员工的数量、职位分布……。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

根据发行人提供的员工名单及工资表、中国台湾员工劳动合同、社保缴纳凭证、中国台湾劳务公司代缴劳健保的相关协议并经本所律师与代缴公司确认，报告期内，发行人中国台湾员工均与发行人或其子公司签订了劳动合同，由发行人或其子公司承担薪酬，其中主要为制造、研发人员，具体情况如下：

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
中国台湾员工数量	340	264	299
其中：			
研发人员	117	59	64
制造人员	168	157	182
销售人员	21	15	11
管理人员	34	33	42

注：截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末，发行人中国台湾员工占发行人总员工比例分别为 21.90%、15.85%、12.50%。

五、《问询函》第 13 题：关于关联交易

根据申报材料：（1）合肥建投和力晶科技通过向发行人委派管理人员的方式向发行人提供企业管理、会计等相关咨询服务。发行人向合肥建投支付咨询服务费用已于 2020 年 3 月 31 日终止，向力晶科技支付的咨询服务费已于 2020 年 6 月 30 日终止。

（2）报告期各期，发行人向智成电子采购服务费分别为 177.18 万元、152.95 万元和 372.62 万元。

请发行人说明：……（3）发行人向智成电子采购服务费的具体情况，后续是否具有持续性，相关定价公允性……。

请保荐机构、发行人律师对上述事项（1）-（3）和申报会计师对上述事项（4）进行核查并发表明确意见。

回复：

（三）发行人向智成电子采购服务费的具体情况，后续是否具有持续性，相关定价公允性

1、发行人向智成电子采购服务费的具体情况，后续是否具有持续性

根据发行人与智成电子于 2017 年 5 月 1 日签订的《产品开发、技术授权暨维护合约书》、于 2019 年 3 月 4 日签订的《智成权利金合同》、于 2020 年 3 月 31 日签订的

《智成权利金合同》以及于 2021 年 7 月 1 日签订的《智成权利金合同》，智成电子同意以其所有的 110nm 逻辑制程所需之 Standard Cell Library 授权发行人，并配合发行人的制程特性，维护发行人向智成电子授权取得之产品技术，以使其符合发行人代工客户需求，并达到效率提升、错误侦错并协助发行人推展逻辑制程代工业务。报告期各期，针对上述 IP 授权交易，发行人分别确认费用 152.95 万元、372.62 万元和 784.48 万元。

发行人对外部授权 IP 的选择，主要受代工产品工艺技术要求驱动，未来，发行人不排除基于代工产品工艺技术要求继续向智成电子取得上述 IP 或其他类型 IP 的授权。因此，发行人与智成电子的 IP 授权交易具有持续性。

2、发行人与智成电子的上述交易相关定价公允性

根据发行人与智成电子签署的 IP 授权协议以及发行人与无关联第三方 IP 供应商签订的授权协议，报告期内，发行人与智成电子就上述授权 IP 约定的价款包括前期开发费用和权利金，其中权利金为交易价款的主要组成部分。报告期内，发行人与智成电子约定的授权 IP 权利金为单片晶圆净销售额的 1%。截至 2021 年 12 月 31 日，除智成电子授权 IP 外，发行人正在使用的其他授权 IP 权利金计提比例（按每片晶圆支付固定金额的除外）主要区间为晶圆销售金额或净额的 0.5%-1.5%。因此，发行人与智成电子的上述交易价格仍处于发行人确定的合理价格区间范围内。

对于与智成电子的上述 IP 授权交易，发行人遵循市场化交易原则，与智成电子协商确定 IP 授权价格，采购价格具备公允性。

2021 年 2 月 9 日，发行人召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认合肥晶合集成电路股份有限公司 2018 年度至 2020 年度期间关联交易的议案》；发行人全体独立董事就报告期内的关联交易事项发表了独立意见，认为包括上述 IP 授权交易在内的关联交易，交易定价公允、合理，关联交易事项按照一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。2021 年 3 月 16 日，发行人召开股东大会，审议通过了关于公司报告期内的关联交易预计的议案，关联股东在股东大会审议该议案时回避表决。

综上，发行人与智成电子的上述 IP 授权交易，交易相关定价具有公允性。

六、《第二轮问询函》第 5 题：关于实际控制人认定

根据问询回复：（1）2019年12月以前，发行人最高权力机构董事会，有9名董事。公司章程规定重大经营、财务、人事事项需2/3董事同意，部分事项需要一致批准。而合肥建投占5席，未达2/3。回复中称合肥国资方委派董事在发行人董事会中占实质主导地位；（2）公司董事长提名人为力晶科技；（3）公司高管成员包括行使敬业监督职能的敬业促进委员会委员长，由合肥建投进行委派；（4）回复中列式了报告期内公司高级管理人员的变化情况，但未说明相关人员的提名情况；（5）公司组建了经营管理委员会作为董事会幕僚机构，其中合肥建投指派人员的职责主要为监督。

请发行人说明：……（2）行使敬业监督职能高管的具体职能行使情况，该职位是否主要针对与力晶科技合作进行设置，报告期内的实际执行情况；……。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（二）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（二）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（3）敬业促进委员会人员构成

自2017年9月敬业促进委员会成立至报告期末，公司敬业促进委员会的人员构成及变化情况具体如下：

日期	委员长	委员			
2017.9至2018.5	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	陈美华（审计师）	-
2018.5至2019.1	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	潘炯升（审计师）	-
2019.1	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	林士然（副审计师）	-
2019.1至2019.12	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	林士然（副审计师）	刘桂云（党委办公室主任）
2019.12至2020.4	杨幼玲	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	林士然（副审计师）	刘桂云（党委办公室主任）
2020.4至2020.8	杨幼玲	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	王兴亚（财会处处长）	刘桂云（党委办公室主任）

2020.8至2021.3	杨幼玲	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	王兴亚（财会处处长）	林士然（总经理特别助理）
2021.3至2021.6	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	王兴亚（财会处处长）	林士然（总经理特别助理）
2021.6至2021.12	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源处代副处长）	王兴亚（财会处处长）	黎翠绫（企业规划室资深处长）

(5) 报告期内的实际执行情况

报告期内，敬业促进委员会共计召开 13 次会议，均由敬业委员会委员长主持，相关会议具体情况如下：

序号	召开日期	会议主要内容及处理结果	董事会汇报情况
1	2019.1.10	审议一起员工工作能力不足、二起员工违反公司出勤规定及一起员工违反公司住宿规定检举事件。各委员依调查结果讨论后，违反出勤规定属实者给予申诫 1 次、并追回虚报加班费用；违反住宿规定属实者，取消入住公司宿舍权利。以上四起案件公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十一一次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
2	2019.4.11	审议一起员工作业疏失及一起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，违反敬业规范属实者给予申诫 1 次，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十二次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
3	2019.6.19	审议二起员工违反工作纪律及一起员工在外行为影响其他同事。各委员依调查结果讨论后，违反工作纪律属实者给予扣二个月绩效，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十三次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
4	2019.9.5	审议一起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，未有违反敬业规范之情况，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十三次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
5	2019.10.24	审议一起拖欠供应商货款。各委员依调查结果讨论后，检举不属实，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十四次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
6	2019.12.17	审议一起员工违反工作纪律。各委员	处理结果在晶合有限第

序号	召开日期	会议主要内容及处理结果	董事会汇报情况
		依调查结果讨论后，未有违反工作纪律之情况，并公告厂内周知	一届第二十五次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
7	2020.1.15	审议一起采购品项不符合招标需求。各委员依调查结果讨论后，检举不属实	处理结果在晶合有限第一届第二十五次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
8	2020.8.27	审议一起采购品项指定单一品牌及一起员工泄露供应商报价。各委员依调查结果讨论后，检举不属实，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第二届第四次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
9	2020.11.5	审议一起员工违反公司住宿补贴规定。各委员依调查结果讨论后，违反住宿补贴规定属实者给予记过 1 次，并追回虚报住宿补贴及取消领取补贴资格，同时公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第三次会议中作为报告事项向董事会汇报
10	2021.1.22	审议一起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，未有违反敬业规范之情况，并公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第三次会议中作为报告事项向董事会汇报
11	2021.3.18	审议二起员工违反公司工作纪律。各委员依调查结果讨论后，违反工作纪律属实者给予解雇，并公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第五次会议中作为报告事项向董事会汇报
12	2021.5.19	审议二起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，违反敬业规范属实者分别给予申诫 1 次和记过 1 次，并公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第六次会议中作为报告事项向董事会汇报
13	2021.8.4	审议一起员工违反公司敬业规范及一起员工违反公司纪律。各委员依调查结果讨论后，未有违反敬业规范之情况、违反工作纪律属实者给予记过 1 次，并公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第八次会议中作为报告事项向董事会汇报

七、《第二轮问询函》第 7 题：关于无形资产和技术

根据问询回复：（1）2015 年 10 月，晶合有限与力晶科技、合肥建投签订《技术转移协议》，约定力晶科技以三项制程技术作价 20 亿元出资晶合有限，包括专利技术、

技术文件及数据以及技术经验等内容，所涉及的 58 项专利使用权的到期时间在 2016 年至 2025 年，截至问询函回复出具日，上述发明专利权中 14 项已到期，但 2018 年和 2019 年末，发行人对无形资产进行了减值测试未发现减值迹象；（2）2018 年导入 90nmM+技术平台；（3）报告期内，发行人向智成电子采购 IP 授权交易分别为 177.18 万元、152.95 万元和 372.62 万元，智成电子系力晶科技控制公司。未来发行人不排除基于代工产品工艺技术要求继续向智成电子取得上述 IP 或其他类型 IP 的授权。发行人与智成电子的 IP 授权交易具有持续性。

请发行人说明：……（3）发行人向智成电子采购 IP 授权交易的原因，在发行人生产经营及技术方面的作用，发行人目前技术与力晶科技之间的关系，是否存在技术依赖。

请保荐机构、发行人律师和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（二）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（二）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（三）发行人向智成电子采购 IP 授权交易的原因，在发行人生产经营及技术方面的作用，发行人目前技术与力晶科技之间的关系，是否存在技术依赖

报告期内，发行人对技术进行持续自主研发并创新升级，以满足不同客户针对不同制程节点、不同工艺平台的产品需求，并形成了稳定的研发人员团队，团队成员均与发行人直接签署劳动合同。同时，发行人不断将研发投入所形成的科研成果及核心技术通过申请专利等方式进行保护，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人已形成与主营业务收入相关的发明专利共 198 件，不依赖于力晶科技的研发团队、科研成果及专利和非专利技术，具有独立研发能力。

八、《第二轮问询函》第 9.2 题

报告期内，报告期内除日本子公司员工外，发行人台籍员工通过中国台湾第三方劳务公司怡东人事顾问股份有限公司为其在中国台湾地区缴纳劳健保。

请结合相关法律法规规定说明上述代缴社保相关情形是否符合相关法律法规规定以及对公司的影响。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（二）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（二）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（四）发行人通过第三方劳务公司代缴劳健保事宜对于发行人经营成果的影响

根据发行人测算，报告期内，发行人为中国台湾员工实际缴纳劳健保、未在中国大陆缴纳社会保险对发行人经营成果的影响如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2020 年度	2021 年度
发行人为中国台湾员工实际缴纳劳健保的金额（a）	555.63	560.10	689.99
发行人应为中国台湾员工缴纳社会保险的金额（b）	1,423.38	413.61	1,391.02
差额（b-a）	867.75	-146.49	701.03
营业总成本（c）	169,998.65	255,660.04	380,028.97
发行人应为中国台湾员工缴纳社会保险的金额占营业总成本的比例（b/c）	0.84%	0.16%	0.37%
差额占营业总成本的比例 [(b-a)/c]	0.51%	-0.06%	0.18%

注：2020 年度，国家在疫情期间推出了社保减免政策，因此，发行人应为中国台湾员工缴纳社会保险的金额大幅降低。

发行人报告期内应当为中国台湾员工在中国大陆缴纳社会保险的金额与发行人为中国台湾员工缴纳劳健保的金额的差额占发行人营业总成本的比例分别为 0.51%、-0.06%、0.18%，发行人通过第三方劳务公司代缴劳健保事对发行人的经营成果影响较小。

九、《第二轮问询函》第 9.3 题

公司于 2017 年在日本设立子公司，员工主要来源于 Synaptics 公司，日本晶合所取得的知识产权权益归属于晶合集成。2017 年前后 Synaptics 公司拟进行业务转型，晶合集成获得吸纳曾于 Synaptics 日本子公司任职的研发团队的机会。

请发行人说明：相关人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，相关研发成果是否涉及其原任职单位的技术成果，是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（二）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（二）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

发行人日本子公司吸纳曾于 Synaptics 日本子公司任职的研发团队，截至 2021 年 12 月 31 日，日本晶合共有 19 名员工，其中 9 名曾任职于 Synaptics 日本子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，日本晶合员工作为发明人、在发行人任职期间自主研发并取得的授权专利共计 16 项，具体情况如下：

序号	权利人	发明人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	国别
1	发行人	田矢真敏； 中野纪夫； 熊谷裕弘	发明专利	半导体组件的 制造方法	ZL2019101 03609.4	2019/02/01	中国
2	发行人	川村昌靖； 夏目秀隆； 藤并康博； 熊谷裕弘	发明专利	电容性半导体 组件	ZL2019103 40165.6	2019/04/25	中国
3	发行人	田矢真敏； 川村昌靖；	发明专利	电容性半导体 组件	ZL2020103 24914.9	2020/04/23	中国

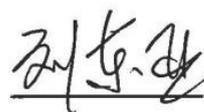
序号	权利人	发明人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	国别
		夏目秀隆; 藤井康博					
4	发行人	小嶋英充	发明专利	ラッチ回路	特许第 6761074号	2019/05/21	日本
5	发行人	小嶋英充	发明专利	SRAM、半導 体集積回路及 びLCDドラ イバ	特许第 6801053号	2019/06/19	日本
6	发行人	川村昌靖; 夏目秀隆; 藤井康博; 熊谷裕弘	发明专利	容量性半導 体素子	特许第 6831067号	2019/04/25	日本
7	发行人	田矢真敏; 中野纪夫; 熊谷裕弘	发明专利	半導体素子の 製造方法	特许第 6826795号	2019/01/09	日本
8	发行人	田矢真敏; 中野纪夫; 熊谷裕弘	发明专利	高耐庄半導 体素子及びその 製造方法	特许第 6892889号	2019/04/15	日本
9	发行人	田矢真敏; 川村昌靖; 夏目秀隆	发明专利	容量性半導 体素子	特许第 6918173号	2020/04/23	日本
10	北京晶 芯成	夏目秀隆; 田矢真敏; 藤井康博; 中野纪夫	发明专利	半导体测试结 构	ZL2020111 59567.5	2020/10/27	中国
11	发行人	田矢真敏; 中野纪夫; 熊谷裕弘	发明专利	高耐压半導 体组件及其制造 方法	ZL2019102 99871.0	2019/04/15	中国

序号	权利人	发明人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	国别
12	北京晶芯成	大田裕之	发明专利	一种半导体装置的制备方法	ZL202011136147.5	2020/10/22	中国
13	北京晶芯成	藤井康博； 李波；陈信全	发明专利	半导体器件	ZL202011122488.7	2020/10/20	中国
14	北京晶芯成	田矢真敏； 石田浩；中野纪夫	发明专利	功率半导体器件及制造方法	ZL202011333530.X	2020/11/25	中国
15	北京晶芯成	小嶋英充； 藤井康博	发明专利	半导体存储器件	ZL202011572842.6	2020/12/28	中国
16	北京晶芯成	田矢真敏； 石田浩；熊谷裕弘	发明专利	半导体器件及其制造方法	ZL202110397617.1	2021/04/14	中国

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（五）》之签章页）



经办律师： 
苏 峥


刘东亚

单位负责人： 
王 玲

二〇二二年三月十一日

附件：发行人及其子公司拥有的知识产权

1、境内注册商标

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式
1	晶合集成	Nexchip	26258933	25	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
2	晶合集成	Nexchip	26283789	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
3	晶合集成	Nexchip	26255490	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
4	晶合集成	晶合	26295138 A	9	2018/11/07-2028/11/06	原始取得
5	晶合集成	晶合	26261189	25	2018/10/28-2028/10/27	原始取得
6	晶合集成	晶合	26283543	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
7	晶合集成	晶合	26258453	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
8	晶合集成	晶合集成	26296982 A	9	2018/11/07-2028/11/06	原始取得
9	晶合集成	晶合集成	26257005	25	2018/10/28-2028/10/27	原始取得
10	晶合集成	晶合集成	26279879	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式
11	晶合集成	晶合集成	26258966	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
12	晶合集成		26279826	9	2018/12/07-2028/12/06	原始取得
13	晶合集成		43218141	25	2020/10/14-2030/10/13	原始取得
14	晶合集成		26279830	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
15	晶合集成		26273278	40	2019/12/14-2029/12/13	原始取得
16	晶合集成	 Nexchip	36794768	25	2020/08/21-2030/08/20	原始取得
17	晶合集成	晶芯成	54924121	9	2021/11/7-2031/11/6	原始取得
18	晶合集成	晶芯成	53267990	25	2021/9/7-2031/9/6	原始取得
19	晶合集成	晶芯成	54895828	35	2021/11/7-2031/11/6	原始取得
20	晶合集成	晶芯成	53268332	40	2021/9/7-2031/9/6	原始取得
21	晶合集成	晶驱	53274613	25	2021/8/28-2031-8/27	原始取得
22	晶合集成	晶驱	53264804	40	2021/8/28-2031/8/27	原始取得

2、境外商标情况

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
1	晶合有限	Nexchip	6098177	9	2018/11/16-2028/11/15	原始取得	日本
2	晶合有限	Nexchip	6071853	25	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
3	晶合有限	Nexchip	6098177	35	2018/11/16-2028/11/15	原始取得	日本
4	晶合有限	Nexchip	6071853	40	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
5	晶合有限	晶合	6050343	9	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
6	晶合有限	晶合	6070505	25	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
7	晶合有限	晶合	6050343	35	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
8	晶合有限	晶合	6070505	40	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
9	晶合有限	晶合集成	6050344	9	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
10	晶合有限	晶合集成	6071852	25	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
11	晶合有限	晶合集成	6050344	35	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
12	晶合有限	晶合集成	6071852	40	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
13	晶合有限		6050345	9	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
14	晶合有限		6070504	25	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
15	晶合有限		6050345	35	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
16	晶合有限		6070504	40	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
17	晶合有限	Nexchip	0191963 9	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
18	晶合集成	Nexchip	0192363 3	25	2018/07/01-2028/06/30	原始取得	中国台湾
19	晶合有限	Nexchip	0192098 3	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
20	晶合集成	Nexchip	0191274 5	40	2018/05/01-2028/04/30	原始取得	中国台湾
21	晶合有限	晶合	0191963 7	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
22	晶合集成	晶合	0190940 1	25	2018/04/16-2028/04/15	原始取得	中国台湾
23	晶合有限	晶合	0192098 1	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
24	晶合集成	晶合	0191274 3	40	2018/05/01-2028/04/30	原始取得	中国台湾

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
25	晶合有限	晶合集成	01919636	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
26	晶合集成	晶合集成	01909400	25	2018/04/16-2028/04/15	原始取得	中国台湾
27	晶合有限	晶合集成	01920980	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
28	晶合集成	晶合集成	01918174	40	2018/06/01-2028/05/31	原始取得	中国台湾
29	晶合有限		01919638	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
30	晶合集成		01909402	25	2018/04/16-2028/04/15	原始取得	中国台湾
31	晶合有限		01920982	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
32	晶合集成		01912744	40	2018/05/01-2028/04/30	原始取得	中国台湾
33	晶合有限	Nexchip	5513533	9	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
34	晶合有限	Nexchip	5513299	25	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
35	晶合有限	Nexchip	5559722	35	2018/09/11-2028/09/10	原始取得	美国
36	晶合有限	Nexchip	5513440	40	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
37	晶合有限	晶合	5523772	9	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
38	晶合有限	晶合	5518583	25	2018/07/17-2028/07/16	原始取得	美国
39	晶合有限	晶合	5513532	35	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
40	晶合有限	晶合	5518584	40	2018/07/17-2028/07/16	原始取得	美国
41	晶合有限	晶合集成	5518591	25	2018/07/17-2028/07/16	原始取得	美国
42	晶合有限	晶合集成	5523770	9	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
43	晶合有限	晶合集成	5523769	35	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
44	晶合有限	晶合集成	5513586	40	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
45	晶合有限		5523767	9	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
46	晶合有限		5523806	25	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
47	晶合有限		5523768	35	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
48	晶合有限		5523807	40	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
49	晶合有限	Nexchip	0180744 17	9	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
50	晶合有限	Nexchip	0180744 17	35	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
51	晶合有限	Nexchip	0180744 17	40	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
52	晶合有限	 Nexchip	0180739 71	9	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
53	晶合有限	 Nexchip	0180739 71	35	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
54	晶合有限	 Nexchip	0180739 71	40	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
55	晶合有限		0180739 76	9	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
56	晶合有限		0180739 76	35	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
57	晶合有限		0180739 76	40	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
58	晶合有限	Nexchip	4196328	35	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度
59	晶合有限	Nexchip	4196329	40	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度
60	晶合有限	 Nexchip	4216333	35	2019/06/25- 2029/06/24	原始取得	印度
61	晶合有限	 Nexchip	4216334	40	2019/06/25- 2029/06/24	原始取得	印度
62	晶合有限		4196323	9	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度
63	晶合有限		4196324	35	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
64	晶合有限		4196325	40	2019/06/03-2029/06/02	原始取得	印度
65	晶合有限	Nexchip	401603379	35	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
66	晶合有限	Nexchip	401603380	40	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
67	晶合集成	Nexchip	401684625	9	2021/1/20-2031/1/19	原始取得	韩国
68	晶合有限	 Nexchip	401605036	35	2020/05/12-2030/05/11	原始取得	韩国
69	晶合有限	 Nexchip	401605037	40	2020/05/12-2030/05/11	原始取得	韩国
70	晶合集成	 Nexchip	401684665	9	2021/1/20-2031/1/19	原始取得	韩国
71	晶合有限		401603377	9	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
72	晶合有限		401603378	35	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
73	晶合有限		401599318	40	2020/04/23-2030/04/22	原始取得	韩国
74	晶合有限	Nexchip	40201926832S	35	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
75	晶合有限	Nexchip	40201926831T	40	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
76	晶合集成	Nexchip	40201926806V	9	2019/12/11-2029/12/10	原始取得	新加坡
77	晶合有限	 Nexchip	40201925814T	35	2019/11/28-2029/11/27	原始取得	新加坡
78	晶合集成	 Nexchip	40201925815S	40	2019/11/28-2029/11/27	原始取得	新加坡
79	晶合集成	 Nexchip	40201926869W	9	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
80	晶合有限		40201926842V	9	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
81	晶合有限		40201926838P	35	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
82	晶合集成		40201926847Q	40	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
83	晶合集成	 Nexchip	TM2019044357	9	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
84	晶合集成	 Nexchip	TM2019044362	35	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚
85	晶合集成	 Nexchip	TM2019044364	40	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚
86	晶合集成	Nexchip	TM2019045346	9	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
87	晶合集成	Nexchip	TM2019045348	35	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
88	晶合集成	Nexchip	TM2019045350	40	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
89	晶合集成		TM2019045352	9	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
90	晶合集成		TM2019045355	35	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
91	晶合集成		TM2019045357	40	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚

3、境内专利

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
1	晶合集成	发明专利	光学光刻方法	ZL03155531.4	2003/08/28	继受取得
2	晶合集成	发明专利	具有自行对准接触窗的半导体元件及其制造方法	ZL20051006558 0.3	2005/04/18	继受取得
3	晶合集成	发明专利	导线的制造方法	ZL20051006560 8.3	2005/04/18	继受取得
4	晶合集成	发明专利	半导体元件及其制造方法	ZL20061000589 1.5	2006/01/19	继受取得
5	晶合集成	发明专利	导线的制造方法以及缩小导线与图案间距的方法	ZL20051012976 7.5	2005/12/05	继受取得
6	晶合集成	发明专利	电路结构及用以定义此电路结构的光掩模	ZL20071016177 5.7	2007/09/26	继受取得
7	晶合集成	发明专利	监控光刻工艺的方法与监控标记	ZL20081009331 7.9	2008/04/18	继受取得
8	晶合集成	发明专利	分栅式非易失性存储器及其制备方法	ZL20181079627 7.8	2018/07/19	原始取得
9	晶合集成	发明专利	一种晶元破片分析装置及其晶元破片分析方法	ZL20181089730 0.2	2018/08/08	原始取得
10	晶合集成	发明专利	一种裂片装置及方法	ZL20181092034 3.8	2018/08/14	原始取得
11	晶合集成	发明专利	一种半导体结构制造方法	ZL20181098035 6.4	2018/08/27	原始取得
12	晶合集成	发明专利	MOS 场效应晶体	ZL20181123719	2018/10/23	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			管及其制造方法	7.5		
13	晶合集成	发明专利	一种非易失性存储器及其制作方法	ZL20181134571 9.3	2018/11/13	原始取得
14	晶合集成	发明专利	一种非易失性存储器及其制作方法	ZL20181135413 9.0	2018/11/14	原始取得
15	晶合集成	发明专利	沟槽隔离结构的形成方法	ZL20191004869 4.9	2019/01/18	原始取得
16	晶合集成	发明专利	一种存储器及其制造方法	ZL20191010474 7.4	2019/02/01	原始取得
17	晶合集成	发明专利	高耐压半导体元件及其制造方法	ZL20191029987 1.0	2019/04/15	原始取得
18	晶合集成	发明专利	预处理方法、金属硅化物的形成方法以及半导体处理装置	ZL20191061196 6.1	2019/07/08	原始取得
19	晶合集成	发明专利	沟槽制作方法及半导体隔离结构制作方法	ZL20191126817 3.0	2019/12/11	原始取得
20	晶合集成	发明专利	半导体集成器件的阱制备方法和阱注入光罩组	ZL20191130399 1.X	2019/12/17	原始取得
21	晶合集成	发明专利	一种半导体器件的制造方法及其形成的半导体器件	ZL20191132656 3.9	2019/12/20	原始取得
22	晶合集成	发明专利	扩散型场效应晶	ZL20201004399	2020/01/15	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			体管的形成方法	7.4		
23	晶合集成	发明专利	半导体器件及其 制造方法	ZL20201009979 8.5	2020/02/18	原始取得
24	晶合集成	发明专利	半导体元件的制 造方法	ZL20191010360 9.4	2019/02/01	原始取得
25	晶合集成	发明专利	一种建立光学数 据校正模型的方 法	ZL20201021935 6.X	2020/03/25	原始取得
26	晶合集成	发明专利	一种晶圆的退火 方法	ZL20201037248 9.0	2020/05/06	原始取得
27	晶合集成	发明专利	一种半导体结构 及其制造方法	ZL20201045497 7.6	2020/05/26	原始取得
28	晶合集成	发明专利	一种半导体结构 及其制造方法	ZL20201035848 3.8	2020/04/29	原始取得
29	晶合集成	发明专利	电容性半导体元 件	ZL20191034016 5.6	2019/04/25	原始取得
30	晶合集成	发明专利	电容性半导体元 件	ZL20201032491 4.9	2020/04/23	原始取得
31	晶合集成	实用新型	一种液位测量仪	ZL20182099552 5.7	2018/06/25	原始取得
32	晶合集成	实用新型	双灯丝离子源装 置	ZL20182116322 6.3	2018/07/23	原始取得
33	晶合集成	实用新型	用于半导体设备 的安装位检测装 置	ZL20182113087 0.0	2018/07/17	原始取得
34	晶合集成	实用新型	用于半导体设备 的定位装置	ZL20182114798 8.4	2018/07/19	原始取得
35	晶合集成	实用新型	一种气体供应装	ZL20182119241 9.1	2018/07/24	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			置			
36	晶合集成	实用新型	一种载台及载具	ZL20182171961 7.9	2018/10/22	原始取得
37	晶合集成	实用新型	一种气体除尘装置及具有该气体除尘装置的气体处理装置	ZL20182175344 0.4	2018/10/26	原始取得
38	晶合集成	实用新型	掩膜板	ZL20182195750 2.3	2018/11/23	原始取得
39	晶合集成	实用新型	可感测基片破损的片盒	ZL20182200299 1.3	2018/11/30	原始取得
40	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的间断储水装置及半导体设备	ZL20192070694 5.3	2019/05/17	原始取得
41	晶合集成	实用新型	一种防干扰装置及半导体制程机台	ZL20192101624 8.1	2019/07/02	原始取得
42	晶合集成	实用新型	流速调节装置	ZL20192123565 0.9	2019/08/01	原始取得
43	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的组件调整装置	ZL20192143957 2.4	2019/09/02	原始取得
44	晶合集成	实用新型	一种半导体设备夹持装置	ZL20192160416 2.0	2019/09/25	原始取得
45	晶合集成	实用新型	半导体检测机台	ZL20192165472 3.8	2019/09/30	原始取得
46	晶合集成	实用新型	一种光罩	ZL20202036835 5.7	2020/03/23	原始取得
47	晶合集成	实用新型	一种晶体管结构	ZL20202025766 4.7	2020/03/04	原始取得
48	晶合集成	实用新型	封装芯片的移除	ZL20192231208	2019/12/20	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			装置	2.4		
49	晶合集成	实用新型	多次可编程存储器的单元结构	ZL20202033115 0.1	2020/03/16	原始取得
50	晶合集成	实用新型	一种非易失性存储器结构	ZL20202051950 1.1	2020/04/10	原始取得
51	晶合集成	实用新型	一种非易失性存储器结构	ZL20202051950 3.0	2020/04/10	原始取得
52	晶合集成	实用新型	一种半导体器件	ZL20202033322 2.6	2020/03/17	原始取得
53	晶合集成	实用新型	半导体器件	ZL20202024773 8.9	2020/03/02	原始取得
54	晶合集成	实用新型	封装结构	ZL20202040462 2.1	2020/03/24	原始取得
55	晶合集成	实用新型	一种半导体结构及其应用的半导体器件	ZL20202077839 8.2	2020/05/12	原始取得
56	晶合集成	实用新型	嵌入式焊盘结构	ZL20202025253 7.8	2020/03/04	原始取得
57	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的腔室及半导体设备	ZL20202060424 3.7	2020/04/21	原始取得
58	晶合集成	实用新型	量测机台	ZL20202083266 6.4	2020/05/15	原始取得
59	晶合集成	实用新型	一种转接装置	ZL20202113745 0.2	2020/06/18	原始取得
60	晶合集成	实用新型	一种半导体的测试装置	ZL20202116695 9.X	2020/06/22	原始取得
61	晶合集成	实用新型	一种基板表面污染物取样装置	ZL20202124862 6.1	2020/06/30	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
62	晶合集成	实用新型	封装芯片的开封装置	ZL20202128218 6.1	2020/07/02	原始取得
63	晶合集成	实用新型	一种晶圆侦测设备	ZL20202128366 1.7	2020/07/03	原始取得
64	晶合集成	实用新型	研磨垫中心校准治具	ZL20202158137 0.6	2020/08/03	原始取得
65	晶合集成	实用新型	流体测量治具	ZL20202161873 9.6	2020/08/06	原始取得
66	晶合集成	实用新型	研磨后清洗装置和化学机械研磨设备	ZL20202164511 6.8	2020/08/10	原始取得
67	晶合集成	实用新型	化学机械研磨装置	ZL20202164507 9.0	2020/08/10	原始取得
68	晶合集成	实用新型	一种用于化学机械研磨的清洗装置	ZL20202179484 3.0	2020/08/25	原始取得
69	晶合集成	实用新型	一种半导体设备	ZL20202187354 9.9	2020/09/01	原始取得
70	晶合集成	实用新型	进样装置	ZL20202193521 7.9	2020/09/03	原始取得
71	晶合集成	实用新型	晶圆表面金属离子收集装置	ZL20202240972 3.0	2020/10/23	原始取得
72	晶合集成	实用新型	吹气管、吹气式液位计和硅片清洗装置	ZL20202261923 2.9	2020/11/12	原始取得
73	晶合集成	实用新型	高度测量装置	ZL20202298275 7.9	2020/12/07	原始取得
74	晶合集成	实用新型	一种循环水控温装置	ZL20212038331 8.8	2021/02/20	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
75	晶合集成	实用新型	晶圆定位标示工具	ZL20212035004 4.2	2021/02/08	原始取得
76	晶合集成	实用新型	电容测试结构	ZL20202327855 0.X	2020/12/29	原始取得
77	晶合集成	实用新型	一种用于微光显微镜的测试夹具	ZL20202272703 5.9	2020/11/23	原始取得
78	晶合集成	实用新型	一种更换制程材料的防呆装置及防呆系统	ZL20212013954 0.3	2021/01/19	原始取得
79	晶合集成	实用新型	一种探针弯折装置	ZL20202300099 1.3	2020/12/11	原始取得
80	晶合集成	实用新型	一种二次离子质谱的样品装载盒	ZL20212041972 4.5	2021/02/25	原始取得
81	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的张力自动调控装置	ZL20212025620 6.6	2021/01/29	原始取得
82	晶合集成	实用新型	变容二极管	ZL20202295212 9.6	2020/12/08	原始取得
83	晶合集成	实用新型	超纯水取样器	ZL20212036709 1.8	2021/02/09	原始取得
84	晶合集成	实用新型	缺陷检测装置	ZL20212166511 6.9	2021/07/21	原始取得
85	晶合集成	实用新型	化学机械研磨装置	ZL20212155490 6.X	2021/07/08	原始取得
86	晶合集成	实用新型	涂胶机喷头位置测量装置及涂胶机	ZL20212166509 8.4	2021/07/21	原始取得
87	晶合集成	实用新型	套刻对准标记及掩模板组件	ZL20212092535 1.9	2021/04/29	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
88	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的压力测量装置	ZL20212152068 5.4	2021/07/05	原始取得
89	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL20201098315 5.7	2020/09/18	原始取得
90	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL20201100144 6.8	2020/09/22	原始取得
91	北京晶芯成	发明专利	SRAM 器件及其形成方法	ZL20201099849 5.7	2020/09/22	原始取得
92	北京晶芯成	发明专利	半导体器件及其制备方法	ZL20201101242 6.0	2020/09/24	原始取得
93	北京晶芯成	发明专利	一种浅沟槽隔离结构的制作方法	ZL20201102104 6.3	2020/09/25	原始取得
94	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL20201101941 1.7	2020/09/25	原始取得
95	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL20201103942 2.1	2020/09/28	原始取得
96	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其形成方法	ZL20201105913 8.0	2020/09/30	原始取得
97	北京晶芯成	发明专利	一种金属互连结构的形成方法	ZL20201105462 0.5	2020/09/30	原始取得
98	北京晶芯成	发明专利	LDMOS 晶体管及其制备方法	ZL20201105465 7.8	2020/09/30	原始取得
99	北京晶芯成	发明专利	浅沟槽隔离结构的制造方法及其形成的浅沟槽隔离结构	ZL20201106960 0.5	2020/10/09	原始取得
100	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆表面处理方法和表面处	ZL20201106958 4.X	2020/10/09	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			理装置			
101	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL20201106919 3.8	2020/10/09	原始取得
102	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL20201107375 1.8	2020/10/10	原始取得
103	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆背封结构及其制造方法	ZL20201108496 5.5	2020/10/12	原始取得
104	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法与制造系统	ZL20201108131 6.X	2020/10/12	原始取得
105	北京晶芯成	发明专利	测试结构及其测试方法	ZL20201110681 4.5	2020/10/16	原始取得
106	北京晶芯成	发明专利	一种沟槽的形成方法	ZL20201110681 3.0	2020/10/16	原始取得
107	北京晶芯成	发明专利	半导体器件的制备方法	ZL20201110669 9.1	2020/10/16	原始取得
108	北京晶芯成	发明专利	一种沟槽的形成方法	ZL20201110669 0.0	2020/10/16	原始取得
109	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL20201110640 7.4	2020/10/16	原始取得
110	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL20201110640 6.X	2020/10/16	原始取得
111	北京晶芯成	发明专利	一种介质层缺陷检测的测试结构	ZL202011114851 .0	2020/10/19	原始取得
112	北京晶芯成	发明专利	一种电介质击穿测试结构	ZL202011114835 .1	2020/10/19	原始取得
113	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆中心的校正方法及系统	ZL202011114387 .5	2020/10/19	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
114	北京晶芯成	发明专利	Nor 闪存结构及其制作方法	ZL20201112250 6.1	2020/10/20	原始取得
115	北京晶芯成	发明专利	半导体器件	ZL20201112248 8.7	2020/10/20	原始取得
116	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆电性测试方法及测试设备	ZL20201112161 4.7	2020/10/20	原始取得
117	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法	ZL20201113646 4.7	2020/10/22	原始取得
118	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法	ZL20201113646 3.2	2020/10/22	原始取得
119	北京晶芯成	发明专利	一种半导体装置的制备方法	ZL20201113614 7.5	2020/10/22	原始取得
120	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法及点胶装置	ZL20201113558 9.8	2020/10/22	原始取得
121	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL20201113535 9.1	2020/10/22	原始取得
122	北京晶芯成	发明专利	半导体数据分析方法、系统及计算机可读存储介质	ZL20201116022 9.3	2020/10/27	原始取得
123	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构	ZL20201115956 7.5	2020/10/27	原始取得
124	北京晶芯成	发明专利	SONOS 存储器及其制造方法	ZL20201115956 6.0	2020/10/27	原始取得
125	北京晶芯成	发明专利	隔离结构的制备方法、DAC 器件	ZL20201115955 6.7	2020/10/27	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			及其制作方法			
126	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制备方法	ZL20201115937 7.3	2020/10/27	原始取得
127	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制造方法	ZL20201117604 0.3	2020/10/29	原始取得
128	北京晶芯成	发明专利	半导体隔离结构及其制作方法	ZL20201118471 2.5	2020/10/30	原始取得
129	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的结构及其制备方法	ZL20201120728 8.1	2020/11/03	原始取得
130	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL20201120728 4.3	2020/11/03	原始取得
131	北京晶芯成	发明专利	LD MOS 晶体管及其制造方法	ZL20201120649 7.4	2020/11/03	原始取得
132	北京晶芯成	发明专利	MIM 电容器的制备方法	ZL20201120649 6.X	2020/11/03	原始取得
133	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL20201121372 5.0	2020/11/04	原始取得
134	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL20201121331 0.3	2020/11/04	原始取得
135	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL20201121330 4.8	2020/11/04	原始取得
136	北京晶芯成	发明专利	一种静态随机存取存储器及其制造方法	ZL20201123557 1.5	2020/11/09	原始取得
137	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆清洗位置的监测装置及监测方法	ZL20201123554 5.2	2020/11/09	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
138	北京晶芯成	发明专利	气体置换装置及光阻烘烤设备	ZL20201124368 2.0	2020/11/10	原始取得
139	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构及其形成方法、半导体器件的测试方法	ZL20201124367 5.0	2020/11/10	原始取得
140	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构及半导体钝化层的质量测试方法	ZL20201124288 3.9	2020/11/10	原始取得
141	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制造方法	ZL20201125109 7.5	2020/11/11	原始取得
142	北京晶芯成	发明专利	一种洁净室过滤装置	ZL20201124978 8.1	2020/11/11	原始取得
143	北京晶芯成	发明专利	半导体隔离结构及其制作方法	ZL20201127511 9.1	2020/11/16	原始取得
144	北京晶芯成	发明专利	一种自动调整半导体设备平衡性的装置及方法	ZL20201128303 6.7	2020/11/17	原始取得
145	北京晶芯成	发明专利	一种半导体设备的报警方法	ZL20201128302 9.7	2020/11/17	原始取得
146	北京晶芯成	发明专利	功率半导体器件及制造方法	ZL20201133353 0.X	2020/11/25	原始取得
147	北京晶芯成	发明专利	一种光学邻近校正模型的建模方法及建模系统	ZL20201135957 6.9	2020/11/27	原始取得
148	北京晶芯成	发明专利	半导体生产过程中的参数监控方法、系统及计算	ZL20201136762 5.3	2020/11/30	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			机可读存储介质			
149	北京晶芯成	发明专利	半导体产品的良率分析方法及良率分析系统	ZL20201138455 1.4	2020/12/02	原始取得
150	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆失效的分析方法及系统	ZL20201141983 0.X	2020/12/08	原始取得
151	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL20201142491 1.9	2020/12/09	原始取得
152	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL20201156514 6.2	2020/12/25	原始取得
153	北京晶芯成	发明专利	一种曝光位置的确定方法及系统	ZL20201157923 4.8	2020/12/28	原始取得
154	北京晶芯成	发明专利	半导体存储器件	ZL20201157284 2.6	2020/12/28	原始取得
155	北京晶芯成	发明专利	ESD 保护电路、ESD 保护结构及其制造方法	ZL20211001026 8.3	2021/01/06	原始取得
156	北京晶芯成	发明专利	半导体器件的形成方法	ZL20211001026 6.4	2021/01/06	原始取得
157	北京晶芯成	发明专利	化学机械研磨方法	ZL20211005157 6.0	2021/01/15	原始取得
158	北京晶芯成	发明专利	一种集成半导体器件	ZL20211024893 5.1	2021/03/08	原始取得
159	北京晶芯成	发明专利	静态随机存储器的制备方法	ZL20211025270 0.X	2021/03/09	原始取得
160	北京晶芯成	发明专利	一种化学机械研磨方法及其分析系统	ZL20211028153 9.9	2021/03/16	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
161	北京晶芯成	发明专利	一种半导体元件的制造方法	ZL20211030617 6.X	2021/03/23	原始取得
162	北京晶芯成	发明专利	半导体器件及其制造方法	ZL20211039761 7.1	2021/04/14	原始取得
163	北京晶芯成	发明专利	3D 半导体器件及其形成方法	ZL20211057482 6.9	2021/05/26	原始取得
164	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL20211081683 4.X	2021/07/20	原始取得
165	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL20211057502 1.6	2021/05/26	原始取得
166	北京晶芯成	发明专利	一种电介质击穿测试电路及其测试方法	ZL20211042152 0.X	2021/04/20	原始取得
167	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL20201110640 8.9	2020/10/16	原始取得
168	北京晶芯成	发明专利	沟槽隔离结构的制备方法	ZL20211025270 3.3	2021/03/09	原始取得
169	北京晶芯成	发明专利	一种 LDMOS 晶体管及其形成方法	ZL20211092191 6.0	2021/08/12	原始取得
170	北京晶芯成	发明专利	沟槽隔离结构及其制备方法	ZL20211092190 8.6	2021/08/12	原始取得
171	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL20211103600 2.2	2021/09/06	原始取得
172	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202111103889 .2	2021/09/22	原始取得
173	南京晶驱	发明专利	晶圆裂片方法及其应用	ZL20201093174 0.2	2020/09/08	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
174	南京晶驱	发明专利	一种检测半导体设备检测感度的方法和检测系统	ZL20201093852 6.X	2020/09/09	原始取得
175	南京晶驱	发明专利	一种光阻层阻挡能力的检测方法 及检测系统	ZL20201093776 8.7	2020/09/09	原始取得
176	南京晶驱	发明专利	一种半导体器件 制造方法	ZL20201093851 9.X	2020/09/09	原始取得
177	南京晶驱	发明专利	刻蚀方法	ZL20201099851 2.7	2020/09/22	原始取得
178	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构的 制备方法	ZL20201100577 3.0	2020/09/23	原始取得
179	南京晶驱	发明专利	一种浅沟槽结构 制备方法	ZL20201101295 9.9	2020/09/24	原始取得
180	南京晶驱	发明专利	半导体结构的制 作方法	ZL20201101343 9.X	2020/09/24	原始取得
181	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构 的制备方法	ZL20201093776 9.1	2020/09/09	原始取得
182	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构 的制备方法	ZL20201102179 8.X	2020/09/25	原始取得
183	南京晶驱	发明专利	一种浅沟槽隔离 结构的制造方法	ZL20201101994 7.9	2020/09/25	原始取得
184	南京晶驱	发明专利	半导体结构的制 造方法	ZL20201101930 2.5	2020/09/25	原始取得
185	南京晶驱	发明专利	电容器及其制备 方法	ZL20201103714 3.1	2020/09/28	原始取得
186	南京晶驱	发明专利	一种静电放电防 护线路	ZL20201109992 6.2	2020/10/15	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
187	南京晶驱	发明专利	半导体器件的制备方法	ZL20201109352 8.X	2020/10/14	原始取得
188	南京晶驱	发明专利	一种版图边界图 案的修正方法与 修正系统	ZL20201109523 7.4	2020/10/14	原始取得
189	南京晶驱	发明专利	MOS 晶体管及其 制造方法	ZL20201109359 9.X	2020/10/14	原始取得
190	南京晶驱	发明专利	电容的测量结构 及测量方法	ZL20201109359 8.5	2020/10/14	原始取得
191	南京晶驱	发明专利	一种光刻图形的 仿真方法及仿真 系统	ZL20201113535 1.5	2020/10/22	原始取得
192	南京晶驱	发明专利	图形显影情况的 检测方法	ZL20201118900 7.4	2020/10/30	原始取得
193	南京晶驱	发明专利	光强阈值的获取 方法以及辅助图 形显影情况的检 测方法	ZL20201118501 8.5	2020/10/30	原始取得
194	南京晶驱	发明专利	辅助图形的添加 方法、装置及测 试版图	ZL20211049263 2.4	2021/05/07	原始取得
195	南京晶驱	发明专利	光学临近修正方 法、装置及电子 设备	ZL20211075459 3.0	2021/07/05	原始取得
196	南京晶驱	发明专利	光学邻近修正模 型的建模方法	ZL20211095188 8.7	2021/08/19	原始取得
197	南京晶驱	发明专利	预测图形桥联的 方法、装置及电	ZL20211095188 1.5	2021/08/19	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			子设备			
198	南京晶驱	发明专利	一种光学临近效应的修正方法及系统	ZL20211081683 0.1	2021/07/20	原始取得

4、境外专利

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
1	晶合有限	发明专利	Method of forming stepped contact trench for semiconductor devices	US 6,583,055 B1	2002/01/25	继受取得	美国
2	晶合有限	发明专利	Method for automatically controlling defect - specification in a semiconductor manufacturing process	US 6,807,454 B2	2003/03/17	继受取得	美国
3	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing semiconductor device with formation of a heavily doped region by implantation through an insulation layer	US 6,670,254 B1	2002/10/01	继受取得	美国
4	晶合有限	发明专利	Semiconductor device formed on silicon-on-insulator substrate	US 6,828,633 B2	2003/02/26	继受取得	美国
5	晶合有限	发明专利	Silicon-on-insulator device structure	US 7,019,582 B2	2004/09/29	继受取得	美国
6	晶合有限	发明专利	Method for producing a gate	US 6,699,755 B1	2003/03/24	继受取得	美国
7	晶合有限	发明专利	Half-tone phase shift mask and patterning method using thereof	US 7,461,472 B2	2003/06/16	继受取得	美国
8	晶合有限	发明专利	Method of improving a resolution of contact hole patterns by utilizing alternate phase shift principle	US 7,008,733 B2	2003/09/25	继受取得	美国
9	晶合有限	发明专利	Re-performable spin-on process	US 6,881,590 B2	2003/08/25	继受取得	美国
10	晶合有限	发明专利	Method for fabricating a through hole on a semiconductor	US 6,995,086 B2	2004/06/28	继受取得	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			substrate				
11	晶合有限	发明专利	Method for forming a titanium nitride layer	US 7,030,015 B2	2004/09/16	继受取得	美国
12	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing semiconductor device	US 7,056,787 B2	2005/01/12	继受取得	美国
13	晶合有限	发明专利	Method of forming contact hole and method of fabricating semiconductor device	US 7,098,124 B2	2005/05/31	继受取得	美国
14	晶合有限	发明专利	Semiconductor device having self-aligned contact	US 7,612,433 B2	2005/09/21	继受取得	美国
15	晶合有限	发明专利	Manufacturing method of semiconductor device having self-aligned contact	US 7,803,692 B2	2009/09/18	继受取得	美国
16	晶合有限	发明专利	Method of fabricating conductive lines with silicide layer	US 7,550,372 B2	2005/08/29	继受取得	美国
17	晶合有限	发明专利	Method for forming buried doped region	US 7,465,632 B2	2005/10/28	继受取得	美国
18	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing self-aligned contact openings	US 7,429,527 B2	2007/09/11	继受取得	美国
19	晶合有限	发明专利	Method of fabricating semiconductor device	US 7,268,055 B2	2005/11/07	继受取得	美国
20	晶合有限	发明专利	Method for manufacturing gate dielectric layer	US 7,273,787 B2	2005/11/18	继受取得	美国
21	晶合有限	发明专利	Method for forming contact window	US 8,722,538 B2	2012/09/12	继受取得	美国
22	晶合有限	发明专利	Method for manufacturing semiconductor device	US 8,822,303 B2	2012/09/15	继受取得	美国
23	晶合有限	发明专利	SPLIT-GATE NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATION METHOD THEREOF	US10,636,801 B2	2018/11/25	原始取得	美国
24	晶合有限	发明专利	METHOD OF	US10,490,647	2018/08/31	原始	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			FORMING METAL SILICIDE LAYER, SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FABRICATING SAME	B1		取得	
25	晶合有限	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY CELL, ARRAY AND FABRICATION METHOD	US10,726,894 B2	2018/11/25	原始取得	美国
26	晶合有限	发明专利	SILICON ISLAND STRUCTURE AND METHOD OF FABRICATING SAME	US 10,490,441 B1	2018/10/18	原始取得	美国
27	晶合有限	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME	US 10,854,758 B2	2019/02/18	原始取得	美国
28	晶合集成	发明专利	Pre-processing method, method for forming metal silicide and semiconductor processing apparatus	US10,916,417B2	2020/06/16	原始取得	美国
29	晶合集成	发明专利	METHOD OF FABRICATING MOSFET	US10,957,776B2	2020/05/21	原始取得	美国
30	晶合集成	发明专利	METHOD FOR FORMING SEMICONDUCTOR STRUCTURE	US10,930,545B2	2019/06/27	原始取得	美国
31	晶合集成	发明专利	CURRENT SOURCE USING EMITTER REGION AS BASE REGION ISOLATION STRUCTURE	US10,950,601B2	2019/04/15	原始取得	美国
32	晶合集成	发明专利	MOSFET AND METHOD OF FABRICATING SAME	US10,971,595B2	2018/12/17	原始取得	美国
33	晶合集成	发明专利	DIFFUSED FIELD-EFFECT TRANSISTOR AND METHOD OF	US11,024,722B1	2020/03/25	原始取得	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			FABRICATING SAME				
34	晶合集成	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME	US10,916,664B2	2020/09/19	原始取得	美国
35	晶合集成	发明专利	SEMICONDUCTOR STRUCTURE AND METHOD OF FORMING SAME	US11,069,559B1	2020/06/22	原始取得	美国
36	晶合集成	发明专利	METHOD FOR FABRICATING SPLIT-GATE NON-VOLATILE MEMORY	US11,088,155B2	2020/03/18	原始取得	美国
37	晶合集成	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME	US11,049,947B2	2019/11/07	原始取得	美国
38	晶合集成	发明专利	以交替式相位移原理改善接触洞图案解析度之方法	I313889	2003/07/21	继受取得	中国台湾
39	晶合集成	发明专利	制作通孔的方法	I240988	2004/01/07	继受取得	中国台湾
40	晶合集成	发明专利	浅沟渠隔离结构的制造方法	I234228	2004/05/12	继受取得	中国台湾
41	晶合集成	发明专利	具有自行对准接触窗之半导体元件及其制造方法	I254409	2005/02/16	继受取得	中国台湾
42	晶合集成	发明专利	导线的制造方法	I254365	2005/01/27	继受取得	中国台湾
43	晶合集成	发明专利	自行对准接触窗开口的制作方法	I301997	2005/06/17	继受取得	中国台湾
44	晶合集成	发明专利	半导体元件及其制造方法	I267190	2005/08/29	继受取得	中国台湾
45	晶合集成	发明专利	隔离结构的制造方法	I300968	2006/06/28	继受取得	中国台湾
46	晶合集成	发明专利	光罩复验方法与系统	I305004	2006/07/17	继受取得	中国台湾
47	晶合集成	发明专利	管制规格界限之制定方法	I305838	2006/09/29	继受取得	中国台湾
48	晶合集成	发明专利	分离闸极快闪记忆体	I301982	2006/09/28	继受	中国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			的故障检测方法			取得	台湾
49	晶合集成	发明专利	接触窗的形成方法	I473206	2012/07/03	继受取得	中国台湾
50	晶合集成	发明专利	半导体元件的制造方法	I464831	2012/06/27	继受取得	中国台湾
51	晶合集成	发明专利	分栅式非挥发性记忆体及其制备方法	I720350	2018/10/09	原始取得	中国台湾
52	晶合集成	发明专利	预处理方法、金属硅化物的形成方法以及半导体处理装置	I739473	2020/06/11	原始取得	中国台湾
53	晶合集成	发明专利	ラッチ回路	特许第6761074号	2019/05/21	原始取得	日本
54	晶合集成	发明专利	SRAM、半導体集積回路及びLCDドライバ	特许第6801053号	2019/06/19	原始取得	日本
55	晶合集成	发明专利	容量性半導体素子	特许第6831067号	2019/04/25	原始取得	日本
56	晶合集成	发明专利	半導体素子の製造方法	特许第6826795号	2019/01/09	原始取得	日本
57	晶合集成	发明专利	高耐压半導体素子及びその製造方法	特许第6892889号	2019/04/15	原始取得	日本
58	晶合集成	发明专利	容量性半導体素子	特许第6918173号	2020/04/23	原始取得	日本

北京市金杜律师事务所
关于合肥晶合集成电路股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
补充法律意见书（六）

致：合肥晶合集成电路股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已出具《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市之补充法律意见书（一）》（以下简称《补充法律意见书（一）》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（二）》（以下简称《补充法律意见书（二）》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（三）》（以下简称《补充法律意见书（三）》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（四）》（以下简称《补充法律意见书（四）》）和《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（五）》（以下简称《补充法律意见书（五）》）。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 19 日出具了《合肥晶合集成电路股份有限公司审计报告》（容诚审字[2022]第 230Z4102 号）（以下简称《2019-2022 年 6 月审计报告》）对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月（以下简称报告期）财务报表进行审计，并出具了《合肥晶合集成电路股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z2791 号）（以下简称《2022 年 6 月内控报告》）。本所现根据《2019-2022 年 6 月审计报告》《2022 年 6 月内控报告》及发行人招股说明书和其他相关申报文件的修改和变动，就其中所涉及的法律问题，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对本所已出具的《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》《补充法律意见书（五）》的补充，并构成《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》《补充法律意见书（五）》不可分割的一部分；本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》《补充法律意见书（五）》中对相关用语的释义、缩写适用于本补充法律意见书；本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》《补充法律意见书（五）》中发表法律意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见书。对于本补充法律意见书特别说明的事项，以本补充法律意见书的说明为准。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用于任何其他目

的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市制作的《招股说明书（注册稿）》中自行引用或按照中国证监会、上交所的审核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，出具补充法律意见如下：

目录

一、 本次发行上市的批准和授权	5
二、 发行人本次发行上市的主体资格	5
三、 本次发行上市的实质条件	5
四、 发行人的独立性及其变化情况	8
五、 发起人和股东的变化情况	9
六、 发行人的股本及其演变	26
七、 发行人的业务	26
八、 关联交易及同业竞争及其变化情况	28
九、 发行人的主要财产及其变化情况	35
十、 发行人的重大债权债务变化情况	40
十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并	43
十二、 发行人公司章程的制定与修改	43
十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	43
十四、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化	45
十五、 发行人的税务及其变化情况	45
十六、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准的变化情况	47
十七、 发行人的劳动与社会保障及其变化情况	49
十八、 发行人募集资金的运用	50
十九、 诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况	50
二十、 发行人《招股说明书（注册稿）》法律风险的评价	51
二十一、 本次发行上市的总体结论性意见	52
附件：发行人及其子公司拥有的知识产权	54

一、 本次发行上市的批准和授权

根据发行人提供的董事会和股东大会的会议文件并经本所律师核查，发行人本次发行上市已获得的批准及授权仍然有效。

发行人本次发行已于 2022 年 3 月 10 日经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并于 2022 年 6 月 20 日取得中国证监会下发的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]954 号）；发行人股票于上交所上市交易尚待获得上交所审核同意。

二、 发行人本次发行上市的主体资格

根据发行人工商档案资料、《营业执照》《企业信用报告》、合肥新站高新技术产业开发区市场监督管理局出具的证明，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>），截至本补充法律意见书出具日，发行人仍为合法存续的股份有限公司，不存在根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》需要终止的情形，发行人仍具备本次发行上市的主体资格。

三、 本次发行上市的实质条件

（一） 本次发行上市符合《公司法》《证券法》的相关条件

1、 根据发行人本次发行上市相关股东大会决议及发行人书面说明，发行人本次发行的股票为每股面值 1.00 元的人民币普通股股票，每股的发行条件和价格相同，每一股份具有同等权利，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、 发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事和董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

3、 根据《2019-2022 年 6 月审计报告》、发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》、发行人及其境内子公司相关主管部门出具的证明及发行人书面说明，截至本补充法律意见书出具日，发行人依法存续，不存在因违法经营而被相关主管部门责

令停业整顿或吊销营业执照的情形，不存在根据法律、法规及《公司章程》规定需要终止的情形。发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

4、根据《2019-2022年6月审计报告》，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

5、根据发行人及其子公司所在地公安机关出具的证明、发行人控股股东填写的调查表及发行人书面说明，并经本所律师核查，发行人及其控股股东最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

（二）本次发行上市符合《注册管理办法》规定的相关条件

1、如本补充法律意见书第一部分“二、发行人本次发行上市的主体资格”所述，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司；发行人已依法设立股东大会、董事会、监事会以及相关职能部门，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

2、根据《2019-2022年6月审计报告》《2022年6月内控报告》和发行人书面说明，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具标准无保留意见的《2019-2022年6月审计报告》；根据《2022年6月内控报告》和发行人书面说明，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具标准无保留意见的《2019-2022年6月审计报告》，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

（1）如本补充法律意见书第一部分“四、发行人的独立性及其变化情况”所述，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立；如本补充法律意见书第一部分“八、关联交易及同业竞争及其变化情况”所述，发行人与控股股东及其控制的其他企业间

不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项之规定。

（2）如本补充法律意见书第一部分“七、发行人的业务”所述，截至本补充法律意见书出具日，发行人的主营业务最近两年内未发生重大不利变化；如本补充法律意见书第一部分“十四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”所述，发行人的董事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内未发生重大不利变化；如本补充法律意见书第一部分“五、发起人和股东”所述，发行人的股权权属清晰，截至本补充法律意见书出具日，控股股东和受控股股东支配的股东持有的发行人股份权属清晰，最近两年控制权稳定、实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项之规定。

（3）如本补充法律意见书第一部分“九、发行人的主要财产及其变化情况”“十、发行人的重大债权债务变化情况”及“十八、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况”所述，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项之规定。

4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策：

（1）如本补充法律意见书第一部分“七、发行人的业务”所述，根据工商、税务等相关政府部门出具的证明文件和发行人书面说明，经本所律师核查，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定。

（2）如本补充法律意见书第一部分“十八、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况”所述，根据发行人及其子公司所在地相关政府部门出具的证明文件、发行人控股股东填写的调查表及发行人书面说明，并经本所律师核查，最近三年内，发行人及其控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

(3) 如本补充法律意见书第一部分“十八、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况”所述，根据发行人董事、监事和高级管理人员填写的调查表，经本所律师核查，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第三款的规定。

(三) 本次发行上市符合《上市规则》规定的相关条件

1、本次发行上市符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》规定的发行条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定。

2、根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》及《招股说明书（注册稿）》，本次发行上市后股本总额不少于 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

3、根据《招股说明书（注册稿）》和本次发行上市相关股东大会决议，发行人股本总额超过 4 亿元，本次发行完成后，发行人公开发行的股份数将达到本次发行后发行人股份总数的 10%以上，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

4、根据《2019-2022 年 6 月审计报告》、保荐机构出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司预计市值的分析报告》及发行人书面说明，发行人申请本次发行上市，预计市值不低于 30 亿元，且最近一年营业收入不低于 3 亿元，符合《上市规则》第 2.1.2 条第（四）项规定的市值和财务指标标准及第 2.1.1 条第（四）项的规定。

综上，本所律师认为，发行人仍具备本次发行上市的实质条件。

四、 发行人的独立性及其变化情况

根据发行人提供的业务合同台账、订单台账及重大业务合同、订单等相关文件资料、发行人高级管理人员填写的调查表，并经本所律师审阅发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》及《2019-2022 年 6 月审计报告》《2022 年 6 月内控报告》等书面材料，以及发行人的确认，自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人业务、资产、人员、机构及财务独立性情况未发生变化，发行人资产完整且仍具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

五、发起人和股东的变化情况

根据发行人提供的资料并经本所核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人的股东变化情况如下：

1、惠友豪创

根据惠友豪创的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，惠友豪创的合伙人发生变更。截至 2022 年 6 月 30 日，惠友豪创的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	深圳市惠友创盈投资管理有限公司	普通合伙人	0.01	0.0000
2	杨庆	有限合伙人	49,000	40.8333
3	周祥书	有限合伙人	12,000	10.0000
4	杨林	有限合伙人	10,000	8.3333
5	深圳市创荟投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8,800	7.3333
6	共青城坤翎豪创投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7,200	6.0000
7	刘晨露	有限合伙人	5,000	4.1667
8	孙义强	有限合伙人	5,000	4.1667
9	王赫	有限合伙人	5,000	4.1667
10	深圳市瑞成永泽投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000	4.1667
11	深圳市君爵投资有限公司	有限合伙人	5,000	4.1667
12	深圳市创欣诚创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000	4.1667
13	苏州锦天前程投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	1,000	0.8333
14	刘军	有限合伙人	1,000	0.8333
15	深圳市新思哲投资管理有限公司	有限合伙人	1,000	0.8333
	合计	-	120,000.01	100.0000

2、泸州隆信

根据泸州隆信的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，泸州隆信的合伙人发生变更。截至 2022 年 6 月 30 日，泸州隆信的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	泸州璞泉私募股权投资基金管理有限公司	普通合伙	100.00	0.62

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
2	青岛启泰一号创业投资中心(有限合伙)	人	100.00	0.62
3	王士明	有限合伙人	3,000.00	18.63
4	上海众乙达企业管理有限公司		3,000.00	18.63
5	四川璞信产融投资有限责任公司		2,900.00	18.01
6	黄海翔		2,200.00	13.66
7	陈越强		1,950.00	12.11
8	君汇(日照)股权投资管理中心(有限合伙)		1,000.00	6.21
9	陕西西电高科中低压开关有限公司		500.00	3.11
10	沈雄杰		300.00	1.86
11	上海亮轩企业管理咨询有限公司		300.00	1.86
12	慈溪怡海企业管理咨询有限公司		200.00	1.24
13	宁波东盈环境建设发展有限公司		200.00	1.24
14	李梦迪		150.00	0.93
15	曹雪丽		100.00	0.62
16	陈葵		100.00	0.62
合计		-	16,100.00	100.00

3、宁波华淳

根据宁波华淳的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，宁波华淳的合伙人结构发生变更。截至2022年6月30日，宁波华淳的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	华泰宝利投资管理有限公司	普通合伙人	324.57	0.36
2	华泰人寿保险股份有限公司	有限合伙人	40,000.00	44.23
3	华泰财产保险有限公司		25,000.00	27.64
4	华泰资产管理有限公司		14,880.00	16.45
5	华泰保险集团股份有限公司		5,000.00	5.53
6	中荷人寿保险有限公司		4,000.00	4.42
7	宁波扬泰企业管理合伙企业(有限合伙)		632.85	0.70
8	蔷薇资本有限公司		600.00	0.66
合计			-	90,437.41

4、安华创新

根据安华创新的公司章程及工商档案并经本所律师核查，截至2022年6月30日，宁波华淳的股东未发生变更。2022年8月，安徽省国有资本运营控股集团有限公司将

其持有安华创新的全部股权转让给安徽国控投资有限公司，前述股权转让完成后，安华创新的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	国元创新投资有限公司	70,000.00	20.00
2	华安嘉业投资管理有限公司	70,000.00	20.00
3	安徽省盐业投资控股集团有限公司	40,000.00	11.43
4	安徽交控资本投资管理有限公司	40,000.00	11.43
5	合肥市产业投资引导基金有限公司	36,000.00	10.29
6	安徽华文创业投资管理有限公司	22,000.00	6.29
7	时代出版传媒股份有限公司	22,000.00	6.29
8	合肥高新建设投资集团公司	20,000.00	5.71
9	阜阳市颍科创新投资有限公司	20,000.00	5.71
10	安徽国控投资有限公司	10,000.00	2.86
合计		350,000.00	100.00

5、集创北方

根据集创北方的股东名册、招股说明书并经本所律师核查，集创北方的股东结构发生变更。截至2022年6月30日，集创北方的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	张晋芳	7,668.75	17.79
2	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	4,115.25	9.55
3	北京永昌寰宇投资有限公司	2,833.26	6.57
4	北京集智非凡科技中心（有限合伙）	1,788.85	4.15
5	北京永昌环宇投资中心（有限合伙）	1,715.90	3.98
6	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	1,609.89	3.73
7	天津海松股权投资合伙企业（有限合伙）	1,480.99	3.44
8	北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	1,304.81	3.03
9	宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙）	1,282.38	2.97
10	国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	1,078.06	2.50
11	珠海科技创业投资有限公司	1,008.99	2.34
12	珠海大横琴创新发展有限公司	1,008.99	2.34
13	厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	746.42	1.73

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
14	北京集创寰宇科技中心（有限合伙）	739.45	1.72
15	维沃移动通信有限公司	685.65	1.59
16	深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）	650.90	1.51
17	集创芯恒（珠海）科技中心（有限合伙）	530.53	1.23
18	苏州哲思灵行投资合伙企业（有限合伙）	512.08	1.19
19	上海聚源载兴投资中心（有限合伙）	499.79	1.16
20	厦门南圃秋风投资合伙企业（有限合伙）	484.72	1.12
21	北京京国创优势产业基金（有限合伙）	449.19	1.04
22	天津海松飞跃股权投资合伙企业（有限合伙）	438.81	1.02
23	北京欧镭德芯科技中心（有限合伙）	408.00	0.95
24	哈勃科技创业投资有限公司	403.60	0.94
25	苏州芯动能显示科技创业投资合伙企业（有限合伙）	342.82	0.80
26	厦门源峰磐松股权投资合伙企业（有限合伙）	342.82	0.80
27	思凯（珠海横琴）科技有限公司	329.11	0.76
28	北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合伙）	283.29	0.66
29	苏州元禾厚望睿芯创业投资合伙企业（有限合伙）	274.26	0.64
30	建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）	274.26	0.64
31	井冈山晨睿股权投资合伙企业（有限合伙）	274.26	0.64
32	天津海河集睿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	274.26	0.64
33	集创芯通（珠海）科技中心（有限合伙）	261.58	0.61
34	北京芯动能投资基金（有限合伙）	253.05	0.59
35	集创芯弘（珠海）科技中心（有限合伙）	248.02	0.58
36	北京晋睿博远科技有限公司	240.00	0.56
37	欧镭德弘（珠海）科技中心（有限合伙）	223.11	0.52
38	湖南湘江祥鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	221.62	0.51
39	北京丝路华创贰号股权投资中心（有限合伙）	212.55	0.49
40	厦门新鼎哨哥玖号股权投资合伙企业（有限合伙）	200.00	0.46
41	无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	179.68	0.42
42	集创芯领（珠海）科技中心（有限合伙）	166.54	0.39
43	嘉兴鼎峰佳创创业投资合伙企业（有限合伙）	146.45	0.34
44	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	141.66	0.33
45	北京欧镭德芯诚科技中心（有限合伙）	138.31	0.32

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
46	辽宁和生中富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	137.13	0.32
47	嘉兴创领隆顺股权投资合伙企业（有限合伙）	137.13	0.32
48	苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	137.13	0.32
49	三亚星睿壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	137.13	0.32
50	广德远润创芯股权投资合伙企业（有限合伙）	137.13	0.32
51	中国互联网投资基金（有限合伙）	137.13	0.32
52	深圳中深双创股权投资合伙企业（有限合伙）	137.13	0.32
53	中青芯鑫鼎橡（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	137.13	0.32
54	深圳前海中明股权投资基金管理企业（有限合伙）	133.20	0.31
55	欧铄德鑫（珠海）科技中心（有限合伙）	125.28	0.29
56	北京丝路云和投资中心（有限合伙）	122.71	0.28
57	集芯领睿（珠海）科技中心（有限合伙）	120.10	0.28
58	湖南泉清投资合伙企业（有限合伙）	119.28	0.28
59	集创芯盛（珠海）科技中心（有限合伙）	118.42	0.27
60	共青城哲灵丰升投资管理合伙企业（有限合伙）	116.79	0.27
61	SK海力士（无锡）投资有限公司	109.70	0.25
62	江苏惠泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）	109.70	0.25
63	集创芯美（珠海）科技中心（有限合伙）	101.21	0.23
64	集创芯兴（珠海）科技中心（有限合伙）	97.34	0.23
65	陕西葆晟控股有限公司	93.50	0.22
66	新疆TCL股权投资有限公司	89.84	0.21
67	集创芯卓（珠海）科技中心（有限合伙）	85.28	0.20
68	芜湖纪源灿辉创业投资合伙企业（有限合伙）	82.28	0.19
69	珠海景祥恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	82.28	0.19
70	德芯非凡（珠海）科技中心（有限合伙）	81.45	0.19
71	珠海景祥宏利股权投资基金合伙企业（有限合伙）	80.72	0.19
72	集芯卓宇（珠海）科技中心（有限合伙）	70.98	0.16
73	苏州纪源皓月创业投资合伙企业（有限合伙）	70.87	0.16
74	欧铄德盛（珠海）科技中心（有限合伙）	69.18	0.16
75	北京汇智合盛电子科技有限公司	68.56	0.16
76	平潭宝盛股权投资合伙企业（有限合伙）	68.56	0.16

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
77	北京屹唐中艺投资中心（有限合伙）	68.56	0.16
78	嘉兴智徽股权投资合伙企业（有限合伙）	68.56	0.16
79	南京又东华兴创业投资合伙企业（有限合伙）	68.56	0.16
80	北京兴投优选创业投资基金（有限合伙）	68.56	0.16
81	珠海华金尚盈二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	68.56	0.16
82	共青城合盛犇犇股权投资合伙企业（有限合伙）	68.56	0.16
83	无锡芯创智享股权投资合伙企业（有限合伙）	68.56	0.16
84	北京中璟三号股权投资合伙企业（有限合伙）	68.56	0.16
85	曲水泉禾企业管理有限责任公司	68.56	0.16
86	银河芯动能壹号股权投资基金（烟台）合伙企业（有限合伙）	68.56	0.16
87	苏州工业园区中鑫致远投资中心（有限合伙）	68.56	0.16
88	珠海鲸芯一号集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	68.56	0.16
89	北京芯创科技一期创业投资中心（有限合伙）	65.09	0.15
90	宁波瀚澜企业管理合伙企业（有限合伙）	65.09	0.15
91	湖南湘江盛世光保股权投资合伙企业（有限合伙）	61.71	0.14
92	烟台德泰新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	57.59	0.13
93	芜湖金牛荣元股权投资中心（有限合伙）	54.85	0.13
94	苏州纪源皓元创业投资合伙企业（有限合伙）	52.55	0.12
95	刘宏辉	48.41	0.11
96	珠海金镒铭股权投资基金合伙企业（有限合伙）	42.57	0.10
97	天铭京福（台州）创业投资合伙企业（有限合伙）	27.43	0.06
98	北京国泰嘉泽创业投资中心（有限合伙）	21.28	0.05
	合计	43,106.52	100%

6、合肥晶焠

根据合肥晶焠的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶焠的合伙人结构发生变更。截至 2022 年 6 月 30 日，合肥晶焠的合伙人及其出资情况如下

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.01	/
2	詹奕鹏	有限合伙人	450.00	14.65	副总经理
3	黎湘鄂	有限合伙人	300.00	9.77	董事长室顾问
4	简瑞荣	有限合伙人	241.00	7.85	协理
5	黎翠綾	有限合伙人	150.00	4.88	企业规划室资深处长
6	张伟瑾	有限合伙人	150.00	4.88	核心技术人员
7	林柏青	有限合伙人	150.00	4.88	N1厂长室副厂长
8	吴佳特	有限合伙人	130.00	4.23	先进整合处处长
9	谢长峯	有限合伙人	105.00	3.42	制程整合技术处副处长
10	李庆民	有限合伙人	100.00	3.26	协理
11	官佳琦	有限合伙人	100.00	3.26	品质处处长
12	方圣昌	有限合伙人	100.00	3.26	N1厂长室副厂长
13	张志宏	有限合伙人	100.00	3.26	业务二处处长
14	柯天麒	有限合伙人	90.00	2.93	模型器件处副处长
15	刘棋彬	有限合伙人	85.00	2.77	风险管理处处长
16	陈信全	有限合伙人	80.00	2.60	技术开发一处副处长
17	江英和	有限合伙人	70.00	2.28	人力资源处代副处长
18	谢文智	有限合伙人	70.00	2.28	营运企划处副处长
19	蔡辉嘉	有限合伙人	65.00	2.12	总经理
20	罗招龙	有限合伙人	60.00	1.95	模组开发处副处长
21	吴启熙	有限合伙人	60.00	1.95	分析及可靠性工程部部经理
22	张永忠	有限合伙人	60.00	1.95	设计服务处副处长
23	施介文	有限合伙人	60.00	1.95	N1厂长室副厂长
24	李天定	有限合伙人	50.00	1.63	经营与营运系统部部经理
25	钟青源	有限合伙人	50.00	1.63	蚀刻工程部部经理
26	王冠博	有限合伙人	50.00	1.63	模组开发处处长
27	吴文达	有限合伙人	50.00	1.63	信息服务处副处长
28	黄国助	有限合伙人	50.00	1.63	流程整合组部经理
20	朱晓娟	有限合伙人	25.00	0.81	董事、副总经理
30	施雪峯	有限合伙人	20.00	0.65	法务室副处长
合计			3,071.20	100.00	-

注：王冠博已将其持有的全部出资额转让至蔡国智，已于2022年10月18日完成工商变更。

7、合肥晶遂

根据合肥晶遂的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶遂的合伙人结构发生变更。截至2022年6月30日，合肥晶遂的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.01	/
2	朱才伟	有限合伙人	450.00	18.14	董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理
3	朱晓娟	有限合伙人	416.10	16.77	董事、副总经理
4	周义亮	有限合伙人	380.00	15.31	副总经理
5	王兴亚	有限合伙人	125.00	5.04	财会处处长
6	方华	有限合伙人	125.00	5.04	对外事务室处长
7	王逸蓉	有限合伙人	50.00	2.02	关务部部经理
8	江英和	有限合伙人	40.00	1.61	人力资源处代处长
9	张庆勇	有限合伙人	40.00	1.61	IP服务二组部经理
10	陈景	有限合伙人	40.00	1.61	客户工程一部部经理
11	王云直	有限合伙人	40.00	1.61	会计部部经理
12	刘桂云	有限合伙人	40.00	1.61	总务部部经理
13	周儒领	有限合伙人	40.00	1.61	先进整合前端组部经理
14	郑晓	有限合伙人	36.00	1.45	产品测试部部经理
15	李德龙	有限合伙人	36.00	1.45	采购一部部经理
16	曹宗野	有限合伙人	30.00	1.21	证券事务部部经理
17	喻加云	有限合伙人	25.00	1.01	会计一课副理
18	张静	有限合伙人	25.00	1.01	会计二课副理
19	缪凤玲	有限合伙人	24.00	0.97	工控与能源课副理
20	李宁	有限合伙人	24.00	0.97	薪资福利部代部经理
21	张英杰	有限合伙人	24.00	0.97	代工业务一部部经理
22	付刚	有限合伙人	20.00	0.81	品质体系管理部部经理
23	赵家保	有限合伙人	20.00	0.81	关务课副理
24	肖丹	有限合伙人	20.00	0.81	业务系统课副理
25	杜雷	有限合伙人	20.00	0.81	光罩服务组代部经理
26	简瑞荣	有限合伙人	20.00	0.81	协理
27	束乐	有限合伙人	20.00	0.81	员工发展课副理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
28	何倩倩	有限合伙人	20.00	0.81	团膳管理课副理
29	杨大桂	有限合伙人	17.00	0.69	机电课技术副理
30	杨昆	有限合伙人	16.00	0.64	平台服务课副理
31	潘坡	有限合伙人	16.00	0.64	业务支援课副理
32	李林	有限合伙人	16.00	0.64	设备一课技术副理
33	魏家信	有限合伙人	16.00	0.64	结构分析课副理
34	程长青	有限合伙人	16.00	0.64	量测设备课副理
35	蒲甜松	有限合伙人	16.00	0.64	核心技术二部代部经理
36	许春龙	有限合伙人	16.00	0.64	核心技术三部代部经理
37	汪小小	有限合伙人	16.00	0.64	元件开发部部经理
38	赵敬国	有限合伙人	16.00	0.64	工务管理课专案副理
39	黄皓皓	有限合伙人	16.00	0.64	储运部代部经理
40	白康茜	有限合伙人	16.00	0.64	材料课副理
41	赵丽云	有限合伙人	16.00	0.64	出货品质保证课副理
42	唐京华	有限合伙人	16.00	0.64	电力课副理
43	李江敏	有限合伙人	16.00	0.64	稽核室专案副理
44	张存兴	有限合伙人	16.00	0.64	经营管理组部经理
45	黄小迪	有限合伙人	13.00	0.52	整合三课技术副理
46	周俊	有限合伙人	13.00	0.52	设备二课主任工程师
47	季能	有限合伙人	12.00	0.48	经营系统课副理
48	钟胤	有限合伙人	12.00	0.48	对外事务室专案副理
49	谢文智	有限合伙人	12.00	0.48	营运企划处副处长
50	王梦曦	有限合伙人	12.00	0.48	对外事务室专案副理
合计			2,481.30	100.00	-

8、合肥晶炯

根据合肥晶炯的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶炯的合伙人结构发生变更。截至 2022 年 6 月 30 日，合肥晶炯的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.01	/

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例	在发行人处任职情况
2	蔡国智	有限合伙人	575.00	25.51	董事长
3	蔡辉嘉	有限合伙人	510.00	22.63	总经理
4	邱显寰	有限合伙人	380.00	16.86	副总经理
5	李迦谕	有限合伙人	200.00	8.87	助理
6	黄晋德	有限合伙人	148.00	6.57	业务一处资深处长
7	林士然	有限合伙人	100.00	4.44	深圳办公室处长
8	王建智	有限合伙人	40.00	1.77	先进整合后端部部长
9	许嘉哲	有限合伙人	36.00	1.60	分析技术部部长
10	吴建宏	有限合伙人	30.00	1.33	微影开发部副理
11	古哲安	有限合伙人	20.00	0.89	制程一课副理
12	田俊鹏	有限合伙人	16.00	0.71	系统课副理
13	黄浩玮	有限合伙人	16.00	0.71	先进整合一部代部经理
14	林政纬	有限合伙人	16.00	0.71	制程二课副理
15	柯天麒	有限合伙人	16.00	0.71	模型器件处副处长
16	蔡汉郅	有限合伙人	12.00	0.53	设备自动化课技术副理
17	邱一峯	有限合伙人	12.00	0.53	空调课技术副理
18	郑子锋	有限合伙人	12.00	0.53	设备二课技术副理
19	苏耕乐	有限合伙人	12.00	0.53	逻辑一课技术副理
20	毛泽民	有限合伙人	12.00	0.53	业务二课技术副理
21	沈俊明	有限合伙人	12.00	0.53	制程一课技术副理
22	柯孟志	有限合伙人	10.00	0.44	制造部部长
23	陈思皓	有限合伙人	10.00	0.44	良率提升课资深工程师
24	简瑞荣	有限合伙人	10.00	0.44	助理
25	陈依柏	有限合伙人	8.00	0.35	故障分析课主任工程师
26	王振择	有限合伙人	8.00	0.35	制程二课技术副理
27	张正一	有限合伙人	7.90	0.35	量测技术部部长
28	张琳琳	有限合伙人	5.00	0.22	故障分析课主任工程师
29	江冬冬	有限合伙人	5.00	0.22	扩散生产课生产线主任
30	李晗飞	有限合伙人	5.00	0.22	制程二课主任工程师
31	翟伟	有限合伙人	5.00	0.22	设备三课主任工程师
32	张振华	有限合伙人	5.00	0.22	设备一课主任工程师
合计			2,254.1	100%	-

注：苏耕乐已将其持有的全部出资额转让至蔡国智，已于2022年9月15日完成工商变更登记。

9、合肥晶珏

根据合肥晶珏的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶珏的合伙人结构发生变更。截至 2022 年 6 月 30 日，合肥晶珏的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.03	/
2	蔡俊郎	有限合伙人	50.00	6.70	良率提升部部长
3	梁君丽	有限合伙人	40.00	5.36	元件技术部部长
4	庄逢杰	有限合伙人	40.00	5.36	薄膜工程部部长
5	陈世昌	有限合伙人	40.00	5.36	整合支援组部长
6	苏贤钧	有限合伙人	40.00	5.36	代工业务二部部长
7	丁明邦	有限合伙人	40.00	5.36	企划部部长
8	龚柏铨	有限合伙人	40.00	5.36	逻辑二部部长
9	洪春田	有限合伙人	40.00	5.36	黄光工程部部长
10	何毓纬	有限合伙人	40.00	5.36	设备整合部部长
11	黄世豪	有限合伙人	36.00	4.82	安全管理二组部长
12	洪国利	有限合伙人	36.00	4.82	安全管理一部部长
13	谢文智	有限合伙人	20.00	2.68	营运企划处副处长
14	谢琦山	有限合伙人	20.00	2.68	设备三课副理
15	宋振睿	有限合伙人	20.00	2.68	水处理课副理
16	吴真良	有限合伙人	20.00	2.68	设备自动化课副理
17	董允文	有限合伙人	20.00	2.68	厂务二部技术经理
18	陈信华	有限合伙人	20.00	2.68	厂务二部部长
19	蔡杰良	有限合伙人	20.00	2.68	制程二课副理
20	李泽育	有限合伙人	20.00	2.68	扩散工程部部长
21	苏智源	有限合伙人	20.00	2.68	空调课副理
22	吴耀杉	有限合伙人	20.00	2.68	故障分析课副理
23	彭昱治	有限合伙人	20.00	2.68	气体化学课副理
24	杨帛霖	有限合伙人	12.00	1.61	设备一课副理
25	林育兴	有限合伙人	12.00	1.61	洗磨生产课副理
26	黄君杰	有限合伙人	12.00	1.61	设备三课技术副理
27	詹益轩	有限合伙人	12.00	1.61	制程一课技术副理
28	彭科津	有限合伙人	12.00	1.61	设备一课技术副理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
29	苏圣哲	有限合伙人	12.00	1.61	制程一课技术副理
30	周中行	有限合伙人	12.00	1.61	制程一课副理
合计			746.20	100.00	-

10、合肥晶梢

根据合肥晶梢的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶梢的合伙人结构发生变更。截至2022年6月30日，合肥晶梢的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.03	/
2	杨宗凯	有限合伙人	70.00	10.08	核心技术一部部经理
3	杨家诚	有限合伙人	50.00	7.20	模型器件处部经理
4	苏深池	有限合伙人	50.00	7.20	资安室部经理
5	许宗能	有限合伙人	50.00	7.20	先进整合处代副处长
6	林士程	有限合伙人	50.00	7.20	微影开发部部经理
7	吴桂茶	有限合伙人	40.00	5.76	储运部副理
8	雷澔仁	有限合伙人	40.00	5.76	稽核室部经理
9	李旭昇	有限合伙人	40.00	5.76	行政与网络系统部部经理
10	张世琛	有限合伙人	20.00	2.88	设备二课副理
11	杨安立	有限合伙人	20.00	2.88	设备一课副理
12	朱哲仪	有限合伙人	20.00	2.88	设备课副理
13	彭泽昌	有限合伙人	20.00	2.88	制程一课副理
14	丁笙玳	有限合伙人	20.00	2.88	制程一课副理
15	蔡富吉	有限合伙人	20.00	2.88	化学机械研磨工程部副理
16	陈春安	有限合伙人	20.00	2.88	设备四课副理
17	王柏翔	有限合伙人	16.00	2.30	元件分析改善课副理
18	张馨文	有限合伙人	16.00	2.30	统计制程管制课副理
19	叶益诚	有限合伙人	16.00	2.30	逻辑一课副理
20	周义亮	有限合伙人	16.00	2.30	副总经理
21	冯文辉	有限合伙人	16.00	2.30	专案课技术副理
22	邓台信	有限合伙人	12.00	1.73	设备二课副理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
23	洪素真	有限合伙人	12.00	1.73	采购处技术副理
24	孙浩晏	有限合伙人	12.00	1.73	生产管理课副理
25	谢秉宏	有限合伙人	12.00	1.73	设备三课技术副理
26	黄志淦	有限合伙人	12.00	1.73	设备一课副理
27	黄志贤	有限合伙人	12.00	1.73	专案课副理
28	方先全	有限合伙人	12.00	1.73	法务室专案副理
合计			694.20	100.00	-

注：杨家诚、叶益诚、方先全已将其持有的全部出资额转让至蔡国智，已于2022年9月14日完成工商变更登记。

11、合肥晶悬

根据合肥晶本的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶本的合伙人结构发生变更。截至2022年6月30日，合肥晶本的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.04	/
2	谢承璋	有限合伙人	20.00	3.97	品质工程部副理
3	林皓庭	有限合伙人	20.00	3.97	制程一课副理
4	刘棋彬	有限合伙人	20.00	3.97	风险管理处处长
5	施介文	有限合伙人	20.00	3.97	N1厂长室副厂长
6	郭琦鋈	有限合伙人	20.00	3.97	业务一课副理
7	卢俊玮	有限合伙人	20.00	3.97	制程三课副理
8	李俊嘉	有限合伙人	20.00	3.97	业务二课副理
9	张永忠	有限合伙人	20.00	3.97	设计服务处副处长
10	沈圣宗	有限合伙人	20.00	3.97	薄膜开发部部长
11	卓俊麒	有限合伙人	20.00	3.97	电脑辅助设计部部长
12	官建宏	有限合伙人	20.00	3.97	洗净工程部副理
13	张贵财	有限合伙人	16.00	3.17	设备三课技术副理
14	杨俊杰	有限合伙人	16.00	3.17	设备三课副理
15	许时斌	有限合伙人	16.00	3.17	设备二课技术副理
16	黄晋德	有限合伙人	16.00	3.17	业务一处资深处长
17	黄铭仁	有限合伙人	16.00	3.17	制程供应课技术副理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
18	黄彦昌	有限合伙人	16.00	3.17	安全管理课副理
19	齐志翰	有限合伙人	16.00	3.17	光罩课副理
20	陈俊宏	有限合伙人	16.00	3.17	设备三课副理
21	吴颖麒	有限合伙人	16.00	3.17	设备一课技术副理
22	陈庆鸿	有限合伙人	16.00	3.17	物管课技术副理
23	陈家宏	有限合伙人	16.00	3.17	设备三课副理
24	廖宥宏	有限合伙人	16.00	3.17	蚀刻生产课副理
25	邓元吉	有限合伙人	16.00	3.17	设备一课技术副理
26	黄国修	有限合伙人	16.00	3.17	制程二课技术副理
27	蔡承佑	有限合伙人	16.00	3.17	制程整合三部部经理
28	唐世桦	有限合伙人	16.00	3.17	应急管理课副理
29	洪佐旻	有限合伙人	16.00	3.17	设备一课技术副理
30	孙秉群	有限合伙人	12.00	2.38	设备三课技术副理
合计			504.20	100.00	-

12、合肥晶本

根据合肥晶本的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶本的合伙人结构发生变更。截至 2022 年 6 月 30 日，合肥晶本的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.04	/
2	计豪	有限合伙人	12.00	2.60	营运系统课技术副理
3	凌军	有限合伙人	12.00	2.60	制造信息课技术副理
4	顾炜	有限合伙人	12.00	2.60	大客户课技术副理
5	王厚有	有限合伙人	12.00	2.60	制程一课副理
6	张润生	有限合伙人	12.00	2.60	专案课副理
7	彭萍	有限合伙人	12.00	2.60	制程一课副理
8	杨排	有限合伙人	12.00	2.60	营运系统课技术副理
9	李强	有限合伙人	12.00	2.60	制程供应课技术副理
10	刘秀梅	有限合伙人	12.00	2.60	光学模型组技术副理
11	詹霄飞	有限合伙人	12.00	2.60	逻辑二课副理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
12	邢志同	有限合伙人	12.00	2.60	设备二课副理
13	封瑞	有限合伙人	10.00	2.17	工业工程二课代副理
14	刘波	有限合伙人	10.00	2.17	洁净及化学分析课副理
15	涂程林	有限合伙人	10.00	2.17	制程一课副理
16	王梦慧	有限合伙人	10.00	2.17	技术一课副理
17	邵迎亚	有限合伙人	10.00	2.17	整合一课副理
18	李倩娣	有限合伙人	10.00	2.17	平台课副理
19	汪高生	有限合伙人	10.00	2.17	网络系统课副理
20	徐东东	有限合伙人	10.00	2.17	大数据分析课副理
21	童佳佳	有限合伙人	10.00	2.17	环保课副理
22	蔡永霞	有限合伙人	10.00	2.17	品质体系稽核课副理
23	金良民	有限合伙人	10.00	2.17	行政系统课副理
24	祝进专	有限合伙人	10.00	2.17	逻辑一课副理
25	严俊生	有限合伙人	10.00	2.17	保安课副理
26	简瑞荣	有限合伙人	10.00	2.17	助理
27	张海英	有限合伙人	8.00	1.73	网络系统课主任工程师
28	李青	有限合伙人	8.00	1.73	生产资源课技术副理
29	张倩倩	有限合伙人	8.00	1.73	行政系统课主任工程师
30	周静	有限合伙人	8.00	1.73	经营系统课主任工程师
31	罗招龙	有限合伙人	8.00	1.73	模组开发处副处长
32	冯维	有限合伙人	8.00	1.73	物管课副理
33	邱显寰	有限合伙人	8.00	1.73	副总经理
34	田春	有限合伙人	8.00	1.73	资安室技术副理
35	胡旺能	有限合伙人	8.00	1.73	制造部技术副理
36	徐国宝	有限合伙人	8.00	1.73	营运系统课主任工程师
37	张兴才	有限合伙人	8.00	1.73	厂务课副理
38	高亮	有限合伙人	8.00	1.73	生产系统课副理
39	刘伟	有限合伙人	8.00	1.73	网络系统课主任工程师
40	未东洋	有限合伙人	8.00	1.73	营运系统课主任工程师
41	黄风	有限合伙人	8.00	1.73	制程一课技术副理
42	檀翠琴	有限合伙人	8.00	1.73	经营系统课技术副理
43	唐昌玉	有限合伙人	8.00	1.73	工业工程一课副理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
44	夏海峰	有限合伙人	8.00	1.73	应急管理课技术副理
45	巫瑶瑶	有限合伙人	8.00	1.73	生产管理课技术副理
46	黄玉	有限合伙人	8.00	1.73	制程二课主任工程师
47	丁超	有限合伙人	8.00	1.73	光罩课技术副理
48	郑兴华	有限合伙人	8.00	1.73	营运系统课主任工程师
49	王冰	有限合伙人	8.00	1.73	客户工程二部代部经理
50	黎翠綾	有限合伙人	5.00	1.08	企业规划室资深处长
合计			461.20	100.00	-

13、合肥晶辽

根据合肥晶辽的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶辽的合伙人结构发生变更。截至 2022 年 6 月 30 日，合肥晶辽的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.07	/
2	周义亮	有限合伙人	12.00	4.08	副总经理
3	许凯迪	有限合伙人	12.00	4.08	自动化系统课副理
4	林胜雄	有限合伙人	12.00	4.08	制程供应课副理
5	刘志铭	有限合伙人	12.00	4.08	系统整合课副理
6	陈宏玮	有限合伙人	12.00	4.08	制程一课副理
7	钟尚仁	有限合伙人	12.00	4.08	气体化学课技术副理
8	黄晋德	有限合伙人	12.00	4.08	业务一处资深处长
9	翁文杰	有限合伙人	12.00	4.08	制程二课技术副理
10	邱显寰	有限合伙人	12.00	4.08	副总经理
11	蔡輝堂	有限合伙人	12.00	4.08	layout课副理
12	王曼真	有限合伙人	12.00	4.08	制程三课副理
13	吴德刚	有限合伙人	10.00	3.40	工业工程三课副理
14	林宗晔	有限合伙人	10.00	3.40	设备信息课副理
15	何瑞凤	有限合伙人	10.00	3.40	基准情报一课副理
16	蔡孟孺	有限合伙人	10.00	3.40	代工业务一部技术经理
17	简瑞荣	有限合伙人	10.00	3.40	协理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
18	张家玮	有限合伙人	8.00	2.72	逻辑四课主任工程师
19	黄绍铭	有限合伙人	8.00	2.72	制程一课技术副理
20	黄任逢	有限合伙人	8.00	2.72	设备一课主任工程师
21	林宏展	有限合伙人	8.00	2.72	设备三课技术副理
22	张建烜	有限合伙人	8.00	2.72	空调课技术副理
23	刘铭哲	有限合伙人	8.00	2.72	设备三课技术副理
24	林子荏	有限合伙人	8.00	2.72	制程四课副理
25	丘卓册	有限合伙人	8.00	2.72	空调课主任工程师
26	张伟瑾	有限合伙人	8.00	2.72	N1厂厂长
27	江承达	有限合伙人	8.00	2.72	制程二课主任工程师
28	蔡志宏	有限合伙人	8.00	2.72	安环体系课副理
29	刘凯文	有限合伙人	8.00	2.72	制程二课技术副理
30	蔡明洋	有限合伙人	8.00	2.72	制程二课副理
31	汤志英	有限合伙人	8.00	2.72	电力课主任工程师
合计			294.20	100.00	-

注：汤志英已将其持有的全部股权转让至蔡国智，已于2022年9月15日完成工商变更登记。

14、合肥晶雄

根据合肥晶雄的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶雄的合伙人结构发生变更。截至2022年6月30日，合肥晶雄的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.13	/
2	黄南翔	有限合伙人	36.00	23.97	生管物管部部经理
3	陈文璟	有限合伙人	20.00	13.32	制程整合一部部经理
4	李维泽	有限合伙人	12.00	7.99	制程一课副理
5	简瑞荣	有限合伙人	10.00	6.66	助理
6	蔡君正	有限合伙人	8.00	5.33	整合二课副理
7	陈欣蕙	有限合伙人	8.00	5.33	元件一课技术副理
8	罗招龙	有限合伙人	6.00	3.99	模组开发处副处长
9	邱显寰	有限合伙人	6.00	3.99	副总经理
10	郑淙徽	有限合伙人	5.00	3.33	量测设备课主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
11	姚怡雯	有限合伙人	5.00	3.33	技术二课主任工程师
12	陈俊雄	有限合伙人	5.00	3.33	统计设备管制课副理
13	谢文智	有限合伙人	5.00	3.33	营运企划处副处长
14	林岳煌	有限合伙人	5.00	3.33	扩散生产课主任工程师
15	葛年翔	有限合伙人	5.00	3.33	制程二课主任工程师
16	李奇威	有限合伙人	5.00	3.33	薄膜生产课生产线主任
17	沈丞伟	有限合伙人	5.00	3.33	设备二课主任工程师
18	黄晋德	有限合伙人	3.00	2.00	业务一处资深处长
19	郭千琦	有限合伙人	1.00	0.67	模型器件一课副理
合计			150.20	100.00	-

注：沈丞伟已将其持有的全部出资额转让至蔡国智，已于 2022 年 10 月 18 日完成工商变更。

根据发行人的股东名册、发行人的确认，并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，除上述变化外，发行人的股东未发生其他变化。本所律师认为，发行人的股东人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

六、 发行人的股本及其演变

根据发行人提供的股东名册、本所律师对发行人股东的补充问卷调查、发行人的工商档案、《公司章程》及发行人确认，并经本所律师核查，自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人的股份结构未发生变化。

根据发行人股东的补充问卷调查确认、发行人说明，并经本所律师检索国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），截至本补充法律意见书出具日，发行人股东所持发行人的股份未设置质押。

七、 发行人的业务

（一）经营范围和经营方式

根据发行人持有的《营业执照》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充

法律意见书出具日期间，发行人的经营方式和经营范围未发生变化。

发行人境内子公司情况详见本补充法律意见书之“九、发行人的主要财产及其变化情况”之“发行人的子公司”。

根据发行人及其子公司所在地工商、税务等相关政府部门出具的证明文件，并经本所律师核查，本所律师认为，发行人及其子公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规的规定，已经取得经营所需的相关业务资质及许可。

（二）境外业务

根据《2019-2022 年 6 月审计报告》、发行人提供的工商资料及书面确认并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人拥有 1 家境外子公司（日本晶合），主要从事集成电路设计服务及技术开发。发行人境外子公司的具体情况详见律师工作报告“十、发行人的主要财产”之“（五）发行人的子公司”。

（三）发行人的主营业务

根据《招股说明书（注册稿）》《2019-2022 年 6 月审计报告》，截至本补充法律意见书出具日，发行人主要从事 12 英寸晶圆代工业务。发行人的主营业务未发生变化。

（四）主要业务资质和许可

经本所律师核查，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，发行人及其子公司新取得的主要经营资质证书情况如下：

资质名称	持证主体	证书/登记编号	授予单位/登记机关	有效期限
辐射安全许可证	发行人	皖环辐证[A0390]	安徽省生态环境厅、合肥市生态环境局	2022 年 5 月 22 日至 2027 年 5 月 21 日
辐射安全许可证	新晶集成	皖环辐证[A0813]	安徽省生态环境厅、合肥市生态环境局	2022 年 1 月 4 日至 2027 年 1 月 3 日
排污许	发行人	91340100343821	合肥市生态环境局	2022 年 1 月 4 日至

资质名称	持证主体	证书/登记编号	授予单位/登记机关	有效期限
可证		433Q001W		2027年1月3日
排污许可证	新晶集成	91340100MA8N4PFB89001V	合肥市生态环境局	2022年2月11日至 2027年2月10日

(五) 发行人的持续经营能力

根据发行人最新的《营业执照》《2019-2022年6月审计报告》及发行人确认，并经本所核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人依法存续，发行人的主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情况，不存在影响其持续经营的法律障碍。

(六) 发行人合作研发的相关情况

根据发行人与相关合作方签订的协议和发行人书面说明，2022年1月1日至2022年6月30日期间，发行人正在从事的合作研发项目情况未发生变化。

八、关联交易及同业竞争及其变化情况

(一) 关联方

根据《公司法》《上市规则》《企业会计准则第36号—关联方披露》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，并经本所律师核查，2022年1月1日至2022年6月30日期间，发行人的主要关联方变化如下：

1、发行人的控股股东、实际控制人

截至2022年6月30日，发行人的控股股东仍为合肥建投，实际控制人仍为合肥市国资委，未发生变化。

2、发行人的控股股东直接或间接控制的其他企业的变化情况

发行人控股股东合肥建投直接或间接控制的其他企业为发行人的关联方。截至2022年6月30日，发行人控股股东控制的其他主要企业未增加。

3、发行人的控股子公司的变化情况

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人控股子公司仍为 4 家，未发生变化。

4、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员的变化情况

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人的董事、监事、高级管理人员未发生变化，发行人董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员为公司的关联方。

5、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者由前述人员（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织的变化情况

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织未发生变化。

6、直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织的变化情况

截至 2022 年 6 月 30 日，直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织未发生变化。

7、直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织的变化情况

截至 2022 年 6 月 30 日，直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织未发生变化。

8、直接控制上市公司的法人的董事、监事、高级管理人员及其控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织的变化情况

（1）直接控制发行人的法人的董事、监事、高级管理人员的变化情况

直接控制发行人的法人为合肥建投，截至 2022 年 6 月 30 日，合肥建投的董事、监事、高级管理人员未发生变化。

(2) 前述关联自然人直接或者间接控制的法人或其他组织的变化情况

截至 2022 年 6 月 30 日，前述关联自然人中，吴子能、杨雪蕾担任董事、高级管理人员的法人或其他组织新增 2 家，相关情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	安徽合泰新能源发展有限公司	吴子能担任董事
2	安徽省通航控股集团有限公司	杨雪蕾担任董事

9、其他关联方

除上述关联方外，发行人的其他关联方还包括其他根据《上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定认定的关联方。

10、关联方信息披露

根据发行人的书面说明，并经本所律师核查，发行人已在《招股说明书（注册稿）》中按照《公司法》《企业会计准则》和中国证监会的相关规定认定并披露关联方。

11、注销或转让重要关联方

根据发行人控股股东填写的调查表和发行人的书面说明，并经本所律师核查，报告期内，发行人不存在注销或转让的子公司，亦不存在与发行人存在关联交易的关联方注销或转让的情形。

(二) 关联交易

根据《2019-2022 年 6 月审计报告》和发行人书面说明，并经本所律师核查，2022 年 1-6 月，发行人与关联方发生的关联交易情况如下：

1、向关联方采购商品及接受服务

2022 年 1-6 月，发行人向关联方采购商品及接受服务的相关情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021 年度	
		金额	占当期营业成本的比例
合肥燃气	采购燃气	679.55	0.25%
合肥供水	采购厂区用水	621.15	0.23%
智成电子	采购服务	939.50	0.35%
合肥租赁	房屋租赁及代缴水电费	1.76	0.00%
关联采购合计		2,241.95	0.84%

2022 年 1-6 月，发行人向合肥供水、合肥燃气采购厂区用水、燃气的价格与合肥供水、合肥燃气向第三方销售的价格一致；发行人向智成电子采购服务为授权许可知识产权（IP），双方定价模式与发行人与其他同类供应商的定价模式一致，且价格处于同类供应商报价范围区间内；发行人向合肥租赁进行租赁房屋的价格按照市场价格确定；2022 年 4 月 27 日，发行人与合肥租赁签订了《关于预存水、电缴纳结算协议》，根据协议约定，为保证智能水电表正常使用，发行人预存水电费至合肥租赁账户中，并在合肥租赁每月扣款后，于月底前将上述款项再次充值至指定账户。

综上，本所认为，发行人与关联方之间的上述关联交易价格公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

2、向关联方销售商品及提供服务

2022 年 1-6 月，发行人不存在向关联方销售商品及提供服务的情况。

3、关联租赁

发行人因经营需要向关联方合肥蓝科租赁土地、厂房及厂务设施，均位于安徽省合肥市瑶海区综合保税区内西淝河路 88 号，为发行人的注册地及主要办公场所。

（1）与合肥蓝科的租赁

2022 年 1-6 月，发行人与土地、厂房及配套厂务设备相关的租赁负债增减变动情况如下：

单位：万元

关联方	2021年 12月31日	本期增加	本期减少	2022年 6月30日
合肥蓝科	346,449.02	-	12,761.88	333,687.15

本所认为，合肥蓝科系依据合肥市人民政府相关政策向公司出租厂房，租赁价格虽低于市场价格，但公司已按照相应会计准则进行会计处理，该等关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

(2) 与合肥租赁的租赁

2022年，发行人与合肥租赁签订房屋租赁合同，相关的租赁负债增减变动情况如下：

单位：万元

关联方	2021年 12月31日	本期增加	本期减少	2022年 6月30日
合肥租赁	-	280.98	215.15	65.84

4、关联担保情况

截至2022年6月30日，发行人接受关联方担保的情况如下：

单位：万元

担保方	出借人	借款余额（含 一年内到期的 长期借款）	借款日期	到期日	担保是否 已经履行 完毕	是否提 供反担 保
合肥建投	华泰资产	130,000.00	2018/9/28	2028/9/27	否	是
		30,000.00	2018/10/30	2028/10/29	否	是
		42,000.00	2018/11/8	2028/11/7	否	是
		90,000.00	2019/7/18	2029/7/17	否	是
		8,000.00	2019/8/29	2029/8/28	否	是
	平安银行合 肥分行	70,410.00	借款发放日	2027/10/10	否	是

担保方	出借人	借款余额（含 一年内到期的 长期借款）	借款日期	到期日	担保是否 已经履行 完毕	是否提 供反担 保
	兴业银行合 肥分行	15,125.40	借款发放日	2028/1/7	否	是
		43,000.00	借款发放日	2027/10/10	否	是
	中国银行庐 阳支行 ¹	65,397.7	借款发放日	2028/1/15	否	是
		20,731.71	2021/3/19	2027/10/10	否	是

2022年1月19日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司对本公司所有的海关监管期限届满的部分机器设备办理了抵押登记，已办理抵押登记的机器设备于2022年6月30日的账面原值、累计折旧及账面价值如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
机器设备	393,374.09	169,842.18	223,531.91

5、关联方资金拆借

2022年1-6月，发行人未发生与关联方资金拆借的情形。

6、关键管理人员薪酬

2022年1-6月，发行人向关键管理人员支付薪酬，关联交易金额为2,019.21万元。

7、关联方往来余额

（1）应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2022年6月30日	
		账面余额	坏账准备

¹ 中国银行合肥北城支行现已更名为中国银行合肥庐阳支行。

项目名称	关联方	2022年6月30日	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	邱显寰	0.22	-
其他应收款	詹奕鹏	5.49	-
其他应收款	简瑞荣	0.18	-
其他应收款	李迦谕	2.75	-
其他应收款	合肥燃气	72.00	-
其他应收款	合肥租赁	80.25	-

(2) 应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2022年6月30日	
		账面余额	坏账准备
其他应付款	合肥蓝科	80.95	
其他应付款	晶相光电	1,917.90	
应付账款	合肥燃气	112.42	
应付账款	智成电子	942.95	
租赁负债	合肥蓝科	333,687.15	
租赁负债	合肥租赁	65.84	

注：上表中晶相光电他应付款系晶相光电缴纳的产能保证金；合肥蓝科租赁负债系发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套厂务设备形成，具体情况详见本补充法律意见书之“九、关联交易及同业竞争及其变化情况”之“（二）关联交易”之“3、关联租赁”。

发行人于2022年6月30日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易的议案》及《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联股东在股东大会审议该等议案时回避表决。

根据《2019-2022年6月审计报告》、发行人相关会议资料、发行人的书面说明，并经本所律师核查，上述报告期内发生的发行人关联方与发行人所发生的关联交易，交易价格及条件均符合公允原则，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

(三) 同业竞争

截至本补充法律意见书出具日，发行人从事 12 英寸晶圆代工业务。根据合肥建投提供的对外投资企业清单并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统、天眼查网站等方式进行核查，合肥建投除投资发行人外，未控制其他从事晶圆代工业务的公司，合肥建投及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争。

(四) 发行人对关联交易和同业竞争事项的披露

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人已在《招股说明书（注册稿）》中对有关减少和规范关联交易的措施及避免同业竞争的承诺进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

九、 发行人的主要财产及其变化情况

(一) 土地使用权和房屋所有权变化情况

1、自有物业

截至本补充法律意见书出具日期间，发行人无自有物业。

2、租赁物业

经发行人确认并经本所律师核查发行人及其子公司的租赁协议及租赁物业产权证明，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司承租用于办公、生产经营的房产共计 4 处，面积合计约 215,785.43 平方米，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积 (m ²)	租赁期限	用途
1	晶合集成	合肥蓝科	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号	215,270.61	2017 年 6 月 28 日至 2037 年 6 月 27 日	生产办公
2	上海晶合	上海莘泽创业投资管理股份	上海市浦东新区区盛夏路 608 号 3 幢 5 层 502 室	141.15	2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日	办公

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积 (m ²)	租赁期限	用途
		有限公司				
3	日本晶合	マスター・プロパティーズ株式会社	東京都立川市曙町一丁目13番11号	242.71	2021年5月1日至2023年4月30日	办公
4	晶合集成	深圳市唐庄实业有限公司	深圳市福田区深南西路车公庙工业区	130.96	2021年6月1日至2023年5月31日	办公

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人不存在租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产的情形。

(二) 在建工程

根据《2019-2022年6月审计报告》《招股说明书（注册稿）》以及发行人书面说明，截至本补充法律意见出具日，发行人的在建工程主要为公司新购置待安装机台设备。截至2022年6月30日，发行人在建工程的账面余额为171,107万元。

(三) 商标、专利等无形资产变化情况

1、注册商标

根据发行人提供的《商标注册证》、商标注册代理机构出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于中国境外注册商标相关事宜的确认函》、国家知识产权局出具的《商标初步审定公告》，并经本所律师核查，截至2022年6月30日，发行人及其控股子公司共拥有118项注册商标，其中，在中国境内注册的商标27项，在中国境外注册的商标91项，该等商标的具体情况详见本补充法律意见书附件。

2、注册专利

根据发行人提供的专利证书等相关文件、专利注册代理机构出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于中国境外注册专利相关事宜的确认函》、国家知识产权局注册结果并查询国家知识产权局综合服务平台专利检索及分析系统（<http://pss-system.cnipa.gov.cn>），并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司在中国境内共拥有 247 项已授权专利，在中国境外共拥有 61 项已授权专利。该等专利注册的具体情况详见本补充法律意见附件。

3、互联网域名

截至 2022 年 6 月 30 日，根据发行人提供的域名证书，并经本所律师核查工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统（<http://beian.miit.gov.cn>），发行人及其子公司拥有的域名情况没有发生变化。

4、发行人使用的授权许可知识产权（IP）

截至 2022 年 6 月 30 日，公司正在使用的授权许可知识产权（IP）情况如下：

序号	合同相对方	授权内容	合同金额或定价依据	有效期限
1	美商矽成积体电路股份有限公司	110纳米嵌入式闪存技术	开发服务费、权利金	最晚至2025/01/30
2	円星科技股份有限公司	90纳米编译器IP、150纳米标准单元库、90纳米编译器IP、150纳米编译器IP	开发服务费、权利金	最晚至2023/03/31
3	力旺电子股份有限公司	单次可编程IP、单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费、权利金等	最晚至2027/07/24
4	智成电子股份有限公司	110纳米标准单元库	量产权利金	最晚至2022/12/31
5	寅通科技股份	80、90、110、55纳	技术开发费、	最晚至2026/06/14

序号	合同相对方	授权内容	合同金额或定价依据	有效期限
	有限公司	米集成电路IP	量产权利金、开发及授权服务费	
6	亿而得微电子股份有限公司	多次可编程电路模块、集成电路模块	产品开发费用、权利金或权利金	最晚至2027/01/20
7	成都锐成芯微科技股份有限公司	110纳米低功耗嵌入式存储工艺平台模拟IP、110纳米多次可编程电路 90纳米多晶硅熔丝IP 150纳米多晶硅熔丝IP、55纳米多晶硅熔丝IP、55纳米多次可编程电路	技术秘密使用费，并根据实际发生金额结算、支付版税费用或支付版税费用或产品开发费用及权利金	最晚至2032/04/07
8	珠海创飞芯科技有限公司	110、90纳米单次可编程（反熔丝）技术、55纳米单次可编程（反熔丝）技术、40纳米单次可编程（反熔丝）技术	授权产品的使用提成费用、产品开发费用	2021/06/01起至达成新协议前永久有效或最晚至2027/03/10
9	IMEC VZW	28纳米集成电路IP	分期支付使用费	2021/12/24-2023/06/23
10	南京华大九天科技有限公司	40纳米集成电路IP	产品开发费用、权利金	2022/3/14-2027/3/13
11	Synopsys Inc.	28纳米集成电路IP	产品开发费用、权利金	2022/4/17-永久有效

(四) 主要生产经营设备

根据《2019-2022年6月审计报告》《招股说明书（注册稿）》、重大生产经营设备的购置合同、履行凭证及发行人说明，发行人的主要生产经营设备包括机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等。截至2022年6月30日，机器设备的账面价值为2,075,068.49万元、电子设备及其他的账面价值为13,436.53万元、房屋及建筑物的账面价值为2,582.88万元。

（五）发行人的子公司

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人子公司北京晶芯成、南京晶驱、日本晶合的基本情况未发生变化，新晶集成已完成增资的工商变更登记，增资完成后新晶集成的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例
1	晶合集成	400,000.00	52.02%
2	建航晶合股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	92,222.57	11.99%
3	建航晶合二期股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	30,802.34	4.01%
4	建航晶合三期股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	6,086.69	0.79%
5	上海景焯投资管理有限公司	18,444.51	2.40%
6	北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）	122,963.42	15.99%
7	农银金融资产投资有限公司	61,481.71	8.00%
8	农银国际投资（苏州）有限公司	12,296.34	1.60%
9	中国东方资产管理股份有限公司	24,592.68	3.20%
	合计	768,890.26	100.00%

（六）主要财产所有权或使用权的受限制情况

根据发行人提供的相关债权合同、担保合同、不动产登记簿、经本所律师核查，自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人及其子公司主要财产存在权利受限的情况未发生重大改变。

十、 发行人的重大债权债务变化情况

根据发行人的说明，并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人的重大债权债务变化情况如下：

（一）重大合同的变化情况

根据发行人确认并经本所律师核查，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，发行人新增的对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同如下：

1、 销售合同

根据发行人提供的相关文件及说明，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，发行人及其子公司与报告期各期前五大的客户新签署的重大销售合同情况如下：

序号	供应主体	客户	有效期/订单日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
1	晶合集成	集创北方	2022/02/24	0.09um LOGIC Foundry IC WAFER	2,612.50 万美元	正在履行
2	晶合集成	深圳天德钰科技股份有限公司	2022/02/25	0.11 um LOGIC Foundry IC WAFER	70.13 万美元	已履行
3	晶合集成	奕力科技股份有限公司	2022/01/12-2026/12/31	110nm、55nm 晶圆代工预约	8,125.92 万美元产能预约金	正在履行
4	晶合集成	联咏科技股份有限公司	2022/02/10	150nm NB,90nm NB,90nm TDDI	4,443.19 万美元	正在履行

序号	供应主体	客户	有效期/订单日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
		公司		LOGIC Foundry IC WAFER		
5	晶合集成	思特威 (上海) 电子科技 股份有限 公司	2022/01/30- 2027/06/30	90nm、55nm 晶圆代 工	28,317.60 万 美元	正在履行

2、采购合同

根据发行人提供的相关文件及说明，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，发行人及其子公司与报告期各期前五大原材料供应商新签署的重大采购合同情况如下：

序号	采购主体	供应商	签订日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
1	晶合集成	环球晶圆股份有限公司	2022/05/31	硅晶圆	3,439 万美 元	正在履行
2	晶合集成	AppliedMaterialsSouthEastAsiaPte.Ltd	2022/05/31	零部件	79.82 万美 元	已履行
3	晶合集成	上海怡康化工材料有限公司	2022/01/13	化学品	753.06 万元	正在履行
4	晶合集成	RohmandHaa sElectronicM aterialsCMP AsicaInc.	2022/01/13	化学品	427.16 万美 元	已履行
5	晶合集成	中环领先半 导体材料有	2022/03/23	硅晶圆	587.50 万美 元	已履行

序号	采购主体	供应商	签订日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
		限公司				

3、借款合同

根据发行人提供的相关文件及说明，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，发行人及其子公司新签订的重大授信、借款及担保合同如下：

序号	借款人/额度申请人	贷款人/额度授予人	签订日期	合同金额	贷款/授信期限	目前履行情况	担保情况
1	晶合集成	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	2022/06/24	1 亿元授信	2022/06/24-2022/11/30	正在履行	——

4、对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的其他合同

除本节之“（一）重大合同”之“1、销售合同”已披露的合同外，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人与主要客户新签订的产能预约金合同如下：

（1）2021 年 6 月 1 日，发行人同客户四签订《2022-2023 产能预约合同》，约定发行人为客户四预留 150nm 产能，合同期限为 2021 年 6 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（2）2021 年 12 月 2 日，发行人同客户三及其关联方签订《产能预约合同》，约定发行人为客户三及其关联方预留 150nm、110nm、90nm、55nm、40nm 产品，合同期限为 2021 年 12 月 2 日至 2026 年 12 月 31 日。

（二）合同主体及合同的履行

上述适用中国法律的重大合同内容和形式不违反中国法律、行政法规的禁止性规定，发行人及其子公司作为上述适用中国法律的重大合同的主体，继续履行该等合同不存在实质性法律障碍。

（三）侵权之债

根据发行人说明、相关工商行政管理部门、人事劳动社会保障部门、税务部门等出具的证明，经本所律师在发行人及其子公司相关主管部门政府网站核查，自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人及其子公司报告期内没有因知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（四）发行人与关联方之间的重大债权债务关系及相互提供担保情况

根据《2019-2022 年 6 月审计报告》并经本所律师核查，截至报告期末，除本补充法律意见第一部分“八、关联交易及同业竞争及其变化”及“十、发行人的重大债权债务变化情况”所述之外，发行人与其关联方之间不存在其他重大债权债务关系，亦不存在其他相互提供担保的情况。

（五）发行人的其他应收、应付款

根据《2019-2022 年 6 月审计报告》并经本所律师核查，报告期内，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款是因正常的经营及投资活动发生，合法有效。

十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并

根据发行人的说明并经本所律师核查，自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人无重大资产收购、出售或拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十二、 发行人公司章程的制定与修改

根据发行人提供的《公司章程》、工商登记资料、股东大会会议文件及发行人说明，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>），自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日，《公司章程》及《发行人章程》未进行修改。

十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

根据发行人确认，并经本所律师核查发行人会议资料，自《补充法律意见书

（五）《出具日至本补充法律意见书出具日期间》：

（一）发行人的组织结构没有发生变化；

（二）发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则内容没有发生变化；

（三）发行人共召开了 1 次股东大会、3 次董事会会议、1 次监事会会议，主要情况如下：

1、根据发行人提供的股东大会会议决议、会议记录、会议通知等相关文件，自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人共召开了 1 次股东大会，其主要情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间
1	2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 30 日

2、根据发行人提供的董事会会议决议、会议记录、会议通知等相关文件，自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人共召开了 3 次董事会，其主要情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间
1	第一届董事会第十一次会议	2022 年 3 月 23 日
2	第一届董事会第十二次会议	2022 年 6 月 10 日
3	第一届董事会第十三次会议	2022 年 10 月 19 日

3、根据发行人提供的监事会会议决议、会议记录、会议通知等相关文件，自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人共召开了 1 次监事会，其主要情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间
1	第一届监事会第三次会议	2022 年 3 月 23 日

经本所律师核查上述会议的召开通知、会议议案、会议决议、会议记录等文件资料，本所律师认为，发行人上述股东大会、董事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

十四、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

(一) 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况

自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员范围未发生变化。经本所律师核查，发行人的董事、监事、高级管理人员任职符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 发行人董事、监事及高级管理人员变化情况

根据发行人提供的股东大会、董事会、监事会决议等相关文件，自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人董事、监事、高级管理人员未发生变化。

十五、 发行人的税务及其变化情况

(一) 税务登记及税种、税率

根据《2019-2022 年 6 月审计报告》《主要税种纳税情况说明的专项审核报告》及发行人书面确认，并经本所律师核查，2022 年 1-6 月，发行人及境内下属企业执行的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、13%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地面积	5 元/平方米

本所律师认为，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其境内子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

（二）税收优惠

根据《2019-2022 年 6 月审计报告》《主要税种纳税情况专项说明》及发行人的说明，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，发行人享有的税收优惠无重大变化。

（三）财政补贴

根据《2019-2022 年 6 月审计报告》及发行人的说明，2022 年 1-6 月，发行人及其境内控股子公司获得的计入当期损益的政府补助金额为 5,511.96 万元。

（四）税务合规证明

2022 年 9 月 9 日，国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局向晶合集成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经金三征管系统查询，该纳税人自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日一直正常申报纳税，未发生违法违规等行为被税务机关处罚的情形。”

2022 年 9 月 22 日，国家税务总局南京市秦淮区税务局向南京晶驱出具《涉税信息查询结果告知书》，“经税收管理系统查询，你单位 2021 年 02 月 01 日至 2022 年 09 月 22 日期间，未发现违法违规记录。”

2022 年 9 月 16 日，国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所（办税服务厅）向北京晶芯成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经查询，晶芯成（北京）科技有限公司为我局登记户，该单位于 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日在我局无缴纳税款。根据税务核心系统记载，该企业在此期间未接受过行政处罚，该单位企业所得税征收方式为查账征收。”

2022 年 9 月 9 日，国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局出具《涉税信息查询结果告知书》，“经金三征管系统查询，该纳税人自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日一直正常申报纳税，未发生违法违规等行为被税务机关处罚的情形。”

（五）税务处罚

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，发行人及其子公司无新增税务处罚情况。

十六、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准的变化情况

(一) 环境保护

1、根据行人说明及其提供的文件，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及新晶集成对于主要环境污染物的处理设施及处理能力情况如下：

处理设备名称	数量 (套)	主要用途	处理能力	运行情况
污水处理站-酸碱废水处理系统	1	处理酸碱废水	7,200 吨/天	正常
污水处理站-含氨废水处理系统	2	处理含氨废水	720 吨/天	正常
污水处理站-含氟废水处理系统	2	处理含氟废水	2,400 吨/天或 1,440 吨/天	正常
污水处理站-研磨废水处理系统	1	处理研磨废水	960 吨/天	正常
污水处理站-有机废水处理系统	2	处理有机废水	480 吨/天	正常
污水处理站-含铜废水处理系统	1	处理含铜废水	720 吨/天	正常
酸性废气处理设施 (44m 排气筒)	14	处理酸性废气	78,000m ³ /h/套	正常
碱性废气处理设施 (44m 排气筒)	7	处理碱性废气	27,000m ³ /h/套或 45,000m ³ /h/套	正常
沸石浓缩转轮、RTO 蓄热燃烧炉 (44m 排 气筒)	6	处理有机废气	60,000m ³ /h/套或 50,000m ³ /h/套	正常

处理设备名称	数量 (套)	主要用途	处理能力	运行情况
含砷废气处理吸附塔 (44m 排气筒)	4	处理含砷废气	6,000m ³ /h	正常
两级酸洗喷淋塔+水喷淋塔 (19m 排气筒)	2	处理废水站废气	30,000m ³ /h+9,000 m ³ /h	正常
锅炉低氮燃烧器 (35m 排气筒)	4	处理锅炉废气	4589 m ³ /h*2 +2295 m ³ /h	正常

2、环保合规证明

2022年9月22日，合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局向发行人出具《证明》，“该公司自2022年1月1日以来，未发生过环境污染事故，也未因环境违法行为受到环保行政处罚或立案调查。”

2022年9月22日，合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局向新品集成出具《证明》，“该公司自2022年1月1日以来，未发生过环境污染事故，也未因环境违法行为受到环保行政处罚或立案调查。”

3、根据发行人确认及本所律师通过网络公开信息检索等方式核查，自2022年1月1日至2022年6月30日期间，发行人不存在因经营活动违反环境保护法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件而受到处罚的情况。

(二) 产品质量和技术监督标准

根据发行人确认及本所律师通过网络公开信息检索等方式核查，自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情况。

(三) 安全生产

根据发行人书面说明，自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，北京晶芯成、南京晶驱无实际经营，日本晶合不从事生产，不涉及安全

生产相关事项，不涉及安全生产相关事项。发行人及新晶集成安全生产合规情况如下：

2022年9月27日，安徽省应急管理厅出具《拟上市（挂牌）企业安全生产相关情况证明》，“合肥晶合集成电路股份有限公司自2022年01月01日至2022年09月23日，在合肥市辖区内未发生亡人生产安全事故。”

2022年9月27日，安徽省应急管理厅出具《拟上市（挂牌）企业安全生产相关情况证明》，“合肥新晶集成电路有限公司自2022年01月01日至2022年09月23日，在合肥市辖区内未发生亡人生产安全事故。”

根据上述安全生产监督管理部门出具的证明、发行人书面确认并经本所律师核查，发行人及其子公司的生产经营符合安全生产监督管理要求，最近三年未发生过安全生产事故，未受过安全生产方面的行政处罚。

十七、 发行人的劳动与社会保障及其变化情况

1、 劳动合同

根据发行人提供的《劳动合同》模板，并经本所律师抽样核查发行人与员工签署的《劳动合同》，该等劳动合同的内容、形式符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的要求。

2、 社会保险缴纳情况

根据发行人提供的统计资料及社会保险及住房公积金缴纳凭证，截至2022年6月30日，发行人及其境内子公司员工共3,499人，已为其中3,121人缴纳社会保险，已为其中3,071人缴纳住房公积金。

发行人及其子公司未为全部员工缴纳社会保险的原因主要为（1）存在个别当月社会保险扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳社会保险；（2）在境内任职的中国台湾员工按照中国台湾地区相关规定缴纳了劳健保；（3）在境内任职的中国香港员工、外籍员工未缴纳社会保险；（4）境外子公司员工遵循当地法律相关规定缴纳社会保险。

发行人及其子公司未为全部员工缴纳住房公积金的原因主要为：（1）存在个别当

月住房公积金扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳住房公积金；（2）在境内任职的中国台湾员工、中国香港员工、外籍员工未缴纳住房公积金；（3）境外子公司员工遵循当地法律相关规定无需缴纳住房公积金。

2022年10月11日，合肥市人力资源和社会保障局出具证明：经核实，晶合集成依法足额缴纳各项社会保险费，自2022年1月1日至2022年10月11日未发现劳动用工违法行为，无人力资源社会保障行政部门处罚的不良记录。

2022年10月11日，合肥市住房公积金管理中心出具证明：晶合集成自2016年7月在我中心开户缴存职工住房公积金，该公司住房公积金缴存正常，未发现违反住房公积金相关法律法规的行为，公司未因住房公积金问题而受到行政处罚。

2022年10月11日，合肥市人力资源和社会保障局出具证明：经核实，新晶集成依法足额缴纳各项社会保险费，自2022年1月1日至2022年10月11日未发现劳动用工违法行为，无人力资源社会保障行政部门处罚的不良记录。

2022年10月11日，合肥市住房公积金管理中心出具证明：新晶集成自2021年12月在我中心开户缴存职工住房公积金，该公司住房公积金缴存正常，未发现违反住房公积金相关法律法规的行为，公司未因住房公积金问题而受到行政处罚。

十八、 发行人募集资金的运用

自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人本次发行上市募集资金投资项目的项目备案文件及环评备案文件未发生变化。

十九、 诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况

（一）发行人及其下属公司

经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/>）、信用中国网（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、中国裁判文书网

(<http://wenshu.court.gov.cn/>)、人民法院公告网(<http://rmfygg.court.gov.cn/>)、中国检察网(<http://www.12309.gov.cnajxxgk.jcy.gov.cn/12309/index.shtml>)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)，访谈发行人董事、监事和高级管理人员并根据发行人书面确认，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚。

(二) 持有发行人 5%以上股份的股东

根据持有发行人 5%以上股份的主要股东填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》、持有发行人 5%以上股份的主要股东出具的承诺函、境外法律意见书，并经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏(<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/>)、信用中国网(<https://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/index.html>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)、人民法院公告网(<http://rmfygg.court.gov.cn/>)、中国检察网(<http://www.12309.gov.cnajxxgk.jcy.gov.cn/12309/index.shtml>)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)等网站查询，截至本补充法律意见书出具日，持有发行人 5%以上股份的主要股东不存在对晶合集成产生影响的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

(三) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

根据发行人董事、监事、高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》、核心技术人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司核心技术人员调查表》，中国证监会安徽监管局诚信信息查询结果，并经本所律师查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)、中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)、人民法院公告网(<http://rmfygg.court.gov.cn/>)等网站，截至本补充法律意见书出具日，发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

二十、 发行人《招股说明书（注册稿）》法律风险的评价

经审阅发行人《招股说明书（注册稿）》所引用的《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》《补充法律意见书（五）》及本补充法律意见书相关内容部分，金杜认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人《招股说明书（注册稿）》及其摘要引用相关内容与《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》《补充法律意见书（五）》及本补充法律意见书不存在矛盾之处。金杜确认，《招股说明书（注册稿）》及其摘要不致因引用《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》《补充法律意见书（五）》及本补充法律意见书的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十一、 本次发行上市的总体结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，发行人自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日期间内所发生的变化，不会对《补充法律意见书（五）》中本所律师发表的结论意见构成影响，本所律师发表的结论意见依然有效。

（本页以下无正文，下接签字盖章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（六）》之签章页）



经办律师：
苏 峥


刘东亚

单位负责人：
王 玲

二〇二二年十一月十四日

附件：发行人及其子公司拥有的知识产权

1、境内注册商标

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式
1	晶合集成	Nexchip	26258933	25	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
2	晶合集成	Nexchip	26283789	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
3	晶合集成	Nexchip	26255490	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
4	晶合集成	晶合	26295138 A	9	2018/11/07-2028/11/06	原始取得
5	晶合集成	晶合	26261189	25	2018/10/28-2028/10/27	原始取得
6	晶合集成	晶合	26283543	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
7	晶合集成	晶合	26258453	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
8	晶合集成	晶合集成	26296982 A	9	2018/11/07-2028/11/06	原始取得
9	晶合集成	晶合集成	26257005	25	2018/10/28-2028/10/27	原始取得
10	晶合集成	晶合集成	26279879	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式
11	晶合集成	晶合集成	26258966	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
12	晶合集成		26279826	9	2018/12/07-2028/12/06	原始取得
13	晶合集成		43218141	25	2020/10/14-2030/10/13	原始取得
14	晶合集成		26279830	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
15	晶合集成		26273278	40	2019/12/14-2029/12/13	原始取得
16	晶合集成	 Nexchip	36794768	25	2020/08/21-2030/08/20	原始取得
17	晶合集成	晶芯成	54924121	9	2021/11/7-2031/11/6	原始取得
18	晶合集成	晶芯成	53267990	25	2021/9/7-2031/9/6	原始取得
19	晶合集成	晶芯成	54895828	35	2021/11/7-2031/11/6	原始取得
20	晶合集成	晶芯成	53268332	40	2021/9/7-2031/9/6	原始取得
21	晶合集成	晶驱	53274613	25	2021/8/28-2031-8/27	原始取得
22	晶合集成	晶驱	53264804	40	2021/8/28-2031/8/27	原始取得
23	晶合集成	新晶	59163417	9	2022/6/14-2032/6/13	原始取得
24	晶合集成	新晶	59154730	25	2022/3/14-2032/3/13	原始取得
25	晶合集成	新晶	59142175	35	2022/5/21-2032/5/20	原始取得
26	晶合集成	新晶	59148502	40	2022/5/21-2032/5/20	原始取得

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式
27	晶合集成	Nexchip	61874559	35	2022/6/21-2032/6/20	原始取得

2、境外商标情况

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
1	晶合有限	Nexchip	6098177	9	2018/11/16-2028/11/15	原始取得	日本
2	晶合有限	Nexchip	6071853	25	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
3	晶合有限	Nexchip	6098177	35	2018/11/16-2028/11/15	原始取得	日本
4	晶合有限	Nexchip	6071853	40	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
5	晶合有限	晶合	6050343	9	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
6	晶合有限	晶合	6070505	25	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
7	晶合有限	晶合	6050343	35	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
8	晶合有限	晶合	6070505	40	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
9	晶合有限	晶合集成	6050344	9	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
10	晶合有限	晶合集成	6071852	25	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
11	晶合有限	晶合集成	6050344	35	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
12	晶合有限	晶合集成	6071852	40	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
13	晶合有限		6050345	9	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
14	晶合有限		6070504	25	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
15	晶合有限		6050345	35	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
16	晶合有限		6070504	40	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
17	晶合有限	Nexchip	0191963 9	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
18	晶合集成	Nexchip	0192363 3	25	2018/07/01-2028/06/30	原始取得	中国台湾
19	晶合有限	Nexchip	0192098 3	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
20	晶合集成	Nexchip	0191274 5	40	2018/05/01-2028/04/30	原始取得	中国台湾
21	晶合有限	晶合	0191963 7	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
22	晶合集成	晶合	0190940 1	25	2018/04/16-2028/04/15	原始取得	中国台湾
23	晶合有限	晶合	0192098 1	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
24	晶合集成	晶合	0191274 3	40	2018/05/01-2028/04/30	原始取得	中国台湾

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
25	晶合有限	晶合集成	01919636	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
26	晶合集成	晶合集成	01909400	25	2018/04/16-2028/04/15	原始取得	中国台湾
27	晶合有限	晶合集成	01920980	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
28	晶合集成	晶合集成	01918174	40	2018/06/01-2028/05/31	原始取得	中国台湾
29	晶合有限		01919638	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
30	晶合集成		01909402	25	2018/04/16-2028/04/15	原始取得	中国台湾
31	晶合有限		01920982	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
32	晶合集成		01912744	40	2018/05/01-2028/04/30	原始取得	中国台湾
33	晶合有限	Nexchip	5513533	9	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
34	晶合有限	Nexchip	5513299	25	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
35	晶合有限	Nexchip	5559722	35	2018/09/11-2028/09/10	原始取得	美国
36	晶合有限	Nexchip	5513440	40	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
37	晶合有限	晶合	5523772	9	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
38	晶合有限	晶合	5518583	25	2018/07/17-2028/07/16	原始取得	美国
39	晶合有限	晶合	5513532	35	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
40	晶合有限	晶合	5518584	40	2018/07/17-2028/07/16	原始取得	美国
41	晶合有限	晶合集成	5518591	25	2018/07/17-2028/07/16	原始取得	美国
42	晶合有限	晶合集成	5523770	9	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
43	晶合有限	晶合集成	5523769	35	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
44	晶合有限	晶合集成	5513586	40	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
45	晶合有限		5523767	9	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
46	晶合有限		5523806	25	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
47	晶合有限		5523768	35	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
48	晶合有限		5523807	40	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
49	晶合有限	Nexchip	0180744 17	9	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
50	晶合有限	Nexchip	0180744 17	35	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
51	晶合有限	Nexchip	0180744 17	40	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
52	晶合有限	 Nexchip	0180739 71	9	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
53	晶合有限	 Nexchip	0180739 71	35	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
54	晶合有限	 Nexchip	0180739 71	40	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
55	晶合有限		0180739 76	9	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
56	晶合有限		0180739 76	35	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
57	晶合有限		0180739 76	40	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
58	晶合有限	Nexchip	4196328	35	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度
59	晶合有限	Nexchip	4196329	40	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度
60	晶合有限	 Nexchip	4216333	35	2019/06/25- 2029/06/24	原始取得	印度
61	晶合有限	 Nexchip	4216334	40	2019/06/25- 2029/06/24	原始取得	印度
62	晶合有限		4196323	9	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度
63	晶合有限		4196324	35	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
64	晶合有限		4196325	40	2019/06/03-2029/06/02	原始取得	印度
65	晶合有限	Nexchip	401603379	35	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
66	晶合有限	Nexchip	401603380	40	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
67	晶合集成	Nexchip	401684625	9	2021/1/20-2031/1/19	原始取得	韩国
68	晶合有限	 Nexchip	401605036	35	2020/05/12-2030/05/11	原始取得	韩国
69	晶合有限	 Nexchip	401605037	40	2020/05/12-2030/05/11	原始取得	韩国
70	晶合集成	 Nexchip	401684665	9	2021/1/20-2031/1/19	原始取得	韩国
71	晶合有限		401603377	9	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
72	晶合有限		401603378	35	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
73	晶合有限		401599318	40	2020/04/23-2030/04/22	原始取得	韩国
74	晶合有限	Nexchip	40201926832S	35	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
75	晶合有限	Nexchip	40201926831T	40	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
76	晶合集成	Nexchip	40201926806V	9	2019/12/11-2029/12/10	原始取得	新加坡
77	晶合有限	 Nexchip	40201925814T	35	2019/11/28-2029/11/27	原始取得	新加坡
78	晶合集成	 Nexchip	40201925815S	40	2019/11/28-2029/11/27	原始取得	新加坡
79	晶合集成	 Nexchip	40201926869W	9	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
80	晶合有限		40201926842V	9	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
81	晶合有限		40201926838P	35	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
82	晶合集成		40201926847Q	40	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
83	晶合集成	 Nexchip	TM2019044357	9	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
84	晶合集成	 Nexchip	TM2019044362	35	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚
85	晶合集成	 Nexchip	TM2019044364	40	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚
86	晶合集成	Nexchip	TM2019045346	9	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
87	晶合集成	Nexchip	TM2019045348	35	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
88	晶合集成	Nexchip	TM2019045350	40	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
89	晶合集成		TM2019045352	9	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
90	晶合集成		TM2019045355	35	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
91	晶合集成		TM2019045357	40	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚

3、境内专利

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
1	晶合集成	发明专利	光学光刻方法	ZL03155531.4	2003/08/28	继受取得
2	晶合集成	发明专利	具有自行对准接触窗的半导体元件及其制造方法	ZL20051006558 0.3	2005/04/18	继受取得
3	晶合集成	发明专利	导线的制造方法	ZL20051006560 8.3	2005/04/18	继受取得
4	晶合集成	发明专利	半导体元件及其制造方法	ZL20061000589 1.5	2006/01/19	继受取得
5	晶合集成	发明专利	导线的制造方法以及缩小导线与图案间距的方法	ZL20051012976 7.5	2005/12/05	继受取得
6	晶合集成	发明专利	电路结构及用以定义此电路结构的光掩模	ZL20071016177 5.7	2007/09/26	继受取得
7	晶合集成	发明专利	监控光刻工艺的方法与监控标记	ZL20081009331 7.9	2008/04/18	继受取得
8	晶合集成	发明专利	分栅式非易失性存储器及其制备方法	ZL20181079627 7.8	2018/07/19	原始取得
9	晶合集成	发明专利	一种晶元破片分析装置及其晶元破片分析方法	ZL20181089730 0.2	2018/08/08	原始取得
10	晶合集成	发明专利	一种裂片装置及方法	ZL20181092034 3.8	2018/08/14	原始取得
11	晶合集成	发明专利	一种半导体结构制造方法	ZL20181098035 6.4	2018/08/27	原始取得
12	晶合集成	发明专利	MOS 场效应晶体	ZL20181123719	2018/10/23	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			管及其制造方法	7.5		
13	晶合集成	发明专利	一种非易失性存储器及其制作方法	ZL20181134571 9.3	2018/11/13	原始取得
14	晶合集成	发明专利	一种非易失性存储器及其制作方法	ZL20181135413 9.0	2018/11/14	原始取得
15	晶合集成	发明专利	沟槽隔离结构的形成方法	ZL20191004869 4.9	2019/01/18	原始取得
16	晶合集成	发明专利	一种存储器及其制造方法	ZL20191010474 7.4	2019/02/01	原始取得
17	晶合集成	发明专利	高耐压半导体元件及其制造方法	ZL20191029987 1.0	2019/04/15	原始取得
18	晶合集成	发明专利	预处理方法、金属硅化物的形成方法以及半导体处理装置	ZL20191061196 6.1	2019/07/08	原始取得
19	晶合集成	发明专利	沟槽制作方法及半导体隔离结构制作方法	ZL20191126817 3.0	2019/12/11	原始取得
20	晶合集成	发明专利	半导体集成器件的阱制备方法和阱注入光罩组	ZL20191130399 1.X	2019/12/17	原始取得
21	晶合集成	发明专利	一种半导体器件的制造方法及其形成的半导体器件	ZL20191132656 3.9	2019/12/20	原始取得
22	晶合集成	发明专利	扩散型场效应晶	ZL20201004399	2020/01/15	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			体管的形成方法	7.4		
23	晶合集成	发明专利	半导体器件及其 制造方法	ZL20201009979 8.5	2020/02/18	原始取得
24	晶合集成	发明专利	半导体元件的制 造方法	ZL20191010360 9.4	2019/02/01	原始取得
25	晶合集成	发明专利	一种建立光学数 据校正模型的方 法	ZL20201021935 6.X	2020/03/25	原始取得
26	晶合集成	发明专利	一种晶圆的退火 方法	ZL20201037248 9.0	2020/05/06	原始取得
27	晶合集成	发明专利	一种半导体结构 及其制造方法	ZL20201045497 7.6	2020/05/26	原始取得
28	晶合集成	发明专利	一种半导体结构 及其制造方法	ZL20201035848 3.8	2020/04/29	原始取得
29	晶合集成	发明专利	电容性半导体元 件	ZL20191034016 5.6	2019/04/25	原始取得
30	晶合集成	发明专利	电容性半导体元 件	ZL20201032491 4.9	2020/04/23	原始取得
31	晶合集成	发明专利	一种监测系统及 监测方法	ZL20181114598 5.1	2018/09/29	原始取得
32	晶合集成	发明专利	一种静态随机存 取存储器	ZL20191053020 3.4	2019/06/19	原始取得
33	晶合集成	发明专利	一种化学机械平 坦化设备及其应 用	ZL20201160741 1.9	2020/12/30	原始取得
34	晶合集成	发明专利	一种降低 CMOS 图像传感器暗电 流的方法	ZL20221022902 7.2	2022/03/10	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
35	晶合集成	发明专利	一种 GOI 测试电路结构	ZL20221022894 8.7	2022/03/10	原始取得
36	晶合集成	发明专利	一种光阻层移除方法及半导体器件的制作方法	ZL20221033624 4.1	2022/04/01	原始取得
37	晶合集成	发明专利	洁净室的空气净化装置及洁净室离子控制系统	ZL20201031715 0.0	2020/04/21	原始取得
38	晶合集成	发明专利	互连结构及其制备方法	ZL20221022902 3.4	2022/03/10	原始取得
39	晶合集成	实用新型	一种液位测量仪	ZL20182099552 5.7	2018/06/25	原始取得
40	晶合集成	实用新型	双灯丝离子源装置	ZL20182116322 6.3	2018/07/23	原始取得
41	晶合集成	实用新型	用于半导体设备的安装位检测装置	ZL20182113087 0.0	2018/07/17	原始取得
42	晶合集成	实用新型	用于半导体设备的定位装置	ZL20182114798 8.4	2018/07/19	原始取得
43	晶合集成	实用新型	一种气体供应装置	ZL20182119241 9.1	2018/07/24	原始取得
44	晶合集成	实用新型	一种载台及载具	ZL20182171961 7.9	2018/10/22	原始取得
45	晶合集成	实用新型	一种气体除尘装置及具有该气体除尘装置的气体处理装置	ZL20182175344 0.4	2018/10/26	原始取得
46	晶合集成	实用新型	掩膜板	ZL20182195750 2.3	2018/11/23	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
47	晶合集成	实用新型	可感测基片破损的片盒	ZL20182200299 1.3	2018/11/30	原始取得
48	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的间断储水装置及半导体设备	ZL20192070694 5.3	2019/05/17	原始取得
49	晶合集成	实用新型	一种防干扰装置及半导体制程机台	ZL20192101624 8.1	2019/07/02	原始取得
50	晶合集成	实用新型	流速调节装置	ZL20192123565 0.9	2019/08/01	原始取得
51	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的组件调整装置	ZL20192143957 2.4	2019/09/02	原始取得
52	晶合集成	实用新型	一种半导体设备夹持装置	ZL20192160416 2.0	2019/09/25	原始取得
53	晶合集成	实用新型	半导体检测机台	ZL20192165472 3.8	2019/09/30	原始取得
54	晶合集成	实用新型	一种光罩	ZL20202036835 5.7	2020/03/23	原始取得
55	晶合集成	实用新型	一种晶体管结构	ZL20202025766 4.7	2020/03/04	原始取得
56	晶合集成	实用新型	封装芯片的移除装置	ZL20192231208 2.4	2019/12/20	原始取得
57	晶合集成	实用新型	多次可编程存储器的单元结构	ZL20202033115 0.1	2020/03/16	原始取得
58	晶合集成	实用新型	一种非易失性存储器结构	ZL20202051950 1.1	2020/04/10	原始取得
59	晶合集成	实用新型	一种非易失性存储器结构	ZL20202051950 3.0	2020/04/10	原始取得
60	晶合集成	实用新型	一种半导体器件	ZL20202033322	2020/03/17	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
				2.6		
61	晶合集成	实用新型	半导体器件	ZL20202024773 8.9	2020/03/02	原始取得
62	晶合集成	实用新型	封装结构	ZL20202040462 2.1	2020/03/24	原始取得
63	晶合集成	实用新型	一种半导体结构及其应用的半导体器件	ZL20202077839 8.2	2020/05/12	原始取得
64	晶合集成	实用新型	嵌入式焊盘结构	ZL20202025253 7.8	2020/03/04	原始取得
65	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的腔室及半导体设备	ZL20202060424 3.7	2020/04/21	原始取得
66	晶合集成	实用新型	量测机台	ZL20202083266 6.4	2020/05/15	原始取得
67	晶合集成	实用新型	一种转接装置	ZL20202113745 0.2	2020/06/18	原始取得
68	晶合集成	实用新型	一种半导体的测试装置	ZL20202116695 9.X	2020/06/22	原始取得
69	晶合集成	实用新型	一种基板表面污染物取样装置	ZL20202124862 6.1	2020/06/30	原始取得
70	晶合集成	实用新型	封装芯片的开封装置	ZL20202128218 6.1	2020/07/02	原始取得
71	晶合集成	实用新型	一种晶圆侦测设备	ZL20202128366 1.7	2020/07/03	原始取得
72	晶合集成	实用新型	研磨垫中心校准治具	ZL20202158137 0.6	2020/08/03	原始取得
73	晶合集成	实用新型	流体测量治具	ZL20202161873 9.6	2020/08/06	原始取得
74	晶合集成	实用新型	研磨后清洗装置	ZL20202164511	2020/08/10	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			和化学机械研磨设备	6.8		
75	晶合集成	实用新型	化学机械研磨装置	ZL20202164507 9.0	2020/08/10	原始取得
76	晶合集成	实用新型	一种用于化学机械研磨的清洗装置	ZL20202179484 3.0	2020/08/25	原始取得
77	晶合集成	实用新型	一种半导体设备	ZL20202187354 9.9	2020/09/01	原始取得
78	晶合集成	实用新型	进样装置	ZL20202193521 7.9	2020/09/03	原始取得
79	晶合集成	实用新型	晶圆表面金属离子收集装置	ZL20202240972 3.0	2020/10/23	原始取得
80	晶合集成	实用新型	吹气管、吹气式液位计和硅片清洗装置	ZL20202261923 2.9	2020/11/12	原始取得
81	晶合集成	实用新型	高度测量装置	ZL20202298275 7.9	2020/12/07	原始取得
82	晶合集成	实用新型	一种循环水控温装置	ZL20212038331 8.8	2021/02/20	原始取得
83	晶合集成	实用新型	晶圆定位标示工具	ZL20212035004 4.2	2021/02/08	原始取得
84	晶合集成	实用新型	电容测试结构	ZL20202327855 0.X	2020/12/29	原始取得
85	晶合集成	实用新型	一种用于微光显微镜的测试夹具	ZL20202272703 5.9	2020/11/23	原始取得
86	晶合集成	实用新型	一种更换制程材料的防呆装置及防呆系统	ZL20212013954 0.3	2021/01/19	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
87	晶合集成	实用新型	一种探针弯折装置	ZL20202300099 1.3	2020/12/11	原始取得
88	晶合集成	实用新型	一种二次离子质谱的样品装载盒	ZL20212041972 4.5	2021/02/25	原始取得
89	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的张力自动调控装置	ZL20212025620 6.6	2021/01/29	原始取得
90	晶合集成	实用新型	变容二极管	ZL20202295212 9.6	2020/12/08	原始取得
91	晶合集成	实用新型	超纯水取样器	ZL20212036709 1.8	2021/02/09	原始取得
92	晶合集成	实用新型	缺陷检测装置	ZL20212166511 6.9	2021/07/21	原始取得
93	晶合集成	实用新型	化学机械研磨装置	ZL20212155490 6.X	2021/07/08	原始取得
94	晶合集成	实用新型	涂胶机喷头位置测量装置及涂胶机	ZL20212166509 8.4	2021/07/21	原始取得
95	晶合集成	实用新型	套刻对准标记及掩模板组件	ZL20212092535 1.9	2021/04/29	原始取得
96	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的压力测量装置	ZL20212152068 5.4	2021/07/05	原始取得
97	晶合集成	实用新型	一种监测系统及检测机台	ZL20212036872 0.9	2022/01/28	原始取得
98	晶合集成	实用新型	晶圆装卸系统	ZL20212178639 5.4	2022/01/28	原始取得
99	晶合集成	实用新型	支撑装置及反应腔	ZL20212169125 5.9	2022/01/28	原始取得
100	晶合集成	实用新型	一种过滤装置及	ZL20212189497	2021/08/13	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			光阻液涂布机	9.3		
101	晶合集成	实用新型	防污染检测系统	ZL20212177803 3.0	2022/01/28	原始取得
102	晶合集成	实用新型	一种芯片失效分析用测试装置	ZL20212233661 7.9	2022/02/11	原始取得
103	晶合集成	实用新型	一种晶圆曝光后的烘烤设备	ZL20212217304 6.1	2021/09/09	原始取得
104	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的废气排放管道连接件及装置	ZL20212252706 5.X	2021/10/20	原始取得
105	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的排气阀及排气装置	ZL20212261173 2.2	2021/10/28	原始取得
106	晶合集成	实用新型	一种晶圆研磨装置	ZL20212293429 4.3	2021/11/26	原始取得
107	晶合集成	实用新型	晶圆清洗装置	ZL20212300879 8.9	2021/11/30	原始取得
108	晶合集成	实用新型	晶圆运载装置	ZL20212290464 7.5	2021/11/19	原始取得
109	晶合集成	实用新型	一种半导体机台液体自动补充装置及半导体机台	ZL20212270492 0.X	2021/11/03	原始取得
110	晶合集成	实用新型	晶圆清洗装置	ZL20222017932 8.4	2022/01/21	原始取得
111	晶合集成	实用新型	一种晶圆清洗设备	ZL20222025581 2.0	2022/02/08	原始取得
112	晶合集成	实用新型	一种光刻对准标记图形结构及半导体晶片	ZL20222053315 0.9	2022/03/11	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
113	晶合集成	实用新型	半导体加热、显影装置	ZL20222052702 7.6	2022/03/11	原始取得
114	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的清洁装置	ZL20202297289 6.3	2020/12/11	原始取得
115	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL20201098315 5.7	2020/09/18	原始取得
116	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL20201100144 6.8	2020/09/22	原始取得
117	北京晶芯成	发明专利	SRAM 器件及其形成方法	ZL20201099849 5.7	2020/09/22	原始取得
118	北京晶芯成	发明专利	半导体器件及其制造方法	ZL20201101242 6.0	2020/09/24	原始取得
119	北京晶芯成	发明专利	一种浅沟槽隔离结构的制作方法	ZL20201102104 6.3	2020/09/25	原始取得
120	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL20201101941 1.7	2020/09/25	原始取得
121	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL20201103942 2.1	2020/09/28	原始取得
122	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其形成方法	ZL20201105913 8.0	2020/09/30	原始取得
123	北京晶芯成	发明专利	一种金属互连结构的形成方法	ZL20201105462 0.5	2020/09/30	原始取得
124	北京晶芯成	发明专利	LD MOS 晶体管及其制造方法	ZL20201105465 7.8	2020/09/30	原始取得
125	北京晶芯成	发明专利	浅沟槽隔离结构的制造方法及其形成的浅沟槽隔离结构	ZL20201106960 0.5	2020/10/09	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
126	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆表面处理方法和表面处理装置	ZL202011069584.X	2020/10/09	原始取得
127	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011069193.8	2020/10/09	原始取得
128	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202011073751.8	2020/10/10	原始取得
129	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆背封结构及其制造方法	ZL202011084965.5	2020/10/12	原始取得
130	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法与制造系统	ZL202011081316.X	2020/10/12	原始取得
131	北京晶芯成	发明专利	测试结构及其测试方法	ZL202011106814.5	2020/10/16	原始取得
132	北京晶芯成	发明专利	一种沟槽的形成方法	ZL202011106813.0	2020/10/16	原始取得
133	北京晶芯成	发明专利	半导体器件的制备方法	ZL202011106699.1	2020/10/16	原始取得
134	北京晶芯成	发明专利	一种沟槽的形成方法	ZL202011106690.0	2020/10/16	原始取得
135	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202011106407.4	2020/10/16	原始取得
136	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202011106406.X	2020/10/16	原始取得
137	北京晶芯成	发明专利	一种介质层缺陷检测的测试结构	ZL202011114851.0	2020/10/19	原始取得
138	北京晶芯成	发明专利	一种电介质击穿测试结构	ZL202011114835.1	2020/10/19	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
139	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆中心的校正方法及系统	ZL202011114387.5	2020/10/19	原始取得
140	北京晶芯成	发明专利	Nor 闪存结构及其制作方法	ZL202011122506.1	2020/10/20	原始取得
141	北京晶芯成	发明专利	半导体器件	ZL202011122488.7	2020/10/20	原始取得
142	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆电性测试方法及测试设备	ZL202011121614.7	2020/10/20	原始取得
143	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法	ZL202011136464.7	2020/10/22	原始取得
144	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法	ZL202011136463.2	2020/10/22	原始取得
145	北京晶芯成	发明专利	一种半导体装置的制备方法	ZL202011136147.5	2020/10/22	原始取得
146	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法及点胶装置	ZL202011135589.8	2020/10/22	原始取得
147	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011135359.1	2020/10/22	原始取得
148	北京晶芯成	发明专利	半导体数据分析方法、系统及计算机可读存储介质	ZL202011160229.3	2020/10/27	原始取得
149	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构	ZL202011159567.5	2020/10/27	原始取得
150	北京晶芯成	发明专利	SONOS 存储器及其制造方法	ZL202011159566.0	2020/10/27	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
151	北京晶芯成	发明专利	隔离结构的制作方法、DAC 器件及其制作方法	ZL20201115955 6.7	2020/10/27	原始取得
152	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制备方法	ZL20201115937 7.3	2020/10/27	原始取得
153	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制造方法	ZL20201117604 0.3	2020/10/29	原始取得
154	北京晶芯成	发明专利	半导体隔离结构及其制作方法	ZL20201118471 2.5	2020/10/30	原始取得
155	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的结构及其制备方法	ZL20201120728 8.1	2020/11/03	原始取得
156	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL20201120728 4.3	2020/11/03	原始取得
157	北京晶芯成	发明专利	LD MOS 晶体管及其制造方法	ZL20201120649 7.4	2020/11/03	原始取得
158	北京晶芯成	发明专利	MIM 电容器的制备方法	ZL20201120649 6.X	2020/11/03	原始取得
159	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL20201121372 5.0	2020/11/04	原始取得
160	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL20201121331 0.3	2020/11/04	原始取得
161	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL20201121330 4.8	2020/11/04	原始取得
162	北京晶芯成	发明专利	一种静态随机存取存储器及其制造方法	ZL20201123557 1.5	2020/11/09	原始取得
163	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆清洗位	ZL20201123554	2020/11/09	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
	成		置的监测装置及 监测方法	5.2		
164	北京晶芯 成	发明专利	气体置换装置及 光阻烘烤设备	ZL20201124368 2.0	2020/11/10	原始取得
165	北京晶芯 成	发明专利	半导体测试结构 及其形成方法、 半导体器件的测 试方法	ZL20201124367 5.0	2020/11/10	原始取得
166	北京晶芯 成	发明专利	半导体测试结构 及半导体钝化层 的质量测试方法	ZL20201124288 3.9	2020/11/10	原始取得
167	北京晶芯 成	发明专利	一种半导体器件 的制造方法	ZL20201125109 7.5	2020/11/11	原始取得
168	北京晶芯 成	发明专利	一种洁净室过滤 装置	ZL20201124978 8.1	2020/11/11	原始取得
169	北京晶芯 成	发明专利	半导体隔离结构 及其制作方法	ZL20201127511 9.1	2020/11/16	原始取得
170	北京晶芯 成	发明专利	一种自动调整半 导体设备平衡性 的装置及方法	ZL20201128303 6.7	2020/11/17	原始取得
171	北京晶芯 成	发明专利	一种半导体设备 的报警方法	ZL20201128302 9.7	2020/11/17	原始取得
172	北京晶芯 成	发明专利	功率半导体器件 及制造方法	ZL20201133353 0.X	2020/11/25	原始取得
173	北京晶芯 成	发明专利	一种光学邻近校 正模型的建模方 法及建模系统	ZL20201135957 6.9	2020/11/27	原始取得
174	北京晶芯	发明专利	半导体生产过程	ZL20201136762	2020/11/30	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
	成		中的参数监控方法、系统及计算机可读存储介质	5.3		
175	北京晶芯成	发明专利	半导体产品的良率分析方法及良率分析系统	ZL20201138455 1.4	2020/12/02	原始取得
176	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆失效的分析方法及系统	ZL20201141983 0.X	2020/12/08	原始取得
177	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL20201142491 1.9	2020/12/09	原始取得
178	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL20201156514 6.2	2020/12/25	原始取得
179	北京晶芯成	发明专利	一种曝光位置的确定方法及系统	ZL20201157923 4.8	2020/12/28	原始取得
180	北京晶芯成	发明专利	半导体存储器件	ZL20201157284 2.6	2020/12/28	原始取得
181	北京晶芯成	发明专利	ESD 保护电路、ESD 保护结构及其制造方法	ZL20211001026 8.3	2021/01/06	原始取得
182	北京晶芯成	发明专利	半导体器件的形成方法	ZL20211001026 6.4	2021/01/06	原始取得
183	北京晶芯成	发明专利	化学机械研磨方法	ZL20211005157 6.0	2021/01/15	原始取得
184	北京晶芯成	发明专利	一种集成半导体器件	ZL20211024893 5.1	2021/03/08	原始取得
185	北京晶芯成	发明专利	静态随机存储器的制备方法	ZL20211025270 0.X	2021/03/09	原始取得
186	北京晶芯成	发明专利	一种化学机械研	ZL20211028153	2021/03/16	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
	成		磨方法及其分析系统	9.9		
187	北京晶芯成	发明专利	一种半导体元件的制造方法	ZL202110306176.X	2021/03/23	原始取得
188	北京晶芯成	发明专利	半导体器件及其制造方法	ZL202110397617.1	2021/04/14	原始取得
189	北京晶芯成	发明专利	3D 半导体器件及其形成方法	ZL202110574826.9	2021/05/26	原始取得
190	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202110816834.X	2021/07/20	原始取得
191	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202110575021.6	2021/05/26	原始取得
192	北京晶芯成	发明专利	一种电介质击穿测试电路及其测试方法	ZL202110421520.X	2021/04/20	原始取得
193	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202011106408.9	2020/10/16	原始取得
194	北京晶芯成	发明专利	沟槽隔离结构的制备方法	ZL202110252703.3	2021/03/09	原始取得
195	北京晶芯成	发明专利	一种 LDMOS 晶体管及其形成方法	ZL202110921916.0	2021/08/12	原始取得
196	北京晶芯成	发明专利	沟槽隔离结构及其制备方法	ZL202110921908.6	2021/08/12	原始取得
197	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202111036002.2	2021/09/06	原始取得
198	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202111103889.2	2021/09/22	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
199	北京晶芯成	发明专利	半导体器件及制造方法	ZL202111083665X	2022/01/28	原始取得
200	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202111125376.1	2022/02/28	原始取得
201	北京晶芯成	发明专利	图像传感器及其制备方法	ZL202111417363.1	2022/02/08	原始取得
202	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202111436365.5	2022/02/11	原始取得
203	北京晶芯成	发明专利	MOM 电容器及集成电路装置	ZL202111118330.7	2022/02/11	原始取得
204	北京晶芯成	发明专利	一种用于气体分流模组的拆除治具及方法	ZL202111417349.1	2021/11/26	原始取得
205	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202111513751.X	2022/03/22	原始取得
206	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202111514590.6	2021/12/13	原始取得
207	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆检测方法及检测装置	ZL202111616331.4	2021/12/28	原始取得
208	北京晶芯成	发明专利	自动化质量管控系统、方法及计算机可读存储介质	ZL202111514086.6	2021/12/13	原始取得
209	北京晶芯成	发明专利	一种阶梯沟槽横向绝缘栅双极型晶体管结构及制造方法	ZL202111513776.X	2021/12/13	原始取得
210	北京晶芯成	发明专利	一种半导体版图	ZL20221007638	2022/01/24	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
	成、晶合集成		的监控方法及系统	5.4		
211	北京晶成、晶合集成	发明专利	一种半导体隔离结构的制造方法	ZL20221008915 6.6	2022/01/26	原始取得
212	北京晶成、晶合集成	发明专利	一种半导体结构的制作方法	ZL20221007689 3.2	2022/01/24	原始取得
213	北京晶成、晶合集成	发明专利	一种通信发射装置、系统、制造方法及电子设备	ZL20221014844 1.0	2022/02/18	原始取得
214	北京晶成、晶合集成	发明专利	半导体器件结构	ZL20221012695 3.7	2022/02/11	原始取得
215	北京晶成、晶合集成	发明专利	一种失效芯片的剥层方法	ZL20221027498 0.9	2022/03/21	原始取得
216	北京晶成、晶合集成	发明专利	一种半导体装置及其制造方法	ZL20221012345 7.6	2022/02/10	原始取得
217	北京晶成、晶合集成	发明专利	一种半导体器件及其制作方法	ZL20221029228 5.5	2022/03/24	原始取得
218	北京晶成、晶合集成	发明专利	集成器件及其制造方法	ZL20221027974 0.8	2022/03/22	原始取得
219	北京晶成、晶合集成	发明专利	半导体器件的制造方法	ZL20221029217 8.2	2022/03/24	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
	集成					
220	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	多次可编程存储器及其制备方法	ZL20221037647 6.X	2022/04/12	原始取得
221	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	半导体结构及其形成方法	ZL20221037648 6.3	2022/04/12	原始取得
222	南京晶驱	发明专利	晶圆裂片方法及其应用	ZL20201093174 0.2	2020/09/08	原始取得
223	南京晶驱	发明专利	一种检测半导体设备检测感度的方法和检测系统	ZL20201093852 6.X	2020/09/09	原始取得
224	南京晶驱	发明专利	一种光阻层阻挡能力的检测方法 及检测系统	ZL20201093776 8.7	2020/09/09	原始取得
225	南京晶驱	发明专利	一种半导体器件 制造方法	ZL20201093851 9.X	2020/09/09	原始取得
226	南京晶驱	发明专利	刻蚀方法	ZL20201099851 2.7	2020/09/22	原始取得
227	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构的 制备方法	ZL20201100577 3.0	2020/09/23	原始取得
228	南京晶驱	发明专利	一种浅沟槽结构 制备方法	ZL20201101295 9.9	2020/09/24	原始取得
229	南京晶驱	发明专利	半导体结构的制 作方法	ZL20201101343 9.X	2020/09/24	原始取得
230	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构的 制备方法	ZL20201093776 9.1	2020/09/09	原始取得
231	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构	ZL20201102179 8.X	2020/09/25	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			的制备方法			
232	南京晶驱	发明专利	一种浅沟槽隔离结构的制造方法	ZL20201101994 7.9	2020/09/25	原始取得
233	南京晶驱	发明专利	半导体结构的制造方法	ZL20201101930 2.5	2020/09/25	原始取得
234	南京晶驱	发明专利	电容器及其制备方法	ZL20201103714 3.1	2020/09/28	原始取得
235	南京晶驱	发明专利	一种静电放电防护线路	ZL20201109992 6.2	2020/10/15	原始取得
236	南京晶驱	发明专利	半导体器件的制备方法	ZL20201109352 8.X	2020/10/14	原始取得
237	南京晶驱	发明专利	一种版图边界图案的修正方法与修正系统	ZL20201109523 7.4	2020/10/14	原始取得
238	南京晶驱	发明专利	MOS 晶体管及其制造方法	ZL20201109359 9.X	2020/10/14	原始取得
239	南京晶驱	发明专利	电容的测量结构及测量方法	ZL20201109359 8.5	2020/10/14	原始取得
240	南京晶驱	发明专利	一种光刻图形的仿真方法及仿真系统	ZL20201113535 1.5	2020/10/22	原始取得
241	南京晶驱	发明专利	图形显影情况的检测方法	ZL20201118900 7.4	2020/10/30	原始取得
242	南京晶驱	发明专利	光强阈值的获取方法以及辅助图形显影情况的检测方法	ZL20201118501 8.5	2020/10/30	原始取得
243	南京晶驱	发明专利	辅助图形的添加方法、装置及测	ZL20211049263 2.4	2021/05/07	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			试版图			
244	南京晶驱	发明专利	光学临近修正方法、装置及电子设备	ZL20211075459 3.0	2021/07/05	原始取得
245	南京晶驱	发明专利	光学邻近修正模型的建模方法	ZL20211095188 8.7	2021/08/19	原始取得
246	南京晶驱	发明专利	预测图形桥联的方法、装置及电子设备	ZL20211095188 1.5	2021/08/19	原始取得
247	南京晶驱	发明专利	一种光学临近效应的修正方法及系统	ZL20211081683 0.1	2021/07/20	原始取得

4、境外专利

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
1	晶合有限	发明专利	Method for automatically controlling defect - specification in a semiconductor manufacturing process	US 6,807,454 B2	2003/03/17	继受取得	美国
2	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing semiconductor device with formation of a heavily doped region by implantation through an insulation layer	US 6,670,254 B1	2002/10/01	继受取得	美国
3	晶合有限	发明专利	Semiconductor device formed on silicon-on-insulator substrate	US 6,828,633 B2	2003/02/26	继受取得	美国
4	晶合有限	发明专利	Silicon-on-insulator device structure	US 7,019,582 B2	2004/09/29	继受取得	美国
5	晶合有限	发明专利	Method for producing a gate	US 6,699,755 B1	2003/03/24	继受取得	美国
6	晶合有限	发明专利	Half-tone phase shift mask and patterning method using thereof	US 7,461,472 B2	2003/06/16	继受取得	美国
7	晶合有限	发明专利	Method of improving a resolution of contact hole patterns by utilizing alternate phase shift principle	US 7,008,733 B2	2003/09/25	继受取得	美国
8	晶合有限	发明专利	Re-performable spin-on process	US 6,881,590 B2	2003/08/25	继受取得	美国
9	晶合有限	发明专利	Method for fabricating a through hole on a semiconductor substrate	US 6,995,086 B2	2004/06/28	继受取得	美国
10	晶合有限	发明专利	Method for forming a titanium nitride layer	US 7,030,015 B2	2004/09/16	继受取得	美国
11	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing	US 7,056,787 B2	2005/01/12	继受取得	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			semiconductor device				
12	晶合有限	发明专利	Method of forming contact hole and method of fabricating semiconductor device	US 7,098,124 B2	2005/05/31	继受取得	美国
13	晶合有限	发明专利	Semiconductor device having self-aligned contact	US 7,612,433 B2	2005/09/21	继受取得	美国
14	晶合有限	发明专利	Manufacturing method of semiconductor device having self-aligned contact	US 7,803,692 B2	2009/09/18	继受取得	美国
15	晶合有限	发明专利	Method of fabricating conductive lines with silicide layer	US 7,550,372 B2	2005/08/29	继受取得	美国
16	晶合有限	发明专利	Method for forming buried doped region	US 7,465,632 B2	2005/10/28	继受取得	美国
17	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing self-aligned contact openings	US 7,429,527 B2	2007/09/11	继受取得	美国
18	晶合有限	发明专利	Method of fabricating semiconductor device	US 7,268,055 B2	2005/11/07	继受取得	美国
19	晶合有限	发明专利	Method for manufacturing gate dielectric layer	US 7,273,787 B2	2005/11/18	继受取得	美国
20	晶合有限	发明专利	Method for forming contact window	US 8,722,538 B2	2012/09/12	继受取得	美国
21	晶合有限	发明专利	Method for manufacturing semiconductor device	US 8,822,303 B2	2012/09/15	继受取得	美国
22	晶合有限	发明专利	SPLIT-GATE NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATION METHOD THEREOF	US10,636,801 B2	2018/11/25	原始取得	美国
23	晶合有限	发明专利	METHOD OF FORMING METAL SILICIDE LAYER, SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FABRICATING	US10,490,647 B1	2018/08/31	原始取得	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			SAME				
24	晶合有限	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY CELL, ARRAY AND FABRICATION METHOD	US10,726,894 B2	2018/11/25	原始取得	美国
25	晶合有限	发明专利	SILICON ISLAND STRUCTURE AND METHOD OF FABRICATING SAME	US 10,490,441 B1	2018/10/18	原始取得	美国
26	晶合有限	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME	US 10,854,758 B2	2019/02/18	原始取得	美国
27	晶合集成	发明专利	Pre-processing method, method for forming metal silicide and semiconductor processing apparatus	US10,916,417B 2	2020/06/16	原始取得	美国
28	晶合集成	发明专利	METHOD OF FABRICATING MOSFET	US10,957,776B 2	2020/05/21	原始取得	美国
29	晶合集成	发明专利	METHOD FOR FORMING SEMICONDUCTOR STRUCTURE	US10,930,545B 2	2019/06/27	原始取得	美国
30	晶合集成	发明专利	CURRENT SOURCE USING EMITTER REGION AS BASE REGION ISOLATION STRUCTURE	US10,950,601B 2	2019/04/15	原始取得	美国
31	晶合集成	发明专利	MOSFET AND METHOD OF FABRICATING SAME	US10,971,595B 2	2018/12/17	原始取得	美国
32	晶合集成	发明专利	DIFFUSED FIELD-EFFECT TRANSISTOR AND METHOD OF FABRICATING SAME	US11,024,722B 1	2020/03/25	原始取得	美国
33	晶合集成	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING	US10,916,664B 2	2020/09/19	原始取得	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			METHOD FOR THE SAME				
34	晶合集成	发明专利	SEMICONDUCTOR STRUCTURE AND METHOD OF FORMING SAME	US11,069,559B1	2020/06/22	原始取得	美国
35	晶合集成	发明专利	METHOD FOR FABRICATING SPLIT-GATE NON-VOLATILE MEMORY	US11,088,155B2	2020/03/18	原始取得	美国
36	晶合集成	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME	US11,049,947B2	2019/11/07	原始取得	美国
37	晶合集成	发明专利	SEMICONDUCTOR STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	US11,257,668B2	2020/07/01	原始取得	美国
38	晶合集成	发明专利	WAFER ANNEALING METHOD	US11,348,781B2	2020/07/10	原始取得	美国
39	晶合集成	发明专利	以交替式相位移原理改善接触洞图案解析度之方法	I313889	2003/07/21	继受取得	中国台湾
40	晶合集成	发明专利	制作通孔的方法	I240988	2004/01/07	继受取得	中国台湾
41	晶合集成	发明专利	浅沟渠隔离结构的制造方法	I234228	2004/05/12	继受取得	中国台湾
42	晶合集成	发明专利	具有自行对准接触窗之半导体元件及其制造方法	I254409	2005/02/16	继受取得	中国台湾
43	晶合集成	发明专利	导线的制造方法	I254365	2005/01/27	继受取得	中国台湾
44	晶合集成	发明专利	自行对准接触窗开口的制作方法	I301997	2005/06/17	继受取得	中国台湾
45	晶合集成	发明专利	半导体元件及其制造方法	I267190	2005/08/29	继受取得	中国台湾
46	晶合集成	发明专利	隔离结构的制造方法	I300968	2006/06/28	继受取得	中国台湾
47	晶合集成	发明专利	光罩复验方法与系统	I305004	2006/07/17	继受取得	中国台湾
48	晶合集成	发明专利	管制规格界限之制定方法	I305838	2006/09/29	继受取得	中国台湾

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
49	晶合集成	发明专利	分离闸极快闪记忆体的故障检测方法	I301982	2006/09/28	继受取得	中国台湾
50	晶合集成	发明专利	接触窗的形成方法	I473206	2012/07/03	继受取得	中国台湾
51	晶合集成	发明专利	半导体元件的制造方法	I464831	2012/06/27	继受取得	中国台湾
52	晶合集成	发明专利	分栅式非挥发性记忆体及其制备方法	I720350	2018/10/09	原始取得	中国台湾
53	晶合集成	发明专利	预处理方法、金属硅化物的形成方法以及半导体处理装置	I739473	2020/06/11	原始取得	中国台湾
54	晶合集成	发明专利	晶圓的退火方法	I755775	2020/06/24	原始取得	中国台湾
55	晶合集成	发明专利	ラッチ回路	特许第 6761074 号	2019/05/21	原始取得	日本
56	晶合集成	发明专利	SRAM、半導体集積回路及び LCD ドライバ	特许第 6801053 号	2019/06/19	原始取得	日本
57	晶合集成	发明专利	容量性半導体素子	特许第 6831067 号	2019/04/25	原始取得	日本
58	晶合集成	发明专利	半導体素子の製造方法	特许第 6826795 号	2019/01/09	原始取得	日本
59	晶合集成	发明专利	高耐压半導体素子及びその製造方法	特许第 6892889 号	2019/04/15	原始取得	日本
60	晶合集成	发明专利	容量性半導体素子	特许第 6918173 号	2020/04/23	原始取得	日本
61	晶合集成	发明专利	半導体テスト構造	特许第 7094344 号	2020/10/27	原始取得	日本

北京市金杜律师事务所

关于

合肥晶合集成电路股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

补充法律意见书（七）

二〇二三年三月

致：合肥晶合集成电路股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已出具《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（一）》（以下简称《补充法律意见书（一）》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（二）》（以下简称《补充法律意见书（二）》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（三）》（以下简称《补充法律意见书（三）》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（四）》（以下简称《补充法律意见书（四）》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（五）》（以下简称《补充法律意见书（五）》）和《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（六）》（以下简称《补充法律意见书（六）》）。

鉴于中国证监会于2023年2月17日正式颁布《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《首发注册管理办法》，原《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》已被废止），上交所于2023年2月17日正式颁布《上海证券交易所股票发行

上市审核规则》等全面实行股票发行注册制业务规则。同时，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月1日出具了《合肥晶合集成电路股份有限公司审计报告》（容诚审字[2023]230Z0133号）（以下简称《2020-2022年审计报告》）对公司2020年度、2021年度及2022年度（以下简称报告期）财务报表进行审计，并出具了《合肥晶合集成电路股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z0277号）（以下简称《2022年12月内控报告》）。本所现根据《2020-2022年审计报告》《2022年12月内控报告》及发行人招股说明书和其他相关申报文件的修改和变动，并根据《首发注册管理办法》及其他全面实行股票发行注册制业务规则，就其中所涉及的法律问题，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对本所已出具的《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》《补充法律意见书（五）》《补充法律意见书（六）》（以下合称前期法律意见书）的补充，并构成前期法律意见书不可分割的一部分；本所在前期法律意见书中对相关用语的释义、缩写适用于本补充法律意见书；本所在前期法律意见书中发表法律意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见书。对于本补充法律意见书特别说明的事项，以本补充法律意见书的说明为准。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市制作的《招股说明书（注册稿）》中自行引用或按照中国证监会、上交所的审核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，根据有关法律、

法规和中国证监会有关规定的要求，出具补充法律意见如下：

目录

一、本次发行上市的批准和授权	6
二、发行人本次发行上市的主体资格	6
三、本次发行上市的实质条件	7
四、发行人的独立性及其变化情况	10
五、发起人和股东的变化情况	10
六、发行人的股本及其演变	27
七、发行人的业务	28
八、关联交易及同业竞争及其变化情况	29
九、发行人的主要财产及其变化情况	38
十、发行人的重大债权债务变化情况	41
十一、发行人的重大资产变化及收购兼并	45
十二、发行人公司章程的制定与修改	45
十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	45
十四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化	46
十五、发行人的税务及其变化情况	47
十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准的变化情况	48
十七、发行人的劳动与社会保障及其变化情况	50
十八、发行人募集资金的运用	52
十九、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况	52
二十、发行人《招股说明书（注册稿）》法律风险的评价	53
二十一、本次发行上市的总体结论性意见	53
附件：发行人及其子公司拥有的知识产权	55

一、 本次发行上市的批准和授权

根据发行人提供的董事会和股东大会的会议文件并经本所律师核查，2023年3月1日，发行人召开了第一届董事会第十五次会议，该次会议审议并通过了《关于继续延长合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案有效期的议案》；2023年3月16日，发行人召开了2023年第一次临时股东大会，该次股东大会审议并通过了前述延长本次发行上市方案有效期的议案。具体内容如下：

“2021年3月16日、2022年3月16日，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称‘公司’）2020年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于晶合集成电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案的议案》《关于延长合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案有效期的议案》，根据股东大会审议，本次发行方案有效期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

根据公司本次A股股票发行并上市事宜的进展，经董事会研究，拟决定将本次A股股票发行并上市方案的有效期限延长至：本议案经2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。原发行上市方案其它内容不变。”

截至本补充法律意见书出具日，发行人股东大会对本次发行上市的批准和授权仍在有效期内，发行人2020年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会通过的与发行人本次发行上市有关的各项议案仍然有效。

发行人本次发行已于2022年3月10日经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并于2022年6月20日取得中国证监会下发的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]954号）；发行人股票于上交所上市交易尚待获得上交所审核同意。

二、 发行人本次发行上市的主体资格

根据发行人工商档案资料、《营业执照》《企业信用报告》、合肥新站高新技术产业开发区市场监督管理局出具的证明，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系

统 (<http://www.gsxt.gov.cn>)，截至本补充法律意见书出具日，发行人仍为合法存续的股份有限公司，不存在根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》需要终止的情形，发行人仍具备本次发行上市的主体资格。

三、 本次发行上市的实质条件

(一) 本次发行上市符合《公司法》《证券法》的相关条件

1、根据发行人本次发行上市相关股东大会决议及发行人书面说明，发行人本次发行的股票为每股面值 1.00 元的人民币普通股股票，每股的发行条件和价格相同，每一股份具有同等权利，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事和董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

3、根据《2020-2022 年审计报告》、发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》、发行人及其境内子公司相关主管部门出具的证明及发行人书面说明，截至本补充法律意见书出具日，发行人依法存续，不存在因违法经营而被相关主管部门责令停业整顿或吊销营业执照的情形，不存在根据法律、法规及《公司章程》规定需要终止的情形。发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

4、根据《2020-2022 年审计报告》，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

5、根据发行人及其子公司所在地公安机关出具的证明、发行人控股股东填写的调查表及发行人书面说明，并经本所律师核查，发行人及其控股股东最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

(二) 本次发行上市符合《首发注册管理办法》规定的相关条件

1、如本补充法律意见书“二、发行人本次发行上市的主体资格”所述，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司；发行人已依法设立股东大会、董事会、监事会以及相关职能部门，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发注册管理办法》第十条的规定。

2、根据《2020-2022 年审计报告》《2022 年 12 月内控报告》和发行人书面说明，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具标准无保留意见的《2020-2022 年审计报告》；根据《2022 年 12 月内控报告》和发行人书面说明，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具标准无保留意见的《2022 年 12 月内控报告》，符合《首发注册管理办法》第十一条的规定。

3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

(1) 如本补充法律意见书“四、发行人的独立性及其变化情况”所述，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立；如本补充法律意见书“八、关联交易及同业竞争及其变化情况”所述，发行人与控股股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《首发注册管理办法》第十二条第（一）项之规定。

(2) 如本补充法律意见书“七、发行人的业务”所述，截至本补充法律意见书出具日，发行人的主营业务最近两年内未发生重大不利变化；如本补充法律意见书“十四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”所述，发行人的董事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内未发生重大不利变化；如本补充法律意见书“五、发起人和股东”所述，截至本补充法律意见书出具日，发行人股份权属清晰，最近两年控制权稳定、实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《首发注册管理办法》第十二条第（二）项之规定。

(3) 如本补充法律意见书“九、发行人的主要财产及其变化情况”“十、发行人的重大债权债务变化情况”及“十八、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况”所述，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担

保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《首发注册管理办法》第十二条第（三）项之规定。

4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策：

（1）如本补充法律意见书“七、发行人的业务”所述，根据工商、税务等相关政府部门出具的证明文件和发行人书面说明，经本所律师核查，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《首发注册管理办法》第十三条第一款的规定。

（2）如本补充法律意见书“十八、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况”所述，根据发行人及其子公司所在地相关政府部门出具的证明文件、发行人控股股东填写的调查表及发行人书面说明，并经本所律师核查，最近三年内，发行人及其控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《首发注册管理办法》第十三条第二款的规定。

（3）如本补充法律意见书“十八、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况”所述，根据发行人董事、监事和高级管理人员填写的调查表，经本所律师核查，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《首发注册管理办法》第十三条第三款的规定。

（三）本次发行上市符合《上市规则》规定的相关条件

1、本次发行上市符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》规定的发行条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定。

2、根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》及《招股说明书（注册稿）》，本次发行上市后股本总额不少于 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

3、根据《招股说明书（注册稿）》和本次发行上市相关股东大会决议，发行人股

本总额超过 4 亿元，本次发行完成后，发行人公开发行的股份数将达到本次发行后发行人股份总数的 10%以上，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

4、根据《2019-2022 年 6 月审计报告》、保荐机构出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司预计市值的分析报告》及发行人书面说明，发行人申请本次发行上市，预计市值不低于 30 亿元，且最近一年营业收入不低于 3 亿元，符合《上市规则》第 2.1.2 条第（四）项规定的市值和财务指标标准及第 2.1.1 条第（四）项的规定。

综上，本所律师认为，发行人仍具备本次发行上市的实质条件。

四、 发行人的独立性及其变化情况

根据发行人提供的业务合同台账、订单台账及重大业务合同、订单等相关文件资料、发行人高级管理人员填写的调查表，并经本所律师审阅发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》及《2020-2022 年审计报告》《2022 年 12 月内控报告》等书面材料，以及发行人的确认，自《补充法律意见书（六）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人业务、资产、人员、机构及财务独立性情况未发生变化，发行人资产完整且仍具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

五、 发起人和股东的变化情况

根据发行人提供的资料并经本所核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的股东变化情况如下：

1、 安华创新

根据安华创新的公司章程及工商档案并经本所律师核查，安华创新的股东结构发生变更。截至本补充法律意见书出具日，安华创新的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	国元创新投资有限公司	70,000.00	20.00
2	华安嘉业投资管理有限公司	70,000.00	20.00
3	安徽省盐业投资控股集团有限公司	40,000.00	11.43
4	安徽交控资本投资管理有限公司	40,000.00	11.43

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
5	合肥市产业投资引导基金有限公司	36,000.00	10.29
6	安徽华文创业投资管理有限公司	22,000.00	6.29
7	时代出版传媒股份有限公司	22,000.00	6.29
8	合肥高新建设投资集团公司	20,000.00	5.71
9	阜阳市颍科创新投资有限公司	20,000.00	5.71
10	安徽国控投资有限公司	10,000.00	2.86
合计		350,000.00	100.00

2、合肥晶焠

根据合肥晶焠的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶焠的合伙人结构发生变更。截至本补充法律意见书出具日，合肥晶焠的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.01	/
2	詹奕鹏	有限合伙人	450.00	14.65	副总经理
3	黎湘鄂	有限合伙人	300.00	9.77	董事长室顾问
4	简瑞荣	有限合伙人	241.00	7.85	协理
5	黎翠綾	有限合伙人	150.00	4.88	企业规划室资深处长
6	张伟瑾	有限合伙人	150.00	4.88	核心技术人员
7	林柏青	有限合伙人	150.00	4.88	N1厂长室副厂长
8	吴佳特	有限合伙人	130.00	4.23	先进整合处处长
9	谢长峯	有限合伙人	105.00	3.42	制程整合技术处副处长
10	李庆民	有限合伙人	100.00	3.26	协理
11	官佳琦	有限合伙人	100.00	3.26	品质处处长
12	方圣昌	有限合伙人	100.00	3.26	N1厂长室副厂长
13	张志宏	有限合伙人	100.00	3.26	业务副总经理技术副处长
14	柯天麒	有限合伙人	90.00	2.93	模型器件处副处长
15	刘棋彬	有限合伙人	85.00	2.77	风险管理处处长
16	陈信全	有限合伙人	80.00	2.60	技术开发一处副处长
17	江英和	有限合伙人	70.00	2.28	人力资源处代副处长
18	谢文智	有限合伙人	70.00	2.28	营运企划处副处长
19	蔡辉嘉	有限合伙人	65.00	2.12	总经理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
20	罗招龙	有限合伙人	60.00	1.95	模组开发处副处长
21	吴启熙	有限合伙人	60.00	1.95	分析及可靠性工程部部经理
22	张永忠	有限合伙人	60.00	1.95	设计服务处副处长
23	施介文	有限合伙人	60.00	1.95	N1厂长室副厂长
24	李天定	有限合伙人	50.00	1.63	经营与营运系统部部经理
25	钟青源	有限合伙人	50.00	1.63	N1厂长室副厂长
26	蔡国智	有限合伙人	50.00	1.63	董事长
27	吴文达	有限合伙人	50.00	1.63	信息服务处副处长
28	黄国助	有限合伙人	50.00	1.63	流程整合组部经理
29	朱晓娟	有限合伙人	25.00	0.81	董事、副总经理
30	施雪峯	有限合伙人	20.00	0.65	法务室副处长
合计			3,071.20	100.00	-

3、合肥晶遂

根据合肥晶遂的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶遂的合伙人结构发生变更。截至本补充法律意见书出具日，合肥晶遂的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.01	/
2	朱才伟	有限合伙人	450.00	18.14	董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理
3	朱晓娟	有限合伙人	416.10	16.77	董事、副总经理
4	周义亮	有限合伙人	380.00	15.31	副总经理
5	王兴亚	有限合伙人	125.00	5.04	财会处处长
6	方华	有限合伙人	125.00	5.04	对外事务室处长
7	王逸蓉	有限合伙人	50.00	2.02	关务部部经理
8	江英和	有限合伙人	40.00	1.61	人力资源处代副处长
9	张庆勇	有限合伙人	40.00	1.61	IP服务二组部经理
10	陈景	有限合伙人	40.00	1.61	客户工程处代副处长
11	王云直	有限合伙人	40.00	1.61	会计部部经理
12	刘桂云	有限合伙人	40.00	1.61	总务部部经理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
13	周儒领	有限合伙人	40.00	1.61	先进整合前端组部经理
14	郑晓	有限合伙人	36.00	1.45	产品工程二部部经理
15	李德龙	有限合伙人	36.00	1.45	采购一部部经理
16	曹宗野	有限合伙人	30.00	1.21	证券事务部部经理
17	喻加云	有限合伙人	25.00	1.01	税务课副理
18	张静	有限合伙人	25.00	1.01	总账课副理
19	缪凤玲	有限合伙人	24.00	0.97	代工业务三部技术副理
20	李宁	有限合伙人	24.00	0.97	薪资福利部代部经理
21	张英杰	有限合伙人	24.00	0.97	代工业务一部部经理
22	蔡国智	有限合伙人	20.00	0.81	董事长
23	赵家保	有限合伙人	20.00	0.81	关务课副理
24	肖丹	有限合伙人	20.00	0.81	业务系统组代部经理
25	杜雷	有限合伙人	20.00	0.81	光罩服务组代部经理
26	简瑞荣	有限合伙人	20.00	0.81	协理
27	束乐	有限合伙人	20.00	0.81	员工发展课副理
28	何倩倩	有限合伙人	20.00	0.81	团膳管理课副理
29	杨大桂	有限合伙人	17.00	0.69	空调课技术副理
30	杨昆	有限合伙人	16.00	0.64	平台服务课副理
31	潘坡	有限合伙人	16.00	0.64	业务支援组专案副理
32	李林	有限合伙人	16.00	0.64	设备一课技术副理
33	魏家信	有限合伙人	16.00	0.64	结构分析课副理
34	程长青	有限合伙人	16.00	0.64	量测设备课副理
35	蒲甜松	有限合伙人	16.00	0.64	核心技术二部代部经理
36	许春龙	有限合伙人	16.00	0.64	核心技术三部代部经理
37	汪小小	有限合伙人	16.00	0.64	元件开发部部经理
38	赵敬国	有限合伙人	16.00	0.64	工务管理课专案副理
39	黄皓皓	有限合伙人	16.00	0.64	储运部代部经理
40	白康茜	有限合伙人	16.00	0.64	材料二课副理
41	赵丽云	有限合伙人	16.00	0.64	出货品质保证课副理
42	唐京华	有限合伙人	16.00	0.64	电力课副理
43	李江敏	有限合伙人	16.00	0.64	稽核室专案副理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
44	张存兴	有限合伙人	16.00	0.64	经营管理组部经理
45	黄小迪	有限合伙人	13.00	0.52	整合三课技术副理
46	周俊	有限合伙人	13.00	0.52	设备二课主任工程师
47	季能	有限合伙人	12.00	0.48	经营系统课副理
48	钟胤	有限合伙人	12.00	0.48	工会事务组专案副理
49	谢文智	有限合伙人	12.00	0.48	营运企划处副处长
50	王梦曦	有限合伙人	12.00	0.48	政府事务组代部经理
合计			2,481.30	100.00	-

4、合肥晶炯

根据合肥晶炯的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶炯的合伙人结构发生变更。截至本补充法律意见书出具日，合肥晶炯的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.01	/
2	蔡国智	有限合伙人	610.90	26.04	董事长
3	蔡辉嘉	有限合伙人	510.00	22.63	总经理
4	邱显寰	有限合伙人	380.00	16.86	副总经理
5	李洳渝	有限合伙人	200.00	8.87	协理
6	黄晋德	有限合伙人	148.00	6.57	分立器件技术中心资深处长
7	林士然	有限合伙人	100.00	4.44	深圳办公室处长
8	王建智	有限合伙人	40.00	1.77	先进整合后端部部经理
9	许嘉哲	有限合伙人	36.00	1.60	分析技术部部经理
10	吴建宏	有限合伙人	30.00	1.33	微影开发部部经理
11	古哲安	有限合伙人	20.00	0.89	制程一课副理
12	田俊鹏	有限合伙人	16.00	0.71	生管二课副理
13	林政纬	有限合伙人	16.00	0.71	制程二课副理
14	柯天麒	有限合伙人	16.00	0.71	模型器件处副处长
15	蔡汉郅	有限合伙人	12.00	0.53	设备自动化课技术副理
16	邱一峯	有限合伙人	12.00	0.53	空调课技术副理

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例	在发行人处任职情况
17	郑子锋	有限合伙人	12.00	0.53	设备二课技术副理
18	毛泽民	有限合伙人	12.00	0.53	业务一课副理
19	沈俊明	有限合伙人	12.00	0.53	制程一课技术副理
20	柯孟志	有限合伙人	10.00	0.44	制造部部长
21	陈思皓	有限合伙人	10.00	0.44	缺陷改善课副理
22	简瑞荣	有限合伙人	10.00	0.44	协理
23	陈依柏	有限合伙人	8.00	0.35	故障分析课主任工程师
24	王振择	有限合伙人	8.00	0.35	制程二课技术副理
25	张琳琳	有限合伙人	5.00	0.22	逻辑四课主任工程师
26	江冬冬	有限合伙人	5.00	0.22	扩散生产课生产线主任
27	李晗飞	有限合伙人	5.00	0.22	制程二课主任工程师
28	翟伟	有限合伙人	5.00	0.22	设备三课主任工程师
29	张振华	有限合伙人	5.00	0.22	设备一课主任工程师
合计			2,254.1	100%	-

5、合肥晶珏

根据合肥晶珏的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶珏的合伙人结构发生变更。截至本补充法律意见书出具日，合肥晶珏的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.03	/
2	蔡俊郎	有限合伙人	50.00	6.70	良率提升部部长
3	梁君丽	有限合伙人	40.00	5.36	元件技术部部长
4	庄逢杰	有限合伙人	40.00	5.36	薄膜工程部部长
5	陈世昌	有限合伙人	40.00	5.36	整合支援组部长
6	苏贤钧	有限合伙人	40.00	5.36	代工业务二部部长
7	丁明邦	有限合伙人	40.00	5.36	企划部部长
8	蔡国智	有限合伙人	80.00	10.72	董事长
9	洪春田	有限合伙人	40.00	5.36	黄光工程部部长
10	何毓纬	有限合伙人	40.00	5.36	设备整合部部长
11	黄世豪	有限合伙人	36.00	4.82	安全管理二组部长
12	洪国利	有限合伙人	36.00	4.82	安全管理一部部长

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
13	谢文智	有限合伙人	20.00	2.68	营运企划处副处长
14	谢琦山	有限合伙人	20.00	2.68	扩散工程部技术副理
15	吴真良	有限合伙人	20.00	2.68	设备自动化课副理
16	董允文	有限合伙人	20.00	2.68	厂务二部技术经理
17	蔡杰良	有限合伙人	20.00	2.68	制程二课副理
18	李泽育	有限合伙人	20.00	2.68	扩散工程部部经理
19	苏智源	有限合伙人	20.00	2.68	空调课副理
20	吴耀杉	有限合伙人	20.00	2.68	故障分析课副理
21	彭昱治	有限合伙人	20.00	2.68	气体化学课副理
22	杨帛霖	有限合伙人	12.00	1.61	设备一课副理
23	林育兴	有限合伙人	12.00	1.61	洗磨生产课副理
24	黄君杰	有限合伙人	12.00	1.61	制程二课技术副理
25	詹益轩	有限合伙人	12.00	1.61	制程一课技术副理
26	彭科津	有限合伙人	12.00	1.61	设备一课技术副理
27	苏圣哲	有限合伙人	12.00	1.61	制程一课技术副理
28	周中行	有限合伙人	12.00	1.61	制程一课副理
合计			746.20	100.00	-

6、合肥晶梢

根据合肥晶梢的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶梢的合伙人结构发生变更。截至本补充法律意见书出具日，合肥晶梢的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.03	/
2	蔡国智	有限合伙人	78.00	11.24	董事长
3	杨宗凯	有限合伙人	70.00	10.08	核心技术一部部经理
4	苏深池	有限合伙人	50.00	7.20	资安室部经理
5	许宗能	有限合伙人	50.00	7.20	先进整合处代副处长
6	林士程	有限合伙人	50.00	7.20	总经理室特助
7	吴桂茶	有限合伙人	40.00	5.76	储运部副理
8	雷澔仁	有限合伙人	40.00	5.76	稽核室部经理
9	李旭昇	有限合伙人	40.00	5.76	行政与网络系统部部经理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
10	张世琛	有限合伙人	20.00	2.88	设备二课副理
11	杨安立	有限合伙人	20.00	2.88	设备一课副理
12	朱哲仪	有限合伙人	20.00	2.88	设备课副理
13	彭泽昌	有限合伙人	20.00	2.88	制程一课副理
14	丁笙玳	有限合伙人	20.00	2.88	制程一课副理
15	蔡富吉	有限合伙人	20.00	2.88	化学机械研磨工程部副理
16	陈春安	有限合伙人	20.00	2.88	设备三课副理
17	王柏翔	有限合伙人	16.00	2.30	元件分析改善课副理
18	张馨文	有限合伙人	16.00	2.30	统计制程管制课副理
19	周义亮	有限合伙人	16.00	2.30	副总经理
20	冯文辉	有限合伙人	16.00	2.30	专案课技术副理
21	邓台信	有限合伙人	12.00	1.73	设备二课副理
22	洪素真	有限合伙人	12.00	1.73	采购处技术副理
23	孙浩晏	有限合伙人	12.00	1.73	生产管理课副理
24	谢秉宏	有限合伙人	12.00	1.73	设备三课技术副理
25	黄志淦	有限合伙人	12.00	1.73	设备一课副理
26	黄志贤	有限合伙人	12.00	1.73	专案课副理
合计			694.20	100.00	-

7、合肥晶柔

根据合肥晶柔的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶柔的合伙人结构发生变更。截至本补充法律意见书出具日，合肥晶柔的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.04	/
2	YAMANAKA TOSHIAKI	有限合伙人	65.00	12.74	日本研发处处长
3	KIM KI JUN	有限合伙人	60.00	11.76	模型器件处技术副处长
4	CHOI JOBONG	有限合伙人	50.00	9.80	器件架构部部长
5	JUNG DAE SUB	有限合伙人	40.00	7.84	可靠性元件模拟课技术经理
6	MUTA TETSUYA	有限合伙人	40.00	7.84	日本研发处技术副理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
7	TAYA MASATOSHI	有限合伙人	24.00	4.70	Device课技术副理
8	KUMAGAI YASUHIRO	有限合伙人	20.00	3.92	Layout课代副理
9	张伟瑾	有限合伙人	20.00	3.92	N1厂长室厂长
10	SUGAWARA TOSHIKAZU	有限合伙人	20.00	3.92	PDK课主任工程师
11	OSAKI HIDEFUMI	有限合伙人	10.00	1.96	PDK课主任工程师
12	OTA HIROYUKI	有限合伙人	10.00	1.96	Device课主任工程师
13	鲁传润	有限合伙人	10.00	1.96	传送设备课副理
14	AOKI MIKIO	有限合伙人	10.00	1.96	PDK课代副理
15	王晓辉	有限合伙人	8.00	1.57	设备一课主任工程师
16	简瑞荣	有限合伙人	7.00	1.37	助理
17	黄晋德	有限合伙人	7.00	1.37	分立器件技术中心资 深处长
18	郑涛	有限合伙人	5.00	0.98	策略规划组主任工程 师
19	蒋丽	有限合伙人	5.00	0.98	基准情报二课主任工 程师
20	宫珊珊	有限合伙人	5.00	0.98	制程三课主任工程师
21	徐婷	有限合伙人	5.00	0.98	经营系统课主任工程 师
22	包玉威	有限合伙人	5.00	0.98	品质体系稽核课主任 工程师
23	项伟	有限合伙人	5.00	0.98	制程一课主任工程师
24	刘扬	有限合伙人	5.00	0.98	整合三课副理
25	熊小玲	有限合伙人	5.00	0.98	整合二课代副理
26	杨铿	有限合伙人	5.00	0.98	元件技术二课代副理
27	沈磊	有限合伙人	5.00	0.98	设备一课主任工程师
28	刘汗青	有限合伙人	5.00	0.98	进料品质控制课代副 理
29	王康满	有限合伙人	5.00	0.98	设备一课主任工程师
30	陈云	有限合伙人	4.00	0.78	平台服务课主任工程 师
31	徐全柱	有限合伙人	3.00	0.59	出货品质保证课技术 副理
32	曹灿	有限合伙人	3.00	0.59	设备三课主任工程师
33	金鹏	有限合伙人	3.00	0.59	元件二课主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
34	王斌	有限合伙人	3.00	0.59	制程二课工程师
35	吴章淦	有限合伙人	3.00	0.59	营运系统课主任工程师
36	童树健	有限合伙人	2.00	0.39	应急管理课主任工程师
37	王建华	有限合伙人	2.00	0.39	水处理课主任工程师
38	蔡国智	有限合伙人	23.00	4.51	董事长
39	张帅	有限合伙人	2.00	0.39	平台服务课主任工程师
40	周其灿	有限合伙人	1.00	0.20	网络系统课主任工程师
合计			510.20	100.00	-

8、合肥晶晟

根据合肥晶晟的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶晟的合伙人结构发生变更。截至本补充法律意见书出具日，合肥晶晟的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.04	/
2	谢承璋	有限合伙人	20.00	3.97	分立器件技术中心技术经理
3	林皓庭	有限合伙人	20.00	3.97	制程一课副理
4	刘棋彬	有限合伙人	20.00	3.97	风险管理处处长
5	施介文	有限合伙人	20.00	3.97	N1厂长室副厂长
6	郭琦鋈	有限合伙人	20.00	3.97	业务一课副理
7	卢俊玮	有限合伙人	20.00	3.97	制程三课副理
8	李俊嘉	有限合伙人	20.00	3.97	业务二课副理
9	张永忠	有限合伙人	20.00	3.97	设计服务处副处长
10	沈圣宗	有限合伙人	20.00	3.97	薄膜开发部部经理
11	卓俊麒	有限合伙人	20.00	3.97	电脑辅助设计部部经理
12	官建宏	有限合伙人	20.00	3.97	洗净工程部技术经理
13	张贵财	有限合伙人	16.00	3.17	设备三课技术副理
14	杨俊杰	有限合伙人	16.00	3.17	设备三课副理
15	许时斌	有限合伙人	16.00	3.17	设备二课技术副理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
16	黄晋德	有限合伙人	16.00	3.17	分立器件技术中心资深处长
17	黄铭仁	有限合伙人	16.00	3.17	系统整合课副理
18	黄彦昌	有限合伙人	16.00	3.17	安全管理课副理
19	齐志翰	有限合伙人	16.00	3.17	光罩课副理
20	陈俊宏	有限合伙人	16.00	3.17	设备三课副理
21	吴颖麒	有限合伙人	16.00	3.17	设备一课技术副理
22	陈庆鸿	有限合伙人	16.00	3.17	物管课技术副理
23	陈家宏	有限合伙人	16.00	3.17	设备三课副理
24	廖宥宏	有限合伙人	16.00	3.17	蚀刻生产课副理
25	邓元吉	有限合伙人	16.00	3.17	设备一课技术副理
26	蔡国智	有限合伙人	16.00	3.17	董事长
27	蔡承佑	有限合伙人	16.00	3.17	制程整合三部部经理
28	唐世桦	有限合伙人	16.00	3.17	消防管理课副理
29	洪佐旻	有限合伙人	16.00	3.17	设备四课技术副理
30	孙秉群	有限合伙人	12.00	2.38	设备三课技术副理
合计			504.20	100.00	-

9、合肥晶洛

根据合肥晶洛的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶洛的合伙人结构发生变更。截至本补充法律意见书出具日，合肥晶洛的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.06	/
2	张艳	有限合伙人	8.00	2.32	设备一课技术副理
3	申政	有限合伙人	8.00	2.32	自动化系统课技术副理
4	张晓亮	有限合伙人	8.00	2.32	制程二课技术副理
5	吴杰	有限合伙人	8.00	2.32	供应商管理课副理
6	甄福强	有限合伙人	8.00	2.32	制程二课副理
7	王茹	有限合伙人	8.00	2.32	基准情报二课副理
8	李波	有限合伙人	8.00	2.32	设备一课技术副理
9	朱晓娟	有限合伙人	8.00	2.32	董事、副总经理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
10	余建军	有限合伙人	8.00	2.32	技术二课技术副理
11	罗贤福	有限合伙人	8.00	2.32	设备一课副理
12	索圣涛	有限合伙人	8.00	2.32	制程二课技术副理
13	冯玲	有限合伙人	8.00	2.32	IP服务一组技术副理
14	张庆楼	有限合伙人	8.00	2.32	设备一课主任工程师
15	杨翼虎	有限合伙人	8.00	2.32	设备整合部技术副理
16	周高	有限合伙人	8.00	2.32	制程二课技术副理
17	陈红军	有限合伙人	8.00	2.32	可靠性工程课主任工程师
18	李加龙	有限合伙人	8.00	2.32	气体化学课技术副理
19	陈诚	有限合伙人	8.00	2.32	电力课主任工程师
20	李翔	有限合伙人	8.00	2.32	传送设备课主任工程师
21	戴东正	有限合伙人	8.00	2.32	传送设备课技术副理
22	王阳阳	有限合伙人	8.00	2.32	PDK二课代副理
23	胡勤	有限合伙人	8.00	2.32	设备信息课技术副理
24	蒋栋梁	有限合伙人	8.00	2.32	气体化学课主任工程师
25	章淑媛	有限合伙人	8.00	2.32	工程信息课技术副理
26	耿辉	有限合伙人	8.00	2.32	电力课主任工程师
27	田园	有限合伙人	8.00	2.32	专案课主任工程师
28	陈炜	有限合伙人	8.00	2.32	客户品质服务课技术副理
29	丁贤林	有限合伙人	8.00	2.32	逻辑一课副理
30	郑璐	有限合伙人	8.00	2.32	品质体系稽核课主任工程师
31	马杰	有限合伙人	8.00	2.32	水处理课主任工程师
32	葛杨	有限合伙人	8.00	2.32	系统整合课技术副理
33	贺勇	有限合伙人	8.00	2.32	设备二课技术副理
34	葛成海	有限合伙人	7.00	2.03	逻辑二课副理
35	田文星	有限合伙人	7.00	2.03	可靠性工程课副理
36	雷明芹	有限合伙人	7.00	2.03	保健课代副理
37	杨黎	有限合伙人	5.00	1.45	业务二课主任工程师
38	李冉	有限合伙人	5.00	1.45	流程整合组技术副理
39	张亚南	有限合伙人	5.00	1.45	制造信息课技术副理
40	陶磊	有限合伙人	5.00	1.45	制程一课主任工程师
41	李晓刚	有限合伙人	5.00	1.45	制造信息课主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
42	李丽鲜	有限合伙人	5.00	1.45	故障分析课主任工程师
43	程挚	有限合伙人	5.00	1.45	制程三课主任工程师
44	陈宗义	有限合伙人	5.00	1.45	先进整合前端组主任工程师
45	崔一丁	有限合伙人	5.00	1.45	调研一课主任工程师
46	殷赛赛	有限合伙人	5.00	1.45	量测设备课主任工程师
47	薛君	有限合伙人	5.00	1.45	量测设备课主任工程师
48	李可玉	有限合伙人	5.00	1.45	光学模型组主任工程师
49	赵伟	有限合伙人	5.00	1.45	设备信息课主任工程师
50	李文庆	有限合伙人	2.00	0.58	客户品质服务课副理
合计			344.20	100.00	——

10、合肥晶辽

根据合肥晶辽的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶辽的合伙人结构发生变更。截至本补充法律意见书出具日，合肥晶辽的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.07	/
2	周义亮	有限合伙人	12.00	4.08	副总经理
3	许凯迪	有限合伙人	12.00	4.08	自动化系统课副理
4	林胜雄	有限合伙人	12.00	4.08	水处理课副理
5	刘志铭	有限合伙人	12.00	4.08	系统整合课副理
6	钟尚仁	有限合伙人	12.00	4.08	气体化学课技术副理
7	黄晋德	有限合伙人	12.00	4.08	分立器件技术中心资深处长
8	翁文杰	有限合伙人	12.00	4.08	制程二课技术副理
9	邱显寰	有限合伙人	12.00	4.08	副总经理
10	蔡辉堂	有限合伙人	12.00	4.08	layout课副理
11	王曼真	有限合伙人	12.00	4.08	制程三课副理
12	吴德刚	有限合伙人	10.00	3.40	工业工程三课副理
13	林宗晔	有限合伙人	10.00	3.40	设备信息课副理
14	何瑞凤	有限合伙人	10.00	3.40	基准情报一课副理
15	蔡孟孺	有限合伙人	10.00	3.40	代工业务三部技术经理
16	简瑞荣	有限合伙人	10.00	3.40	协理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
17	张家玮	有限合伙人	8.00	2.72	逻辑四课主任工程师
18	黄绍铭	有限合伙人	8.00	2.72	制程一课技术副理
19	黄任逢	有限合伙人	8.00	2.72	设备一课主任工程师
20	林宏展	有限合伙人	8.00	2.72	设备三课技术副理
21	张建烜	有限合伙人	8.00	2.72	空调课技术副理
22	刘铭哲	有限合伙人	8.00	2.72	设备三课技术副理
23	林子荏	有限合伙人	8.00	2.72	制程四课副理
24	丘卓册	有限合伙人	8.00	2.72	空调课主任工程师
25	张伟瑾	有限合伙人	8.00	2.72	N1厂厂长
26	江承达	有限合伙人	8.00	2.72	制程二课主任工程师
27	蔡志宏	有限合伙人	8.00	2.72	安环体系课副理
28	刘凯文	有限合伙人	8.00	2.72	制程二课技术副理
29	蔡明洋	有限合伙人	8.00	2.72	制程二课副理
30	蔡国智	有限合伙人	20.00	6.80	董事长
合计			294.20	100.00	-

11、合肥晶确

根据合肥晶确的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶确的合伙人结构发生变更。截至本补充法律意见书出具日，合肥晶确的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.08	/
2	简瑞荣	有限合伙人	15.00	6.12	助理
3	刘云	有限合伙人	5.00	2.04	洁净及化学分析课主任工程师
4	冉薇	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
5	龚睿	有限合伙人	5.00	2.04	自动化系统课主任工程师
6	夏飞	有限合伙人	5.00	2.04	电力课主任工程师
7	王超	有限合伙人	5.00	2.04	分析技术部主任工程师
8	蔡国智	有限合伙人	5.00	2.04	董事长
9	李晶	有限合伙人	5.00	2.04	空调课主任工程师
10	苏翔	有限合伙人	5.00	2.04	水处理课主任工程师
11	王伟	有限合伙人	5.00	2.04	气体化学课主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
12	李伟	有限合伙人	5.00	2.04	气体化学课主任工程师
13	高玉春	有限合伙人	5.00	2.04	设备自动化课主任工程师
14	吴曦	有限合伙人	5.00	2.04	空调课主任工程师
15	张悦	有限合伙人	5.00	2.04	结构分析课主任工程师
16	李克飞	有限合伙人	5.00	2.04	逻辑二课主任工程师
17	李建	有限合伙人	5.00	2.04	空调课主任工程师
18	章昭	有限合伙人	5.00	2.04	气体化学课主任工程师
19	余学会	有限合伙人	5.00	2.04	洁净及化学分析课主任工程师
20	何震	有限合伙人	5.00	2.04	洁净及化学分析课主任工程师
21	梁锐	有限合伙人	5.00	2.04	电力课主任工程师
22	何春龙	有限合伙人	5.00	2.04	空调课主任工程师
23	陈晓红	有限合伙人	5.00	2.04	制程三课主任工程师
24	马统越	有限合伙人	5.00	2.04	气体化学课主任工程师
25	于心礼	有限合伙人	5.00	2.04	传送设备课主任工程师
26	李左军	有限合伙人	5.00	2.04	传送设备课主任工程师
27	丁佳佳	有限合伙人	5.00	2.04	传送设备课主任工程师
28	王永辉	有限合伙人	5.00	2.04	设备四课主任工程师
29	谢泉	有限合伙人	5.00	2.04	设备三课主任工程师
30	李文庆	有限合伙人	5.00	2.04	专案课技术副理
31	陆瑞	有限合伙人	5.00	2.04	水处理课主任工程师
32	潘雨	有限合伙人	5.00	2.04	水处理课技术副理
33	张雷	有限合伙人	5.00	2.04	洁净及化学分析课主任工程师
34	范圣罗	有限合伙人	5.00	2.04	传送设备课主任工程师
35	夏晶京	有限合伙人	5.00	2.04	电力课主任工程师
36	夏炎照	有限合伙人	5.00	2.04	电力课主任工程师
37	顾亚秋	有限合伙人	5.00	2.04	电力课主任工程师
38	张克磊	有限合伙人	5.00	2.04	气体化学课主任工程师
39	赵琼	有限合伙人	5.00	2.04	设备整合部主任工程师
40	祖文秀	有限合伙人	5.00	2.04	大数据分析课主任工程师
41	钱发	有限合伙人	5.00	2.04	电力课主任工程师
42	王翠	有限合伙人	5.00	2.04	结构分析课主任工程师
43	汪雪春	有限合伙人	5.00	2.04	整合二课代副理

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
44	程奎	有限合伙人	5.00	2.04	系统整合课主任工程师
45	韦彬	有限合伙人	5.00	2.04	传送设备课主任工程师
46	蒋磊	有限合伙人	5.00	2.04	制程二课主任工程师
47	李贵徽	有限合伙人	5.00	2.04	设备三课主任工程师
48	万焜	有限合伙人	5.00	2.04	自动化系统课主任工程师
合计			245.20	100.00	-

12、合肥晶妥

根据合肥晶妥的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶妥的合伙人结构发生变更。截至本补充法律意见书出具日，合肥晶妥的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.08	/
2	黄晋德	有限合伙人	15.00	6.24	分立器件技术中心资深处长
3	黎翠綾	有限合伙人	5.00	2.08	企业规划室资深处长
4	谢烈翔	有限合伙人	5.00	2.08	逻辑三课代副理
5	刘利娟	有限合伙人	5.00	2.08	异常管理课主任工程师
6	孙航海	有限合伙人	5.00	2.08	设备信息课主任工程师
7	柯焱	有限合伙人	5.00	2.08	制程一课主任工程师
8	邱显寰	有限合伙人	5.00	2.08	副总经理
9	马忠祥	有限合伙人	5.00	2.08	逻辑一课副理
10	丁璇璇	有限合伙人	5.00	2.08	行政与网络系统部技术副理
11	吴俊	有限合伙人	5.00	2.08	行政系统课主任工程师
12	张静	有限合伙人	5.00	2.08	整合一课代副理
13	侯丹丹	有限合伙人	5.00	2.08	变更管理课主任工程师
14	程洋	有限合伙人	5.00	2.08	技术二课副理
15	郝利兰	有限合伙人	5.00	2.08	制程二课副理
16	王丽雅	有限合伙人	5.00	2.08	失效分析课代副理
17	张永仓	有限合伙人	5.00	2.08	专案课副代理
18	许飞	有限合伙人	5.00	2.08	技术一课主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
19	俞佩佩	有限合伙人	5.00	2.08	失效分析课主任工程师
20	周芹芹	有限合伙人	5.00	2.08	营运系统课主任工程师
21	陈国彬	有限合伙人	5.00	2.08	异常管理课代副理
22	张国庆	有限合伙人	5.00	2.08	设备一课主任工程师
23	叶秀平	有限合伙人	5.00	2.08	总经理室主任管理师
24	颜传奇	有限合伙人	5.00	2.08	安全管理二组主任工程师
25	谭倩倩	有限合伙人	5.00	2.08	营运系统课主任工程师
26	蔡国智	有限合伙人	5.00	2.08	董事长
27	马婷	有限合伙人	5.00	2.08	元件二课副理
28	高创	有限合伙人	5.00	2.08	制程二课主任工程师
29	李磊	有限合伙人	5.00	2.08	安全管理二组主任工程师
30	目晶晶	有限合伙人	5.00	2.08	可靠性工程课主任工程师
31	葛祥福	有限合伙人	5.00	2.08	变更管理课主任工程师
32	葛键	有限合伙人	5.00	2.08	流程整合组主任工程师
33	王博	有限合伙人	5.00	2.08	出货品质保证课主任工程师
34	操梦雅	有限合伙人	5.00	2.08	整合二课代副理
35	吕玉波	有限合伙人	5.00	2.08	供应商管理课主任工程师
36	崔洁	有限合伙人	5.00	2.08	平台服务课主任工程师
37	宋明明	有限合伙人	5.00	2.08	逻辑三课代副理
38	朱晓娟	有限合伙人	5.00	2.08	董事、副总经理
39	郑鹏	有限合伙人	5.00	2.08	设备二课主任工程师
40	王云龙	有限合伙人	5.00	2.08	消防管理课主任工程师
41	孟娟	有限合伙人	5.00	2.08	技术一课代副理
42	马成	有限合伙人	5.00	2.08	经营管理组主任工程师
43	彭涛	有限合伙人	5.00	2.08	工业工程三课主任工程师
44	张东杰	有限合伙人	5.00	2.08	设备信息课主任工程师
45	韩小琴	有限合伙人	5.00	2.08	制程一课主任工程师
46	徐恩杰	有限合伙人	5.00	2.08	网络系统课主任工程师
47	曹文强	有限合伙人	5.00	2.08	经营系统课主任工程师
合计			240.20	100.00	-

13、合肥晶雄

根据合肥晶雄的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶雄的合伙人结构发生变更。截至本补充法律意见书出具日，合肥晶雄的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.13	/
2	黄南翔	有限合伙人	36.00	23.97	生管物管部部长
3	陈文璟	有限合伙人	20.00	13.32	制程整合一部部长
4	李维泽	有限合伙人	12.00	7.99	制程一课副理
5	简瑞荣	有限合伙人	10.00	6.66	助理
6	蔡君正	有限合伙人	8.00	5.33	先进整合前端组技术副理
7	陈欣蕙	有限合伙人	8.00	5.33	元件一课技术副理
8	罗招龙	有限合伙人	6.00	3.99	模组开发处副处长
9	邱显寰	有限合伙人	6.00	3.99	副总经理
10	郑淙徽	有限合伙人	5.00	3.33	量测设备课主任工程师
11	姚怡雯	有限合伙人	5.00	3.33	整合四部一课代副理
12	陈俊雄	有限合伙人	5.00	3.33	统计设备管制课副理
13	谢文智	有限合伙人	5.00	3.33	营运企划处副处长
14	林岳煌	有限合伙人	5.00	3.33	扩散生产课主任工程师
15	葛年翔	有限合伙人	5.00	3.33	制程二课主任工程师
16	李奇威	有限合伙人	5.00	3.33	薄膜生产课生产线主任
17	蔡国智	有限合伙人	5.00	3.33	董事长
18	黄晋德	有限合伙人	3.00	2.00	分立器件技术中心资深处长
19	郭千琦	有限合伙人	1.00	0.67	模型器件一课副理
合计			150.20	100.00	-

根据发行人的股东名册、发行人的确认，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，除上述变化外，发行人的股东未发生其他变化。

本所律师认为，发行人的股东人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

六、 发行人的股本及其演变

根据发行人提供的股东名册、本所律师对发行人股东的补充问卷调查、发行人的

工商档案、《公司章程》及发行人确认，并经本所律师核查，自《补充法律意见书（六）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人的股份结构未发生变化。

根据发行人股东的补充问卷调查确认、发行人说明，并经本所律师检索国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），截至本补充法律意见书出具日，发行人股东所持发行人的股份未设置质押。

七、 发行人的业务

（一）经营范围和经营方式

根据发行人持有的《营业执照》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），自《补充法律意见书（六）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人的经营方式和经营范围未发生变化。

发行人境内子公司情况详见前期法律意见书及本补充法律意见书“九、发行人的主要财产及其变化情况”之“发行人的子公司”。

根据发行人及其子公司所在地工商、税务等相关政府部门出具的证明文件，并经本所律师核查，本所律师认为，发行人及其子公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规的规定，已经取得经营所需的相关业务资质及许可。

（二）境外业务

根据《2020-2022 年审计报告》、发行人提供的工商资料及书面确认并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人拥有 1 家境外子公司（日本晶合），主要从事集成电路设计服务及技术开发。发行人境外子公司的具体情况详见前期法律意见书。

（三）发行人的主营业务

根据《招股说明书（注册稿）》《2020-2022 年审计报告》，截至本补充法律意见书出具日，发行人主要从事 12 英寸晶圆代工业务。发行人的主营业务未发生变化。

（四）主要业务资质和许可

经本所律师核查，2022年7月1日至2022年12月31日期间，发行人及其子公司不存在新取得的主要经营资质证书。

(五) 发行人的持续经营能力

根据发行人最新的《营业执照》《2020-2022年审计报告》及发行人确认，并经本所核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人依法存续，发行人的主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情况，不存在影响其持续经营的法律障碍。

(六) 发行人合作研发的相关情况

根据发行人与相关合作方签订的协议和发行人书面说明，2022年7月1日至2022年12月31日期间，发行人正在从事的合作研发项目情况未发生变化。

八、 关联交易及同业竞争及其变化情况

(一) 关联方

根据《公司法》《上市规则》《企业会计准则第36号—关联方披露》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，并经本所律师核查，2022年7月1日至2022年12月31日期间，发行人的主要关联方变化如下：

1、 发行人的控股股东、实际控制人

截至2022年12月31日，发行人的控股股东仍为合肥建投，实际控制人仍为合肥市国资委，未发生变化。

2、 发行人的控股股东直接或间接控制的其他企业的变化情况

发行人控股股东合肥建投直接或间接控制的其他企业为发行人的关联方。截至2022年12月31日，发行人控股股东控制的其他主要企业新增情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业 (有限合伙)	合肥建投控制

3、 发行人的控股子公司的变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人控股子公司仍为 4 家，未发生变化。

4、 发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员的变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人的董事、监事、高级管理人员未发生变化，发行人董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员为公司的关联方。

5、 发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者由前述人员（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织的变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织新增情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	合肥市电动汽车充电设施运营有限公司	杨国庆担任董事

6、 直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织的变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织未发生变化。

7、 直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织的变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织新增情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	飞圣航空股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
2	瑞相科技股份有限公司	力晶科技直接或间接控制

8、 直接控制上市公司的法人的董事、监事、高级管理人员及其控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织的变化情况

(1) 直接控制发行人的法人的董事、监事、高级管理人员的变化情况

直接控制发行人的法人为合肥建投，截至 2022 年 12 月 31 日，合肥建投的董事、监事、高级管理人员名单如下：

序号	关联方姓名	关联关系说明
1	李宏卓	合肥建投董事长
2	陈小蓓	董事兼副总经理兼董事会秘书
3	陆勤航	合肥建投董事兼总经理
4	杨雪蕾	合肥建投董事兼副总经理
5	刘国恺	合肥建投董事
6	苏孙铭	合肥建投董事
7	许一云	合肥建投董事
8	毕功兵	合肥建投董事
9	王志银	合肥建投监事
10	王郑	合肥建投监事
11	郭兆志	合肥建投监事
12	杨国庆	合肥建投监事
13	范红金	合肥建投监事
14	吴子能	合肥建投副总经理
15	罗文萍	合肥建投总会计师
16	嵇小玲	合肥建投副总经理

(2) 前述关联自然人直接或者间接控制的法人或其他组织的变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，前述关联自然人中，控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织新增 16 家，相关情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	合肥市交通控股有限公司	苏孙铭担任董事
2	安徽睿正律师事务所	许一云控制
3	合肥鼓楼商厦有限责任公司	郭兆志担任董事
4	安徽中安智通科技股份有限公司	郭兆志担任董事
5	百货大楼商业大厦有限公司	郭兆志担任董事

序号	关联方名称	关联关系说明
6	合肥科融高科技产业投资有限公司	郭兆志担任执行董事、总经理
7	合肥德电新能源汽车股份有限公司	郭兆志担任董事
8	安徽六方深冷股份有限公司	郭兆志担任董事
9	合肥建翔投资有限公司	郭兆志担任董事长、总经理
10	合肥水务环境建设投资有限公司	郭兆志担任董事
11	合肥蓝科投资有限公司	郭兆志担任董事
12	合肥金太阳能源科技股份有限公司	郭兆志担任董事
13	合肥市勘察院有限责任公司	郭兆志担任董事
14	中煤新集合肥发电有限公司	郭兆志担任董事
15	合安高铁股份有限公司	嵇小玲担任董事
16	辰安天泽智联技术有限公司	嵇小玲担任董事

9、其他关联方

除上述关联方外，发行人的其他关联方还包括其他根据《上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定认定的关联方。

10、关联方信息披露

根据发行人的书面说明，并经本所律师核查，发行人已在《招股说明书（注册稿）》中按照《公司法》《企业会计准则》和中国证监会的相关规定认定并披露关联方。

11、注销或转让重要关联方

根据发行人控股股东填写的调查表和发行人的书面说明，并经本所律师核查，报告期内，发行人不存在注销或转让的子公司，亦不存在与发行人存在关联交易的关联方注销或转让的情形。

(二) 关联交易

根据《招股说明书（注册稿）》《2020-2022 年审计报告》和发行人书面说明，并经本所律师核查，2022 年度，发行人与关联方发生的关联交易情况如下：

1、向关联方采购商品及接受服务

2022 年度，发行人向关联方采购商品及接受服务的相关情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年度	
		金额	占当期营业成本的比例
合肥燃气	采购货物	1,295.01	0.24%
合肥供水	采购货物	1,294.45	0.24%
智成电子	采购服务	1,615.82	0.30%
合肥租赁	房屋租赁及代缴水电费	15.32	0.00%
关联采购合计		4,220.60	0.78%

2022 年度，发行人向合肥供水、合肥燃气采购厂区用水、燃气的价格与合肥供水、合肥燃气向第三方销售的价格一致；发行人向智成电子采购服务为授权许可知识产权（IP），双方定价模式与发行人与其他同类供应商的定价模式一致，且价格处于同类供应商报价范围区间内；发行人向合肥租赁进行租赁房屋的价格按照市场价格确定；2022 年 4 月 27 日，发行人与合肥租赁签订了《关于预存水、电缴纳结算协议》，根据协议约定，为保证智能水电表正常使用，发行人预存水电费至合肥租赁账户中，并在合肥租赁每月扣款后，于月底前将上述款项再次充值至指定账户。

2022 年度，发行人向智成电子采购服务相关交易主要系发行人向智成电子采购 IP 授权的费用。采购价格系遵循市场化交易原则，双方协商确定，采购价格具备公允性。

综上，本所认为，发行人与关联方之间的上述关联交易价格公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

2、向关联方销售商品及提供服务

2022 年度，发行人向关联方销售商品及提供服务的相关情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年度	
		金额	占当期营业收入的比例

关联方	关联交易内容	2022 年度	
		金额	占当期营业收入的比例
晶相光电股份有限公司	销售商品	6.54	0.00%
关联销售合计		6.54	0.00%

3、关联租赁

发行人因经营需要向关联方合肥蓝科租赁土地、厂房及厂务设施，均位于安徽省合肥市瑶海区综合保税区内西淝河路 88 号，为发行人的注册地及主要办公场所。

(1) 与合肥蓝科的租赁

2022 年度，发行人与土地、厂房及配套厂务设备相关的租赁负债增减变动情况如下：

单位：万元

关联方	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
合肥蓝科	346,449.02	-	25,523.75	320,925.27

本所认为，合肥蓝科系依据合肥市人民政府相关政策向公司出租厂房，租赁价格虽低于市场价格，但公司已按照相应会计准则进行会计处理，该等关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

(2) 与合肥租赁的租赁

2022 年度，发行人与合肥租赁签订房屋租赁合同，相关的租赁负债增减变动情况如下：

单位：万元

关联方	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
合肥租赁	-	480.06	425.88	54.18

4、关联担保情况

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人接受关联方担保的情况如下：

单位：万元

担保方	出借人	借款余额（含一年内到期的长期借款）	借款日期	到期日	担保是否已经履行完毕	是否提供反担保
合肥建投	华泰资产	130,000.00	2018/9/28	2028/9/27	否	是
		30,000.00	2018/10/30	2028/10/29	否	是
		42,000.00	2018/11/8	2028/11/7	否	是
		90,000.00	2019/7/18	2029/7/17	否	是
		8,000.00	2019/8/29	2029/8/28	否	是
	平安银行合肥分行	62,080.00	借款发放日	2027/10/10	否	是
	兴业银行合肥分行	15,125.40	借款发放日	2028/1/7	否	是
		39,000.00	借款发放日	2027/10/10	否	是
	中国银行庐阳支行 ¹	65,397.83	借款发放日	2028/1/15	否	是
		18,292.69	2021/3/19	2027/10/10	否	是

2022 年 1 月 19 日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司对发行人所有的海关监管期限届满的部分机器设备办理了抵押登记，已办理抵押登记的机器设备于 2022 年 12 月 31 日的账面原值、累计折旧及账面价值如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
机器设备	443,871.50	210,391.12	233,480.38

5、关联方资金拆借

2022 年度，发行人未发生与关联方资金拆借的情形。

6、关键管理人员薪酬

2022 年度，发行人向关键管理人员支付薪酬，关联交易金额为 3,631.83 万元。

7、受让关联方银行存单

¹ 中国银行合肥北城支行现已更名为中国银行合肥庐阳支行。

2022年8月29日，发行人与合肥融科项目投资有限公司签订了3份《徽商银行单位大额存单产品转让协议》，约定发行人按照商定的转让价格受让合肥融科项目投资有限公司持有的3份产品徽商银行股份有限公司单位大额存单，并委托徽商银行合肥蜀山支行办理相关转让事宜，转让信息具体如下：

单位：万元

产品名称	产品本金	转让价格
徽商银行股份有限公司单位大额存单	10,000.00	10,016.26
徽商银行股份有限公司单位大额存单	10,000.00	10,016.26
徽商银行股份有限公司单位大额存单	10,000.00	10,016.26

2022年12月26日，发行人与合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）签订了2份《徽商银行单位大额存单产品转让协议》，约定发行人按照商定的转让价格受让合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）持有的2份产品徽商银行股份有限公司单位大额存单，并委托徽商银行合肥蜀山支行办理相关转让事宜，转让信息具体如下：

单位：万元

产品名称	产品本金	转让价格
徽商银行股份有限公司单位大额存单	10,000.00	10,017.82
徽商银行股份有限公司单位大额存单	5,000.00	5,008.91

8、关联方往来余额

（1）应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2022年12月31日	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	邱显寰	2.68	-
其他应收款	詹奕鹏	2.02	-
其他应收款	简瑞荣	3.24	-
其他应收款	合肥燃气	72.00	-

项目名称	关联方	2022年12月31日	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	合肥租赁	152.70	-

(2) 应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2022年12月31日
其他应付款	蔡辉嘉	1.34
其他应付款	合肥蓝科	63.67
应付账款	合肥燃气	105.69
应付账款	智成电子	688.78
应付账款	合肥租赁	2.40
合同负债	晶相光电股份有限公司	1,994.26
租赁负债	合肥蓝科	320,925.27
租赁负债	合肥租赁	54.18

注：上表中其他应付个人款项主要为员工报销款；合肥蓝科租赁负债系发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套厂务设备形成，具体情况详见本补充法律意见书之“九、关联交易及同业竞争及其变化情况”之“（二）关联交易”之“3、关联租赁”。对晶相光电股份有限公司的其他应付款系发行人收到的晶相光电股份有限公司的产能保证金，根据双方2022年度签署的补充协议，晶相光电股份有限公司的产能保证金可用于抵扣货款，发行人于2022年末将其确认为合同负债。

发行人于2022年6月30日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联股东在股东大会审议该等议案时回避表决。

根据《2020-2022年审计报告》、发行人相关会议资料、发行人的书面说明，并经本所律师核查，上述报告期内发生的发行人关联方与发行人所发生的关联交易，交易价格及条件均符合公允原则，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

(三) 同业竞争

截至本补充法律意见书出具日，发行人从事12英寸晶圆代工业务。根据合肥建投提供的对外投资企业清单并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统、天眼查网站等方式进行核查，合肥建投除投资发行人外，未控制其他从事晶圆代工业务的公司，合肥建投及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争。

(四) 发行人对关联交易和同业竞争事项的披露

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人已在《招股说明书（注册稿）》中对有关减少和规范关联交易的措施及避免同业竞争的承诺进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

九、发行人的主要财产及其变化情况

（一）土地使用权和房屋所有权变化情况

1、自有物业

截至本补充法律意见书出具日期间，发行人无自有物业。

2、租赁物业

经发行人确认并经本所律师核查发行人及其子公司的租赁协议及租赁物业产权证明，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司承租用于办公、生产经营的房产共计 4 处，面积合计约 215,785.43 平方米，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积 (m ²)	租赁期限	用途
1	晶合集成	合肥蓝科	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号	215,270.61	2017 年 6 月 28 日至 2037 年 6 月 27 日	生产办公
2	上海晶合	上海莘泽创业投资管理股份有限公司	上海市浦东新区区盛夏路 608 号 3 幢 5 层 502 室	141.15	2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日	办公
3	日本晶合	マスター・プロパティーズ株式会社	東京都立川市曙町一丁目 13 番 11 号	242.71	2021 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日	办公
4	晶合集成	深圳市唐庄实业有限公司	深圳市福田区深南西路车公庙工业区	130.96	2021 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日	办公

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人不存在租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产的情形。

（二）在建工程

根据《2020-2022 年审计报告》《招股说明书（注册稿）》以及发行人书面说明，截至本补充法律意见出具日，发行人的在建工程主要为公司新购置待安装机台设备。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人在建工程的账面余额为 138,504.36 万元。

（三）商标、专利等无形资产变化情况

1、注册商标

根据发行人提供的《商标注册证》、商标注册代理机构出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于中国境外注册商标相关事宜的确认函》、国家知识产权局出具的《商标初步审定公告》，并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司共拥有 126 项注册商标，其中，在中国境内注册的商标 35 项，在中国境外注册的商标 91 项，该等商标的具体情况详见本补充法律意见书附件。

2、注册专利

根据发行人提供的专利证书等相关文件、专利注册代理机构出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于中国境外注册专利相关事宜的确认函》、国家知识产权局查询结果并查询国家知识产权局综合服务平台专利检索及分析系统（<http://pss-system.cnipa.gov.cn>），并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司在中国境内共拥有 349 项已授权专利，在中国境外共拥有 67 项已授权专利。该等专利注册的具体情况详见本补充法律意见附件。

3、互联网域名

截至 2022 年 12 月 31 日，根据发行人提供的域名证书，并经本所律师核查工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统（<http://beian.miit.gov.cn>），发行人及其子公司拥有的域名情况没有发生变化。

4、发行人使用的授权许可知识产权（IP）

截至 2022 年 12 月 31 日，公司正在使用的授权许可知识产权（IP）情况如下：

序号	合同相对方	授权内容	合同金额或定价依据	有效期限
1	美商矽成积体电路股份有限公司	110纳米嵌入式闪存技术	开发服务费、权利金	最晚至2025/01/30
2	円星科技股份有限公司	90纳米编译器IP、150纳米标准单元库、90纳米编译器IP、150纳米编译器IP	开发服务费、权利金	最晚至2032/10/15
3	力旺电子股份有限公司	单次可编程IP、单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费、权利金等	最晚至2027/10/16
4	智成电子股份有限公司	110纳米标准单元库	量产权利金	最晚至2027/12/31
5	寅通科技股份有限公司	80、90、110、55纳米集成电路IP	技术开发费、量产权利金、开发及授权服务费	最晚至2027/09/14
6	亿而得微电子股份有限公司	多次可编程电路模块、集成电路模块	产品开发费用、权利金或权利金	最晚至2027/01/20
7	成都锐成芯微科技股份有限公司	110纳米低功耗嵌入式存储工艺平台模拟IP、110纳米多次可编程电路 90纳米多晶硅熔丝IP 150纳米多晶硅熔丝IP、55纳米多晶硅熔丝IP、55纳米多次可编程电路	技术秘密使用费，并根据实际发生金额结算、支付版税费用或支付版税费用或产品开发费用及权利金	最晚至2032/11/24
8	珠海创飞芯科技有限公司	110、90纳米单次可编程（反熔丝）技术、55纳米单次可编程（反熔丝）技术、40纳米单次可编程（反熔丝）技术	授权产品的使用提成费用、产品开发费用	2021/06/01起至达成新协议前永久有效或最晚至2027/08/14
9	IMEC VZW	28纳米集成电路IP	分期支付使用费	2021/12/24-2023/06/23
10	南京华大九天科技有限公司	40纳米集成电路IP	产品开发费用、权利金	最晚至2032/11/24
11	Synopsys Inc.	28纳米集成电路IP	产品开发费用、权利金	2022/4/17-永久有效或最晚至2027/07/26
12	芯耀辉科技有	28纳米集成电路IP	产品开发费用	2022/11/29-永久有

序号	合同相对方	授权内容	合同金额或定价依据	有效期限
	限公司			效
13	ARM WESTERN TECHNOLOGY RESEARCH DEVELOPMENT CO.,LTD	28纳米集成电路IP	产品开发费用	2022/12/16-2027/12/15
14	苏州腾芯微电子有限公司	110纳米集成电路IP	权利金	2022/5/20-2032/5/20

(四) 主要生产经营设备

根据《2020-2022 年审计报告》《招股说明书（注册稿）》、重大生产经营设备的购置合同、履行凭证及发行人说明，发行人的主要生产经营设备包括机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等。截至 2022 年 12 月 31 日，机器设备的账面价值为 2,126,441.03 万元、电子设备及其他的账面价值为 13,393.57 万元、房屋及建筑物的账面价值为 3,902.22 万元。

(五) 发行人的子公司

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自《补充法律意见书（六）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人子公司北京晶芯成、南京晶驱、日本晶合的基本情况未发生变化。

(六) 主要财产所有权或使用权的受限制情况

根据发行人提供的相关债权合同、担保合同、不动产登记簿、经本所律师核查，自《补充法律意见书（六）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人及其子公司主要财产存在权利受限的情况未发生重大改变。

十、 发行人的重大债权债务变化情况

根据发行人的说明，并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人的重大债权债务变化情况如下：

(一) 重大合同的变化情况

根据发行人确认并经本所律师核查，自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，发行人新增的对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同如下：

1、销售合同

根据发行人提供的相关文件及说明，自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，发行人及其子公司与报告期各期前五大的客户新签署的重大销售合同情况如下：

序号	供应主体	客户	有效期/订单日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
1	晶合集成	深圳天德钰科技股份有限公司	2022/07/28	0.11 um LOGIC Foundry IC WAFER	582.46 万美元	已履行

2、采购合同

根据发行人提供的相关文件及说明，自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，发行人及其子公司与报告期各期前五大原材料供应商新签署的重大采购合同情况如下：

序号	采购主体	供应商	签订日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
1	晶合集成	RohmandH aasElectroni cMaterialsC MPAsicalnc.	2022/08/18	化学品	475.29 万美元	正在履行
2	晶合集成	合肥广钢气体有限公司、广钢气体（广州）有限公司	2022/02/28	氮气、普通/高纯氧气、高纯氢气、高纯氦气、高纯氩气	/	正在履行

3、授信、借款及担保合同

根据发行人提供的相关文件及说明，自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，发行人及其子公司新签订单一金额在 5 亿元以上的重大授信、借款及担保合同如下：

序号	借款人/额度申请人	贷款人/额度授予人	签订日期	合同金额	贷款/授信期限	目前履行情况	担保情况
1	晶合集成	平安银行股份有限公司合肥分行	2022/10/28	8 亿元授信	2022/11/11-2023/11/10	正在履行	---
2	晶合集成	招商银行股份有限公司合肥分行	2022/07/20	10 亿元授信	2022/08/02-2023/08/01	正在履行	---
3	晶合集成	中国光大银行股份有限公司合肥分行	2022/11/14	7.5 亿元授信	2022/11/14-2025/11/13	正在履行	---
4	晶合集成	合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	2022/11/21	10 亿元授信	2022/11/21-2023/10/28	正在履行	---
5	晶合集成	中国民生银行股份有限公司合肥分行	2022/08/24	15 亿元授信	2022/08/24-2023/08/23	正在履行	---
6	晶合集成	华夏银行股份有限公司合肥分行	2022/12/13	6 亿元授信	2022/09/23-2023/09/23	正在履行	---
7	新品集成	兴业银行股份有限公司合肥分行	2022/09/29	7 亿元授信	2022/09/29-2023/01/09	正在履行	晶合集成提供最高 7 亿元担保
8	新品集成	兴业银行股份有限公司合肥分行	2022/09/29	7 亿元借款	2022/09/09-2032/09/28	正在履行	
9	新品集成	中国建设银行股份有限公司	2022/11/10	8 亿元借款	2022/11/30-2032/05/20	正在履行	晶合集成提供总计为 8 亿元

序号	借款人/额度申请人	贷款人/额度授予人	签订日期	合同金额	贷款/授信期限	目前履行情况	担保情况
		合肥城东支行					的担保
10	新品集成	招商银行股份有限公司合肥分行	2022/09/23	7 亿元借款	2022/09/23-2032/09/22	正在履行	晶合集成提供总计为 7 亿元的担保
11	新品集成	中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	2022/09/10	8 亿元借款	首次提款日起 120 个月	正在履行	晶合集成提供担保
12	新品集成	中国农业银行股份有限公司包河区支行、中信银行股份有限公司合肥分行	2022/09/15	15 亿元借款	2022/09/22-2024/01/22	正在履行	晶合集成提供总计为 15 亿元的担保
13	新品集成	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	2022/08/23	10 亿元借款	首次提款日起 120 个月	正在履行	晶合集成提供总计为 10 亿元的担保

4、对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的其他合同

除前期法律意见书相关章节及本节“（一）重大合同”之“1、销售合同”已披露的合同外，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人与主要客户无新签订的产能预约金合同。

（二）合同主体及合同的履行

上述适用中国法律的重大合同内容和形式不违反中国法律、行政法规的禁止性规定，发行人及其子公司作为上述适用中国法律的重大合同的主体，继续履行该等合同不存在实质性法律障碍。

（三）侵权之债

根据发行人说明、相关工商行政管理部门、人事劳动社会保障部门、税务部门等出具的证明，经本所律师在发行人及其子公司相关主管部门政府网站核查，自《补充

法律意见书（六）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人及其子公司报告期内没有因知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（四）发行人与关联方之间的重大债权债务关系及相互提供担保情况

根据《2020-2022 年审计报告》并经本所律师核查，截至报告期末，除本补充法律意见书“八、关联交易及同业竞争及其变化”及“十、发行人的重大债权债务变化情况”所述之外，发行人与其关联方之间不存在其他重大债权债务关系，亦不存在其他相互提供担保的情况。

（五）发行人的其他应收、应付款

根据《2020-2022 年审计报告》并经本所律师核查，报告期内，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款是因正常的经营及投资活动发生，合法有效。

十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并

根据发行人的说明并经本所律师核查，自《补充法律意见书（六）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人无重大资产收购、出售或拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十二、 发行人公司章程的制定与修改

根据发行人提供的《公司章程》、工商登记资料、股东大会会议文件及发行人说明，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>），自《补充法律意见书（六）》出具日至本补充法律意见书出具日，《公司章程》及《发行人章程》未进行修改。

十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

根据发行人确认，并经本所律师核查发行人会议资料，自《补充法律意见书（六）》出具日至本补充法律意见书出具日期间：

（一）发行人的组织结构没有发生变化；

(二) 发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则内容没有发生变化;

(三) 发行人共召开了 1 次股东大会、2 次董事会会议, 主要情况如下:

1、根据发行人提供的股东大会会议决议、会议记录、会议通知等相关文件, 自《补充法律意见书(六)》出具日至本补充法律意见书出具日期间, 发行人共召开了 1 次股东大会, 其主要情况如下:

序号	会议届次	会议召开时间
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 16 日

2、根据发行人提供的董事会会议决议、会议记录、会议通知等相关文件, 自《补充法律意见书(六)》出具日至本补充法律意见书出具日期间, 发行人共召开了 2 次董事会, 其主要情况如下:

序号	会议届次	会议召开时间
1	第一届董事会第十四次会议	2022 年 11 月 25 日
2	第一届董事会第十五次会议	2023 年 3 月 1 日

3、根据发行人提供的监事会会议决议、会议记录、会议通知等相关文件, 自《补充法律意见书(六)》出具日至本补充法律意见书出具日期间, 发行人未召开监事会。

经本所律师核查上述会议的召开通知、会议议案、会议决议、会议记录等文件资料, 本所律师认为, 发行人上述股东大会、董事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

十四、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

(一) 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况

自《补充法律意见书(六)》出具日至本补充法律意见书出具日期间, 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员范围未发生变化。经本所律师核查, 发行人的董事、监事、高级管理人员任职符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 发行人董事、监事及高级管理人员变化情况

根据发行人提供的股东大会、董事会、监事会决议等相关文件，自《补充法律意见书（六）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人董事、监事、高级管理人员未发生变化。

十五、 发行人的税务及其变化情况

（一）税务登记及税种、税率

根据《2020-2022 年审计报告》《主要税种纳税情况说明的专项审核报告》及发行人书面确认，并经本所律师核查，2022 年度，发行人及境内下属企业执行的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、13%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地面积	5 元/平方米

本所律师认为，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其境内子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

（二）税收优惠

根据《2020-2022 年审计报告》《主要税种纳税情况专项说明》及发行人的说明，2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，发行人享有的税收优惠无重大变化。

（三）财政补贴

根据《2020-2022 年审计报告》及发行人的说明，2022 年度，发行人及其境内控股子公司获得的计入当期损益的政府补助金额为 15,895.57 万元。

（四）税务合规证明

2023年2月2日，国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局向晶合集成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经金三征管系统查询，该纳税人自2022年1月1日至2022年12月31日一直正常申报纳税，未发生违法违规等行为被税务机关处罚的情形。”

2023年2月8日，国家税务总局南京市秦淮区税务局向南京晶驱出具《涉税信息查询结果告知书》，“经税收管理系统查询，你单位2020年01月01日至2023年01月31日期间，未发现违法违规记录。”

2023年2月10日，国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所（办税服务厅）向北京晶芯成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经查询，晶芯成（北京）科技有限公司为我局登记户，该单位于2022年01月01日至2022年12月31日在我局无缴纳税款。根据税务核心系统记载，该企业在此期间未接受过行政处罚，该单位企业所得税征收方式为查账征收。”

2023年2月2日，国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局向新品集成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经金三征管系统查询，该纳税人自2022年1月1日至2022年12月31日一直正常申报纳税，未发生违法违规等行为被税务机关处罚的情形。”

（五）税务处罚

自2022年7月1日至2022年12月31日期间，发行人及其子公司无新增税务处罚情况。

十六、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准的变化情况

（一）环境保护

1、根据行人说明及其提供的文件，截至2022年12月31日，发行人及新品集成对于主要环境污染物的处理设施及处理能力情况如下：

处理设备名称	数量 (套)	主要用途	处理能力	运行情况
--------	-----------	------	------	------

处理设备名称	数量(套)	主要用途	处理能力	运行情况
污水处理站-酸碱废水处理系统	1	处理酸碱废水	7,200 吨/天	正常
污水处理站-含氨废水处理系统	2	处理含氨废水	720 吨/天/套	正常
污水处理站-含氟废水处理系统	2	处理含氟废水	2,400 吨/天或 1,440 吨/天	正常
污水处理站-研磨废水处理系统	1	处理研磨废水	960 吨/天	正常
污水处理站-有机废水处理系统	2	处理有机废水	480 吨/天/套	正常
污水处理站-含铜废水处理系统	1	处理含铜废水	720 吨/天	正常
酸性废气处理设施(44m 排气筒)	14	处理酸性废气	78,000m ³ /h/套或 82,000m ³ /h/套	正常
碱性废气处理设施(44m 排气筒)	7	处理碱性废气	27,000m ³ /h/套或 45,000m ³ /h/套	正常
沸石浓缩转轮、RTO 蓄热燃烧炉(44m 排气筒)	6	处理有机废气	60,000m ³ /h/套或 50,000m ³ /h/套	正常
含砷废气处理吸附塔(44m 排气筒)	4	处理含砷废气	3,000m ³ /h/套	正常
两级酸洗喷淋塔+水喷淋塔(19m 排气筒)	2	处理废水站废气	30,000m ³ /h+9,000 m ³ /h	正常
锅炉低氮燃烧器(35m 排气筒)	4	处理锅炉废气	4589 m ³ /h*2 +2295 m ³ /h +4,015 m ³ /h	正常

2、环保合规证明

2023 年 2 月 24 日，合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局向发行人出具《证明》，“该公司自 2022 年 7 月 1 日以来，未发生过环境污染事故，也未因环境违法行为受到环保行政处罚或立案调查。”

2022 年 2 月 24 日，合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局向新品集成出具《证明》，“该公司自 2022 年 7 月 1 日以来，未发生过环境污染事故，也未因环境违法行为受到环保行政处罚或立案调查。”

3、根据发行人确认及本所律师通过网络公开信息检索等方式核查，自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，发行人不存在因经营活动违反环境保护法律、行

政法规、部门规章及其他规范性文件而受到处罚的情况。

（二）产品质量和技术监督标准

根据发行人确认及本所律师通过网络公开信息检索等方式核查，自《补充法律意见书（六）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情况。

（三）安全生产

根据发行人书面说明，自《补充法律意见书（六）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，北京晶芯成、南京晶驱无实际经营，日本晶合不从事生产，不涉及安全生产相关事项，不涉及安全生产相关事项。发行人及新品集成安全生产合规情况如下：

2023年3月7日，安徽省应急管理厅出具《拟上市（挂牌）企业安全生产相关情况证明》，“合肥晶合集成电路股份有限公司自2022年7月1日至2023年2月21日，在合肥市辖区内未发生亡人生产安全事故。”

2023年3月7日，安徽省应急管理厅出具《拟上市（挂牌）企业安全生产相关情况证明》，“合肥新品集成电路有限公司自2022年7月1日至2023年2月21日，在合肥市辖区内未发生亡人生产安全事故。”

根据上述安全生产监督管理部门出具的证明、发行人书面确认并经本所律师核查，发行人及其子公司的生产经营符合安全生产监督管理要求，最近三年未发生过安全生产事故，未受过安全生产方面的行政处罚。

十七、 发行人的劳动与社会保障及其变化情况

1、劳动合同

根据发行人提供的《劳动合同》模板，并经本所律师抽样核查发行人与员工签署的《劳动合同》，该等劳动合同的内容、形式符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的要求。

2、社会保险缴纳情况

根据发行人提供的统计资料及社会保险及住房公积金缴纳凭证，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其境内子公司员工共 4,224 人，已为其中 3,844 人缴纳社会保险，已为其中 3,842 人缴纳住房公积金。

发行人及其子公司未为全部员工缴纳社会保险的原因主要为（1）存在个别当月社会保险扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳社会保险；（2）在境内任职的中国台湾员工按照中国台湾地区相关规定缴纳了劳健保；（3）在境内任职的中国香港员工、外籍员工未缴纳社会保险；（4）境外子公司员工遵循当地法律相关规定缴纳社会保险。

发行人及其子公司未为全部员工缴纳住房公积金的原因主要为：（1）存在个别当月住房公积金扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳住房公积金；（2）在境内任职的中国台湾员工、中国香港员工、外籍员工未缴纳住房公积金；（3）境外子公司员工遵循当地法律相关规定无需缴纳住房公积金。

2023 年 3 月 3 日，合肥市人力资源和社会保障局出具证明：经核实，晶合集成依法足额缴纳各项社会保险费（拖欠农民工工资违法行为），自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 3 月 3 日未发现劳动用工违法行为，无人力资源社会保障行政部门处罚的不良记录。

2023 年 3 月 3 日，合肥市住房公积金管理中心出具证明：晶合集成自 2016 年 7 月在我中心开户缴存职工住房公积金，该公司住房公积金缴存正常，未发现违反住房公积金相关法律法规的行为，公司未因住房公积金问题而受到行政处罚。

2023 年 3 月 3 日，合肥市人力资源和社会保障局出具证明：经核实，新晶集成依法足额缴纳各项社会保险费，自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 3 月 3 日未发现劳动用工违法行为（拖欠农民工工资违法行为），无人力资源社会保障行政部门处罚的不良记录。

2023 年 3 月 3 日，合肥市住房公积金管理中心出具证明：新晶集成自 2021 年 12 月在我中心开户缴存职工住房公积金，该公司住房公积金缴存正常，未发现违反住房公积金相关法律法规的行为，公司未因住房公积金问题而受到行政处罚。

十八、 发行人募集资金的运用

自《补充法律意见书（六）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人本次发行上市募集资金投资项目的项目备案文件及环评备案文件未发生变化。

十九、 诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况

（一）发行人及其下属公司

经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/>）、信用中国网（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、人民法院公告网（<http://rmfygg.court.gov.cn/>）、中国检察网（<http://www.12309.gov.cnajxxgk.jcy.gov.cn/12309/index.shtml>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>），访谈发行人董事、监事和高级管理人员并根据发行人书面确认，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚。

（二）持有发行人 5%以上股份的股东

根据持有发行人 5%以上股份的主要股东填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》、持有发行人 5%以上股份的主要股东出具的承诺函，并经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/>）、信用中国网（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、人民法院公告网（<http://rmfygg.court.gov.cn/>）、中国检察网（<http://www.12309.gov.cnajxxgk.jcy.gov.cn/12309/index.shtml>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，截至本补充法律意见书出具日，持有发行人 5%以上股份的主要股东不存在对晶合集成产生影

响的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

根据发行人董事、监事、高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》、核心技术人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司核心技术人员调查表》，中国证监会安徽监管局诚信信息查询结果，并经本所律师查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、人民法院公告网（<http://rmfygg.court.gov.cn/>）等网站，截至本补充法律意见书出具日，发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

二十、 发行人《招股说明书（注册稿）》法律风险的评价

经审阅发行人《招股说明书（注册稿）》所引用的前期法律意见书及本补充法律意见书相关内容部分，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人《招股说明书（注册稿）》及其摘要引用相关内容与前期法律意见书及本补充法律意见书不存在矛盾之处。本所确认，《招股说明书（注册稿）》及其摘要不致因引用前期法律意见书及本补充法律意见书的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十一、 本次发行上市的总体结论性意见

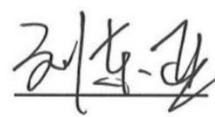
基于上述事实，本所认为，发行人仍符合《证券法》《公司法》《首发注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的各项条件，不存在重大违法违规行为。本次发行完成后，经上交所审核同意，发行人股票可于上交所科创板上市交易。

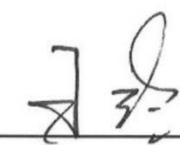
（本页以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（七）》之签章页）



经办律师： 
苏 峥


刘东亚

单位负责人： 
王 玲

二〇二三年 三 月二十八日

附件：发行人及其子公司拥有的知识产权

1、境内注册商标

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式
1	晶合集成	Nexchip	26258933	25	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
2	晶合集成	Nexchip	26283789	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
3	晶合集成	Nexchip	26255490	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
4	晶合集成	晶合	26295138 A	9	2018/11/07-2028/11/06	原始取得
5	晶合集成	晶合	26261189	25	2018/10/28-2028/10/27	原始取得
6	晶合集成	晶合	26283543	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
7	晶合集成	晶合	26258453	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
8	晶合集成	晶合集成	26296982 A	9	2018/11/07-2028/11/06	原始取得
9	晶合集成	晶合集成	26257005	25	2018/10/28-2028/10/27	原始取得
10	晶合集成	晶合集成	26279879	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式
11	晶合集成	晶合集成	26258966	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
12	晶合集成		26279826	9	2018/12/07-2028/12/06	原始取得
13	晶合集成		43218141	25	2020/10/14-2030/10/13	原始取得
14	晶合集成		26279830	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
15	晶合集成		26273278	40	2019/12/14-2029/12/13	原始取得
16	晶合集成	 Nexchip	36794768	25	2020/08/21-2030/08/20	原始取得
17	晶合集成	晶芯成	54924121	9	2021/11/7-2031/11/6	原始取得
18	晶合集成	晶芯成	53267990	25	2021/9/7-2031/9/6	原始取得
19	晶合集成	晶芯成	54895828	35	2021/11/7-2031/11/6	原始取得
20	晶合集成	晶芯成	53268332	40	2021/9/7-2031/9/6	原始取得
21	晶合集成	晶驱	53274613	25	2021/8/28-2031-8/27	原始取得
22	晶合集成	晶驱	53264804	40	2021/8/28-2031/8/27	原始取得
23	晶合集成	新晶	59163417	9	2022/6/14-2032/6/13	原始取得
24	晶合集成	新晶	59154730	25	2022/3/14-2032/3/13	原始取得
25	晶合集成	新晶	59142175	35	2022/5/21-2032/5/20	原始取得
26	晶合集成	新晶	59148502	40	2022/5/21-2032/5/20	原始取得

序号	商标权人名 称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得 方式
27	晶合集成	Nexchip	61874559	35	2022/6/21-2032/6/20	原始 取得
28	晶合集成	 Nexchip	61859353	16	2022/7/7/-2032/7/6	原始 取得
29	晶合集成	 Nexchip	61857484	24	2022/7/7-2032/7/6	原始 取得
30	晶合集成	 Nexchip	61854331	35	2022/7/7-2032/7/6	原始 取得
31	晶合集成	Nexchip	61890806	16	2022/7/7-2032/7/6	原始 取得
32	晶合集成	Nexchip	61877615	24	2022/7/7-2032/7/6	原始 取得
33	晶合集成	Nexchip	62617086	16	2022/8/14/-2032/8/13	原始 取得
34	晶合集成	Nexchip	62615949	24	2022/8/14-2032/8/13	原始 取得
35	晶合集成	Nexchip	62618866	35	2022/8/14-2032/8/13	原始 取得

2、境外商标情况

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
1	晶合有限	Nexchip	6098177	9	2018/11/16-2028/11/15	原始取得	日本
2	晶合有限	Nexchip	6071853	25	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
3	晶合有限	Nexchip	6098177	35	2018/11/16-2028/11/15	原始取得	日本
4	晶合有限	Nexchip	6071853	40	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
5	晶合有限	晶合	6050343	9	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
6	晶合有限	晶合	6070505	25	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
7	晶合有限	晶合	6050343	35	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
8	晶合有限	晶合	6070505	40	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
9	晶合有限	晶合集成	6050344	9	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
10	晶合有限	晶合集成	6071852	25	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
11	晶合有限	晶合集成	6050344	35	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
12	晶合有限	晶合集成	6071852	40	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
13	晶合有限		6050345	9	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
14	晶合有限		6070504	25	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
15	晶合有限		6050345	35	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
16	晶合有限		6070504	40	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
17	晶合有限	Nexchip	0191963 9	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
18	晶合集成	Nexchip	0192363 3	25	2018/07/01-2028/06/30	原始取得	中国台湾
19	晶合有限	Nexchip	0192098 3	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
20	晶合集成	Nexchip	0191274 5	40	2018/05/01-2028/04/30	原始取得	中国台湾
21	晶合有限	晶合	0191963 7	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
22	晶合集成	晶合	0190940 1	25	2018/04/16-2028/04/15	原始取得	中国台湾
23	晶合有限	晶合	0192098 1	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
24	晶合集成	晶合	0191274 3	40	2018/05/01-2028/04/30	原始取得	中国台湾

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
25	晶合有限	晶合集成	01919636	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
26	晶合集成	晶合集成	01909400	25	2018/04/16-2028/04/15	原始取得	中国台湾
27	晶合有限	晶合集成	01920980	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
28	晶合集成	晶合集成	01918174	40	2018/06/01-2028/05/31	原始取得	中国台湾
29	晶合有限		01919638	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
30	晶合集成		01909402	25	2018/04/16-2028/04/15	原始取得	中国台湾
31	晶合有限		01920982	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
32	晶合集成		01912744	40	2018/05/01-2028/04/30	原始取得	中国台湾
33	晶合有限	Nexchip	5513533	9	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
34	晶合有限	Nexchip	5513299	25	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
35	晶合有限	Nexchip	5559722	35	2018/09/11-2028/09/10	原始取得	美国
36	晶合有限	Nexchip	5513440	40	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
37	晶合有限	晶合	5523772	9	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
38	晶合有限	晶合	5518583	25	2018/07/17-2028/07/16	原始取得	美国
39	晶合有限	晶合	5513532	35	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
40	晶合有限	晶合	5518584	40	2018/07/17-2028/07/16	原始取得	美国
41	晶合有限	晶合集成	5518591	25	2018/07/17-2028/07/16	原始取得	美国
42	晶合有限	晶合集成	5523770	9	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
43	晶合有限	晶合集成	5523769	35	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
44	晶合有限	晶合集成	5513586	40	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
45	晶合有限		5523767	9	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
46	晶合有限		5523806	25	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
47	晶合有限		5523768	35	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
48	晶合有限		5523807	40	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
49	晶合有限	Nexchip	0180744 17	9	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
50	晶合有限	Nexchip	0180744 17	35	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
51	晶合有限	Nexchip	0180744 17	40	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
52	晶合有限	 Nexchip	0180739 71	9	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
53	晶合有限	 Nexchip	0180739 71	35	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
54	晶合有限	 Nexchip	0180739 71	40	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
55	晶合有限		0180739 76	9	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
56	晶合有限		0180739 76	35	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
57	晶合有限		0180739 76	40	2019/05/31- 2029/05/31	原始取得	欧盟
58	晶合有限	Nexchip	4196328	35	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度
59	晶合有限	Nexchip	4196329	40	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度
60	晶合有限	 Nexchip	4216333	35	2019/06/25- 2029/06/24	原始取得	印度
61	晶合有限	 Nexchip	4216334	40	2019/06/25- 2029/06/24	原始取得	印度
62	晶合有限		4196323	9	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度
63	晶合有限		4196324	35	2019/06/03- 2029/06/02	原始取得	印度

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
64	晶合有限		4196325	40	2019/06/03-2029/06/02	原始取得	印度
65	晶合有限	Nexchip	401603379	35	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
66	晶合有限	Nexchip	401603380	40	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
67	晶合集成	Nexchip	401684625	9	2021/1/20-2031/1/19	原始取得	韩国
68	晶合有限	 Nexchip	401605036	35	2020/05/12-2030/05/11	原始取得	韩国
69	晶合有限	 Nexchip	401605037	40	2020/05/12-2030/05/11	原始取得	韩国
70	晶合集成	 Nexchip	401684665	9	2021/1/20-2031/1/19	原始取得	韩国
71	晶合有限		401603377	9	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
72	晶合有限		401603378	35	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
73	晶合有限		401599318	40	2020/04/23-2030/04/22	原始取得	韩国
74	晶合有限	Nexchip	40201926832S	35	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
75	晶合有限	Nexchip	40201926831T	40	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
76	晶合集成	Nexchip	40201926806V	9	2019/12/11-2029/12/10	原始取得	新加坡
77	晶合有限	 Nexchip	40201925814T	35	2019/11/28-2029/11/27	原始取得	新加坡
78	晶合集成	 Nexchip	40201925815S	40	2019/11/28-2029/11/27	原始取得	新加坡
79	晶合集成	 Nexchip	40201926869W	9	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
80	晶合有限		40201926842V	9	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
81	晶合有限		40201926838P	35	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
82	晶合集成		40201926847Q	40	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
83	晶合集成	 Nexchip	TM2019044357	9	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
84	晶合集成	 Nexchip	TM2019044362	35	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚
85	晶合集成	 Nexchip	TM2019044364	40	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚
86	晶合集成	Nexchip	TM2019045346	9	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
87	晶合集成	Nexchip	TM2019045348	35	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
88	晶合集成	Nexchip	TM2019045350	40	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
89	晶合集成		TM2019045352	9	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
90	晶合集成		TM2019045355	35	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
91	晶合集成		TM2019045357	40	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚

3、境内专利

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
1	晶合集成	发明专利	光学光刻方法	ZL03155531.4	2003/08/28	继受取得
2	晶合集成	发明专利	具有自行对准接触窗的半导体元件及其制造方法	ZL200510065580.3	2005/04/18	继受取得
3	晶合集成	发明专利	导线的制造方法	ZL200510065608.3	2005/04/18	继受取得
4	晶合集成	发明专利	半导体元件及其制造方法	ZL200610005891.5	2006/01/19	继受取得
5	晶合集成	发明专利	导线的制造方法以及缩小导线与图案间距的方法	ZL200510129767.5	2005/12/05	继受取得
6	晶合集成	发明专利	电路结构及用以定义此电路结构的光掩模	ZL200710161775.7	2007/09/26	继受取得
7	晶合集成	发明专利	监控光刻工艺的方法与监控标记	ZL200810093317.9	2008/04/18	继受取得
8	晶合集成	发明专利	分栅式非易失性存储器及其制备方法	ZL201810796277.8	2018/07/19	原始取得
9	晶合集成	发明专利	一种晶元破片分析装置及其晶元破片分析方法	ZL201810897300.2	2018/08/08	原始取得
10	晶合集成	发明专利	一种裂片装置及方法	ZL201810920343.8	2018/08/14	原始取得
11	晶合集成	发明专利	一种半导体结构制造方法	ZL201810980356.4	2018/08/27	原始取得
12	晶合集成	发明专利	MOS 场效应晶体管及其制造方法	ZL201811237197.5	2018/10/23	原始取得
13	晶合集成	发明专利	一种非易失性存储器及其制作方法	ZL201811345719.3	2018/11/13	原始取得
14	晶合集成	发明专利	一种非易失性存储器及其制作方法	ZL201811354139.0	2018/11/14	原始取得
15	晶合集成	发明专利	沟槽隔离结构的形成方法	ZL201910048694.9	2019/01/18	原始取得
16	晶合集成	发明专利	一种存储器及其制造方法	ZL201910104747.4	2019/02/01	原始取得
17	晶合集成	发明专利	高耐压半导体元件及其制造方法	ZL201910299871.0	2019/04/15	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
18	晶合集成	发明专利	预处理方法、金属硅化物的形成方法以及半导体处理装置	ZL20191061196 6.1	2019/07/08	原始取得
19	晶合集成	发明专利	沟槽制作方法及半导体隔离结构制作方法	ZL20191126817 3.0	2019/12/11	原始取得
20	晶合集成	发明专利	半导体集成器件的阱制备方法和阱注入光罩组	ZL20191130399 1.X	2019/12/17	原始取得
21	晶合集成	发明专利	一种半导体器件的制造方法及其形成的半导体器件	ZL20191132656 3.9	2019/12/20	原始取得
22	晶合集成	发明专利	扩散型场效应晶体管的形成方法	ZL20201004399 7.4	2020/01/15	原始取得
23	晶合集成	发明专利	半导体器件及其制造方法	ZL20201009979 8.5	2020/02/18	原始取得
24	晶合集成	发明专利	半导体元件的制造方法	ZL20191010360 9.4	2019/02/01	原始取得
25	晶合集成	发明专利	一种建立光学数据校正模型的方法	ZL20201021935 6.X	2020/03/25	原始取得
26	晶合集成	发明专利	一种晶圆的退火方法	ZL20201037248 9.0	2020/05/06	原始取得
27	晶合集成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL20201045497 7.6	2020/05/26	原始取得
28	晶合集成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL20201035848 3.8	2020/04/29	原始取得
29	晶合集成	发明专利	电容性半导体元件	ZL20191034016 5.6	2019/04/25	原始取得
30	晶合集成	发明专利	电容性半导体元件	ZL20201032491 4.9	2020/04/23	原始取得
31	晶合集成	发明专利	一种监测系统及监测方法	ZL20181114598 5.1	2018/09/29	原始取得
32	晶合集成	发明专利	一种静态随机存取存储器	ZL20191053020 3.4	2019/06/19	原始取得
33	晶合集成	发明专利	一种化学机械平坦化设备及其应用	ZL20201160741 1.9	2020/12/30	原始取得
34	晶合集成	发明专利	一种降低 CMOS 图像传感器暗电流的方法	ZL20221022902 7.2	2022/03/10	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
35	晶合集成	发明专利	一种 GOI 测试电路结构	ZL20221022894 8.7	2022/03/10	原始取得
36	晶合集成	发明专利	一种光阻层移除方法及半导体器件的制作方法	ZL20221033624 4.1	2022/04/01	原始取得
37	晶合集成	发明专利	洁净室的空气净化装置及洁净室离子控制系统	ZL20201031715 0.0	2020/04/21	原始取得
38	晶合集成	发明专利	互连结构及其制备方法	ZL20221022902 3.4	2022/03/10	原始取得
39	晶合集成	实用新型	一种液位测量仪	ZL20182099552 5.7	2018/06/25	原始取得
40	晶合集成	实用新型	双灯丝离子源装置	ZL20182116322 6.3	2018/07/23	原始取得
41	晶合集成	实用新型	用于半导体设备的安装位检测装置	ZL20182113087 0.0	2018/07/17	原始取得
42	晶合集成	实用新型	用于半导体设备的定位装置	ZL20182114798 8.4	2018/07/19	原始取得
43	晶合集成	实用新型	一种气体供应装置	ZL20182119241 9.1	2018/07/24	原始取得
44	晶合集成	实用新型	一种载台及载具	ZL20182171961 7.9	2018/10/22	原始取得
45	晶合集成	实用新型	一种气体除尘装置及具有该气体除尘装置的气体处理装置	ZL20182175344 0.4	2018/10/26	原始取得
46	晶合集成	实用新型	掩膜板	ZL20182195750 2.3	2018/11/23	原始取得
47	晶合集成	实用新型	可感测基片破损的片盒	ZL20182200299 1.3	2018/11/30	原始取得
48	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的不间断储水装置及半导体设备	ZL20192070694 5.3	2019/05/17	原始取得
49	晶合集成	实用新型	一种防干扰装置及半导体制程机台	ZL20192101624 8.1	2019/07/02	原始取得
50	晶合集成	实用新型	流速调节装置	ZL20192123565 0.9	2019/08/01	原始取得
51	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的组件调整装置	ZL20192143957 2.4	2019/09/02	原始取得
52	晶合集成	实用新型	一种半导体设备夹持装置	ZL20192160416 2.0	2019/09/25	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
53	晶合集成	实用新型	半导体检测机台	ZL20192165472 3.8	2019/09/30	原始取得
54	晶合集成	实用新型	一种光罩	ZL20202036835 5.7	2020/03/23	原始取得
55	晶合集成	实用新型	一种晶体管结构	ZL20202025766 4.7	2020/03/04	原始取得
56	晶合集成	实用新型	封装芯片的移除装置	ZL20192231208 2.4	2019/12/20	原始取得
57	晶合集成	实用新型	多次可编程存储器的单元结构	ZL20202033115 0.1	2020/03/16	原始取得
58	晶合集成	实用新型	一种非易失性存储器结构	ZL20202051950 1.1	2020/04/10	原始取得
59	晶合集成	实用新型	一种非易失性存储器结构	ZL20202051950 3.0	2020/04/10	原始取得
60	晶合集成	实用新型	一种半导体器件	ZL20202033322 2.6	2020/03/17	原始取得
61	晶合集成	实用新型	半导体器件	ZL20202024773 8.9	2020/03/02	原始取得
62	晶合集成	实用新型	封装结构	ZL20202040462 2.1	2020/03/24	原始取得
63	晶合集成	实用新型	一种半导体结构及其应用的半导体器件	ZL20202077839 8.2	2020/05/12	原始取得
64	晶合集成	实用新型	嵌入式焊盘结构	ZL20202025253 7.8	2020/03/04	原始取得
65	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的腔室及半导体设备	ZL20202060424 3.7	2020/04/21	原始取得
66	晶合集成	实用新型	量测机台	ZL20202083266 6.4	2020/05/15	原始取得
67	晶合集成	实用新型	一种转接装置	ZL20202113745 0.2	2020/06/18	原始取得
68	晶合集成	实用新型	一种半导体的测试装置	ZL20202116695 9.X	2020/06/22	原始取得
69	晶合集成	实用新型	一种基板表面污染物取样装置	ZL20202124862 6.1	2020/06/30	原始取得
70	晶合集成	实用新型	封装芯片的开封装置	ZL20202128218 6.1	2020/07/02	原始取得
71	晶合集成	实用新型	一种晶圆侦测设备	ZL20202128366 1.7	2020/07/03	原始取得
72	晶合集成	实用新型	研磨垫中心校准治具	ZL20202158137 0.6	2020/08/03	原始取得
73	晶合集成	实用新型	流体测量治具	ZL20202161873 9.6	2020/08/06	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
74	晶合集成	实用新型	研磨后清洗装置和化学机械研磨设备	ZL202021645116.8	2020/08/10	原始取得
75	晶合集成	实用新型	化学机械研磨装置	ZL202021645079.0	2020/08/10	原始取得
76	晶合集成	实用新型	一种用于化学机械研磨的清洗装置	ZL202021794843.0	2020/08/25	原始取得
77	晶合集成	实用新型	一种半导体设备	ZL202021873549.9	2020/09/01	原始取得
78	晶合集成	实用新型	进样装置	ZL202021935217.9	2020/09/03	原始取得
79	晶合集成	实用新型	晶圆表面金属离子收集装置	ZL202022409723.0	2020/10/23	原始取得
80	晶合集成	实用新型	吹气管、吹气式液位计和硅片清洗装置	ZL202022619232.9	2020/11/12	原始取得
81	晶合集成	实用新型	高度测量装置	ZL202022982757.9	2020/12/07	原始取得
82	晶合集成	实用新型	一种循环水控温装置	ZL202120383318.8	2021/02/20	原始取得
83	晶合集成	实用新型	晶圆定位标示工具	ZL202120350044.2	2021/02/08	原始取得
84	晶合集成	实用新型	电容测试结构	ZL202023278550.X	2020/12/29	原始取得
85	晶合集成	实用新型	一种用于微光显微镜的测试夹具	ZL202022727035.9	2020/11/23	原始取得
86	晶合集成	实用新型	一种更换制程材料的防呆装置及防呆系统	ZL202120139540.3	2021/01/19	原始取得
87	晶合集成	实用新型	一种探针弯折装置	ZL202023000991.3	2020/12/11	原始取得
88	晶合集成	实用新型	一种二次离子质谱的样品装载盒	ZL202120419724.5	2021/02/25	原始取得
89	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的张力自动调控装置	ZL202120256206.6	2021/01/29	原始取得
90	晶合集成	实用新型	变容二极管	ZL202022952129.6	2020/12/08	原始取得
91	晶合集成	实用新型	超纯水取样器	ZL202120367091.8	2021/02/09	原始取得
92	晶合集成	实用新型	缺陷检测装置	ZL202121665116.9	2021/07/21	原始取得
93	晶合集成	实用新型	化学机械研磨装	ZL20212155490	2021/07/08	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			置	6.X		
94	晶合集成	实用新型	涂胶机喷头位置测量装置及涂胶机	ZL20212166509 8.4	2021/07/21	原始取得
95	晶合集成	实用新型	套刻对准标记及掩模板组件	ZL20212092535 1.9	2021/04/29	原始取得
96	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的压力测量装置	ZL20212152068 5.4	2021/07/05	原始取得
97	晶合集成	实用新型	一种监测系统及检测机台	ZL20212036872 0.9	2022/01/28	原始取得
98	晶合集成	实用新型	晶圆装卸系统	ZL20212178639 5.4	2022/01/28	原始取得
99	晶合集成	实用新型	支撑装置及反应腔	ZL20212169125 5.9	2022/01/28	原始取得
100	晶合集成	实用新型	一种过滤装置及光阻液涂布机	ZL20212189497 9.3	2021/08/13	原始取得
101	晶合集成	实用新型	防污染检测系统	ZL20212177803 3.0	2022/01/28	原始取得
102	晶合集成	实用新型	一种芯片失效分析用测试装置	ZL20212233661 7.9	2022/02/11	原始取得
103	晶合集成	实用新型	一种晶圆曝光后的烘烤设备	ZL20212217304 6.1	2021/09/09	原始取得
104	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的废气排放管道连接件及装置	ZL20212252706 5.X	2021/10/20	原始取得
105	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的排气阀及排气装置	ZL20212261173 2.2	2021/10/28	原始取得
106	晶合集成	实用新型	一种晶圆研磨装置	ZL20212293429 4.3	2021/11/26	原始取得
107	晶合集成	实用新型	晶圆清洗装置	ZL20212300879 8.9	2021/11/30	原始取得
108	晶合集成	实用新型	晶圆运载装置	ZL20212290464 7.5	2021/11/19	原始取得
109	晶合集成	实用新型	一种半导体机台液体自动补充装置及半导体机台	ZL20212270492 0.X	2021/11/03	原始取得
110	晶合集成	实用新型	晶圆清洗装置	ZL20222017932 8.4	2022/01/21	原始取得
111	晶合集成	实用新型	一种晶圆清洗设备	ZL20222025581 2.0	2022/02/08	原始取得
112	晶合集成	实用新型	一种光刻对准标记图形结构及半	ZL20222053315 0.9	2022/03/11	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			导体晶片			
113	晶合集成	实用新型	半导体加热、显影装置	ZL20222052702 7.6	2022/03/11	原始取得
114	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的清洁装置	ZL20202297289 6.3	2020/12/11	原始取得
115	晶合集成	发明专利	一种非易失性存储器单元、阵列及制备方法	ZL20181079653 5.2	2018/07/19	原始取得
116	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	半导体结构及其制备方法	ZL20221033600 9.4	2022/04/01	原始取得
117	晶合集成	发明专利	半导体器件的形成方法	ZL20221033563 1.3	2022/04/01	原始取得
118	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	晶圆对准装置及方法、晶圆测试方法	ZL20221032144 9.2	2022/03/30	原始取得
119	晶合集成	实用新型	一种光刻对准标记图形结构及半导体晶片	ZL20222053283 6.6	2022/03/11	原始取得
120	晶合集成	发明专利	一种光学临近效应修正模型的获取方法及系统	ZL20221031504 8.6	2022/03/29	原始取得
121	晶合集成	发明专利	一种版图图形的修正方法及系统	ZL20221031504 7.1	2022/03/29	原始取得
122	晶合集成	实用新型	一种光刻对准标记图形结构及半导体晶片	ZL20222053314 9.6	2022/03/11	原始取得
123	晶合集成	发明专利	半导体结构及其制作方法	ZL20221032147 9.3	2022/03/30	原始取得
124	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种 MOS 晶体管的形成方法	ZL20221033595 6.1	2022/04/01	原始取得
125	晶合集成	实用新型	一种光刻对准标记图形结构及半导体晶片	ZL20222055937 9.X	2022/03/11	原始取得
126	晶合集成	发明专利	光学临近修正方法及装置	ZL20221033563 0.9	2022/04/01	原始取得
127	晶合集成	发明专利	3D 半导体器件及其形成方法	ZL20221033644 5.1	2022/04/01	原始取得
128	晶合集成	实用新型	一种用于吹净晶圆的吹净装置及其半导体设备腔	ZL20222061634 0.7	2022/03/21	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			室			
129	晶合集成	实用新型	一种晶圆吸附设备	ZL20222074773 7.X	2022/04/01	原始取得
130	晶合集成	发明专利	一种金属互连结构及其制作方法	ZL20221050031 7.6	2022/05/10	原始取得
131	晶合集成	实用新型	加热装置及半导体设备	ZL20222077167 8.X	2022/03/29	原始取得
132	晶合集成	发明专利	一种集成电路结构及其形成方法	ZL20221056600 9.3	2022/05/24	原始取得
133	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种 MIM 电容及其形成方法	ZL20221008960 7.6	2022/01/26	原始取得
134	晶合集成	发明专利	光学临近修正方法、装置及电子设备	ZL20221050643 4.3	2022/05/11	原始取得
135	新晶集成	发明专利	生产力分析方法及生产力分析系统	ZL20221065976 1.2	2022/06/13	原始取得
136	晶合集成	实用新型	一种晶圆处理装置	ZL20222118362 6.7	2022/05/17	原始取得
137	晶合集成	发明专利	一种图像传感器及其制作方法	ZL20221057170 3.4	2022/05/25	原始取得
138	晶合集成	发明专利	SRAM 及其制作方法	ZL20221060330 1.8	2022/05/31	原始取得
139	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL20221060326 8.9	2022/05/31	原始取得
140	晶合集成	发明专利	一种对准误差的量测方法及系统	ZL20221056586 9.5	2022/05/24	原始取得
141	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种图像传感器及其制造方法	ZL20221052553 3.6	2022/05/16	原始取得
142	新晶集成	发明专利	光罩及半导体结构	ZL20221056007 9.8	2022/05/23	原始取得
143	新晶集成	发明专利	半导体器件结构及其制备方法	ZL20221053681 9.4	2022/05/18	原始取得
144	晶合集成	发明专利	测试结构	ZL20221058145 3.2	2022/05/26	原始取得
145	晶合集成	发明专利	集成电路及其形成方法	ZL20221067736 1.4	2022/06/16	原始取得
146	晶合集成	发明专利	一种半导体集成器件的制作方法	ZL20221066377 3.2	2022/06/14	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
147	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	高压晶体管仿真模型及建模方法	ZL202210229031.9	2022/03/10	原始取得
148	晶合集成	发明专利	金属硅化物层的形成方法、半导体器件及其形成方法	ZL201810717248.8	2018/07/03	原始取得
149	晶合集成	发明专利	金属刻蚀方法	ZL202210659482.6	2022/06/13	原始取得
150	晶合集成	实用新型	一种晶圆转移设备	ZL202221383880.1	2022/06/02	原始取得
151	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	半导体器件的制备方法	ZL202210664390.7	2022/06/14	原始取得
152	晶合集成	发明专利	一种半导体器件的制作方法	ZL202210701233.9	2022/06/21	原始取得
153	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202210785556.0	2022/07/06	原始取得
154	晶合集成	实用新型	一种关键尺寸测试条结构	ZL202221464366.0	2022/06/10	原始取得
155	晶合集成	实用新型	一种测试电路结构	ZL202221281593.X	2022/05/25	原始取得
156	晶合集成	发明专利	一种半导体器件及其制作方法	ZL202210701263.X	2022/06/21	原始取得
157	晶合集成	发明专利	一种介质层可靠性测试结构及测试方法	ZL202210817928.3	2022/07/13	原始取得
158	晶合集成	发明专利	一种半导体集成器件及其制作方法	ZL202210571693.4	2022/05/25	原始取得
159	晶合集成	实用新型	晶圆支撑装置	ZL202221086125.7	2022/04/29	原始取得
160	晶合集成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202010506035.8	2020/06/05	原始取得
161	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202210754353.5	2022/06/30	原始取得
162	晶合集成	实用新型	晶圆背面自清洁装置及光刻机	ZL202220462327.0	2022/03/04	原始取得
163	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	半导体器件及其制备方法	ZL202210694366.8	2022/06/20	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
164	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种半导体器件的制造方法及半导体结构	ZL202210418608.0	2022/04/21	原始取得
165	晶合集成	发明专利	半导体器件版图结构及其形成方法	ZL202210844793.X	2022/07/19	原始取得
166	晶合集成	发明专利	半导体结构及其制作方法	ZL202210433073.4	2022/04/24	原始取得
167	晶合集成	实用新型	一种晶圆装载装置及其校准装置	ZL202221941646.6	2022/07/26	原始取得
168	晶合集成	发明专利	闪存器件、存储单元及其制造方法	ZL202210850397.8	2022/07/20	原始取得
169	晶合集成	发明专利	半导体器件及其制作方法	ZL202210844726.8	2022/07/19	原始取得
170	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	3D CMOS 图像传感器及其形成方法	ZL202210852983.6	2022/07/20	原始取得
171	晶合集成	发明专利	3D CMOS 图像传感器及其形成方法	ZL202210850365.8	2022/07/20	原始取得
172	晶合集成	发明专利	一种逻辑芯片漏电失效分析方法	ZL202210966115.0	2022/08/12	原始取得
173	晶合集成	发明专利	晶体管及其制造方法	ZL202210844962.X	2022/07/19	原始取得
174	晶合集成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202211015524.9	2022/08/24	原始取得
175	晶合集成	实用新型	一种真空调压装置及曝光机	ZL202221678854.1	2022/07/01	原始取得
176	晶合集成	实用新型	一种晶圆的快速热处理装置	ZL202222020880.1	2022/08/02	原始取得
177	晶合集成	实用新型	一种化学机械研磨装置	ZL202222021080.1	2022/08/02	原始取得
178	晶合集成	发明专利	对准标记的制作方法及其晶圆键合方法	ZL202210677258.X	2022/06/16	原始取得
179	晶合集成	发明专利	一种半导体器件及其制作方法	ZL202210941301.9	2022/08/08	原始取得
180	晶合集成	发明专利	一种半导体结构的制造方法及半导体结构	ZL202210844521.X	2022/07/19	原始取得
181	晶合集成	发明专利	一种半导体器件的制作方法	ZL202210941307.6	2022/08/08	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
182	晶合集成	发明专利	一种 efuse 单元结构以及存储器	ZL20221096466 4.4	2022/08/12	原始取得
183	晶合集成	实用新型	一种晶圆盒检测系统	ZL2022130444 6.X	2022/05/27	原始取得
184	晶合集成	发明专利	存储器及其形成方法	ZL20221096585 9.0	2022/08/12	原始取得
185	晶合集成	发明专利	晶圆键合方法以及背照式图像传感器的形成方法	ZL20221085035 9.2	2022/07/20	原始取得
186	晶合集成	发明专利	晶圆结构及芯片良率检测方法	ZL20221102589 0.2	2022/08/25	原始取得
187	晶合集成	发明专利	一种晶圆的刻蚀方法及系统	ZL20221098392 2.3	2022/08/17	原始取得
188	南京、晶合集成	发明专利	一种测试结构及测试方法	ZL20221085074 0.9	2022/07/20	原始取得
189	晶合集成	发明专利	一种高压器件的形成方法及高压器件	ZL20221084501 2.9	2022/07/19	原始取得
190	晶合集成	发明专利	一种测试结构	ZL20221108138 8.3	2022/09/06	原始取得
191	晶合集成	发明专利	半导体器件及其制备方法	ZL20221084477 5.1	2022/07/19	原始取得
192	晶合集成	发明专利	一种版图图形的修正方法及系统	ZL20221100291 7.6	2022/08/22	原始取得
193	晶合集成	实用新型	一种晶圆的分析设备	ZL20222204324 4.0	2022/08/04	原始取得
194	晶合集成	发明专利	3D CMOS 图像传感器及其形成方法	ZL20221085036 3.9	2022/07/20	原始取得
195	晶合集成	发明专利	金属线的去层方法以及器件缺陷检测方法	ZL20191056884 4.9	2019/06/27	原始取得
196	晶合集成	发明专利	目标结构晶圆获取方法、装置、设备及存储介质	ZL20221099182 8.2	2022/08/18	原始取得
197	晶合集成	实用新型	一种外加式流量测装置、混合设备及清洗机	ZL20222238923 2.3	2022/09/08	原始取得
198	晶合集成	实用新型	一种漏液侦测设备	ZL20222239452 6.5	2022/09/07	原始取得
199	晶合集成	发明专利	半导体器件的制备方法	ZL20221106777 4.7	2022/09/02	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
200	晶合集成	实用新型	一种漏液侦测设备	ZL20222237609 9.8	2022/09/07	原始取得
201	晶合集成	发明专利	一种掩模板及形成方法	ZL20221103675 9.6	2022/08/29	原始取得
202	晶合集成	发明专利	一种电容器及其制备方法	ZL20221105995 6.X	2022/09/01	原始取得
203	晶合集成	发明专利	图像传感器及其制作方法	ZL20221105992 0.1	2022/09/01	原始取得
204	晶合集成	发明专利	一种芯片的失效分析方法及系统	ZL20221119476 6.9	2022/09/29	原始取得
205	晶合集成	实用新型	一种湿法刻蚀机	ZL20222229146 6.4	2022/08/30	原始取得
206	晶合集成	实用新型	一种电子激发组件、电离装置及离子植入机	ZL20222237567 9.5	2022/09/07	原始取得
207	晶合集成	发明专利	栅极结构的制作方法	ZL20221125027 0.9	2022/10/13	原始取得
208	晶合集成	发明专利	栅极结构的制作方法	ZL20221125026 9.6	2022/10/13	原始取得
209	晶合集成	发明专利	一种半导体结构及其制作方法	ZL20221113373 6.7	2022/09/19	原始取得
210	晶合集成	实用新型	一种半导体设备功率匹配器的连接装置	ZL20222219975 0.9	2022/08/18	原始取得
211	晶合集成	发明专利	CMOS 图像传感器的制作方法	ZL20221117049 5.3	2022/09/26	原始取得
212	晶合集成	发明专利	一种半导体结构的制作方法	ZL20221121958 9.5	2022/10/08	原始取得
213	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL20201098315 5.7	2020/09/18	原始取得
214	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL20201100144 6.8	2020/09/22	原始取得
215	北京晶芯成	发明专利	SRAM 器件及其形成方法	ZL20201099849 5.7	2020/09/22	原始取得
216	北京晶芯成	发明专利	半导体器件及其制造方法	ZL20201101242 6.0	2020/09/24	原始取得
217	北京晶芯成	发明专利	一种浅沟槽隔离结构的制作方法	ZL20201102104 6.3	2020/09/25	原始取得
218	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL20201101941 1.7	2020/09/25	原始取得
219	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL20201103942 2.1	2020/09/28	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
220	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其形成方法	ZL202011059138.0	2020/09/30	原始取得
221	北京晶芯成	发明专利	一种金属互连结构的形成方法	ZL202011054620.5	2020/09/30	原始取得
222	北京晶芯成	发明专利	LD MOS 晶体管及其制造方法	ZL202011054657.8	2020/09/30	原始取得
223	北京晶芯成	发明专利	浅沟槽隔离结构的制造方法及其形成的浅沟槽隔离结构	ZL202011069600.5	2020/10/09	原始取得
224	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆表面处理方法和表面处理装置	ZL202011069584.X	2020/10/09	原始取得
225	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011069193.8	2020/10/09	原始取得
226	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202011073751.8	2020/10/10	原始取得
227	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆背封结构及其制造方法	ZL202011084965.5	2020/10/12	原始取得
228	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法与制造系统	ZL202011081316.X	2020/10/12	原始取得
229	北京晶芯成	发明专利	测试结构及其测试方法	ZL202011106814.5	2020/10/16	原始取得
230	北京晶芯成	发明专利	一种沟槽的形成方法	ZL202011106813.0	2020/10/16	原始取得
231	北京晶芯成	发明专利	半导体器件的制备方法	ZL202011106699.1	2020/10/16	原始取得
232	北京晶芯成	发明专利	一种沟槽的形成方法	ZL202011106690.0	2020/10/16	原始取得
233	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202011106407.4	2020/10/16	原始取得
234	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202011106406.X	2020/10/16	原始取得
235	北京晶芯成	发明专利	一种介质层缺陷检测的测试结构	ZL202011114851.0	2020/10/19	原始取得
236	北京晶芯成	发明专利	一种电介质击穿测试结构	ZL202011114835.1	2020/10/19	原始取得
237	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆中心的校正方法及系统	ZL202011114387.5	2020/10/19	原始取得
238	北京晶芯成	发明专利	Nor 闪存结构及其制作方法	ZL202011122506.1	2020/10/20	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
239	北京晶芯成	发明专利	半导体器件	ZL20201112248 8.7	2020/10/20	原始取得
240	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆电性测试方法及测试设备	ZL20201112161 4.7	2020/10/20	原始取得
241	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法	ZL20201113646 4.7	2020/10/22	原始取得
242	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法	ZL20201113646 3.2	2020/10/22	原始取得
243	北京晶芯成	发明专利	一种半导体装置的制备方法	ZL20201113614 7.5	2020/10/22	原始取得
244	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法及点胶装置	ZL20201113558 9.8	2020/10/22	原始取得
245	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL20201113535 9.1	2020/10/22	原始取得
246	北京晶芯成	发明专利	半导体数据分析方法、系统及计算机可读存储介质	ZL20201116022 9.3	2020/10/27	原始取得
247	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构	ZL20201115956 7.5	2020/10/27	原始取得
248	北京晶芯成	发明专利	SONOS 存储器及其制造方法	ZL20201115956 6.0	2020/10/27	原始取得
249	北京晶芯成	发明专利	隔离结构的制作方法、DAC 器件及其制作方法	ZL20201115955 6.7	2020/10/27	原始取得
250	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制备方法	ZL20201115937 7.3	2020/10/27	原始取得
251	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制造方法	ZL20201117604 0.3	2020/10/29	原始取得
252	北京晶芯成	发明专利	半导体隔离结构及其制作方法	ZL20201118471 2.5	2020/10/30	原始取得
253	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的结构及其制备方法	ZL20201120728 8.1	2020/11/03	原始取得
254	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL20201120728 4.3	2020/11/03	原始取得
255	北京晶芯成	发明专利	LD MOS 晶体管及其制造方法	ZL20201120649 7.4	2020/11/03	原始取得
256	北京晶芯成	发明专利	MIM 电容器的制作方法	ZL20201120649 6.X	2020/11/03	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
257	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202011213725.0	2020/11/04	原始取得
258	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202011213310.3	2020/11/04	原始取得
259	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202011213304.8	2020/11/04	原始取得
260	北京晶芯成	发明专利	一种静态随机存取存储器及其制造方法	ZL202011235571.5	2020/11/09	原始取得
261	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆清洗位置的监测装置及监测方法	ZL202011235545.2	2020/11/09	原始取得
262	北京晶芯成	发明专利	气体置换装置及光阻烘烤设备	ZL202011243682.0	2020/11/10	原始取得
263	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构及其形成方法、半导体器件的测试方法	ZL202011243675.0	2020/11/10	原始取得
264	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构及半导体钝化层的质量测试方法	ZL202011242883.9	2020/11/10	原始取得
265	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制造方法	ZL202011251097.5	2020/11/11	原始取得
266	北京晶芯成	发明专利	一种洁净室过滤装置	ZL202011249788.1	2020/11/11	原始取得
267	北京晶芯成	发明专利	半导体隔离结构及其制作方法	ZL202011275119.1	2020/11/16	原始取得
268	北京晶芯成	发明专利	一种自动调整半导体设备平衡性的装置及方法	ZL202011283036.7	2020/11/17	原始取得
269	北京晶芯成	发明专利	一种半导体设备的报警方法	ZL202011283029.7	2020/11/17	原始取得
270	北京晶芯成	发明专利	功率半导体器件及制造方法	ZL202011333530.X	2020/11/25	原始取得
271	北京晶芯成	发明专利	一种光学邻近校正模型的建模方法及建模系统	ZL202011359576.9	2020/11/27	原始取得
272	北京晶芯成	发明专利	半导体生产过程中的参数监控方法、系统及计算机可读存储介质	ZL202011367625.3	2020/11/30	原始取得
273	北京晶芯成	发明专利	半导体产品的良率分析方法及良	ZL202011384551.4	2020/12/02	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			率分析系统			
274	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆失效的分析方法及系统	ZL202011419830.X	2020/12/08	原始取得
275	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011424911.9	2020/12/09	原始取得
276	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011565146.2	2020/12/25	原始取得
277	北京晶芯成	发明专利	一种曝光位置的确定方法及系统	ZL202011579234.8	2020/12/28	原始取得
278	北京晶芯成	发明专利	半导体存储器件	ZL202011572842.6	2020/12/28	原始取得
279	北京晶芯成	发明专利	ESD 保护电路、ESD 保护结构及其制造方法	ZL202110010268.3	2021/01/06	原始取得
280	北京晶芯成	发明专利	半导体器件的形成方法	ZL202110010266.4	2021/01/06	原始取得
281	北京晶芯成	发明专利	化学机械研磨方法	ZL202110051576.0	2021/01/15	原始取得
282	北京晶芯成	发明专利	一种集成半导体器件	ZL202110248935.1	2021/03/08	原始取得
283	北京晶芯成	发明专利	静态随机存储器的制备方法	ZL202110252700.X	2021/03/09	原始取得
284	北京晶芯成	发明专利	一种化学机械研磨方法及其分析系统	ZL202110281539.9	2021/03/16	原始取得
285	北京晶芯成	发明专利	一种半导体元件的制造方法	ZL202110306176.X	2021/03/23	原始取得
286	北京晶芯成	发明专利	半导体器件及其制造方法	ZL202110397617.1	2021/04/14	原始取得
287	北京晶芯成	发明专利	3D 半导体器件及其形成方法	ZL202110574826.9	2021/05/26	原始取得
288	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202110816834.X	2021/07/20	原始取得
289	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202110575021.6	2021/05/26	原始取得
290	北京晶芯成	发明专利	一种电介质击穿测试电路及其测试方法	ZL202110421520.X	2021/04/20	原始取得
291	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202011106408.9	2020/10/16	原始取得
292	北京晶芯成	发明专利	沟槽隔离结构的制备方法	ZL202110252703.3	2021/03/09	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
293	北京晶芯成	发明专利	一种 LDMOS 晶体管及其形成方法	ZL202110921916.0	2021/08/12	原始取得
294	北京晶芯成	发明专利	沟槽隔离结构及其制备方法	ZL202110921908.6	2021/08/12	原始取得
295	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202111036002.2	2021/09/06	原始取得
296	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202111103889.2	2021/09/22	原始取得
297	北京晶芯成	发明专利	半导体器件及制造方法	ZL202111083665X	2022/01/28	原始取得
298	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202111125376.1	2022/02/28	原始取得
299	北京晶芯成	发明专利	图像传感器及其制备方法	ZL202111417363.1	2022/02/08	原始取得
300	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202111436365.5	2022/02/11	原始取得
301	北京晶芯成	发明专利	MOM 电容器及集成电路装置	ZL202111118330.7	2022/02/11	原始取得
302	北京晶芯成	发明专利	一种用于气体分流模组的拆除治具及方法	ZL202111417349.1	2021/11/26	原始取得
303	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202111513751.X	2022/03/22	原始取得
304	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202111514590.6	2021/12/13	原始取得
305	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆检测方法及其检测装置	ZL202111616331.4	2021/12/28	原始取得
306	北京晶芯成	发明专利	自动化质量管控系统、方法及计算机可读存储介质	ZL202111514086.6	2021/12/13	原始取得
307	北京晶芯成	发明专利	一种阶梯沟槽横向绝缘栅双极型晶体管结构及制造方法	ZL202111513776.X	2021/12/13	原始取得
308	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种半导体版图的监控方法及系统	ZL202210076385.4	2022/01/24	原始取得
309	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种半导体隔离结构的制造方法	ZL202210089156.6	2022/01/26	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
310	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种半导体结构的制作方法	ZL20221007689 3.2	2022/01/24	原始取得
311	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种通信发射装置、系统、制造方法及电子设备	ZL20221014844 1.0	2022/02/18	原始取得
312	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	半导体器件结构	ZL20221012695 3.7	2022/02/11	原始取得
313	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种失效芯片的剥层方法	ZL20221027498 0.9	2022/03/21	原始取得
314	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种半导体装置及其制造方法	ZL20221012345 7.6	2022/02/10	原始取得
315	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	一种半导体器件及其制作方法	ZL20221029228 5.5	2022/03/24	原始取得
316	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	集成器件及其制作方法	ZL20221027974 0.8	2022/03/22	原始取得
317	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	半导体器件的制造方法	ZL20221029217 8.2	2022/03/24	原始取得
318	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	多次可编程存储器及其制备方法	ZL20221037647 6.X	2022/04/12	原始取得
319	北京晶芯成、晶合集成	发明专利	半导体结构及其形成方法	ZL20221037648 6.3	2022/04/12	原始取得
320	南京晶驱	发明专利	晶圆裂片方法及其应用	ZL20201093174 0.2	2020/09/08	原始取得
321	南京晶驱	发明专利	一种检测半导体设备检测感度的方法和检测系统	ZL20201093852 6.X	2020/09/09	原始取得
322	南京晶驱	发明专利	一种光阻层阻挡能力的检测方法及其检测系统	ZL20201093776 8.7	2020/09/09	原始取得
323	南京晶驱	发明专利	一种半导体器件制造方法	ZL20201093851 9.X	2020/09/09	原始取得
324	南京晶驱	发明专利	刻蚀方法	ZL20201099851 2.7	2020/09/22	原始取得
325	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构	ZL20201100577	2020/09/23	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			的制备方法	3.0		
326	南京晶驱	发明专利	一种浅沟槽结构制备方法	ZL20201101295 9.9	2020/09/24	原始取得
327	南京晶驱	发明专利	半导体结构的制备方法	ZL20201101343 9.X	2020/09/24	原始取得
328	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL20201093776 9.1	2020/09/09	原始取得
329	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL20201102179 8.X	2020/09/25	原始取得
330	南京晶驱	发明专利	一种浅沟槽隔离结构的制造方法	ZL20201101994 7.9	2020/09/25	原始取得
331	南京晶驱	发明专利	半导体结构的制造方法	ZL20201101930 2.5	2020/09/25	原始取得
332	南京晶驱	发明专利	电容器及其制备方法	ZL20201103714 3.1	2020/09/28	原始取得
333	南京晶驱	发明专利	一种静电放电防护线路	ZL20201109992 6.2	2020/10/15	原始取得
334	南京晶驱	发明专利	半导体器件的制备方法	ZL20201109352 8.X	2020/10/14	原始取得
335	南京晶驱	发明专利	一种版图边界图案的修正方法与修正系统	ZL20201109523 7.4	2020/10/14	原始取得
336	南京晶驱	发明专利	MOS 晶体管及其制造方法	ZL20201109359 9.X	2020/10/14	原始取得
337	南京晶驱	发明专利	电容的测量结构及测量方法	ZL20201109359 8.5	2020/10/14	原始取得
338	南京晶驱	发明专利	一种光刻图形的仿真方法及仿真系统	ZL20201113535 1.5	2020/10/22	原始取得
339	南京晶驱	发明专利	图形显影情况的检测方法	ZL20201118900 7.4	2020/10/30	原始取得
340	南京晶驱	发明专利	光强阈值的获取方法以及辅助图形显影情况的检测方法	ZL20201118501 8.5	2020/10/30	原始取得
341	南京晶驱	发明专利	辅助图形的添加方法、装置及测试版图	ZL20211049263 2.4	2021/05/07	原始取得
342	南京晶驱	发明专利	光学临近修正方法、装置及电子设备	ZL20211075459 3.0	2021/07/05	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
343	南京晶驱	发明专利	光学邻近修正模型的建模方法	ZL20211095188 8.7	2021/08/19	原始取得
344	南京晶驱	发明专利	预测图形桥联的方法、装置及电子设备	ZL20211095188 1.5	2021/08/19	原始取得
345	南京晶驱	发明专利	一种光学临近效应的修正方法及系统	ZL20211081683 0.1	2021/07/20	原始取得
346	新晶集成	发明专利	优化图像传感器死线的方法及图像传感器	ZL20221072247 4.1	2022/06/24	原始取得
347	新晶集成	发明专利	目标图像的更新方法及系统、晶圆检测方法和计算机设备	ZL20221073369 3.X	2022/06/27	原始取得
348	新晶集成	发明专利	晶圆清洗系统及方法	ZL20221073861 2.5	2022/06/28	原始取得
349	新晶集成	发明专利	对准标记图形的识别方法及装置、计算机设备和存储介质	ZL20221100324 0.8	2022/08/22	原始取得

4、境外专利

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
1	晶合有限	发明专利	Method for automatically controlling defect - specification in a semiconductor manufacturing process	US 6,807,454 B2	2003/03/17	继受取得	美国
2	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing semiconductor device with formation of a heavily doped region by implantation through an insulation layer	US 6,670,254 B1	2002/10/01	继受取得	美国
3	晶合有限	发明专利	Semiconductor device formed on silicon-on-insulator substrate	US 6,828,633 B2	2003/02/26	继受取得	美国
4	晶合有限	发明专利	Silicon-on-insulator device structure	US 7,019,582 B2	2004/09/29	继受取得	美国
5	晶合有限	发明专利	Method for producing a gate	US 6,699,755 B1	2003/03/24	继受取得	美国
6	晶合有限	发明专利	Half-tone phase shift mask and patterning method using thereof	US 7,461,472 B2	2003/06/16	继受取得	美国
7	晶合有限	发明专利	Method of improving a resolution of contact hole patterns by utilizing alternate phase shift principle	US 7,008,733 B2	2003/09/25	继受取得	美国
8	晶合有限	发明专利	Re-performable spin-on process	US 6,881,590 B2	2003/08/25	继受取得	美国
9	晶合有限	发明专利	Method for fabricating a through hole on a semiconductor substrate	US 6,995,086 B2	2004/06/28	继受取得	美国
10	晶合有限	发明专利	Method for forming a titanium nitride layer	US 7,030,015 B2	2004/09/16	继受取得	美国
11	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing	US 7,056,787 B2	2005/01/12	继受取得	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			semiconductor device				
12	晶合有限	发明专利	Method of forming contact hole and method of fabricating semiconductor device	US 7,098,124 B2	2005/05/31	继受取得	美国
13	晶合有限	发明专利	Semiconductor device having self-aligned contact	US 7,612,433 B2	2005/09/21	继受取得	美国
14	晶合有限	发明专利	Manufacturing method of semiconductor device having self-aligned contact	US 7,803,692 B2	2009/09/18	继受取得	美国
15	晶合有限	发明专利	Method of fabricating conductive lines with silicide layer	US 7,550,372 B2	2005/08/29	继受取得	美国
16	晶合有限	发明专利	Method for forming buried doped region	US 7,465,632 B2	2005/10/28	继受取得	美国
17	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing self-aligned contact openings	US 7,429,527 B2	2007/09/11	继受取得	美国
18	晶合有限	发明专利	Method of fabricating semiconductor device	US 7,268,055 B2	2005/11/07	继受取得	美国
19	晶合有限	发明专利	Method for manufacturing gate dielectric layer	US 7,273,787 B2	2005/11/18	继受取得	美国
20	晶合有限	发明专利	Method for forming contact window	US 8,722,538 B2	2012/09/12	继受取得	美国
21	晶合有限	发明专利	Method for manufacturing semiconductor device	US 8,822,303 B2	2012/09/15	继受取得	美国
22	晶合有限	发明专利	SPLIT-GATE NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATION METHOD THEREOF	US10,636,801 B2	2018/11/25	原始取得	美国
23	晶合有限	发明专利	METHOD OF FORMING METAL SILICIDE LAYER, SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FABRICATING	US10,490,647 B1	2018/08/31	原始取得	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			SAME				
24	晶合有限	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY CELL, ARRAY AND FABRICATION METHOD	US10,726,894 B2	2018/11/25	原始取得	美国
25	晶合有限	发明专利	SILICON ISLAND STRUCTURE AND METHOD OF FABRICATING SAME	US 10,490,441 B1	2018/10/18	原始取得	美国
26	晶合有限	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME	US 10,854,758 B2	2019/02/18	原始取得	美国
27	晶合集成	发明专利	Pre-processing method, method for forming metal silicide and semiconductor processing apparatus	US10,916,417B 2	2020/06/16	原始取得	美国
28	晶合集成	发明专利	METHOD OF FABRICATING MOSFET	US10,957,776B 2	2020/05/21	原始取得	美国
29	晶合集成	发明专利	METHOD FOR FORMING SEMICONDUCTOR STRUCTURE	US10,930,545B 2	2019/06/27	原始取得	美国
30	晶合集成	发明专利	CURRENT SOURCE USING EMITTER REGION AS BASE REGION ISOLATION STRUCTURE	US10,950,601B 2	2019/04/15	原始取得	美国
31	晶合集成	发明专利	MOSFET AND METHOD OF FABRICATING SAME	US10,971,595B 2	2018/12/17	原始取得	美国
32	晶合集成	发明专利	DIFFUSED FIELD-EFFECT TRANSISTOR AND METHOD OF FABRICATING SAME	US11,024,722B 1	2020/03/25	原始取得	美国
33	晶合集成	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING	US10,916,664B 2	2020/09/19	原始取得	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			METHOD FOR THE SAME				
34	晶合集成	发明专利	SEMICONDUCTOR STRUCTURE AND METHOD OF FORMING SAME	US11,069,559B1	2020/06/22	原始取得	美国
35	晶合集成	发明专利	METHOD FOR FABRICATING SPLIT-GATE NON-VOLATILE MEMORY	US11,088,155B2	2020/03/18	原始取得	美国
36	晶合集成	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME	US11,049,947B2	2019/11/07	原始取得	美国
37	晶合集成	发明专利	SEMICONDUCTOR STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	US11,257,668B2	2020/07/01	原始取得	美国
38	晶合集成	发明专利	WAFER ANNEALING METHOD	US11,348,781B2	2020/07/10	原始取得	美国
39	晶合集成	发明专利	Method for manufacturing Semiconductor Element	US11,398,411B2	2020/06/19	原始取得	美国
40	晶合集成	发明专利	SEMICONDUCTOR STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	US11,404,328B2	2020/07/23	原始取得	美国
41	晶合集成	发明专利	METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE AND SEMICONDUCTOR DEVICE THEREBY FORMED	US11,437,281B2	2020/04/16	原始取得	美国
42	晶合集成	发明专利	以交替式相位移原理改善接触洞图案解析度之方法	I313889	2003/07/21	继受取得	中国台湾
43	晶合集成	发明专利	制作通孔的方法	I240988	2004/01/07	继受取得	中国台湾
44	晶合集成	发明专利	浅沟渠隔离结构的制造方法	I234228	2004/05/12	继受取得	中国台湾
45	晶合集成	发明专利	具有自行对准接触窗	I254409	2005/02/16	继受	中国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			之半导体元件及其制造方法			取得	台湾
46	晶合集成	发明专利	导线的制造方法	I254365	2005/01/27	继受取得	中国台湾
47	晶合集成	发明专利	自行对准接触窗开口的制作方法	I301997	2005/06/17	继受取得	中国台湾
48	晶合集成	发明专利	半导体元件及其制造方法	I267190	2005/08/29	继受取得	中国台湾
49	晶合集成	发明专利	隔离结构的制造方法	I300968	2006/06/28	继受取得	中国台湾
50	晶合集成	发明专利	光罩复验方法与系统	I305004	2006/07/17	继受取得	中国台湾
51	晶合集成	发明专利	管制规格界限之制定方法	I305838	2006/09/29	继受取得	中国台湾
52	晶合集成	发明专利	分离闸极快闪记忆体的故障检测方法	I301982	2006/09/28	继受取得	中国台湾
53	晶合集成	发明专利	接触窗的形成方法	I473206	2012/07/03	继受取得	中国台湾
54	晶合集成	发明专利	半导体元件的制造方法	I464831	2012/06/27	继受取得	中国台湾
55	晶合集成	发明专利	分栅式非挥发性记忆体及其制备方法	I720350	2018/10/09	原始取得	中国台湾
56	晶合集成	发明专利	预处理方法、金属硅化物的形成方法以及半导体处理装置	I739473	2020/06/11	原始取得	中国台湾
57	晶合集成	发明专利	晶圓的退火方法	I755775	2020/06/24	原始取得	中国台湾
58	晶合集成	发明专利	一种套刻标记、套刻标记方法及套刻测量方法	I775382	2021/04/09	原始取得	中国台湾
59	晶合集成	发明专利	半導體結構及其製造方法	I777422	2020/07/24	原始取得	中国台湾
60	晶合集成	发明专利	ラッチ回路	特许第 6761074 号	2019/05/21	原始取得	日本
61	晶合集成	发明专利	SRAM、半導體集積回路及び LCD ドライバ	特许第 6801053 号	2019/06/19	原始取得	日本
62	晶合集成	发明专利	容量性半導體素子	特许第 6831067 号	2019/04/25	原始取得	日本
63	晶合集成	发明专利	半導體素子の製造方法	特许第 6826795 号	2019/01/09	原始取得	日本
64	晶合集成	发明专利	高耐压半導體素子及	特许第 6892889	2019/04/15	原始	日本

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			びその製造方法	号		取得	
65	晶合集成	发明专利	容量性半導体素子	特许第 6918173号	2020/04/23	原始取得	日本
66	晶合集成	发明专利	半導体テスト構造	特许第 7094344号	2020/10/27	原始取得	日本
67	晶合集成	发明专利	半導体装置、及びその製造方法	特许第 7171650号	2020/05/27	原始取得	日本

北京市金杜律师事务所

关于

合肥晶合集成电路股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

律师工作报告

2021年4月

目 录

释 义	4
引 言	8
一、 本所及经办律师简介	8
二、 本所制作本次发行上市律师工作报告和《法律意见书》的工作过程	9
正 文	13
一、 本次发行上市的批准和授权	13
二、 发行人本次发行上市的主体资格	16
三、 本次发行上市的实质条件	17
四、 发行人的设立	20
五、 发行人的独立性	24
六、 发起人和股东	27
七、 发行人的股本及其演变	94
八、 发行人的业务	108
九、 关联交易及同业竞争	110
十、 发行人的主要财产	132
十一、 发行人的重大债权债务	140
十二、 发行人重大资产变化及收购兼并	146
十三、 发行人公司章程的制定与修改	146
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	148
十五、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化	149
十六、 发行人的税务	156
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准	157

十八、 发行人的劳动及社会保障.....	164
十九、 发行人募集资金的运用.....	166
二十、 发行人业务发展目标.....	167
二十一、 诉讼、仲裁或行政处罚.....	167
二十二、 本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施.....	169
二十三、 发行人《招股说明书（申报稿）》法律风险的评价.....	171
二十四、 关于本次发行上市的总体结论性意见.....	171
附件：发行人及其子公司拥有的知识产权.....	173

释 义

在本律师工作报告内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

金杜/本所	指	北京市金杜律师事务所
公司/发行人/晶合集成	指	合肥晶合集成电路股份有限公司
晶合有限	指	发行人前身合肥晶合集成电路有限公司
日本晶合	指	晶合日本株式会社，发行人全资子公司
北京晶芯成	指	晶芯成（北京）科技有限公司，发行人全资子公司
南京晶驱	指	南京晶驱集成电路有限公司，发行人全资子公司
上海晶合	指	合肥晶合集成电路股份有限公司上海分公司，发行人分公司
合肥建投	指	合肥市建设投资控股（集团）有限公司
合肥芯屏	指	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）
力晶科技	指	力晶科技股份有限公司
美的创新	指	美的创新投资有限公司
中安智芯	指	合肥中安智芯股权投资合伙企业（有限合伙）
惠友豪创	指	深圳市惠友豪创投资合伙企业（有限合伙）
合肥存鑫	指	合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙）
海通创新	指	海通创新证券投资有限公司
杭州承富	指	杭州承富投资管理合伙企业（有限合伙）
泸州隆信	指	泸州隆信投资合伙企业（有限合伙）
宁波华淳	指	宁波华淳投资管理合伙企业（有限合伙）
中小企业基金	指	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）
安华创新	指	安徽安华创新风险投资基金有限公司
集创北方	指	北京集创北方科技股份有限公司
中金浦成	指	中金浦成投资有限公司
合肥晶煅	指	合肥晶煅企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶遂	指	合肥晶遂企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶炯	指	合肥晶炯企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶咖	指	合肥晶咖企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶珏	指	合肥晶珏企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶梢	指	合肥晶梢企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台

合肥晶柔	指	合肥晶柔企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶悬	指	合肥晶悬企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶本	指	合肥晶本企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶洛	指	合肥晶洛企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶辽	指	合肥晶辽企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶确	指	合肥晶确企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶铁	指	合肥晶铁企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶妥	指	合肥晶妥企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶雄	指	合肥晶雄企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶策	指	合肥晶策企业管理有限公司，为发行人员工持股平台的管理机构
保荐机构/中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
容诚	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中水致远	指	中水致远资产评估有限公司
A股	指	境内上市人民币普通股
本次发行上市	指	发行人首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
合肥市市监局	指	合肥市市场监督管理局
合肥市工商局	指	原合肥市工商行政管理局，现已整合为合肥市市监局
合肥市国资委	指	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
《合资合同》	指	根据上下文意所需，指当时有效的《关于合肥晶合集成电路有限公司之合资合同》
《发起人协议》	指	合肥建投、合肥芯屏、力晶科技、美的创新、中安智芯、惠友豪创、合肥存鑫、海通创新、杭州承富、泸州隆信、宁波华淳、中小企业基金、安华创新、集创北方、中金浦成、合肥晶焯、合肥晶遂、合肥晶炯、合肥晶咖、合肥晶珏、合肥晶梢、合肥晶柔、合肥晶悬、合肥晶本、合肥晶洛、合肥晶辽、合肥晶确、合肥晶铁、合肥晶妥、合肥晶雄于2020年11月5日共同签署的《合肥晶合集成电路股份有限公司发起人协议》
《公司章程》	指	根据上下文意所需，指当时有效的《中外合资经营企业合肥

		晶合集成电路有限公司章程》、《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》
《发行人章程》	指	发行人为本次发行上市而修订的公司章程，经发行人于 2021 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第三次会议及于 2021 年 3 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，自发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市之日起生效实施
《股东大会议事规则》	指	发行人于 2020 年 11 月 20 日召开的创立大会审议通过的《合肥晶合集成电路股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	发行人于 2020 年 11 月 20 日召开的创立大会审议通过的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	发行人于 2020 年 11 月 20 日召开的创立大会审议通过的《合肥晶合集成电路股份有限公司监事会议事规则》
《独立董事工作制度》	指	发行人于 2020 年 11 月 20 日召开的第一届董事会第一次会议审议通过的《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》
《关联交易实施细则》	指	发行人于 2020 年 11 月 20 日召开的创立大会审议通过的《合肥晶合集成电路股份有限公司关联交易实施细则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2018 修正）》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2019 修订）》
《注册管理办法》	指	《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《编报规则第 12 号》	指	《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发[2001]37 号）
《证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国司法部令第 41 号）
《证券法律业务执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国司法部公告[2010]33 号）
《私募基金登记备案办法》	指	中国证券投资基金业协会于 2014 年 1 月 17 日发布并于 2014 年 2 月 7 日实施的《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（中基协发[2014]1 号）
《私募基金管理办法》	指	中国证监会于 2014 年 8 月 21 日发布并实施的《私募投资基金监督管理暂行办法》（中国证券监督管理委员会令第 105 号）
台湾理律	指	理律法律事务所新竹事务所
台湾杰宇	指	杰宇法律事务所
日本律师	指	King & Wood Mallesons Law Offices (Foreign Law Joint Enterprise)
本律师工作报告	指	《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》
《法律意见书》	指	《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》

《台湾理律法律意见书》	指	台湾理律于 2021 年 4 月 20 日出具的关于晶合集成的法律意见书
《台湾杰宇法律意见书》	指	台湾杰宇于 2021 年 1 月 22 日出具的关于力晶科技的法律意见书
《日本法律意见书》	指	日本律师于 2021 年 3 月 12 日出具的关于日本晶合的法律意见书
《审计报告》	指	容诚为本次发行上市于 2021 年 2 月 9 日出具的《审计报告》（[2021]230Z0089），包括后附的经审计的发行人的财务报表及其附注
《内控报告》	指	容诚为本次发行上市于 2021 年 2 月 9 日出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司内部控制鉴证报告》（[2021]230Z0141）
《主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》	指	容诚为本次发行上市于 2021 年 2 月 9 日出具的《主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》（[2021]230Z0143）
《招股说明书（申报稿）》	指	《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》
报告期/最近三年	指	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
中国香港	指	中华人民共和国香港特别行政区
中国台湾	指	中华人民共和国台湾地区
中国	指	中华人民共和国（为本律师工作报告之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）
元	指	人民币元

注：本律师工作报告所列出的数据可能因四舍五入原因与根据本律师工作报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

致：合肥晶合集成电路股份有限公司

本所接受发行人委托，作为发行人本次发行上市的专项法律顾问，根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》和《编报规则第 12 号》等中国现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本律师工作报告。

本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和证监会的有关规定以及本律师工作报告出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行上市相关事项进行了充分的核查验证，保证本律师工作报告所认定的事实真实、准确、完整，对本次发行上市所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

引 言

一、本所及经办律师简介

金杜成立于一九九三年，是中国最早设立的合伙制律师事务所之一。金杜总部设在北京，办公室分布于北京、上海、深圳、广州、海口、三亚、杭州、苏州、南京、青岛、济南、成都、重庆和香港特别行政区。在中国内地及香港特别行政区，金杜拥有 400 多名合伙人和 1,700 多名专业法律人员。在中国，金杜为客户提供综合性、全方位、“一站式”的法律服务，业务领域涉及银行融资、公司、跨境并购、证券与资本市场、诉讼仲裁、知识产权、企业合规、金融服务、金融科技、国际基金、私募股权投资、能源、资源与基础设施、医疗健康与医药、娱乐、媒体与高科技、互联网领域等。

本所为发行人本次发行上市出具《法律意见书》和本律师工作报告的经办律师为苏峥律师和刘东亚律师，其主要证券业务执业记录、主要经历及联系方式如下：

（一）苏峥律师

苏峥律师作为金杜金融证券部合伙人，主要从事证券、公司、收购兼并业务等领域的法律业务。

苏峥律师的律师执业证号为 11101200511447116。苏峥律师作为签字律师，主办的项目包括：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国人民保险集团股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、富士康工业互联网股份有限公司、中国铁塔股份有限公司、索通发展股份有限公司等公司的 A 股及/或 H 股发行上市及/或再融资项目。

苏峥律师毕业于对外经济贸易大学。苏峥律师的联系方式为：电话：（010）5878 5588，传真：（010）5878 5566，电子邮箱：suzheng@cn.kwm.com。

（二）刘东亚律师

刘东亚律师作为金杜金融证券部合伙人，主要从事企业改制及境内外上市、上市公司并购重组及再融资、私募投资等领域的法律业务。

刘东亚的律师执业证号为 13101200511553626。刘东亚律师主要参与的项目包括：上海硅产业集团股份有限公司、北京赛微电子股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海电影股份有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司、苏州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、杭州启明医疗器械股份有限公司、光大证券股份有限公司等公司的 A 股及/或 H 股发行上市及/或再融资项目。

刘东亚律师毕业于对外经济贸易大学。刘东亚律师的联系方式为：电话：（021）2412 6186，传真：（021）2412 6150，电子邮箱：liudongya@cn.kwm.com。

二、本所制作本次发行上市律师工作报告和《法律意见书》的工作过程

为保证发行人本次发行上市的合法性，本所接受发行人委托，为发行人本次发行上市出具本律师工作报告和《法律意见书》。本所制作本律师工作报告和《法律意见书》的工作过程包括：

（一）了解发行人基本情况并编制查验计划，提交尽职调查文件清单

本所接受发行人委托担任本次发行上市的专项法律顾问后，依据《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》和中国证监会的其他有关规定，结合发行人实际情况编制了查验计划，确定了查验事项、查验工作程序和查验方法，并就查验事项向发行人提交了全面的法律尽职调查文件清单，详细了解发行人的历史沿革、股权结构及其演变、股东和实际控制人、主营业务、关联交易及同业竞争、主要财产、重大债权债务、重大资产、董事和高级管理人员、公司治理、组织结构、劳动人事、规范运作（含工商、税务等）、诉讼仲裁等情况。上述法律尽职调查文件清单包括了出具本律师工作报告和《法律意见书》所需调查的所有方面的详细资料及相关文件的提交指引。本所向发行人认真解释了法律尽职调查的要求和责任，并逐项回答了发行人提出的问题，使其充分了解法律尽职调查的目的、过程、方式及严肃性。

（二）落实查验计划，制作工作底稿

为全面落实查验计划，本所组成专门的工作组，收集相关法律文件和证据资料，在发行人保证提供了本所为出具本律师工作报告所要求发行人提供的文件和材料（包括原始书面材料、副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料，无论该等资料是通过电子邮件、移动硬盘传输、项目工作网盘或开放内部文件系统访问权限等各互联网传输和接收等方式所获取的）是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所提供的副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签名、印章是真实的，并已履行该等签名和盖章所需的法律程序，获得合法授权；所有的口头陈述和说明均与事实一致的基础上，本所独立、客观、公正地遵循审慎性及重要性原则，合理、充分地运用了面谈、书面审查、实地调查、查询或复核等方式进行查验，对发行人提供的材料之性质和效力进行了必要的分析和判断，以查证和确认有关事实。在查验过程中，本所工作组不时对查验计划的落实进度、效果等进行评估和总结，视情况进行适当调整，多次向发行人提交补充尽职调查文件清单。

本所按照《证券法律业务执业规则》的要求，独立、客观、公正地就业务事项是否与法律相关、是否应当履行法律专业人士特别注意义务作出了分析、判断。对需要履行法律专业人士特别注意义务的事项，本所拟定了履行义务的具体方式、手段和措施，并逐一落实；对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务。本所对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构等机构直接取得的文书，按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；对于不是从前述机构直接取得的文书，经查验后作为出具法律意见的依据。本所对于从前述机构抄录、复制的材料，经该机构确认，并按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；未取得前述机构确认的，对相关内容进行查验后作为出具法律意见的依据。从不同来源获取的证据材料或者通过不同查验方式获取的证据材料，对同一事项所证明的结论不一致的，本所追加了必要的程序作进一步查证。

结合查验工作，本所协助发行人建立了专业的法律资料库。查验工作结束后，本所对查验计划的落实情况进行了评估和总结，认为查验计划得到了全面落实。本所将尽职调查中收集到的重要文件资料和查验过程中制作的书面记录、面谈和查询笔录、回复函等归类成册，完整保存出具本律师工作报告和《法律意见书》过程中形成的工作记录，以及在工作中获取的所有文件、资料，及时制作成工作底稿，作为本律师工作报告和为本次发行上市出具《法律意见书》的基础材料。

（三）协助发行人解决有关法律问题，参与对发行人的辅导工作

针对尽职调查和查验工作中发现的问题，本所通过备忘录和其他形式，及时向发行人提出了相应的建议和要求，督促与协助发行人依法予以解决。本所还根据保荐机构的安排，对发行人董事、监事、高级管理人员进行了《公司法》《证券法》等相关法律法规的培训，协助发行人依法规范运作。

（四）参与发行人本次发行上市的准备工作

本所全程参与了发行人本次发行上市的现场工作，出席中介机构协调会和相关专题会议，与发行人和其他中介机构一起，拟定发行上市方案和实施计划。为协助发行人完善法人治理结构，满足首次公开发行股票和上市的条件，本所协助发行人按照相关法律法规的要求，制定和修改了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事

规则》《监事会议事规则》等一系列公司治理文件，并督促发行人实际执行。本所还参与了《招股说明书（申报稿）》有关内容的讨论和修改，审阅了相关申请文件。

（五）内核小组复核

本所内核小组对查验计划及其落实情况、工作底稿的制作情况、工作过程中相关问题的解决情况、本律师工作报告和《法律意见书》的制作情况等，进行了认真的讨论和复核。经办律师根据内核意见，修改完善了本律师工作报告和《法律意见书》。

（六）出具本律师工作报告和《法律意见书》

截至本律师工作报告出具日，本所已就发行人本次发行上市工作投入工作时间累计约 3600 小时。基于上述工作，本所按照《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》的要求查验相关材料和事实、对相关法律问题进行认真分析和判断后，制作本律师工作报告。本所确保其内容真实、准确、完整，逻辑严密、论证充分。

正文

一、本次发行上市的批准和授权

（一）本次发行上市的批准

根据发行人提供的第一届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会的会议通知、会议议案及会议决议并经本所律师核查，发行人于 2021 年 2 月 9 日召开第一届董事会第三次会议，会议审议通过《关于合肥晶合集成电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案；发行人于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过《关于合肥晶合集成电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。发行人股东大会逐项审议通过的本次发行上市方案，具体内容如下：

1、发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元；

2、发行股票的数量：本次公司拟公开发行股票数量不超过 501,533,789 股（占本次发行后公司总股本的 25%），且不低于发行完成后公司总股本的 10%。本次发行上市授予主承销商不超过前述发行股票数量 15% 的超额配售选择权，在全额行使超额配售选择权的情况下，公司本次发行股票数量不超过 576,763,857 股（占本次发行后公司总股本的 27.71%）。最终发行股票的数量以中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等有权监管机构核准并注册的数量为准；

3、发行对象：经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者（以下统称“网下投资者”）和符合法律法规规定的自然人、法人及其他投资者（法律法规或监管机构禁止的购买者除外）；

4、发行方式：本次发行全部采取发行新股的方式。本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管机构认可的其他发行方式（包括但不限于向保荐机构依法设立的相关子公司、公司高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划等法律法规允许的投资者配售股票）；

5、定价方式：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向网下投资者询价的方式或者法律法规或监管机构认可的其他方式确定发行价格；

6、承销方式：采取由主承销商或主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票；

7、发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定；

8、股票上市地：上交所科创板；

9、决议有效期：本次发行上市有关决议自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

经本所律师核查，发行人第一届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本所认为，发行人本次发行上市已获得公司 2020 年年度股东大会的批准，该次股东大会的召开程序、决议内容合法有效。

（二）本次发行上市的授权

发行人 2020 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》，授权董事会及其授权人士（董事长蔡国智先生、董事会秘书朱才伟先生）全权办理本次发行上市有关具体事宜，包括但不限于：

1、根据本次发行上市有关法律、法规或规范性文件的变化情况、监管机构关于本次发行上市政策的变化情况及监管机构意见、市场环境等对本次发行上市方案进行修改完善并组织具体实施，包括但不限于确定发行规模、发行比例、发行方式、定价方

式、发行对象、发行价格、公司重大承诺事项、战略配售、超额配售事宜、发行时间、网上网下发行数量比例、变更上市地点、其他与本次发行上市方案实施有关的具体事宜以及暂停、终止发行方案的实施等（依据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定必须由股东大会重新表决的事项除外）；

2、根据本次发行上市方案，就本次发行上市相关事宜向监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意、注册等手续；签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织等提交各项与本次发行上市有关的所有必要文件；根据需要在本次发行上市前确定募集资金专用账户；

3、起草、修改、签署、递交、刊发、披露、执行、中止、终止与本次发行上市有关的协议、合同、公告或其他文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、战略配售协议、上市协议、中介服务协议等）；聘请保荐机构、承销商、律师事务所、会计师事务所、资产评估师、行业咨询顾问、收款银行及其他与本次发行上市有关的中介机构等；决定和支付本次发行上市的相关费用；

4、对于股东大会、董事会审议通过的公司因本次发行上市的需要而根据法律、法规及其他规范性文件制定、修改的公司章程及其它公司治理文件、公司上市后股东分红回报三年规划、公司上市后三年稳定股价预案、公司上市摊薄即期回报及填补措施等申请文件内容，根据法律、法规及其他规范性文件的变化情况、有关监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况进行调整和修改；在 A 股发行完毕后对公司章程中有关公司注册资本、股权结构等条款作出相应的修改，及向市场监督管理部门等其他相关政府部门办理变更、备案、登记事宜；办理申请人民币普通股（A 股）股票在证券交易所挂牌上市的有关事宜；

5、根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管机构的意见，在符合法律法规规定的前提下对募集资金投资项目进行适当变更和调整，包括但不限于确定募集资金投资项目的投资计划进度，募集资金使用时的具体分配比例，根据募集资金投资项目的实施时机，在募集资金到位前可以自筹资金先行投入，待募集资金到位后置换先行投入的资金等；确定募集资金存放的银行及专用账户，批准、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

6、根据本次发行实际情况，向市场监督管理部门等有关监管机构办理公司注册资本变更的登记及备案手续等事宜，向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记结算等事宜，包括但不限于股份发行登记、股份流通锁定等事宜；

7、在不违反相关法律法规的情况下，办理其认为与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的其他一切事宜，包括但不限于根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定以及本次发行上市的实际需要，作出相关的承诺；

8、本授权有效期与首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的有效期限一致。

经本所律师核查，发行人股东大会已授权董事会办理本次发行上市事宜，上述授权范围、程序合法有效。

综上，本所认为，发行人本次发行上市已获得发行人内部的批准及授权；发行人本次发行尚待上交所科创板股票上市委员会审核，并报中国证监会履行发行注册程序；本次发行完成后，发行人股票于上交所上市交易尚待获得上交所审核同意。

二、发行人本次发行上市的主体资格

（一）发行人发行上市的主体资格

发行人系由晶合有限按照经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，自 2015 年 5 月 19 日晶合有限成立之日起计算，发行人持续经营时间已超过 3 年。

发行人现持有合肥市市场监管局于 2020 年 11 月 25 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q），注册资本：人民币 1,504,601,368 元；住所：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号；法定代表人：蔡国智；公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）；成立日期：2015 年 5 月 19 日；营业期限：长期；经营范围：集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人依法有效存续

根据本所律师登录国家企业信用信息公示系统进行查询与检索，发行人自设立至今依法有效存续，不存在因营业期限届满、股东大会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的需要终止的情形。

（三）发行人的组织机构

发行人已依据《公司法》等法律法规设立了股东大会、董事会和监事会，在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并建立了独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会工作制度，聘请了高级管理人员，设置了若干职能部门。发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

综上，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条之规定，发行人具备本次发行上市的主体资格。

三、本次发行上市的实质条件

（一）本次发行上市符合《证券法》的相关条件

1、发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事和董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

2、根据《审计报告》、发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》、发行人及其境内子公司相关主管部门出具的证明及发行人书面说明，截至本律师工作报告出具日，发行人依法存续，不存在因违法经营而被相关主管部门责令停业整顿或吊销营业执照的情形，不存在根据法律、法规及《公司章程》规定需要终止的情形。发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

3、根据《审计报告》，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

4、根据发行人及其子公司所在地公安机关出具的证明、发行人控股股东填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》及发行人书面说明，并经本所律师登录中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）、人民法院公告网（<http://rmfygg.court.gov.cn>）、中国检察网（<http://www.12309.gov.cn>）等网站查询，发行人及其控股股东最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

（二）本次发行上市符合《注册管理办法》规定的相关条件

1、如本律师工作报告“二、发行人本次发行上市的主体资格”所述，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

2、根据《审计报告》《内控报告》和发行人书面说明，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具标准无保留意见的《审计报告》；根据《内控报告》和发行人书面说明，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具标准无保留意见的《内控报告》，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

（1）如本律师工作报告“五、发行人的独立性”所述，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立；如本律师工作报告“九、关联交易及同业竞争”所述，发行人与控股股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项之规定。

（2）如本律师工作报告“八、发行人的业务”所述，发行人的主营业务最近两年内未发生重大不利变化；如本律师工作报告“十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”所述，发行人的董事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内未发生重大不利变化；如本律师工作报告“六、发起人和股东”所述，发行人的股权

权属清晰，控股股东和受控股股东支配的股东持有的发行人股份权属清晰，最近两年控制权稳定、实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项之规定。

（3）如本律师工作报告“十、发行人的主要财产”“十一、发行人的重大债权债务”及“二十一、诉讼、仲裁或行政处罚”所述，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项之规定。

4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策：

（1）如本律师工作报告“八、发行人的业务”所述，根据工商、税务等相关政府部门出具的证明文件和发行人书面说明，经本所律师核查，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定。

（2）如本律师工作报告“二十一、诉讼、仲裁或行政处罚”所述，根据发行人及其子公司所在地相关政府部门出具的证明文件、发行人控股股东填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》及发行人书面说明，并经本所律师核查，最近三年内，发行人及其控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

（3）如本律师工作报告“二十一、诉讼、仲裁或行政处罚”所述，根据发行人董事、监事和高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》及其在中国证监会安徽监管局诚信信息查询结果并访谈发行人董事、监事和高级管理人员，经本所律师核查，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第三款的规定。

（三）本次发行上市符合《上市规则》规定的相关条件

1、本次发行上市符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》规定的发行条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定。

2、根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》及《招股说明书（申报稿）》，本次发行上市后股本总额不少于 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

3、根据《招股说明书（申报稿）》和本次发行上市相关股东大会决议，发行人股本总额超过 4 亿元，本次发行完成后，发行人公开发行的股份数将达到本次发行后发行人股份总数的 10%以上，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

4、根据《审计报告》、保荐机构出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司预计市值的分析报告》及发行人书面说明，发行人申请本次发行上市，预计市值不低于 30 亿元，且最近一年营业收入不低于 3 亿元，符合《上市规则》第 2.1.2 条第（四）项规定的市值和财务指标标准及第 2.1.1 条第（四）项的规定。

综上，本所认为，发行人具备本次发行上市的实质条件。

四、发行人的设立

（一）发行人设立的程序、方式

发行人系由晶合有限整体变更设立的股份有限公司，其整体变更为股份有限公司时履行了以下程序：

2020 年 10 月 19 日，容诚出具《审计报告》（容诚审字[2020]230Z3994 号），经审计，截至 2020 年 9 月 30 日，晶合有限账面净资产值为 7,353,140,545.50 元。

2020 年 10 月 21 日，中水致远出具《合肥晶合集成电路有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第 020502 号）。根据该报告，截至 2020 年 9 月 30 日，晶合有限的净资产评估值为 918,198.75 万元。2020 年 11 月 9 日，合肥市国资委就上述资产评估项目基本情况及资产评估结果出具了《国有资产评估项目备案表》。

2020年10月21日，晶合有限召开董事会，同意公司整体变更为股份公司的方案，公司全体股东作为发起人以公司按截至2019年9月30日经容诚审计的账面净资产值7,353,140,545.50元为基础，按1:0.204620比例折合1,504,601,368股，公司的注册资本变更为1,504,601,368元，资本公积和未分配利润在整体变更前后保持不变。

2020年11月5日，晶合有限全体股东签署《合肥晶合集成电路股份有限公司发起人协议》。

2020年11月20日，晶合有限召开创立大会，审议通过《关于合肥晶合集成电路股份有限公司筹备情况的报告的议案》《关于合肥晶合集成电路股份有限公司筹备费用的报告的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司章程>的议案》等议案，选举产生第一届董事会董事、第一届监事会监事，并授权公司董事会办理工商注册登记及相关事宜。

2020年11月20日，容诚出具《验资报告》（容诚验字[2020]第230Z0263号），对晶合有限整体变更为股份有限公司的情况予以审验。

2020年11月25日，合肥市市监局向晶合集成换发《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q）。根据合肥市人民政府办公厅发布的《加快推进“三证合一”登记制度改革工作方案》相关规定，发行人取得由工商行政管理部门核发的营业执照后，无需另行申领税务登记证书。

综上，本所认为，发行人设立的程序、方式等符合有关法律、法规和规范性文件的规定，发行人已完成工商登记注册和税务登记相关程序，整体变更相关事项符合《公司法》等法律法规规定。

（二）发行人的设立资格和条件

经本所律师核查，发行人具备《公司法》第七十六条、第七十八条规定的股份有限公司设立的资格和条件，具体如下：

- 1、发起人共有30名，符合法定人数，且半数以上在中国境内有住所；

2、发起人缴纳的注册资本为 1,504,601,368 元，符合《公司章程》规定的全体发起人认购的股本总额；

3、发起人将其在晶合有限的权益所对应的净资产投入发行人，并折算为各发行人所持有的发行人的股份，整体变更后的股本与整体变更前的注册资本保持一致，资本公积和未分配利润在整体变更前后保持不变，股份发行、筹办事项符合法律规定；

4、发起人共同签署《公司章程》；

5、发行人有公司名称，并且设立了股东大会、董事会、监事会、总经理等股份有限公司应当具备的组织机构；

6、发行人注册于安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号，具有公司住所。

综上，本所认为，发行人设立的资格、条件等符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人设立过程中签订的改制重组合同

经本所律师核查，发行人不存在国有企业、集体企业改制而来的或历史上存在挂靠集体组织经营的情形。2020 年 11 月 5 日，晶合有限全体股东签署《发起人协议》，约定了改制方案，股份公司的名称、住所，公司的经营宗旨和经营范围，公司设立的方式、组织形式，公司注册资本、股份总额、发起人认购股份的数额、形式及期限，发起人的权利和义务，费用承担等重要事项。

本所认为，《发起人协议》的签署符合有关法律、法规和规范性文件规定，不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷。

（四）发行人设立过程中的审计、资产评估及验资事项

1、发行人设立过程中的审计事项

根据容诚于 2020 年 10 月 19 日出具的以 2020 年 9 月 30 日为基准日的《审计报告》（容诚审字[2020]230Z3994 号），截至 2020 年 9 月 30 日，晶合有限账面净资产值为 7,353,140,545.50 元。

2、发行人设立过程中的资产评估事项

根据中水致远于 2020 年 10 月 21 日出具的以 2020 年 9 月 30 日为基准日的《合肥晶合集成电路有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第 020502 号），截至 2020 年 9 月 30 日，晶合有限的净资产评估值为 918,198.75 万元。2020 年 11 月 9 日，合肥市国资委就上述资产评估项目基本情况及资产评估结果出具了《国有资产评估项目备案表》。

3、发行人设立过程中的验资事项

根据容诚于 2020 年 11 月 20 日出具的《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0263 号），晶合集成登记的注册资本为人民币 1,504,601,368 元，由晶合有限全体股东以其拥有的晶合有限截至 2020 年 9 月 30 日止的净资产缴纳 7,353,140,545.50 元，并按照 1:0.204620 比例折合股本 1,504,601,368 元，整体变更后的股本与整体变更前的注册资本保持一致，资本公积和未分配利润在整体变更前后保持不变。

综上，本所认为，发行人设立过程中有关审计、资产评估、验资等已履行了必要程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（五）发行人创立大会的程序及所议事项

根据发行人提供的创立大会会议通知、议案及决议并经本所律师核查，发行人于 2020 年 11 月 20 日召开创立大会，审议通过《关于合肥晶合集成电路股份有限公司筹办情况的报告的议案》《关于合肥晶合集成电路股份有限公司筹办费用的报告的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司章程>的议案》《关于选举合肥晶合集成电路股份有限公司第一届董事会成员的议案》《关于选举合肥晶合集成电路股份有限公司第一届监事会成员的议案》《关于合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事薪酬的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司董事会议事规则>

的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司关联交易实施细则>的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司对外投资管理制度>的议案》《关于设置董事会专门委员会的议案》《关于授权办理合肥晶合集成电路股份有限公司设立相关事宜的议案》。

经核查，本所认为，发行人创立大会的程序及所议事项符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

（六）改制中是否存在侵害债权人合法权益情形

2020年10月21日，晶合有限召开董事会，同意公司整体变更为股份公司的方案，整体变更后的注册资本为1,504,601,368元，未高于晶合有限经审计的净资产额7,353,140,545.50元，同时，公司的一切资产及债权、债务，由依法变更后的股份公司继承，不存在通过自身资产的调整或者企业间资产转移等行为侵害债权人合法利益的情形。

经查询中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等，截至本律师工作报告出具日，发行人不存在改制中侵害债权人合法权益而导致的纠纷。

综上，本所认为，发行人改制中不存在侵害债权人合法权益的情形，发行人不存在改制中侵害债权人合法权益而导致的纠纷。

五、发行人的独立性

（一）发行人的业务独立

根据发行人提供的业务合同台账、订单台账及重大业务合同、订单等相关文件资料和发行人书面说明，经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，发行人依法经营，发行人独立开展业务并对外签署合同，其业务独立于发行人控股股东及其控制的其他企业。如本律师工作报告“九、关联交易及同业竞争”所述，截至本律师工作报告

出具日，发行人与控股股东及其控制的其他企业不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响发行人独立性或显失公平的关联交易。

本所认为，截至本律师工作报告出具日，发行人的业务独立。

（二）发行人的资产独立、完整

根据容诚出具的《审计报告》《验资报告》、发行人提供的工商档案文件、相关资产权属证明等文件和发行人书面说明，经本所律师核查，发行人不存在部分资产来自于上市公司的情形；发行人设立及历次增资时的出资均已经会计师事务所验资，发行人的注册资本已足额缴纳。如本律师工作报告“十、发行人的主要财产”所述，发行人具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；发行人主要生产经营厂房系向控股股东下属子公司合肥蓝科投资有限公司租赁，相关厂房以租赁方式提供给公司使用系合肥市人民政府与力晶科技合作初始确定的招商引资政策之一，发行人能够长期使用上述厂房、土地，不会对发行人正常生产经营造成重大不利影响。

本所认为，截至本律师工作报告出具日，发行人的资产独立、完整。

（三）发行人的人员独立

根据发行人高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》和发行人书面说明，经本所律师核查，报告期内，发行人存在合肥建投、力晶科技向发行人委派高级管理人员的情形，具体包括：合肥建投曾向发行人委派销售副总监周义亮（曾兼任采购副总监），采购副总监王继武，总会计师朱才伟，审计师、敬业管理委员会委员长、行政副总朱晓娟，审计师、敬业管理委员会委员长杨幼玲；力晶科技曾向发行人委派副总会计师邱垂源、李洳谕，行政副总经理刘荫，审计师陈美华、潘炯升。截至本律师工作报告出具日，公司高级管理人员均由公司聘任并在公司专职工作。

截至本律师工作报告出具日，发行人的总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的

其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

本所认为，截至本律师工作报告出具日，发行人的人员独立。

（四）发行人的机构独立

根据《内控报告》《公司章程》等公司内部治理文件和发行人书面说明，经本所律师核查，发行人已按照《公司法》及《公司章程》的规定，设立股东大会、董事会及其专门委员会、监事会等机构，聘请高级管理人员，发行人按照自身经营管理的需要设置了相关职能部门，已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

本所认为，截至本律师工作报告出具日，发行人的机构独立。

（五）发行人的财务独立

根据《内控报告》、发行人财务会计制度和发行人书面说明，经本所律师通过对发行人财务负责人访谈等方式进行核查，发行人设立了独立的财务部门，已建立独立的财务会计核算体系，能够独立作出财务决策；发行人具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度；发行人依法独立设立账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

本所认为，截至本律师工作报告出具日，发行人的财务独立。

（六）发行人具有面向市场自主经营的能力

根据《内控报告》、发行人说明以及本所律师对发行人经营场所的实地调查结果，经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，发行人主要从事 12 英寸晶圆代工业务；发行人拥有业务经营所需的资质许可，独立从事经营范围内的业务，其业务独立于发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系；发行人具有健全的内部组织结构，独立地面向市场进行经营活动。

本所认为，截至本律师工作报告出具日，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

综上，本所认为，截至本律师工作报告出具日，发行人拥有业务经营所需的资质许可，独立从事经营范围内的业务，其业务独立于发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人的业务独立、人员独立、财务独立、机构独立、资产独立完整，具有面向市场自主经营的能力。

六、发起人和股东

（一）发起人的资格

根据发行人提供的工商档案资料，并经本所律师核查，发行人整体变更为股份有限公司的发起人共 30 名，分别为合肥建投、合肥芯屏、力晶科技、美的创新、中安智芯、惠友豪创、合肥存鑫、海通创新、杭州承富、泸州隆信、宁波华淳、中小企业基金、安华创新、集创北方、中金浦成、合肥晶煨、合肥晶遂、合肥晶炯、合肥晶咖、合肥晶珏、合肥晶梢、合肥晶柔、合肥晶悬、合肥晶本、合肥晶洛、合肥晶辽、合肥晶确、合肥晶铁、合肥晶妥、合肥晶雄，该等发起人分别以其持有的晶合有限股权所对应的净资产作为对发行人的出资，各发起人基本情况如下：

1、合肥建投

（1）基本情况

合肥建投是一家依据中国法律成立的有限责任公司，发行人设立时合肥建投持有发行人股份的比例为 31.14%。

根据合肥建投持有的《营业执照》、现行有效的公司章程，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，合肥建投的基本情况如下：

名称：	合肥市建设投资控股（集团）有限公司
住所：	合肥市滨湖新区武汉路 229 号
统一社会信用代码：	91340100790122917R
法定代表人：	李宏卓
注册资本：	1,329,800 万元
公司类型：	有限责任公司（国有独资）

经营范围：	承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）
营业期限：	2006年6月16日至2056年5月12日

（2）股东情况

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，合肥建投的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥市国资委	1,329,800.00	100.00
	合计	1,329,800.00	100.00

2、合肥芯屏

（1）基本情况

合肥芯屏是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，发行人设立时合肥芯屏持有发行人股份的比例为21.85%。

根据合肥芯屏持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，合肥芯屏的基本情况如下：

名称：	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）
主要经营场所：	合肥市包河区武汉路229号
统一社会信用代码：	91340111MA2MRYQY4Y
执行事务合伙人：	合肥建投资本管理有限公司
类型：	有限合伙企业
经营范围：	投资管理、资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限：	2016年1月18日至2026年1月14日

（2）合伙人情况

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，合肥芯屏的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	合肥建投资本管理有限公司	普通合伙人	1,000.00	0.04
2	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	有限合伙人	1,159,000.00	47.44
3	合肥瀚和投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,033,125.00	42.29
4	合肥瀚屏投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	250,000.00	10.23
合计		-	2,443,125.00	100.00

（3）私募基金备案情况

根据合肥芯屏提供的《私募投资基金备案证明》等资料，并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站（<http://gs.amac.org.cn>），合肥芯屏基金管理人合肥建投资本管理有限公司已于 2016 年 9 月 19 日办理私募基金管理人登记（登记编号为 P1033786），合肥芯屏已于 2016 年 12 月 8 日办理私募基金备案（备案编码：SM7232）。本所认为，合肥芯屏已按照《私募基金管理办法》和《私募基金登记备案办法》履行了私募投资基金备案程序。

3、力晶科技

（1）基本情况

力晶科技是一家依据台湾地区法律成立的股份有限公司，发行人设立时力晶科技持有发行人股份的比例为 27.44%。

力晶科技于 2019 年经过业务重组将其晶圆代工业务转让至力晶积成电子制造股份有限公司（以下简称力积电），重组完成后，力晶科技成为控股型公司。截至 2021 年 4 月 7 日，力晶科技直接持有力积电 26.82% 的股权。根据力晶科技注册登记文件、现行有效的公司章程，力晶科技的基本情况如下：

名称:	力晶科技股份有限公司
公司统一编号:	84149385
注册地区:	中国台湾
注册办事处地址:	台北市中山区南京东路3段70号15楼
注册日期:	1994年12月20日
核定股本股数:	15,000,000,000股
核定股本金额:	新台币150,000,000,000元

2021年1月，台湾杰宇出具法律意见书，认为：“力晶科技系依台湾法律组织设立并良好存续之股份有限公司”，“力晶科技在台湾地区并无涉及对其财务、业务、运营或资产有重大不利影响的现有或可能发生之诉讼、仲裁、行政争讼、调查或类似法律程序。”

(2) 股东情况

根据力晶科技公开披露的2019年年报，截至2020年4月29日，力晶科技的前十大股东的持股情况如下：

序号	股东	持股数量(股)	股权比例(%)
1	黄崇仁	150,267,935.00	4.74
2	瑞圣股份有限公司	39,728,436.00	1.25
3	智丰科技股份有限公司	38,627,865.00	1.22
4	陈嘉益	27,240,724.00	0.86
5	世成科技股份有限公司	23,672,905.00	0.75
6	仁典投资股份有限公司	23,074,453.00	0.73
7	智翔投资股份有限公司	21,788,164.00	0.69
8	汇丰托管凯基代理人(香港)有限公司专户	21,216,912.00	0.67
9	元隆投资有限公司	20,105,086.00	0.63
10	林纬程	18,468,384.00	0.58
合计		384,190,864.00	12.12

4、美的创新

(1) 基本情况

美的创新是一家依据中国法律成立的有限责任公司，发行人设立时美的创新持有发行人股份的比例为 5.85%。

根据美的创新持有的《营业执照》、现行有效的公司章程，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，美的创新的基本情况如下：

名称：	美的创新投资有限公司
住所：	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
统一社会信用代码：	91440300335090909A
法定代表人：	刘啸
注册资本：	10,000 万元
公司类型：	有限责任公司
经营范围：	一般经营项目是：投资管理及咨询；企业资产管理、投资顾问服务（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。
营业期限：	永续经营

(2) 股东情况

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，美的创新的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	美的集团股份有限公司	8,500.00	85.00
2	佛山市美的空调工业投资有限公司	1,500.00	15.00
	合计	10,000.00	100.00

(3) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据美的创新填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》及出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项の確認函》、发行人董事、监事及高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，美的创新于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，美的创新的增资价格及定价依据等情况详见

本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。截至本律师工作报告出具日，美的创新的实际控制人为何享健。美的创新与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。美的创新持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

5、中安智芯

（1）基本情况

中安智芯是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，发行人设立时中安智芯持有发行人股份的比例为 2.63%。

根据中安智芯持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，中安智芯的基本情况如下：

名称：	合肥中安智芯股权投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：	安徽省合肥市高新区望江西路 860 号创新大厦 B 座 11 楼
统一社会信用代码：	91340100MA2W5JBC7E
执行事务合伙人：	安徽创谷股权投资基金管理有限公司
类型：	有限合伙企业
经营范围：	股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等相关金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限：	2020 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 1 日

（2）合伙人情况

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，中安智芯的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	安徽创谷股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	450.00	0.99
2	安徽省量子科学产业发展基金有限公司	有限合伙人	20,000.00	44.00
3	安徽省铁路发展基金股份有限公司	有限合伙人	20,000.00	44.00
4	安徽省中安金融资产管理股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	11.00
合计		-	45,450.00	100.00

(3) 私募基金备案情况

根据中安智芯提供的《私募投资基金备案证明》等资料，并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站（<http://gs.amac.org.cn>），中安智芯基金管理人安徽创谷股权投资基金管理有限公司于 2018 年 7 月 25 日办理私募基金管理人登记（登记编号为 P1068748），中安智芯已于 2020 年 9 月 24 日办理私募基金备案（备案编码：SLY251）。本所认为，中安智芯已按照《私募基金管理办法》和《私募基金登记备案办法》履行了私募投资基金备案程序。

(4) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据中安智芯填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》及出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项の確認函》、发行人董事、监事及高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，中安智芯于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，中安智芯的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。截至本律师工作报告出具日，中安智芯无实际控制人。中安智芯与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。中安智芯持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

6、惠友豪创

(1) 基本情况

惠友豪创是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，发行人设立时惠友豪创持有发行人股份的比例为 1.75%。

根据惠友豪创持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，惠友豪创的基本情况如下：

名称：	深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期）8号楼 606A-15
统一社会信用代码：	91440300MA5G7CPA2R
执行事务合伙人：	深圳市惠友创盈投资管理有限公司
类型：	有限合伙企业
经营范围：	一般经营项目是：科技项目投资（不含限制类项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；科技信息咨询。
合伙期限：	永续经营

(2) 合伙人情况

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，惠友豪创的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市惠友创盈投资管理有限公司	普通合伙人	0.01	0.00001
2	杨庆	有限合伙人	50,000.00	41.67
3	周祥书	有限合伙人	12,000.00	10.00
4	杨林	有限合伙人	10,000.00	8.33
5	深圳市创荟投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8,800.00	7.33
6	共青城坤翎豪创投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7,200.00	6.00
7	孙义强	有限合伙人	5,000.00	4.17
8	刘晨露	有限合伙人	5,000.00	4.17
9	深圳市伯翰创盈信息服务合伙企业	有限合伙人	5,000.00	4.17

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	(有限合伙)			
10	深圳市瑞成永泽投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000.00	4.17
11	深圳市创欣诚创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000.00	4.17
12	深圳市前海君爵投资管理有限公司	有限合伙人	5,000.00	4.17
13	苏州锦天前程投资管理中心(有限合伙)	有限合伙人	1,000.00	0.83
14	深圳市新思哲投资管理有限公司	有限合伙人	1,000.00	0.83
	合计	-	120,000.01	100.00

(3) 私募基金备案情况

根据惠友豪创提供的《私募投资基金备案证明》等资料，并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站（<http://gs.amac.org.cn>），惠友豪创的基金管理人深圳市惠友创盈投资管理有限公司已于 2015 年 9 月 29 日办理私募基金管理人登记（登记编号 P1023992），惠友豪创已于 2020 年 6 月 24 日办理私募基金备案（备案编码：SLE922）。本所认为，惠友豪创已按照《私募基金管理办法》和《私募基金登记备案办法》履行了私募投资基金备案程序。

(4) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据惠友豪创填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》及出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项の確認函》、发行人董事、监事及高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，惠友豪创于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，惠友豪创的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。截至本律师工作报告出具日，惠友豪创实际控制人为杨龙忠。惠友豪创与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。惠友豪创持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

7、合肥存鑫

(1) 基本情况

合肥存鑫是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，发行人设立时合肥存鑫持有发行人股份的比例为 1.75%。

根据合肥存鑫持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，合肥存鑫的基本情况如下：

名称：	合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：	安徽省合肥市高新区创新产业园二期 G4 幢 C 座 401 室
统一社会信用代码：	91340100MA2UYMDW82
执行事务合伙人：	苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）
类型：	有限合伙企业
经营范围：	股权投资；创业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限：	2020 年 7 月 2 日至 2026 年 7 月 1 日

(2) 合伙人情况

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，合肥存鑫的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）	普通合伙人	100.00	0.33
2	甘肃上峰水泥股份有限公司	有限合伙人	25,000.00	83.06
3	王强	有限合伙人	5,000.00	16.61
	合计	-	30,100.00	100.00

(3) 私募基金备案情况

根据合肥存鑫提供的《私募投资基金备案证明》等资料，并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站（<http://gs.amac.org.cn>），合肥存鑫的基金管理人苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）已于 2018 年 2 月 11 日办理私募基金管理人登记（登记编号：P1067353），合肥存鑫已于 2020 年 9 月 24 日办理私募基金备案（备案编码：SLX942）。本所认为，合肥存鑫已按照《私募基金管理办法》和《私募基金登记备案办法》履行了私募投资基金备案程序。

（4）申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据合肥存鑫填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》及出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项の確認函》、发行人董事、监事及高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，合肥存鑫于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，合肥存鑫的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。截至本律师工作报告出具日，合肥存鑫实际控制人为李海涛。合肥存鑫与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。合肥存鑫持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

8、海通创新

（1）基本情况

海通创新是一家依据中国法律成立的有限责任公司，发行人设立时海通创新持有发行人股份的比例为 1.17%。

根据海通创新持有的《营业执照》、现行有效的公司章程，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，海通创新的基本情况如下：

名称：	海通创新证券投资有限公司
住所：	上海市静安区常德路 774 号 2 幢 107N 室

统一社会信用代码:	91310000594731424M
法定代表人:	时建龙
注册资本:	830,000 万元
公司类型:	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:	证券投资，金融产品投资，股权投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限:	2012年4月24日至无固定期限

（2）股东情况

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，海通创新的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	海通证券股份有限公司	830,000.00	100.00
	合计	830,000.00	100.00

（3）申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据海通创新填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》及出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项の確認函》、发行人董事、监事及高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，海通创新于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，海通创新的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。截至本律师工作报告出具日，海通创新无实际控制人。海通创新与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。海通创新持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

9、杭州承富

（1）基本情况

杭州承富是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，发行人设立时杭州承富持有发行人股份的比例为 1.02%。

根据杭州承富持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，杭州承富的基本情况如下：

名称：	杭州承富投资管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：	浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 958 号科创大楼 1 幢 301-306-05 室
统一社会信用代码：	91330185MA28WBUF65
执行事务合伙人：	杭州东方嘉富资产管理有限公司
类型：	有限合伙企业
经营范围：	资产管理、股权投资、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限：	2017 年 7 月 28 日至长期

（2）合伙人情况

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，杭州承富的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	杭州东方嘉富资产管理有限公司	普通合伙人	200.00	1.00
2	西藏新华长江投资有限公司	有限合伙人	6,000.00	30.00
3	杭州戎富投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,800.00	19.00
4	深圳久悦投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,350.00	16.75
5	杭州驰富投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	10.00
6	安徽长安开元投资有限公司	有限合伙人	2,000.00	10.00
7	曾乐民	有限合伙人	1,000.00	5.00
8	安徽华柏利华投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	5.00

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
9	上海元仁企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	650.00	3.25
合计		-	20,000.00	100.00

（3）私募基金备案情况

根据杭州承富提供的《私募投资基金备案证明》等资料，并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站（<http://gs.amac.org.cn>），杭州承富的基金管理人杭州东方嘉富资产管理有限公司已于 2016 年 9 月 8 日办理私募基金管理人登记（登记编号：P1033503），杭州承富已于 2020 年 8 月 17 日办理私募基金备案（备案编码：SLR006）。本所认为，杭州承富已按照《私募基金管理办法》和《私募基金登记备案办法》履行了私募投资基金备案程序。

（4）申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据杭州承富填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》及出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项の確認函》、发行人董事、监事及高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，杭州承富于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，杭州承富的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。截至本律师工作报告出具日，杭州承富实际控制人为陈万翔。杭州承富与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。杭州承富持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

10、泸州隆信

（1）基本情况

泸州隆信是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，发行人设立时泸州隆信持有发行人股份的比例为 0.88%。

根据泸州隆信持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，泸州隆信的基本情况如下：

名称：	泸州隆信投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：	四川自贸区川南临港片区临港大道1段一带一路国家馆603号
统一社会信用代码：	91510504MA69EXG8X7
执行事务合伙人：	泸州璞泉私募股权投资基金管理有限公司
类型：	有限合伙企业
经营范围：	股权投资；投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限：	2020年5月19日至长期

（2）合伙人情况

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，泸州隆信的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	泸州璞泉私募股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.62
2	青岛启泰一号创业投资中心（有限合伙）	普通合伙人	100.00	0.62
3	王士明	有限合伙人	3,000.00	18.63
4	上海中房建筑设计有限公司	有限合伙人	3,000.00	18.63
5	四川璞信产融投资有限责任公司	有限合伙人	2,900.00	18.01
6	黄海翔	有限合伙人	2,200.00	13.66
7	陈越强	有限合伙人	1,950.00	12.11
8	君汇（日照）股权投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	6.21
9	陕西西电高科中低压开关有限公司	有限合伙人	500.00	3.11
10	沈雄杰	有限合伙人	300.00	1.86
11	上海亮轩企业管理咨询有限公司	有限合伙人	300.00	1.86
12	慈溪怡海企业管理咨询有限	有限合伙人	200.00	1.24

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	公司			
13	宁波东盈环境建设发展有限公司	有限合伙人	200.00	1.24
14	李梦迪	有限合伙人	150.00	0.93
15	曹雪丽	有限合伙人	100.00	0.62
16	陈葵	有限合伙人	100.00	0.62
	合计	-	16,100.00	100.00

(3) 私募基金备案情况

根据泸州隆信提供的《私募投资基金备案证明》等资料，并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站（<http://gs.amac.org.cn>），泸州隆信的基金管理人泸州璞泉私募股权投资基金管理有限公司已于 2018 年 7 月 12 日办理私募基金管理人登记（登记编号：P1068660），泸州隆信已于 2020 年 9 月 21 日办理私募基金备案（备案编码：SLV278）。本所认为，泸州隆信已按照《私募基金管理办法》和《私募基金登记备案办法》履行了私募投资基金备案程序。

(4) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据泸州隆信填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》及出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项の確認函》、发行人董事、监事及高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，泸州隆信于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，泸州隆信的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。截至本律师工作报告出具日，泸州隆信实际控制人为泸州市国有资产监督管理委员会。泸州隆信与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。泸州隆信持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

11、宁波华淳

(1) 基本情况

宁波华淳是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，发行人设立时宁波华淳持有发行人股份的比例为 0.88%。

根据宁波华淳持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，宁波华淳的基本情况如下：

名称：	宁波华淳投资管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E0604
统一社会信用代码：	91330206MA2AENWU8D
执行事务合伙人：	华泰宝利投资管理有限公司
类型：	有限合伙企业
经营范围：	投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
合伙期限：	2017 年 9 月 29 日至 2037 年 9 月 28 日

（2）合伙人情况

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，宁波华淳的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	华泰宝利投资管理有限公司	普通合伙人	324.57	0.37%
2	华泰人寿保险股份有限公司	有限合伙人	40,000.00	45.23%
3	华泰财产保险有限公司	有限合伙人	25,000.00	28.27%
4	华泰资产管理有限公司 (以下简称华泰资产)	有限合伙人	14,880.00	16.83%
5	华泰保险集团股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	5.65%
6	中荷人寿保险有限公司	有限合伙人	2,000.00	2.26%
7	宁波扬泰企业管理合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	632.85	0.72%
8	蔷薇资本有限公司	有限合伙人	600.00	0.68%
	合计	-	88,437.41	100.00

（3）私募基金备案情况

根据宁波华淳提供的《私募投资基金备案证明》等资料，并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站（<http://gs.amac.org.cn>），宁波华淳的基金管理人华泰宝利投资管理有限公司已于 2017 年 7 月 27 日办理私募基金管理人登记（登记编号：P1063983），宁波华淳已于 2017 年 12 月 6 日办理私募基金备案（备案编码：SY3246）。本所认为，宁波华淳已按照《私募基金管理办法》和《私募基金登记备案办法》履行了私募投资基金备案程序。

（4）申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据宁波华淳填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》及出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项の確認函》、发行人董事、监事及高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，宁波华淳于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，宁波华淳的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。截至本律师工作报告出具日，宁波华淳无实际控制人。宁波华淳与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。宁波华淳持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

12、中小企业基金

（1）基本情况

中小企业基金是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，发行人设立时中小企业基金持有发行人股份的比例为 0.88%。

根据中小企业基金持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，中小企业基金的基本情况如下：

名称：	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）
-----	--------------------

主要经营场所:	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 508
统一社会信用代码:	91440300MA5DR2J60E
执行事务合伙人:	深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司
类型:	有限合伙企业
经营范围:	一般经营项目是:对中小企业发展创业投资业务,股权投资及相关业务(不得从事证券投资活动、不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务)
合伙期限:	2016 年 12 月 21 至 2026 年 12 月 21 日

(2) 合伙人情况

经本所律师核查,截至本律师工作报告出具日,中小企业基金的合伙人及其出资情况如下:

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司	普通合伙人	4,500.00	1.00%
2	国家中小企业发展基金有限公司	有限合伙人	110,000.00	24.44%
3	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	109,500.00	24.33%
4	安信证券股份有限公司	有限合伙人	60,000.00	13.33%
5	深圳市汇通金控基金投资有限公司	有限合伙人	45,000.00	10.00%
6	新余市华邦投资管理中心(有限合伙)	有限合伙人	31,000.00	6.89%
7	万科企业股份有限公司	有限合伙人	30,000.00	6.67%
8	山证创新投资有限公司	有限合伙人	30,000.00	6.67%
9	深圳市创东方富盛投资企业(有限合伙)	有限合伙人	20,000.00	4.44%
10	山西交通产业基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000.00	2.22%
	合计	-	450,000.00	100.00

(3) 私募基金备案情况

根据中小企业基金提供的《私募投资基金备案证明》等资料，并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站（<http://gs.amac.org.cn>），中小企业基金的基金管理人深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司已于 2016 年 6 月 8 日办理私募基金管理人登记（登记编号：P1031644），中小企业基金已于 2017 年 3 月 16 日办理私募基金备案（备案编码：SR5570）。本所认为，中小企业基金已按照《私募基金管理办法》和《私募基金登记备案办法》履行了私募投资基金备案程序。

（4）申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据中小企业基金填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》及出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项の確認函》、发行人董事、监事及高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，中小企业基金于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，中小企业基金的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。截至本律师工作报告出具日，中小企业基金的实际控制人为陈玮、程厚博。中小企业基金与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。中小企业基金持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

13、安华创新

（1）基本情况

安华创新是一家依据中国法律成立的有限责任公司，发行人设立时安华创新持有发行人股份的比例为 0.58%。

根据安华创新持有的《营业执照》、现行有效的公司章程，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，安华创新的基本情况如下：

名称：	安徽安华创新风险投资基金有限公司
住所：	合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 866 室

统一社会信用代码:	91340100MA2RAP0C60
法定代表人:	方立彬
注册资本:	350,000 万元
公司类型:	其他有限责任公司
经营范围:	股权投资；债权投资；投资顾问、管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限:	2017 年 11 月 30 日至 2024 年 11 月 29 日

(2) 股东情况

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，安华创新的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	国元创新投资有限公司	70,000.00	20.00
2	华富嘉业投资管理有限公司	70,000.00	20.00
3	安徽省盐业投资控股集团有限公司	40,000.00	11.43
4	安徽交控资本投资管理有限公司	40,000.00	11.43
5	合肥市产业投资引导基金有限公司	36,000.00	10.29
6	安徽华文创业投资管理有限公司	22,000.00	6.29
7	时代出版传媒股份有限公司	22,000.00	6.29
8	合肥高新建设投资集团公司	20,000.00	5.71
9	阜阳市颍科创新投资有限公司	20,000.00	5.71
10	安徽省国有资本运营控股集团有限公司	10,000.00	2.86
合计		350,000.00	100.0000

(3) 私募基金备案情况

根据安华创新提供的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SCJ944），并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站（<http://gs.amac.org.cn>），安华创新的基金管理人华富嘉业投资管理有限公司已于 2015 年 7 月 16 日办理私募基金管理人登记（登记编号：P1018000），安华创新已于 2018 年 3 月 15 日办理私募基金备案（备案编码：SCJ944）。本所认为，安华创新已按照《私募基金管理办法》和《私募基金登记备案办法》履行了私募投资基金备案程序。

(4) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据安华创新填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》及出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项确认函》、发行人董事、监事及高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，安华创新于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，安华创新的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。截至本律师工作报告出具日，安华创新无实际控制人。安华创新与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。安华创新持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

14、集创北方

（1）基本情况

集创北方是一家依据中国法律成立的股份有限公司，发行人设立时集创北方持有发行人股份的比例为 0.58%。

根据集创北方持有的《营业执照》、现行有效的公司章程，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，集创北方的基本情况如下：

名称：	北京集创北方科技股份有限公司
住所：	北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 56 幢 8 层 801（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
统一社会信用代码：	91110108679604408D
法定代表人：	张晋芳
注册资本：	31278.7725 万元
公司类型：	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围：	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售电子产品、器件和元件、计算机、软件及辅助设备、灯具、五金交电、自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门

	门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
营业期限：	2008年9月3日至长期

(2) 股东情况

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，集创北方的股权结构如下：

序号	股东	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	张晋芳	65,427,978	20.92
2	北京亦庄国际新兴产业投资中心(有限合伙)	54,865,447	17.54
3	北京永昌寰宇投资有限公司	28,332,633	9.06
4	北京永昌环宇投资中心(有限合伙)	18,000,000	5.75
5	北京集智非凡科技中心(有限合伙)	17,888,483	5.72
6	北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)	13,048,091	4.17
7	国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	10,780,579	3.45
8	珠海科技创业投资有限公司	10,089,921	3.23
9	珠海大横琴创新发展有限公司	10,089,921	3.23
10	北京集创寰宇科技中心(有限合伙)	7,394,492	2.36
11	北京芯动能投资基金(有限合伙)	7,083,158	2.26
12	苏州哲思灵行投资合伙企业(有限合伙)	5,120,775	1.64
13	上海聚源载兴投资中心(有限合伙)	4,997,900	1.60
14	北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	4,491,908	1.44
15	北京中技高科财富投资中心(有限合伙)	2,833,263	0.91
16	北京光荣联盟半导体照明产业投资中心(有限合伙)	2,832,861	0.91
17	北京丝路云和投资中心(有限合伙)	2,598,431	0.83
18	北京晋睿博远科技有限公司	2,400,000	0.77
19	厦门新鼎哨哥玖号股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0.64
20	无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,796,763	0.57
21	北京汇智合盛电子科技有限公司	1,796,945	0.57
22	北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)	1,416,632	0.45
23	深圳前海中明股权投资基金管理企业(有限合伙)	1,332,036	0.43
24	湖南泉清投资合伙企业(有限合伙)	1,192,806	0.38
25	共青城哲灵丰升投资管理合伙企业(有限合伙)	1,167,896	0.37

序号	股东	持股数量 (股)	持股比例 (%)
26	陕西葆晟控股有限公司	934,977	0.30
27	新疆 TCL 股权投资有限公司	898,382	0.29
28	北京国泰嘉泽创业投资中心（有限合伙	898,473	0.29
29	珠海景祥宏利股权投资基金合伙企业（有限合伙）	807,194	0.26
30	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	14,125,897	4.52
31	哈勃科技投资有限公司	4,035,971	1.29
32	宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙）	8,071,941	2.58
33	厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,035,971	1.29
合计		312,787,725	100.00

（3）申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据集创北方填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》及出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项の確認函》、发行人董事、监事及高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，集创北方于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，集创北方的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。截至本律师工作报告出具日，集创北方的实际控制人为张晋芳。集创北方与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。集创北方持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

15、中金浦成

（1）基本情况

中金浦成是一家依据中国法律成立的有限责任公司，发行人设立时中金浦成持有发行人股份的比例为 0.12%。

根据中金浦成持有的《营业执照》、现行有效的公司章程，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，中金浦成的基本情况如下：

名称:	中金浦成投资有限公司
住所:	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 29 层 2904A 单元
统一社会信用代码:	91310000594713322Q
法定代表人:	刘健
注册资本:	200,000 万元
公司类型:	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:	投资管理，投资咨询，从事货物及技术的进出口业务，国内货物运输代理服务，仓储（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限:	2012 年 4 月 10 日至不约定期限

（2）股东情况

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，中金浦成的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国国际金融股份有限公司	200,000	100.00
	合计	200,000	100.00

（3）申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据中金浦成填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》及出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项の確認函》、发行人董事、监事及高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，中金浦成于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，中金浦成的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。截至本律师工作报告出具日，中金浦成为中金公司的全资子公司，中金公司的控股股东为中央汇金投资有限责任公司。中金浦成为晶合集成本次发行上市保荐机构中国国际金融股份有限公司的全资子公司，除此之外，中金浦成与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。中金浦成持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

16、合肥晶煨

(1) 基本情况

合肥晶煨是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，系发行人员工持股平台，发行人设立时合肥晶煨持有发行人股份的比例为 0.35%。

根据合肥晶煨持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，合肥晶煨的基本情况如下表所示：

名称：	合肥晶煨企业管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1109-2
统一社会信用代码：	91340100MA2W47T562
执行事务合伙人：	合肥晶策企业管理有限公司
类型：	有限合伙企业
经营范围：	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限：	2020年8月19日至2030年8月16日

(2) 合伙人情况

根据合肥晶煨的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶煨的合伙人及其出资情况如下表所示：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.01	/
2	詹奕鹏	有限合伙人	450.00	14.65	副总经理
3	黎湘鄂	有限合伙人	300.00	9.77	董事长室顾问
4	简瑞荣	有限合伙人	241.00	7.85	协理
5	黎翠綾	有限合伙人	150.00	4.88	企业规划室资深处长
6	张伟瑾	有限合伙人	150.00	4.88	N1厂长室厂长
7	林柏青	有限合伙人	150.00	4.88	N1厂长室副厂长
8	吴佳特	有限合伙人	130.00	4.23	先进整合处处长
9	谢长峯	有限合伙人	105.00	3.42	制程整合技术处副处长

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
10	李庆民	有限合伙人	100.00	3.26	协理
11	官佳琦	有限合伙人	100.00	3.26	品质处处长
12	方圣昌	有限合伙人	100.00	3.26	N1厂长室副厂长
13	张志宏	有限合伙人	100.00	3.26	业务二处处长
14	柯天麒	有限合伙人	90.00	2.93	模型器件处副处长
15	蔡信裕	有限合伙人	90.00	2.93	产品工程处处长
16	刘棋彬	有限合伙人	85.00	2.77	风险管理处处长
17	陈信全	有限合伙人	80.00	2.60	技术开发一处副处长
18	江英和	有限合伙人	70.00	2.28	人力资源部经理
19	谢文智	有限合伙人	70.00	2.28	营运企划处代副处长
20	罗招龙	有限合伙人	60.00	1.95	模组开发处经理
21	吴启熙	有限合伙人	60.00	1.95	分析及可靠性工程部经理
22	张永忠	有限合伙人	60.00	1.95	设计服务处代副处长
23	施介文	有限合伙人	60.00	1.95	扩散工程部经理
24	李天定	有限合伙人	50.00	1.63	经营与营运系统部经理
25	钟青源	有限合伙人	50.00	1.63	蚀刻工程部经理
26	王冠博	有限合伙人	50.00	1.63	模组开发处副处长
27	吴文达	有限合伙人	50.00	1.63	信息服务处副处长
28	黄国助	有限合伙人	50.00	1.63	资安室经理
29	施雪峯	有限合伙人	20.00	0.65	法务室副处长
合计			3,071.20	100.00	-

(3) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据合肥晶焯的工商档案资料、合肥晶焯出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项的确认证函》、发行人董事、监事和高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，合肥晶焯于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，合肥晶焯的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。合肥晶焯为发行人员工持股平台，与发行人其他员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策（系发行人员工持股平台的管理机构）；合肥晶焯的有限合伙人中，詹奕鹏、简瑞荣、李庆民为发行

人的高级管理人员，除此之外，合肥晶焠与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。合肥晶焠持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

17、合肥晶遂

(1) 基本情况

合肥晶遂是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，系发行人员工持股平台，发行人设立时合肥晶遂持有发行人股份的比例为 0.28%。

根据合肥晶遂持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，合肥晶遂的基本情况如下表所示：

名称：	合肥晶遂企业管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1109-3
统一社会信用代码：	91340100MA2W4D7A3D
执行事务合伙人：	合肥晶策企业管理有限公司（委派代表：曹宗野）
类型：	有限合伙企业
经营范围：	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限：	2020 年 8 月 14 日至 2030 年 8 月 13 日

(2) 合伙人情况

根据合肥晶遂的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶遂的合伙人及其出资情况如下表所示：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.01	/
2	朱才伟	有限合伙人	450.00	18.14	董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理
3	朱晓娟	有限合伙人	416.10	16.77	董事、副总经理

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
4	周义亮	有限合伙人	380.00	15.31	助理
5	王兴亚	有限合伙人	125.00	5.04	财会处处长
6	方华	有限合伙人	125.00	5.04	对外事务室处长
7	王逸蓉	有限合伙人	50.00	2.02	关务部经理
8	杜松苗	有限合伙人	40.00	1.61	代工业务一组经理
9	张庆勇	有限合伙人	40.00	1.61	IP服务二组经理
10	陈景	有限合伙人	40.00	1.61	客户工程一部经理
11	王云直	有限合伙人	40.00	1.61	会计部经理
12	刘桂云	有限合伙人	40.00	1.61	总务部经理
13	周儒领	有限合伙人	40.00	1.61	先进整合一组经理
14	郑晓	有限合伙人	36.00	1.45	产品测试组经理
15	李德龙	有限合伙人	36.00	1.45	采购一部代经理
16	曹宗野	有限合伙人	30.00	1.21	证券事务部经理
17	喻加云	有限合伙人	25.00	1.01	会计部副理
18	张静	有限合伙人	25.00	1.01	会计部副理
19	缪凤玲	有限合伙人	24.00	0.97	代工业务一组技术副理
20	李宁	有限合伙人	24.00	0.97	人力资源部副理
21	张英杰	有限合伙人	24.00	0.97	客户工程二部代经理
22	付刚	有限合伙人	20.00	0.81	品质体系管理部副理
23	赵家保	有限合伙人	20.00	0.81	关务部副理
24	肖丹	有限合伙人	20.00	0.81	业务管理部副理
25	杜雷	有限合伙人	20.00	0.81	电脑辅助设计组副理
26	简瑞荣	有限合伙人	20.00	0.81	助理
27	束乐	有限合伙人	20.00	0.81	人力资源部副理
28	何倩倩	有限合伙人	20.00	0.81	总务部副理
29	杨大桂	有限合伙人	17.00	0.69	厂务二部技术副理
30	杨昆	有限合伙人	16.00	0.64	行政与网络系统部副理
31	潘坡	有限合伙人	16.00	0.64	业务管理部专案副理
32	李林	有限合伙人	16.00	0.64	黄光工程部技术副理
33	魏家信	有限合伙人	16.00	0.64	分析技术部副理
34	程长青	有限合伙人	16.00	0.64	量测技术部副理
35	蒲甜松	有限合伙人	16.00	0.64	核心技术二部副理

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
36	许春龙	有限合伙人	16.00	0.64	核心技术一部副理
37	汪小小	有限合伙人	16.00	0.64	元件开发部副理
38	赵敬国	有限合伙人	16.00	0.64	总务部专案副理
39	黄皓皓	有限合伙人	16.00	0.64	储运部副理
40	白康茜	有限合伙人	16.00	0.64	采购二部副理
41	赵丽云	有限合伙人	16.00	0.64	品质工程部副理
42	唐京华	有限合伙人	16.00	0.64	厂务一部技术副理
43	李江敏	有限合伙人	16.00	0.64	稽核室专案副理
44	张存兴	有限合伙人	16.00	0.64	经营管理组代经理
45	黄小迪	有限合伙人	13.00	0.52	分析技术部主任工程师
46	周俊	有限合伙人	13.00	0.52	蚀刻工程部主任工程师
47	季能	有限合伙人	12.00	0.48	经营与营运系统部技术副理
48	钟胤	有限合伙人	12.00	0.48	对外事务室专案副理
49	丁磊	有限合伙人	12.00	0.48	经营与营运系统部技术副理
50	王梦曦	有限合伙人	12.00	0.48	对外事务室专案副理
合计			2,481.30	100.00	-

(3) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据合肥晶遂的工商档案资料、合肥晶遂出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项的确认证书》、发行人董事、监事和高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，合肥晶遂于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，合肥晶遂的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。合肥晶遂为发行人员工持股平台，与发行人其他员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策（系发行人员工持股平台的管理机构）；合肥晶遂的有限合伙人中，朱晓娟、朱才伟为发行人的董事及高级管理人员，周义亮为发行人的高级管理人员，除此之外，合肥晶遂与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安

排，具备法律、法规规定的股东资格。合肥晶遂持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

18、合肥晶炯

(1) 基本情况

合肥晶炯是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，系发行人员工持股平台，发行人设立时合肥晶炯持有发行人股份的比例为 0.25%。

根据合肥晶炯持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，合肥晶炯的基本情况如下表所示：

名称：	合肥晶炯企业管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1109-3
统一社会信用代码：	91340100MA2W4D7A3D
执行事务合伙人：	合肥晶策企业管理有限公司（委派代表：曹宗野）
类型：	有限合伙企业
经营范围：	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限：	2020年8月20日至2030年8月9日

(2) 合伙人情况

根据合肥晶炯的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶炯的合伙人及其出资情况如下表所示：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.01	/
2	蔡国智	有限合伙人	575.00	25.51	董事长
3	蔡辉嘉	有限合伙人	510.00	22.63	总经理
4	邱显寰	有限合伙人	380.00	16.86	副总经理
5	李迦谕	有限合伙人	200.00	8.87	协理
6	黄晋德	有限合伙人	132.00	5.86	业务一处资深处长

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
7	林士然	有限合伙人	100.00	4.44	总经理室总经理特助
8	王建智	有限合伙人	40.00	1.77	先进整合后端组经理
9	许嘉哲	有限合伙人	36.00	1.60	产品工程处技术副理
10	吴建宏	有限合伙人	30.00	1.33	微影开发部副理
11	古哲安	有限合伙人	20.00	0.89	微影开发部副理
12	田俊鹏	有限合伙人	16.00	0.71	生管物管部副理
13	黄浩玮	有限合伙人	16.00	0.71	先进整合一组技术副理
14	林政纬	有限合伙人	16.00	0.71	蚀刻开发部副理
15	伍至上	有限合伙人	16.00	0.71	设备整合部技术副理
16	吴家頰	有限合伙人	16.00	0.71	洗净工程部技术副理
17	蔡汉郅	有限合伙人	12.00	0.53	自动化工程部技术副理
18	邱一峯	有限合伙人	12.00	0.53	厂务一部技术副理
19	郑子锋	有限合伙人	12.00	0.53	洗净工程部技术副理
20	苏耕乐	有限合伙人	12.00	0.53	客户工程二部技术副理
21	毛泽民	有限合伙人	12.00	0.53	代工业务二组技术副理
22	沈俊明	有限合伙人	12.00	0.53	微影开发部技术副理
23	柯孟志	有限合伙人	10.00	0.44	风险控制部副理
24	陈思皓	有限合伙人	10.00	0.44	良率提升部副理
25	简瑞荣	有限合伙人	10.00	0.44	协理
26	陈依柏	有限合伙人	8.00	0.35	产品工程部主任工程师
27	王振择	有限合伙人	8.00	0.35	蚀刻开发部主任工程师
28	张正一	有限合伙人	7.90	0.35	量测技术部经理
29	张琳琳	有限合伙人	5.00	0.22	分析技术部主任工程师
30	江冬冬	有限合伙人	5.00	0.22	制造部生产线主任
31	李晗飞	有限合伙人	5.00	0.22	蚀刻工程部主任工程师
32	翟伟	有限合伙人	5.00	0.22	黄光工程部主任工程师
33	张振华	有限合伙人	5.00	0.22	化学机械研磨工程部主任工程师
合计			2,254.10	100.00	-

(3) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据合肥晶炯的工商档案资料、合肥晶炯出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项的确认证函》、发行人董事、监事和高级管理人员填写的

《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，合肥晶炯于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，合肥晶炯的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。合肥晶炯为发行人员工持股平台，与发行人其他员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策（系发行人员工持股平台的管理机构）；合肥晶炯的有限合伙人中，蔡国智为发行人的董事，蔡辉嘉、邱显寰、李洵谕为发行人的高级管理人员，除此之外，合肥晶炯与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。合肥晶炯持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

19、合肥晶咖

（1）基本情况

合肥晶咖是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，系发行人员工持股平台，发行人设立时合肥晶咖持有发行人股份的比例为 0.10%。

根据合肥晶咖持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，合肥晶咖的基本情况如下表所示：

名称：	合肥晶咖企业管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1110-1
统一社会信用代码：	91340100MA2W4EHT54
执行事务合伙人：	合肥晶策企业管理有限公司（委派代表：曹宗野）
类型：	有限合伙企业
经营范围：	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限：	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 16 日

（2）合伙人情况

根据合肥晶咖的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶咖的合伙人及其出资情况如下表所示：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.02	/
2	林滔天	有限合伙人	50.00	5.81	逻辑一部经理
3	简瑞荣	有限合伙人	50.00	5.81	协理
4	杨子亿	有限合伙人	47.00	5.46	洗净开发部经理
5	林群证	有限合伙人	42.00	4.88	洗净工程部经理
6	曲厚任	有限合伙人	42.00	4.88	制程整合部代经理
7	陈义元	有限合伙人	40.00	4.64	化学机械研磨工程部经理
8	柯孟志	有限合伙人	36.00	4.18	制造部代经理
9	柯家宇	有限合伙人	36.00	4.18	品质工程部经理
10	魏郁忠	有限合伙人	36.00	4.18	品质体系管理部经理
11	杨智强	有限合伙人	36.00	4.18	蚀刻开发部代经理
12	陈文棋	有限合伙人	36.00	4.18	设备整合部经理
13	邱浩源	有限合伙人	30.00	3.48	蚀刻工程部副理
14	刘文彬	有限合伙人	30.00	3.48	薄膜开发部技术经理
15	洪启恭	有限合伙人	30.00	3.48	自动化工程部副理
16	秦典昇	有限合伙人	30.00	3.48	黄光工程部副理
17	杨国栋	有限合伙人	30.00	3.48	黄光工程部副理
18	王嘉祥	有限合伙人	30.00	3.48	蚀刻工程部副理
19	张凯帆	有限合伙人	25.00	2.90	经营与营运系统部副理
20	方建智	有限合伙人	24.00	2.79	薄膜工程部副理
21	林祐丞	有限合伙人	21.00	2.44	蚀刻开发部副理
22	徐柏谦	有限合伙人	20.00	2.32	人力资源部副理
23	罗国基	有限合伙人	20.00	2.32	制造部副理
24	黄惠春	有限合伙人	20.00	2.32	采购三组专案副理
25	范振富	有限合伙人	20.00	2.32	制造部副理
26	黄凯全	有限合伙人	20.00	2.32	策略规划组经理
27	曾文钦	有限合伙人	20.00	2.32	制造部副理
28	许信忠	有限合伙人	20.00	2.32	制造部副理
29	李昶材	有限合伙人	20.00	2.32	黄光工程部副理

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
	合计		861.20	100.00	-

(3) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据合肥晶咖的工商档案资料、合肥晶咖出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项的确认证函》、发行人董事、监事和高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，合肥晶咖于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，合肥晶咖的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。合肥晶咖为发行人员工持股平台，与发行人其他员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策（系发行人员工持股平台的管理机构），除此之外，合肥晶咖与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。合肥晶咖持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

20、合肥晶珏

(1) 基本情况

合肥晶珏是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，系发行人员工持股平台，发行人设立时合肥晶珏持有发行人股份的比例为 0.08%。

根据合肥晶珏持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，合肥晶珏的基本情况如下表所示：

名称：	合肥晶珏企业管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1111-2
统一社会信用代码：	91340100MA2W4E4J0J
执行事务合伙人：	合肥晶策企业管理有限公司（委派代表：曹宗野）
类型：	有限合伙企业

经营范围:	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限:	2020年8月20日至2030年8月16日

(2) 合伙人情况

根据合肥晶珏的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶珏的合伙人及其出资情况如下表所示：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.03	/
2	蔡俊郎	有限合伙人	50.00	6.70	良率提升部经理
3	梁君丽	有限合伙人	40.00	5.36	元件技术部经理
4	庄逢杰	有限合伙人	40.00	5.36	薄膜工程部经理
5	陈世昌	有限合伙人	40.00	5.36	整合支援组经理
6	苏贤钧	有限合伙人	40.00	5.36	代工业务二组经理
7	丁明邦	有限合伙人	40.00	5.36	企划部经理
8	龚柏铨	有限合伙人	40.00	5.36	逻辑二部经理
9	洪春田	有限合伙人	40.00	5.36	黄光工程部经理
10	何毓纬	有限合伙人	40.00	5.36	采购三组经理
11	黄世豪	有限合伙人	36.00	4.82	工安环保部代经理
12	洪国利	有限合伙人	36.00	4.82	风险控制部经理
13	谢佳荣	有限合伙人	20.00	2.68	分析技术部副理
14	谢琦山	有限合伙人	20.00	2.68	扩散工程部副理
15	宋振睿	有限合伙人	20.00	2.68	厂务一部代经理
16	吴真良	有限合伙人	20.00	2.68	自动化工程部副理
17	董允文	有限合伙人	20.00	2.68	厂务二部技术经理
18	陈信华	有限合伙人	20.00	2.68	厂务二部经理
19	蔡杰良	有限合伙人	20.00	2.68	扩散工程部副理
20	李泽育	有限合伙人	20.00	2.68	扩散工程部副理
21	苏智源	有限合伙人	20.00	2.68	厂务一部副理
22	吴耀杉	有限合伙人	20.00	2.68	分析技术部技术副理
23	彭昱治	有限合伙人	20.00	2.68	厂务一部副理
24	杨帛霖	有限合伙人	12.00	1.61	化学机械研磨工程部技术副理

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
25	林育兴	有限合伙人	12.00	1.61	制造部副理
26	黄君杰	有限合伙人	12.00	1.61	黄光工程部技术副理
27	詹益轩	有限合伙人	12.00	1.61	蚀刻工程部技术副理
28	彭科津	有限合伙人	12.00	1.61	薄膜工程部技术副理
29	苏圣哲	有限合伙人	12.00	1.61	薄膜工程部技术副理
30	周中行	有限合伙人	12.00	1.61	蚀刻工程部副理
合计			746.20	100.00	-

(3) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据合肥晶珏的工商档案资料、合肥晶珏出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项の確認函》、发行人董事、监事和高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，合肥晶珏于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，合肥晶珏的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。合肥晶珏为发行人员工持股平台，与发行人其他员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策（系发行人员工持股平台的管理机构），除此之外，合肥晶珏与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。合肥晶珏持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

21、合肥晶梢

(1) 基本情况

合肥晶梢是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，系发行人员工持股平台，发行人设立时合肥晶梢持有发行人股份的比例为 0.08%。

根据合肥晶梢持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，合肥晶梢的基本情况如下表所示：

名称:	合肥晶梢企业管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所:	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1112-2
统一社会信用代码:	91340100MA2W49PY30
执行事务合伙人:	合肥晶策企业管理有限公司（委派代表：曹宗野）
类型:	有限合伙企业
经营范围:	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限:	2020年8月20日至2030年8月16日

（2）合伙人情况

根据合肥晶梢的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶梢的合伙人及其出资情况如下表所示：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.03	/
2	杨宗凯	有限合伙人	70.00	10.08	核心技术一部经理
3	杨家诚	有限合伙人	50.00	7.20	可靠度元件模拟组经理
4	苏深池	有限合伙人	50.00	7.20	自动化工程部经理
5	许宗能	有限合伙人	50.00	7.20	先进整合前端组经理
6	林士程	有限合伙人	50.00	7.20	微影开发部经理
7	吴桂茶	有限合伙人	40.00	5.76	储运部经理
8	雷滢仁	有限合伙人	40.00	5.76	稽核室经理
9	李旭昇	有限合伙人	40.00	5.76	行政与网络系统部经理
10	张世琛	有限合伙人	20.00	2.88	蚀刻工程部副理
11	杨安立	有限合伙人	20.00	2.88	薄膜工程部副理
12	朱哲仪	有限合伙人	20.00	2.88	黄光工程部副理
13	彭泽昌	有限合伙人	20.00	2.88	黄光工程部副理
14	丁笙玳	有限合伙人	20.00	2.88	薄膜工程部副理
15	蔡富吉	有限合伙人	20.00	2.88	化学机械研磨工程部副理
16	陈春安	有限合伙人	20.00	2.88	扩散工程部副理
17	王柏翔	有限合伙人	16.00	2.30	元件技术部副理
18	张馨文	有限合伙人	16.00	2.30	品质体系管理部副理

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
19	叶益诚	有限合伙人	16.00	2.30	客户工程二部副理
20	郑淑芬	有限合伙人	16.00	2.30	市场营销处技术副理
21	冯文辉	有限合伙人	16.00	2.30	洗净工程部技术副理
22	邓台信	有限合伙人	12.00	1.73	扩散工程部技术副理
23	洪素真	有限合伙人	12.00	1.73	采购处技术副理
24	孙浩晏	有限合伙人	12.00	1.73	制造部副理
25	谢秉宏	有限合伙人	12.00	1.73	扩散工程部技术副理
26	黄志淦	有限合伙人	12.00	1.73	扩散工程部技术副理
27	黄志贤	有限合伙人	12.00	1.73	薄膜工程部技术副理
28	方先全	有限合伙人	12.00	1.73	法务室专案副理
合计			694.20	100.00	-

(3) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据合肥晶梢的工商档案资料、合肥晶梢出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项の確認函》、发行人董事、监事和高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，合肥晶梢于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，合肥晶梢的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。合肥晶梢为发行人员工持股平台，与发行人其他员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策（系发行人员工持股平台的管理机构），除此之外，合肥晶梢与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。合肥晶梢持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

22、合肥晶柔

(1) 基本情况

合肥晶柔是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，系发行人员工持股平台，发行人设立时合肥晶柔持有发行人股份的比例为 0.06%。

根据合肥晶柔持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，合肥晶柔的基本情况如下表所示：

名称：	合肥晶柔企业管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1112-1
统一社会信用代码：	91340100MA2W4EW46Y
执行事务合伙人：	合肥晶策企业管理有限公司（委派代表：曹宗野）
类型：	有限合伙企业
经营范围：	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限：	2020年8月21日至2030年8月9日

（2）合伙人情况

根据合肥晶柔的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶柔的合伙人及其出资情况如下表所示：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.04	/
2	YAMANAKA TOSHIKI	有限合伙人	65.00	12.74	日本子公司处长
3	KIM KI JUN	有限合伙人	60.00	11.76	研发副总经理室技术副 处长
4	CHOI JOBONG	有限合伙人	50.00	9.80	器件架构组经理
5	JUNG DAE SUB	有限合伙人	40.00	7.84	器件架构组技术经理
6	MUTA TETSUYA	有限合伙人	40.00	7.84	日本晶合技术经理
7	TAYA MASATOSHI	有限合伙人	24.00	4.70	日本晶合主任工程师
8	KUMAGAI YASUHIRO	有限合伙人	20.00	3.92	日本晶合主任工程师
9	冯永波	有限合伙人	20.00	3.92	扩散开发部代经理
10	SUGAWARA TOSHIKAZU	有限合伙人	20.00	3.92	日本晶合主任工程师
11	OSAKI HIDEFUMI	有限合伙人	10.00	1.96	日本晶合主任工程师
12	OTA HIROYUKI	有限合伙人	10.00	1.96	日本晶合技术经理

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
13	鲁传润	有限合伙人	10.00	1.96	自动化工程部副理
14	AOKI MIKIO	有限合伙人	10.00	1.96	日本晶合技术副理
15	李新强	有限合伙人	8.00	1.57	行政与网络系统部主任工 程师
16	张纪稳	有限合伙人	8.00	1.57	器件架构组主任工程师
17	王晓辉	有限合伙人	8.00	1.57	扩散工程部主任工程师
18	简瑞荣	有限合伙人	7.00	1.37	协理
19	郑涛	有限合伙人	5.00	0.98	策略规划组主任工程师
20	蒋丽	有限合伙人	5.00	0.98	制程整合部主任工程师
21	宫珊珊	有限合伙人	5.00	0.98	良率提升部主任工程师
22	徐婷	有限合伙人	5.00	0.98	经营与营运系统部主任工 程师
23	曾权飞	有限合伙人	5.00	0.98	模型器件组主任工程师
24	包玉威	有限合伙人	5.00	0.98	品质体系管理部主任工程 师
25	陈依纯	有限合伙人	5.00	0.98	薄膜开发部主任工程师
26	项伟	有限合伙人	5.00	0.98	薄膜开发部主任工程师
27	刘扬	有限合伙人	5.00	0.98	制程整合部主任工程师
28	熊小玲	有限合伙人	5.00	0.98	制程整合部主任工程师
29	杨铿	有限合伙人	5.00	0.98	元件技术部主任工程师
30	沈磊	有限合伙人	5.00	0.98	洗净工程部主任工程师
31	刘汗青	有限合伙人	5.00	0.98	品质体系管理部主任工程 师
32	王康满	有限合伙人	5.00	0.98	蚀刻工程部主任工程师
33	陈云	有限合伙人	4.00	0.78	行政与网络系统部主任工 程师
34	徐全柱	有限合伙人	3.00	0.59	品质工程部主任工程师
35	曹灿	有限合伙人	3.00	0.59	扩散工程部主任工程师
36	金鹏	有限合伙人	3.00	0.59	元件开发部主任工程师
37	王斌	有限合伙人	3.00	0.59	厂务一部主任工程师
38	吴章淦	有限合伙人	3.00	0.59	经营与营运系统部主任工 程师
39	童树健	有限合伙人	2.00	0.39	风险控制部主任工程师
40	王建华	有限合伙人	2.00	0.39	厂务一部主任工程师
41	游凯	有限合伙人	2.00	0.39	行政与网络系统部主任工

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
					程师
42	许建东	有限合伙人	2.00	0.39	良率提升部主任工程师
43	张帅	有限合伙人	2.00	0.39	行政与网络系统部主任工 程师
44	周其灿	有限合伙人	1.00	0.20	行政与网络系统部主任工 程师
合计			510.20	100.00	-

(3) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据合肥晶柔的工商档案资料、合肥晶柔出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项の確認函》、发行人董事、监事和高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，合肥晶柔于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，合肥晶柔的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。合肥晶柔为发行人员工持股平台，与发行人其他员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策（系发行人员工持股平台的管理机构），除此之外，合肥晶柔与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。合肥晶柔持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

23、合肥晶悬

(1) 基本情况

合肥晶悬是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，系发行人员工持股平台，发行人设立时合肥晶悬持有发行人股份的比例为 0.06%。

根据合肥晶悬持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，合肥晶悬的基本情况如下表所示：

名称：	合肥晶悬企业管理合伙企业（有限合伙）
-----	--------------------

主要经营场所:	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1110-2
统一社会信用代码:	91340100MA2W49Q956
执行事务合伙人:	合肥晶策企业管理有限公司（委派代表：曹宗野）
类型:	有限合伙企业
经营范围:	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限:	2020年8月20日至2030年8月16日

（2）合伙人情况

根据合肥晶晟的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶晟的合伙人及其出资情况如下表所示：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.04	/
2	谢承璋	有限合伙人	20.00	3.97	品质工程部副理
3	林皓庭	有限合伙人	20.00	3.97	良率提升部副理
4	陈建铨	有限合伙人	20.00	3.97	产品工程部代经理
5	王怡婷	有限合伙人	20.00	3.97	电脑整合制造部副理
6	郭琦鋈	有限合伙人	20.00	3.97	代工业务二组技术副理
7	卢俊玮	有限合伙人	20.00	3.97	蚀刻开发部副理
8	李俊嘉	有限合伙人	20.00	3.97	代工业务二组技术副理
9	李芄葳	有限合伙人	20.00	3.97	元件技术部副理
10	沈圣宗	有限合伙人	20.00	3.97	薄膜开发部代经理
11	卓俊麒	有限合伙人	20.00	3.97	电脑辅助设计组副理
12	官建宏	有限合伙人	20.00	3.97	洗净工程部副理
13	张贵财	有限合伙人	16.00	3.17	薄膜工程部技术副理
14	杨俊杰	有限合伙人	16.00	3.17	蚀刻工程部技术副理
15	许时斌	有限合伙人	16.00	3.17	黄光工程部技术副理
16	林慧妮	有限合伙人	16.00	3.17	核心技术二部技术副理
17	黄铭仁	有限合伙人	16.00	3.17	厂务二部副理
18	黄彦昌	有限合伙人	16.00	3.17	工安环保部副理
19	齐志翰	有限合伙人	16.00	3.17	黄光工程部副理

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
20	陈俊宏	有限合伙人	16.00	3.17	薄膜工程部技术副理
21	吴颖麒	有限合伙人	16.00	3.17	黄光工程部技术副理
22	陈庆鸿	有限合伙人	16.00	3.17	生管物管部技术副理
23	陈家宏	有限合伙人	16.00	3.17	黄光工程部技术副理
24	廖宥宏	有限合伙人	16.00	3.17	制造部副理
25	邓元吉	有限合伙人	16.00	3.17	蚀刻工程部技术副理
26	黄国修	有限合伙人	16.00	3.17	蚀刻工程部技术副理
27	蔡承佑	有限合伙人	16.00	3.17	制程整合部副理
28	唐世桦	有限合伙人	16.00	3.17	风险控制部副理
29	洪佐旻	有限合伙人	16.00	3.17	扩散工程部技术副理
30	孙秉群	有限合伙人	12.00	2.38	黄光工程部技术副理
合计			504.20	100.00	-

(3) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据合肥晶恳的工商档案资料、合肥晶恳出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项の確認函》、发行人董事、监事和高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，合肥晶恳于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，合肥晶恳的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。合肥晶恳为发行人员工持股平台，与发行人其他员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策（系发行人员工持股平台的管理机构），除此之外，合肥晶恳与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。合肥晶恳持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

24、合肥晶本

(1) 基本情况

合肥晶本是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，系发行人员工持股平台，发行人设立时合肥晶本持有发行人股份的比例为 0.05%。

根据合肥晶本持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，合肥晶本的基本情况如下表所示：

名称：	合肥晶本企业管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1109-1
统一社会信用代码：	91340100MA2W3YKG77
执行事务合伙人：	合肥晶策企业管理有限公司（委派代表：曹宗野）
类型：	有限合伙企业
经营范围：	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限：	2020 年 8 月 17 日至 2030 年 8 月 16 日

（2）合伙人情况

根据合肥晶本的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶本的合伙人及其出资情况如下表所示：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.04	/
2	计豪	有限合伙人	12.00	2.60	经营与营运系统部技术副理
3	凌军	有限合伙人	12.00	2.60	电脑整合制造部技术副理
4	顾炜	有限合伙人	12.00	2.60	代工业务一组技术副理
5	王厚有	有限合伙人	12.00	2.60	扩散开发部副理
6	张润生	有限合伙人	12.00	2.60	黄光工程部技术副理
7	彭萍	有限合伙人	12.00	2.60	化学机械研磨工程部技术副理
8	杨排	有限合伙人	12.00	2.60	经营与营运系统部技术副理
9	李强	有限合伙人	12.00	2.60	厂务二部技术副理
10	刘秀梅	有限合伙人	12.00	2.60	光学模型组技术副理
11	詹霄飞	有限合伙人	12.00	2.60	客户工程一部副理
12	邢志同	有限合伙人	12.00	2.60	薄膜工程部副理

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
13	封瑞	有限合伙人	10.00	2.17	企划部主任工程师
14	刘波	有限合伙人	10.00	2.17	分析技术部副理
15	涂程林	有限合伙人	10.00	2.17	洗净工程部副理
16	王梦慧	有限合伙人	10.00	2.17	核心技术二部主任工程师
17	邵迎亚	有限合伙人	10.00	2.17	制程整合部主任工程师
18	李倩娣	有限合伙人	10.00	2.17	制程整合部副理
19	汪高生	有限合伙人	10.00	2.17	行政与网络系统部副理
20	徐东东	有限合伙人	10.00	2.17	分析技术部副理
21	童佳佳	有限合伙人	10.00	2.17	工安环保部代副理
22	蔡永霞	有限合伙人	10.00	2.17	品质体系管理部副理
23	金良民	有限合伙人	10.00	2.17	行政与网络系统部副理
24	祝进专	有限合伙人	10.00	2.17	逻辑一部副理
25	严俊生	有限合伙人	10.00	2.17	风险控制部代副理
26	简瑞荣	有限合伙人	10.00	2.17	协理
27	张海英	有限合伙人	8.00	1.73	行政与网络系统部主任工程师
28	李青	有限合伙人	8.00	1.73	制造部主任工程师
29	张倩倩	有限合伙人	8.00	1.73	行政与网络系统部主任工程师
30	周静	有限合伙人	8.00	1.73	经营与营运系统部主任工程师
31	葛礼玉	有限合伙人	8.00	1.73	行政与网络系统部主任工程师
32	冯维	有限合伙人	8.00	1.73	生管物管部副理
33	唐鹤飞	有限合伙人	8.00	1.73	行政与网络系统部主任工程师
34	田春	有限合伙人	8.00	1.73	资安室主任工程师
35	胡旺能	有限合伙人	8.00	1.73	制造部主任工程师
36	徐国宝	有限合伙人	8.00	1.73	经营与营运系统部主任工程师
37	张兴才	有限合伙人	8.00	1.73	采购二部副理
38	高亮	有限合伙人	8.00	1.73	制造部技术副理
39	刘伟	有限合伙人	8.00	1.73	行政与网络系统部主任工程师
40	未东洋	有限合伙人	8.00	1.73	经营与营运系统部主任工程师
41	黄风	有限合伙人	8.00	1.73	黄光工程部主任工程师
42	檀翠琴	有限合伙人	8.00	1.73	经营与营运系统部技术副理
43	唐昌玉	有限合伙人	8.00	1.73	企划部副理
44	夏海峰	有限合伙人	8.00	1.73	风险控制部主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
45	巫瑶瑶	有限合伙人	8.00	1.73	制造部主任工程师
46	黄玉	有限合伙人	8.00	1.73	黄光工程部主任工程师
47	丁超	有限合伙人	8.00	1.73	黄光工程部技术副理
48	郑兴华	有限合伙人	8.00	1.73	经营与营运系统部主任工程师
49	王冰	有限合伙人	8.00	1.73	客户工程二部副理
50	胡守时	有限合伙人	5.00	1.08	代工业务一组技术副理
合计			461.20	100.00	-

(3) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据合肥晶本的工商档案资料、合肥晶本出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项の確認函》、发行人董事、监事和高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，合肥晶本于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，合肥晶本的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。合肥晶本为发行人员工持股平台，与发行人其他员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策（系发行人员工持股平台的管理机构），除此之外，合肥晶本与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。合肥晶本持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

25、合肥晶洛

(1) 基本情况

合肥晶洛是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，系发行人员工持股平台，发行人设立时合肥晶洛持有发行人股份的比例为 0.04%。

根据合肥晶洛持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，合肥晶洛的基本情况如下表所示：

名称:	合肥晶洛企业管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所:	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1111-1
统一社会信用代码:	91340100MA2W3YBK2D
执行事务合伙人:	合肥晶策企业管理有限公司（委派代表：曹宗野）
类型:	有限合伙企业
经营范围:	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限:	2020年8月17日至2030年8月16日

（2）合伙人情况

根据合肥晶洛的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶洛的合伙人及其出资情况如下表所示：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.06	/
2	张艳	有限合伙人	8.00	2.32	洗净工程部主任工程师
3	申政	有限合伙人	8.00	2.32	自动化工程部主任工程师
4	张晓亮	有限合伙人	8.00	2.32	蚀刻工程部技术副理
5	吴杰	有限合伙人	8.00	2.32	品质体系管理部主任工程师
6	甄福强	有限合伙人	8.00	2.32	良率提升部主任工程师
7	王茹	有限合伙人	8.00	2.32	制程整合部技术副理
8	李波	有限合伙人	8.00	2.32	厂务一部主任工程师
9	周亚	有限合伙人	8.00	2.32	厂务一部主任工程师
10	余建军	有限合伙人	8.00	2.32	产品工程部技术副理
11	罗贤福	有限合伙人	8.00	2.32	洗净工程部技术副理
12	索圣涛	有限合伙人	8.00	2.32	黄光工程部技术副理
13	冯玲	有限合伙人	8.00	2.32	IP服务一组主任工程师
14	张庆楼	有限合伙人	8.00	2.32	化学机械研磨工程部主任工程师
15	杨翼虎	有限合伙人	8.00	2.32	设备整合部主任工程师
16	周高	有限合伙人	8.00	2.32	薄膜工程部主任工程师
17	陈红军	有限合伙人	8.00	2.32	分析技术部主任工程师
18	李加龙	有限合伙人	8.00	2.32	厂务一部技术副理

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
19	陈诚	有限合伙人	8.00	2.32	厂务二部主任工程师
20	李翔	有限合伙人	8.00	2.32	自动化工程部主任工程师
21	戴东正	有限合伙人	8.00	2.32	自动化工程部主任工程师
22	王阳阳	有限合伙人	8.00	2.32	PDK 组主任工程师
23	胡勤	有限合伙人	8.00	2.32	电脑整合制造部主任工程师
24	蒋栋梁	有限合伙人	8.00	2.32	厂务一部主任工程师
25	章淑媛	有限合伙人	8.00	2.32	电脑整合制造部主任工程师
26	耿辉	有限合伙人	8.00	2.32	厂务二部主任工程师
27	田园	有限合伙人	8.00	2.32	薄膜工程部主任工程师
28	陈炜	有限合伙人	8.00	2.32	品质工程部技术副理
29	丁贤林	有限合伙人	8.00	2.32	客户工程一部主任工程师
30	郑璐	有限合伙人	8.00	2.32	品质体系管理部主任工程师
31	马杰	有限合伙人	8.00	2.32	厂务一部主任工程师
32	葛杨	有限合伙人	8.00	2.32	厂务一部技术副理
33	贺勇	有限合伙人	8.00	2.32	扩散工程部主任工程师
34	葛成海	有限合伙人	7.00	2.03	逻辑一部代副理
35	田文星	有限合伙人	7.00	2.03	分析及可靠性工程部代副理
36	雷明芹	有限合伙人	7.00	2.03	工安环保部代副理
37	杨黎	有限合伙人	5.00	1.45	代工业务一组主任工程师
38	李冉	有限合伙人	5.00	1.45	流程整合组技术副理
39	张亚南	有限合伙人	5.00	1.45	电脑整合制造部主任工程师
40	陶磊	有限合伙人	5.00	1.45	扩散开发部主任工程师
41	李晓刚	有限合伙人	5.00	1.45	电脑整合制造部主任工程师
42	李丽鲜	有限合伙人	5.00	1.45	产品工程部主任工程师
43	程挚	有限合伙人	5.00	1.45	扩散开发部主任工程师
44	陈宗义	有限合伙人	5.00	1.45	先进整合后端组主任工程师
45	崔一丁	有限合伙人	5.00	1.45	市场行销处主任工程师
46	殷赛赛	有限合伙人	5.00	1.45	量测技术部主任工程师
47	薛君	有限合伙人	5.00	1.45	量测技术部主任工程师
48	李可玉	有限合伙人	5.00	1.45	光学模型组主任工程师
49	赵伟	有限合伙人	5.00	1.45	电脑整合制造部主任工程师
50	李文庆	有限合伙人	2.00	0.58	品质工程部副理

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
	合计		344.20	100.00	-

(3) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据合肥晶洛的工商档案资料、合肥晶洛出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项の確認函》、发行人董事、监事和高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，合肥晶洛于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，合肥晶洛的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。合肥晶洛为发行人员工持股平台，与发行人其他员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策（系发行人员工持股平台的管理机构），除此之外，合肥晶洛与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。合肥晶洛持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

26、合肥晶辽

(1) 基本情况

合肥晶辽是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，系发行人员工持股平台，发行人设立时合肥晶辽持有发行人股份的比例为 0.03%。

根据合肥晶辽持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，合肥晶辽的基本情况如下表所示：

名称：	合肥晶辽企业管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1110-3
统一社会信用代码：	91340100MA2W49RG9F
执行事务合伙人：	合肥晶策企业管理有限公司（委派代表：曹宗野）
类型：	有限合伙企业

经营范围:	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限:	2020年8月20日至2030年8月12日

(2) 合伙人情况

根据合肥晶辽的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶辽的合伙人及其出资情况如下表所示：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.07	/
2	曾凯慧	有限合伙人	12.00	4.08	分析技术部副理
3	许凯迪	有限合伙人	12.00	4.08	自动化工程部技术副理
4	林胜雄	有限合伙人	12.00	4.08	厂务二部技术副理
5	刘志铭	有限合伙人	12.00	4.08	厂务一部副理
6	陈宏玮	有限合伙人	12.00	4.08	洗净开发部副理
7	钟尚仁	有限合伙人	12.00	4.08	厂务一部技术副理
8	王新贵	有限合伙人	12.00	4.08	薄膜开发部副理
9	翁文杰	有限合伙人	12.00	4.08	微影开发部技术副理
10	曾盟善	有限合伙人	12.00	4.08	薄膜开发部技术副理
11	蔡辉堂	有限合伙人	12.00	4.08	电脑辅助设计组技术副理
12	王曼真	有限合伙人	12.00	4.08	扩散工程部技术副理
13	吴德刚	有限合伙人	10.00	3.40	企划部副理
14	林宗晔	有限合伙人	10.00	3.40	电脑整合制造部副理
15	何瑞凤	有限合伙人	10.00	3.40	制程整合部代副理
16	蔡孟孺	有限合伙人	10.00	3.40	客户工程一部副理
17	简瑞荣	有限合伙人	10.00	3.40	协理
18	张家玮	有限合伙人	8.00	2.72	逻辑一部主任工程师
19	黄绍铭	有限合伙人	8.00	2.72	扩散工程部技术副理
20	黄任逢	有限合伙人	8.00	2.72	薄膜工程部主任工程师
21	林宏展	有限合伙人	8.00	2.72	蚀刻工程部主任工程师
22	张建烜	有限合伙人	8.00	2.72	厂务一部主任工程师
23	刘铭哲	有限合伙人	8.00	2.72	蚀刻工程部技术副理
24	林子荏	有限合伙人	8.00	2.72	蚀刻开发部技术副理

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
25	丘卓册	有限合伙人	8.00	2.72	厂务二部主任工程师
26	颜嘉亨	有限合伙人	8.00	2.72	策略规划组主任工程师
27	江承达	有限合伙人	8.00	2.72	量测技术部主任工程师
28	蔡志宏	有限合伙人	8.00	2.72	工安环保部技术副理
29	刘凯文	有限合伙人	8.00	2.72	薄膜工程部技术副理
30	蔡明洋	有限合伙人	8.00	2.72	扩散开发部技术副理
31	汤志英	有限合伙人	8.00	2.72	厂务一部主任工程师
合计			294.20	100.00	-

(3) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据合肥晶辽的工商档案资料、合肥晶辽出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项的确认函》、发行人董事、监事和高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，合肥晶辽于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，合肥晶辽的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。合肥晶辽为发行人员工持股平台，与发行人其他员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策（系发行人员工持股平台的管理机构），除此之外，合肥晶辽与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。合肥晶辽持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

27、合肥晶确

(1) 基本情况

合肥晶确是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，系发行人员工持股平台，发行人设立时合肥晶确持有发行人股份的比例为 0.03%。

根据合肥晶确持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，合肥晶确的基本情况如下表所示：

名称:	合肥晶确企业管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所:	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1111-3
统一社会信用代码:	91340100MA2W3YFJXN
执行事务合伙人:	合肥晶策企业管理有限公司（委派代表：曹宗野）
类型:	有限合伙企业
经营范围:	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限:	2020年8月17日至2030年8月16日

（2）合伙人情况

根据合肥晶确的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶确的合伙人及其出资情况如下表所示：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.08	/
2	简瑞荣	有限合伙人	15.00	6.12	协理
3	刘云	有限合伙人	5.00	2.04	分析技术部主任工程师
4	冉薇	有限合伙人	5.00	2.04	扩散工程部主任工程师
5	龚睿	有限合伙人	5.00	2.04	自动化工程部主任工程师
6	夏飞	有限合伙人	5.00	2.04	厂务一部主任工程师
7	王超	有限合伙人	5.00	2.04	分析技术部主任工程师
8	龚超	有限合伙人	5.00	2.04	分析技术部主任工程师
9	李晶	有限合伙人	5.00	2.04	厂务一部主任工程师
10	苏翔	有限合伙人	5.00	2.04	厂务一部主任工程师
11	王伟	有限合伙人	5.00	2.04	厂务一部主任工程师
12	李伟	有限合伙人	5.00	2.04	厂务一部主任工程师
13	高玉春	有限合伙人	5.00	2.04	自动化工程部主任工程师
14	吴曦	有限合伙人	5.00	2.04	厂务一部主任工程师
15	张悦	有限合伙人	5.00	2.04	分析技术部主任工程师
16	李克飞	有限合伙人	5.00	2.04	分析技术部主任工程师
17	李建	有限合伙人	5.00	2.04	厂务一部主任工程师
18	章昭	有限合伙人	5.00	2.04	厂务一部主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
19	余学会	有限合伙人	5.00	2.04	分析技术部主任工程师
20	何震	有限合伙人	5.00	2.04	分析技术部主任工程师
21	梁锐	有限合伙人	5.00	2.04	厂务一部主任工程师
22	何春龙	有限合伙人	5.00	2.04	厂务一部主任工程师
23	陈晓红	有限合伙人	5.00	2.04	扩散工程部主任工程师
24	马统越	有限合伙人	5.00	2.04	厂务一部主任工程师
25	于心礼	有限合伙人	5.00	2.04	自动化工程部主任工程师
26	李左军	有限合伙人	5.00	2.04	自动化工程部主任工程师
27	丁佳佳	有限合伙人	5.00	2.04	自动化工程部主任工程师
28	王永辉	有限合伙人	5.00	2.04	扩散工程部主任工程师
29	谢泉	有限合伙人	5.00	2.04	扩散工程部主任工程师
30	李文庆	有限合伙人	5.00	2.04	扩散工程部主任工程师
31	陆瑞	有限合伙人	5.00	2.04	厂务一部主任工程师
32	潘雨	有限合伙人	5.00	2.04	厂务一部主任工程师
33	张雷	有限合伙人	5.00	2.04	分析技术部主任工程师
34	范圣罗	有限合伙人	5.00	2.04	自动化工程部主任工程师
35	夏晶京	有限合伙人	5.00	2.04	厂务一部主任工程师
36	夏炎照	有限合伙人	5.00	2.04	厂务一部主任工程师
37	顾亚秋	有限合伙人	5.00	2.04	厂务一部主任工程师
38	张克磊	有限合伙人	5.00	2.04	厂务一部主任工程师
39	赵琼	有限合伙人	5.00	2.04	设备整合部主任工程师
40	祖文秀	有限合伙人	5.00	2.04	分析技术部主任工程师
41	钱发	有限合伙人	5.00	2.04	厂务一部主任工程师
42	王翠	有限合伙人	5.00	2.04	分析技术部主任工程师
43	汪雪春	有限合伙人	5.00	2.04	制程整合部主任工程师
44	程奎	有限合伙人	5.00	2.04	厂务二部主任工程师
45	韦彬	有限合伙人	5.00	2.04	自动化工程部主任工程师
46	蒋磊	有限合伙人	5.00	2.04	扩散工程部主任工程师
47	李贵徽	有限合伙人	5.00	2.04	扩散工程部主任工程师
48	万焜	有限合伙人	5.00	2.04	自动化工程部主任工程师
合计			245.20	100.00	-

(3) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据合肥晶确的工商档案资料、合肥晶确出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项的确认证函》、发行人董事、监事和高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，合肥晶确于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，合肥晶确的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。合肥晶确为发行人员工持股平台，与发行人其他员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策（系发行人员工持股平台的管理机构），除此之外，合肥晶确与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。合肥晶确持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

28、合肥晶铁

（1）基本情况

合肥晶铁是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，系发行人员工持股平台，发行人设立时合肥晶铁持有发行人股份的比例为 0.03%。

根据合肥晶铁持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，合肥晶铁的基本情况如下表所示：

名称：	合肥晶铁企业管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1113-2
统一社会信用代码：	91340100MA2W3Y9Y4K
执行事务合伙人：	合肥晶策企业管理有限公司（委派代表：曹宗野）
类型：	有限合伙企业
经营范围：	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限：	2020 年 8 月 17 日至 2030 年 8 月 16 日

（2）合伙人情况

根据合肥晶铁的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶铁的合伙人及其出资情况如下表所示：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.08	/
2	宫保友	有限合伙人	5.00	2.04	薄膜工程部主任工程师
3	汪丹丹	有限合伙人	5.00	2.04	蚀刻工程部主任工程师
4	王安然	有限合伙人	5.00	2.04	蚀刻工程部主任工程师
5	刘辉	有限合伙人	5.00	2.04	黄光工程部主任工程师
6	卜立一	有限合伙人	5.00	2.04	化学机械研磨工程部主任工程师
7	耿佳	有限合伙人	5.00	2.04	蚀刻工程部主任工程师
8	张乐	有限合伙人	5.00	2.04	化学机械研磨工程部主任工程师
9	吴宣	有限合伙人	5.00	2.04	黄光工程部主任工程师
10	张凯	有限合伙人	5.00	2.04	制造部生产线主任
11	刘刚	有限合伙人	5.00	2.04	蚀刻工程部主任工程师
12	黄未来	有限合伙人	5.00	2.04	蚀刻工程部主任工程师
13	王璇	有限合伙人	5.00	2.04	化学机械研磨工程部主任工程师
14	陈博	有限合伙人	5.00	2.04	黄光工程部主任工程师
15	沈毛振	有限合伙人	5.00	2.04	化学机械研磨工程部主任工程师
16	吴东东	有限合伙人	5.00	2.04	薄膜工程部主任工程师
17	王光宇	有限合伙人	5.00	2.04	客户工程二部主任工程师
18	牛保林	有限合伙人	5.00	2.04	制造部生产线主任
19	王璐璐	有限合伙人	5.00	2.04	制造部主任工程师
20	邱明记	有限合伙人	5.00	2.04	黄光工程部主任工程师
21	张晗	有限合伙人	5.00	2.04	生管物管部主任工程师
22	王龙	有限合伙人	5.00	2.04	制造部主任工程师
23	吴数林	有限合伙人	5.00	2.04	薄膜工程部主任工程师
24	邵风展	有限合伙人	5.00	2.04	薄膜工程部主任工程师
25	王亮	有限合伙人	5.00	2.04	薄膜工程部主任工程师
26	陆舒楠	有限合伙人	5.00	2.04	黄光工程部主任工程师
27	范成健	有限合伙人	5.00	2.04	黄光工程部主任工程师
28	简瑞荣	有限合伙人	5.00	2.04	助理
29	陈建龙	有限合伙人	5.00	2.04	黄光工程部主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
30	胡亚东	有限合伙人	5.00	2.04	化学机械研磨工程部主任工程师
31	王昆	有限合伙人	5.00	2.04	蚀刻工程部主任工程师
32	单洪亮	有限合伙人	5.00	2.04	扩散工程部主任工程师
33	苗洁	有限合伙人	5.00	2.04	薄膜工程部主任工程师
34	熊健	有限合伙人	5.00	2.04	生管物管部代副理
35	赵昆	有限合伙人	5.00	2.04	薄膜工程部主任工程师
36	李孙峰	有限合伙人	5.00	2.04	蚀刻工程部主任工程师
37	汪小敏	有限合伙人	5.00	2.04	蚀刻工程部主任工程师
38	戴惠敏	有限合伙人	5.00	2.04	生管物管部主任工程师
39	金满根	有限合伙人	5.00	2.04	制造部主任工程师
40	高攀	有限合伙人	5.00	2.04	蚀刻工程部主任工程师
41	董骏	有限合伙人	5.00	2.04	薄膜工程部主任工程师
42	冯静	有限合伙人	5.00	2.04	制造部主任工程师
43	金志欢	有限合伙人	5.00	2.04	制造部生产线主任
44	方小峰	有限合伙人	5.00	2.04	薄膜工程部主任工程师
45	蒋建新	有限合伙人	5.00	2.04	化学机械研磨工程部主任工程师
46	方娟	有限合伙人	5.00	2.04	生管物管部主任工程师
47	黄瑞宇	有限合伙人	5.00	2.04	黄光工程部主任工程师
48	代阳阳	有限合伙人	5.00	2.04	量测技术部主任工程师
49	张亚楠	有限合伙人	5.00	2.04	黄光工程部主任工程师
50	刘小东	有限合伙人	5.00	2.04	薄膜工程部主任工程师
合计			245.20	100.00	-

(3) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据合肥晶铁的工商档案资料、合肥晶铁出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项的确认证》、发行人董事、监事和高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，合肥晶铁于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，合肥晶铁的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。合肥晶铁为发行人员工持股平台，与发行人其他员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策（系发行人员工

持股平台的管理机构），除此之外，合肥晶铁与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。合肥晶铁持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

29、合肥晶妥

(1) 基本情况

合肥晶妥是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，系发行人员工持股平台，发行人设立时合肥晶妥持有发行人股份的比例为 0.03%。

根据合肥晶妥持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，合肥晶妥的基本情况如下表所示：

名称:	合肥晶妥企业管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所:	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1115-2
统一社会信用代码:	91340100MA2W3YDJ77
执行事务合伙人:	合肥晶策企业管理有限公司（委派代表：曹宗野）
类型:	有限合伙企业
经营范围:	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限:	2020年8月17日至2030年8月16日

(2) 合伙人情况

根据合肥晶妥的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶妥的合伙人及其出资情况如下表所示：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.08	/
2	黄晋德	有限合伙人	10.00	4.16	业务一处资深处长
3	余鹏	有限合伙人	5.00	2.08	电脑整合制造部主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
4	谢烈翔	有限合伙人	5.00	2.08	逻辑一部主任工程师
5	刘利娟	有限合伙人	5.00	2.08	品质工程部主任工程师
6	孙航海	有限合伙人	5.00	2.08	电脑整合制造部主任工程师
7	柯焱	有限合伙人	5.00	2.08	洗净工程部主任工程师
8	李波	有限合伙人	5.00	2.08	逻辑二部代副理
9	马忠祥	有限合伙人	5.00	2.08	逻辑二部代副理
10	丁璇璇	有限合伙人	5.00	2.08	行政与网络系统部主任工程师
11	吴俊	有限合伙人	5.00	2.08	行政与网络系统部主任工程师
12	张静	有限合伙人	5.00	2.08	先进整合前端组主任工程师
13	侯丹丹	有限合伙人	5.00	2.08	品质工程部主任工程师
14	程洋	有限合伙人	5.00	2.08	核心技术一部代副理
15	郝利兰	有限合伙人	5.00	2.08	洗净工程部主任工程师
16	王丽雅	有限合伙人	5.00	2.08	分析及可靠性工程部代副理
17	张永仓	有限合伙人	5.00	2.08	洗净工程部主任工程师
18	许飞	有限合伙人	5.00	2.08	核心技术一部主任工程师
19	俞佩佩	有限合伙人	5.00	2.08	分析及可靠性工程部主任工程师
20	周芹芹	有限合伙人	5.00	2.08	经营与营运系统部主任工程师
21	陈国彬	有限合伙人	5.00	2.08	品质工程部主任工程师
22	刘丹丹	有限合伙人	5.00	2.08	元件开发部主任工程师
23	张国庆	有限合伙人	5.00	2.08	洗净工程部主任工程师
24	叶秀平	有限合伙人	5.00	2.08	总经理室主任管理师
25	颜传奇	有限合伙人	5.00	2.08	风险控制部主任工程师
26	谭倩倩	有限合伙人	5.00	2.08	经营与营运系统部主任工程师
27	王琳	有限合伙人	5.00	2.08	工安环保部主任工程师
28	马婷	有限合伙人	5.00	2.08	元件开发部代副理
29	高创	有限合伙人	5.00	2.08	洗净工程部主任工程师
30	李磊	有限合伙人	5.00	2.08	风险控制部主任工程师
31	目晶晶	有限合伙人	5.00	2.08	分析及可靠性工程部主任工程师
32	葛祥福	有限合伙人	5.00	2.08	品质工程部主任工程师
33	葛键	有限合伙人	5.00	2.08	流程整合组主任工程师
34	王博	有限合伙人	5.00	2.08	品质工程部主任工程师
35	操梦雅	有限合伙人	5.00	2.08	先进整合一组主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
36	吕玉波	有限合伙人	5.00	2.08	品质体系管理部主任工程师
37	崔洁	有限合伙人	5.00	2.08	行政与网络系统部主任工程师
38	宋明明	有限合伙人	5.00	2.08	逻辑二部主任工程师
39	储挺进	有限合伙人	5.00	2.08	电脑辅助设计组主任工程师
40	郑鹏	有限合伙人	5.00	2.08	洗净工程部主任工程师
41	王云龙	有限合伙人	5.00	2.08	风险控制部主任工程师
42	孟娟	有限合伙人	5.00	2.08	核心技术一部主任工程师
43	马成	有限合伙人	5.00	2.08	经营管理组主任工程师
44	彭涛	有限合伙人	5.00	2.08	企划部主任工程师
45	张东杰	有限合伙人	5.00	2.08	电脑整合制造部主任工程师
46	韩小琴	有限合伙人	5.00	2.08	洗净工程部主任工程师
47	徐恩杰	有限合伙人	5.00	2.08	行政与网络系统部主任工程师
48	曹文强	有限合伙人	5.00	2.08	经营与营运系统部主任工程师
合计			240.20	100.00	-

(3) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据合肥晶妥的工商档案资料、合肥晶妥出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项の確認函》、发行人董事、监事和高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，合肥晶妥于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，合肥晶妥的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。合肥晶妥为发行人员工持股平台，与发行人其他员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策（系发行人员工持股平台的管理机构），除此之外，合肥晶妥与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。合肥晶妥持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

30、合肥晶雄

(1) 基本情况

合肥晶雄是一家依据中国法律成立的有限合伙企业，系发行人员工持股平台，发行人设立时合肥晶雄持有发行人股份的比例为 0.02%。

根据合肥晶雄持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，合肥晶雄的基本情况如下表所示：

名称:	合肥晶雄企业管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所:	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦 1115-2
统一社会信用代码:	91340100MA2W4DM4X7
执行事务合伙人:	合肥晶策企业管理有限公司（委派代表：曹宗野）
类型:	有限合伙企业
经营范围:	企业管理咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限:	2020年8月20日至2030年8月16日

（2）合伙人情况

根据合肥晶雄的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶雄的合伙人及其出资情况如下表所示：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.13	/
2	黄南翔	有限合伙人	36.00	23.97	生管物管部代经理
3	陈文璟	有限合伙人	20.00	13.32	制程整合部副理
4	李维泽	有限合伙人	12.00	7.99	扩散工程部技术副理
5	简瑞荣	有限合伙人	10.00	6.66	协理
6	蔡君正	有限合伙人	8.00	5.33	先进整合前端组技术副理
7	陈欣蕙	有限合伙人	8.00	5.33	元件开发部技术副理
8	陈佳局	有限合伙人	6.00	3.99	经营与营运系统部副理
9	萧凯彰	有限合伙人	6.00	3.99	厂务一部副理
10	郑淙徽	有限合伙人	5.00	3.33	量测技术部主任工程师
11	姚怡雯	有限合伙人	5.00	3.33	核心技术二部主任工程师
12	陈俊雄	有限合伙人	5.00	3.33	品质体系管理部主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	在发行人处任职情况
13	赖韦伶	有限合伙人	5.00	3.33	制程整合技术处主任工程师
14	林岳煌	有限合伙人	5.00	3.33	制造部主任工程师
15	葛年翔	有限合伙人	5.00	3.33	蚀刻工程部主任工程师
16	李奇威	有限合伙人	5.00	3.33	制造部生产线主任
17	沈丞伟	有限合伙人	5.00	3.33	薄膜工程部主任工程师
18	陈明睿	有限合伙人	3.00	2.00	可靠度元件模拟组主任工程师
19	郭千琦	有限合伙人	1.00	0.67	模型器件组技术副理
合计			150.20	100.00	-

(3) 申报前 12 个月内新增股东的相关核查

根据合肥晶雄的工商档案资料、合肥晶雄出具的《关于所持合肥晶合集成电路股份有限公司股份等相关事项的确认函》、发行人董事、监事和高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师核查，合肥晶雄于 2020 年 9 月通过增资扩股成为发行人股东，系申报前 12 个月内新增股东，合肥晶雄的增资价格及定价依据等情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。合肥晶雄为发行人员工持股平台，与发行人其他员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策（系发行人员工持股平台的管理机构），除此之外，合肥晶雄与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，具备法律、法规规定的股东资格。合肥晶雄持有的晶合集成股份不存在争议或潜在纠纷。

综上，本所认为，各发起人均具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人或进行出资的资格。

(二) 发起人的人数、住所、出资比例

根据发行人《公司章程》《发起人协议》及容诚于 2020 年 11 月 20 日出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司（筹）验资报告》（容诚验字[2020]230Z0263 号）并经本所律师核查，发行人股份公司设立时，发起人共计 30 名。各发起人的住所情况详见本律师工作报告“六、发起人和股东”之“（一）发起人的资格”。

发行人作为股份公司设立时，各发起人的出资比例如下表所示：

股东名称	出资方式	持股股数（万股）	持股比例（%）
合肥建投	净资产折股	46,847.4592	31.14
合肥芯屏	净资产折股	32,873.6799	21.85
力晶科技	净资产折股	41,282.4208	27.44
美的创新	净资产折股	8,801.4118	5.85
中安智芯	净资产折股	3,960.6354	2.63
惠友豪创	净资产折股	2,640.4236	1.75
合肥存鑫	净资产折股	2,640.4236	1.75
海通创新	净资产折股	1,760.2824	1.17
杭州承富	净资产折股	1,540.2471	1.02
泸州隆信	净资产折股	1,320.2118	0.88
宁波华淳	净资产折股	1,320.2118	0.88
中小企业基金	净资产折股	1,320.2118	0.88
安华创新	净资产折股	880.1412	0.58
集创北方	净资产折股	880.1412	0.58
中金浦成	净资产折股	176.0282	0.12
合肥晶煅	净资产折股	519.5398	0.35
合肥晶遂	净资产折股	419.7429	0.28
合肥晶炯	净资产折股	381.3060	0.25
合肥晶咖	净资产折股	145.6606	0.10
合肥晶珏	净资产折股	126.2054	0.08
合肥晶梢	净资产折股	117.4082	0.08
合肥晶柔	净资产折股	86.2798	0.06
合肥晶悬	净资产折股	85.2648	0.06
合肥晶本	净资产折股	77.9902	0.05
合肥晶洛	净资产折股	58.1966	0.04
合肥晶辽	净资产折股	49.7378	0.03
合肥晶确	净资产折股	41.4481	0.03
合肥晶铁	净资产折股	41.4481	0.03
合肥晶妥	净资产折股	40.6023	0.03
合肥晶雄	净资产折股	25.3764	0.02
合计	-	150,460.1368	100.00

经本所律师核查，发行人 30 名发起人中，除力晶科技外，其他 29 名发起人合肥建投、合肥芯屏、美的创新、中安智芯、惠友豪创、合肥存鑫、海通创新、杭州承富、泸州隆信、宁波华淳、中小企业基金、安华创新、集创北方、中金浦成、合肥晶煨、合肥晶遂、合肥晶炯、合肥晶咖、合肥晶珏、合肥晶梢、合肥晶柔、合肥晶悬、合肥晶本、合肥晶洛、合肥晶辽、合肥晶确、合肥晶铁、合肥晶妥、合肥晶雄皆在中国境内有住所，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，本所认为，发行人的发起人人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人的现有股东

经本所律师核查，自发行人设立至本律师工作报告出具日，发行人的股份结构未发生变化，发行人的现有股东即发行人的发起人。

（四）发行人现有股东之间的关联关系

根据发行人股东提供的资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，发行人现有股东之间存在的关联关系情况如下：

合肥建投直接持有合肥芯屏 47.44%的合伙份额，并通过持有合肥芯屏普通合伙人合肥建投资本管理有限公司 70.83%的股权控制合肥芯屏。发行人 15 个员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构。

除上述情况外，发行人股东之间不存在关联关系。

（五）发行人的控股股东及实际控制人

1、发行人的控股股东及实际控制人的认定

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，合肥建投直接持有发行人 31.14%的股份，并通过合肥芯屏控制发行人 21.85%的股份，合计控制发行人 52.99%的股份；发行人董事会中，6 名董事由合肥建投提名，合肥建投系发行人的控股股东。合肥市国资委持有合肥建投 100%的股权，系发行人的实际控制人。经核查，发行人控股股东、实际控制人不存在设立在国际避税区且持股层次复杂的情形。

2、发行人实际控制人近两年未发生变更

经本所律师核查，报告期内，合肥建投支配发行人 50% 以上的股权，委派或提名发行人半数以上董事，合肥建投实际支配的表决权足以对发行人董事会、股东大会的决议产生重大影响；合肥建投的唯一股东为合肥市国资委。本所认为，发行人最近两年实际控制人未发生变更。

（六）发起人的出资

1、根据《发起人协议》《公司章程》及容诚于 2020 年 11 月 20 日出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司（筹）验资报告》（容诚验字[2020]230Z0263 号），并经本所律师核查，发行人系由其前身晶合有限以其经审计净资产值折股整体变更而来，各发起人均以其所持晶合有限股权所对应的净资产作为对发行人的出资。各发起人投入发行人的资产产权关系清晰，将上述资产投入发行人不存在法律障碍。

2、经本所律师核查，发行人的设立属于有限责任公司整体变更为股份有限公司，发行人不存在将全资附属企业或其他企业先注销再折价入股或以在其他企业中的权益折价入股的情形。

3、经本所律师核查，发行人的设立属于有限责任公司整体变更为股份有限公司，各发起人以其对晶合有限出资形成的权益所对应的净资产折为其所拥有的发行人的股份，晶合有限的资产、业务和债权、债务全部由发行人承继，相应的资产或权利的权属证书所有人名称已变更为发行人或正在办理变更为发行人的手续。

（七）员工持股计划

1、员工持股计划的人员构成

发行人 15 个员工持股平台的人员构成详见本律师工作报告“六、发起人和股东”之“（一）发起人的资格”。

本所认为，发行人员工持股计划的人员构成符合公司《员工持股管理办法》的规定。

2、减持承诺

根据公司《员工持股管理办法》，员工持股平台不在公司首次公开发行股票时转让股份，并自公司上市之日起锁定 36 个月。

发行人 15 个员工持股平台作为发行人股东，分别出具了《关于股份锁定的承诺函》，就所持发行人股份的锁定期承诺如下：自晶合集成本次发行上市之日起 36 个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份，也不由晶合集成回购本公司/本企业在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份。

本所认为，发行人员工持股平台上述锁定承诺符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规和中国证监会、上交所的相关规定。

3、员工持股平台的具体安排及规范运行情况

2020 年 9 月 10 日，晶合有限董事会通过《员工持股管理办法》，对于员工加入及退出员工持股平台进行了明确规定，具体如下：

（1）员工加入持股平台的相关规定

根据公司《员工持股管理办法》，除非另有规定，在经批准的员工持股计划实施方案范围内，公司相关员工达到公司考核标准后，经员工持股平台管理人书面同意，可以取得员工持股平台的股权/出资份额。如直系亲属多人在公司的，只能一人持股。员工持股计划实行以岗定股，相关员工不得存在以下情形：最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；最近 36 个月内存在损害公司利益的情形的；存在《公司法》第 148 条规定的行为，违反其对公司、子公司或任职关联企业的忠实义务的；为各级党委、政府及其部门、机构任命的国有企业领导人员；为公司外部董事、监事（含职工代表监事）；法律法规规定不得参与员工持股计划的。

（2）员工退出持股平台的相关规定

根据公司《员工持股管理办法》，除非另有规定，并经员工持股平台管理人事先书面同意，于禁售期届满前员工不得向第三人（包括员工持股平台的其他员工）转让

其在员工持股平台中的全部或部分股权/财产份额。员工违反本办法擅自转让的，该转让行为无效并应当赔偿由此给员工持股平台造成的损失。

根据公司《员工持股管理办法》，于禁售期届满前，员工因任何原因（包括但不限于解除或终止劳动合同关系、退休、丧失民事行为能力、死亡等）自公司或其子公司或关联企业离职的，则该员工（或其继承人、法定代理人或监护人）应当向员工持股平台管理人（或其指定的符合条件的人士；下同）转让其持有的员工持股平台全部股权/财产份额，但另有约定或员工持股平台管理人书面同意的除外。员工（或其继承人、法定代理人或监护人）按照规定向员工持股平台管理人转让其股权/财产份额的，转让价格由交易双方协商确定，员工持股平台向该等员工支付转让价款时将扣减相应的税费。

于禁售期届满后，员工因任何原因（包括但不限于解除或终止劳动合同关系、退休、丧失民事行为能力、死亡等）自公司或其子公司或关联企业离职的，则该员工（或其继承人、法定代理人或监护人）应当向员工持股平台管理人转让其持有的、尚未完全解除出售限制的全部员工持股平台股权/财产份额，但另有约定或员工持股平台管理人书面同意的除外。员工（或其继承人、法定代理人或监护人）按照规定向员工持股平台管理人转让其股权/财产份额的，转让价格由交易双方协商确定，员工持股平台向该等员工支付转让价款时将扣减相应的税费。

除另有约定或员工持股平台管理人书面同意外，无论员工因任何原因离职，该员工（或其继承人、法定代理人或监护人）应于其提出离职之日起 15 个自然日内（以下简称出售期限）向员工持股平台管理人发出指示，按规定出售/减持其持有的员工持股平台股权/财产份额。出售期限届满后，员工未向员工持股平台管理人发出出售/减持指示的，员工持股平台管理人有权自主决定出售/减持上述员工持有的股权/财产份额，且无须对此承担法律责任。离职员工持有的未经解除出售限制的股权/财产份额，依照前述规定办理。

员工持股平台的合伙人如存在与发行人解除或终止劳动合同关系的情形，经员工持股平台管理人事先同意后，向员工持股平台管理人及其指定的符合条件的人士转让。

(3) 员工持股平台的规范运行情况

根据发行人书面说明，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，发行人15个员工持股平台中的有限合伙人均为发行人在职员工，符合《员工持股管理办法》的相关规定，具体情况详见本律师工作报告“六、发起人和股东”之“（一）发起人的资格”。

4、是否履行登记备案程序

发行人的员工持股平台，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，不涉及由私募投资基金管理人管理并进行有关投资活动，或者受托管理任何私募投资基金的情形，除投资发行人外，未开展其他经营活动。本所认为，发行人的员工持股平台不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需按照规定履行私募投资基金备案程序。

七、发行人的股本及其演变

（一）发行人设立时的股本结构

发行人设立时的具体情况详见本律师工作报告“四、发行人的设立”。发行人设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	持股股数（万股）	持股比例（%）
1	合肥建投	46,847.4592	31.14
2	合肥芯屏	32,873.6799	21.85
3	力晶科技	41,282.4208	27.44
4	美的创新	8,801.4118	5.85
5	中安智芯	3,960.6354	2.63
6	惠友豪创	2,640.4236	1.75
7	合肥存鑫	2,640.4236	1.75
8	海通创新	1,760.2824	1.17
9	杭州承富	1,540.2471	1.02
10	泸州隆信	1,320.2118	0.88

序号	股东名称	持股股数（万股）	持股比例（%）
11	宁波华淳	1,320.2118	0.88
12	中小企业基金	1,320.2118	0.88
13	安华创新	880.1412	0.58
14	集创北方	880.1412	0.58
15	中金浦成	176.0282	0.12
16	合肥晶煨	519.5398	0.35
17	合肥晶遂	419.7429	0.28
18	合肥晶炯	381.3060	0.25
19	合肥晶咖	145.6606	0.10
20	合肥晶珏	126.2054	0.08
21	合肥晶梢	117.4082	0.08
22	合肥晶柔	86.2798	0.06
23	合肥晶悬	85.2648	0.06
24	合肥晶本	77.9902	0.05
25	合肥晶洛	58.1966	0.04
26	合肥晶辽	49.7378	0.03
27	合肥晶确	41.4481	0.03
28	合肥晶铁	41.4481	0.03
29	合肥晶妥	40.6023	0.03
30	合肥晶雄	25.3764	0.02
合计		150,460.1368	100.00

综上所述，本所认为，发行人设立时的股权设置、股本结构合法有效。

（二）发行人及其前身的历次股权变动情况

1、2015年5月，晶合有限设立

2015年4月27日，合肥市人民政府与力晶科技签署《12吋晶圆制造基地项目合作框架协议》，约定双方共同合作实施合肥新站综合开发试验区12英寸晶圆制造基地项目。

2015年5月12日，合肥市国资委下发合国资产权[2015]60号批复，同意合肥建投组建全资子公司晶合有限，注册资本为1,000万元。

2015年5月19日，合肥建投签署《合肥晶合集成电路有限公司章程》，晶合有限注册资本为1,000.00万元，由合肥建投全额认缴。

2015年5月19日，合肥市工商局向晶合有限核发了《营业执照》（注册号：340108000130981），注册资本为1,000万元，由合肥建投全额认缴。

2021年3月12日，容诚出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0049号），经复核，截至2015年5月29日，晶合有限已收到合肥建投缴纳的实收资本合计1,000万元。

根据晶合有限设立时的工商档案资料，晶合有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投	1,000	100
	合计	1,000	100

2、2016年2月，第一次增资

2015年10月，合肥建投与力晶科技签署《合肥12吋晶圆制造基地项目投资参股协议书》（以下简称《投资参股协议》），约定合肥建投或其协调指定投资机构与力晶科技共同投资参股晶合有限，各方投资按项目实施进度分期投入。

2015年12月25日，受合肥建投委托，北京中企华资产评估有限责任公司出具了《合肥市建设投资控股（集团）有限公司拟对所持合肥晶合集成电路有限公司的股权价值进行评估项目的评估报告》（中企华评报字[2015]第4241号），截至评估基准日2015年11月30日，晶合有限的净资产价值评估结果为1,003.72万元。2016年1月4日，合肥市国资委就上述资产评估项目基本情况及资产评估结果出具了《国有资产评估项目备案表》。

2016年1月11日，合肥市国资委下发《关于同意对合肥晶合集成电路有限公司增资的批复》（合国资产权[2016]9号），同意将晶合有限注册资本增加至111,000万元，增资后股本结构为：合肥芯屏出资99,996.28万元、持股90.09%，力晶科技出资10,000万元、持股9.01%，合肥建投出资1,003.72万元、持股0.90%。

2016年1月20日，合肥建投、力晶科技和合肥芯屏签署《增资并购协议》及《合资合同》，约定投资完成后，晶合有限的投资总额为111,000万元，注册资本为111,000万元，其中：合肥芯屏出资99,996.28万元、持股90.09%，力晶科技出资10,000万元、持股9.01%，合肥建投出资1,003.72万元、持股0.90%。

2016年2月1日，合肥市商务局下发《关于同意外资并购合肥晶合集成电路有限公司的批复》（合商审[2016]7号），同意晶合有限增加注册资本110,000万元，其中：合肥芯屏以人民币现金出资99,996.28万元，力晶科技以境外人民币出资10,000万元，合肥建投以经评估后的2015年末分配利润3.72万元人民币转增注册资本。增资后，晶合有限企业类型由内资企业变更为中外合资企业。

2016年2月2日，安徽省人民政府就上述增资事宜向晶合有限颁发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资皖府资字[2016]17号）。

2016年2月19日，合肥市工商局向晶合有限换发《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q），公司注册资本变更为111,000万元。

2016年4月6日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（会验字[2016]2407号），经审验，截至2016年4月6日，已收到合肥芯屏和力晶科技缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币109,996.28万元，已将未分配利润3.72万元转增资本。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投	1,003.72	0.90
2	合肥芯屏	99,996.28	90.09
3	力晶科技	10,000.00	9.01
合计		111,000.00	100.00

3、2017年3月，第二次增资

（1）基本情况

2015年10月，晶合有限与力晶科技、合肥建投签订《技术移转协议》，约定力晶科技将驱动芯片代工所需技术提供给公司，用以出资的转移技术（专有技术）作价20亿元，2017年3月31日前完成20亿元技术入股出资手续。

2016年12月28日，安徽华洲资产评估有限公司就力晶科技拟以无形资产出资项目出具《资产评估报告书》（华洲评报字[2016]第056号），截至评估基准日2016年10月31日，力晶科技拟出资58项专利技术使用权的评估价值为204,950.05万元。2017年3月10日，合肥市国资委就上述资产评估项目基本情况及资产评估结果出具了《接受非国有资产评估项目备案表》。

2017年3月17日，晶合有限召开董事会并作出决议，同意公司增加注册资本446,000万元，其中：力晶科技以货币出资20,000万元、以技术使用权出资200,000万元，合肥建投以货币出资226,000万元。增资后，公司注册资本变更为557,000万元。

2017年3月24日，合肥市国资委下发《关于同意对合肥晶合集成电路有限公司增资的批复》（合国资产权[2017]45号），同意将晶合有限注册资本增加至557,000万元，增资后股本结构为：合肥芯屏出资99,996.28万元、持股17.95%，力晶科技出资230,000万元、持股41.29%，合肥建投出资227,003.72万元、持股40.76%。

2017年3月24日，合肥市工商局向晶合有限换发《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q），公司注册资本变更为557,000万元。

2017年3月29日，台湾投审委出具经审二字第10600015560号函，依据《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》及《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》的规定，核准力晶科技以专门技术（晶圆代工制程相关技术）作价人民币20亿元，作为大陆地区投资业晶合有限之增资股本。

2017年3月29日，公司完成了外商投资企业变更备案。

2017年4月11日，安徽安智会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（安智验字[2017]第021号），经审验，截至2017年4月10日止，晶合有限已收到力晶科技、合肥建投缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币446,000万元，各股东以货币出资246,000万元，无形资产使用权出资200,000万元。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投	227,003.72	40.76
2	合肥芯屏	99,996.28	17.95
3	力晶科技	230,000.00	41.29
合计		557,000.00	100.00

（2）专利技术使用权出资的相关情况

根据《公司法》第二十七条规定，“可以用货币估价”并“可以依法转让”的非货币财产可以作价出资，且专利技术使用权不属于《公司注册资本登记管理规定》第五条列举的“劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等”不得作价出资的财产，双方已就专利技术使用权出资履行了资产评估、工商登记等手续。

2020年9月3日，为进一步完善力晶科技无形资产出资的资产的权利完整性，力晶科技与晶合有限签订了《专利转让协议》，力晶科技将上述58项专利中尚在有效期内的44项专利的所有权无偿转让给晶合有限。同日，晶合有限与全体股东（包括合肥建投、力晶科技和合肥芯屏）共同签署了《关于力晶科技对合肥晶合集成专利出资事项の確認函》，确认如下事项：

（1）公司全部注册资本已足额缴纳，公司股权权属清晰、明确，股东之间不存在任何争议及纠纷；此外，各方股东承诺若因其各自出资事项给晶合有限带来损失，相关损失由各方股东各自予以承担。

（2）为进一步完善力晶科技无形资产出资的资产的权利完整性，各方同意力晶科技将其以专利技术使用权出资所涉的专利技术的所有权无偿转让给晶合有限；各方同意晶合有限受让上述授权专利的所有相关权利；自转让完成之日起，晶合有限对上述授权专利享有完整的所有相关权利。

力晶科技以58项专利技术使用权出资时，已对出资专利技术使用权进行评估作价，但出具评估报告的资产评估公司安徽华洲资产评估有限公司不具备证券期货相关业务评估资格。为此，晶合有限聘请具备证券期货相关业务资格的评估机构同致信德（北京）资产评估有限公司（以下简称同致信德）对上述专利技术使用权进行评估复

核。2020年1月20日，同致信德出具了《关于对华州评报字（2016）第056号<力晶科技股份有限公司拟以无形资产出资项目>资产评估报告的复核报告》（同致信德评核字（2020）第050001号），经复核，原评估报告书所涉及评估基准日的选择适当，评估所依据的法律、法规和政策基本齐全，评估报告的格式、内容全面、正确、基本符合规范要求，评估方法的选用恰当，评估结论合理。

2021年1月7日，合肥新站高新技术产业开发区市场监督管理局出具《证明》，“经核查，合肥晶合集成电路股份有限公司自2018年1月1日起至2020年12月31日，在本辖区无因违反市场监管类法律法规而受到我局行政处罚的记录”。

本所认为，力晶科技以专利技术使用权出资未违反《公司法》等相关法律法规的强制性规定，发行人未因此受到工商行政主管部门的行政处罚，力晶科技已将尚在有效期内的44项专利的所有权无偿转让给晶合有限并完成了变更登记，双方之间不存在纠纷或潜在纠纷，力晶科技以专利技术使用权出资事宜不会对本次发行上市构成法律障碍。

4、2018年10月，第三次增资

2018年10月8日，晶合有限召开董事会并作出决议，一致同意增加公司注册资本137,000万元，其中：力晶科技以货币出资56,500万元，合肥芯屏以货币出资80,500万元。增资后，公司注册资本变更为694,000万元。

2018年10月11日，合肥市工商局向晶合有限换发《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q），公司注册资本变更为694,000万元。

2018年10月12日，公司完成了外商投资企业变更备案。

2018年10月17日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（会验字[2018]5985号），经审验，截至2018年10月15日止，晶合有限已收到合肥芯屏、力晶科技缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币137,000万元，各股东均以货币资金出资。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投	227,003.72	32.71
2	合肥芯屏	180,496.28	26.01
3	力晶科技	286,500.00	41.28
合计		694,000.00	100.00

5、2020年9月，减资

2020年7月24日，合肥市国资委出具《关于合肥晶合集成电路有限公司减少注册资本的意见》，晶合有限应按照《公司法》等有关规定，依法合规进行晶合有限减少注册资本工作。

2020年7月29日，晶合有限董事会通过决议，截至2020年6月底，晶合有限净资产规模低于实收资本，为确保后续引资、股改、上市的顺利进行，拟将公司注册资本核减至10亿元，核减的注册资本金额将等额计入资本公积，晶合有限净资产及各股东对晶合有限的持股比例保持不变。

2020年8月1日，晶合有限在《安徽日报》上刊登了减资公告，并就注册资本减少事宜通知了相关债权人。

2020年9月10日，晶合有限董事会通过决议，由于公司债权人对公司核减注册资本无异议，拟于减资公告发布45日期满后，向主管政府机关申请减资。

2020年9月15日，容诚出具《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0190号），经审验，截至2020年9月15日，公司已减少实收资本594,000.00万元，其中：减少合肥建投出资194,294.25万元，减少合肥芯屏出资154,488.17万元，减少力晶科技出资245,217.58万元。变更后，公司的累计注册资本为100,000.00万元，实收资本100,000.00万元。

2020年9月15日，合肥市市监局向晶合有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q）。

本次减资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投	32,709.47	32.71
2	合肥芯屏	26,008.11	26.01
3	力晶科技	41,282.42	41.28
合计		100,000.00	100.00

6、2020年9月，第四次增资

2020年7月1日，深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具《合肥市建设投资控股（集团）有限公司拟向其他投资者推介所涉及的合肥晶合集成电路有限公司股东全部权益资产评估报告》（鹏信资评报字[2020]第080号），以2019年12月31日为基准日对晶合有限全部股东权益进行评估，评估值为591,071.91万元。2020年9月16日，合肥市国资委就上述资产评估项目基本情况及资产评估结果出具了《国有资产评估项目备案表》。

2020年9月7日，合肥市国资委出具《关于同意对合肥晶合集成电路有限公司增资的批复》（合国资产权[2020]84号），同意合肥建投采用非公开协议方式以作价基础58.99亿元向晶合有限增资12.39亿元，同意员工持股平台采用非公开协议方式以作价基础59.11亿元向晶合有限增资1.31亿元。

2020年9月10日，晶合有限董事会通过决议，为进一步建立、健全公司的激励机制，形成对核心员工的有效激励与约束，增强公司凝聚力，与公司共担风险，保持公司在市场、技术及管理方面的竞争力，通过员工持股方案和员工持股管理办法；同意公司注册资本增加23,219.77万元，其中：合肥建投以货币出资认缴公司新增注册资本14,137.99万元，合肥芯屏以货币出资认缴公司新增注册资本6,865.57万元，员工持股平台以货币出资合计认缴公司新增注册资本2,216.21万元。

2020年9月16日，合肥市市监局向晶合有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q）。

2020年9月17日，容诚出具《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0191号），经审验，截至2020年9月17日，公司已收到新增注册资本23,219.77万元，变更后公司的累计注册资本为123,219.77万元，实收资本123,219.77万元。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投	46,847.4592	38.03
2	力晶科技	41,282.4208	33.50
3	合肥芯屏	32,873.6799	26.68
4	合肥晶焠	519.5398	0.35
5	合肥晶遂	419.7429	0.28
6	合肥晶炯	381.3060	0.25
7	合肥晶咖	145.6606	0.10
8	合肥晶珏	126.2054	0.08
9	合肥晶梢	117.4082	0.08
10	合肥晶柔	86.2798	0.06
11	合肥晶悬	85.2648	0.06
12	合肥晶本	77.9902	0.05
13	合肥晶洛	58.1966	0.04
14	合肥晶辽	49.7378	0.03
15	合肥晶确	41.4481	0.03
16	合肥晶铁	41.4481	0.03
17	合肥晶妥	40.6023	0.03
18	合肥晶雄	25.3764	0.02
合计		123,219.77	100.00

7、2020年9月，第五次增资

因公司产能扩充方面的资金需求，公司与外部机构投资者进行了接洽，拟引入外部机构投资者对公司增资。

2020年9月7日，中水致远出具了《合肥晶合集成电路有限公司拟进行增资扩股涉及的合肥晶合集成电路有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第020443号），以2020年7月31日为基准日对晶合有限股东全部权益价值进行评估，评估值为601,400.00万元。2020年9月16日，合肥市国资委就上述资产评估项目基本情况及资产评估结果出具了《国有资产评估项目备案表》。

2020年9月23日，合肥市国资委出具《关于同意引入战略投资者对合肥晶合集成电路有限公司增资扩股的批复》（合国资产权[2020]89号），同意合肥建投以经备案的评估价60.14亿元为底价，引入中安智芯等12家投资者，采用非公开协议方式按140亿元估值对晶合有限合计增资30.95亿元。

2020年9月25日，晶合有限董事会通过决议，同意引入中安智芯等12家外部投资者向公司增资，公司注册资本增加27,240.37万元，其中：美的创新以货币出资100,000万元认缴公司新增注册资本8,801.41万元，中安智芯以货币出资45,000万元认缴公司新增注册资本3,960.64万元，惠友豪创以货币出资30,000万元认缴公司新增注册资本2,640.42万元，合肥存鑫以货币出资30,000万元认缴公司新增注册资本2,640.42万元，海通创新以货币出资20,000万元认缴公司新增注册资本1,760.28万元，杭州承富以货币出资17,500万元认缴公司新增注册资本1,540.25万元，泸州隆信以货币出资15,000万元认缴公司新增注册资本1,320.21万元，宁波华淳以货币出资15,000万元认缴公司新增注册资本1,320.21万元，中小企业基金以货币出资15,000万元认缴公司新增注册资本1,320.21万元，安华创新以货币出资10,000万元认缴公司新增注册资本880.14万元，集创北方以货币出资10,000万元认缴公司新增注册资本880.14万元，中金浦成以货币出资2,000万元认缴公司新增注册资本176.03万元。

2020年9月27日，容诚出具《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0205号），经审验，截至2020年9月27日，公司已收到各股东以货币出资缴纳的新增注册资本27,240.37万元，变更后公司的累计注册资本为150,460.14万元，实收资本150,460.14万元。

2020年9月28日，合肥市市监局向晶合有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q）。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投	46,847.4592	31.14
2	合肥芯屏	32,873.6799	21.85
3	力晶科技	41,282.4208	27.44

4	美的创新	8,801.4118	5.85
5	中安智芯	3,960.6354	2.63
6	惠友豪创	2,640.4236	1.75
7	合肥存鑫	2,640.4236	1.75
8	海通创新	1,760.2824	1.17
9	杭州承富	1,540.2471	1.02
10	泸州隆信	1,320.2118	0.88
11	宁波华淳	1,320.2118	0.88
12	中小企业基金	1,320.2118	0.88
13	安华创新	880.1412	0.58
14	集创北方	880.1412	0.58
15	中金浦成	176.0282	0.12
16	合肥晶焠	519.5398	0.35
17	合肥晶遂	419.7429	0.28
18	合肥晶炯	381.3060	0.25
19	合肥晶咖	145.6606	0.10
20	合肥晶珏	126.2054	0.08
21	合肥晶梢	117.4082	0.08
22	合肥晶柔	86.2798	0.06
23	合肥晶愆	85.2648	0.06
24	合肥晶本	77.9902	0.05
25	合肥晶洛	58.1966	0.04
26	合肥晶辽	49.7378	0.03
27	合肥晶确	41.4481	0.03
28	合肥晶铁	41.4481	0.03
29	合肥晶妥	40.6023	0.03
30	合肥晶雄	25.3764	0.02
合计		150,460.14	100.00

8、2020年11月，整体变更设立股份公司

2020年10月19日，容诚出具《审计报告》（容诚审字[2020]230Z3994号），经审计，截至2020年9月30日，晶合有限账面净资产值为7,353,140,545.50元。

2020年10月21日，中水致远出具《合肥晶合集成电路有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第020502号），截至评估基准日2020年9月30日，晶合有限的净资产评估价值为918,198.75万元。

2020年10月21日，晶合有限召开董事会，同意公司整体变更为股份公司的方案，公司全体股东作为发起人以公司截至2019年9月30日经容诚审计的账面净资产值7,353,140,545.50元为基础，按1:0.20462比例折合1,504,601,368股，整体变更后股份公司的股本与整体变更前的注册资本保持一致，资本公积和未分配利润在整体变更前后保持不变。

2020年11月5日，晶合有限全体股东签署《合肥晶合集成电路股份有限公司发起人协议》，对改制方案，股份公司的名称、住所、经营期限，公司的经营宗旨和经营范围，公司设立的方式、组织形式，公司注册资本、股份总额、类别、发起人认购股份的数额、形式及期限，发起人的权利和义务，费用承担等重要事项进行了约定。

2020年11月12日，合肥市国资委出具《关于同意合肥晶合集成电路有限公司变更为合肥晶合集成电路股份有限公司的批复》（合国资产权[2020]105号），同意公司以截至2020年9月30日经审计的账面净资产7,353,140,545.50元按1:0.204620比例折合1,504,601,368股，即每股面值1元，整体变更为股份有限公司。

2020年11月20日，晶合有限召开创立大会，审议通过《关于合肥晶合集成电路股份有限公司筹备情况的报告的议案》《关于合肥晶合集成电路股份有限公司筹备费用的报告的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司章程>的议案》等议案。

根据容诚于2020年11月20日出具的《验资报告》（容诚验字[2020]第230Z0263号），晶合集成登记的注册资本为人民币1,504,601,368元，由晶合有限全体股东以其拥有的晶合有限截至2020年9月30日止的净资产缴纳7,353,140,545.50元，并按照1:0.204620比例折合股本1,504,601,368元，整体变更后的股本与整体变更前的注册资本保持一致，资本公积和未分配利润在整体变更前后保持不变。

2020年11月25日，合肥市市监局向晶合集成换发《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q）。

本次整体变更设立股份公司完成后，公司的股东及其持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股股数（万股）	持股比例（%）
1	合肥建投	46,847.4592	31.14
2	合肥芯屏	32,873.6799	21.85
3	力晶科技	41,282.4208	27.44
4	美的创新	8,801.4118	5.85
5	中安智芯	3,960.6354	2.63
6	惠友豪创	2,640.4236	1.75
7	合肥存鑫	2,640.4236	1.75
8	海通创新	1,760.2824	1.17
9	杭州承富	1,540.2471	1.02
10	泸州隆信	1,320.2118	0.88
11	宁波华淳	1,320.2118	0.88
12	中小企业基金	1,320.2118	0.88
13	安华创新	880.1412	0.58
14	集创北方	880.1412	0.58
15	中金浦成	176.0282	0.12
16	合肥晶煅	519.5398	0.35
17	合肥晶遂	419.7429	0.28
18	合肥晶炯	381.3060	0.25
19	合肥晶咖	145.6606	0.10
20	合肥晶珏	126.2054	0.08
21	合肥晶梢	117.4082	0.08
22	合肥晶柔	86.2798	0.06
23	合肥晶悬	85.2648	0.06
24	合肥晶本	77.9902	0.05
25	合肥晶洛	58.1966	0.04
26	合肥晶辽	49.7378	0.03
27	合肥晶确	41.4481	0.03
28	合肥晶铁	41.4481	0.03
29	合肥晶妥	40.6023	0.03
30	合肥晶雄	25.3764	0.02
合计		150,460.14	100.00

综上，本所认为，发行人历史上不存在工会、职工持股会持股或者自然人股东人数较多等情形，发行人历次股权变动均合法、有效。

（三）国有股东标识管理

2021年3月19日，合肥市国资委出具《关于合肥晶合集成电路股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》（合国资产权[2021]27号）。根据该批复，合肥市国资委同意将合肥建投所持发行人的股份界定为国有法人股，其证券账户应标识为“SS”。

（四）发行人股份质押情况

根据发行人及其全体股东出具的书面确认并经本所律师检索国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），截至本律师工作报告出具日，发行人股东所持发行人的股份未设置质押。

八、发行人的业务

（一）经营范围和经营方式

根据发行人现持有的《营业执照》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），发行人的经营范围为“集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

发行人境内子公司的经营范围详见本律师工作报告“十、发行人的主要财产”之“（五）发行人的子公司”。

根据发行人及其子公司所在地工商、税务等相关政府部门出具的证明文件、发行人书面确认并经核查，本所认为，发行人及其子公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规的规定，已经取得经营所需的相关业务资质及许可。

（二）境外业务

根据发行人说明、《审计报告》并经本所律师核查，截至2020年12月31日，发行人拥有1家境外子公司（日本晶合），主要从事集成电路设计服务及技术开发。发

行人境外子公司的具体情况详见本律师工作报告“十、发行人的主要财产”之“（五）发行人的子公司”。

（三）主营业务变更情况

根据《审计报告》、发行人提供的工商资料及书面确认并经本所律师核查，发行人最近两年内主营业务未发生变更。

（四）主要业务资质、许可或备案

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，发行人拥有的主要经营资质证书情况如下：

资质名称	证书/登记编号	授予单位/登记机关	有效期限
辐射安全许可证	皖环辐证[A0390]	安徽省生态环境厅、合肥市生态环境局	2020年6月5日至2022年5月21日
排污许可证	91340100343821433Q001W	合肥市生态环境局	2019年11月11日至2022年11月10日
对外贸易经营者备案登记表	02360936	-	-
海关进出口货物收发货人备案	3401660005	庐州海关	2020年7月8日至长期

（五）发行人的主营业务

根据《招股说明书（申报稿）》《审计报告》及发行人书面确认，截至本律师工作报告出具日，发行人主要从事12英寸晶圆代工业务。

（六）发行人的持续经营能力

根据《招股说明书（申报稿）》《审计报告》《企业信用报告》以及发行人的书面确认，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，发行人依法存续，主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情况，不存在影响其持续经营的法律障碍。

（七）发行人合作研发的相关情况

根据发行人与相关合作方签订的协议和发行人书面说明，发行人正在从事的合作研发项目具体情况如下：

序号	合作方	合作内容	研发成果归属	合作期间	保密措施
1	合肥海图微电子有限公司	高集成度 CMOS 图像传感器设计与制造关键技术研发	共同拥有	2020/10/1-2023/9/30	已签署保密协议
2	杰华特微电子（杭州）有限公司	150nm 高压/超高压电源管理芯片技术平台	共同拥有	2020/11/01-2027/06/29	已签署保密协议
3	思特威（上海）电子科技有限公司	90 纳米 CMOS 后照度图像传感器平台（90BSI）	共同拥有	2020/3/20-2025/3/19	已签署保密协议

发行人目前 CIS 技术平台分别与合肥海图微电子有限公司、思特威（上海）电子科技有限公司进行合作开发，PMIC 技术平台与杰华特微电子（杭州）有限公司进行合作开发。报告期内，发行人 CIS、PMIC 工艺平台对营业收入贡献较小。

九、关联交易及同业竞争

（一）关联方

根据《公司法》《上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，发行人的主要关联方如下：

1、发行人的控股股东、实际控制人

发行人的控股股东为合肥建投，实际控制人为合肥市国资委。合肥建投的具体情况，详见本律师工作报告“六、发起人和股东”之“（五）发行人的控股股东及实际控制人”。

2、发行人的控股股东直接或间接控制的其他企业

截至本律师工作报告出具日，除发行人及其控股子公司以外，发行人控股股东直接或间接控制的其他主要企业如下：

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
1	合肥芯屏	2016年1月18日	合肥市包河区武汉路229号	投资管理、资产管理；投资咨询。
2	合肥蓝科投资有限公司（以下简称合肥蓝科）	2008年11月5日	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内	项目投资；基础设施建设；自营和代理各类商品和技术进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术）；房产租赁；仓储（除危险品）物流；房地产开发及经营；科技工业园开发及管理；物业管理；酒店管理；展览展示服务；会议服务。
3	合肥燃气集团有限公司（以下简称合肥燃气）	1995年11月13日	合肥市蜀山区合作化南路466号	燃气生产、销售和管道输配；市政公用工程、燃气工程、供暖工程及配套工程的设计、建设、安装、维修、服务、监理、咨询；房屋建筑工程的监理及咨询；机电设备安装，装修装饰工程，土方工程，铆焊加工；燃气器具制造经营；燃气设备及智能安全家居产品生产销售与安装维修；商务信息咨询；教育信息咨询；保险信息咨询；能源项目建设、开发利用、运营管理；汽车货物运输；自有房产及设备租赁。
4	合肥供水集团有限公司（以下简称合肥供水）	1994年7月21日	安徽省合肥市屯溪路70号	自来水生产与供应、管道安装、水质监测、水表阀门修理、科研设计、工程监理、自有固定资产租赁。
5	合肥蜀山百大购物中心有限公司（以下简称百大购物）	2012年6月27日	安徽省合肥市蜀山区望江西路218号	预包装食品批发兼零售（在许可证有效期内经营）；保健食品销售（李宝赢堂牌参茸酒）（在许可证有效期内经营）；日用百货、针纺织品、鞋帽、服装、五金交电、化工产品（除危险品）、文体用品、办公用品、金银珠宝玉器、家具、皮革制品、钟表眼镜、照相器材、工艺品、儿童游乐设施、通讯设备、家电、电子产品、计算机软硬件及配件、劳保用品、建材、装饰材料、儿童用品销售；卷烟零售；合肥通卡代收代付（在协议范围内经营）；物业服务；企业管理咨询；房屋租赁。
6	安徽百大合	2000年6月	安徽省合肥市沿	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
	家福连锁超市股份有限公司（以下简称百大合家福）	15日	河路118号	售、散装食品（含冷藏冷冻食品、含散装熟食）销售、保健食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售、热食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、糕点类食品制售、自制饮品制售、其他类食品制售；酒、卷烟零售、农副产品、餐饮服务（现场制售：面点、熟食、豆制品、泡菜、中餐）；农产品收购；日用百货、针纺织品、家用电器及电子产品、通讯器材销售；家具、文体用品、五金车件、化工产品（除危险品）、建筑材料、劳保用品、汽车（除小轿车）及配件、摩托车及配件、花卉、玩具、宠物用品销售、自行车、电动车、服装、黄金制品、珠宝首饰零售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定和禁止企业经营商品除外）；医疗器械销售（除国家限制项目）、音像制品、图书；儿童娱乐服务；彩扩服务；房屋租赁、场地出租（涉及许可在许可证有效期内经营）；停车场服务项目；特殊医学用途配方食品销售；网络表演；为本超市销售产品提供配送服务。
7	合肥市建设投资有限公司	1992年4月15日	合肥市滨湖新区武汉路229号	项目投资、股权投资、资产重组及并购（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房屋租赁。
8	合肥市交通投资控股有限公司	2004年2月11日	安徽省合肥市梅山路77号	公路项目建设、营运、收费、咨询及服务；城乡交通基础设施及相关产业的投资与运营；营运授权范围内的国有资产；按照法定程序处置、租赁所属企业土地和房屋资产；国内广告制作、代理、发布；公路服务区经营、策划及住宿、餐饮服务；车辆救援服务及汽车维修；交通工程物资销售；道路普通货运；仓储服务；实业投资；旅游项目的投资开发。
9	合肥城建投	2001年12月	合肥市滨湖区武	城市建设项目开发和经营，房地产

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
	资控股有限公司	6日	汉路229号	综合开发，对项目和企业进行投资，参股和收购，物资贸易，房屋租赁。
10	合肥百货大楼集团股份有限公司	1996年7月29日	安徽省合肥市长江路150号	预包装食品、酒、乳制品销售，烟、西药制剂及中成药零售，汽车运输，土产品、纺织品、服装、工艺美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品、针织品、家具、食用农产品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售及为网上销售提供服务，自制饮品销售，糕点类食品制售，保健食品、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、音像制品、书刊、电子出版物及设备的零售，接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务，进出口业务，黄金饰品零售及修旧改制，服装、鞋帽、塑料制品加工，房屋租赁，玩具及轨道赛车服务，餐饮、停车服务。
11	合肥丰乐种业股份有限公司	1997年4月16日	合肥市蜀山区创业大道4号	农作物种子、种苗生产、销售；大米、芝麻、棉花生产、销售；肥料销售；农药、专用肥、植物生长素、食用香料香精、薄荷脑及薄荷油、茶叶生产、销售；粮食作物、油料作物种植、储藏、运输、销售；农副产品及其深加工产品、花卉、包装材料生产、销售；农业高新技术开发及成果转让；农业技术咨询、技术服务；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；农业机械类产品的出口和种子的进出口业务。
12	合肥科融高科技产业投资有限公司	2009年11月10日	安徽省合肥市滨湖新区武汉路229号	高科技产业风险投资，企业参股、并购及重组，项目投资及运营，股权管理。
13	合肥市轨道交通集团有限公司	2009年6月2日	安徽省合肥市阜阳路17号	城市轨道交通系统项目策划、投资、建设、运营、管理及资源开发；系统设备租赁、销售；轨道交通沿线及相关地区、地下空间资源开发及管理；物业管理；酒店管理；城市基础设计及咨询；代理设

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				计、制作、发布国内广告。
14	合肥金太阳能源科技股份有限公司	2010年12月30日	安徽省合肥市高新区黄山路630号	大中型光伏并网电站、小型并（离）网光伏发电系统、光伏建筑一体化项目勘测设计、施工安装、工程总承包服务、运营管理；系统集成；技术咨询。
15	合肥文旅博览集团有限公司	2002年4月30日	安徽省合肥政务文化新区习友路988号	高端现代服务业投融资平台研发；文化体育产业策划、投资、运营管理；旅游产业策划、投资、运营管理；会展场馆运营、展会开发、广告搭建及展会综合配套服务；酒店投资运营及受托管理；餐饮管理；物业管理；教育投资及咨询；大健康产业、休闲养老产业投资建设运营管理；公益设施、基本建设项目开发、经营、融资管理；资产管理；投资管理；房地产综合开发、销售；供应链管理；电子商务、农业支撑服务；中介服务；房屋、停车场租赁、管理；企业管理咨询；信息技术咨询。
16	合肥市水环境建设投资有限公司	2000年8月8日	安徽省合肥市包河区包河大道398号A座1-7楼	水务和环境项目的投资、建设、运营、管理；承担政府性项目的投资、融资、委托代建、运营和管理任务；受政府委托从事土地一级开发，土地收储、拆迁、整理、基础配套等熟化工作；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；房屋租赁；承担市政府授权的其他工作。
17	合肥通航控股有限公司	2015年10月19日	合肥市包河区徽州大道1号骆岗机场	机场运营、资产管理、设备维修、物业管理、企业管理、投资咨询、企业策划、航空投资、计算机系统集成、数据处理。
18	合肥建投资本管理有限公司	2016年1月11日	合肥市包河区武汉路229号	投资管理、资产管理。
19	合肥市乡村振兴投资有限责任公司	2013年1月9日	安徽省合肥市包河区包河大道398号建投综合	农业、文化旅游产业项目投资及运营管理；农村基础设施建设及人居环境建设；乡村旅游开发；特色小

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
			办公区 A 座 8-9 楼	镇开发及田园综合体开发；农产品生产种植与销售；城市基础设施建设；土地整治；土地储备业务。
20	安徽环巢湖生态发展有限公司	2004 年 10 月 18 日	安徽省巢湖市巢庐路（原东庵林场）	生态产业投资与建设，休闲旅游产业、文化旅游产业的投资与运营，旅游景区的开发、建设、运营，旅行社、旅游交通服务，文化演艺与婚庆、展览服务，旅游商品开发与销售，酒店管理，物业管理，会议、培训服务，旅游策划与管理咨询，文化体育运动的组织与服务。
21	合肥市电动汽车充电设施投资运营有限公司	2015 年 2 月 15 日	合肥市蜀山区合作化南路 466 号燃气大厦 22-24 层	电动汽车充、换电设施的投资运营、建设及网络规划、设计；电动汽车充、换电服务；售电业务；电动汽车采购、销售；销售汽车配件；电动汽车租赁；计算机信息系统及互联网技术开发和服务；发布国内广告；充、换电设施及零部件的销售、维修服务；停车场运营管理。
22	合肥市综合管廊投资运营有限公司	2016 年 12 月 23 日	合肥市包河区武汉路 229 号建投大厦	城市地下综合管廊或管沟等的投资、建设及运营管理工作；地下空间开发及运营；资产管理及物业管理。
23	合肥融科项目投资有限公司	2010 年 11 月 11 日	合肥市新站区大禹路与东方大道交口西北角合肥综合保税区进口商品展示中心大楼 12-14 层	项目投资。
24	合肥市引江济淮投资有限公司	2017 年 8 月 30 日	安徽省合肥市经济技术开发区九龙路 118 号	引江济淮主体工程沿线土地、岸线、水资源、生态旅游综合开发和经营；产业投资、项目建设、项目管理与运营；股权投资；文化旅游、休闲、养老、健康产业的物业投资、管理。
25	合肥市建庐建设投资有限公司	2017 年 12 月 21 日	合肥市庐江县庐城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼 15 层	县域基础设施项目投资、建设、运营和管理。
26	安徽中安智通科技股份有限公司	2015 年 12 月 16 日	合肥市包河区常青街道姚公社居委南屏路 555 号	城市智能交通系统设计施工、产品研发、技术服务和销售；城市交通项目投资；交通设施和器材的研

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				发、设计、制作、安装及维护维修；机械式立体停车设备、智能车位引导等自动化控制系统及系统集成的研发设计、生产制造销售、技术服务；停车场相关设计施工、技术服务、管理服务；软件开发；广告发布、传媒灯箱、信息咨询服务；住房及商用房屋租赁；物业管理。
27	合肥市住房租赁发展股份有限公司	2020年5月18日	安徽省合肥市蜀山区长江西路460号合房租赁办公区	住房租赁，商业房产运营，房地产开发、咨询、代理、经纪，房屋建筑工程施工，室内外装饰工程设计施工，酒店管理，物业管理，停车场（库）运营，户外广告、道路绿化及工程施工咨询，家具及家用电器用品出租服务，计算机和网络技术服务，互联网信息服务。

此外，过去 12 个月内发行人控股股东直接或间接控制的其他企业亦为发行人的关联方。

3、发行人的控股子公司

截至本律师工作报告出具日，发行人在中国境内拥有 2 家控股子公司，在中国境外拥有 1 家控股子公司。上述公司的具体情况，详见本律师工作报告“十、发行人的主要财产”之“（五）发行人的子公司”。

4、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

发行人现任董事、监事、高级管理人员以及过去 12 个月内曾经担任发行人董事、监事、高级管理人员的人员构成发行人关联方，上述人员的具体情况，详见本律师工作报告“十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”。此外，与上述人员关系密切的家庭成员亦构成发行人的关联方。

5、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者由前述人员（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织

截至本律师工作报告出具日，发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者除独立董事外的前述人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织的情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	智慧记忆科技股份有限公司	蔡国智担任董事、郑素芬担任董事
2	Xsense Technology Corporation	蔡国智担任董事
3	合肥建投	陆勤航担任董事兼总经理、黄颢担任董事兼副总经理
4	启迪控股股份有限公司	陆勤航担任董事
5	合肥建投资本管理有限公司	黄颢担任董事
6	合肥德轩投资管理有限公司	黄颢担任董事
7	合肥京东方显示技术有限公司	黄颢担任董事长
8	合肥市信实产业投资基金（有限合伙）	黄颢担任执行事务合伙人委派代表
9	合肥奕斯伟封测控股有限公司	黄颢担任董事
10	合肥硕中封测技术有限公司	黄颢担任董事
11	合肥维信诺科技有限公司	黄颢担任董事
12	蔚来控股有限公司	黄颢担任董事
13	启迪新基建产业（合肥）集团有限公司	黄颢担任董事
14	合肥德电新能源汽车股份有限公司	黄颢担任董事
15	合肥神州数码信创控股有限公司	黄颢担任董事
16	智丰科技股份有限公司	郑素芬担任总经理
17	新相科技股份有限公司	郑素芬担任董事长
18	顺立投资股份有限公司	郑素芬担任董事
19	瑞相科技股份有限公司	郑素芬担任董事
20	晶相光电股份有限公司	郑素芬担任董事
21	力相光学股份有限公司	郑素芬担任董事
22	宏丽数位创意股份有限公司	郑素芬担任董事
23	智合精准医学科技股份有限公司	郑素芬担任董事
24	智成电子股份有限公司（以下简称智成电	郑素芬担任董事

序号	关联方名称	关联关系说明
	子)	
25	景睿科技股份有限公司	郑素芬担任董事
26	集邦科技股份有限公司	郑素芬担任董事
27	智仁科技开发股份有限公司	郑素芬担任董事
28	智高医学科技股份有限公司	郑素芬担任董事
29	英达投资股份有限公司	胡竞英担任董事长且控制
30	疯狂秀股份有限公司	胡竞英担任董事
31	中兴农林开发股份有限公司	胡竞英担任董事
32	合富润生企业管理咨询(上海)有限公司	胡竞英担任董事
33	合润生活国际有限公司	胡竞英担任董事

此外,过去 12 个月内发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的,或者除独立董事外的前述人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织亦为发行人的关联方。

6、直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织

截至本律师工作报告出具日,除合肥建投以外,直接持有发行人 5%以上股份的股东为合肥芯屏、力晶科技、美的创新。

美的集团股份有限公司(以下简称美的集团)直接持有美的创新 70%的股权,并通过全资子公司佛山市美的空调工业投资有限公司间接持有美的创新 30%的股权,亦系发行人的关联方。

7、直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织

截至本律师工作报告出具日,直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织包括:

序号	关联方名称	关联关系说明
1	力信投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制

序号	关联方名称	关联关系说明
2	世仁投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
3	富硕投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
4	Sprout International Limited	力晶科技直接或间接控制
5	智典国际股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
6	世成科技股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
7	智仁科技开发股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
8	智慧记忆体科技股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
9	Deutron Japan Corp.	力晶科技直接或间接控制
10	智翔投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
11	智成电子	力晶科技直接或间接控制
12	力相光学股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
13	广东美云智数科技有限公司	美的创新直接或间接控制
14	深圳数智场景定位科技有限公司	美的创新直接或间接控制
15	上海美仁半导体有限公司	美的创新直接或间接控制

此外，过去 12 个月内直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织亦为发行人的关联方。

8、直接控制上市公司的法人的董事、监事、高级管理人员及其控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

(1) 直接控制发行人的法人的董事、监事、高级管理人员

直接控制发行人的法人为合肥建投，截至 2020 年 12 月 31 日，合肥建投的董事、监事、高级管理人员及其控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织如下：

序号	关联方姓名	关联关系说明
1	李宏卓	合肥建投董事长
2	陈小蓓	合肥建投董事
3	陆勤航	合肥建投董事兼总经理
4	黄颢	合肥建投董事兼副总经理

序号	关联方姓名	关联关系说明
5	倪敬东	合肥建投董事
6	吴子能	合肥建投董事
7	杨雪蕾	合肥建投董事
8	黄跃明	合肥建投监事
9	杨国庆	合肥建投监事
10	范红金	合肥建投监事
11	田胜彬	合肥建投监事
12	朱庆	合肥建投监事
13	罗文萍	合肥建投高级管理人员

过去 12 个月内曾经担任合肥建投董事、监事、高级管理人员的人员构成发行人关联方。

(2) 前述关联自然人直接或者间接控制的法人或其他组织

前述关联自然人中，陆勤航、黄灏亦系发行人董事。除陆勤航、黄灏外，其他关联自然人控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	合肥维信诺科技有限公司	李宏卓担任董事长
2	合肥建投资本管理有限公司	李宏卓担任董事长，陈小蓓、罗文萍担任董事
3	合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
4	合肥芯屏	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
5	合肥新站高新创业投资合伙企业（有限合伙）	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
6	合肥市乡村振兴产业投资合伙企业（有限合伙）	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
7	合肥市大数据资产运营有限公司	陈小蓓担任董事
8	合肥通航控股有限公司	陈小蓓担任董事
9	安徽省合肥联合发电有限公司	陈小蓓担任董事
10	合肥高特佳创业投资有限责任公司	陈小蓓担任董事

序号	关联方名称	关联关系说明
11	合肥百货大楼集团股份有限公司	陈小蓓担任董事
12	合肥丰乐种业股份有限公司	陈小蓓担任董事
13	合肥市水务环境建设投资有限公司	吴子能担任董事长
14	合肥市铭城建设发展有限公司	吴子能担任董事长
15	合肥市环巢湖建设发展有限公司	吴子能担任董事长
16	合肥泽众城市智能科技有限公司	吴子能担任副董事长
17	安徽庐铜铁路有限公司	吴子能担任副董事长
18	铜陵江北港铁路专用线有限责任公司	吴子能担任副董事长
19	合肥新桥国际机场有限公司	吴子能担任副董事长
20	合肥龙和投资咨询有限公司	黄跃明担任董事兼总经理
21	合肥科融高科技产业投资有限公司	黄跃明担任执行董事兼总经理
22	合肥二号线轨道交通有限公司	田胜彬担任董事
23	合肥市建庐建设投资有限公司	杨雪蕾担任董事长，田胜彬担任董事
24	合肥建翔投资有限公司	田胜彬担任董事
25	合肥市建设投资有限公司	罗文萍担任执行董事兼总经理
26	合肥市乡村振兴投资有限责任公司	杨雪蕾担任执行董事

除此之外，前述关联自然人过去 12 个月内曾经担任董事、高级管理人员的法人或其他组织亦为发行人的关联方。

9、其他关联方

除上述关联方外，发行人的其他关联方还包括其他根据《上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定认定的关联方。

10、关联方信息披露

根据发行人的书面说明，并经本所律师核查，发行人已在《招股说明书（申报稿）》中按照《公司法》《企业会计准则》和中国证监会的相关规定认定并披露关联方。

11、注销或转让重要关联方

根据发行人控股股东填写的调查表和发行人的书面说明，并经本所律师核查，报告期内，发行人不存在注销或转让的子公司，亦不存在与发行人存在关联交易的关联方注销或转让的情形。

（二）关联交易

根据《审计报告》和发行人书面说明，并经本所律师核查，发行人报告期内关联交易的情况如下：

1、向关联方采购商品及接受服务

报告期内，发行人向关联方采购商品及接受服务的相关情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
合肥建投	咨询服务	199.69	0.12%	672.40	0.63%	696.23	0.85%
合肥燃气	采购燃气	368.42	0.22%	303.58	0.28%	286.98	0.35%
合肥供水	采购厂区用水	308.09	0.19%	293.89	0.27%	516.43	0.63%
百大购物	采购商品	2.70	0.00%	-	-	-	-
百大合家福	采购商品	2.28	0.00%	-	-	-	-
力晶科技	采购商品及服务	160.17	0.10%	2,236.81	2.09%	1,890.24	2.32%
智成电子	采购服务	372.62	0.23%	152.95	0.14%	177.18	0.22%
关联采购合计		1,413.97	0.86%	3,659.62	3.42%	3,567.06	4.37%

报告期内，发行人向合肥供水、合肥燃气采购厂区用水、燃气的价格与合肥供水、合肥燃气向第三方销售的价格一致；发行人向力晶科技、合肥建投支付咨询服务，系因力晶科技、合肥建投按照《合资合同》《投资参股协议》等文件向公司委派高管，公司按照股东委派高管相应职位在晶合集成的薪酬标准，向合肥建投、力晶科技支付咨询服务费；发行人向力晶科技采购商品主要为依据《90nm 项目技术协议》向力晶科技购买技术数据支付的技转费用，该价格系双方参照资产评估结果协商确定；

发行人向智成电子采购服务为授权许可知识产权（IP），双方定价模式与发行人与其他同类供应商的定价模式一致，且价格处于同类供应商报价范围区间内。

综上，本所认为，发行人与关联方之间的上述关联交易价格公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

2、向关联方销售商品及提供服务

报告期内，发行人未向关联方销售商品及提供服务。

3、关联租赁

报告期内，发行人因经营需要向关联方合肥蓝科租赁土地、厂房及厂务设施，均位于安徽省合肥市瑶海区综合保税区内西淝河路 88 号，为发行人的注册地及主要办公场所。根据发行人与合肥蓝科、力晶科技签订的《厂房建设与租用协议》及发行人与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》，发行人作为承租方向合肥蓝科租入土地、厂房及配套厂务设施的具体情况如下：

单位：万元

关联方	租赁资产种类	2020 年度	2019 年度	2018 年度
合肥蓝科	土地	263.24	263.24	263.24
合肥蓝科	厂房及配套厂务设施	6,235.21	3,117.61	-

发行人向合肥蓝科租赁厂房、土地的定价依据详见本律师工作报告“十、发行人的主要财产”之“（一）土地使用权及房屋所有权”之“2、租赁物业”。

本所认为，合肥蓝科系依据合肥市人民政府相关政策向公司出租厂房，租赁价格虽低于市场价格，但公司已按照相应会计准则确认为政府补助，计入递延收益，该等关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

4、关联担保情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人接受关联方担保的情况如下：

单位：元

担保方	出借人	借款余额（含一年内到期的长期借款）	借款日期	到期日	担保是否已经履行完毕	是否提供反担保
合肥建投	华泰资产	1,300,000,000.00	2018/9/28	2028/9/27	否	是
		300,000,000.00	2018/10/30	2028/10/29	否	是
		420,000,000.00	2018/11/8	2028/11/7	否	是
		900,000,000.00	2019/7/18	2029/7/17	否	是
		80,000,000.00	2019/8/29	2029/8/28	否	是
	平安银行股份有限公司合肥分行	809,397,599.99	借款发放日	2027/10/10	否	是
	兴业银行股份有限公司合肥分行	668,360,017.01	借款发放日	2028/1/7	否	是
中国银行股份有限公司合肥北城支行	492,833,531.73	借款发放日	2028/1/15	否	是	

2017年12月14日，合肥建投与中国银行股份有限公司合肥北城支行（以下简称中国银行北城支行）签署了《最高额保证合同》，约定合肥建投为公司与中国银行北城支行签署的《授信额度协议》项下70,000万元授信提供连带责任保证担保，保证期间为《授信额度协议》生效之日至主债权期限届满之日起两年。

2017年12月28日，合肥建投与平安银行股份有限公司合肥分行（以下简称平安银行合肥分行）签署了《最高额保证担保合同》，合肥建投为公司与平安银行合肥分行签署的《综合授信额度合同》项下110,000万元的债务提供最高额连带责任保证担保，担保期限至主合同项下债务完全清偿。

2017年12月29日，合肥建投与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称兴业银行合肥分行）签署了《最高额保证合同》，合肥建投为公司与兴业银行合肥分行在保证额度有效期内最高本金限额70,000万元的债务提供连带责任保证担保，保证额度有效期自2017年12月29日至2028年1月5日止。

2018年8月20日，合肥建投与华泰资产签署了《华泰—合肥晶合集成电路基础设施债权投资计划保证担保合同》，合肥建投为公司与华泰资产签署的《华泰—合肥晶合集成电路基础设施债权投资计划投资合同》项下本金300,000万元的债务提供连带责任保证担保，担保期间自同生效之日起至全部债务期限届满之日起两年。

根据公司与合肥建投签订的反担保合同及补充协议，公司就合肥建投为公司上述借款的担保以部分机器设备及原物料提供反担保。

5、关联方资金拆借

报告期内，发行人作为借款人向关联方进行资金拆借情况如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利率
合肥建投	75,500.00	2018/5/9	2018/10/18	4.35%
合肥建投	5,000.00	2018/5/2	2018/10/18	4.35%

2018年4月28日，发行人与合肥建投、中国银行合肥北城支行签订人民币委托贷款合同，合同约定借款金额为80,500.00万元，借款期限为6个月，借款利率为4.35%，按季结息。截至2018年10月18日，发行人和关联方的上述资金拆借情况已清理完毕。报告期内未再发生发行人与关联方资金拆借的情形。

6、关键管理人员薪酬

报告期内，发行人向关键管理人员支付薪酬，关联交易金额分别为1,002.60万元、1,022.05万元和1,417.96万元。

7、关联方往来余额

(1) 应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	邱显寰	13.83	-	11.10	-	3.12	-
其他应收款	詹奕鹏	2.02	-	-	-	-	-
其他应收款	简瑞荣	0.18	-	-	-	-	-

项目名称	关联方	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	朱才伟	-	-	7.30	-	1.20	-
其他应收款	黎湘鄂	-	-	-	-	5.58	-
其他应收款	谢明霖	-	-	0.90	-	-	-
其他应收款	合肥燃气	40.00	-	94.00	-	94.00	-
其他非流动资产	力晶科技	-	-	-	-	1,330.39	-

(2) 应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
其他应付款	周义亮	0.07	0.22	-
其他应付款	王燕	-	0.02	-
其他应付款	李迦谕	0.34	-	-
其他应付款	朱才伟	0.05	-	-
其他应付款	简瑞荣	-	-	0.80
其他应付款	合肥蓝科	712.94	444.12	338.05
应付账款	合肥蓝科	704.13	444.20	235.96
应付账款	力晶科技	7.44	-	1,376.54
应付账款	合肥燃气	27.18	5.02	5.93
应付账款	智成电子	189.74	92.01	75.05
长期应付款	合肥蓝科	180,182.88	183,938.79	187,056.39

注：其他应付个人款项主要为员工报销款；合肥蓝科长期应付款系发行人向合肥蓝科融资租赁厂房及配套厂务设备形成。

8、其他关联交易事项

(1) 《委托经营管理合约》的签订与解除情况

2015年10月19日，晶合有限与力晶科技签订《委托经营管理合约》，约定公司委托力晶科技进行经营管理，以协助公司执行于合肥新站区建成12英寸晶圆制造厂项

目。2020年1月2日，公司与力晶科技签订了《委托经营管理合约之终止协议》，双方同意自2019年12月25日起即终止《委托经营管理合约》。

（2）专利所有权的转让情况

2017年3月，力晶科技使用58项专利技术使用权等专有技术向晶合有限增资。2020年9月3日，力晶科技与晶合有限签署《专利转让协议》，约定将上述58项专利中尚在有效期内的44项专利的所有权无偿转让给晶合有限。截至本律师工作报告出具日，前述44项专利的所有权已转让至晶合有限，相关专利具体情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。

（三）关联交易的决策程序

1、报告期内关联交易所履行的决策程序

发行人于2021年2月9日召开的第一届董事会第三次会议以及于2021年3月16日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于确认合肥晶合集成电路股份有限公司2018年度至2020年度期间关联交易的议案》《关于<合肥晶合集成电路股份有限公司2021年度日常关联交易预计>的议案》，对发行人在报告期内关联交易以及报告期后预计持续发生的日常关联交易的公允性进行了确认，关联董事和关联股东已回避表决，独立董事已就发行人报告期内关联交易出具了独立意见：“（1）上述关联交易事项审议程序和表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决；（2）上述关联交易事项均是为了满足公司日常正常业务开展的需要而进行，该等关联交易是必要、合理的；（3）合肥蓝科投资有限公司系依据合肥市人民政府相关政策向公司出租厂房，租赁价格虽低于市场价格，但公司已按照相应会计准则确认为政府补助，计入递延收益，该等关联交易符合公司和全体股东的利益；（4）除此之外，公司其他与关联方的交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，关联交易事项按照一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意上述关联交易事项。”

发行人于2021年3月5日召开的第一届董事会第四次会议以及于2021年3月16日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于公司与合肥建投签订反担保相关协议的议案》《关于公司与合肥蓝科签订<晶合二厂厂务及配套项目租赁合同>及<晶合二厂厂

务及配套项目收购意向协议>的议案》，关联董事和关联股东已回避表决，独立董事已就上述报告期外新增关联交易出具了独立意见：“（1）上述关联交易事项审议程序和表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决；（2）上述关联交易事项均是为了满足公司日常正常业务开展的需要而进行，该等关联交易是必要、合理的；（3）公司与关联方的交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，关联交易事项经双方充分商业谈判达成相关条款，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意上述关联交易事项。”

综上所述，发行人与关联方之间关联交易合同的签订和决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》及发行人内部规章制度的规定。本所认为，发行人与关联方进行上述关联交易已经公司董事会、股东大会审议或确认，独立董事就此事宜发表了相关意见，上述关联交易已经采取必要措施对其他股东的利益进行保护，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

2、发行人《公司章程》等对于关联交易决策程序的规定

发行人在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》以及上市后生效的《发行人章程》中，规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序。

发行人除在上述制度中规定了关联交易决策程序的内容以外，还专门制定了《关联交易实施细则》。该制度就关联人的界定、关联交易的范围、关联人报备、关联交易披露及决策程序、关联交易定价、关联人及关联交易应当披露的内容、日常关联交易披露和决策程序的特别规定、关联交易披露和决策程序的豁免等内容进行了具体规定。

综上所述，本所认为，发行人已在其《公司章程》及其他内部规章制度中明确了关联交易的公允决策程序。

（四）减少和规范关联交易的措施

为规范及减少公司与关联方之间未来可能发生的关联交易，发行人控股股东及其他持股 5%以上的股东出具承诺如下：

1、发行人控股股东合肥建投就规范并减少关联交易事宜出具承诺如下：

“（1）本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将尽量减少与晶合集成及其控股子公司的关联交易。

（2）对于与晶合集成经营活动相关的且无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件中关于关联交易的相关要求，履行晶合集成公司章程中关联交易决策程序，按照公平合理的原则确定关联交易价格，并依法履行信息披露义务。

（3）本公司保证将依照有关适用的法律、法规、规范性文件、晶合集成的公司章程及相关制度行使相应权利，承担相应义务，不会利用控股股东地位谋求晶合集成及其控股子公司在业务经营等方面给予本公司及本公司直接或间接控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益，不利用关联交易非法转移晶合集成及其控股子公司的资金、利润，保证不通过关联交易损害晶合集成及其无关联关系股东的合法权益。

（4）如违反上述承诺，本公司愿意承担由此给晶合集成造成的实际损失。”

2、发行人控股股东的一致行动人合肥芯屏就规范并减少关联交易事宜出具承诺如下：

“（1）本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将尽量减少与晶合集成及其控股子公司的关联交易。

（2）对于与晶合集成经营活动相关的且无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件中关于关联交易的相关要求，履行晶合集成公司章程中关联交易决策程序，按照公平合理的原则确定关联交易价格，并依法履行信息披露义务。

（3）本企业保证将依照有关适用的法律、法规、规范性文件、晶合集成的公司章程及相关制度行使相应权利，承担相应义务，不会利用控股股东一致行动人的地位谋

求晶合集成及其控股子公司在业务经营等方面给予本企业及本企业直接或间接控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益，不利用关联交易非法转移晶合集成及其控股子公司的资金、利润，保证不通过关联交易损害晶合集成及其无关联关系股东的合法权益。

（4）如违反上述承诺，本企业愿意承担由此给晶合集成造成的实际损失。”

3、其他持股 5%以上的股东出具的承诺

其他单独或合计持有发行人 5%以上股份的股东力晶科技、美的创新就规范并减少关联交易事宜出具承诺如下：

“（1）本公司及本公司直接或间接控制的公司将尽量减少与晶合集成及其控股子公司的关联交易。

（2）对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司直接或间接控制的公司将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本公司保证不通过关联交易损害晶合集成除本公司之外的其他股东的合法权益。

（3）保证将依照有关法律、法规、规范性文件、晶合集成章程和相关制度行使相应权利，承担相应义务，不利用股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移晶合集成及其控股子公司的资金、利润，保证不利用关联交易损害晶合集成除本公司之外的其他股东的合法权益。

（4）如违反上述承诺，本公司愿意承担由此给公司造成的全部损失。”

（五）同业竞争

1、发行人控股股东及其控制的其他企业

发行人控股股东及其控制的其他企业的基本情况详见本律师工作报告“六、发起人和股东”之“（五）发行人的控股股东及实际控制人”以及本律师工作报告“九、关联交易及同业竞争”之“（一）关联方”。

截至本律师工作报告出具日，发行人从事 12 英寸晶圆代工业务。根据合肥建投提供的对外投资企业清单并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统、天眼查网站等方式进行核查，合肥建投除投资发行人外，未控制其他从事晶圆代工业务的公司，合肥建投及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争。

（六）避免同业竞争的承诺或措施

为了避免未来可能发生的同业竞争情况，合肥建投及合肥芯屏已分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：

1、本企业目前一直公允地对待本企业直接或间接控制的其他企业，将来也不会利用控股股东（及其一致行动人）的地位谋求不正当利益或作出不利于晶合集成而有利于其他下属企业的任何决定，不会损害晶合集成及其他股东的合法权益。因违反本承诺函的任何条款而导致晶合集成及其控股子公司遭受的一切损失、损害和开支，本企业将予以赔偿。

2、本企业及本企业直接或间接控制的其他企业，目前不存在、将来也不会在中国境内外，以任何方式直接或间接从事与晶合集成及其控股子公司所从事的主营业务相同或相似业务的情形。

3、如果本企业及本企业直接或间接控制的其他企业从事了与晶合集成业务相同或相似的业务，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将愿意以公平合理的价格将构成竞争业务有关的资产或股权（若有）转让给晶合集成或其控股子公司，晶合集成享有优先受让上述资产或股权的权利。若晶合集成因任何原因决定不行使前述优先受让的权利，应及时通知本企业，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将停止该等业务，或转让该等资产或股权直至不再控制。

4、如果本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将来可能存在任何与晶合集成业务产生竞争的业务机会，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将通知晶合集成并尽力促使该业务机会首先提供给晶合集成或其控股子公司，晶合集成或其控股子公司享有优先获取上述业务的权利。若晶合集成或其控股子公司因任何原因决定不行使前述优先获取的权利，应及时通知本企业；本企业直接或间接控制的其他企业应确保不会导致与晶合集成产生同业竞争。

5、本企业及本企业直接或间接控制的其他企业不向晶合集成业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供与晶合集成业务有关之专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

6、本企业保证将严格遵循相关法律法规和上海证券交易所及中国证监会的要求，确保晶合集成按照上市公司的规范独立自主经营，保证晶合集成的资产、业务、财务、人员、机构独立。

7、上述承诺于本企业作为晶合集成的控股股东（及其一致行动人）期间内持续有效。

（七）发行人对关联交易及同业竞争事项的披露

根据发行人的书面说明，并经本所律师核查，发行人已在《招股说明书（申报稿）》中对有关减少和规范关联交易的措施及避免同业竞争的承诺进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

十、发行人的主要财产

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有或使用的主要财产情况如下：

（一）土地使用权及房屋所有权

1、自有物业

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人无自有物业。

2、租赁物业

经发行人确认并经本所律师核查发行人及其子公司的租赁协议及租赁物业产权证明，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司承租用于办公、生产经营的房产共计 3 处，面积合计约 215,654.47 平方米，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积 (m ²)	租赁期限	用途
1	晶合集成	合肥蓝科	安徽省合肥市新站	215,270.61	2017 年 6 月	生产

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积 (m ²)	租赁期限	用途
			区合肥综合保税区内西淝河路 88 号		28 日至 2037 年 6 月 27 日	办公
2	上海晶合	上海莘泽创业投资管理股份有限公司	上海市张江高科技园区盛夏路 608 号 2 幢 5 层 502 室	141.15	2019 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日	办公
3	日本晶合	マスター・プロパティーズ株式会社	東京都立川市曙町一丁目 13 番 11 号	242.71	2016 年 11 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日	办公

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人不存在租赁使用集体建设用地上、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产的情形。

(1) 发行人向关联方租赁物业的背景及未投入发行人的原因

根据合肥市人民政府与力晶科技签订的《合作框架协议书》，双方共同合作实施合肥新站综合开发试验区 12 英寸晶圆制造基地项目，项目厂房建设所需资金约 20.4 亿元由合肥市人民政府提供，项目选址位于合肥新站区综合保税区内。合肥市人民政府负责提供土地与厂房建设资金，并以租赁方式供项目公司使用该土地及厂房。

合肥蓝科系合肥市国资委下属国资管理经营平台，亦系合肥建投的全资子公司，《合作框架协议书》签订时，合肥综合保税区的整体基础设施的建设由合肥蓝科负责，相关土地均在合肥蓝科名下，合肥蓝科对合肥综合保税区整体办理了建设用地规划许可，因此由合肥蓝科负责落实合肥市人民政府招商引资相关政策，根据项目实际需要建设了相关厂房并出租给公司使用。相关厂房以租赁方式提供给公司使用系合肥市人民政府与力晶科技合作初始确定的招商引资政策之一，因此未投入公司。

(2) 向关联方租赁物业对发行人的重要程度及是否能够长期使用

发行人向关联方合肥蓝科租赁土地、厂房作为发行人目前主要生产经营地点，用途涵盖公司生产、研发、办公，重要性较高，鉴于：

(i) 根据发行人与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》，发行人向合肥蓝科租赁的厂房设施及土地的租赁期限至 2049 年 6 月 27 日。

(ii) 根据合肥蓝科出具的《关于厂房设施租赁的承诺函》，在晶合集成如约履行合同的情况下：（A）未经晶合集成同意，合肥蓝科不向其他单位或个人出租或处置上述租赁物业；（B）租赁期届满后，若晶合集成无重大营运问题且晶合集成需继续承租上述租赁物业，合肥蓝科承诺按照市场公允价格租赁给晶合集成。

综上，发行人能够长期使用上述厂房、土地，不会对发行人正常生产经营造成重大不利影响。

（3） 租赁费用的定价依据

发行人向合肥蓝科租赁土地、厂房及配套厂务设施的租金系按照合肥蓝科相关土地、厂房及配套设施实际建设成本以 30 年折旧年限计算的年折旧金额收取，相关租赁价格较为优惠，系因合肥市政府招商引资政策，根据《审计报告》，公司已按照相应会计准则进行处理，具体为：公司按照最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，长期应付款的入账价值与最低租赁付款额现值的差额，确认为未确认融资费用，在租赁期内采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。融资租入资产按照竣工决算金额入账，公司对于竣工决算金额与最低租赁付款额现值的差额，确认为政府补助，计入递延收益，在租赁期内进行分摊，计入其他收益。

2021 年 3 月，公司董事会、股东大会已对上述关联租赁予以确认，独立董事发表了独立意见，上述关联交易已按照公司章程履行了相应的决策程序。

（二） 在建工程

根据《审计报告》《招股说明书（申报稿）》以及发行人书面说明，截至本律师工作报告出具日，发行人的在建工程主要为公司新购置待安装机台设备。截至 2020 年 12 月 31 日，发行人在建工程的账面余额为 139,070.50 万元。

（三） 知识产权

1、 商标

根据发行人提供的《商标注册证》等相关文件、商标注册代理机构出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于中国境外注册商标相关事宜的确认函》、国家工商行政管理总局商标局查册结果并查询中国商标网（<http://sbj.cnipa.gov.cn>），并经本所律师核查，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司共拥有 93 项注册商标，其中，在中国境内注册的商标 17 项，在中国境外注册的商标 76 项。该等商标的具体情况详见本律师工作报告附件。

2、专利

根据发行人提供的专利证书等相关文件、专利注册代理机构出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于中国境外注册专利相关事宜的确认函》、国家知识产权局查册结果并查询国家知识产权局综合服务平台专利检索及分析系统（<http://pss-system.cnipa.gov.cn>），并经本所律师核查，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司在中国境内共拥有 54 项已授权专利，在中国境外共拥有 44 项已授权专利。该等专利注册的具体情况详见本律师工作报告附件。

根据发行人与力晶科技签订的《专利转让协议》《关于力晶科技对合肥晶合集成电路出资事项的确认函》，发行人上述专利中的 44 项专利系继受自力晶科技，具体情况如下：

（1）继受取得专利的背景

2015 年 10 月，晶合有限与力晶科技、合肥建投签订《技术移转协议》，约定力晶科技将驱动芯片代工所需技术提供给公司，用以出资的转移技术（专有技术）作价 20 亿元，2017 年 3 月 31 日前完成 20 亿元技术入股出资手续。2017 年 3 月，力晶科技以 58 项专利技术使用权作价 20 亿元向公司出资。为进一步完善力晶科技无形资产出资的资产的权利完整性，2020 年 9 月，力晶科技与晶合有限签订了《专利转让协议》，力晶科技将上述 58 项专利中尚在有效期内的 44 项专利的所有权无偿转让给晶合有限，详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”之“3、2017 年 3 月，第二次增资”。

本所认为，发行人上述继受取得专利不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷。

（2）原权利人的基本信息

上述 44 项继受取得专利的原权利人为力晶科技，力晶科技的基本信息详见本律师工作报告“六、发起人和股东”之“（一）发起人的资格”之“3、力晶科技”。

综上所述，本所认为，发行人已取得上述继受专利的所有权，与原权利人之间不存在纠纷或潜在纠纷，该等情形不会对发行人持续经营造成重大不利影响。

3、互联网域名

截至 2020 年 12 月 31 日，根据发行人提供的域名证书，并经本所律师核查工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统（<http://beian.miit.gov.cn>），发行人及其子公司合法拥有 1 项注册域名。该等域名的具体情况如下：

序号	注册域名	注册所有人	注册日期	到期日期
1	nexchip.com.cn	晶合集成	2015 年 9 月 16 日	2023 年 9 月 16 日

4、发行人使用的授权许可知识产权（IP）

截至 2020 年 12 月 31 日，公司正在使用的授权许可知识产权（IP）情况如下：

序号	许可方	授权许可内容	合同定价依据	有效期限
1	美商矽成积体电路股份有限公司	110 纳米嵌入式闪存技术	开发服务费用	2019 年 1 月 31 日-2025 年 1 月 30 日
2	円星科技股份有限公司	90 纳米编译器 IP	开发服务费及权利金	2019 年 1 月 25 日-2022 年 1 月 24 日
		150 纳米标准单元库	开发服务费及权利金	2019 年 1 月 25 日-2022 年 1 月 24 日
		150 纳米标准单元库	开发服务费及权利金	2019 年 10 月 16 日-2022 年 10 月 15 日
		90 纳米编译器 IP	开发服务费及权利金	2020 年 4 月 1 日-2023 年 3 月 31 日
		90 纳米编译器 IP	开发服务费及权利金	2019 年 10 月 16 日-2022 年 10 月 15 日
3	力旺电子股份有限公司	单次可编程 IP	设计服务费及权利金等	2019 年 1 月 25 日-2024 年 1 月 24 日
		单次可编程（反熔丝）IP	设计服务费及权利金等	2018 年 7 月 15 日-2021 年 7 月 14 日

序号	许可方	授权许可内容	合同定价依据	有效期限
		单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2019年1月25日-2024年1月24日
		单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2020年8月18日-2025年8月17日
		单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2020年8月18日-2025年8月17日
4	智成电子	110纳米标准单元库	量产权利金	2020年1月1日-2022年12月31日
5	寅通科技股份有限公司	80纳米集成电路IP	技术开发费及量产权利金	2019年3月8日-2024年3月7日
		90纳米集成电路IP	技术开发费及量产权利金	2019年4月1日-2024年3月31日
		集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2019年4月1日-2024年3月31日
		110纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2019年7月18日-2024年7月17日
		55纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2019年10月25日-2024年10月24日
		集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2018年2月28日-2023年2月27日
		110纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2018年5月22日-2023年5月21日
		90纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2018年6月11日-2023年6月10日
		55纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2020年4月15日-2025年4月14日
		110纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2020年9月1日-2025年8月31日
6	亿而得微电子股份有限公司	多次可编程电路模块	产品开发费用、权利金	2019年7月19日-2024年7月18日
		集成电路模块	产品开发费用、权利金	2017年11月1日-2023年10月31日
7	成都锐成芯微科技股份有限公司	110纳米低功耗嵌入式存储工艺平台模拟IP	技术秘密使用费，并根据实际发生金额结算、支付版税费用	2020年4月1日-2030年3月31日
		110纳米多次可编程电路	技术秘密使用费，并根据实际发生金额结算、支付版税费用	2020年4月1日-2030年3月31日
		90纳米多晶硅熔丝IP 150纳米多晶硅熔丝IP	技术秘密使用费，并根据实际发生金额结算、支付版税费用	2020年4月1日-2030年3月31日

（四）主要生产经营设备

根据《审计报告》、重大生产经营设备的购置合同、履行凭证及发行人说明，发行人的主要生产经营设备包括机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等。截至2020年12月31日，机器设备的账面价值为608,864.61万元、电子设备及其他的账面价值为3,347.06万元、运输工具的账面价值为0.21万元。

（五）发行人的子公司

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，发行人在中国境内拥有2家控股子公司及1家分支机构，在中国境外拥有1家控股子公司。具体情况如下：

1、境内控股子公司

（1）北京晶芯成

截至本律师工作报告出具日，发行人持有北京晶芯成100%股权，北京晶芯成为发行人全资子公司。根据北京经济技术开发区市场监督管理局2020年9月7日向北京晶芯成核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110302MA01UPKJ2C），北京晶芯成的基本情况如下表所示：

公司名称	晶芯成（北京）科技有限公司
住所	北京市北京经济技术开发区科创十三街29号院一区2号楼13层1302-C54
法定代表人	朱才伟
注册资本	20万元
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围	半导体技术和产品的技术开发、技术服务；销售集成电路、集成电路芯片及产品；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）南京晶驱

截至本律师工作报告出具日，发行人持有南京晶驱 100%的股权，南京晶驱为发行人全资子公司。根据南京市秦淮区行政审批局于 2021 年 2 月 19 日向南京晶驱核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320113MA229M2A6A），南京晶驱的基本情况如下表所示：

公司名称	南京晶驱集成电路有限公司
住所	南京市秦淮区江宁路 5 号 D 栋 409-32 号
法定代表人	朱才伟
注册资本	20 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、境内分支机构

公司名称	合肥晶合集成电路股份有限公司上海分公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 608 号 2 幢 502 室
负责人	蔡辉嘉
企业类型	有限责任公司分公司（港澳台投资、非独资）
经营范围	集成电路相关产品、配套产品的研发及销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、境外控股子公司

截至本律师工作报告出具日，发行人持有日本晶合 100%的股权，日本晶合为发行人全资子公司。根据日本法律意见书，日本晶合的基本情况如下：

公司名称	晶合日本株式会社
会社法人等番号	0128-01-0182209
法定住所	东京都立川市咯町一丁目 13 番 11 号立川クレストビル 2 階
注册资本	35,000 万日元
经营范围	为集成电路设计支持服务及技术开发支持。

2016年7月27日，晶合有限董事会作出决议，同意设立日本晶合。

2017年3月13日，合肥市国资委下发合国资产权[2017]34号批复，同意晶合有限投资3亿5000万日元在东京都立川市注册设立“晶合日本株式会社”。

2017年5月2日，安徽省商务厅就晶合有限设立晶合日本株式会社签发《企业境外投资证书》（境外投资证第N3400201700027号）。

2017年6月2日，安徽省发展和改革委员会就晶合有限投资设立日本子公司签发《安徽省发展改革委关于合肥晶合集成电路有限公司投资设立日本子公司项目备案的批复》（皖发改外资函[2017]303号），同意就上述项目进行备案。

本所认为，发行人就境外子公司的设立履行了必要的境内企业境外投资备案手续。

（六）主要财产所有权或使用权的受限制情况

根据发行人提供的相关债权合同、担保合同、发行人说明并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，除本律师工作报告“九、关联交易及同业竞争”之“（二）关联交易”之“4、关联担保情况”所述发行人向合肥建投提供的反担保外，发行人及其子公司拥有的主要财产所有权或使用权不存在担保或其他权利受到限制的情况。

十一、发行人的重大债权债务

（一）经本所律师核查，发行人及其子公司签署的对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同如下：

1、销售合同

截至2020年12月31日，发行人及其子公司与报告期各期前五大客户签署的正在履行的或已经履行完毕的合同或各期金额最高的订单情况如下：

序号	供应主体	客户	有效期/订单日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
1.	发行人	客户一	2020/01/10-2021/3/31	90nm TDDI、110nm LED	350万美 元产能预	履行完毕

序号	供应主体	客户	有效期/订单日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
				Driver 以及 150nm LDDI 产品晶圆代工产能预约	约金	
2.			2020/09/15-2021/12/31	90nm、110nm、150nm 产能预留	624 万美 元产能预 约金	正在履行
3.			2020/11/15-2021/12/31	90nm 产能预留	96 万美 元产能预 约金	正在履行
4.			2018/01/01-2020/01/01	晶圆代工服务	/	履行完毕
5.	发行人	客户二	2020/09/30 前 支付保证金 生效- 2021/12/31	90nm、110nm 产 能预留	69.15 万美 元产能保 证金	正在履行
6.			2018/04/30	0.11um LOGIC Foundry IC WAFER	13.05 万美 元	履行完毕
7.			2019/08/22	0.11um LOGIC Foundry IC WAFER	21.75 万美 元	履行完毕
8.	发行人	客户三	2020/04/30- 2021/12/31	90nm、110nm、 150nm 产能预留	100 万元 产能保证 金	正在履行
9.			2019/08/16	0.11um LOGIC Foundry IC WAFER	432 万美 元	履行完毕
10.	发行人	客户四	2020/11/03- 保证金结算 完毕	2021、2022 年度 90nm 产能预留	2021 年产 能预留保 证金 96 万 美元； 2022 年产 能预留保 证金 360 万美元	正在履行
11.			2020/09/18- 保证金结算 完毕	110nm、150nm 产能预留	111 万美 元产能保 证金	正在履行
12.			2018/06/19	0.11um LOGIC Foundry IC WAFER	90 万美 元	履行完毕
13.			2019/11/01	0.11um LOGIC Foundry IC	160 万美 元	履行完毕

序号	供应主体	客户	有效期/订单日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
				WAFER		
14.	发行人	客户五	2018/11/30	0.15um LOGIC Foundry IC WAFER、0.09um LOGIC Foundry IC WAFER	854.1 万美元	履行完毕
15.			2019/11/22	0.15um LOGIC Foundry IC WAFER、0.09um LOGIC Foundry IC WAFER	1,033.18 万美元	履行完毕
16.			2020/06/24	0.09um LOGIC Foundry IC WAFER	2,990.91 万美元	履行完毕
17.	发行人	客户六	2020/09/14-2021/12/31	110nm、150nm 产能预留	280.8 万美元	正在履行
18.			2018/05/10	0.11um LOGIC Foundry IC WAFER	276 万美元	履行完毕
19.			2019/10/18	0.11um LOGIC Foundry IC WAFER	160 万美元	履行完毕

2、采购合同

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司与报告期各期前五大原材料供应商签署的正在履行的或已经履行完毕的合同或各期金额最高的采购订单情况如下：

序号	采购主体	供应商	签订日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
1	发行人	供应商一	2018/04/20	硅晶圆	/	履行完毕
2			2018/12/18	硅晶圆	1,416 万美元	履行完毕
3			2019/11/27	硅晶圆	237.5 万美元	履行完毕
4			2020/12/11	硅晶圆	2,100 万美元	正在履行
5	发行人	供应商二	2018/12/12	零部件	13.17 万美元	履行完毕
6			2019/01/11	零部件	49.12 万美元	履行完毕
7			2020/09/24	零部件	35.07 万美元	履行完毕
8	发行人	供应商三	2018/12/17	化学品	52.5 万美元	履行完毕
9			2019/07/11	化学品	55.61 万美元	履行完毕
10			2020/01/15	化学品	83.84 万美元	履行完毕

序号	采购主体	供应商	签订日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
11	发行人	供应商四	2018/11/28	靶材	7,152 万日元	履行完毕
12			2019/12/23	靶材	7,077 万日元	履行完毕
13			2020/09/28	靶材	7,588.2 万日元	履行完毕
14	发行人	供应商五	2019/08/14	工业气体	/	履行完毕
15	发行人	供应商六	2016/11	氮气、氢气、氧气、氩气、氦气	/	正在履行
16	发行人	供应商七	2018/12/24	化学品	101.10 万美元	履行完毕
17			2019/12/25	化学品	63.04 万美元	履行完毕
18			2020/12/31	化学品	65.87 万美元	正在履行
19	发行人	供应商八	2018/12/26	零配件	4,084.55 万日元	履行完毕
20			2019/09/04	零配件	616.5 万日元	履行完毕
21			2020/11/23	零配件	5,946.34 万日元	正在履行

3、授信、借款合同及担保合同

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司正在履行及已履行完毕的授信、借款及担保合同如下：

序号	借款人/额度申请人	贷款人/额度授予人	签订日期	合同金额	贷款/授信期限	目前履行情况	担保情况
1	发行人	平安银行合肥分行	2017/04/11	50 亿元授信	2017/04/11-2027/04/10	正在履行	合肥建投为 50 亿授信中的 11 亿元提供担保
2			2018/02/24	11 亿元借款	120 个月	正在履行	
3	发行人	兴业银行合肥分行	2017/05/18	5 亿元授信	2017/05/18-2018/05/17	履行完毕	合肥建投提供最高额为 7 亿元的担保
4			2020/11/17	11.68 亿元授信	至 2021/03/04	履行完毕	
5			2018/01/08	7 亿元借款	2018/01/08-2028/01/07	正在履行	
6	发行人	中国银行北城支行	2017/11/14	7 亿元授信	生效之日起至 2018/09/21	履行完毕	合肥建投提供担保

序号	借款人/额度申请人	贷款人/额度授予人	签订日期	合同金额	贷款/授信期限	目前履行情况	担保情况
7			2017/11/14	7 亿元借款	实际提款日起 120 个月	正在履行	
8	发行人	中国银行北城支行（受合肥建投委托提供贷款）	2018/04/28	8.05 亿借款	提款日起 6 个月	履行完毕	-
9	发行人	华泰资产	2018/08/20	不超过 30 亿投资本金	10 年	正在履行	合肥建投提供担保

公司就合肥建投为公司上述借款的担保以部分机器设备及原物料提供反担保。

4、对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的其他合同

(1) 入区协议

2015 年 10 月 19 日，合肥新站综合开发区试验区管委会、晶合有限、力晶科技、合肥蓝科签订了《合肥 12 吋晶圆制造基地项目入区协议》。根据该协议，四方对合肥 12 英寸晶圆制造基地项目概况、合肥新站综合开发区试验区管委会向晶合有限提供的基础设施、相关配套与能源供应、四方责任、优惠政策等进行了约定。

(2) 一厂厂房租赁协议

2017 年 6 月 28 日，晶合有限与合肥蓝科签订了《电子器件厂房设施租赁合同》，约定租赁期间自 2017 年 6 月 28 日起至 2037 年 6 月 27 日。

(3) 90nm 项目技术协议

2018 年 4 月 10 日及 2021 年 4 月 7 日，晶合有限与力晶科技分别签订了《90nm 项目技术协议》及其补充协议，约定力晶科技向发行人移转 90nm M+ 驱动 IC 制程技术相关技术数据及文件，发行人向力晶科技合计支付 500 万美元。

(4) 二厂厂务设施租赁及收购意向协议

2021年4月8日，发行人与合肥蓝科签订了《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》，约定合肥蓝科在现有已建成的二厂厂房中建设洁净室及相关厂务设施，并建设相关配套设施等，发行人向合肥蓝科租赁二厂洁净室与厂务设施及配套设施，租赁期限为10年，具体起租时间以实际交付日为准。租赁期满后，发行人有优先承租权，续租协议由双方另行协商确定。同日，发行人与合肥蓝科签订了《晶合二厂厂务及配套项目收购意向协议》，约定发行人自愿收购合肥蓝科建设的“晶合二厂厂务及配套项目”，双方将按照国资监管管理相关要求，以及资产转让相关程序，参考第三方机构资产评估价值及发行人已支付之建设成本，一次性全款收购，发行人承诺在项目交付之日起五年内完成收购。

（5）合作框架协议

2020年3月20日及2020年4月2日，晶合有限与思特威（上海）电子科技有限公司（以下简称思特威）分别签订了《合作框架协议》及其补充协议，约定双方将在CIS领域开展合作，合作工艺节点为90nm，思特威按照约定支付合作开发订金和产能订金，晶合有限需在约定时间内，保障思特威的产能需求和合作开发之平台的技术排他性。协议有效期自签订之日起至2025年3月19日止。

除上述协议外，发行人签署的被授权使用IP的协议情况详见本律师工作报告“十、发行人的主要财产”之“（三）知识产权”。

（二）上述适用中国法律的重大合同内容和形式不违反中国法律、行政法规的禁止性规定，发行人及其子公司作为上述适用中国法律的重大合同的主体，继续履行该等合同不存在实质性法律障碍。

（三）根据发行人说明、相关工商行政管理部门、人事劳动社会保障部门、税务部门等出具的证明，经本所律师在发行人及其子公司相关主管部门政府网站核查，发行人及其子公司报告期内没有因知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（四）根据《审计报告》并经本所律师核查，截至报告期末，除本律师工作报告“九、关联交易及同业竞争”及“十一、发行人的重大债权债务”所述之外，发行人与其关联方之间不存在其他重大债权债务关系，亦不存在其他相互提供担保的情况。

(五) 报告期内，发行人金额较大的应收款、应付款是因正常的经营及投资活动发生，合法有效。

十二、发行人重大资产变化及收购兼并

(一) 发行人的增资扩股及减资

发行人自设立以来历次增资扩股及减资情况详见本律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”。经本所律师核查，发行人的历次增资扩股及减资符合当时中国法律、法规和规范性文件的规定，已经履行了必要的中国法律手续。

(二) 发行人重大资产收购/出售

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，发行人报告期内无重大资产收购或出售。

(三) 发行人拟进行的重大资产出售/收购

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，发行人没有拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等计划或安排。

十三、发行人公司章程的制定与修改

(一) 发行人公司章程的制定

2020年11月20日，发行人召开创立大会，审议通过了《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司章程>的议案》。

经本所律师核查，本所认为，发行人现行有效的《公司章程》的制定已经履行了必要的法定程序，内容符合《公司法》等现行法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 发行人公司章程的修改

发行人及其前身晶合有限最近三年对公司章程进行了如下修订：

2018年10月8日，晶合有限召开董事会并作出决议，同意增加公司注册资本、变更公司住所等，并据此修订公司章程。本次修订后的章程于2018年10月11日完成备案登记。

2019年10月25日，晶合有限召开董事会并作出决议，同意修改公司经营范围。2019年12月17日，晶合有限召开董事会并作出决议，同意修改董事会一致批准事项及特殊表决事项。本次修订后的章程于2020年3月5日完成备案登记。

2020年7月29日，晶合有限召开董事会并作出决议，同意减少公司注册资本，并据此修订公司章程。本次章程修正案于2020年9月15日完成备案登记。

2020年9月10日，晶合有限召开董事会并作出决议，同意增加公司注册资本，并据此修订公司章程。本次修订后的章程于2020年9月16日完成备案登记。

2020年9月25日，晶合有限召开董事会并作出决议，同意增加公司注册资本，并据此修订公司章程。本次修订后的章程于2020年9月28日完成备案登记。

2020年11月20日，发行人召开了创立大会，同意晶合有限整体变更为股份有限公司，并审议通过了《公司章程》。本次修订后的章程于2020年11月25日完成备案登记。

2021年3月16日，发行人召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于上市后适用的<合肥晶合集成电路股份有限公司章程（草案）>的议案》。《发行人章程》自发行人本次发行上市后生效。

公司整体变更为股份有限公司前，公司为外商投资企业，最高权力机构为公司董事会，章程修订事宜由董事会作出决议；公司整体变更为股份有限公司后，章程修订事宜由股东大会作出决议。经本所律师核查，发行人公司章程的制定及最近三年的历次修订已经履行了必要的法定程序，其内容符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

为本次发行上市之目的，发行人已按照《公司法》《上市公司章程指引》及其他有关规定制定了《发行人章程》，《发行人章程》已获发行人2020年年度股东大会审议通过，自发行人完成首次公开发行A股股票并在科创板上市之日起生效。经本所律

师核查，《发行人章程》的内容符合《公司法》等现行法律、法规和规范性文件的规定。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人的组织机构

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，发行人已设置股东大会、董事会、监事会，选举了公司董事（包括独立董事）、监事（包括职工代表监事），并聘请了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员；董事会由独立董事和非独立董事组成，独立董事人数占全体董事人数不少于三分之一；董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，发行人具有健全的组织机构。

（二）发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则

经本所律师核查，发行人根据《公司法》并参照《上市公司股东大会规则》等规定，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《战略委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《关联交易实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等制度。

本所认为，该等议事规则及公司治理制度符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人历次股东大会、董事会、监事会会议的召开情况

1、股东大会会议

自发行人整体变更为股份有限公司至本律师工作报告出具日，发行人共召开了 2 次股东大会会议，其主要情况如下：

序号	股东大会会议名称	会议日期
1	创立大会	2020年11月20日
2	2020年年度股东大会	2021年3月16日

2、董事会会议

自发行人整体变更为股份有限公司至本律师工作报告出具日，发行人共召开了 4 次董事会会议，其主要情况如下：

序号	董事会会议名称	会议日期
1	第一届董事会第一次会议	2020年11月20日
2	第一届董事会第二次会议	2020年12月25日
3	第一届董事会第三次会议	2021年2月9日
4	第一届董事会第四次会议	2021年3月5日

3、监事会会议

自发行人整体变更为股份有限公司至本律师工作报告出具日，发行人共召开了 2 次监事会会议，其主要情况如下：

序号	监事会会议名称	会议日期
1	第一届监事会第一次会议	2020年11月20日
2	第一届监事会第二次会议	2021年2月9日

经本所律师核查上述会议的召开通知、会议议案、会议决议、会议记录等文件资料，本所认为，发行人上述历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

（四）发行人股东大会、董事会历次授权或重大决策

根据发行人提供的股东大会、董事会会议决议、会议记录等文件资料，并经本所律师核查，本所认为，发行人股东大会、董事会做出历次授权或重大决策行为，均符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及公司其他现行有效的内部规章制度所规定的股东大会或董事会的职权范围，该等授权或重大决策行为合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

（一）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况

1、发行人的董事

发行人董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，具体情况如下：

序号	姓名	职务
1	蔡国智	董事长
2	陆勤航	副董事长
3	黄颢	董事
4	郑素芬	董事
5	朱晓娟	董事、副总经理
6	朱才伟	董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理
7	安广实	独立董事
8	陈绍亨	独立董事
9	BEICHAO ZHANG (张北超)	独立董事

发行人现任董事均由发行人创立大会选举产生，根据发行人创立大会会议资料，陆勤航、黄颢、朱晓娟、朱才伟、安广实、BEICHAO ZHANG（张北超）由合肥建投提名，蔡国智、郑素芬、陈绍亨由力晶科技提名；发行人的 9 名董事中，有 2 人兼任高级管理人员，该等兼职符合《上市公司章程指引》中关于董事兼任高级管理人员不超过董事总数二分之一的规定。

2、发行人的监事

发行人监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，具体情况如下：

序号	姓名	职务
1	杨国庆	监事会主席
2	胡竞英	监事
3	王燕	职工代表监事

发行人现任非职工代表监事均由发行人创立大会选举产生，根据发行人创立大会会议资料，杨国庆由合肥建投提名，胡竞英由力晶科技提名；发行人职工代表监事王燕由职工代表会议选举产生，职工代表担任的监事不少于监事总人数的三分之一。

3、高级管理人员

发行人高级管理人员共 9 名，具体情况如下：

序号	姓名	职务
1	蔡辉嘉	总经理
2	朱才伟	董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理
3	詹奕鹏	副总经理
4	朱晓娟	董事、副总经理
5	邱显寰	副总经理
6	周义亮	助理
7	李迦谕	助理
8	简瑞荣	助理
9	李庆民	助理

发行人上述高级管理人员的聘任均由董事会一致同意通过。

根据发行人董事、监事和高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》、简历及其在中国证监会安徽监管局诚信信息查询结果，发行人董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条所列示的情形，也不存在董事和高级管理人员兼任监事、被中国证监会处以证券市场禁入处罚或期限未届满的情形。本所认为，发行人董事、监事和高级管理人员的任职，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、核心技术人员

发行人核心技术人员共 5 名，具体情况如下：

序号	姓名	职务
1	蔡辉嘉	总经理
2	詹奕鹏	副总经理
3	邱显寰	副总经理
4	李庆民	助理
5	张伟瑾	N1 厂厂长

(二) 发行人最近两年内董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化

根据发行人自 2019 年 1 月 1 日以来的股东大会、董事会和监事会会议决议及工商登记备案等资料，发行人董事、监事、高级管理人员自 2019 年 1 月 1 日至本律师工作报告出具日变化情况如下：

1、董事变化情况

截至 2019 年 1 月 1 日，公司的董事为 YI LU（陆祎）、黄崇仁、谢再居、黎湘鄂、陆勤航、朱晓娟、黄颢、王刚、曾治国，其中 YI LU（陆祎）为董事长。

（1）2019 年 6 月 28 日及 2019 年 7 月 1 日，力晶科技向晶合有限发出《董事会成员委派书》及函件，原董事黄崇仁、谢再居不再担任晶合有限的董事，改派王其国、陈章鉴接任。

（2）2019 年 10 月 21 日及 2019 年 10 月 22 日，合肥建投、合肥芯屏向晶合有限发出《关于调整晶合公司董事人员的通知》及《关于委派合肥晶合集成电路有限公司董事人选的函》，决定曾治国不再担任晶合有限董事，委派王友军为晶合有限的董事。

（3）2019 年 12 月 10 日，力晶科技向晶合有限发出函件，推举王其国担任晶合有限董事长职务，并免去之前委任的 YI LU（陆祎）在晶合有限的董事长职务。

（4）2019 年 12 月 16 日，合肥建投向晶合有限发出《关于推荐晶合公司董事人选的通知》，推荐孔亦融为晶合有限董事。

（5）2019 年 12 月 25 日及 2019 年 12 月 26 日，力晶科技向晶合有限发出《董事会成员委派书》及函件，原董事陈章鉴改委派为郑素芬；原董事黎湘鄂即日起辞任。

（6）2020 年 4 月 8 日，晶合有限董事会进行换届并召开第二届第一次董事会，根据合肥建投向晶合有限发出的《关于推荐晶合公司董事人选的通知》，合肥建投委派陆勤航、黄颢、朱晓娟、王刚、朱才伟为董事；根据合肥芯屏投向晶合有限发出的《关于委派合肥晶合集成电路有限公司董事人选的函》，合肥芯屏委派王友军为董事；根据力晶科技向晶合有限发出的《董事会成员委派书》，力晶科技委派蔡国智、陆祎、郑素芬为董事；根据晶合有限董事会讨论，推举蔡国智为董事长、陆勤航为副董事长。

(7) 2020年11月20日,晶合集成召开创立大会,选举蔡国智、陆勤航、郑素芬、朱才伟、朱晓娟、黄颢、安广实、陈绍亨、BEICHAO ZHANG(张北超)作为晶合集成第一届董事会成员,其中安广实、陈绍亨、BEICHAO ZHANG(张北超)为独立董事。同日,发行人召开第一届董事会第一次会议,选举蔡国智为董事长、陆勤航为副董事长。

2、监事变化情况

截至2019年1月1日,公司的监事为杨国庆和谢明霖。

(1) 2019年12月25日,力晶科技向晶合有限发出《监事委派书》及函件,力晶科技委派胡竞英担任晶合有限监事职务,并免去之前委任的谢明霖在晶合有限的监事职务。

(2) 2020年11月13日,晶合有限召开职工代表大会选举王燕为职工代表监事。2020年11月20日,发行人召开创立大会,选举杨国庆、胡竞英作为晶合集成监事,与职工代表监事王燕共同组成第一届监事会。同日,发行人召开第一届监事会第一次会议,选举杨国庆为监事会主席。

3、高级管理人员变化情况

2019年1月1日,公司的高级管理人员为黎湘鄂、蔡辉嘉、朱才伟、邱垂源、盛惟健、陈耿川、朱晓娟、周义亮。

(1) 2019年3月15日,陈耿川因个人原因辞任。

(2) 2019年3月29日,晶合有限召开2019年第一届第二十一一次董事会,原力晶科技委派高管邱垂源因个人原因辞任,依据力晶科技之函文,聘任李洵为公司副总会计师;聘任詹奕鹏为公司研发协理。

(3) 2019年5月24日,晶合有限召开2019年第一届第二十二次董事会,依据合肥建投之函文,聘任王继武为公司采购副总监,原合肥建投委派高管周义亮不再兼任公司采购副总监。

(4) 2019年10月25日，晶合有限召开2019年第一届第二十三次董事会，聘任孙志明为公司业务协理，聘任朱晓娟为公司行政副总。

(5) 2019年12月17日，晶合有限召开2019年第一届第二十四次董事会，解除朱晓娟审计师、敬业委员会委员长职务，聘任杨幼玲为公司审计师、敬业委员会委员长；聘任蔡嘉辉为公司执行副总经理；聘任邱显寰为公司营运协理。

(6) 2020年3月27日，晶合有限召开2020年第一届第二十五次董事会，解除黎湘鄂总经理职务，黎湘鄂仍担任公司顾问，聘任蔡辉嘉为公司总经理。

(7) 2020年4月8日，晶合有限召开2020年第二届第一次董事会，聘任朱才伟为公司董事会秘书；聘任邱显寰为公司营运副总经理；聘任孙志明为公司业务副总经理；聘任詹奕鹏为公司研发副总经理；免去王继武公司采购副总监、杨幼玲公司审计师职务。

(8) 2020年6月3日，孙志明因个人原因辞任。

(9) 2020年11月19日，晶合有限召开第二届第八次董事会，原采购副总经理盛惟健退休，聘任简瑞荣为公司采购协理。

(10) 2020年11月20日，发行人召开第一届董事会第一次会议，聘任蔡辉嘉为公司总经理，聘任詹奕鹏、朱晓娟、邱显寰为公司副总经理，聘任朱才伟为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，聘任周义亮、李迦谕、简瑞荣为公司协理。

(11) 2020年12月25日，发行人召开第一届董事会第二次会议，聘任李庆民为营运副总经理室公司协理。

4、核心技术人员变化情况

根据核心技术人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司核心技术人员调查表》，詹奕鹏系最近两年加入发行人的核心技术人员，其余4名核心技术人员近两年均在发行人处任职。

经核查，发行人董事、高级管理人员的上述变化符合法律法规及当时有效的公司章程的有关规定，并已履行必要的法律程序；最近两年内，公司董事变化均系股东更

换委派董事人选，新增董事均来自发行人原股东委派或提名，发行人董事最近两年内没有发生重大不利变化；除陈耿川、孙志明系因个人原因离职外，最近两年内，发行人高级管理人员变化均系股东更换委派高级管理人员人选、公司内部职位调整或晋升、员工退休等原因引起，辞任的总经理目前仍在发行人担任顾问职务。上述董事、高级管理人员的变动不属于重大变化，发行人核心管理层稳定，对发行人的生产经营未产生不利影响。

本所认为，发行人董事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内没有发生重大不利变化，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

（三）发行人的独立董事

发行人现有 3 名独立董事，分别为安广实、陈绍亨、BEICHAO ZHANG（张北超）。独立董事占全体董事的比例不低于三分之一，其中安广实为会计专业人士。安广实已取得独立董事资格证书并完成上交所科创板独立董事视频课程学习，陈绍亨、BEICHAO ZHANG（张北超）尚待取得独立董事资格证书并完成上交所科创板独立董事视频课程学习。

根据独立董事填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》并经核查，本所认为，发行人的独立董事具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发（2001）102 号）所要求的独立性，具有 5 年以上履行独立董事职责所必须的工作经验，包括发行人在内，兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家，且不属于下列不应当担任独立董事的人员：

（1）其本人及其直系亲属、主要社会关系在发行人或者其附属企业任职；（2）其本人及其直系亲属直接或间接持有发行人已发行股份 1%以上或者是发行人前十名股东中的自然人股东；（3）其本人及其直系亲属在直接或间接持有发行人已发行股份 5%以上的股东单位或者在发行人前五名股东单位任职；（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形；（5）其本人为发行人或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；（6）属于《公司章程》规定的不得担任独立董事的其他人员。

综上，本所认为，除陈绍亨、BEICHAO ZHANG（张北超）尚待取得独立董事资格证书并完成上交所科创板独立董事视频课程学习外，发行人的独立董事任职资格符

合法律、法规、规范性文件、中国证监会的有关规定及《发行人章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定。

十六、发行人的税务

（一）税务登记及税种、税率

根据《审计报告》《主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》及发行人书面确认，并经本所律师核查，发行人及其境内子公司报告期内执行的主要税种及税率情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、13%（16%、17%）
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地面积	5 元/平方米

综上，本所认为，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其境内子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

（二）税收优惠

根据《审计报告》《主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》及发行人书面确认，并经本所律师核查，发行人及其境内子公司报告期内享受的主要税收优惠政策情况如下：

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《安徽省 2020 年第二批高新技术企业通过认定名单的通知》（皖科高[2020]37 号），发行人被认定为安徽省 2020 年第二批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202034003384，有效期：3 年）。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，发行人自 2020 年度适用 15% 的所得税税率。

综上，本所认为，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其境内子公司享受的税收优惠合法、合规，不存在税收优惠到期的情形。

（三）政府补贴

根据《审计报告》、发行人说明并经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司2018年度、2019年度、2020年度获得的与资产相关的政府补助分别为33,318,547.22元、47,527,511.10元及62,053,047.60元；与收益相关的政府补助为18,760,685.60元、29,542,567.16元及30,007,536.30元。

本所认为，发行人及其境内控股子公司在报告期内享受的主要政府补贴合法、合规。

（四）税务合规证明

2021年2月3日，国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局向晶合集成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经征管系统查询，该纳税人自2018年1月1日以来，按时申报缴纳各项税费款，未发现欠缴税费款，未发现税收违法行为不良记录及因违反税收相关法律法规和规范性文件规定受到行政处罚。”

2021年2月3日，国家税务总局南京市栖霞区税务局向南京晶驱出具《涉税信息查询结果告知书》，“该公司自2020年12月28日至2021年1月31日经税务征管系统查询能够按时申报纳税，未发现其有偷税漏税情况及违规情况。”

2021年1月6日，国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所（办税服务厅）向北京晶芯成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经查询，晶芯成（北京）科技有限公司为我局登记户，该单位于2020年01月01日至2020年12月31日在我局无缴纳税款。根据税务核心系统记载，该企业在此期间未接受过行政处罚。”

2021年2月25日，国家税务总局上海市浦东新区税务局向上海晶合出具《税务证明》，“在2019年12月1日至2020年12月31日期间，能按税法的规定按期办理纳税申报，暂未发现有欠税、偷逃税款和重大违反税收管理法规的情形。”

（五）税务处罚

报告期内，发行人及其境内子公司不存在税务处罚。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）环境保护

根据发行人说明及其提供的文件，截至本律师工作报告出具日，北京晶芯成、南京晶驱无实际经营，日本晶合不从事生产，不涉及环保相关事项。发行人环保实施情况如下：

1、发行人生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要环境污染物及排放量、主要处理设施及处理能力

（1）发行人生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要环境污染物及排放量

发行人的主营业务为 12 英寸晶圆代工，主要生产环节包括清洗、光刻、刻蚀、离子注入、扩散、沉积、化学机械研磨等，发行人生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物及满产后排放量具体如下：

类别	具体产污环节	主要污染物类型	主要污染物指标及排放量	
废水	光刻、刻蚀、清洗、化学机械研磨	酸碱废水、含氨废水、含氟废水、研磨废水、有机废水、含铜废水等	COD	166.31 吨/年
			氨氮	26.86 吨/年
			总磷	2.98 吨/年
			总氮	66.86 吨/年
			氟化物	12.8 吨/年
			总铜	0.04 吨/年
废气	光刻、化学机械研磨、沉积清洗、刻蚀、离子注入、扩散	酸性废气、碱性废气、有机废气、含砷废气、废水站废气、锅炉废气等	颗粒物/烟尘	1.59 吨/年
			二氧化硫	2.88 吨/年
			氮氧化物	40.18 吨/年
			非甲烷总烃	19.89 吨/年
			氯气	1.76 吨/年
			砷烷	0.00064 吨/年
			氯化氢	1.87 吨/年
			氟化物	8.7 吨/年
			硫酸雾	5.39 吨/年
			磷酸	0.82 吨/年
			砷烷	0.00064 吨/年
			硅烷	0.2 吨/年
危险废物	刻蚀、光刻、清洗、化学机械研磨、离子注入及含铜废水处理	化学品废液、废化学品容器、废矿物油、废化学品沾染物、含铜污泥等	3,553 吨/年	
一般固废	含氟废水、研磨废水处理产出污	氟系及研磨系污泥、硫酸铵结晶和纸箱/	4,521 吨/年	

	泥, 含氨废水处理产出硫酸铵结晶、设备包装材料等	木材等其他资源回收类工业固废等		
生活垃圾	食堂、日常行政办公	食材包装盒袋、饮料空瓶空罐、清洁废纸等	213 吨/年	
噪音	机械设备运转等	冷冻机组、空压机、真空泵、风机、水泵等设备运转振动等	厂界噪声	昼间 53-58 分贝 夜间 47-49 分贝

(2) 主要处理设施及处理能力

发行人对于主要环境污染物的处理设施及处理能力具体情况如下

处理设备名称	数量(套)	主要用途	处理能力	运行情况
污水处理站-酸碱废水处理系统	1	处理酸碱废水	7,200 吨/天	正常
污水处理站-含氨废水处理系统	1	处理含氨废水	720 吨/天	正常
污水处理站-含氟废水处理系统	1	处理含氟废水	2,400 吨/天	正常
污水处理站-研磨废水处理系统	1	处理研磨废水	960 吨/天	正常
污水处理站-有机废水处理系统	1	处理有机废水	480 吨/天	正常
污水处理站-含铜废水处理系统	1	处理含铜废水	720 吨/天	正常
酸性废气处理设施(44m 排气筒)	6	处理酸性废气	78,000m ³ /h/套	正常
碱性废气处理设施(44m 排气筒)	3	处理碱性废气	27,000m ³ /h/套	正常
沸石浓缩转轮、RTO 蓄热燃烧炉(44m 排气筒)	3	处理有机废气	60,000m ³ /h/套	正常
含砷废气处理吸附塔(44m 排气筒)	1	处理含砷废气	3,000m ³ /h	正常
两级酸洗喷淋塔+水喷淋塔(19m 排气筒)	2	处理废水站废气	30,000m ³ /h+9,000m ³ /h	正常
锅炉低氮燃烧器(35m 排气筒)	3	处理锅炉废气	4,589 m ³ /h*2 +2,295 m ³ /h	正常

2、发行人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施实际运行情况，报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配

报告期内，发行人环保投资主要系废水、废气等环保设施的购置及改造费用；环保运行费用支出主要系一般固废及危废委外处理费、环保检测费等；其他环保费用主要系建设项目环评报告编制费、环保竣工验收费、环保税、环境管理体系认证及其他环保技术咨询服务费等，发行人环保投资和相关费用成本支出情况如下：

单位：万元

项目	2020年	2019年	2018年
环保投资	36.93	1,247.63	101.90
环保运行费用	341.76	402.75	496.34
其他环保费用	27.87	80.55	45.29
合计	406.56	1,730.93	643.53

报告期内，发行人主要环保设施运行正常，环保投资系根据发行人生产项目的建设情况陆续投入。2019年，发行人实施“12英寸集成电路晶圆制造技术改造项目”时购置了相关环保设备，因此环保投资金额较大。此外，发行人生产经营相关的废水处理站、洁净室系统等环保设施，包含在发行人向合肥蓝科租赁的厂务设施中，由合肥蓝科与厂房一同建设并出租给发行人使用。

发行人2019年度、2020年度环保运营费用低于2018年度，主要原因系：（1）2019年3月，发行人增加了相关环保设施，对生产过程中产生的废液进行蒸发结晶处理，从而大幅降低了需处置的固体废物重量，固体废物处理量亦随之降低；（2）发行人每年对废弃物委外处理供应商进行采购招标议价，随着发行人运营日渐稳定、议价能力增强，废弃物委外处理费用的单价逐年降低。综上，发行人在产能提升的情况下，环保运行费用有所下降。发行人环保相关成本费用与处理公司生产经营所产生的污染总体上相匹配。

3、募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额

发行人本次募集资金拟投资的“12英寸晶圆制造二厂项目”目前处于立项阶段，尚需在开工建设前编制环境影响评价报告并报环保主管部门审批。根据发行人募投项目可行性研究报告，发行人拟投资项目主要污染物类型与目前正在运营项目的类型基本

一致，拟采取的环保措施亦与目前运营项目采取的环保措施基本一致，相关环保措施所需资金由本次公开发行的募集资金和公司自筹资金解决。

4、发行人生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求

(1) 发行人生产经营是否符合国家和地方环保要求

根据《关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）的要求，排污许可证管理的核发分行业、分阶段实施，到2020年全国基本完成排污许可证核发。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环境保护部令第45号）的规定，现有企业事业单位和其他生产经营者应当按照本名录的规定，在实施期限内申请排污许可证。

发行人已于2019年11月11日取得合肥市生态环境局核发的编号为91340100343821433Q001W的《排污许可证》，有效期自2019年11月11日至2022年11月10日。

2021年1月20日，合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局向发行人出具《证明》，“该公司自2018年1月1日以来，未发生过环境污染事故，也未因环境违法行为受到环保行政处罚或立案调查。”

综上，报告期内，发行人生产经营符合国家和地方产业政策和环保规定，符合相关主管部门的要求。

(2) 发行人募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求

根据《中华人民共和国环境影响评价法(2018修正)》第二十五条规定，“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。”发行人本次募集资金拟投资的“12英寸晶圆制造二厂项目”目前处于立项阶段，尚需在开工建设前办理环评相关审批手续。

5、已建项目和已经开工的在建项目是否履行环评手续，公司排污达标检测情况和环保部门现场检查情况，公司是否发生环保事故或重大群体性的环保事件，有关公司环保的媒体报道等

(1) 发行人已建项目和已经开工的在建项目是否履行环评手续

根据发行人正在运营的项目的环境影响报告表、环境主管部门出具的审批意见、环境保护验收文件等资料并经核查，发行人不存在已经开工的在建项目，发行人已建项目环评情况如下：

序号	主体	项目名称	环评批复	验收批复
1	发行人	12英寸晶圆制造基地项目	环建审[2016]18号	合环验[2018]15号
				合环（新）验[2020]36号
2	发行人	12英寸集成电路晶圆制造技术改造项目	环建审[2019]6号	合环（新）验[2020]37号

(2) 公司排污达标检测情况和环保部门现场检查情况

报告期内，发行人每季度委托第三方检测公司对发行人生产经营中产生的废水、废气、厂界噪音等进行检测，并出具了检测报告，检测结果均符合排放要求。

报告期内，发行人所在地环保主管部门不定期对发行人环保运营情况进行现场检查，并委托第三方检测公司对发行人生产经营中产生的废水、废气等进行监督性检测，出具检测报告。根据现场检查记录，环保部门在现场检查中未发现发行人生产经营中存在违法违规行为。

(3) 公司是否发生环保事故或重大群体性的环保事件，有关公司环保的媒体报道等

根据环保部门出具的证明并经登录安徽省及合肥市环境保护主管部门的网站、安徽省企业环境信用评价网站查询，以及通过互联网检索发行人环保相关信息，报告期内，发行人未发生环保事故或重大群体性的环保事件，不存在与发行人有关的重大环保事故或重大群体性环保事件的负面媒体报道，发行人在安徽省生态环境厅组织开展的2019年度安徽省重点污染源单位环境信用评价工作中被评为环保诚信企业。

6、环保合规证明

2021年1月20日，合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局向发行人出具《证明》，“该公司自2018年1月1日以来，未发生过环境污染事故，也未因环境违法行为受到环保行政处罚或立案调查。”

综上所述，发行人主要环保设施运行正常，环保相关成本费用与处理公司生产经营所产生的污染总体上相匹配；发行人生产经营符合国家和地方产业政策和环保规定，符合相关主管部门的要求；发行人已建项目履行了环评手续，报告期内未发生过环境污染事故，也未因环境违法行为受到环保行政处罚或立案调查。本所认为，发行人的经营情况总体符合国家和地方环保要求。

（二）产品质量和技术监督标准

根据发行人书面说明，截至本律师工作报告出具日，北京晶芯成、南京晶驱无实际经营，日本晶合不从事生产，不涉及产品质量和技术监督标准相关事项。根据发行人书面说明，并经本所律师登录安徽省市场监督管理局网站（<http://amr.ah.gov.cn>）、合肥市市场监督管理局网站（<http://amr.hefei.gov.cn>）查询，发行人及其子公司最近三年没有因违反国家、地方有关质量、技术监督方面的规定而被质量技术监督部门处罚的情形。

（三）安全生产

根据发行人书面说明，截至本律师工作报告出具日，北京晶芯成、南京晶驱无实际经营，日本晶合不从事生产，不涉及安全生产相关事项。发行人安全生产合规情况如下：

2021年1月15日，合肥市新站高新技术产业开发区应急管理局出具《关于合肥晶合集成电路股份有限公司安全生产有关情况的证明》，“自2018年1月1日至今，我局未发现合肥晶合集成电路股份有限公司在合肥新站高新技术产业开发区发生重大安全生产事故，也未因违反安全生产法律法规而受到我局安全生产行政处罚。”

根据上述安全生产监督管理部门出具的证明、发行人书面确认并经本所律师核查，发行人及其子公司的生产经营符合安全生产监督管理要求，最近三年未发生过安全生产事故，未受过安全生产方面的行政处罚。

十八、发行人的劳动及社会保障

（一）劳动及社会保险

1、劳动合同

根据发行人提供的《劳动合同》模板，并经本所律师抽样核查发行人与员工签署的《劳动合同》，该等劳动合同的内容、形式符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的要求。

2、社会保险缴纳情况

根据发行人提供的社保缴纳凭证及其说明，报告期内，发行人及其境内子公司为员工缴纳社会保险的情况如下：

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
员工总数（人）	1,652	1,352	1,245
已缴人数（人）	1,297	1,029	902
已缴人数比例（%）	78.51%	76.11%	72.45%
未缴人数（人）	355	323	343
未缴人数比例（%）	21.49%	23.89%	27.55%

报告期内，发行人及其境内子公司未为全部员工缴纳社会保险的原因主要为：1）存在个别当月社会保险扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳社会保险；2）在境内任职的中国台湾籍员工按照台湾地区法规缴纳了劳健保；3）在境内任职的外籍员工未缴纳社会保险。

2021年1月7日，合肥市人力资源和社会保障局出具证明：经核实，晶合集成依法足额缴纳各项社会保险费，自2018年1月1日至2021年1月7日未发现劳动用工违法行为，无人力资源社会保障行政部门处罚的不良记录。

（二）住房公积金缴纳情况

报告期内，发行人及其境内子公司为员工缴纳住房公积金的情况如下：

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
员工总数（人）	1,652	1,352	1,245
已缴人数（人）	1,352	1,035	927
已缴人数比例（%）	81.84%	76.55%	74.46%
未缴人数（人）	300	317	318
未缴人数比例（%）	18.16%	23.45%	25.54%

报告期内，发行人及其境内子公司未为全部员工缴纳住房公积金的原因主要为：

- 1) 存在个别当月住房公积金扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳住房公积金；
- 2) 在境内任职的中国台湾籍、外籍员工未缴纳住房公积金。

2021年1月8日，合肥市住房公积金管理中心出具证明：晶合集成自2016年7月在我中心开户缴存职工住房公积金，该公司住房公积金缴存正常，未发现违反住房公积金相关法律法规的行为，公司未因住房公积金问题而受到行政处罚。

（三）劳务派遣及劳务外包

1、劳务派遣

报告期内，发行人及其子公司不存在劳务派遣用工。

2、劳务外包

报告期内，发行人及其子公司劳务外包的相关情况如下：

单位：万元

供应商名称	合作时间	劳务外包主要内容	2020年	2019年	2018年
安徽诚和物业服务 有限公司	2018年1月至 2019年12月	研发楼物业 保洁服务	-	129.16	146.09
保利物业服务股份 有限公司	2020年1月至 2020年12月		210.39	-	-
南京神龙保安服务 有限公司芜湖分公 司	2018年1月至 2018年5月	厂区保安服 务	-	-	57.25
安徽恒杰保安服务 有限公司	2018年5月至 2019年4月		-	60.64	125.54
安徽中天保安服务 集团有限公司	2020年4月至 2020年12月		185.62	108.47	-
合肥浩顺物业管理	2018年1月至	公租房物业	22.65	22.95	23.20

有限公司	2020年12月	服务			
合肥安景物业服务有限责任公司	2018年1月至 2018年5月	公租房保安 服务	-	-	9.42
上海景瑞物业管理 有限公司	2018年5月至 2020年12月		68.16	61.24	28.29
上海坤钰物业管理 有限公司	2020年3月至 2020年12月	上海办公室 保洁服务	0.57	-	-
合肥永屹人力资源 服务	2018年1月至 2020年12月	搬运服务	40.96	34.15	33.05
合计			528.35	416.61	422.84
占管理费用的比例			1.93%	3.00%	3.22%

报告期内，发行人劳务外包主要为保安、保洁、物业、搬运等生产经营中辅助性工作，各年度劳务外包费用占发行人管理费用的比例较低，发行人不存在将主要生产经营活动交由劳务外包公司实施的情况。

十九、发行人募集资金的运用

2021年3月16日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于合肥晶合集成电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》《关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》，公司拟公开发行不超过501,533,789股人民币普通股（行使超额配售选择权前），实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

单位：亿元

序号	实施主体	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	发行人	12英寸晶圆制造二厂项目	165	120

发行人“12英寸晶圆制造二厂项目”的实施地点为安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号，位于发行人厂区范围内，募投项目实施相关厂房系向合肥蓝科租赁，合肥蓝科已取得相关房屋的不动产权证，具体情况如本律师工作报告“十、发行人的主要财产”之“（一）土地使用权及房屋所有权”所述。

发行人“12英寸晶圆制造二厂项目”已向相关部门申请备案，备案完成后可向环保主管部门申请办理环评相关审批手续。

本所认为，发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、投资项目管理、环境保护、土地管理及其他法律、行政法规和规章的规定。

二十、发行人业务发展目标

（一）发行人业务发展目标与主营业务的一致性

根据《招股说明书（申报稿）》及发行人出具的书面说明，发行人的发展战略为：

在当前的国内行业上下游仍高度依赖进口的背景下，发行人将抓住 5G、AI、物联网等市场机遇，提升晶圆制造环节的本土企业市场影响力，实现国内显示驱动芯片、微处理器、CMOS 图像传感器等集成电路产品的自主可控供应，进一步提高集成电路行业的国产化水平。

未来，公司将不断依托核心优势、提升专业技术水平，整合行业及客户资源，发挥管理团队和技术团队能动性，进一步向兼顾晶圆代工产品和设计服务能力的综合性晶圆制造企业发展，逐步形成显示驱动、图像传感、微控制器、电源管理四大集成电路特色工艺应用产品线，矢志成为全球第一的面板驱动晶圆代工厂，矢志成为中国卓越的集成电路专业制造公司。

本所认为，发行人的业务发展目标与其主营业务一致。

（二）发行人业务发展目标的合法性

经本所律师核查，本所认为，发行人在《招股说明书（申报稿）》中所述的业务发展目标符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十一、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）发行人及其下属公司

经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/>）、信用中国网（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、全国法院失信被执行人

名单信息公布与查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/index.html>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)、人民法院公告网 (<http://rmfygg.court.gov.cn/>)、中国检察网 ([http://www.12309.gov.cn/ajxxgk.jcy.gov.cn/12309/index.shtml](http://www.12309.gov.cn/ajxxgk/jcy.gov.cn/12309/index.shtml))、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)，访谈发行人董事、监事和高级管理人员并根据发行人书面确认，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚。

(二) 持有发行人 5%以上股份的股东

根据持有发行人 5%以上股份的主要股东填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》、持有发行人 5%以上股份的主要股东出具的承诺函、境外法律意见书，并经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏 (<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/>)、信用中国网 (<https://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/index.html>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)、人民法院公告网 (<http://rmfygg.court.gov.cn/>)、中国检察网 ([http://www.12309.gov.cn/ajxxgk.jcy.gov.cn/12309/index.shtml](http://www.12309.gov.cn/ajxxgk/jcy.gov.cn/12309/index.shtml))、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>) 等网站查询，截至 2020 年 12 月 31 日，持有发行人 5%以上股份的主要股东不存在对晶合集成产生影响的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

(三) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

根据发行人董事、监事、高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》、核心技术人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司核心技术人员调查表》，中国证监会安徽监管局诚信信息查询结果，并经本所律师查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)、人民法院公告网 (<http://rmfygg.court.gov.cn/>) 等网站，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

二十二、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施

（一）发行人及其控股股东等责任主体相关承诺的合法性

根据发行人及其控股股东等责任主体签署的相关承诺函并经本所律师核查，发行人及其控股股东等责任主体就本次发行上市涉及的相关事宜作出的主要承诺如下：

序号	承诺事项	承诺方
1	关于所持股份锁定期	发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		持有发行人 5%以上股份的股东力晶科技、美的创新
		持有发行人不足 5%股份的股东
		持有发行人股份的董事、高级管理人员，以及核心技术人员
2	关于持股意向及减持意向	发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		持有发行人 5%以上股份的股东力晶科技、美的创新
3	关于上市后三年内稳定公司股价措施	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		董事（不含独立董事）及高级管理人员
4	股份回购和股份购回的措施和承诺	发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
5	对欺诈发行上市的股份购回承诺	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
6	关于摊薄即期回报填补措施	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		全体董事、高级管理人员
7	关于依法承担赔偿责任或赔偿责任	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
8	关于避免同业竞争	发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		全体董事、监事、高级管理人员
9	关于规范并减少关联交易	发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		持有发行人 5%以上股份的股东力晶科技、美的创新
		全体董事、监事、高级管理人员
10	关于未履行承诺事项的约束措施	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏

序号	承诺事项	承诺方
		持有发行人 5% 以上股份的股东力晶科技、美的创新
		全体董事、监事、高级管理人员，以及核心技术人员
11	关于避免资金占用和违规担保	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
12	关于诉讼/仲裁事项及行政处罚事项	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		持有发行人 5% 以上股份的股东力晶科技、美的创新
13	关于缴纳社保及公积金	发行人
14	关于不存在违规情形的承诺函	全体董事、监事、高级管理人员
15	关于申请文件真实、准确、完整	发行人
		全体董事、监事、高级管理人员
16	关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		全体董事、监事、高级管理人员
17	股东信息披露专项承诺	发行人
18	力晶科技出具的其他承诺	持有发行人 5% 以上股份的股东力晶科技

经本所律师核查，本次发行上市涉及的相关责任主体作出的主要承诺文件已经相关责任主体或其授权代表签署，相关承诺合法合规。

（二）发行人及其控股股东等责任主体未履行相关承诺的约束措施的合法性

经本所律师核查，上述对于未履行相关承诺的约束措施已经发行人及其控股股东等相关责任主体签署，内容合法、合规，符合《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》对相关责任主体作出公开承诺事项应同时提出未履行承诺时的约束措施的相关要求。

同时，发行人已就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了摊薄即期回报的填补措施。发行人及其董事、高级管理人员、控股股东已根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，就确保发行人填补回报措施的切实履行作出了承诺。发行人第一届董事会第三次会议已将摊薄即期回

报分析、填补即期回报措施及上述相关承诺主体的承诺等事项形成议案，由发行人2020年年度股东大会审议通过。

二十三、发行人《招股说明书（申报稿）》法律风险的评价

本所律师已参与《招股说明书（申报稿）》的编制和讨论，已审阅了《招股说明书（申报稿）》，并特别审阅了其中引用本律师工作报告和《法律意见书》的相关内容。本所认为，发行人《招股说明书（申报稿）》引用的本律师工作报告和《法律意见书》相关内容与本律师工作报告和《法律意见书》无矛盾之处。本所对发行人《招股说明书（申报稿）》中引用本律师工作报告和《法律意见书》的相关内容无异议，确认《招股说明书（申报稿）》不致因引用本律师工作报告和《法律意见书》的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十四、关于本次发行上市的总体结论性意见

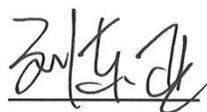
综上所述，本所认为，发行人符合《证券法》《公司法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的各项条件，不存在重大违法违规行为。本所对发行人《招股说明书（申报稿）》中引用本律师工作报告和《法律意见书》的相关内容无异议，确认《招股说明书（申报稿）》不致因引用本律师工作报告和《法律意见书》的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人本次发行尚待获得上交所审核同意并报经中国证监会注册，本次发行完成后，经上交所审核同意，发行人股票可于上交所科创板上市交易。

（本页以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》之签章页）



经办律师： 
苏 峥


刘东亚

单位负责人： 
王 玲

二〇二一年四月二十五日

附件：发行人及其子公司拥有的知识产权

1、境内注册商标

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限
1	发行人	Nexchip	26296999A	9	2018年11月7日-2028年11月6日
2	发行人	Nexchip	26258933	25	2018年8月28日-2028年8月27日
3	发行人	Nexchip	26283789	35	2018年9月7日-2028年9月6日
4	发行人	Nexchip	26255490	40	2018年8月28日-2028年8月27日
5	发行人	晶合	26295138A	9	2018年11月7日-2028年11月6日
6	发行人	晶合	26261189	25	2018年10月28日-2028年10月27日
7	发行人	晶合	26283543	35	2018年9月7日-2028年9月6日

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限
8	发行人	晶合	26258453	40	2018年8月28日-2028年8月27日
9	发行人	晶合集成	26296982A	9	2018年11月7日-2028年11月6日
10	发行人	晶合集成	26257005	25	2018年10月28日-2028年10月27日
11	发行人	晶合集成	26279879	35	2018年9月7日-2028年9月6日
12	发行人	晶合集成	26258966	40	2018年8月28日-2028年8月27日
13	发行人		26279826	9	2018年12月7日-2028年12月6日
14	发行人		43218141	25	2020年10月14日-2030年10月13日
15	发行人		26279830	35	2018年9月7日-2028年9月6日

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限
16	发行人		26273278	40	2019年12月14日-2029年 12月13日
17	发行人		36794768	25	2020年8月21日-2030年 8月20日

2、境外注册商标

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	国家/地区
1	发行人	Nexchip	6098177	9	2018年11月16日-2028年11月15日	日本
2	发行人	Nexchip	6071853	25	2018年8月17日-2028年8月16日	日本
3	发行人	Nexchip	6098177	35	2018年11月16日-2028年11月15日	日本
4	发行人	Nexchip	6071853	40	2018年8月17日-2028年8月16日	日本
5	发行人	晶合	6050343	9	2018年6月8日-2028年6月7日	日本
6	发行人	晶合	6070505	25	2018年8月10日-2028年8月9日	日本
7	发行人	晶合	6050343	35	2018年6月8日-2028年6月7日	日本
8	发行人	晶合	6070505	40	2018年8月10日-2028年8月9日	日本

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	国家/地区
9	发行人	晶合集成	6050344	9	2018年6月8日-2028年 6月7日	日本
10	发行人	晶合集成	6071852	25	2018年8月17日-2028年 8月16日	日本
11	发行人	晶合集成	6050344	35	2018年6月8日-2028年 6月7日	日本
12	发行人	晶合集成	6071852	40	2018年8月17日-2028年 8月16日	日本
13	发行人		6050345	9	2018年6月8日-2028年 6月7日	日本
14	发行人		6070504	25	2018年8月10日-2028年 8月9日	日本
15	发行人		6050345	35	2018年6月8日-2028年 6月7日	日本
16	发行人		6070504	40	2018年8月10日-2028年 8月9日	日本
17	发行人	Nexchip	01919639	9	2018年6月16日-2028年	中国台湾

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	国家/地区
					6月15日	
18	发行人	Nexchip	01923633	25	2018年7月1日-2028年6月30日	中国台湾
19	发行人	Nexchip	01920983	35	2018年6月16日-2028年6月15日	中国台湾
20	发行人	Nexchip	01912745	40	2018年5月1日-2028年4月30日	中国台湾
21	发行人	晶合	01919637	9	2018年6月16日-2028年6月15日	中国台湾
22	发行人	晶合	01909401	25	2018年4月16日-2028年4月15日	中国台湾
23	发行人	晶合	01920981	35	2018年6月16日-2028年6月15日	中国台湾
24	发行人	晶合	01912743	40	2018年5月1日-2028年4月30日	中国台湾
25	发行人	晶合集成	01919636	9	2018年6月16日-2028年6月15日	中国台湾

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	国家/地区
26	发行人	晶合集成	01909400	25	2018年4月16日-2028年4月15日	中国台湾
27	发行人	晶合集成	01920980	35	2018年6月16日-2028年6月15日	中国台湾
28	发行人	晶合集成	01918174	40	2018年6月1日-2028年5月31日	中国台湾
29	发行人		01919638	9	2018年6月16日-2028年6月15日	中国台湾
30	发行人		01909402	25	2018年4月16日-2028年4月15日	中国台湾
31	发行人		01920982	35	2018年6月16日-2028年6月15日	中国台湾
32	发行人		01912744	40	2018年5月1日-2028年4月30日	中国台湾
33	发行人	Nexchip	5513533	9	2018年7月10日-2028年7月9日	美国
34	发行人	Nexchip	5513299	25	2018年7月10日-2028年	美国

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	国家/地区
					7月9日	
35	发行人	Nexchip	5559722	35	2018年9月11日-2028年9月10日	美国
36	发行人	Nexchip	5513440	40	2018年7月10日-2028年7月9日	美国
37	发行人	晶合	5523772	9	2018年7月24日-2028年7月23日	美国
38	发行人	晶合	5518583	25	2018年7月17日-2028年7月16日	美国
39	发行人	晶合	5513532	35	2018年7月10日-2028年7月9日	美国
40	发行人	晶合	5518584	40	2018年7月17日-2028年7月16日	美国
41	发行人	晶合集成	5518591	25	2018年7月17日-2028年7月16日	美国
42	发行人	晶合集成	5523770	9	2018年7月24日-2028年7月23日	美国

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	国家/地区
43	发行人	晶合集成	5523769	35	2018年7月24日-2028年7月23日	美国
44	发行人	晶合集成	5513586	40	2018年7月10日-2028年7月9日	美国
45	发行人		5523767	9	2018年7月24日-2028年7月23日	美国
46	发行人		5523806	25	2018年7月24日-2028年7月23日	美国
47	发行人		5523768	35	2018年7月24日-2028年7月23日	美国
48	发行人		5523807	40	2018年7月24日-2028年7月23日	美国
49	发行人	Nexchip	018074417	9	2019年5月31日-2029年5月31日	欧盟
50	发行人	Nexchip	018074417	35	2019年5月31日-2029年5月31日	欧盟
51	发行人	Nexchip	018074417	40	2019年5月31日-2029年	欧盟

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	国家/地区
					5月31日	
52	发行人	 Nexchip	018073971	9	2019年5月31日-2029年5月31日	欧盟
53	发行人	 Nexchip	018073971	35	2019年5月31日-2029年5月31日	欧盟
54	发行人	 Nexchip	018073971	40	2019年5月31日-2029年5月31日	欧盟
55	发行人		018073976	9	2019年5月31日-2029年5月31日	欧盟
56	发行人		018073976	35	2019年5月31日-2029年5月31日	欧盟
57	发行人		018073976	40	2019年5月31日-2029年5月31日	欧盟
58	发行人	Nexchip	4196328	35	2019年6月3日-2029年6月2日	印度
59	发行人	Nexchip	4196329	40	2019年6月3日-2029年6月2日	印度

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	国家/地区
60	发行人	 Nexchip	4216333	35	2019年6月25日-2029年6月24日	印度
61	发行人	 Nexchip	4216334	40	2019年6月25日-2029年6月24日	印度
62	发行人		4196323	9	2019年6月3日-2029年6月2日	印度
63	发行人		4196324	35	2019年6月3日-2029年6月2日	印度
64	发行人		4196325	40	2019年6月3日-2029年6月2日	印度
65	发行人	Nexchip	40-1603379	35	2020年5月7日-2030年5月6日	韩国
66	发行人	Nexchip	40-1603380	40	2020年5月7日-2030年5月6日	韩国
67	发行人	 Nexchip	40-1605036	35	2020年5月12日-2030年5月11日	韩国
68	发行人	 Nexchip	40-1605037	40	2020年5月12日-2030年	韩国

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	国家/地区
					5月11日	
69	发行人		40-1603377	9	2020年5月7日-2030年 5月6日	韩国
70	发行人		40-1603378	35	2020年5月7日-2030年 5月6日	韩国
71	发行人		40-1599318	40	2020年4月23日-2030年 4月22日	韩国
72	发行人	Nexchip	40201926832S	35	2019年12月12日-2029 年12月11日	新加坡
73	发行人	Nexchip	40201926831T	40	2029年12月12日-2029 年12月11日	新加坡
74	发行人	 Nexchip	40201925814T	35	2019年11月28日-2029 年11月27日	新加坡
75	发行人		40201926842V	9	2019年12月12日-2029 年12月11日	新加坡
76	发行人		40201926838P	35	2019年12月12日-2029 年12月11日	新加坡

3-3-2-185

1102

3、境内专利

序号	专利名称	类型	专利号	专利权人	申请日期	授权公告日	取得方式
1	光学光刻方法	发明	ZL03155531.4	发行人	2003/8/28	2008/4/9	继受取得
2	具有自行对准接触窗的半导体元件及其制造方法	发明	ZL200510065580.3	发行人	2005/4/18	2008/9/24	继受取得
3	导线的制造方法	发明	ZL200510065608.3	发行人	2005/4/18	2008/11/26	继受取得
4	导线的制造方法以及缩小导线与图案间距的方法	发明	ZL200510129767.5	发行人	2005/12/5	2008/11/26	继受取得
5	半导体元件及其制造方法	发明	ZL200610005891.5	发行人	2006/1/19	2009/5/6	继受取得
6	电路结构及用以定义此电路结构的光掩模	发明	ZL200710161775.7	发行人	2007/9/26	2011/5/18	继受取得
7	监控光刻工艺的方法与监控标记	发明	ZL200810093317.9	发行人	2008/4/18	2011/9/14	继受取得
8	半导体元件的制造方法	发明	ZL201910103609.4	发行人	2019/2/1	2020/10/16	原始取得
9	扩散型场效应晶体管的形成方法	发明	ZL202010043997.4	发行人	2020/1/15	2020/10/16	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	专利权人	申请日期	授权公告日	取得方式
10	MOS 场效应晶体管及其制造方法	发明	ZL201811237197.5	发行人	2018/10/23	2020/11/13	原始取得
11	沟槽制作方法及半导体隔离结构制作方法	发明	ZL201911268173.0	发行人	2019/12/11	2020/11/13	原始取得
12	沟槽隔离结构的形成方法	发明	ZL201910048694.9	发行人	2019/1/18	2020/11/20	原始取得
13	一种存储器及其制造方法	发明	ZL201910104747.4	发行人	2019/2/1	2020/12/4	原始取得
14	半导体器件及其制造方法	发明	ZL202010099798.5	发行人	2020/2/18	2020/12/4	原始取得
15	预处理方法、金属硅化物的形成方法以及半导体处理装置	发明	ZL201910611966.1	晶合集成	2019/7/8	2020/12/11	原始取得
16	一种液位测量仪	实用新型	ZL201820995525.7	发行人	2018/6/25	2019/3/8	原始取得
17	用于半导体设备的安装位检测装置	实用新型	ZL201821130870.0	发行人	2018/7/17	2019/3/26	原始取得
18	一种气体供应装置	实用新型	ZL201821192419.1	发行人	2018/7/24	2019/3/26	原始取得
19	用于半导体设备的定位装置	实用新型	ZL201821147988.4	发行人	2018/7/19	2019/5/3	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	专利权人	申请日期	授权公告日	取得方式
20	双灯丝离子源装置	实用新型	ZL201821163226.3	发行人	2018/7/23	2019/5/21	原始取得
21	一种载台及载具	实用新型	ZL201821719617.9	发行人	2018/10/22	2019/6/14	原始取得
22	掩膜板	实用新型	ZL201821957502.3	发行人	2018/11/23	2019/6/28	原始取得
23	可感测基片破损的片盒	实用新型	ZL201822002991.3	发行人	2018/11/30	2019/6/28	原始取得
24	一种气体除尘装置及具有该气体除尘装置的气体处理装置	实用新型	ZL201821753440.4	发行人	2018/10/26	2019/7/19	原始取得
25	一种半导体设备的不间断储水装置及半导体设备	实用新型	ZL201920706945.3	发行人	2019/5/17	2019/11/19	原始取得
26	一种防干扰装置及半导体制程机台	实用新型	ZL201921016248.1	发行人	2019/7/2	2020/3/27	原始取得
27	一种半导体设备的组件调整装置	实用新型	ZL201921439572.4	发行人	2019/9/2	2020/4/7	原始取得
28	流速调节装置	实用新型	ZL201921235650.9	发行人	2019/8/1	2020/5/1	原始取得
29	一种半导体设备夹持装置	实用新型	ZL201921604162.0	发行人	2019/9/25	2020/5/19	原始取得
30	半导体检测机台	实用新型	ZL201921654723.8	发行人	2019/9/30	2020/6/16	原始取得
31	封装芯片的移除装置	实用新型	ZL201922312082.4	发行人	2019/12/20	2020/6/16	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	专利权人	申请日期	授权公告日	取得方式
32	半导体器件	实用新型	ZL202020247738.9	发行人	2020/3/2	2020/8/25	原始取得
33	嵌入式焊盘结构	实用新型	ZL202020252537.8	发行人	2020/3/4	2020/8/25	原始取得
34	多次可编程存储器的单元结构	实用新型	ZL202020331150.1	发行人	2020/3/16	2020/8/25	原始取得
35	封装结构	实用新型	ZL202020404622.1	发行人	2020/3/24	2020/8/25	原始取得
36	一种晶体管结构	实用新型	ZL202020257664.7	发行人	2020/3/4	2020/9/11	原始取得
37	一种半导体器件	实用新型	ZL202020333222.6	发行人	2020/3/17	2020/9/11	原始取得
38	一种非易失性存储器结构	实用新型	ZL202020519501.1	发行人	2020/4/10	2020/9/11	原始取得
39	一种非易失性存储器结构	实用新型	ZL202020519503.0	发行人	2020/4/10	2020/9/11	原始取得
40	一种半导体设备的腔室及半导体设备	实用新型	ZL202020604243.7	发行人	2020/4/21	2020/9/18	原始取得
41	一种光罩	实用新型	ZL202020368355.7	发行人	2020/3/23	2020/10/2	原始取得
42	一种半导体结构及其应用的半导体器件	实用新型	ZL202020778398.2	发行人	2020/5/12	2020/12/4	原始取得
43	一种半导体结构的制备方法	发明	ZL202010937769.1	南京晶驱	2020/9/9	2020/12/4	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	专利权人	申请日期	授权公告日	取得方式
44	一种检测半导体设备检测感度的方法和检测系统	发明	ZL202010938526.X	南京晶驱	2020/9/9	2020/12/4	原始取得
45	晶圆裂片方法及其应用	发明	ZL202010931740.2	南京晶驱	2020/9/8	2020/12/11	原始取得
46	一种光阻层阻挡能力的检测方法及检测系统	发明	ZL202010937768.7	南京晶驱	2020/9/9	2020/12/22	原始取得
47	一种浅沟槽结构制备方法	发明	ZL202011012959.9	南京晶驱	2020/9/24	2020/12/22	原始取得
48	一种半导体结构的制备方法	发明	ZL202011021798.X	南京晶驱	2020/9/25	2020/12/22	原始取得
49	一种静电放电防护线路	发明	ZL 202011099926.2	南京晶驱	2020/10/15	2020/12/22	原始取得
50	电容器及其制备方法	发明	ZL202011037143.1	南京晶驱	2020/9/28	2020/12/25	原始取得
51	半导体器件的制备方法	发明	ZL202011093528.X	南京晶驱	2020/10/14	2020/12/25	原始取得
52	一种半导体结构及其制造方法	发明	ZL202011039422.1	北京晶芯成	2020/9/28	2020/12/22	原始取得
53	一种金属互连结构的形成方法	发明	ZL202011054620.5	北京晶芯成	2020/9/30	2020/12/25	原始取得
54	测试结构及其测试方法	发明	ZL202011106814.5	北京晶芯成	2020/10/16	2020/12/25	原始取得

4、境外专利

序号	专利名称	类别	专利号	专利权人	授权公告日	取得方式	注册地
1	Method for forming stepped contact hole for semiconductor devices	发明	US 6,444,574 B1	发行人	2002/9/3	继受取得	美国
2	Semiconductor device having reduced interconnect-line parasitic capacitance	发明	US 6,531,776 B2	发行人	2003/3/11	继受取得	美国
3	Method of forming stepped contact trench for semiconductor devices	发明	US 6,583,055 B1	发行人	2003/6/24	继受取得	美国
4	Method of manufacturing semiconductor device with formation of a heavily doped region by implantation through an insulation layer	发明	US 6,670,254 B1	发行人	2003/12/30	继受取得	美国
5	Method for producing a gate	发明	US 6,699,755 B1	发行人	2004/3/2	继受取得	美国
6	METHOD FOR AUTOMATICALLY CONTROLLING DEFECT - SPECIFICATION IN A SEMICONDUCTOR	发明	US 6,807,454 B2	发行人	2004/10/19	继受取得	美国

序号	专利名称	类别	专利号	专利权人	授权公告日	取得方式	注册地
	MANUFACTURING PROCESS						
7	Semiconductor device formed on silicon-on-insulator substrate	发明	US 6,828,633 B2	发行人	2004/12/7	继受取得	美国
8	Re-performable spin-on process	发明	US 6,881,590 B2	发行人	2005/4/19	继受取得	美国
9	浅沟渠隔离结构的制造方法	发明	I234228	发行人	2005/6/11	继受取得	台湾
10	制作通孔的方法	发明	I240988	发行人	2005/10/1	继受取得	台湾
11	METHOD FOR FABRICATING A THROUGH HOLE ON A SEMICONDUCTOR SUBSTRATE	发明	US 6,995,086 B2	发行人	2006/2/7	继受取得	美国
12	METHOD OF IMPROVING A RESOLUTION OF CONTACT HOLE PATTERNS BY UTILIZING ALTERNATE PHASE SHIFT PRINCIPLE	发明	US 7,008,733 B2	发行人	2006/3/7	继受取得	美国
13	Silicon-on-insulator device structure	发明	US 7,019,582 B2	发行人	2006/3/28	继受取得	美国

序号	专利名称	类别	专利号	专利权人	授权公告日	取得方式	注册地
14	METHOD FOR FORMING A TITANIUM NITRIDE LAYER	发明	US 7,030,015 B2	发行人	2006/4/18	继受取得	美国
15	具有自行对准接触窗的半导体组件及其制造方法	发明	I254409	发行人	2006/5/1	继受取得	台湾
16	导线的制造方法	发明	I254365	发行人	2006/5/1	继受取得	台湾
17	METHOD OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE	发明	US 7,056,787 B2	发行人	2006/6/6	继受取得	美国
18	Method of forming contact hole and method of fabricating semiconductor device	发明	US 7,098,124 B2	发行人	2006/8/29	继受取得	美国
19	半导体元件及其制造方法	发明	I267190	发行人	2006/11/21	继受取得	台湾
20	METHOD OF FABRICATING SEMICONDUCTOR DEVICE	发明	US 7,268,055 B2	发行人	2007/9/11	继受取得	美国
21	METHOD FOR MANUFACTURING GATE DIELECTRIC LAYER	发明	US 7,273,787 B2	发行人	2007/9/25	继受取得	美国
22	隔离结构的制造方法	发明	I300968	发行人	2008/9/11	继受取得	台湾

序号	专利名称	类别	专利号	专利权人	授权公告日	取得方式	注册地
23	METHOD OF MANUFACTURING SELF-ALIGNED CONTACT OPENINGS	发明	US 7,429,527 B2	发行人	2008/9/30	继受取得	美国
24	自行对准接触窗开口的制作方法	发明	I301997	发行人	2008/10/11	继受取得	台湾
25	分离闸极快闪记忆体的故障检测方法	发明	I301982	发行人	2008/10/11	继受取得	台湾
26	HALF-TONE PHASE SHIFT MASK AND PATTERNING METHOD USING THEREOF	发明	US 7,461,472 B2	发行人	2008/12/9	继受取得	美国
27	METHOD FOR FORMING BURIED DOPED REGION	发明	US 7,465,632 B2	发行人	2008/12/16	继受取得	美国
28	光罩复验方法与系统	发明	I305004	发行人	2009/1/1	继受取得	台湾
29	管制规格界限之制定方法	发明	I305838	发行人	2009/2/1	继受取得	台湾
30	METHOD OF FABRICATING CONDUCTIVE LINES WITH SILICIDE LAYER	发明	US 7,550,372 B2	发行人	2009/6/23	继受取得	美国

序号	专利名称	类别	专利号	专利权人	授权公告日	取得方式	注册地
31	以交替式相位移原理改善接觸洞圖案解析度之方法	发明	I313889	发行人	2009/8/21	继受取得	台湾
32	Semiconductor device having self-aligned contact	发明	US 7,612,433 B2	发行人	2009/11/3	继受取得	美国
33	MANUFACTURING METHOD OF SEMICONDUCTOR DEVICE HAVING SELF-ALIGNED CONTACT	发明	US 7,803,692 B2	发行人	2010/9/28	继受取得	美国
34	METHOD FOR FORMING CONTACT WINDOW	发明	US 8,722,538 B2	发行人	2014/5/13	继受取得	美国
35	METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE	发明	US 8,822,303 B2	发行人	2014/9/2	继受取得	美国
36	半導體元件的製造方法	发明	I464831	发行人	2014/12/11	继受取得	台湾
37	接觸窗的形成方法	发明	I473206	发行人	2015/2/11	继受取得	台湾

序号	专利名称	类别	专利号	专利权人	授权公告日	取得方式	注册地
38	METHOD OF FORMING METAL SILICIDE LAYER, SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FABRICATING SAME	发明	US10,490,647 B1	发行人	2019/11/26	原始取得	美国
39	SILICON ISLAND STRUCTURE AND METHOD OF FABRICATING SAME	发明	US 10,490,441 B1	发行人	2019/11/26	原始取得	美国
40	NON-VOLATILE MEMORY CELL, ARRAY AND FABRICATION METHOD	发明	US10,726,894 B2	发行人	2020/7/28	原始取得	美国
41	Split-gate non-volatile memory and fabrication method thereof	发明	US10,636,801 B2	发行人	2020/4/28	原始取得	美国
42	ラッチ回路	发明	特许第 6761074 号	发行人	2020/9/7	原始取得	日本
43	SRAM、半導体集積回路及び LCD ドライバ	发明	特许第 6801053 号	发行人	2020/11/27	原始取得	日本
44	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD	发明	US10,854,758 B2	发行人	2020/12/1	原始取得	美国

序号	专利名称	类别	专利号	专利权人	授权公告日	取得方式	注册地
	FOR THE SAME						

合肥晶合集成电路股份有限公司



章程
(草案)

目录

第一章 总则	1
第二章 经营宗旨和范围	2
第三章 股份	2
第一节 股份发行	2
第二节 股份增减和回购	4
第三节 股份转让和质押	5
第四章 股东和股东大会	6
第一节 股东	6
第二节 股东大会的一般规定	9
第三节 股东大会的召集	12
第四节 股东大会的提案与通知	13
第五节 股东大会的召开	15
第六节 股东大会的表决和决议	17
第五章 董事会	21
第一节 董事	21
第二节 董事会	24
第六章 总经理及其他高级管理人员	29
第七章 监事会	31
第一节 监事	31
第二节 监事会	31
第八章 党组织	33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计	34
第一节 财务会计制度	34
第二节 内部审计	37
第三节 会计师事务所的聘任	37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	38
第一节 合并、分立、增资和减资	38
第二节 解散和清算	39
第十一章 通知	41
第一节 通知	41
第二节 公告	41
第十二章 修改章程	42
第十三章 附则	42

第一章 总则

第一条 为维护合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定成立的股份有限公司。公司由原合肥晶合集成电路有限公司（以下简称“有限责任公司”）整体变更为股份有限公司，承继原有限责任公司的全部资产、负债和业务，有限责任公司的全体股东即为公司的发起人。公司在合肥市新站区市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码：91340100343821433Q。

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：合肥晶合集成电路股份有限公司

公司英文名称：Nexchip Semiconductor Corporation

第五条 公司住所：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号

第六条 公司注册资本为人民币【】万元，总股数为【】万股，均为普通股股份。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股

东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及协理。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：利用先进且实用的技术以及科学的经营管理手段，开展经营范围内的业务，并以使各股东获得满意的经济效益为目的。

第十三条 公司的经营范围：集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司的经营范围以公司登记机关核定为准。

第十四条 根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥政治领导核心作用，公司党组织活动依照《党章》及相关政策规定办理。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，遵循公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

第十七条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第二十条 公司的股份均为普通股，每股面值人民币壹元。公司由有限责任公司整体变更设立之时，发起人按其出资比例以净资产折股的方式出资认购股份，

持股情况如下：

序号	发起人	认购股份数 (股)	出资方式	持股比例 (%)	出资时间
1	合肥市建设投资控股 (集团)有限公司	468,474,592	净资产折股	31.1362	2020年9月30日
2	合肥芯屏产业投资基金 (有限合伙)	328,736,799	净资产折股	21.8488	2020年9月30日
3	力晶科技股份有限公司	412,824,208	净资产折股	27.4374	2020年9月30日
4	合肥晶煅企业管理合 伙企业(有限合伙)	5,195,398	净资产折股	0.3453	2020年9月30日
5	合肥晶咖企业管理合 伙企业(有限合伙)	1,456,606	净资产折股	0.0968	2020年9月30日
6	合肥晶珏企业管理合 伙企业(有限合伙)	1,262,054	净资产折股	0.0839	2020年9月30日
7	合肥晶恩企业管理合 伙企业(有限合伙)	852,648	净资产折股	0.0567	2020年9月30日
8	合肥晶辽企业管理合 伙企业(有限合伙)	497,378	净资产折股	0.0331	2020年9月30日
9	合肥晶梢企业管理合 伙企业(有限合伙)	1,174,082	净资产折股	0.0780	2020年9月30日
10	合肥晶柔企业管理合 伙企业(有限合伙)	862,798	净资产折股	0.0573	2020年9月30日
11	合肥晶炯企业管理合 伙企业(有限合伙)	3,813,060	净资产折股	0.2534	2020年9月30日
12	合肥晶雄企业管理合 伙企业(有限合伙)	253,764	净资产折股	0.0169	2020年9月30日
13	合肥晶本企业管理合 伙企业(有限合伙)	779,902	净资产折股	0.0518	2020年9月30日
14	合肥晶洛企业管理合 伙企业(有限合伙)	581,966	净资产折股	0.0387	2020年9月30日
15	合肥晶确企业管理合 伙企业(有限合伙)	414,481	净资产折股	0.0275	2020年9月30日
16	合肥晶遂企业管理合 伙企业(有限合伙)	4,197,429	净资产折股	0.2790	2020年9月30日
17	合肥晶铁企业管理合 伙企业(有限合伙)	414,481	净资产折股	0.0275	2020年9月30日
18	合肥晶安企业管理合 伙企业(有限合伙)	406,023	净资产折股	0.0270	2020年9月30日
19	美的创新投资有限公 司	88,014,118	净资产折股	5.8498	2020年9月30日
20	合肥中安智芯股权投 资合伙企业(有限合 伙)	39,606,354	净资产折股	2.6323	2020年9月30日
21	深圳市惠友豪创科技 投资合伙企业(有限合 伙)	26,404,236	净资产折股	1.7549	2020年9月30日

22	合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙）	26,404,236	净资产折股	1.7549	2020年9月30日
23	海通创新证券投资有限公司	17,602,824	净资产折股	1.1699	2020年9月30日
24	杭州承富投资管理合伙企业（有限合伙）	15,402,471	净资产折股	1.0237	2020年9月30日
25	泸州隆信投资合伙企业（有限合伙）	13,202,118	净资产折股	0.8774	2020年9月30日
26	宁波华淳投资管理合伙企业（有限合伙）	13,202,118	净资产折股	0.8774	2020年9月30日
27	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）	13,202,118	净资产折股	0.8774	2020年9月30日
28	安徽安华创新风险投资基金有限公司	8,801,412	净资产折股	0.5850	2020年9月30日
29	北京集创北方科技股份有限公司	8,801,412	净资产折股	0.5850	2020年9月30日
30	中金浦成投资有限公司	1,760,282	净资产折股	0.1170	2020年9月30日
合计		1,504,601,368	--	100.00	

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定，收购公司的股份：

(一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有公司股票的其他公司合并；
(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

第二十五条 公司收购公司股份，按照下列方式之一进行：

(一) 证券交易所集中竞价交易方式；

(二) 要约方式；

(三) 中国证监会认可的其他方式。

公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

第三节 股份转让和质押

第二十七条 公司的股份可以依法转让。

第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

第二十九条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。

第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类和份额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。

第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十三条 公司股东享有下列权利：

- (一) 股东享有收益权，依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

- (二) 股东享有表决权, 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会, 并行使相应的表决权;
- (三) 股东享有监督权, 对公司的经营进行监督, 提出建议或者质询;
- (四) 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;
- (五) 股东享有知情权, 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程的规定获得有关信息, 包括: 有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、公司财务会计报告;
- (六) 公司终止或者清算时, 按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;
- (七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东, 要求公司收购其股份;
- (八) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程规定的其他权利。

第三十四条 股东依据前条规定提出查阅有关信息或者索取资料的, 应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件, 公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的, 股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程, 或者决议内容违反本章程的, 股东有权自决议作出之日起60日内, 请求人民法院撤销。

第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定, 给公司造成损失的, 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼; 监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定, 给公司造成损失的, 前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼, 或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼, 或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益

受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

法律、法规及本章程另有规定的,从其规定。

第三十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十八条 公司股东承担下列义务:

- (一) 遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程;
- (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
- (三) 除法律、行政法规规定的情形外,不得退股;
- (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;
- (五) 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;
- (六) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定应当承担的其他义务。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。

第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。

第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

公司的控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东严格依法行使出资人的权利,控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资金占用、担保、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害上市公司利益,侵害公司财产权利,谋取公司商业机会。

公司控股股东、实际控制人应当维护公司独立性,按照公司的决策程序行使权利。公司控股股东、实际控制人不得违反法律法规和本章程,直接或间接干预

公司决策和经营活动,或以其他形式利用其控制地位损害公司和股东的合法权益。

公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资产安全的法定义务。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产的,公司董事会视情节轻重对直接负责人给予处分,对负有严重责任的董事,提请股东大会予以罢免。

第二节 股东大会的一般规定

第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划;
- (二) 选举、更换或罢免非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
- (三) 审议批准董事会的工作报告;
- (四) 审议批准监事会的工作报告;
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
- (八) 对发行公司债券作出决议;
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
- (十) 对修改本章程作出决议;
- (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
- (十二) 审议批准本章程第四十二条规定的对外担保事项;
- (十三) 审议批准法律、行政法规、规章、规范性文件和本章程规定应当由股东大会审议批准的关联交易事项;
- (十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;
- (十五) 审议公司单笔或连续12个月内累计发生金额超过公司最近一期经审计总资产50%的借款或融资;
- (十六) 审议批准变更募集资金用途事项;

- (十七) 审议股权激励计划;
- (十八) 审议批准法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程规定的应由股东大会决定的其他事项。

第四十二条 公司下列对外担保事项, 须经股东大会审议通过:

- (一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;
- (二) 公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;
- (三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
- (四) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;
- (五) 按照担保金额连续12个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保;
- (六) 按照担保金额连续12个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计净资产的50%, 且绝对金额超过人民币5,000万元的担保;
- (七) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
- (八) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程规定需经股东大会审议通过的其他担保。

股东大会审议本条第(五)项担保事项时, 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过; 在股东大会审议本条上述第(七)项担保事项, 即为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时, 该股东或受该实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决。表决须由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

本条所称“对外担保”、“担保事项”, 是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的担保。

本条规定的由股东大会审议的对外担保事项, 必须经董事会审议通过后, 方可提交股东大会审议。

除上述所列情形之外的对外担保, 由公司董事会审议批准。应由公司董事会审批的对外担保, 除应当经全体董事的过半数通过外, 还应当经出席董事会会议三分之二以上董事同意。

第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现本章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。

第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会：

- （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；
- （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
- （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东（以下简称“提议股东”）请求时；
- （四）董事会认为必要时；
- （五）监事会提议召开时；
- （六）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程规定的其他情形。

本条前款第（三）项所述的有表决权数比例，按提议股东提出书面请求之日计算。

第四十五条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中所列明的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第四十六条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

- （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
- （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三节 股东大会的召集

第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第四十九条 提议股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，提议股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东

大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东（以下简称“召集股东”）可以自行召集和主持。

第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

第四节 股东大会的提案与通知

第五十三条 股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的有关规定。

第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知及补充通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第五十五条 召集人应于年度股东大会召开20日前（不包括会议召开当日，

但包括通知发出当日)以公告方式通知各股东,临时股东大会应于会议召开15日前(不包括会议召开当日,但包括通知发出当日)通知各股东。

第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:

- (一) 会议的时间、地点和会议期限;
- (二) 提交会议审议的事项和提案;
- (三) 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
- (四) 有权出席股东大会股东的股权登记日;
- (五) 会务常设联系人姓名,电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。

第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

- (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
- (二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
- (三) 披露持有公司股份数量;
- (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第五十八条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人

应当在原定召开日前至少2个工作日发布延期通知并说明原因。

第五节 股东大会的召开

第五十九条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第六十条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- (一) 代理人的姓名；
- (二) 是否具有表决权；
- (三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- (四) 委托书签发日期和有效期限；
- (五) 委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托书应注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第六十六条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长代行其职权；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，因会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第六十八条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。

第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去1年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议做作出解释和说明。

第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
- (三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- (六) 律师及计票人、监票人姓名；
- (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人及记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。

第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第六节 股东大会的表决和决议

第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）除法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定和本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的合并、分立、变更组织形式、解散、清算；
- （三）本章程的修改；
- （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
- （五）股权激励计划；
- （六）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；
- （七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东表决应当单独计

票。单独计票结果应当及时公开披露。

前款所称影响中小股东利益的重大事项是指应当由独立董事发表独立意见的事项，前述中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%（含）以上股份的股东以外的其他股东。

董事会、独立董事、符合相关规定的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

第八十一条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制度。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会以累积投票方式选举董事、监事的，董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

第八十三条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第八十四条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变

更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。

第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第九十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第九十一条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十二条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，

应当在股东大会决议通知中作特别提示。

第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在选举该董事、监事的股东大会决议通过之日。

第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

第五章 董事会

第一节 董事

第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
- (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
- (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- (六) 被有关监管机构处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- (七) 法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满

未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程，对公司负有下列忠实义务：

- (一) 维护公司及全体股东利益，不得为实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益损害公司利益；
- (二) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
- (三) 不得挪用公司资金；
- (四) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- (五) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- (六) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；
- (七) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；
- (八) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；
- (九) 保守商业秘密，不得泄露尚未披露的重大信息，不得利用内幕信息获取不法利益，离职后履行与公司约定的竞业禁止义务；
- (十) 不得利用其关联关系损害公司利益；
- (十一) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

- (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
- (二) 保证有足够的时间和精力参与公司事务，审慎判断审议事项可能产生的风险和收益；原则上应当亲自出席董事会会议，因故授权其他董事代为出席的，应当审慎选择受托人，授权事项和决策意向应当具体明确，不得全权委托；
- (三) 应公平对待所有股东；
- (四) 及时了解公司业务经营管理状况，及时向董事会报告相关问题和风险，不得以对公司业务不熟悉或者对相关事项不了解为由主张免除责任；
- (五) 应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整；
- (六) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
- (七) 积极推动公司规范运行，督促公司履行信息披露义务，及时纠正和报告公司的违规行为，支持公司履行社会责任；
- (八) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程规定的其他勤勉义务。

第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百〇一条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在合理期限内仍

然有效；其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第一百〇二条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第一百〇三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定执行。

第二节 董事会

第一百〇五条 公司设董事会，对股东大会负责。

第一百〇六条 董事会由9名董事组成，其中6名为非独立董事，3名为独立董事。

董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百〇七条 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产

抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

(十一) 制定公司的基本管理制度；

(十二) 制订本章程的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东大会提请聘任或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六) 拟订股权激励计划；

(十七) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程规定的以及股东大会授予的其他职权。

公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百〇八条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第一百〇九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第一百一十一条 应由董事会批准的交易事项如下：

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的或公司在一年内

购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过人民币 100 万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元的，还应提交股东大会审议；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万元的，还应提交股东大会审议；

（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过人民币 100 万元；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元的，还应提交股东大会审议。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第一百一十二条 董事会有权审批本章程第四十一条规定的应由股东大会批准以外的其他对外担保事项及借款事项。

董事会决定对外担保时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。

第一百一十三条 董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）行使法定代表人的职权；
- （四）提名公司总经理、董事会秘书；
- （五）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

(六) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

(七) 董事会授予的其他职权。

第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长代行其职权; 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次, 由董事长召集。

有下列情形之一的, 董事长应当在接到提议后 10 日内召集临时董事会会议:

(一) 代表公司十分之一以上表决权的股东提议;

(二) 三分之一以上的董事联名提议;

(三) 监事会提议;

(四) 董事长认为必要;

(五) 二分之一以上独立董事提议;

(六) 总经理提议;

(七) 监管部门要求召开;

(八) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定的其他情形。

第一百一十六条 召开定期董事会会议, 应当于会议召开 10 日前书面通知全体董事和监事; 召开临时董事会会议, 应当于会议召开 5 日前通知全体董事。有紧急事项时, 经全体董事的过半数同意, 召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制, 但应在合理时限内发出通知。

第一百一十七条 董事会会议通知按以下形式发出:

(一) 定期会议应以书面形式通知, 书面通知包括以专人送出的邮件、挂号邮件、传真、电报、电子邮件等方式;

(二) 临时会议原则上以书面形式通知, 如时间紧急, 可以电话通知, 事后补送书面通知。

第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容:

(一) 会议召开时间和地点;

(二) 会议的召开方式;

(三) 拟审议的事项 (会议提案);

- (四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;
- (五) 董事表决所必须的会议材料;
- (六) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;
- (七) 联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开临时董事会会议的说明。

第一百一十九条 董事会会议原则上应当以现场会议的方式进行。在保障董事充分表达意见的前提下,可以采取电话会议、视频会议等方式进行。临时董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用书面传签的方式进行并作出决议,并由参会董事签字。

第一百二十条 董事会会议应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

一名董事不得接受超过两名董事的委托,董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。

董事会会议可采取举手、口头或记名投票的方式进行表决。董事会决议的表决,实行一人一票。

第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。

第一百二十三条 董事会应将会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。

第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容:

- (一) 会议届次和召开的时间、地点、方式;
- (二) 会议通知的发出情况;
- (三) 会议召集人和主持人;
- (四) 董事亲自出席和受托出席的情况;
- (五) 会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;
- (六) 每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);
- (七) 与会董事认为应当记载的其他事项。

第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

公司设财务负责人1名,由董事会聘任或解聘。公司可以设副总经理、协理,由总经理提名,并由董事会聘任或解聘。

第一百二十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。

本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)至(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

第一百二十八条 总经理和其他高级管理人员任期3年,连聘可以连任。

第一百二十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权:

- (一) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
- (四) 拟订公司的基本管理制度;
- (五) 制定公司的具体规章;

- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、协理等其他高级管理人员，董事会秘书除外；
- (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
- (八) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定的或股东大会、董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第一百三十条 公司应当制定总经理工作制度，报董事会批准后实施。

总经理工作制度包括下列内容：

- (一) 总经理会议召开的条件、程序和参会的人员；
- (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- (三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- (四) 董事会认为必要的其他事项。

第一百三十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第一百三十二条 副总经理、协理等高级管理人员行使下列职权：

- (一) 协助总经理进行经营管理；
- (二) 负责分管范围内的工作；
- (三) 总经理因故不能履行职责时，根据总经理授权代行总经理职务；
- (四) 总经理授予的其他职权。

第一百三十三条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件的保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程的有关规定。

第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百三十六条 监事应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百三十七条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

第一百三十八条 监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定，履行监事职务。

第一百三十九条 监事应当保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第一百四十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百四十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百四十二条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节 监事会

第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例

不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百四十四条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托公司其他监事代为出席。监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东代表担任的监事由股东大会予以撤换，公司职工代表担任的监事由职工代表大会、职工大会或者其他形式予以撤换。

第一百四十五条 监事会行使下列职权：

- (一) 应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (二) 检查公司财务；
- (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (五) 提议召开股东大会，在董事会不能履行或不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (六) 向股东大会提出提案；
- (七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第一百四十六条 监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议。定期监事会会议每6个月至少召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议。

召开定期监事会会议，应当于会议召开10日前书面通知全体董事和监事；召开临时监事会会议，应当于会议召开5日前通知全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会会议可采取举手、口头或记名投票的方式进行表决。监事会决议的表决，实行一人一票。

第一百四十七条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

第一百四十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。

第一百四十九条 书面的监事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议召开时间和地点；
- (二) 拟审议的事项（会议提案）；
- (三) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面建议；
- (四) 监事表决所必需的会议材料；
- (五) 监事应当亲自出席会议的要求；
- (六) 联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开临时监事会会议的说明。

第八章 党组织

第一百五十条 公司根据《党章》规定，设立合肥晶合集成电路股份有限公司委员会，设党委书记1名，党委委员若干名。党委书记担任公司董事，参加董事会，主抓企业党建工作。

第一百五十一条 建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织机构配置、人员编制纳入公司管理机构的编制，党组织的工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第一百五十二条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责。

- (1) 坚持全面从严治党，依据《党章》和其他党内法规开展工作。
- (2) 保障监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织有

关重要工作安排。

- (3) 支持股东、董事会、监事、经理层依法行使职权。
- (4) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
- (5) 研究部署企业党的建设工，加强党组织的自身建设。领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等工作。

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百五十三条 公司依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定进行编制。

第一百五十五条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产不以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

第一百五十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百五十九条 公司结合自身的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要,建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

公司利润分配政策为:

- (一) 公司利润分配不得超过累计可分配利润,不得损害公司持续经营能力;
- (二) 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、行政法规、部门规章、规范性文件允许的其他方式分配利润;在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配;
- (三) 公司拟实施现金分红的,应同时满足以下条件:
 1. 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
 2. 公司累计可供分配利润为正值;
 3. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
 4. 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);重大投资计划或重大现金支出指:公司未来12个月内拟建设项目、

对外投资、收购资产或者购买设备等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的【10%】且绝对金额超过【5,000】万元；或公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的【5%】。

- (四) 在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红；
- (五) 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足前述现金分红条件情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的按照合并财务报表口径的可分配利润的【10】%；
- (六) 公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
 2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
 3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

公司进行利润分配应履行下述决策程序：

- (一) 公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；
- (二) 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

- (三) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；
- (四) 在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；
- (五) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；
- (六) 股东大会应根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，需要事先征求独立董事及监事会意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

第二节 内部审计

第一百六十条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百六十一条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节 会计师事务所的聘任

第一百六十二条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以

续聘。

第一百六十三条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

第一百六十四条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第一百六十五条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百六十六条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前10日事先通知会计师事务所，股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第一百六十七条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

第一百六十八条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第一百六十九条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。

公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百七十条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内予以公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第一百七十一条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第二节 解散和清算

第一百七十二条 公司因下列原因解散:

- (一) 本章程规定的解散事由出现;
- (二) 股东大会决议解散;
- (三) 因公司合并或者分立需要解散;
- (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
- (五) 公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。

第一百七十三条 公司有本章程第一百七十二条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。

第一百七十四条 公司因本章程第一百七十二条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组,开始清算。清算组由董事会或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以向人民法院申请指定有关人员组成清算组进行清算。

因本章程第一百七十二条第(三)项规定而解散的,清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。

第一百七十五条 清算组在清算期间行使下列职权:

- (一) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- (二) 通知、公告债权人；
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；
- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- (五) 清理债权、债务；
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第一百七十六条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第一百七十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，赔偿或者给付保险金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

第一百七十八条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送国家工商行政管理部门，申请注销公司登记，公告公司终止。

第一百七十九条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百八十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第一百八十一条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第十一章 通知

第一节 通知

第一百八十二条 公司的通知以下列形式发出：

- (一) 以专人送出；
- (二) 以邮件方式送出；
- (三) 以公告方式发出；
- (四) 本章程规定的其他形式。

第一百八十三条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。公司召开股东大会的会议通知，以公告进行。公司召开董事会的会议通知，以第一百八十四条规定的方式进行。公司召开监事会的会议通知，以第一百八十四条规定的方式进行。

第一百八十四条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以传真机确认的日期为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，以电子邮件发出时确认的日期为送达日期；公司以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

第一百八十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第二节 公告

第一百八十六条 公司根据监管机构要求指定《中国证券报》等至少一家指定报刊以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第十二章 修改章程

第一百八十七条 有下列情形之一的，公司应当修改本章程：

- (一) 《公司法》或有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件修改后，本章程规定的事项与修改后的法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定相抵触；
- (二) 公司的情况发生变化，与本章程记载的事项不一致；
- (三) 股东大会决定修改本章程。

第一百八十八条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第一百八十九条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

第一百九十条 章程修改事项属于法律、行政法规、部门规章及规范性文件要求披露的信息，按规定予以公告。

第十三章 附则

第一百九十一条 释义：

- (一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
- (二) 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
- (三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第一百九十二条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”、“过”不含本数。

第一百九十三条 本章程由公司董事会负责解释。

第一百九十四条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

第一百九十五条 本章程自公司股东大会审议通过，并自公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市之日起生效。

第一百九十六条 本章程未尽事宜或本章程与中国（为本章程之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，下同）法律、行政法规、部门规章及规范性文件的强制性规定发生冲突，则以中国法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定为准。

（以下无正文，为《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》之签字盖章页）



中国证券监督管理委员会

证监许可〔2022〕954号

关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复

合肥晶合集成电路股份有限公司：

中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》和《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令第174号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批复如下：

- 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
 - 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
 - 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
 - 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发
-

生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

